



股票代碼：3374

精材科技股份有限公司 Xintec Inc. 公開說明書

(現金增資發行新股辦理上櫃前公開承銷暨股票初次上櫃用)

一、公司名稱：精材科技股份有限公司

二、本公開說明書編印目的：現金增資發行新股辦理上櫃前公開承銷暨股票初次上櫃用

(一)新股來源：現金增資。

(二)新股種類：記名式普通股，每股面額新台幣 10 元。

(三)股數：本公司原股數 238,286,881 股(含尚未辦理變更登記已執行之員工認股權憑 166,200 股)，加計本次現金增資 30,000,000 股，共計 268,286,881 股。

(四)金額：本公司原實收資本額新台幣 2,382,868,810 元整(含尚未辦理變更登記已執行之員工認股權憑證 1,662,000 元)，加計本次現金增資新台幣 300,000,000 元整，共計新台幣 2,682,868,810 元。

(五)發行條件：

1.現金增資發行新股30,000,000股，每股面額新台幣10元，發行價格為每股新台幣42元，募集資金總額為新台幣1,260,000,000元。

2.本次增資依公司法第267條規定，保留增資發行新股15%計4,500,000股予本公司員工認購，本次員工認購不足或放棄部分，授權董事長洽特定人認購之；其餘85%計25,500,000股係委由推薦證券商辦理對外公開承銷。

3.本次現金增資發行新股之權利義務，與原發行之普通股相同。

(五)公開承銷比例：本次現金增資發行新股之 85%，計 25,500,000 股。

(六)承銷及配售方式：以詢價圈購及公開申購方式辦理承銷。

三、本次資金運用計畫之用途及預計可能產生效益之概要：請詳閱本公開說明書第100頁。

四、本次發行之相關費用

(一)承銷費用：包括上櫃輔導費及承銷手續費等費用，新台幣伍佰萬元。

(二)上櫃審查費：新台幣伍拾萬元。

(三)其他費用：包括會計師公費、律師公費及印刷等其他費用，合計約新台幣壹佰陸拾萬元。

五、有價證券之生效，不得藉以作為證實申報事項或保證證券價值之宣傳。

六、本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開說明書上簽名或蓋章者依法負責。

七、投資人投資前應至金融監督管理委員會指定之資訊申報網站詳閱公開說明書之內容，並應注意本公司之風險事項，請參閱本公開說明書第 46 頁至第 51 頁。

八、本公開說明書，適用於初次申請股票櫃檯買賣，並計劃以現金增資發行新股委託推薦證券商辦理上櫃前之公開銷售。

九、本公開說明書，適用於初次申請股票櫃檯買賣，掛牌後首五個交易日無漲跌幅之限制，投資人應注意交易之風險。

十、本次現金增資所發行之股票，為因應證券市場價格之變動，證券承銷商必要時得依規定進行安定操作。

十一、查詢本公開說明書之網址：<http://mops.twse.com.tw>。

精材科技股份有限公司 編製

中華民國一〇四年三月二十三日 刊印



本公司申請已公開發行普通股238,050,781股上櫃乙案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」審查後，並以104年2月2日證櫃審字第10401001581號函同意俟本次現金增資發行新股公開銷售完畢後，列為上櫃股票。另本公司於申請上櫃後至股票掛牌前，因已執行員工認股權憑證而新增之股數為236,100股。本次辦理現金增資發行普通股30,000,000股，每股面額10元，總額新台幣300,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年2月25日證櫃審字第1040003140號函准予申報生效，經本次辦理現金增資後實收資本額為新台幣2,682,868,810元。

一、本次發行前實收資本之來源：

單位：新台幣元

實收資本來源	金額	占實收資本額之比例
創立資本	216,000,000	9.07%
技術股	64,000,000	2.69%
現金增資	1,825,260,000	76.65%
盈餘轉增資	192,877,910	8.10%
員工認股權行使	83,068,900	3.49%
合計	2,381,206,810	100.00%

註：截至公開說明書刊印日止流通在外股數為2,382,868,810元，其中未完成變更登記之員工認股權憑證為1,662,000元。

二、公開說明書之分送計畫：

(一)陳列處所：依規定函送有關單位外，另陳列於本公司以供查閱。

(二)分送方式：依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定辦理。

(三)索取方式：請至公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw> 查詢及下載。

三、證券承銷商之名稱、地址、網址及電話：

名稱：凱基證券股份有限公司

網址：<http://www.kgi.com.tw>

地址：台北市明水路700號3樓

電話：(02)2181-8888

名稱：第一金證券股份有限公司

網址：<http://www.ftsi.com.tw>

地址：台北市長安東路一段22號4樓

電話：(02)2563-6262

名稱：元富證券股份有限公司

網址：<http://www.masterlink.com.tw>

地址：台北市敦化南路二段97號22樓

電話：(02)2325-5818

名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司

網址：<http://www.entrust.com.tw>

地址：台北市民生東路四段54號5樓

電話：(02)2545-6888

名稱：國泰綜合證券股份有限公司

網址：<http://www.cathayholdings.com>

地址：台北市敦化南路二段333號20樓

電話：(02)2326-9888

四、公司債保證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

五、公司債受託機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

六、股票或公司債簽證機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

七、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：

名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

網址：<http://www.taishinbank.com.tw>

地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓

電話：(02)2504-8125

八、信用評等機構之名稱、地址、網址及電話：不適用。

九、公司債簽證會計師及律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：不適用。

十、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

會計師姓名：林鴻鵬、黃裕峰會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

網址：<http://www.deloitte.com>

地址：台北市民生東路三段156號12樓

電話：(02)2545-9988

十一、複核律師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：

律師姓名：邱雅文律師

事務所名稱：翰辰法律事務所

網址：<http://www.fsi-law.com>

地址：台北市大安區敦化南路一段216號4樓

電話：(02)2715-9918

十二、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：

發言人姓名：林中安

代理發言人姓名：林恕敏

職稱：副總經理

職稱：財務協理

電話：(03) 433-1818

電話：(03) 433-1818

電子郵件信箱：invest@xintec.com.tw

電子郵件信箱：invest@xintec.com.tw

十三、公司網址：<http://www.xintec.com.tw>

精材科技股份有限公司

產業、營運及其他重要風險因素

一、 產業風險

(一)終端產品生命週期短，平均售價下滑

產品替代性高，在眾多競爭者同時分食市場大餅的情況下，競爭激烈，使得價格下跌快速，產品利潤薄。

因應對策：

因應電子產業及半導體產業市場與其技術的不斷變化，本公司的競爭利基為持續開發先進製程與新衍生技術，強化與關鍵客戶合作並整合上游產業龍頭技術，提供客戶高附加價值之封裝解決方案，並確保客戶產品即時導入市場，持續精進製造管理以提高生產力並降低營運成本，進而提升或維持利潤。

(二)中國大力扶植本土半導體產業

中國政府重金支持半導體先進製程技術之開發包含 IC 設計、晶圓代工、封裝測試乃至設備研發等產業，藉由資金的挹助，降低市場價格，以掠奪市場佔有率及人才獵取。

因應對策：

聚焦發展先進晶圓層級封裝，因應各種功能應用來達到產品差異化的效果，導入自動化設備，提升產能及品質，並有效降低成本。選擇及轉進利基應用市場，包括綠能、醫療及車用電子等領域。對於類比、感測器等晶片出現高度需求，同時強力佈局專利地圖，以提升並拉大競爭力之差異化。

二、 營運風險

(一)研發與工程人員流失之風險

本公司專注於研發不同感測器的先進封裝解決方案，包括各式 3D 晶圓級封裝等，成功的應用於光學、微機電及指紋辨識等產品，均為公司辛勤研發之成果，產品的效能亦領先全球同性質的廠商，故培養出具有高素質 3D 封裝專長之研發人員，以提升研發成果及產品競爭力為主要訴求，而研發人員之異動將對本公司營運產生影響。

因應措施：

本公司除了加強研發人員之專業訓練以強化其開發及行銷能力、提供各項優渥福利措施以吸引及留住人才外，提供一個公平、健全及追求創新研發成就導向的優良的工作環境，並實施員工認股機制，使員工成為股東，分享公司獲利成果，亦積極推動公司上櫃，以延攬更多優秀人才，進而促進技術層次之提升。

三、 其他重要風險

請詳本公開說明書第 46~51 頁。

精材科技股份有限公司公開說明書摘要

實收資本額：新台幣 2,382,868,810 元		公司地址：桃園市中壢區吉林路 23 號 9 樓		電話：(03)433-1818	
設立日期：87 年 9 月 11 日			網址：http://www.xintec.com.tw		
上市日期：不適用		上櫃日期：不適用		公開發行日期：92 年 12 月 29 日	
管理股票日期：不適用					
負責人：董事長：台灣積體電路製造(股)公司代表人 關欣 總經理：關欣		發言人：林中安 職稱：副總經理 代理發言人：林恕敏 職稱：財務協理			
股票過戶機構：台新國際商業銀行(股)公司股務代理部		電話：(02)2504-8125 網址：http://www.taishinbank.com.tw 地址：台北市中山區建國北路一段 96 號地下一樓			
股票承銷機構：凱基證券股份有限公司		電話：(02)2181-8888 網址：http://www.kgi.com.tw 地址：台北市明水路 700 號 3 樓			
第一金證券股份有限公司		電話：(02)2563-6262 網址：http://www.ftsi.com.tw 地址：台北市長安東路一段 22 號 4 樓			
元富證券股份有限公司		電話：(02)2325-5818 網址：http://www.masterlink.com.tw 地址：台北市敦化南路二段 97 號 22 樓			
華南永昌綜合證券股份有限公司		電話：(02)2545-6888 網址：http://www.entrust.com.tw 地址：台北市民生東路四段 54 號 5 樓			
國泰綜合證券股份有限公司		電話：(02)2326-9888 網址：http://www.cathayholdings.com 地址：台北市敦化南路二段 333 號 20 樓			
最近年度簽證會計師：勤業眾信聯合會計師事務所 林鴻鵬、黃裕峰會計師		電話：(02)2545-9988 網址：http://www.deloitte.com 地址：台北市民生東路三段 156 號 12 樓			
複核律師：翰辰法律事務所 邱雅文律師		電話：(02)2715-9918 網址：http://www.fsi-law.com 地址：台北市大安區敦化南路一段 216 號 4 樓			
信用評等機構：不適用		電話：不適用 網址：不適用 地址：不適用			
評 等 標 的	發行公司：不適用		無■ ； 有□，評等日期：		評等等級：
	本次發行公司債：不適用		無■ ； 有□，評等日期：		評等等級：
董事選任日期：102 年 6 月 13 日，任期：3 年			監察人選任日期：不適用(本公司採審計委員制)		
全體董事持股比例：43.96%(104 年 3 月 23 日)			全體監察人持股比率：不適用		
董事、監察人及持股 10% 以上股東及其持股比例：(104 年 3 月 23 日)					
職 稱	姓 名	持 股 比 例	職 稱	姓 名	持 股 比 例
董 事 長	關欣 台灣積體電路製造(股)公司代表人	39.85%	獨立董事	王文宇	0%
董 事	何麗梅 台灣積體電路製造(股)公司代表人	39.85%	獨立董事	徐中時	0%
董 事	林錦坤 台灣積體電路製造(股)公司代表人	39.85%	獨立董事	謝徽榮	0%
董 事	Hongli Yang 台灣豪威投資控股(股)公司代表人	4.12%	大 股 東	英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company	15.63%
工廠地址：Line-A：桃園市中壢區吉林路 25 號 Line-B：桃園市中壢區自強二路 1 號 Line-C：桃園市中壢區中園路 188 號			電話：(03) 433-1818 (03) 433-1818 (03) 433-1818		
主要產品：晶圓級尺寸封裝及晶圓級後護層封裝 市場結構(103 年度)：內銷 42%；外銷 58%					參閱本文之頁次
					第 80 頁
風險事項：請參閱本公司說明書公司概況之風險事項					第 46~51 頁
去(103)年度	營業收入：4,934,078 仟元 稅前純益：628,653 仟元 每股盈餘(稅後)：2.65 元				第 109 頁
本次募集發行有價證券種類及金額：		請參閱公開說明書封面。			
發 行 條 件：		請參閱公開說明書封面。			
募集資金用途及預計產生效益概述：		請參閱公開說明書第 100 頁。			
主辦推薦證券商執行過額配售及價格穩定之相關資訊：		本公司與主辦推薦證券商簽訂過額配售協議書，協議相關事宜。			
本次公開說明書刊印日期：104 年 3 月 23 日		刊印目的：股票現金增資發行新股辦理上櫃前公開承銷暨股票初次上櫃用。			
其他重要事項之扼要說明及參閱本文之頁次：請參閱本公開說明書目錄。					

公開說明書目錄

壹、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃董事會暨審議委員會要求補充揭露事項 ..	1
一、於公開說明書揭露下列事項	1
二、推薦證券商評估報告中對該公司以下項目說明之評估意見	21
貳、公司概况	45
一、公司簡介	45
(一)設立日期	45
(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話	45
(三)公司沿革	45
二、風險事項	46
(一)風險因素	46
(二)訴訟或非訟事件	48
(三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響	51
(四)發行人於最近一會計年度或申請上櫃會計年度內，符合會計師查核簽證財務報表規則第二條之一第二項重要子公司標準之一者，或推薦證券商認為對發行人財務報告有重大影響者，應增列其風險事項說明	51
(五)外國發行人申請股票登錄興櫃或第一上櫃者，應增列敘明外國發行人註冊地國及主要營運地國之總體經濟、政經環境變動、相關法令、外匯管制及租稅，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項，並說明所採行之因應措施	51
(六)其他重要事項	51
三、公司組織	52
(一)組織系統	52
(二)關係企業圖	52
(三)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	53
(四)董事及監察人資料	54
(五)發起人	58
(六)董事、監察人、總經理及副總經理之酬金	59
(七)發行人之非董事，而實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營而實質指揮董事執行業務者，應增列敘明上開人士之姓名、經(學)歷、持有股份、目前兼任發行人及其他公司職務、並與發行人董事及監察人之關係及對發行人實質控制情形	62
四、資本及股份	63
(一)股份種類	63
(二)股本形成經過	63
(三)最近股權分散情形	64
(四)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料	69
(五)公司股利政策及執行狀況	69
(六)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響	69
(七)員工分紅及董事、監察人酬勞	70
(八)公司買回本公司股份情形	70
五、公司債(含海外公司債)辦理情形	70

六、特別股辦理情形.....	70
七、參與發行海外存託憑證之辦理情形.....	70
八、員工認股權憑證辦理情形.....	71
九、限制員工權利新股辦理情形限制員工權利新股辦理情形.....	73
十、併購辦理情形.....	73
十一、受讓他公司股份發行新股辦理情形、發行新股數尚在進行中者.....	73
參、營運概況.....	74
一、公司之經營.....	74
(一)業務內容.....	74
(二)市場及產銷概況.....	80
(三)最近二年度及截至公開說明書刊印日止從業員工人數.....	92
(四)環保支出資訊.....	92
(五)勞資關係.....	95
(六)公司及其子公司於申請上櫃年度及其前二年度如有委託單一加工工廠於年度內加工金額達五千萬元以上者，應揭露該加工工廠之名稱、地址、電話、董事成員、持股百分之十大股東及最近期財務報表.....	96
(七)有無爭訟事件，及勞資間關係有無尚須協調之處.....	96
(八)有無因應景氣變動之能力.....	96
(九)關係人間交易事項是否合理.....	96
(十)如其事業係屬生物技術工業、製藥工業或醫療儀器工業者，應增列其依法令取得主管機關許可進行人體臨床試驗或田間實驗者或在國內從事生物技術工業或醫療儀器工業研究發展，且已有生物技術或醫療儀器相關產品製造及銷售或提供技術服務之實績暨最近一年度產品及相關技術服務之營業額、研究發展費用所占本公司總營業額之比例情形.....	96
(十一)公司如於提出上櫃申請前一年度因調整事業經營，終止其部分事業，或已將其部分之事業獨立另設公司、移轉他公司或與他公司合併者，應分別予以記載說明其終止，移出或合併之事業暨目前存續之營業項目，並提出目前存續營業項目前一年度之營業額研究、發展費用占公司該年度總營業額之比例情形.....	97
二、不動產、廠房及設備及其他不動產.....	97
(一)自有資產.....	97
(二)租賃資產.....	97
(三)各生產工廠現況及最近二年度設備產能利用率.....	98
三、轉投資事業.....	98
(一)轉投資事業概況.....	98
(二)綜合持股比例.....	98
(三)上市或上櫃公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司財務績效及財務狀況之影響.....	98
(四)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，發生公司法第一百八十五條情事或有以部分營業、研發成果移轉子公司者，應揭露放棄子公司現金增資認購情形，認購相對人之名稱及其與公司、董事、監察人及持股比例超過百分之十股東之關係及認購股數.....	98

(五)已赴或擬赴大陸地區從事間接投資者，應增列該投資事業之名稱、地址、 電話、董事成員、持股百分之十大股東及最近期財務報表	98
四、重要契約.....	99
肆、發行計劃及執行情形.....	100
一、前次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計畫分析應記載 事項.....	100
二、本次現金增資、發行公司債、員工認股權憑證或限制員工權利新股計劃應記載 事項.....	100
三、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項.....	107
四、本次併購發行新股應記載事項.....	107
伍、財務概況.....	108
一、最近五年度簡明財務資料.....	108
(一)簡明資產負債表及綜合損益表.....	108
(二)影響上述財務報表作一致性比較之重要事項，如會計變動、公司合併或營 業部門停工及其發生對年度財務報表之影響.....	111
(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見.....	112
(四)財務分析.....	113
(五)會計科目重大變動說明.....	117
(六)本國發行人自公開發行後最近連續五年或外國發行人最近連續五年由相同 會計師查核簽證者，應增列說明未更換之原因、目前簽證會計師之獨立性 暨發行公司對強化會計師簽證獨立性之具體因應措施.....	117
(七)外國發行人申請股票登錄興櫃者，得僅列示最近二年度之財務資料；外國 發行人申請股票第一上櫃者，得僅列示最近三年度之財務資料.....	117
二、財務報表應記載事項.....	118
(一)發行人申報募集發行有價證券時之最近兩年度財務報告及會計師查核報 告，並應加列最近一季依法公告申報之財務報告.....	118
(二)最近二年度發行人經會計師查核簽證之年度個體財務報告.....	118
(三)發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，如有最近期 經會計師查核簽證或核閱之財務報告及個體財務報告.....	118
三、財務概況其他重要事項應記載事項.....	118
(一)公司及其關係企業最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財 務週轉困難情事，應列明其對公司財務狀況之影響.....	118
(二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條 情事者，應揭露資訊.....	118
(三)期後事項.....	118
(四)其他.....	118
四、財務狀況及經營結果檢討分析.....	119
(一)財務狀況.....	119
(二)財務績效.....	120
(三)現金流量.....	121
(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響.....	121
(五)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投 資計劃.....	121
(六)其他重要事項.....	121

陸、特別記載事項.....	122
一、內部控制制度執行狀況	122
(一)最近三年度會計師提出之內部控制改進建議	122
(二)最近三年度內部稽核發現重大缺失之改善情形	122
(三)內部控制聲明書	122
(四)委託會計師專案審查內部控制之審查報告	122
二、委託經金融監督管理委員會核准或認可之信用評等機構進行評等者，應揭露該信用評等機構所出具之評等報告.....	122
三、證券承銷商評估總結意見	122
四、律師法律意見書	122
五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見	122
六、前次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經金融監督管理委員會證券期貨局通知應自行改進事項之改進情形.....	122
七、本次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時，經金融監督管理委員會證券期貨局通知應補充揭露之事項.....	122
八、公司初次上市、上櫃或前次及最近三年度申報(請)募集與發行有價證券時，於公開說明書中揭露之聲明書或承諾事項及其目前執行情形.....	122
九、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容.....	122
十、最近年度及截至公開說明書刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失及改善情形	122
十一、本國發行人自行評估內部控制制度作成之內部控制聲明書及委託會計師進行專案審查取具之報告書.....	122
十二、發行人及其聯屬公司各出具之財務業務往來無非常規交易情事之書面承諾，及其重要業務之政策	122
十三、發行人是否有與其他公司共同使用申請貸款額度.....	122
十四、發行人有無因非正當理由仍有大量資金貸與他人.....	122
十五、發行人申請公司債上櫃者，其公司債本金及利息償還之資金來源，暨發行標的或保證金融機構之信用評等等級，評等理由及評等展望等信用評等結果 ..	122
十六、發行人有證券櫃檯買賣中心審查準則第十條第一項第四款或外國審查準則第九條第一項第三款情事者，應將該重大未改善之非常規交易詳細內容及處理情形充分揭露，並提報股東會.....	122
十七、充分揭露發行人與證券承銷商共同訂定承銷價格之依據及方式.....	122
十八、發行人分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至且採內含價值法之員工認股權憑證，於股票上櫃後所產生之費用對財務報表可能之影響	122
十九、其他基於相關規定出具之書面承諾或聲明.....	123
二十、證券承銷商、發行人及其董事、監察人、總經理、財務或會計主管以及與本次申報募集發行有價證券案件有關之經理人等人出具不得退還或收取承銷相關費用之聲明書	123
二十一、發行人辦理現金增資或募集具股權性質之公司債，並採詢價圈購對外公開承銷之案件，證券承銷商及發行人等出具不得配售予關係人及內部人等對	

象之聲明書	123
二十二、其他必要補充說明事項	123
二十三、上市上櫃公司之公司治理運作情形	123
柒、重要決議、公司章程及相關法規	136
一、與本次發行有關之決議文	136
二、未來股利發放政策	136
三、截至公開說明書刊印日止之背書保證相關資訊	136
附件：	
一、股票初次上櫃證券承銷商評估報告	
二、現金增資發行新股證券承銷商評估報告	
三、承銷價格計算書	

壹、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃董事會暨審議委員會要求補充揭露事項

一、於公開說明書揭露下列事項

(一)風險事項乙節

- 1.本公司之銷售客戶 OVTI 集團最近三年度營收占比分別為 40.17%、37.13%及 28.90%，OVTI 集團於 103 年 8 月中接獲北京清芯華創投資管理有限公司(Hua Capital Management)和上海浦東科技投資有限公司等所組成財團主導之收購邀約，有關此一收購案對未來財務業務之影響及所採行具體因應措施之說明。

公司說明

(1) OVTI 集團背景

OmniVision Technologies, Inc.(以下簡稱 OVTI 集團)成立於 84 年，總部位於美國加州，在全球 12 個國家設有 19 個據點，103 年 10 月 31 日淨值約為 10.8 億美金，創辦人為 Shaw Hong(洪筱英)，背後股東多為投顧公司及避險基金，OVTI 集團為本公司之主要銷售客戶，且透過台灣豪威投資(股)公司(以下簡稱台灣豪威)及英屬蓋曼群島 VisEra Holding Company(以下簡稱 VisEra)分別直接及間接持有本公司 4.12%及 7.68%之股份，綜合持股為 11.80%，其中，台灣豪威為本公司之法人董事，VisEra 為 OVTI 集團與台積電及日本上市公司 Dai Nippon Printing Co., Ltd.合資成立，故 VisEra 亦為本公司之大股東。

(2)欲併購 OVTI 集團者之基本資料

A. OVTI 集團係於 103 年 8 月 14 日(美國時間)發佈其接獲中國北京清芯華創投資管理有限公司(Hua Capital Management Ltd.，以下簡稱華創投資)及上海浦東科技投資有限公司(以下稱浦東科技)所組成之財團之現金收購邀約(以每股價格 29 美元收購 OVTI 集團全部股權，折合新台幣約 500 億元)。

B. 欲併購公司之基本資料如下：

a. 華創投資：

I. 華創投資業經北京市積體電路產業發展股權投資基金遴選為設計和封測基金之管理公司(該基金由中國國家發展和改革委員會、工業和信息化部與北京市政府共同成立)，故華創投資係為中國國家級晶片產業扶持的代表基金之一。

II. 華創投資成立於 103 年 6 月，係由中國資深半導體投資團隊為首，清華控股有限公司和中芯聚源股權投資管理(上海)有限公司共同組建之投資公司。

III. 主要營業項目係對於積體電路產業及上下游的投資，專注於發現行業內早期、成長期和成熟期的科技公司，深入挖掘企業的成長潛力與競爭優勢，通過專業化的運營管理，給予被投企業全面的增值服務。

b. 浦東科技：

I. 浦東科技成立於 88 年 6 月，為中國浦東新區政府之國有獨資公司。

II. 目前主要業務涵蓋直接投資、併購投資、品牌運作、母基金管理、債權投資等領域。

C. 併購原因

依據媒體報導，北京政府於 102 年底宣布成立規模人民幣 300 億元北京市積體電路產業發展股權投資基金扶植半導體，該基金係為加速產業升級，投資重點涵蓋半導體設備、IC 設計、製造、封裝等產業。由於半導體產業是日韓的經濟命脈，中國無法從中獲得相關業務，因此，華創投資收購 OVTI 集團，可視為中國晶片製造發展的突破口。故若併購交易順利完成，將對中國晶圓製造、封裝、相機模組、智慧型手機等產業鏈環節都有重大提振作用。

D. 目前此收購案進度

自 103 年 8 月 14 日 OVTI 集團網站公告收到華創投資及浦東科技之非約束性收購邀約後截至目前為止尚未有進一步訊息，若有進一步消息隨時更新。

(3) 併購案若成立，對本公司財務業務之影響

A. 本公司歷年對 OVTI 集團的營收獲利狀況

本公司主要提供 OVTI 集團產品項目為影像感測器封裝產品，100~103 年度 OVTI 集團佔對本公司營收比重分別為 47.33%、40.17%、37.13%及 28.90%，在 100 年~102 年為本公司銷售額第一大客戶，103 年為第二大客戶，故有銷貨集中之情形。以下茲就銷貨集中之原因、對財務業務之影響、因應措施及分散銷貨集中風險之成效評估如下：

a. 銷貨集中之原因

OVTI 集團(美國 NASDAQ：OVTI)成立於 84 年，主要營業項目為影像感測器元件之設計、研發及市場銷售，為全球影像感測器元件領導供應商，全球市佔率高達三成。本公司與 OVTI 集團之交易始於 92 年，係提供 OVTI 集團 3D 晶圓級尺寸封裝服務，93 年度起 OVTI 集團將其影像感測器交由本公司封裝，且由於 OVTI 集團在全球市佔率較高，導致其可提供之訂單量亦較多。

b. 對本公司財務業務之影響

本公司 100~103 年度對 OVTI 集團銷貨金額分別為 1,829,969 仟元、1,261,163 仟元、1,580,579 仟元及 1,425,860 仟元。因 101 年度全球景氣尚非明朗，影響半導體市場及其產業鏈之相關需求，致晶圓級尺寸封裝服務需求下滑，而 101 年度 OVTI 集團 CSP 使用需求降低，故減少對本公司之下單。

102 年度在影像感測器畫素隨著手機前鏡頭由 VGA 進階至 1~200 萬畫素(畫素提高需藉由感測器元件尺寸放大)，帶動晶圓數量需求成長，加上 OVTI 集團將重心移回中國大陸手機市場，並持續委託本公司進行影像感測器封裝，致晶圓級尺寸封裝(CSP)毛利率較 101 年回升。

103 年則因 OVTI 集團調整產品組合需求，逐漸增加 12 吋晶圓級尺寸封裝訂單並增加採用 COB 封裝方式之需求，故調整對本公司之訂單，103 年整體晶圓級尺寸封裝銷售數量為 317 仟片低於 102 年的 370 仟片(減少 14.3%)，故 103 年之毛利率 7.41%較 102 年度下滑。

本公司近年於晶圓級後護層封裝業務上則大有進展，因指紋辨識封裝業務(102 年下半年)之成功導入智慧型行動裝置品牌市場，晶圓級後護

層封裝營業收入由 101 年度的 248,757 仟元(佔總營收 7.92%)快速成長，至 103 年之營收為 1,879,970 仟元(佔總營收 38.10%)，毛利金額亦由 101 年度的 78,389 仟元，至 103 年毛利金額達 712,899 仟元。

綜前所述，OVTI 集團之訂單因產業特性，對本公司之營收與獲利仍具相當之影響，惟本公司對其銷貨集中度逐年下降，由 100 年度之 47.33%下降至 103 年之 28.90%，且經評估下述原因，OVTI 集團於短期流失之機率應屬有限，此外，本公司已於 103 年開始建置 12 吋晶圓級封裝生產線，應可滿足 OVTI 等客戶訂單需求，並持續在晶圓級尺寸封裝服務開發其他客戶，且透過晶圓級後護層封裝業務的拓展，在降低與分散單一產品封裝服務的風險已有顯著成效，故本公司 100~103 年度銷貨集中於 OVTI 集團對財務業務之影響尚稱允當。

c. 產品日新月異，技術涵量影響客戶依存度

本公司使用之 3D 晶圓級尺寸封裝技術受到 ShellCase 之專利保護，本公司業已依所簽契約(89 年簽訂)，按時支付權利金予 ShellCase，故一般公司進入 3D 晶圓級尺寸封裝具一定門檻。本公司與 OVTI 集團為長期合作夥伴，品質及服務深受信賴，OVTI 集團每更換一次產品設計或調整封裝製程，均需經過一定時間及成本支出以進行產品功能及可靠度測試驗證，在半導體供應鏈相關認證均屬嚴格之情況下，將造成 OVTI 集團更換封裝廠成本增加，另因競爭者在短期內投資封裝設備及取得技術認證均屬不易，經評估 OVTI 對本公司尚有一定依存度。

d. 訂單需大量生產始能達成規模經濟之效益

由於不同銷售客戶之 IC 設計，其所要求之晶圓封裝性能均不同，本公司與 OVTI 集團合作多年，影像感測器之封裝儼然已為本公司之完整標準封裝產品，且因本公司之半導體封裝製程設備具有一定之共用性，當銷售客戶訂單數量大，又為連續生產下，有利於擴大產量，提高產能利用率，故對本公司而言，訂單需求數量大的訂單將具有規模經濟效益。且由於本公司在 3D 晶圓級尺寸封裝產業中為目前產能最大之供應商(目前主要以 8 吋晶圓封裝為主)，故在產品規模、品質、良率及交期均能配合 OVTI 集團之需求供貨；且本公司並為配合銷售客戶及市場需求趨勢，除持續提供最大 8 吋生產產能外，亦已於 103 年佈局 12 吋晶圓級尺寸封裝領域，以符合未來趨勢。

B. 本公司之因應措施及分散銷貨集中風險之成效

a. 開發新客戶

本公司銷貨集中於 OVTI 集團之因應措施除持續強化與該客戶之良好關係外，並積極拓展新封裝服務、新市場及新客戶。本公司以自身優質技術承接其他客戶之訂單，致使 OVTI 集團占本公司營收比重逐年下滑至 103 年之 28.90%，銷貨集中情形呈現明顯下降趨勢。

b. 拓展新產品

本公司除深耕於 3D 晶圓級尺寸之封裝技術領域之研究外，為強化競爭力亦持續開發晶圓後護層封裝技術，本公司於 102 年下半年成功取得終端客戶指紋辨識感測器之封裝訂單，且至 102 年 6 月起開始出貨且 8 月已量產，102 年度及 103 年本公司透過 turnkey service 銷售予台積電於

晶圓後護層封裝技術之金額分別為 862,283 仟元及 1,732,290 仟元，本公司對台積電之銷售已明顯增加。另外，本公司封裝之產品終端應用領域以手機、筆記型電腦及平板電腦等消費性電子產品為主，由於消費性電子產品推陳出新且生命週期短，亦受景氣波動之影響，故本公司亦逐步將產品之應用由消費性電子產品進而推展應用至汽車電子產業。

c. 與客戶共同研究開發，加強客戶依存度

由於影像感測器之產品(較為成熟)客戶(例如：OVTI 集團)已多具有管理供應鏈(包括晶圓代工、彩色濾光片、晶圓重組(Reconstruct wafer)、3D CSP、測試等)之能力。因此，客戶傾向直接與本公司合作開發，以有效降低營運成本，使客戶更有誘因持續與本公司交易往來。

綜上所述，該併購案短期內並對本公司之財務業務尚無重大影響，且以現有台灣從上游半導體晶圓代工、彩色濾光薄膜及微透鏡代工，乃至於本公司之晶圓級封裝業務，相較於其他市場(如例：中國)既有供應鏈，在產能、技術、客戶服務仍具相當競爭優勢。然而，全球半導體供應鏈的競合未曾間歇，本公司將持續精進晶圓級相關先進製程技術之開發，未來期能將業務擴展至晶圓級系統整合封裝(System in Package)外，並建置 12 吋晶圓級封裝之產線，以因應高端感測器客戶之需求，希冀藉由封裝服務技術暨應用產品之多元化，增加新領域產品營收以及開發更多新客戶，並提供客戶最佳之封裝解決方案，在供應鏈中持續扮演其關鍵地位。

推薦證券商說明

(1) 目前此收購案進度

經檢視 OVTI 集團之官方網站(Corporate Release)，該公司於 103 年 8 月 14 日(美國時間)發佈其董事會接獲中國北京清芯華創投資管理有限公司(Hua Capital Management Ltd.)及上海浦東科技投資有限公司之現金收購邀約之訊息，另檢視 OVTI 集團於美國證管會(以下稱 SEC)申報之訊息，僅 103 年 8 月 18 日 OVTI 集團向 SEC 申報其於 103 年 8 月 12 日接獲前述公司之現金收購邀約，且董事會業已進行相關檢視及評估(並未做出任何決定)，並聘請 JP Morgan Securities LLC. 為其財務顧問、Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. 為法律顧問，惟截至目前尚無其他進度亦未在 SEC 有相關新申報之資訊，故此收購案是否會被 OVTI 集團董事會接受以及後續之收購進度皆尚未能確定。

(2) 該併購案對該公司財務業務影響之評估

A. 對 OVTI 集團銷售集中之原因及其合理性

該公司係提供 OVTI 集團 3D 晶圓級尺寸封裝服務，產品主要應用於手機、平板及筆記型電腦等。由於產業特性因素，該公司所提供的封裝服務係涉及 OVTI 集團之 IC 設計，需要在產品初期即與 OVTI 集團密切合作，在其封裝產品可靠度及產能等獲 OVTI 集團之認可後，93 年度起 OVTI 集團大量將其影像感測器交由該公司封裝，且由於 OVTI 集團在全球市佔率較高，導致其可提供之訂單量亦較多，在該公司新產品(新技術)及新客戶尚未開發階段，致該公司之銷貨有集中於 OVTI 集團之情形，其原因應屬合理。

B. 對財務業務影響之評估

OVTI 集團之終端產品市場因競爭激烈，故易有因客戶調整產品組合，進而對該公司之訂單量有所調整，可能造成該公司之營業收入及毛利受到影響。經檢視該公司依客戶別之銷貨明細表，並經訪談公司經營階層，以及抽核與發函客戶等評估程序，該公司之客戶確持續增加，且也有與許多客戶合作開發產品中，其業務拓展之計畫已逐漸展現成效中，且與既有客戶維持良好往來關係，降低因單一客戶調整產品組合造成之影響。此外，半導體產業具有更換廠商之成本較高之特性，對其他廠商而言具有較高之進入門檻，再加上該公司之專利技術截至 104 年 2 月底已取得台灣、中國、美國、日本及歐盟之專利共計 208 項，尚在申請中之專利共 422 項，其自行研發之衍生技術與研發成果卓然，且該公司之產品品質及良率、交期等多能使客戶滿意，故該公司過去之既有客戶除其本身之產品銷售狀況影響下單金額外，多年來其合作狀況尚稱穩定，該公司係有其競爭力。

綜上評估，該公司除緊密與現有客戶合作外，並積極開發新客戶，以降低銷貨集中之比率及風險。而該公司為 3D 晶圓級尺寸封裝供應商中產能最大者，目前市場上並無其他規模相當之廠商，且其所提供之封裝服務無論在產能、品質、良率及交期均滿足 OVTI 集團之客製化需求，加以更換供應商之時間、成本與風險過高，在終端產品市場汰換率高的情況下，OVTI 集團短期內選擇其他封裝廠商之可能性不高。又封裝產業進入門檻較高，同業投入 3D 晶圓級尺寸封裝，並成為足以影響該公司之競爭者的可能性不高。而該公司並為配合銷售客戶及市場需求趨勢，除持續提供最大 8 吋生產產能外，並於 103 年佈局 12 吋晶圓級封裝領域，故對該公司財務業務應不致產生重大影響。

C. 分散銷貨集中風險之成效

目前該公司已陸續開發諸多國際大廠之客戶，並已逐步將產品之應用由消費性電子產品進而提昇至汽車電子產業，且因指紋辨識感測器訂單挹注，自 102 年下半年起營收動能續強，均導致 OVTI 集團對該公司營收比重逐年下降，由此可見該公司藉由拓展產品應用範圍及客戶群以分散銷貨集中之風險已逐步顯現。

D. 若被收購成立，是否違反陸資持股規定董事席次中有一席陸資之影響

根據「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」所訂定之「大陸地區人民來臺投資許可辦法」(以下簡稱投資許可辦法)、「大陸地區人民來台投資業別項目」(以下稱投資項目)，OVTI 集團因持有該公司之直接與間接持股約為 11.81%，已高於投資許可辦法第 4 條第 1 項第 1 款規定「投資人依本辦法規定應申請許可之投資行為如下：一、持有臺灣地區公司或事業之股份或出資額。但不包括單次且累計投資均未達百分之十之上市、上櫃及興櫃公司股份。」之規定，故若收購案成立，則 OVTI 集團依規定應向投審會申請投資許可，此外，該公司所營項目係符合投資項目之正面表列營業項目第 26 項「電子零組件製造業-2613 半導體封裝及測試業」，惟需提出產業合作策略並經專案審查，且對投資事業不得具有控制力。本券商曾就其他上市櫃公司併購案例詢問相關單位，相關單位目前認為陸資股東在台資企業不宜有控制

力，故陸資應亦不宜擔任董事一職。該公司目前董事席次共計 7 席，台灣豪威(OVTI 集團子公司)僅占 1 席，若 OVTI 集團併購案確定後台灣豪威為配合主管機關要求而須辭任董事，尚不會達公司法第 201 條董事缺額達三分之一需立即召開股東會補選之條件，亦無違反該公司章程所列董事席次應有 5 至 7 席之規定，再依上櫃審查準則不宜條款第八條「申請公司之董事會成員應至少五席，其中獨立董事席次不得低於二席且不得少於董事席次五分之一。」評估，該董事之辭任亦無違反本款規定。

整體而言，基於 OVTI 集團是否接受收購邀約而成為陸資企業的可能性與時程均尚未確定，加以該公司已對後續可能面臨之議題備好適當應變措施，故針對 OVTI 集團轉換身份為陸資對該公司可能產生之影響尚無重大疑慮。

(3)不宜上櫃之具體認定標準第 1 條第 1 項第 2 款及第 11 條之評估

該併購案係該公司客戶 OVTI 集團發佈其董事會接獲中國北京清芯華創投資管理有限公司及上海浦東科技投資有限公司之收購邀約，惟截至目前為止 OVTI 集團並未有任何進一步之行動或公開說明，故該公司截至目前為止，財務業務尚未受該收購案之影響，且該公司業已針對銷貨集中之風險及因應措施亦有其評估及改善措施，並與晶圓代工、影像感測器 IC 設計、環境感測器 IC 設計、電源管理元件 IC 設計等各類半導體大廠交易，讓 OVTI 集團對該公司之財務業務影響逐漸降低，且該公司亦無遇有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計劃之重要內容，或退票，其結果足使公司之財務狀況有顯著重大之變更，而有影響市場秩序或損害公益之虞者而有違反不宜上櫃之具體認定標準第 1 條第 1 項第 2 款之情事。

該公司 103 年度營業收入及營業利益分別較 102 年度成長 15.91%及 77.50%，而 103 年度稅前淨利較 102 年度成長 89.22%，此外，該公司最近三個會計年度之營業收入分別為 3,139,385 仟元、4,256,761 仟元及 4,934,078 仟元，營業淨利(損失)分別為 (96,240)仟元、380,636 仟元及 675,630 仟元，最近三會計年度之稅前淨(損)益分別為(107,769)仟元、348,763 仟元及 659,926 仟元，均呈現連續成長情形者。且經蒐集相關產業資訊並與公司相關人員訪談，並未發現該公司所屬之產業有嚴重衰退及產品或技術過時之情事。綜上評估，該公司尚無營運狀況顯有重大衰退而有違反不宜上櫃之具體認定標準第 11 條所營事業嚴重衰退之情事。

2.本公司屬資本密集產業，有關新興產品未來發展趨勢對公司封裝技術需求改變，以及產能利用率不佳等可能造成虧損之風險及所採行具體因應措施之說明。

公司說明

IC 封裝業屬半導體產業鏈之後段製程，半導體產業與全球經濟景氣息息相關，本公司所封裝產品之終端應用領域，又以手機、筆記型電腦及平板電腦等消費性電子產品為主，亦受景氣波動之影響，而各家半導體晶圓製造廠陸續邁入更高階先進製程，封裝技術難度亦同步提高，所需投入之資本支出亦將增加，對於本公司來說亦是一大風險，因此，晶圓級封裝之投資風險為本公司所面臨之重要經營課題，尤其針對

此新興感測器產業之興起，本公司因應對策如下：

(1)佈建 12 吋影像感測器生產線

為因應封裝技術升級及預計現有產能不敷未來市場需求成長所需，本公司自 100 年迄 103 年度陸續通過佈建 12 吋廠之資本支出預算案，將以影像感測器產品為主。

(2)持續開發潛在客戶

本公司已耕耘半導體封裝服務領域多年，積極持續開發先進製程與新衍生技術，並已擁有百項國際專利之保護。本公司之銷售客戶多為關係良好且合作多年之國際大廠，包括影像感測器國際大廠、國內外半導體設計公司等，且對本公司之封裝技術及產品品質亦相當肯定。

(3)持續開發先進製程與新衍生技術

本公司耕耘影像感測器封裝供應鏈市場將近十年，影像感測器已然成為本公司之標準封裝服務，且本公司對影像感測器具有獨立開發客戶之能力，由於 12 吋 3D 晶圓級尺寸封裝技術為現有 8 吋 3D 晶圓級尺寸封裝技術之延續，未來將循同樣模式進行 12 吋 3D 晶圓級尺寸封裝技術產品認證與量產，本公司在擴充新產品線時，會先使用既有生產設備做製程改良，再添購全新的設備，以降低擴充新產品線之資本支出，相信有助於降低產品上市之風險。為積極擴展晶圓級尺寸封裝服務於影像感測器市場占有率。同時，針對下世代智慧型感測器(Smart Sensor)開發先進 3D 晶圓級尺寸封裝/3D 堆疊模組解決方案，以提供客戶一站購足 (One Stop Shopping) 服務解決方案。其應用範疇將擴及下世代物聯網(IoT)需要之關鍵性零組件，如作動感知器，環境感知器(光、聲、電、氣體等)以及生物識別等產品。

推薦證券商說明

因該公司主要封裝產品之終端應用領域係以消費性電子產品為主，易受景氣波動之影響，各家半導體晶圓製造廠陸續邁入更高階先進製程，封裝技術難度亦同步提高，所需投入之資本支出亦將增加，該公司為因應相關新興感測器產業之興起，除仍持續開發先進製程與新衍生技術外，業於 103 年佈建 12 吋影像感測器生產線，且為因應智慧型行動裝置、汽車電子及穿戴式裝置等新興產品的興起，目前已提供銷貨客戶加速度計、陀螺儀及光感測器之封裝服務，其終端產品應用於智慧手錶，雖因智慧手錶在市場上推出不久，終端客戶尚處觀察市場接受度階段，惟智慧穿戴式裝置在感應器方面，係透過大量感應器來抓取各種不同的資料，使得感測器種類逐漸增多，讓裝置能獲得之資料種類增加，亦可導致感測種類的需求增加，新的感測器出現或是原該既有的裝置開始小型化，進而帶動先進封裝製程在穿戴式裝置之應用。此外，該公司近年來亦跨足車用影像感測器封裝，知名汽車大廠已開始試用或生產階段，由於汽車電子屬高可靠度要求之產品，一旦經車廠驗證導入後不會隨意更換零組件供應商，在在顯現該公司已做好準備因應此等新興產品的興起。

3.本公司面臨終端消費性電子產品生命週期短及售價快速下滑之風險所採行具體因應措施之說明。

公司說明

(1)行動裝置市場

本公司耕耘半導體封裝服務領域多年，主要產品為影像感測器、指紋辨識感測器、微機電及電源控制元件之晶圓層級封裝，已成功切入如手機、平板電腦及筆記型電腦等消費性電子產品多年，由於感測器產品所需之封裝服務客製化程度高，需依客戶所設計不同產品特性提供創新之封裝解決方案，且需與上游晶圓供應商製程技術緊密結合。近年來本公司已掌握關鍵客戶產品需求並有效縮短產品開發時程，主要銷貨客戶多為合作多年之國際大廠，足見對本公司之封裝技術及產品品質已相當肯定。由於終端產品生命週期短，價格下跌快速致產品利潤薄，本公司除了致力於衍生製程與新製程之研究發展外，並積極拓展其他感測器市場(如：指紋辨識感測器及作動感測器等)，本公司亦已逐步將產品之應用由消費性電子產品進而提昇至汽車電子產業，以降低景氣循環所帶來之衝擊，茲就本公司之因應措施及目前成效說明如下：

A.因應措施

- (A)長期與關鍵客戶開發具競爭力之晶圓級尺寸封裝解決方案，拉大與競爭對手之距離。
- (B)與先進晶圓代工廠密切合作，開發適合先進晶圓製程之封裝解決方案，以滿足客戶之產品上市時程。
- (C)隨時掌握電子產業及半導體產業市場與其技術之變化，藉由積極開發 3D 先進晶圓級封裝技術，拉開與傳統封裝產業之差異，使其他同業進入較為不易。
- (D)建置 12 吋晶圓級封裝之產線，以因應高端感測器客戶之需求。
- (E)持續精進晶圓級相關先進製程技術之開發，未來期能將業務擴展至晶圓級系統整合封裝(System in Package)，將封裝產品應用於 smart sensor(同一種類的感測器封裝在一起，如：光學類、作動類及環境類等)，整合更多感測器、數位處理元件或記憶體元件，以提供客戶多元之封裝解決方案，以提高產品效能、減小尺寸及成本。

B.目前之成效

(A)在影像感測器應用市場開拓方面：

- a.除手機、筆記型電腦及平板電腦等消費性電子產品外，同時，亦將技術擴展至光感測器，成功導入手機市場。
- b.以新開發之先進 3D 晶圓級封裝技術成功切入汽車與監控市場。

(B)產品線之擴展成效方面：

- a.憑藉緊密與客戶以及晶圓代工廠之合作，開發微機電封裝技術，其技術得應用於作動感測器，以強化公司市場地位，並帶動公司成長。
- b.成功開發晶圓級三維埠端重佈製程服務於指紋辨識產品，應用於指紋辨識感測器，成為本公司於 102 年與 103 年之重要成長動能。

(2)有關汽車市場

本公司封裝之產品終端應用領域以手機、筆記型電腦及平板電腦等消費性電子產品為主，由於消費性電子產品推陳出新且生命週期短，亦受景氣波動之影響，故本公司逐步將產品之應用由消費性電子產品進而提昇至汽車電子產業，以

降低消費性電子產品因景氣循環所帶來之衝擊。基於汽車電子市場產品生命週期長，且一台車至少將搭載 6~8 顆以上之影像感測器，車用影像感測器數量在市場成熟後將不亞於手機市場，將為影像感測器產業成長性最大的應用產品。

本公司於數年前即與關鍵客戶開發利基型 3D 晶圓級封裝解決方案，以先進 3D 晶圓級封裝技術成功切入汽車與監控市場，其係應用於汽車環景安全、倒車影像及安全監測裝置，並已通過歐、日汽車關鍵零組件供應商之車規認證，且廣受終端車廠之好評(滿足輕量化與小型化要求)，並已開始裝置在歐洲與日本高端汽車。汽車電子市場對於可靠性之需求高，本公司一如以往，積極了解客戶以及終端客戶之需求，包括產品與可靠性之規格，以確保符合客戶需求，並藉此強化生產管理能力，提升公司市場競爭力。

推薦證券商說明

該公司以往主要業務為影像感測器之晶圓層級封裝，應用於手機、筆記型電腦及平板電腦等消費性電子產品為主，由於終端產品平均售價下滑速度快，可能造成該公司產品價格波動，因此，該公司除長期與關鍵客戶開發具競爭力之晶圓級尺寸封裝解決方案，並與先進晶圓代工廠密切合作，開發適合先進晶圓製程之封裝解決方案，以滿足客戶之產品上市時程外，並積極開發影像感測器之應用市場及其他感測器市場，近幾年成功開發之產品如環境光感測器、作動感測器、指紋辨識感測器及應用於無線模組之整合式被動元件等，並成功導入手機產品。有鑑於消費性電子產品推陳出新且生命週期短，亦受景氣波動之影響，該公司亦積極開發車用影像感測器，逐步將產品之應用由消費性電子產品進而提昇至汽車電子產業，以降低消費性電子產品因景氣循環所帶來之衝擊。

而針對汽車電子產業之感測器的功能，由於從攝取周圍狀況呈現在車內螢幕擴大至周圍異常檢測之感測用途，各車用元件廠商皆在思索如何提高附加價值，而各車廠積極投入先進駕駛支援系統之開發，具備感測功能之車用攝影機需求逐步提高。汽車電子市場對於安全及可靠度要求越來越嚴苛，車用電子元件均須通過車規認證，該公司經過多年努力，已通過歐、日汽車關鍵零組件供應商AEC-Q100(車用可靠性測試標準)及ISO/TS16949(全球汽車產業品質管理系統)認證，符合汽車電子產業之高規格要求，並已成功切入汽車與監控市場。其在產品責任部分，倘若產品在符合相關規格要求前提下且可歸責於該公司者，該公司亦須負連帶產品責任，因此，該公司除積極了解市場及終端客戶之需求及強化產品規格可靠性外，隨時留意相關法規規範，並進行產品責任險之保險，藉以降低未來可能產生之連帶產品責任風險，整體而言，應屬合理。

(二)營運概況乙節

1. 本公司為提供台積電公司感測器封裝服務而與其有設備採購及租賃等交易合理性之說明。

公司說明

本公司專注於研發各式感測器之先進 3D 晶圓級封裝解決方案，並成功應用於光學、微機電及指紋辨識等產品。近年本公司緊密與終端客戶合作並為其研發新型封裝技術，以及配合該終端客戶採用目前之交易模式，其中針對與終端客戶之交易內容及其衍生之關係人交易說明如下：

- (1)本公司自主研發技術成熟，過去已成功研發相關指紋辨識技術。
- (2)本公司自 100 年起即提供特定客戶感測器 IC 封裝服務，而透過相關供應鏈，該終端客戶已熟悉本公司之封裝技術及製造能力。該終端客戶於是開始與本公司接洽有關特定感測 IC 封裝業務，雙方始有合作契機。
- (3)配合終端客戶指定台積電以 Turnkey Service 交易模式由台積電下單予本公司。
- (4)因應取得特定感測 IC 封裝訂單，始有大量採購設備之需求(少部分設備係向關係人採購)

本公司因應特定感測 IC 封裝急單，始有大量採購機器設備之需求，自 102 年 4 月起本公司因特定感測 IC 封裝訂單新購置之機器設備及相關配管工程等共計 21.70 億元，採購作業主要集中於 102 年底前，而總採購設備或相關工程中，向關係人台積電採購佔總採購設備金額為 6.21%，包含蝕刻機、金屬濺鍍等設備。

由於晶圓封裝製程與上游晶圓製造商部分製程所使用之機器設備大致相容，且為配合客戶要求的量產時間，本公司採購單位依照工程部提出之設備規格需求，具以向台積電洽詢有無適合之設備，按台積電之回覆評估設備狀況、交期時點及價格是否符合營運需求後，再依取得或處份資產處理程序及採購作業程序辦理。本公司因應終端客戶訂單生產時程迫切，部分設備需求一般設備廠商交期時間未能及時，然經評估台積電二手機器設備狀況(機況掌握度較明確)及交期時點符合營運需求，本公司遂有向台積電採購相關設備之情事。

- (5)受終端客戶訂單急迫影響，始出租設備予台積電並在南科廠從事相同封裝業務並收取租金

由於特定感測 IC 封裝為終端客戶產品之創新應用，對其產品問市時程影響甚鉅，終端客戶訂單急迫，惟本公司當時現有廠房空間有限，且於短期間內無法覓得或立即建置適合之無塵室廠房並放置所有符合產能需求之相關設備，為滿足終端客戶產量需求，本公司遂與台積電協議將本公司部分設備以租賃方式出租並放置於台積電南科廠。然因係放置於台積電南科廠，基於員工管理、營運風險及業務機密等因素之考量，又本公司於南科園區並無分公司之設置，並無法在台積電廠房負責管理營運相關設備，遂由台積電自行負責該部分封裝服務。本公司業與台積電簽立設備租賃契約，業經 102 年 3 月 25 日董事會決議通過(調高資本支出並出租部分設備予台積電)，租賃期間原係自 102 年 5 月至 103 年 6 月 30 日止，惟因產品市場接受度佳，終端客戶產量需求滿載，本公司與台積電遲未能尋求適當時機中斷南科租賃設備產線，並將該產線移轉回本公司自行生產，故雙方遂增補合約協議將設備租賃期間延展至 103 年底(經 103 年 3 月 4 日審計委員會及 103 年 3 月 6 日董事會決議通過)，截至 103 年第四季已重新議定並再延展至 104 年底(經 103 年 11 月 10 日審計

委員會及 103 年 11 月 12 日董事會決議通過)。

本公司依合約自 102 年 7 月開始按月認列設備租賃租金收入，租金之議定包括折舊之計提、加權平均資金成本、保險費及合理利潤等。設備租金之相關成本則包含出租設備(含裝機成本)之折舊費用、保險費及其他相關運雜費等，並依營業租賃方式認列租金收入。

此外，以設備投資風險而言，本公司已建置相當鉅大之產能以滿足單一客戶之需求，對於出租設備於出租期間，無法用以開發其他客戶及相關業務，且此一特定感測 IC 封裝之新創應用未來在市場之接受度與技術之改變亦為主要風險之一，以上風險考量，亦已適當反映在租金之議定。

綜上所述，本公司先進製程與新衍生技術，提供客戶高附加價值之封裝解決方案，並確保客戶產品即時導入市場，強化與關鍵客戶合作關係，足見本公司自有技術能力獲得國際知名大廠肯定，本公司具有獨立接單能力。然因配合終端客戶欲採用之交易模式所衍生之各項關係人交易，本公司業經相當決策考量並依循內部控制辦法及相關會計準則辦理之，與關係人交易未有非常規之情事。

推薦證券商說明

Turnkey service 為半導體業常見之交易模式，係當 IC 設計公司向晶圓製造廠下單時，晶圓製造廠可以提供從晶圓代工、封裝、測試之全套解決方案服務，整合上游 IC 設計公司、晶圓製造廠、下游封裝廠及測試廠，可節省終端客戶於晶圓廠、封裝廠及測試廠乃至終端使用者間之個別聯繫成本，進而提升產品品質穩定性、交貨速度及產品上市效益，係以終端客戶偏好採用 Turnkey 交易模式，指定晶圓製造廠代為管理並統籌訂單，以確保產品之良率、品質控管、交期及責任分工。

經訪談該公司人員並檢視相關合約，該公司先進封裝技術成熟獲終端客戶青睞，並取得合作契機，惟因終端客戶欲採 Turnkey 交易模式進行，終端客戶遂將訂單交付指定之晶圓製造廠-台積電負責統籌管理，台積電完成晶圓生產再垂直整合下游供應鏈製程，以有效管理並降低產品風險及縮短產品交期。故雖該公司係終端客戶指定之主要封裝廠商，惟因配合此交易(Turnkey)模式，終端客戶對該公司之訂單均係透過台積電下單，應屬合理。

另，該公司為因應指紋辨識器訂單生產，遂新增購置相關機器設備。然而，由於終端客戶訂單急迫，該公司現有廠房空間有限，現有產能未能滿足終端客戶需求，為避免延宕終端客戶產品上市時程，該公司遂與台積電協議將該公司部分設備出租並放置於台積電，由台積電自行負責部分封裝服務。經檢視雙方簽立之租賃契約暨其增補修訂協議(前述契約係經 102 年 3 月 25 日董事會決議通過，自 102 年 6 月設置審計委員會後，增補協議則分別經 103 年 3 月 4 日審計委員會及 103 年 3 月 6 日董事會決議通過、103 年 11 月 10 日審計委員會及 103 年 11 月 12 日董事會決議通過)，該公司自 102 年 7 月按月認列租金收入並逐季收款，經抽核相關憑證及收款情形，尚無發現重大異常之情事。此外，該公司設備租賃之租金計價係經該公司充分考量資金成本及產品營運風險等因素後與租賃方洽談後由雙方協議訂定，另經檢視該設備租賃交易產生之利潤並與市場從事設備租賃業務之公司相較，該公司設備租賃利潤尚落於設備租賃採樣公司(承業及盛弘)毛利區間，故其租金之計算應尚屬合理。另在該公司出租給台

積電之設備中有少部分設備係向台積電等關係人所採購(134,854/2,170,105=6.21%)，係因機台設備需求急迫，在考量採購設備交期是否能符合需求之前提下，台積電等關係人若有適合之機台可為該公司使用，再綜合考量設備之使用年限及狀況並依循內控制度辦理採購流程作業，再決議是否向該關係人採購。經抽核相關表單，該公司向關係人採購之機器設備業經 102 年 8 月及 11 月董事會提案決議或報備通過(依“取得或處分資產處理程序”規定，其採購金額在新台幣壹億元(含)以下者由董事長或其授權之人核可並於事後最近一次董事會中提會報備；其金額超過新台幣壹億元者，應經審計委員會同意，再經董事會決議通過後始得為之。)且遵循採購標準程序進行採購作業，故其緣由及程序應屬合理。在租賃設備中，該公司向關係人採購部分所占比重甚小，且該公司向關係人採購固定資產業遵循相關內控辦法及作業流程辦理，經評估應尚屬合理。

2. 本公司未來研發技術布局策略及如何避免侵犯他人專利與被他人侵權具體作法之說明。

公司說明

(1)研發能量

本公司從事晶圓級尺寸封裝技術(Wafer Level Chip Size Packaging)的開發、代工及其相關業務，主要技術來源為 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.(以下簡稱 EIPA，其公司原名為以色列商 ShellCase Ltd.)，因 EIPA 之專利 Wafer Level Packaging 封裝技術在早期被認為是未來晶圓級尺寸封裝技術的主流之一，傳統 2D 晶圓級封裝技術無法滿足光學感測器之需求，因此，本公司導入 3D 晶圓級封裝技術以契合光學感測器封裝之需求，於 89 年 6 月與 EIPA 簽訂技術授權合約。本公司長期以來專注於晶圓級封裝，主要產品為影像感測器、指紋辨識感測器、微機電及電源控制元件之晶圓層級封裝，所封裝之產品廣泛被應用在行動裝置，包括手機、筆記型電腦、平板電腦、汽車電子及未來之穿戴式裝置產業等領域，除 EIPA 技術授權外，近年來本公司自行研發之衍生技術與研發成果如下：

- A. TSV (矽穿孔) 封裝技術，成功導入影像感測器產品量產，並可應用於 MEMS(微機電)等相關封裝製程。
- B. 影像感測器晶圓尺寸封裝製程改善，導入車規影像感測器產品，已完成驗證及量產。
- C. 導入特殊光學鍍層玻璃並應用於各式先進光學感測器。
- D. 最近五年度成功開發之技術或產品及主要功能：

年度	研發成果	主要功能/效益
98	CMOS 影像感測器模組整合應用	搭配外部鏡頭整合 CMOS 影像感測器成單一模組，提供完整解決方案。
	雙層重佈線技術(RDL)製程開發	提供客戶 Ball grid array 更彈性的繞線方式，可搭配原先 PCB 球墊配合設計。
99	矽穿孔(integrated circuits through silicon vias，縮寫 TSV)製程導入量產	Taper Via 製程技術導入量產，提供可靠度佳的封裝方式。
	2D Fan in/out	提供 BGA 製程來連接晶片表面 pad

年度	研發成果	主要功能/效益
100	Lead tail 保護製程導入	提升模組對於高溼氣環境的抵抗能力
101	矽穿孔(TSV)製程導入量產	Vertical Via 製程技術導入量產，提供傳輸速率更快的封裝方式。
	建立電路 spice model 資料庫	提供客戶封裝的電性 model，讓客戶針對電路設計做先期評估。
102	溝渠式打線結構製程量產	提供溝渠式打線結構封裝製程。
	二代矽穿孔(TSV)製程導入量產	Taper Via (low cost)的矽穿孔製程，技術導入量產，並提供更佳可靠度的封裝方式。
103	功率節能元件的厚銅製程	應用於系統晶片和被動元件(電阻、電感等)產品整合。

(2)專利佈局

本公司對於智財權亦極為重視，目前所開發產品之專利佈局策略技術大致可分成影像感測器封裝技術、微機電封裝技術及指紋辨識器封裝技術三個部分。因本公司之客戶來源多樣，應用端之產品亦相對複雜，每一產品所需之封裝技術皆不盡相同，為保障客戶利益與本公司之智財權，在專利佈局上，除須對於現有的量產技術做基本防護，對於客戶不同產品應用所衍生之必要技術，積極地針對創新提出專利申請，並隨時監控產學界之最新技術，早在量產之前對於前瞻性技術持續性地檢視提出專利申請之可能，以強化本公司近期、中期及遠期之智財權佈局。本公司除落實研發記錄之智慧財產知識管理外，並且定期針對智慧財產權與專利檢索進行教育訓練，同時監控掌握產業界相關專利之申請與獲權現況，可期在獨立技術研發轉化為專利權之過程中，具體呈現並保護本公司之創新概念，並達避免侵犯他人專利之雙效目的。本公司之專利佈局以發明專利為主，截至 104 年 2 月底已取得台灣、中國、美國、日本及歐盟之專利共計 208 項，尚在申請中之專利共 422 項。綜上所述，本公司已由 EIPA 之封裝技術發展出多項封裝技術，並有 630 項專利已核准或申請中之專利，應可有效掌控關鍵技術。

推薦證券商說明

該公司之影像感測器晶圓級封裝主要技術來源為 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.(以下簡稱 EIPA)，因 EIPA 之專利 Wafer Level Packaging 封裝技術在早期被認為是未來晶圓級尺寸封裝技術的主流之一，故該公司於 89 年 6 月與 EIPA 簽訂技術授權合約，技術授權費已於 90 年 6 月全數支付完畢，並自 92 年 4 月起連續 12 年每季支付權利金，截至 104 年 2 月底止，該公司並無違反合約之情事。除 EIPA 之技術授權外，該公司已自行開發多項技術，而對於客戶不同產品應用所衍生之封裝技術，亦積極提出專利申請，截至 104 年 2 月底止已取得及申請中之專利分別為 208 項及 422 項，且係以發明專利為主，該公司亦設法務處負責專利佈局策略之擬定、專利管理、專利申請、營業秘密之保護，同時亦緊密與研發部門、業務市場部門及製造生產部門針對特定技術作專案開發研究，並提出必要之設計方案，以取得專利保護。截至 104 年 2 月底止，該公司尚無專利侵權或專利舉發無效之情事，顯見該公司專利權佈局策略及如何避免侵犯他人專利與被他人侵權之具體因應措施應屬可行，並無重大異常之情事。

該公司已耕耘半導體封裝服務領域多年，主要銷貨客戶多為國際大廠，且已合作多年，足見對該公司之封裝技術及產品品質已相當肯定。綜上所述，該公司已由 EIPA 之封裝技術發展出多項封裝技術，並有 630 項專利已核准或申請中之專利，應可有效掌控關鍵技術。

3. 本公司關鍵技術及與同業優劣勢分析之說明。

公司說明

(1)公司關鍵技術及與同業優劣勢之比較

A. 3D 晶圓級尺寸封裝與晶圓級後護層封裝與傳統封裝之異

本公司為專業晶圓級 IC 封裝之領導廠商，主要服務包括 3D 晶圓級尺寸封裝服務與晶圓級後護層封裝服務，晶圓級尺寸封裝主要應用於影像感測器及環境感測器等光學感測元件，晶圓級後護層封裝服務主要應用於功率分離式元件、微機電系統感測器元件、指紋辨識感測器元件和整合式被動元件等，綜觀目前國內上市櫃及興櫃公司，封裝技術及產品組合並無與本公司完全相同者。

而半導體封測業之國內外封裝大廠則包含 ASE(日月光)、SPIL(矽品)、AMKOR(艾克爾，美國)等主要晶粒封裝供應商(俗稱 OSAT)。晶圓級尺寸封裝位居晶圓代工與主要晶粒封裝供應商(OSAT)之間，俗稱半導體中段服務，為新興之產業服務鏈，主要因應需三維封裝且小型化之感測元件需要，產品應用由影像感測器開始，逐漸擴展至微機電及指紋辨識等產品。市場應用由筆記型電腦、手機、平板、可攜式消費性電子產品，未來將往穿戴式以及汽車電子擴展。與 OSAT 之比較如下：

- a. 3D 晶圓級封裝(CSP)使用之主技術主要包含半導體晶圓製程、微機電以及部份後段封裝技術，主要投資為晶圓製程設備，與 OSAT 設備不同，因此，不論在封裝技術、專利佈局、資本投資與產能供給均與主要 OSAT 迥異。
- b. OSAT 目前主要仍著重於數位晶片、記憶體晶片、功率/驅動晶片等產品之 2D 封裝(僅於晶片表面進行線路佈局，亦即 XY 軸向，與本公司感測元件之後 3D 封裝 XYZ 3 軸佈局)迥異。

綜上，目前國內外主要 OSAT 目前並非本公司主要競爭對象。

B. 與同業在規模及產品定位之各項比較

本公司長期以來專注於晶圓級封裝，主要產品為影像感測器、指紋辨識感測器、微機電及電源控制元件之晶圓層級封裝，所使用之封裝技術除使用部分傳統封裝技術外(如：壓合技術、BGA 植球、晶圓切割等)，主係以半導體製造中的相關技術(例如：光刻技術、薄膜沉相技術等)來進行封裝，與傳統 IC 封裝同業不同。

另因感測器(如：光學或加速度計)之測試係根據感測器元件需求而設計，需使用特殊測試機台，大部分由感測器 IC 設計公司與測試機台供應商客製化研發，為感測器 IC 設計公司之核心技術之一，故多由感測器 IC 設計公司自行測試，而邏輯元件、記憶體、無線通訊模組等 IC 可用一般標準 IC

測試機台，故一般委由封裝廠或獨立測試廠代為服務，而本公司僅有封裝業務，並無測試業務，知名度及規模不如封裝大廠。以下就本公司與同業 103 年截至 9 月底之資本額、營收及產品定位等進行比較說明：

單位：新台幣億元

	精材	日月光 (上市：2311) (ASE)	矽品 (上市：2325) (Spil)	同欣 (上市：6271)	菱生 (上市：2369)	中國 蘇州晶方 (上海交所：603005)	中國 天水華天 (深圳證交所：002185)
資本額	23.81	788.38	311.64	16.29	38.01	11.19	32.06
營業收入	34.96	1,799.47	616.41	64.12	44.75	20.68	85.74
主要技術	3D 晶圓級封裝、晶圓級後護層封裝	IC 封裝與模組組裝、2D 晶圓級封裝、測試	IC 封裝與模組組裝、2D 晶圓級封裝、測試	無線模組組裝、LED 陶瓷基板、晶圓重佈服務	小尺寸 IC 封裝	3D 晶圓級封裝、晶圓級後護層封裝	3D 晶圓級封裝其他封裝服務
產品定位	影像感測器、指紋辨識感測器、加速度計、陀螺儀、金氧半導體效電晶體及光感測器等	邏輯元件、記憶體、無線通訊模組等之封裝與組裝。	邏輯元件、記憶體、無線通訊模組等之封裝與組裝。	無線通訊模組、LED 基板、影像感測元件晶圓重佈服務	利基型微機電等產品	影像感測器及指紋辨識感測器	影像感測器相機模組
市場聚焦	手機、筆記型電腦，平板電腦、穿戴式裝置、汽車	電子產品	電子產品	電子產品	電子產品	手機、筆記型電腦，平板電腦	手機、筆記型電腦，平板電腦

資料來源：各公司經會計師查核簽證或核閱簽證之合併財務報告，各公司公告資料註：人民幣對新台幣之匯率係以台銀 103.9.30 即期平均匯率@4.934 換算

本公司主要封裝方式為 3D 晶圓級封裝，產品用途主要為影像感測器及指紋辨識感測器，以下就主要技術相同之同業比較如下：

	精 材	中國蘇州晶方	中國天水華天
主要產品	影像感測器 指紋辨識感測器	影像感測器 指紋辨識感測器	影像感測器 其他封裝測試
封裝方式	晶圓級尺寸封裝 晶圓級後護層封裝	晶圓級尺寸封裝 晶圓級後護層封裝	晶圓級尺寸封裝 QFP、BGA、QFN
優勢	1.IC 本體以玻璃保護，不易受環境影響。 2.晶圓層級製作，每片晶圓之晶粒顆數越多，每晶粒之封裝成本越低。 3.可直接進行 SMT 製程，模組組裝設備投資低。 4.擁有最大 8 吋產能 (102 度產能 77.4 萬片)，12 吋預計於 104 年量產。 5.產品市場應用多元，成功切入新產品及新市場。 6.透過專利佈局，建立先進封裝優勢。	1.IC 本體以玻璃保護，不易受環境影響。 2. 晶圓層級製作，每片晶圓之晶粒顆數越多，每晶粒之封裝成本越低。 3.可直接進行 SMT 製程，模組組裝設備投資低。 4.12 吋產能優勢。 5.中國政府扶植補貼 6.人工便宜	1.IC 本體以玻璃保護，不易受環境影響。 2.晶圓層級製作，每片晶圓之晶粒顆數越多，每晶粒之封裝成本越低。 3.可直接進行 SMT 製程，模組組裝設備投資低。 4.中國政府扶植補貼 5.人工便宜 6.相機模組組裝服務

劣勢	1.晶圓層級製作對於大尺寸、低良率之感測器相較於 COB 封裝技術，無法享有成本優勢。 2.依個別產品需準備一套光罩，不適用需求量少之市場。	1.晶圓層級製作對於大尺寸、低良率之感測器相較於 COB 封裝技術，無法享有成本優勢。 2.依個別產品需準備一套光罩，不適用需求量少之市場。 3.產品市場應用較少。 4.8 吋產能較少。 5.專利佈局較少。	1.晶圓層級製作對於大尺寸、低良率之感測器相較於 COB 封裝技術，無法享有成本優勢。 2.依個別產品需準備一套光罩，不適用需求量少之市場。 3.產品市場應用較少。 4.以實用新型專利為主。

資料來源：本公司整理；蘇州晶方半導體科技(股)公司2014年1月首次公開發行股票招股說明書；天水華天科技(股)公司2013年8月公開發行可轉換公司債券募集說明書

由產品與市場觀之，相較同業，除影像感測器及指紋辨識感測器產品外，本公司業已順利切入加速度計、陀螺儀及光感測器等產品線，應用領域亦擴展至手機、筆記型電腦，平板電腦以外之穿戴式裝置、汽車及生醫等領域，顯見本公司在技術整合與客戶合作關係領先競爭對手。另本公司致力於持續開發先進製程與新衍生技術(如矽穿孔(TSV)製程及雙層重佈線技術(RDL)製程等封裝技術)，並緊密與銷貨客戶(如 IC 設計公司或終端客戶)及晶圓代工廠之合作，以提供符合產品之客製化封裝解決方案，除影像感測器外，亦開發作動感測器及指紋辨識感測器等其他感測器市場，藉以提升本公司之競爭利基。

推薦證券商說明

(1)該公司關鍵技術及與同業優劣勢之比較

A. 3D 晶圓級尺寸封裝與晶圓級後護層封裝與傳統封裝之異

該公司為專業晶圓級 IC 封裝之領導廠商，主要服務包括 3D 晶圓級尺寸封裝服務與晶圓級後護層封裝服務，綜觀目前國內上市櫃及興櫃公司，封裝技術及產品組合並無與該公司完全相同者，而國內外半導體封裝大廠包含 ASE(日月光)、SPIL(矽品)、AMKOR(艾克爾，美國)等主要晶粒封裝供應商(俗稱 OSAT)。晶圓級尺寸封裝位居晶圓代工與主要晶粒封裝供應商(OSAT)之間，俗稱半導體中段服務，為新興之產業服務鏈，主要因應需三維封裝且小型化之感測元件需要，產品應用由影像感測器開始，逐漸擴展至微機電及指紋辨識等產品。市場應用由筆記型電腦、手機、平板、可攜式消費性電子產品，未來將往穿戴式以及汽車電子擴展。與 OSAT 之比較如下：

- a. 3D 晶圓級封裝(CSP)使用之主技術主要包含半導體晶圓製程、微機電以及部份後段封裝技術，主要投資為晶圓製程設備，與 OSAT 設備不同，因此，不論在封裝技術、專利佈局、資本投資與產能供給均與主要 OSAT 迥異。
- b. OSAT 目前主要仍著重於數位晶片(如繪圖晶片、手機基頻/射頻/無線晶片等)、記憶體晶片、功率/驅動晶片(如碩邦，南茂之金凸塊製程與 TCP、COF、COG 等組裝服務)等產品之 2D 封裝(僅於晶片表面進行線路佈局，亦即 XY 軸向，與該公司感測元件之後 3D 封裝 XYZ 3 軸佈局)迥異。

綜上，目前國內外主要 OSAT 目前並非該公司主要競爭對象。

B. 與同業優劣勢之比較

該公司長期以來專注於晶圓級封裝，主要產品為影像感測器、指紋辨識感測器、微機電及電源控制元件之晶圓層級封裝，所使用之封裝技術除使用部分傳統封裝技術外(如：壓合技術、BGA 植球、晶圓切割等)，主係以半導體製造中的相關技術(例如：光刻技術、薄膜沉相技術等)來進行封裝，與傳統 IC 封裝同業不同。

另因感測器(如：光學或加速度計)之測試係根據感測器元件需求而設計，需使用特殊測試機台，大部分由感測器 IC 設計公司與測試機台供應商客製化研發，為感測器 IC 設計公司之核心技術之一，故多由感測器 IC 設計公司自行測試，而邏輯元件、記憶體、無線通訊模組等 IC 可用一般標準 IC 測試機台，故一般委由封裝廠或獨立測試廠代為服務，而該公司僅有封裝業務，並無測試業務，知名度及規模不如封裝大廠。

該公司主要封裝方式為 3D 晶圓級封裝，產品用途主要為影像感測器及指紋辨識感測器，下面就主要技術相同之同業比較如下：

	精 材	中國蘇州晶方	中國天水華天
主要產品	影像感測器 指紋辨識感測器	影像感測器 指紋辨識感測器	影像感測器 其他封裝測試
封裝方式	晶圓級尺寸封裝 晶圓級後護層封裝	晶圓級尺寸封裝 晶圓級後護層封裝	晶圓級尺寸封裝 QFP、BGA、QFN
優勢	1.IC 本體以玻璃保護，不易受環境影響。 2.晶圓層級製作，每片晶圓之晶粒顆數越多，每晶粒之封裝成本越低。 3.可直接進行 SMT 製程，模組組裝設備投資低。 4.擁有最大 8 吋產能，12 吋預計於 104 年量產。 5.產品市場應用多元，成功切入新產品及新市場。(作動感測器及功率元件等，市場包括汽車、穿戴式裝置及生醫等) 6.透過專利佈局，建立先進封裝優勢。	1.IC 本體以玻璃保護，不易受環境影響。 2. 晶圓層級製作，每片晶圓之晶粒顆數越多，每晶粒之封裝成本越低。 3.可直接進行 SMT 製程，模組組裝設備投資低。 4.12 吋產能優勢 5.中國政府扶植補貼 6.人工成本較低	1.IC 本體以玻璃保護，不易受環境影響。 2.晶圓層級製作，每片晶圓之晶粒顆數越多，每晶粒之封裝成本越低。 3.可直接進行 SMT 製程，模組組裝設備投資低。 4.中國政府扶植補貼 5.人工成本較低 6.相機模組組裝服務
劣勢	1.晶圓層級製作對於大尺寸、低良率之感測器相較於 COB 封裝技術，無法享有成本優勢。 2.依個別產品需準備一套光罩，不適用需求量少之市場。	1.晶圓層級製作對於大尺寸、低良率之感測器相較於 COB 封裝技術，無法享有成本優勢。 2.依個別產品需準備一套光罩，不適用需求量少之市場。 3.產品市場應用較少。 4.8 吋產能較少 5.專利佈局較少	1.晶圓層級製作對於大尺寸、低良率之感測器相較於 COB 封裝技術，無法享有成本優勢。 2.依個別產品需準備一套光罩，不適用需求量少之市場。 3.產品市場應用較少。 4.以實用新型專利為主，專利佈局較少

資料來源：該公司整理；蘇州晶方半導體科技(股)公司2014年1月首次公開發行股票招股說明書；天水華天科技(股)公司2013年8月公開發行可轉換公司債券募集說明書

除影像感測器及指紋辨識感測器產品外，該公司業已順利切入加速度計、陀螺儀、光感測器等產品線，應用領域亦擴展至手機、筆記型電腦，平板電腦以外之穿戴式裝置、汽車及生醫等領域，顯見該公司在技術整合與客戶合作關係領先競爭對手。另該公司致力於持續開發先進製程與新衍生技術(如矽穿孔(TSV)製程及雙層重佈線技術(RDL)製程等封裝技術)，並緊密與銷貨客戶(如IC設計公司或終端客戶)及晶圓代工廠之合作，以提供符合產品之客製化封裝解決方案，除影像感測器外，亦開發作動感測器及指紋辨識感測器等其他感測器市場，藉以提升該公司之競爭利基。

(三)特別記載事項乙節

1.本公司擴建廠房之必要性、目前進度、資金來源及預計未來效益之說明。

公司說明

(1)因應 12 吋晶圓封裝市場，本公司擴廠計劃計畫內容

本公司深耕晶圓級尺寸封裝技術多年，並以封裝高畫素之影像感測器為主，隨行動裝置產品對影像畫素需求日益殷切，影像感測器畫素隨市場需求不斷提升，因畫素提高需藉由感測器元件尺寸放大，故帶動晶圓數量需求大幅成長。根據半導體研究機構 IC Insights 指出，因半導體晶片種類繁多，並非所有產品都適合改用大尺寸的 12 吋晶圓廠生產，目前 12 吋晶圓廠主要用於生產數量多或商品類型多的產品，例如：DRAM、快閃記憶體、複雜邏輯 IC 等半導體元件。而類比 IC、電源管理 IC、射頻 IC、觸控 IC 以及指紋辨識感測器等，則仍暫以 8 吋晶圓廠為生產主力。至於影像感測器產品，受限於 8 吋晶圓產能以及高端手機產品需要先進 12 吋晶圓製程，又因晶圓代工廠已停止擴建 8 吋晶圓廠產能，為滿足影像感測器市場需求，客戶逐漸進入 12 吋晶圓製程。

本公司目前之現有兩座廠房以封裝 8 吋產品為主，為因應晶圓尺寸放大及預計現有產能不敷未來市場需求成長所需，遂規劃建置新廠房並增添相關機器設備。由於半導體封裝作業均需在無塵室裡進行，整體生產流程至少包括黃光區、蝕刻區、壓合區及切割區等，本公司本次擴建計劃除增加辦公室、品保實驗室及倉庫外，主要係建置無塵室及 12 吋晶圓級尺寸封裝產線，以提升本公司整體產能，支應未來影像感測器客戶需求。本公司係屬半導體產業供應鏈中下游封裝廠商，鑑於上游晶圓大廠製程演進及評估 12 吋封裝時機已成熟，本公司開始積極投入建置 12 吋晶圓級尺寸封裝生產線以銜接產業未來走向，預計擴充之 12 吋晶圓級尺寸封裝生產線將吸引影像感測器廠商訂單需求，挹注本公司未來成長動力，對本公司未來營運具有正面效益，且客戶為因應上游晶圓代工廠 8 吋產能供給有限之因素，客戶已漸多陸續採用 12 吋之製程來生產，故本公司進入 12 吋產線之設置實有其必要性。

(2)擴廠進度

本公司係於 100 年 1 月 14 日之董事會決議得因應擴充產能需求購置不動產，考量廠房空間需求及廠區位址，故向本公司廠區附近佳鼎科技(股)公司(以下簡稱佳鼎)購置其位於桃園市中壢區中園路之土地及廠房，本公司已於 100 年 3 月 23 日辦理過戶完成。因佳鼎之廠房原係供 PCB 之生產用，故本公司需進行相關廠務設施之改善後，再進行無塵室之建置，而後才得將安裝設備機台以供驗證、試產及量產。因應前述各項建置工程，本公司業經董事會決議通過相關廠房建置計畫預算。本公司無塵室工程業已完成並已取得工廠使用執照。預計 104 年上半年可開始進行試產及客戶認證等程序。

(3)擴廠之資金來源

本公司之新廠房(以下稱 Line C)擴建計畫預計投資總金額為 3,830,045 仟元，包括土地與建物購置款、廠房整修等建置工程款、無塵室等廠務設施建置款及機器設備款等，資金來源多以中長期銀行借款及自有資金支應。

(4)擴廠之預計效益

目前本公司已與亞洲及歐美等潛在影像感測器客戶進行 12 吋晶圓級尺寸封裝業務開發，預計建置之 12 吋晶圓級尺寸封裝生產線將可供應前述影像感測器客戶之封裝需求。

Line C 初期之損失對本公司 104 年整體營運尚不致造成重大影響，且隨 Line C 良率提升、經濟規模效益逐漸顯現後，Line C 將可望挹助本公司相當營收及獲利，綜前所述，本公司預估之擴產效益應屬合理。

推薦證券商說明

(1)擴建廠房之必要性

該公司目前之現有兩座廠房以封裝 8 吋產品為主，為因應晶圓尺寸放大及預計現有產能不敷未來市場需求成長所需，遂規劃建置新廠房並增添相關機器設備。由於半導體封裝作業均需在無塵室裡進行，整體生產流程至少包括黃光區、蝕刻區、壓合區及切割區等，該公司本次擴建計劃除增加辦公室、品保實驗室及倉庫外，主要係建置無塵室及 12 吋晶圓級尺寸封裝產線，以提升該公司整體產能，支應未來影像感測器客戶需求。該公司係屬半導體產業供應鏈中下游封裝廠商，鑑於上游晶圓大廠製程演進及評估 12 吋封裝時機已成熟，該公司開始積極投入建置 12 吋晶圓級尺寸封裝生產線以銜接產業未來走向，預計擴充之 12 吋晶圓級尺寸封裝生產線將吸引影像感測器廠商訂單需求，挹注該公司未來成長動力，對該公司未來營運具有正面效益，且客戶為因應上游晶圓代工廠 8 吋產能供給有限之因素，客戶已漸多陸續採用 12 吋之製程來生產，故該公司進入 12 吋產線之設置實有其必要性。

(2)擴廠進度

該公司係於 100 年 1 月 14 日之董事會決議得因應擴充產能需求購置不動產，考量廠房空間需求及廠區位址，故向該公司廠區附近佳鼎科技(股)公司(以下簡稱佳鼎)購置其位於桃園市中壢區中園路之土地及廠房，經取得不動產買賣合約書

及鑑價報告等文件，該公司已於 100 年 3 月 23 日辦理過戶完成。因佳鼎之廠房原係供 PCB 之生產用，故該公司需進行相關廠務設施之改善後，再進行無塵室之建置，而後才得將安裝設備機台以供驗證、試產及量產。因應前述各項建置工程，該公司分別經 100 年 3 月 15 日、100 年 11 月 11 日、102 年 3 月 25 日及 103 年 4 月 3 日董事會決議通過相關廠房建置計畫預算。該公司無塵室工程業已取得工廠使用執照。預計 104 年上半年可開始進行試產及客戶認證等程序。

(3)擴廠之資金來源

該公司之新廠房(以下稱 Line C)擴建計畫預計投資總金額為 3,830,045 仟元，包括土地與建物購置款、廠房整修等建置工程款、無塵室等廠務設施建置款及機器設備款等，資金來源多以中長期銀行借款及自有資金支應。其中，土地與建物購置款共計 1,050,000 仟元已於 101 年 2 月全數付訖，另截至 104 年 2 月底止，依工程進度及付款時程，該公司分別已支付廠房整修等建置工程款計 119,645 仟元、無塵室等廠務設施建置款計 512,159 仟元及機器設備款計 779,282 仟元，尚餘 1,368,959 仟元之款項，將可透過自有資金或中長期銀行借款支應，其資金來源應屬合理。

(4)擴廠之預計效益

目前該公司已與多家潛在影像感測器客戶進行 12 吋晶圓級尺寸封裝業務開發，預計建置之 12 吋晶圓級尺寸封裝生產線將可供應前述影像感測器客戶之封裝需求。

整體而言，雖104年Line C因尚屬產線量產初期，產量未達經濟規模，致使Line C挹注該公司全年營收效益未顯現，然該公司既有業績穩定，且積極拓展新業務來源，Line C初期之損失對該公司104年整體營運尚不致造成重大影響，且隨Line C良率提升、經濟規模效益逐漸顯現後，Line C將可望挹助該公司相當營收及獲利，綜前所述，該公司預估之擴產效益應屬合理。

二、推薦證券商評估報告中對該公司以下項目說明之評估意見

(一) 對該公司業績變化合理性、所面臨營運風險及未來發展性之說明。

精材科技股份有限公司(以下簡稱該公司)為專業 3D 晶圓級 IC 封裝之領導者，主要從事光學感測元件之晶圓級封裝服務，以及應用於其他感測器及汽車電子相關之晶圓級後護層封裝服務，也是全球第一家將三維晶圓級封裝技術商品化的公司，其最近二年度之業績變化情形如下表，有關該公司業績變化合理性及未來發展性為何？經洽推薦證券商評估如後：

單位：新台幣仟元

年度 項目		102 年度		103 年度	
		金額	%	金額	%
營業收入(淨額)		4,256,761	100.00	4,934,078	100.00
營業成本		3,561,619	83.67	3,985,874	80.78
營業毛利		695,142	16.33	948,204	19.22
營業費用		365,514	8.59	463,495	9.39
其他收益及費損淨額		51,008	1.20	190,921	3.87
營業利益		380,636	8.94	675,630	13.69
營業外收入及支出		(31,873)	(0.75)	(15,704)	(0.32)
稅前 淨利	歸屬於母公司權益	348,763	8.19	659,926	13.37
	歸屬於非控制權益	-	-	-	-
所得稅費用		(59,882)	(1.41)	(31,273)	(0.63)
本期淨利		288,881	6.78	628,653	12.74
期末資本額		2,364,018		2,381,207	
每股稅後 淨利(元)	追溯前(註 1)	1.22		2.65	
	追溯後(註 2)	1.22		2.65	

資料來源：該公司各期間經會計師查核簽證之財務報告

註 1：係以當年度加權平均流通在外股數計算之基本每股稅後純益。

註 2：係以 103 年度為基準往前追溯調整之基本每股稅後純益。

註 3：最近二年度財務報告係採國際財務報導準則編製。

推薦證券商評估：

(一) 該公司所屬行業之產業概況及所營業務之主要內容

1. 該公司所屬行業之產業概況

該公司從事半導體產業鏈後段製程之封裝服務，主要係提供 3D 晶圓級尺寸封裝及晶圓級後護層封裝服務，產品可應用於影像感測器、環境感測器、作動感測器、指紋辨識感測器及 MOSFET 功率場效電晶體等，為智慧型手機、個人電腦、平板電腦、電源供應裝置等產品不可或缺之元件。其中，該公司主要封裝之光學元件及指紋辨識感測器等，主要應用於智慧型行動裝置(例如手機、筆記型電腦及平板電腦等)，約佔該公司營收比重九成以上，故智慧型行動裝置出貨情況與該公司近期業績變化息息相關。

2013 年由於智慧型手機及平板電腦市場需求趨緩，我國 IC 封裝產業產值較 2012 年微幅成長 4.6%；2014 年，由於已開發國家經濟開始復甦成長，PC 市場經過幾年的成長停滯後，104 年可望持穩不再衰退，而中低階智慧型手機則因在新興市場大幅成長抵銷高階智慧型手機成長趨緩之不利影響，整體手機數量依舊成長，手機晶片之高階封測產能、覆晶及晶圓、凸塊需求仍持續增加，足見智慧型手機及平板電腦是 2014 年推升預估 IC 封裝業主要成長動力，故 IEK 預估 2014 年我國 IC 封裝產業產值較 2013 年成長 13.9%。

2. 該公司所營業務之主要內容

單位：新台幣仟元

產品項目	重 要 用 途 及 功 能	102 年度		103 年度	
		營收淨額	%	營收淨額	%
晶圓級尺寸封裝服務 (CSP)	在晶圓尚未切割前即完成主要封裝之製程服務，包括晶圓薄膜、黃光及蝕刻等晶圓製程，並結合後段雷射打印及晶圓背面迴焊黏著錫球(BGA)等封裝製程，最後再切割成單顆的 IC 封裝。此種製程可視為前段半導體晶圓廠製程的延伸(屬於半導體供應鏈後段部分)，在供應鏈已屬完整且趨於標準化之封裝型態。其最大優點是在封裝的過程中，藉由以晶圓封裝的方式，取代傳統晶粒須個別的封裝，可有效降低封裝成本，且封裝完成後之尺寸幾乎等同於晶粒本身的大小，滿足市場對小型化及高性能產品之需求。 目前主要封裝服務應用於影像感測器及環境感測器等光學元件。	3,308,413	77.72	3,028,799	61.39
晶圓級後護層封裝服務 (PPI)	主要係於晶圓上利用三維埠端重佈技術、三維埠端披露技術等製程技術從事半導體晶圓加工，完成製程服務後，以晶圓之形式運送至其他下游廠商(例如：傳統封裝廠)進行後續產品封裝製程。 目前主要製程服務應用於指紋辨識感測器、微機電(如：加速器、陀螺儀)及 MOSFET 功率場效電晶體等產品。	920,633	21.63	1,879,970	38.10
其他	主係設計收入及出售原物料收入。	27,715	0.65	25,309	0.51
合 計		4,256,761	100.00	4,934,078	100.00

資料來源：該公司提供。

(二) 最近二年度及申請年度業績變化原因及其合理性分析

最近二年度及申請年度各主要產品別業績及毛利率變動表

單位：新台幣仟元

年度 產品	102 年度						103 年度					
	營業收入	營業毛利	銷量(註 1) (仟片)	單位售 價(元)	單位成 本(元)	毛利率 (%)	營業收入	營業毛利	銷量(註 1) (仟片)	單位售 價(元)	單位成 本(元)	毛利率 (%)
晶圓級尺寸封裝(CSP)	3,308,413	502,099	370	8,941.66	7,584.63	15.18	3,028,799	224,562	317	9,554.57	8,846.17	7.41
晶圓級後護層封裝(PPI)	920,633	224,076	255	3,610.33	2,731.60	24.34	1,879,970	712,899	397	4,735.44	2,939.73	37.92
其他(註 2)	27,715	(31,033)	-	-	-	(111.97)	25,309	10,743	-	-	-	42.45
合計	4,256,761	695,142	625	-	-	16.33	4,934,078	948,204	714	-	-	19.22

資料來源：該公司提供

註 1：約當 8 吋晶圓之片數換算。

註 2：其他包括設計收入、出售原物料收入。

1. 依主要產品別說明營業收入變化分析

該公司成立於 87 年，從事半導體產業鏈後段製程之封裝服務，主要係提供晶圓級尺寸封裝及晶圓級後護層封裝服務，產品以影像感測器、環境感測器及指紋辨識感測器為大宗，占該公司營收比重九成以上，其餘產品則包含作動感測器、微機電(如：加速器、陀螺儀)及 MOSFET 功率場效電晶體等，為智慧型行動裝置(如智慧型手機、個人電腦、平板電腦)、電源供應裝置與印表機噴墨頭等產品不可或缺之元件。該公司 102 年度及 103 年度之營業收入淨額分別為 4,256,761 仟元及 4,934,078 仟元，呈逐年增加趨勢。變化主係因 102 年度全球經濟景氣逐漸復甦，受惠於智慧行動裝置需求增加，帶動整體半導體產業成長，該公司業績跟著上揚，且因應行動裝置對於個人隱私的保護需求，指紋辨識感測器之市場需求大幅增加，該公司於 102 年下半年成功導入該項封裝產品並進入量產，致 102 年度及 103 年度之營收與獲利均有顯著之貢獻。茲就該公司各產品別之業績變化情形分析說明如下：

(1) 晶圓級尺寸封裝服務

在營業收入方面，該公司最近二年度晶圓級尺寸封裝服務之營收淨額分別為 3,308,413 仟元及 3,028,799 仟元，占各年度營業收入淨額之比例則分別為 77.72%及 61.39%，為占該公司營業收入最大宗之品項，終端產品主要應用於智慧型行動裝置(例如：智慧型手機、個人電腦、平板電腦之影像感測器及環境感測器)，該項產品銷售金額之增減主要視終端產品出貨情況而定。103 年度在晶圓級後護層封裝業務持續成長下，其占整體營業收入淨額之金額與比重則呈現下滑。整體而言，最近二年度晶圓級尺寸封裝服務之營業收入之變動尚屬合理。

在產品單價方面，由於封裝產業為高度客製化之產業，係以整片晶圓所需製程來計價，倘客戶要求的製程工序較為繁複，則成本及售價亦隨之增加(例如若一片晶圓採用較多道光罩製程，或所載晶粒數若較多致切割次數較多，則單價較高)。103 年度晶圓級尺寸封裝單位售價較高，主係因高晶粒數且需較多工序之環境感測器產品比重較高所致。

在單位成本方面，103 年度平均單位成本為 8,846 元較 102 年度單位成本 7,585 元上升約 1,261 元，主係因 103 年度因影像感測器之需求略降，致環境感測器銷售數量占比提高，而環境感測器依客戶需求需增加鍍膜玻璃且產品晶粒數較多，故每片晶圓封裝成本較高。另自 103 年因新佈建 12 吋晶圓封裝生產線而認列相關建置成本，均造成 103 年度單位成本較 102 年為高。

在產品毛利率方面，103 年度雖環境感測器之訂單(較該產品別其他客戶之單位售價、單位成本及單位毛利率均為高)增加，惟因 OVTI 集團配合終端客戶需求增加對更高階影像感測器需求，對該公司之訂單隨之下降，致產能利用率下降，又因新佈建 12 吋封裝生產線而認列相關建置成本，致毛利率由 102 年度之 15.18%下滑至 7.41%。

(2) 晶圓級後護層封裝服務

在營業收入方面，該公司之晶圓級後護層封裝服務，主要製程服務應用於指紋辨識感測器、微機電(如：加速器、陀螺儀)、MOSFET 功率場效電晶體等。該公司最近二年度晶圓級後護層封裝服務營收金額分別為 920,633 仟元及

1,879,970 仟元，占各年度銷貨收入淨額之比例則分別為 21.63%及 38.10%，呈大幅成長趨勢。由於該公司提供指紋辨識感測器之封裝技術深得終端客戶青睞，在該公司之指紋辨識感測器技術獲得終端客戶認證後，考量產品良率、品質控管、責任分工以及簡化供應鏈之管理需要，最終決定委由晶圓代工廠台積電統籌以 Turnkey Service 交易模式下單予該公司，該公司業於 102 年下半年度成功導入指紋辨識感測器並進入量產貢獻營收，又因持續提供 MOSFET 功率場效電晶體及作動感測器等之後護層製程服務，故 102 年度之銷貨淨額達 920,633 仟元；103 年度因指紋辨識感測器之終端市場需求暢旺，加上其他感測器之後護層封裝需求增加，致 103 年度之營收淨額達 1,879,970 仟元。

在產品單價及成本方面，因晶圓級後護層封裝服務產品組合包含指紋辨識感測器、微機電(如：加速器、陀螺儀)及 MOSFET 功率場效電晶體等產品，各產品製程服務之價格及數量均不相仿，故平均單位售價及成本易受產品組合影響。因指紋辨識感測器製程及工序較其他使用晶圓級後護層封裝服務產品複雜，故成本及售價亦較高，而 103 年度指紋辨識感測器銷售比重較 102 年度為高，致其整體產品單位售價及單位成本均較 102 年度增加。

在產品毛利率方面，主要係因指紋辨識感測器銷售數量及比重增加，致 103 年度毛利率相較 102 年度增加至 37.92%。

(3) 其它

該公司最近二年度其他類產品之銷售金額分別為 27,715 仟元及 25,309 仟元，占各年度銷貨收入淨額之比例皆小於 1%，其他收入包括產品光罩設計與原型製作等收入以及因應銷售客戶或供應商之研發需求，出售少量原物料之收入，正常毛利率約為 36%，然因 102 年度之其他營業成本中，除前述設計服務及出售原物料之成本外，該公司尚將新廠之廠務成本列入此項(103 年度因已開始佈建 12 吋晶圓級尺寸封裝生產線，故改列入晶圓級尺寸封裝項下)，故造成營業毛損；而 103 年度亦因前述分類影響，其他營業成本減少，致營業毛利已由虧轉為盈，尚無重大異常之情事。

綜上所述，該公司最近二年度受智慧型行動裝置需求增加與新產品導入量產使銷售金額呈逐年上升趨勢，其營業成本及毛利率主要受訂單數量、產品組合項目及市場景氣等因素所影響，其變化經評估尚屬合理。

2. 主要銷售對象變化分析

單位：新台幣仟元

	102 年度			103 年度		
	名稱	金額	%	名稱	金額	%
1	OVTI 集團	1,580,579	37.13	台積電集團	1,732,290	35.11
2	台積電集團	862,283	20.26	OVTI 集團	1,425,860	28.90
3	A 公司	484,182	11.37	B 公司	667,339	13.52
4	B 公司	422,281	9.92	A 公司	476,558	9.66
5	C 公司	386,302	9.08	D 公司	184,350	3.74
6	D 公司	124,266	2.92	C 公司	123,377	2.50
7	H 公司	106,399	2.50	I 公司	70,579	1.43
8	F 公司	66,657	1.57	H 公司	48,851	0.99
9	I 公司	65,592	1.54	比亞迪	43,434	0.88
10	無錫鴻圖	33,879	0.80	G 公司	39,232	0.79
	小計	4,132,420	97.09	小計	4,811,870	97.52
	其他	124,341	2.91	其他	122,208	2.48
	銷貨淨額	4,256,761	100.00	銷貨淨額	4,934,078	100.00

資料來源：該公司提供

該公司為專業 3D 晶圓級 IC 封裝之領導者，主要業務為提供影像感測器、環境感測器等之晶圓級尺寸封裝，其指紋辨識感測器、微機電及電源控制元件之晶圓級後護層封裝服務技術已臻成熟，並深獲客戶肯定。該公司主要客戶為晶圓代工大廠、影像感測器 IC 設計大廠、環境感測器 IC 設計公司、電源管理元件 IC 設計大廠、印表機噴墨頭 IC 設計公司等，最近二年度對前十大銷售對象之銷售比重分別為 97.09%及 97.52%，其銷貨對象、金額及比率之變化情形，主要受產業景氣波動、客戶營運情形及新產品開發進度等因素而變動，茲就其最近二年度主要銷售對象變化情形及原因分析如下：

- (1) 台積電集團(台灣積體電路製造股份有限公司，負責人：張忠謀；資本額：新台幣259,286,171仟元；設立地區：台灣新竹科學園區；授信條件：月結30天；網址：www.tsmc.com)

台灣積體電路製造(股)公司(以下簡稱台積電)(台灣 TSE：2330，美國 NYSE：TSM) 成立於 76 年，在半導體產業中首創專業積體電路製造服務模式，為全球規模最大的專業積體電路製造公司，持續提供客戶最先進的技術及設計服務。台積電為全球六百多個客戶提供服務，生產超過一萬一千多種的晶片，被廣泛地運用在電腦產品、通訊產品與消費性電子產品等多樣應用領域。台積電的全球總部位於台灣新竹科學園區，在北美、歐洲、日本、中國大陸、南韓、印度等地均設有子公司或辦事處，提供全球客戶即時的業務和技術服務。

該公司與台積電之合作已超過 9 年，主係台積電透過 Turnkey Service 交易模式，由該公司提供台積電晶圓級後護層封裝服務。(Turnkey Service 為半導體業常見之交易模式，係當 IC 設計公司向晶圓製造廠下單時，晶圓製造廠可以提供從晶圓代工、封裝、測試之全套解決方案服務稱之)該公司最近二年度對其之銷售金額分別為 862,283 仟元及 1,732,290 仟元，銷售比率分別為 20.26%及 35.11%，(102 年度包含對台積電(中國)有限公司之銷售約新台幣 81 仟元(美金 3 仟元))。102 年起全球半導體產業復甦，智慧型手持裝置包括智慧型手機及平板電腦的市場需求成長，其中，行動裝置對於個人隱私的保護需求成為市場新趨勢，而指紋辨識感測器即為一獨特且安全之辨識方式。因該公司晶圓級後護層封裝服務所使用之先進封裝技術成熟深獲終端客戶青睞，惟終端客戶為確保產品良率、品質控管及責任分工，並考量整體產品的產能供應鏈生產順暢，遂與台積電合作以 Turnkey 之商業模式合作，由台積電完成晶圓生產再垂直整合下游供應鏈製程，以有效管理並降低產品風險及縮短產品交期，故在行動裝置市場大幅成長帶動指紋辨識感測器之需求下，該公司自 102 年下半年起持續提供台積電指紋辨識感測器之晶圓級後護層封裝服務，103 年度延續訂單熱度，銷售金額持續增加，並首度超越 OVTI 集團，成為該公司第一大客戶。綜上，該公司對台積電之銷售變化情形尚屬合理。

- (2) OVTI集團(OmniVision Technologies，負責人：Shaw Hong；股權淨值：美金1,082,671仟元；設立地區：美國加州；授信條件：月結30天；網址：www.ovt.com)

OmniVision Technologies, Inc.(美國 NASDAQ：OVTI)成立於 84 年，主要營業項目為影像感測器元件之設計、研發及市場銷售，為全球前十大影像感測器元件供應商，全球市佔率高達三成，產品廣泛應用於消費性及商務商品上(例

如手機、筆記型電腦、安全監控系統、數位相機、車用顯示攝影及醫療攝影系統等)，其終端客戶包括國際知名品牌及非主流品牌廠商，並設有 19 家子公司，銷售市場遍及全球。

該公司主要提供其晶圓級尺寸封裝服務予 OVTI 集團，銷售對象主要包括 OmniVision Technologies, Inc.、OmniVision Technologies Singapore Pte. Ltd、OmniVision International Holding Ltd、台灣豪威科技有限公司及台灣豪威光電科技(股)公司等(以下通稱為 OVTI 集團)，產品主要應用於手機、平板及筆記型電腦等。該公司與 OVTI 之交易始於 92 年，與 OVTI 集團業務往來多年且合作關係良好穩定，103 年度因配合市場需求增加對高階影像感測器需求，略為調整對該公司之下單量，致 103 年度該公司對其營業收入為 1,425,860 仟元，較 102 年度為低。綜上，該公司對 OVTI 集團之銷售變化之情形尚屬合理。

(3) A公司

A 公司成立於 92 年，主要營業項目為積體電路及相關電子產品的設計、研發及測試，以及影像感測器的生產，並提供相關技術諮詢服務等，目標客群為中國及新興市場，產品主要應用在智慧型手機、平板電腦等移動裝置。該公司主要提供其晶圓級尺寸封裝服務，產品應用於影像感測器上，該公司配合 A 公司客製化需求而進行封裝服務，最近二年度 A 公司皆為該公司之前五大銷售客戶，對其銷售淨額分別為 484,182 仟元及 476,558 仟元，銷售比率分別為 11.37%及 9.66%，大致呈穩定趨勢。綜上，該公司對 A 公司之銷售變化情形尚屬合理。

(4) B公司

B 公司係國外上市公司，其主要營業項目為設計、製造及銷售類比及混合信號積體電路，產品主要應用在感測器、感測器介面、功率管理積體電路等，並可廣泛應用於消費、工業、醫療、流動通信及汽車市場。

該公司主要提供其晶圓級尺寸封裝服務，應用於影像感測器，最近二年度該公司對其銷售淨額分別為 422,281 仟元及 667,339 仟元，103 年度因該公司製程成熟，故該公司對 B 公司之銷售金額與比重略微回升。綜上，該公司對 B 公司之銷售變化情形尚屬合理。

(5) C公司

C 公司係國外上市公司，除耕耘記憶體市場有成外，基於記憶半導體領域所積累的技術競爭力，亦成功進入影像感測器市場，其產品得以廣泛應用於網路攝影機，微型醫療影像設備，以及搭載相機的行動電話與智慧型手機等。該公司主要提供其晶圓級尺寸封裝服務，產品應用於影像感測器，103 年度因 C 公司調整其產品組合，減少對該公司之下單量，以致該公司對 C 公司銷貨金額下降至 123,377 仟元。綜上，該公司對 C 公司之銷售變化情形尚無重大異常。

(6) D公司

D 公司其成立於 96 年，係國外上市公司之旗下子公司，技術核心聚焦於

影像感測器、系統級晶片整合以及晶圓級攝影機解決方案，主要應用端包括手持式移動設備、消費性電子產品、監視安防攝影機及新興智慧型感測器市場。影像感測器之製造需要結合光學、美學、IC 設計與晶圓製造等四大領域專才，進入門檻高，D 公司於成立 2 年內即推出影像感測器產品，且產品深獲國際大廠採用，於近年在美國影像感測器應用市場之市佔率大幅提升。該公司主係提供 D 公司晶圓級尺寸封裝服務，產品應用於影像感測器，最近二年度該公司對其銷售金額分別為 124,266 仟元及 184,350 元，銷售比率分別為 2.92%及 3.74%，銷售金額及比重穩定，並無發現其銷售變化情形有重大異常情事。

(7) F公司

F 公司成立於 97 年，係台灣上櫃公司之子公司，主營業務項目為影像感測元件的研發、設計、製造及其相關產品之進出口貿易業務。該公司主要提供其晶圓級尺寸封裝服務，產品應用於影像感測器，因 F 公司深耕中國大陸手機市場多年，102 年度銷售金額為 66,657 仟元，然因近年來中國手機市場競爭激烈，F 公司逐步調整產品組合，並轉戰至行車紀錄器及安全監控市場，故其於 103 年度對該公司訂單金額大幅減少為 9,383 仟元。綜上，該公司對 F 公司之銷售變化情形尚屬合理。

(8) G公司

G 公司成立於 89 年，主要係生產噴墨印表頭晶片，該種印表機主要客群為商用印表機需求者及 SOHO 族，商品特色為可快速列印高畫質圖像。該公司主要提供其晶圓級後護層封裝服務，進行微機電元件(MEMS)之重佈線製程。該公司與 G 公司往來超過 5 年，最近二年度對其銷售金額分別為 21,446 仟元及 39,232 仟元，主係因高階智能噴墨列印機市場景氣不佳，造成 G 公司業績不穩定，連帶影響對該公司之下單量。綜上，該公司對 G 公司之銷售變化情形尚屬合理。

(9) H公司

H 公司成立於 86 年，為一專業晶片設計公司，並為全球平面顯示螢幕驅動 IC 之主要供應商，產品成功獲得國際知名平面顯示器供應商之採用。其產品廣泛應用於手機、數位相機、MP3、iPod 等個人消費性電子產品，以及家庭及商業應用的顯示螢幕與數位產品。該公司主要提供其晶圓級尺寸封裝服務，產品應用於影像感測器。該公司自 98 年與 H 公司首次交易，最近二年度之銷售額分別為 106,399 仟元與 48,851 仟元。103 年度因 H 公司持續消化庫存，雖該公司與 H 公司已合作開發其他高階產品方案，仍無法及時挹注 103 年度之銷貨金額，致銷售額大幅下降。綜上，該公司對 H 公司科技之銷售變化情形尚屬合理。

(10)I公司

I公司為全球功率半導體及電源管理方案之領導廠商，係國外上市公司，其生產之整流器可應用於電腦、效率能源應用設備、照明、汽車、衛星、飛機及防衛系統上。過去該公司主要係提供MOSFET功率場效電晶體之封裝服務

(此類產品對可靠度要求高)，惟當時之交易模式屬於台積電Turnkey Service一環，因該公司之封裝品質獲得I公司之肯定，故自101年起I公司開始調整其下單模式，逐步改與該公司直接交易，並自102年起已全面改成直接交易模式，故102年度及103年度銷售金額分別為65,592仟元及70,579仟元。綜上，該公司對I公司之銷售變化尚屬合理。

- (11)比亞迪(深圳比亞迪微電子有限公司，負責人：王傳福；資本額：人民幣2,354,100仟元；設立地區：深圳；授信條件：月結30天)

深圳比亞迪微電子有限公司(以下簡稱比亞迪)設立於93年，是比亞迪股份有限公司(港交所：1211；深交所：002594)的子公司，致力於積體電路及功率器件的開發，並提供產品應用的整套解決方案，主要產品為影像感測器、IGBT 晶片及模組，智慧功率模組(IPM)、功率場效應管(MOSFET)、觸控板等。比亞迪擁有豐富的技術人才，獨立開發出多款具有世界先進水準的產品，並獲得多項中國及國際專利，以及多家國際手機大廠之認可。該公司主要提供其影像感測器之晶圓級尺寸封裝服務，最近二年度該公司對其銷售金額分別為27,533仟元及43,434仟元，主要係因102年起隨着移動互聯網的快速普及和智慧應用的不斷豐富，智慧型手機市場需求上升，帶動比亞迪對該公司之下單量，綜上，該公司對比亞迪之銷售變化情形尚屬合理。

- (12)無錫鴻圖(無錫鴻圖微電子技術有限公司，負責人：魏玉；資本額：人民幣10,000仟元；設立地區：中國江蘇省；授信條件：月結30天；網址：www.hongtuic.com)

無錫鴻圖微電子技術有限公司(以下簡稱無錫鴻圖)成立於101年，為影像感測器核心晶片設計、開發、生產及銷售，產品廣泛應用於手機照相攝像、數碼相機和攝像機、筆記型電腦及網路攝像機、安防監控、汽車照相及醫療窺鏡等領域。該公司主要提供其晶圓級尺寸封裝服務，產品應用於影像感測器與環境感測器，並自102年起開始與其交易，該年度其亦為該公司前十大銷貨客戶之一，最近二年度銷貨金額分別為33,879仟元及5,240仟元，103年因其改變產品組合，且逐漸淡出市場，故對該公司訂單數量減少。綜上，該公司對無錫鴻圖之銷售變化情形尚屬合理。

3.銷貨集中於台積電及OVTI集團之原因、風險及因應措施

- (1)銷貨集中於台積電之原因、風險及因應措施說明如下：

①銷貨集中於台積電之原因

該公司為求長期發展，擬策略性引進半導體業界之技術領導者，以合作發展新技術提昇其製程技術，故於96年辦理私募現金增資發行新股，策略性引進台積電為合作夥伴。該公司與台積電之交易始於95年，雙方係以Turnkey Service模式交易迄今，且主要係提供其晶圓級後護層封裝服務，產品應用於作動感測器及MOSFET功率場效電晶體等。然102年上半年度以前台積電與該公司之交易往來情形並非頻繁，98年以前對台積電之營收占比小於2%，99年至101年銷貨占比亦小於10%，102年下半年度起全球半

導體產業復甦，智慧型手持裝置包括智慧型手機及平板電腦的市場需求成長，其中，行動裝置對於個人隱私的保護需求成為市場新趨勢，而指紋辨識感測器即為一獨特且安全之辨識方式，因該公司晶圓級後護層封裝服務所使用之先進封裝技術成熟深獲終端客戶青睞，因終端客戶考量產品良率、品質控管、責任分工以及簡化供應鏈之管理需要，最終決定委由晶圓代工廠台積電統籌代為管理 (turnkey service)，並由台積電以 Turnkey Service 交易模式下單予該公司，故在行動裝置市場大幅成長帶動指紋辨識感測器之需求下，致使其對該公司之訂單量大幅增加，而有銷售逐漸集中於台積電之情形，102 年度及 103 年度對台積電營收占比分別為 20.26% 及 35.11%。

② 銷貨集中於台積電之風險

A. 終端產品市場反應不如預期，客戶調整產品組合

該公司台積電集團以 turnkey service 交易模式提供其晶圓級後護層封裝服務，封裝產品除主要應用在電源管理 IC 及作動感測器外，自 102 年下半年起持續提供台積電指紋辨識感測器之晶圓級後護層封裝服務，103 年度延續訂單熱度，銷售金額持續增加，因終端客戶為國際知名手機及相關產品的領導品牌，其市佔率高，且推出產品多能深獲市場認同，故客戶調整產品組合之風險有限。

B. 產品日新月異，技術能力不及，客戶轉單給其他同業等

指紋辨識產品應用為終端客戶尋求多項解決方案及評估後，對該公司之技術予以肯定，進而透過晶圓代工大廠台積電以 turnkey service 交易模式合作下單。由於終端客戶之產品近年來持續為全球手機及相關產品之領導品牌，其對本身產品供應鏈之品質、交期、良率、產能、環境安全及社會責任等方面均有高度要求，且認證程序繁雜且費時，因此，在終端客戶為確保產品之品質穩定度，且在指紋辨識產品訂單量成長下，其轉換封裝廠成本極高。另該公司之封裝技術具多項專利之保護，故一般公司進入前需先迴避該公司之專利佈局始得從事相關業務，故因該公司在產品規模、品質、效能及交期均能配合台積電與終端客戶之需求供貨，是以，轉單給其他同業之風險有限。而該公司藉由此種交易模式，不僅精進封裝能力與品管要求，更能掌握產業動向，成為半導體供應鏈上下互惠之典範。

C. 投入之設備資金成本高

該公司配合終端客戶指紋辨識感測器量產訂單及產品上市時程，進行相關設備採購及生產，並於 102 年積極佈建生產設備，然在產品銷售初期市場的接受度難以預估，為維護該公司利益並保障已投入之成本未來得以回收，由台積電與終端客戶協議，支付該公司投入設備之產能保證金，並由台積電代收代付轉交該公司，以降低該公司投入設備之資金成本之風險。由於 103 年初指紋辨識感測市場接受度良好，故經協議後該公司已返還相關產能保證金。

③銷貨集中於台積電之因應措施

由於該公司提供之晶圓級後護層封裝服務獲得終端客戶之認可，始有相關之訂單挹注營收，然隨著指紋辨識產品應用為市場接受，新興之 IC 設計公司紛紛投入此產品之開發，該公司陸續開發指紋辨識之市場應用，期能持續營收之成長並降低單一客戶之風險。該公司藉由持續各類研發技術的精進，除持續開發更多新客戶外，並能將現有之晶圓級後護層封裝服務客戶轉為晶圓級尺寸封裝服務項下，為其提供更完整之封裝服務，成為客戶信賴之長期合作夥伴，滿足客戶產品及時上市(Time to market)與及時量產(Time to volume)之需求。

綜上評估，該公司透過台積電 turnkey service 模式與國際知名手機品牌大廠之合作經驗，有效提升公司知名度及市場佔有率等，且該公司持續強化研發能量，並為打入世界品牌大廠供應鏈建立良好基礎，且該公司並已積極開發新客戶，未來對單一客戶之依存度可望降低，應可有效降低銷貨集中之風險。

(2) 銷貨集中於 OVTI 集團之原因及風險評估如下：

①銷貨集中於 OVTI 集團之原因

該公司與 OVTI 集團之交易始於 92 年，係提供 OVTI 集團晶圓級尺寸封裝服務，產品之應用市場由原本之手機，後又擴及筆記型電腦及平板電腦等。由於產業特性因素，該公司所提供的封裝服務係涉及 OVTI 集團之 IC 設計，需要在產品初期即與 OVTI 集團密切合作，在其封裝產品可靠度及產能等獲 OVTI 集團之認可後，93 年度起 OVTI 集團大量將其影像感測器交由該公司封裝，且由於 OVTI 集團在全球市佔率較高，故訂單量亦較多，在該公司新產品(新技術)及新客戶尚未開發階段，致該公司之銷貨有集中於 OVTI 集團之情形。

②銷貨集中於 OVTI 集團之風險

A.終端產品市場競爭激烈或反應不如預期，客戶調整產品組合

OVTI 集團之產品廣泛應用於消費性及商務商品上(例如手機、筆記型電腦、安全監控系統、數位相機、車用顯示攝影及醫療攝影系統等)，其中，消費性產品之競爭者眾，若因終端產品市場競爭激烈，或因新世代產品之市場反應不如預期，客戶調整產品組合，進而對該公司之訂單價量有所調整，均可能造成該公司之營業收入及毛利受到影響。以該公司最近二年度對 OVTI 集團之銷售狀況而言，其銷售金額分別為 1,580,579 仟元及 1,425,860 仟元，103 年度因配合市場需求增加對高階影像感測器需求，略為調整對該公司之下單量，致 103 年度該公司對其營業收入略為下滑。OVTI 集團對該公司之下單及市場反應狀況，對該公司雖有一定程度之影響，然該公司已持續開發其他新客戶，將客戶調整產品組合所造成的影響降至最低。

B. 產品日新月異，技術能力不及，客戶轉單給其他同業等

該公司使用之 3D 晶圓級尺寸封裝技術較適用於中低畫素以下之影像感測器，且該項封裝方式受到 ShellCase 之專利保護，一般公司進入 3D 晶圓級尺寸封裝具一定門檻。該公司與 OVTI 集團為長期合作夥伴，品質及服務深受信賴，OVTI 集團每更換一次產品設計或調整封裝製程，均需經過一定花費及時間進行產品功能及可靠度測試驗證，在半導體業生產供應鏈之相關認證均屬嚴格之情況下，將造成 OVTI 集團更換封裝廠成本增加。

③銷貨集中於 OVTI 集團之因應措施

由於該公司長期以來致力於各類研發技術的精進，並投以大量資本支出於建置產線所需設備，加上封裝產業具有進入障礙門檻，且該公司所提供之 3D 晶圓級尺寸封裝技術為全球應用該技術之廠商中最大規模者，故短期內同業競爭之壓力應較低。此外，該公司亦持續以自身優質技術承接其他客戶之訂單，致使 OVT 集團占該公司營收比重已從 93 年曾高達 87.97%逐年下滑至 103 年度之 28.90%。該公司除深耕於 3D 晶圓級尺寸之封裝技術領域之研究，以強化產品競爭力，致力於維護與客戶之合作關係，協助客戶開發新產品，同時並持續精進晶圓級相關先進製程技術之開發，未來期能將業務擴展至晶圓級系統整合封裝(System in Package)外，並建置 12 吋晶圓級封裝之產線，以因應高端感測器客戶之需求，希冀藉由封裝服務技術暨應用產品之多元化，增加新領域產品營收以及開發更多新客戶，並提供客戶最佳之封裝解決方案，以積極降低製造成本及提升生產效能，進而提升或維持利潤。

綜上評估，因 OVTI 集團係屬該公司之影像感測器客戶，該類型客戶具有管理整體供應鏈(包括晶圓代工、彩色濾光片、晶圓重置(Reconstruct wafer)、3D 晶圓級尺寸封裝、測試等)之能力，因此該公司對影像感測器之客戶近年來已均採直接接單模式，客戶亦直接與該公司合作開發，無需透過 turnkey service 模式，以有效降低客戶營運成本。另由於 OVTI 集團為影像感測元件領導廠商，隨著半導體業朝大者恆大發展的趨勢下，使得下游之封裝廠商容易有銷貨集中之情形。是以，該公司受產業特性影響，導致其銷售予 OVTI 集團有銷貨集中之情事，惟經評估其銷貨集中風險應屬有限，未發現異常之情事。

4. 營業成本及營業毛利變化原因及其合理性分析

單位：新台幣仟元

年度 主要產品	102 年度			103 年度		
	營業 成本	營業 毛利	毛利率 (%)	營業 成本	營業 毛利	毛利率 (%)
晶圓級尺寸封裝	2,806,314	502,099	15.18	2,804,237	224,562	7.41
晶圓級後護層封裝	696,557	224,076	24.34	1,167,071	712,899	37.92
其他	58,748	(31,033)	(111.97)	14,566	10,743	42.45
合計	3,561,619	695,142	16.33	3,985,874	948,204	19.22

資料來源：該公司提供。

該公司主要係於晶圓上利用相關製程技術從事晶圓加工，其晶圓係由銷貨客戶所提供，另配合特定客戶需求委託耀穎光電(股)公司進行光學薄化玻璃之加工鍍膜外，均為自製後即運送至下游廠商。該公司最近二年度營業成本分別為 3,561,619 仟元及 3,985,874 仟元，毛利率分別為 16.33%及 19.22%，其中，晶圓級尺寸封裝服務之營業成本分別為 2,806,314 仟元及 2,804,237 仟元，營業毛利及毛利率則分別為 502,099 仟元、224,562 仟元及 15.18%及 7.41%；而晶圓級後護層封裝服務之營業成本分別為 696,557 仟元及 1,167,071 仟元，營業毛利及毛利率則分別為 224,076 仟元、712,899 仟元及 24.34%、37.92%，有關營業毛利變化，請參閱「主要產品別說明營業收入變化分析」。

在營業成本方面，該公司最近二年度晶圓級尺寸封裝服務之營業成本分別為 2,806,314 仟元及 2,804,237 仟元。103 年度營業成本除分攤相關折舊等固定成本、分攤水電費以及隨銷量成長而增加投入之相關原物料成本、權利金支出(支付予 shellcase)等因素外，另因新增佈建 12 吋封裝生產線而產生之建置成本，致 103 年度營業成本達 2,804,237 仟元。

該公司最近二年度晶圓級後護層封裝服務之營業成本分別為 696,557 仟元及 1,167,071 仟元。變化主係因指紋辨識感測器之出貨暢旺，其製程相對其他封裝製程繁複，致使相關原物料及人事成本(陸續增聘員工)增加，且因應指紋辨識感測器購置相關固定資產，其使用專用機台之比重較高，故認列之設備折舊費用金額亦較多，加上該公司 103 年進一步將產能建置重新分配(將部分其他封裝製程之產能調整至指紋辨識感測器之產能)，致使分攤之設備折舊成本及相關水電費等亦持續上升，致整體營業成本大幅成長。整體而言，該公司晶圓級後護層封裝服務受到指紋辨識感測器產品進入量產之影響，該類產品無論在製程光罩數及使用專用機台比重等均較其他晶圓級後護層封裝服務產品為高，導致成本結構產生變化，營業成本亦隨營收逐年增加。

5.最近二年度及申請年度與二家同業財務報告損益資料分析比較

申請公司與二家同業財務報告損益資料分析比較

最近二年度及最近期申請公司與二家同業之營業收入及毛利率一覽表

單位：新台幣仟元

公司名稱	年度 項目	102 年度		103 年度	
		金額	%	金額	%
精材	營業收入淨額	4,256,761	100.00	4,934,078	100.00
	營業成本	3,561,619	83.67	3,985,874	80.78
	營業毛利	695,142	16.33	948,204	19.22
日月光	營業收入淨額	219,862,446	100.00	註	註
	營業成本	177,048,702	80.53	註	註
	營業毛利	42,813,744	19.47	註	註
菱生	營業收入淨額	6,047,661	100.00	註	註
	營業成本	5,150,628	85.17	註	註
	營業毛利	897,033	14.83	註	註

資料來源：各公司經會計師查核簽證之財務報告。

註：尚未公告 103 年度財務報告。

該公司為專業晶圓級 IC 封裝之領導廠商，主要服務包括晶圓級尺寸封裝服務與晶圓級後護層封裝服務，晶圓級尺寸封裝主要應用於影像感測器及環境感測器等光學感測元件，晶圓級後護層封裝服務主要應用於功率分離式元件、微機電系統感測器元件、生物辨識感測器元件和整合式被動元件等。綜觀目前國內上市櫃及興櫃公司，封裝技術及產品組合並無與該公司完全相同者，故以同為半導體封裝及測試產業及部分產品應用端相同作為取樣之依據：上市公司日月光主要係從事各型積體電路之製造、組合、加工、測試及外銷，亦有封裝影像感測器模組及生物辨識感測器模組與該公司產品應用端相同；上市公司同欣主要係從事高頻無線通訊模組、混合積體電路模組、陶瓷電路板及影像產品等電子產品生產及銷售，亦有影像感測器封裝與該公司產品應用端相同；上市公司菱生主要係從事各積體電路及各種半導體零組件之封裝加工、測試、製造及買賣，亦有用於手機或行動裝置之環境光學感測器模組封裝測試與該公司產品應用端相同，茲就該公司最近二年度之營業收入、營業毛利及營業利益與同業之比較分析如下：

(1)申請公司與二家同業最近二年度之營業收入淨額變化分析

該公司 102 年度及 103 年度之營業收入分別為 4,256,761 仟元及 4,934,078 仟元，營業收入呈成長趨勢，主係因 102 年度全球經濟景氣逐漸復甦，受惠於智慧行動裝置需求增加，帶動整體半導體產業成長，該公司業績跟著上揚，且因應行動裝置對於個人隱私的保護需求，指紋辨識感測器之市場需求大幅增加，該公司於 102 年下半年成功導入該項封裝產品並進入量產，致 102 年度及 103 年度之營收與獲利均有顯著之貢獻。

與採樣同業相較，由於封裝產業為高度客製化之產業，又各採樣公司封裝服務內容及營運規模互異，故營收成長趨勢不盡相同。日月光受惠於市場對影像感測器之需求大幅增加，營收呈成長趨勢，而菱生因微機電(MEMS)元件市場成長趨緩，以及面對第一季為傳統淡季之影響，其營收呈衰退趨勢，該公司則受惠於指紋辨識感測器封裝產品之挹注，其營收成長率均優於採樣同業，變化原因尚屬合理。

(2)申請公司與二家同業最近二年度之毛利變化分析

該公司 102 年度及 103 年度之營業毛利分別為 695,142 仟元及 948,204 仟元，營業毛利率則分別為 16.33%及 19.22%。由於封裝服務產業為資本密集之產業，其相關設備之折舊費用通常佔營業成本較高比重，103 年度延續毛利較高之指紋辨識感測器訂單熱度，毛利率較 102 年度為高。與採樣公司相較，該公司隨營收增加及新產品之挹注及產能利用率提升，毛利率介於採樣同業間尚屬合理。

6.營業費用及營業利益變化原因及其合理性分析

單位：新台幣仟元

項目	年度	102 年度		103 年度	
		金額	占營收比率	金額	占營收比率
推銷費用		38,049	0.89%	39,809	0.81%
管理費用		110,494	2.60%	147,006	2.98%
研究發展費用		216,971	5.10%	276,680	5.61%
營業費用合計		365,514	8.59%	463,495	9.39%
其他收益及費損淨額		51,008	1.20%	190,921	3.87%
營業利益(損失)		380,636	8.94%	675,630	13.69%

資料來源：該公司各期間經會計師查核簽證之財務報告。

(1)營業費用

該公司 102 年度及 103 年度之營業費用分別為 365,514 仟元及 463,495 仟元，包含推銷費用、管理費用及研究發展費用，茲分述如下：

①推銷費用

該公司 102 年度及 103 年度之推銷費用分別為 38,049 仟元及 39,809 仟元，該公司推銷費用包含薪資及獎金(包括本薪、加班費、年終獎金、績效獎金、員工分紅費用、員工認股權計畫酬勞成本等)、廠房租金、進出口費用、保險費及退休金等，最近二年度相較差異不大。

②管理費用

該公司 102 年度及 103 年度之管理費用分別為 110,494 仟元及 147,006 仟元，該公司管理費用包含薪資及獎金(包括本薪、加班費、年終獎金、員工分紅費用化、員工認股權計畫酬勞成本、員工股票增值計畫酬勞成本等)、電腦及通訊設備等設備之修繕費、電腦軟體之攤銷費用、退休金、董監事酬勞等。103 年度之管理費用 147,006 仟元較去年同期相較增加 36,512 仟元，主要包括員工分紅費用增加 6,887 仟元、員工股票增值計畫酬勞成本增加 12,059 仟元及因營運狀況較佳，致使整體薪資及獎金較 102 年度增加 19,202 仟元，又因其他管理費用互有消長，致整體 103 年度之管理費用較 102 年度成長。

③研究發展費用

該公司 102 年度及 103 年度之研究發展費用分別為 216,971 仟元及 276,680 仟元，該公司研發費用包含研發人員薪資及獎金(包括本薪、加班費、年終獎金、績效獎金、員工分紅費用化、員工認股權計畫酬勞成本等)、間接物料費、模具費及委託研究費、專利權及電腦軟體之攤銷費用等，該公司 103 年度之研究發展費用較 102 年度增加 59,709 仟元，主係因研發人力之擴編(103 年度平均 175 人較去年同期增加 39 人)，給予研發單位之加班費、相關年終獎金、績效獎金增加，又因認列員工分紅費用計 13,995 仟元，致 103 年度整體薪資及獎金費用較 102 年同期成長 31,808 仟元，而該公司 103 年持續強化研發能量，產生實驗相關費用(如實驗耗材及儀器租用)

所需之實驗用品、模具費用及因添購研發設備而產生之折舊攤提費用等分別較 102 年度增加 4,364 仟元、5,815 仟元及 6,636 仟元，又因其他研發費用互有消長，致整體 103 年度之研發費用較 102 年度成長。

(2)其他收益及費損淨額

該公司 102 年度及 103 年度之其他收益及費損淨額分別為 51,008 仟元及 190,921 仟元，包含出租資產收益、不動產、廠房及設備減損損失、處分不動產、廠房及設備淨益及其他：

單位：新台幣仟元

項目	102 年度		103 年度	
	金額	占營收比率	金額	占營收比率
出租資產收益淨額	48,984	1.15%	285,914	5.79%
不動產、廠房及設備減損損失	(3,804)	(0.09%)	(86,067)	(1.74%)
處分不動產、廠房及設備淨益	2,670	0.06%	236	-
其他	3,158	0.07%	(9,162)	(0.19%)
其他收益及費損淨額	51,008	1.20%	190,921	3.87%

資料來源：該公司各期間經會計師查核簽證之財務報告

①出租資產收益

該公司 102 年度及 103 年度之出租資產收益淨額分別為 48,984 仟元及 285,914 仟元。此係因指紋辨識感測器為特定客戶產品之創新應用，對其產品問市時程影響甚鉅，特定客戶原係直接與該公司接洽開發合作新產品，惟因考量整體產品的產能供應鏈生產順暢，最後採由台積電 turnkey service 的方式為特定客戶提供服務，並透過台積電發包(One-stop Shopping Service)委由該公司進行封裝業務。然而，當時因該公司現有廠房空間有限，且該公司於短期間內無法覓得或立即建置適合之無塵室廠房放置所有符合產能需求之相關設備，故該公司與台積電協議將部分設備出租並放置於台積電。且係因放置於台積電廠房，基於員工管理、營運風險及業務機密等因素之考量，又該公司於園區並無分公司之設置，無法於台積電廠房負責管理營運相關設備，遂以租賃設備方式，由台積電自行負責部分封裝服務。該公司自 102 年 7 月按月認列租金收入並逐季收款，102 年度共計收取租金 151,006 仟元，扣除相關出租資產折舊後淨額為 48,984 仟元，而 103 年因合約條件略有調整，且認列期間為全年度，故出租資產收益淨額達 285,914 仟元。

②不動產、廠房及設備減損損失

該公司 102 年度及 103 年度之不動產、廠房及設備減損損失分別為 3,804 仟元及 86,067 仟元。102 年度主要為晶圓級尺寸封裝製程改變(原有製程中，若客戶送來之晶圓上已完成部分製程(Dam on wafer)，則後續製程所需之玻璃壓合機較為單純，新製程(Dam on glass)則可使良率較高，且平均單位售價亦增加。)新製程所需之玻璃壓合機可同時應用於兩種製程之需求，故將不適用於新製程之機台認列資產減損；另自 103 年第二季起為增

進資產管理效率，將閒置資產提列政策從嚴認定由「為閒置期間累積滿 18 個月且未來 6 個月無使用需求者即提列減損損失」改為「閒置期間累積滿 6 個月且未來 18 個月無使用需求者即提列減損損失」，103 年度減損損失 86,067 仟元主係經評估製程改變後已無使用需求、無法改機或改機不符成本效益等封裝設備，經評估尚無重大異常情事。

③處分不動產、廠房及設備淨益

該公司 102 年度及 103 年度之處分不動產、廠房及設備淨益分別為 2,670 仟元及 236 仟元。係因部分製程進行轉換後，若干設備已不再使用，經該公司評估而出售該等固定資產，進而產生淨處分固定資產利益。

④其他

該公司 102 年度及 103 年度之其他項金額分別為 3,158 仟元及(9,162) 仟元。102 年度主係備抵呆帳損失迴轉轉列收入。103 年度之其他損失係因該公司向一寶科技(股)公司(以下簡稱一寶)採購 Lam 蝕刻機台，然一寶未符合該公司要求，雙方經爭訟後，一寶因無法再上訴，且進行強制執行程序中，此案件原已支付價金 10,105 仟元(未稅)，扣除經該公司評估尚可回收金額 2,503 仟元後，將差額再加計原機台配管資本支出 1,560 仟元(需拆除)全數轉列為其他營業損失 9,162 仟元。

(3)營業利益(損失)

該公司 102 年度及 103 年度之營業利益分別為 380,636 仟元及 675,630 仟元，雖營業費用逐年增加，惟因受惠於景氣復甦，市場需求勁揚，致使訂單暢旺，產能利用率與毛利率亦隨之上升，另因該公司 102 年下半年度起新接之指紋辨識感測器訂單大幅挹注營收，且該品項 102 年度及 103 年度毛利率分別高達 28.19%及 41.66%，均致使該公司之營業收入、毛利呈現成長趨勢，另因收取出租資產收益淨額，致營業利益持續增加。

7.營業外收支變化原因及其合理性分析

單位：新台幣仟元

項目		年度	102 年度	103 年度
利息收入			4,575	6,114
其他利益及損失	透過損益按公允價值衡量之金融工具淨損失		(20,661)	(51,338)
	外幣兌換淨益		12,117	49,819
	保險理賠收入		-	8,856
	其他		254	4,803
財務成本			28,158	33,958
合計			(31,873)	(15,704)

資料來源：該公司各期間經會計師查核簽證之財務報告

(1)利息收入

該公司最近二年度之利息收入分別為 4,575 仟元及 6,114 仟元，主係該公司銀行活存與定存產生之利息收入，各期金額及變動尚非屬重大。

(2)其他利益及損失

①透過損益按公允價值衡量之金融工具淨損、外幣兌換淨益

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	102 年度	103 年度
透過損益按公允價值衡量之金融工具淨損(A)	(20,661)	(51,338)
外幣兌換淨益(B)	12,117	49,819
淨額(C=A+B)	(8,544)	(1,519)
營業收入(D)	4,256,761	4,934,078
營業淨利(E)	380,636	675,630
C/D(%)	(0.20%)	(0.03%)
C/E(%)	(2.24%)	(0.22%)

資料來源：該公司各期間經會計師查核簽證之財務報告

該公司最近二年度之透過損益按公允價值衡量之金融工具淨損分別 20,661 仟元及 51,338 仟元，外幣兌換淨益為 12,117 仟元及 49,819 仟元，主係該公司之進、銷貨多以美元計價，為規避因外幣淨資產部位所產生之匯率風險，進而操作衍生性金融商品而產生之遠期外匯損益，大致隨美元兌台幣匯率變動增減，由上表可知，該公司 102 年度及 103 年度之淨兌換損失占各年度營業收入淨額及營業淨利之比例分別為(0.20%)、(0.03%)及(2.24%)、(0.22%)，各年之淨兌換損失占營收淨額及營業淨利比重均尚非重大，故對匯兌波動對該公司之影響有限。

②保險理賠收入

該公司 103 年度之保險理賠收入為 8,856 仟元，係該公司於 101 年因一批待驗收之空氣污染防治設備等機台發生燒燬事件，並於 103 年取得保險公司給付之理賠收入。

③其他

該公司最近二年度之其他收入分別為 254 仟元及 4,803 仟元，103 年度金額大幅增加主係因該出售整修 Line C 所拆除原交易相對人佳鼎公司遺留之廠務設施廢料予回收公司之款項共計 2,048 仟元，另因部分應付設備款掛帳多年，業經徵詢會計師意見後轉列其他收入共計 5,782 仟元，另該公司委由利昌電機企業社(以下簡稱利昌)進行一批機台設備之升級工程，然因該廠商逾期未能開發完成，故該公司提起返還價金之訴訟，並經台灣桃園地方法院民事判決確定，該廠商應返還該公司已付價款 3,938 仟元與利息。惟因利昌並無財產可供法院進行債權扣押，該公司評估無法收回之可能性極高，故於 103 年度抵銷應付利昌之設備款 631 仟元後，將剩

餘款項 3,307 仟元全數認列其他損失，致 103 年度之營業外收支-其他淨額大幅增加。

(3)財務成本

該公司最近二年度之財務成本分別為 28,158 仟元及 33,958 仟元，主係該公司向銀行借款產生之利息費用，大致隨該公司借款金額及期間長短而有所增減，經評估應無重大異常。

(三)該公司未來發展性之評估

1. 行業未來發展趨勢

該公司從事半導體產業中後段製程之封裝服務，主要係提供晶圓級尺寸封裝服務及晶圓級後護層封裝服務，產品可應用於影像感測器、環境感測器、作動感測器、指紋辨識感測器及 MOSFET 功率場效電晶體等，為智慧型手機、個人電腦、平板電腦、電源供應裝置等產品不可或缺之元件。其中，該公司主要封裝之光學元件及指紋辨識感測器等，主要應用於智慧型行動裝置(例如手機、筆記型電腦及平板電腦等)，約佔該公司營收比重九成以上，故智慧型行動裝置出貨情況與該公司近期業績變化息息相關。茲就其產業及應用領域之現況及未來發展趨勢說明如下：

(1)IC 封裝產業之現況

台灣 IC 產業以特有之上下游垂直分工方式獨步全球，產業價值鏈分工極細且結構完整，包括上游化學材料與矽晶圓，中游 IC 設計業、IC 製造業、IC 封裝業、IC 測試業，以及下游的終端 PC/NB、手機及消費性電子之系統廠商。由 IEK2014 年 5 月之統計資料顯示，台灣 IC 封裝及測試業在全球 IC 封測市場自 2011 年迄 2013 年均保持 55% 以上之全球市占率。由於 2011 年受到日本 311 震災、歐盟債務和泰國水災等接連事件的交互影響下，全球經濟發展始終不如預期順遂，連帶拖累全球半導體產業產值表現，亦使得我國半導體各次產業產值呈現成長趨緩或衰退，我國 IC 封裝產業產值較 2010 年衰退 6.1%；而 2012 年全球景氣一片不明朗，歐、美、大陸三大經濟體的經濟狀況都持續呈現低迷景象，其中，歐洲在歐債與高失業率的雙重打擊下，以及美國財政懸崖的不確定性，消費市場終端需求持續不振，智慧型手機及平板電腦雖成長優異，惟因 PC 產業買氣不振，進而影響全球半導體產業的表現，我國 IC 封裝產業產值僅較 2011 年微幅成長 0.9%；2013 年由於智慧型手機及平板電腦市場需求趨緩，我國 IC 封裝產業產值較 2012 年微幅成長 4.6%；2014 年由於已開發國家經濟開始復甦成長，PC 市場經過幾年的成長停滯後，2015 年可望持穩不再衰退，而中低階智慧型手機則因在新興市場大幅成長抵銷高階智慧型手機成長趨緩之不利影響，整體手機數量依舊成長，手機晶片之高階封測產能、覆晶及晶圓凸塊需求仍持續增加，足見智慧型手機及平板電腦是 2014 年推升預估 IC 封裝業主要成長動力，故 IEK 預估 2014 年我國 IC 封裝產業產值較 2013 年成長 13.9%。

(2) 手機產業之現況與發展

2013 年受北美、歐洲及日本之景氣尚未全面復甦，以及手機市場逐漸飽和且成長趨緩的影響，手機品牌大廠除積極布局高階智慧型手機外，亦紛紛推出中階旗艦款或中低價位之智慧型手機搶攻市場，促使以低價高規為訴求的新興市場(例如：中國大陸、印度及巴西等)之多數功能型手機用戶，將手機汰換為智慧型手機，致使 2013 年手機出貨量達 18.4 億支，仍較 2012 年成長 5.4%，其中，中國大陸已成為全球最大的智慧型手機市場，故 IEK 預估 2014 年在中國大陸為主的新興市場需求強勁帶動下，手機出貨量將達 19.0 億支，成長率 3.5%，且 2015 年及 2016 年亦維持成長趨勢。

(3) 筆記型電腦產業之現況與發展

2013 年全球經濟雖未持續惡化，原市場預期之觸控筆記型電腦與 Windows 8 之換機潮均未明顯提升筆記型電腦之市場需求，致 2013 年全球筆記型電腦出貨量僅 160.3 百萬台，衰退幅度達 16.5%。在面對平板電腦市場排擠效應下，筆記型電腦業者已持續致力於提升產品效能，希冀能與以娛樂功能為主之平板電腦做出市場區隔外，又將平板電腦輕薄及方便攜帶移動等優勢納入產品設計，然而，近來市面上出現能自由轉換平板電腦與筆記型電腦的二合一產品，同時兼納桌上型電腦、筆記型電腦及平板電腦的三合一產品，致使筆記型電腦及平板電腦的界線逐漸模糊。雖筆記型電腦出貨持續萎縮，但因 Microsoft 停止支援 Windows XP，企業換機潮可望帶動商用筆記型電腦的出貨成長，故 IEK 預估 2014 年全球筆記型電腦出貨量可達 148.9 百萬台，成長率衰退幅度可降至 10% 以內。

(4) 平板電腦產業之現況與發展

隨著平板電腦市場趨於成熟，已不見甫出現之高成長率，但相對於桌上型電腦及筆記型電腦，仍屬成長性高之產品。2013 年全球平板電腦出貨量達 220 百萬台，較 2012 年成長 51.8%，首度超越筆記型電腦，顯示對於行動裝置市場來說，平板電腦已逐漸取得領先地位。且由於市場開始進入成熟期，消費者更著重在平板電腦產品的多樣性，可通話之平板電腦、結合數位家電與大尺寸螢幕將為 2014 年平板電腦的新趨勢，而 7 吋低價平板電腦提升新興市場對平板電腦的接受度，也將持續帶動平板電腦產品出貨成長，故 IEK 預估 2014 年全球平板電腦出貨量將達 263 百萬台，成長率 19.7%。

(5) 汽車電子產業之現況與發展

近年來技術逐漸成熟化的汽車，支援電子控制技術的汽車電子產品主要是搭配各種感測器(如影像、加速度、壓力或溫度等)、微電腦控制器、影音娛樂機器、衛星導航機、無線通訊等產品應用與服務，提供車輛及人員有關節能減碳、低噪音污染、舒適、主動與行車安全、保全、緊急救援與道路指引等功能，讓汽車操控更具人性化，更加聰明且符合智慧化需求。根據全球汽車產業分析機構 IHS Automotive 的統計數據顯示，2013 年全球汽車銷售量約為 8,280 萬輛，較 2012 年成長 4.2%，創全球年度汽車銷量新紀錄，預估 2014 年汽車出貨量將達 8,500 萬輛。

(6) 穿戴式裝置產業之現況與發展

2014 年國際消費電子展(47th International Consumer Electronics Show 2014, CES)中，以穿戴式技術產品之裝置成為 CES 展之焦點，全球之廠商紛紛開始進軍於穿戴式技術領域市場。目前智慧穿戴式裝置應用範圍橫跨數大產業，包含安全、醫療、健康、運動、生活運算、通訊及穿著等領域，尚包括安全與保全、軍事用途等特殊領域市場，其中，醫療居家照護、資訊娛樂相關及運動健身三大應用領域成長最快，其應用領域。智慧穿戴式裝置有四個關鍵的發展方向，分別為感應器、雲端網路、資料分析及整合服務。在感應器方面，透過大量感應器來抓取各種不同的資料，使得感測器種類逐漸增多，讓裝置能獲得之資料種類增加，亦可導致感測種類的需求增加，新的感測器出現或是原本既有的裝置開始小型化，進而帶動先進封裝在穿戴式裝置之應用。根據拓璞產業研究所研究報告指出，預估全球穿戴式消費電子出貨量在 2014 年達到 3,930 萬台，成長率 49.32%，而 2015 年將出貨 6,570 萬台，成長率 67.1%。

綜上所述，該公司所屬行業未來之成長動力主要來自於筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機等消費性通訊電子及智慧型手持裝置產品，而歐美市場日趨成熟，大陸及其他新興市場將成為消費主力之趨勢下，將促使各終端應用產品售價日趨平價。

2. 該公司之競爭優勢

(1) 生產效率提升，降低成本提升競爭優勢

近年積極加速設備自動化及生產線流程優化，以提升產品良率與產能稼動率，並整合資源利用各廠區產能機動調配之方式，快速提供產品及服務，取得客戶長期穩定之信賴。

(2) 技術領先暨產品應用多樣化

該公司經營團隊具備多年 IC 半導體研發、生產暨銷售經驗，除產品優良、交期迅速、售後服務良好深受客戶信賴外，市場行銷與研發團隊建立完整的新技術專利，目前所擁有之各國專利將近兩百項，並配合客戶產品需求開發出多種先進之晶圓層級封裝解決方案，獲得國際品牌大廠認可。

(3) 產業鏈優化與整合

該公司為台積電策略投資之公司，除利用本身之先進技術與業務開發能力建立強大之客戶群外，更結台積電在半導體供應鏈中之龍頭地位提供上下游完整之一條龍服務(Turn-key service)，並透過與台積電(晶圓供應商)技術緊密整合，提供客戶最先進、快速且完整之封裝解決方案。

(4) 國際分工之優勢

我國封裝業的發展，即以扮演全球半導體業供應鏈夥伴的定位，藉先進技術發展策略及整合品質、成本、交期、產能、服務總體運籌優勢，締造在國際分工體系中的總體競爭地位。該公司身為先進晶圓層級封裝服務之提供者，不僅提供國內外客戶上游 IC 設計公司完整之供應生產體系，並藉由與 IC foundry 公司合作，解決生產過程衍生之相關議題。

(四)綜合具體結論

該公司從事半導體產業中後段製程之封裝服務，主要係提供晶圓級尺寸封裝及晶圓級後護層製程服務，產品可應用於影像感測器、環境感測器、作動感測器、MOSFET 功率場效電晶體及指紋辨識感測器等，為智慧型手機、個人電腦、平板電腦、電源供應裝置等產品不可或缺之元件。其最近二年度之營業收入分別為 4,256,761 仟元及 4,934,078 仟元，主係因受惠於智慧行動裝置需求增加，帶動整體半導體產業成長，且自 102 年下半年起，該公司成功切入指紋辨識感測器之供應鏈，大幅挹注其營收與獲利。而其最近二年度之營業毛利率則分別為 16.33%及 19.22%，103 年度延續指紋辨識感測器訂單熱度，毛利率亦呈成長趨勢；而在營業費用方面，該公司最近二年度之營業費用分別為 365,514 仟元及 463,495 仟元，該公司除因業績逐年成長，導致相關營業費用增加外，另該公司 103 年持續強化研發能量，所需之實驗用品、模具費用及添購研發設備所產生之折舊攤提費用等分別較上年度為高，均致使營業費用金額增加。該公司最近二年度之營業利益分別為 380,636 仟元及 675,630 仟元，除因營收及毛利之成長因素外，另因收取出租資產收益淨額持續增加所致。另在營業外收支淨額方面，最近二年度之營業外收支淨額分別為(31,873)仟元及(15,704)仟元，各期間為因應營運需求持續增加銀行借款，致財務成本較高，而 103 年度則因獲得保險理賠收入、出售舊廠務設施廢料收入，以及掛帳多年之應付設備款轉列其他收入等因素，致營業外淨支出較過去年度為低。

綜上所述，該公司最近二年度之營運規模受智慧型手機、個人電腦、平板電腦市場需求增溫影響，帶動其成長動能，在因應電子產業及半導體產業市場與其技術的不斷變化，該公司持續開發先進製程與新衍生技術，以製造功能更多的產品，藉由產品功能的提升及提高產能利用率以降低固定成本，進而提升或維持利潤，並希冀隨著該公司成功切入主要銷貨客戶之供應鏈，以及終端市場需求量增加，未來該公司之營運可望隨之持續成長。

貳、公司概况

一、公司簡介

(一)設立日期：中華民國 87 年 9 月 11 日

(二)總公司、分公司及工廠地址及電話：

名 稱	地 址	電 話
總 公 司	桃園市中壢區吉林路 23 號 9 樓	(03)433-1818
Line-A	桃園市中壢區吉林路 25 號	(03)433-1818
Line-B	桃園市中壢區自強二路 1 號	(03)433-1818
Line-C	桃園市中壢區中園路 188 號	(03)433-1818

(三)公司沿革：

日期	重要記事
87/09	精材科技股份有限公司成立，實收資本額新台幣 280,000 仟元。
89/05	與 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.（原以色列商雪兒凱斯 ShellCase Ltd.）簽定技術授權合約，引進晶圓級封裝技術，並開始從事積體電路封裝業務。
89/10	獲准進駐桃園縣中壢工業區設廠。
90/10	開始進入試產、量產階段。
91/03	通過 ISO9000 品質認證。
92/02	通過 QS9000 品質認證。
92/12	經向證期會申報生效後，為股票公開發行公司。
93/07	獲准成立保稅工廠。
93/09	經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准登錄為興櫃股票。
94/01	通過 ISO14001 環境管理系統認證。
94/12	通過 TL9000 品質管理系統認證。
94/12	英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company 持有本公司股份 30% 成為最大股東。
94/12	中壢 Line-A 廠的 8 吋 CSP 月產能達 10,000 片。
95/09	中壢 Line-A 廠的 8 吋 CSP 月產能達 20,000 片。
95/12	取得中壢 Line-B 廠。
96/01	辦理私募現金增資，策略性引進台灣積體電路製造股份有限公司投資持有本公司股份 43% 成為最大股東。
96/09	8 吋 CSP 月產能達 40,000 片。
96/12	通過 OHSAS18001 職業健康安全系統認證。
96/12	新竹廠 12 吋月產能達 2,000 片。
98/01	通過 TOSHMS 台灣職業安全衛生管理系統認證。
99/11	中壢廠 Line-A 榮獲勞委會勞安衛管理單位績效認證。
99/12	通過 ISO/TS16949 品質管理系統認證。
100/02	取得中壢 Line-C 廠。

日期	重要記事
100/07	撤銷新竹分公司並將新竹廠搬遷回中壢廠。
101/07	中壢廠區通過 GHG 溫室氣體排放盤查及外部認證機構的查證。
101/09	中壢廠區通過重要產品的碳足跡盤查及外部認證機構的查證。
102/08	建置 8 吋生物辨識感測器產能。
104/01	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會通過股票上櫃案。

二、風險事項

(一)風險因素

1.利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

(1)利率變動風險方面：

近年利率呈現逐步上升之局勢，對公司損益之影響可分為兩部分，營業外收入部分，現金項目之利息收入隨利率上升而增加。營業外支出部分，因銀行借款所需繳納之利息也隨之增加，故為避免未來利率走高，增加融資成本之不確定性，本公司承作利率交換交易規避利率波動之風險。惟利息收入與支出兩者抵銷後之淨影響數不大，且近年銀行存款利率水準仍普遍偏低，故利率變動對本公司整體淨利之影響不大。

假設利率上升一百個基點(1%)，且其他條件不變的情況下，本公司借款之利息費用稅後淨額在 103 年度將增加 17,949 仟元。

(2)匯率變動風險方面：

本公司營收主要係以美元計價，部分製造成本亦以外幣支付，因此，任何顯著的國際匯率變動均可能對公司損益造成不利之影響。本公司主要使用遠期外匯及換匯換利合約以規避因外幣資產、負債所產生之匯率風險。有關衍生性商品交易細節，請參考本公開說明書第 316 頁。

(3)通貨膨脹風險方面：

面對國內油電雙漲及國外通貨膨脹的壓力下，本公司除密切掌握原物料供需狀況，積極尋求兼具品質和價格競爭力的替代來源外，並致力於製程改良、良率改善及效率提升的成本縮減活動，以減少物價上漲的影響。

2.從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司最近年度並未從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人及背書保證之情形。本公司所從事之衍生性商品交易係以避險為目的，主要為規避外幣資產及負債之匯率風險。為了控管財務交易風險，本公司已依據相關法令及規定，訂定了以健全財務及營運為基礎的內部管理辦法及作業程序。這些管理辦法包括「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」以及「背書保證作業程序」。

3.未來研發計畫及預計投入之研發費用

為加速先進光學晶圓級封裝技術的開發以擴大於高階影像感測器在手機市場的應用，未來將著重於開口式矽穿孔封裝(TSV)在各式光學感測器元件的應用及新一代改良矽穿孔封裝(TSV CSP)等晶圓級封裝技術研發，並以創新之晶圓級封裝技術服務將產品線擴展至微機電(MEMS)、功率場效電晶體、電源控制及類比元件等產品。104 年度預計投入之研發費用為 337,490 仟元。

4.國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司的經營團隊一直密切注意任何可能會影響公司業務及營運的政策與法令。103 年相關法令的變化對本公司的營運並無重大影響。

5.科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司的經營團隊一直密切注意任何科技改變及產業變化之相關訊息及趨勢，未來也積極投入研發以提昇競爭力。

6.企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司重視災害發生時的緊急應變準備（例如：颱風、地震、環境污染、資訊系統服務中斷、罷工、原物料或水電氣公用設施短缺等天然或人為災難），並已建立周全的應變計劃，包括在災難發生時成立專案應變小組的流程與步驟。在危機發生時，應變計劃會徹底分析事件原因、影響範圍、替代方案及各種狀況的解決方案，並提出適當的防範措施及重建方法。使本公司於事件發生時，將人員傷害、業務中斷以及財務衝擊降至最低，並維持營運順暢。本公司截至公開說明書刊印日止並無重大影響正常營運及企業形象的風險事項發生。

7.進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。

8.擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：請參閱本公開說明書第 121 頁。

9.進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

本公司儘可能向不同供應商採購原物料，以確保原物料供應無虞，並降低集中採購風險。雖然本公司仍有從單一供應商取得部份原物料之情形，但本公司仍將持續找尋其他購買方式以降低購買集中的風險。

本公司民國 102 年度最大客戶 OVT 集團之銷貨金額佔本公司銷貨淨額 37%，103 年度已降至 29%，103 年度最大客戶台積電佔本公司銷貨淨額為 35%，本公司未來仍將積極開發新市場及新客戶，並與原有客戶保持良好的合作關係，持續降低風險。

10.董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

11.經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

12.其他重要風險及因應措施：無。

(二)訴訟或非訟事件

1.公司最近年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉案當事人及目前處理情形：

(1)確認僱傭關係民事訴訟案

本公司作業員湯君因足部病痛，經勞工保險局100年8月16日保給傷字第10010173570號函認定為職業傷病，湯君主張其於復健治療期遭調動工作多次，並於101年11月30日經本公司終止其勞動契約並資遣，雖分別在101年10月12日及101年11月19日向桃園縣人力資源管理協會及桃園縣政府勞資爭議調解委員會申請勞資調解，然未達成共識，故湯君於102年1月11日向台灣桃園地方法院提起確認僱傭關係存在之民事訴訟，103年6月20日業經台灣桃園地方法院判決，本公司一審敗訴在案，本公司另於103年7月19日再提起第二審上訴，然經評估業於103年7月25日與湯君達成庭外和解，約定由湯君撤回訴訟，並於103年8月13日向台灣桃園地方法院遞狀撤回本訴訟案。依據和解書之約定本公司應分三次給付湯君和解金(共計2,139仟元)，截至103年8月31日止，本公司業已於103年8月29日支付713仟元及104年1月30日支付713仟元，尚餘713仟元亦將依約定付款，對本公司之財務業務並無重大不利影響。

(2)返還價金民事訴訟案

a.利昌案

本公司為進行機台設備升級，於99年12月30日與利昌機電企業社(以下簡稱利昌)簽訂機器開發契約，並依契約約定於100年8月30日以採購單號2000010755委由利昌進行一批機台設備之升級工程，總價為7,875仟元(含稅)，本公司並於100年11月18日支付工程款50%之訂金共3,938仟元(含稅)予利昌，然因設備逾期未能開發完成，故本公司於102年3月22日寄發存證信函通知利昌解除契約並要求返還已付價款3,938仟元與利息，並於102年5月14日向台灣桃園地方法院提起返還價金之民事訴訟，本案業於103年2月13日經台灣桃園地方法院民事判決確定，本公司獲得勝訴，判決應由利昌返還之3,938仟元款項及利息。截至103年8月31日止，因利昌無財產可供法院進行債權扣押，本公司就採購訂單2000007639應付利昌之設備款631仟元為抵銷後，尚餘款項3,307仟元將待利昌有財產可供強制執行後，再提出債權憑證予以強制執行，此案件對本公司之財務業務並無產生重大影響。

b.鋒華案

本公司向鋒華科技(股)公司(以下簡稱鋒華)購買晶圓Tray盤翻轉機一批，總價為3,150仟元(含稅)，本公司已依採購訂單先給付總價80%即2,520仟元(含稅)予鋒華，然因鋒華所交付晶圓Tray盤翻轉機並未符合採購訂單所定規格，致無法完成驗收，本公司要求限期改正，然鋒華仍逾期未改正，故本公司於102年12月31日通知鋒華以書面解除此採購訂單，並於103年1月10日向台灣桃園地方法院提起返還價金之民事訴訟，要求鋒華返還其已付價款與利息。截至目前為止，本案件仍在台灣桃園地方法院民事庭審理

中，尚不致對本公司之財務業務產生重大影響。

c.一寶案

本公司向一寶科技(股)公司(以下簡稱一寶)採購 Lam 蝕刻機台，總金額為美金 394 仟元(含稅)，本公司業於 101 年度先後給付總金額之 90%合計美金 354 仟元(含稅)予一寶，然一寶未符合本公司要求，且不斷要求展期致無法完成驗收，本公司遂於 103 年 2 月 19 日寄發存證信函要求其限期改善，然一寶拒絕本公司之要求，故本公司於 103 年 3 月 10 日再度寄發存證信函通知一寶解除此採購訂單，並於 103 年 3 月 31 日向台灣桃園地方法院提起返還價金之民事訴訟，要求一寶返還其已付價款與利息。一寶已於 103 年 7 月 3 日經台灣桃園地方法院判決敗訴，其另於 7 月 28 日提起二審上訴，然因未繳納裁判費，於 103 年 9 月 9 日經法院裁定予以駁回，一寶逾上訴期間已無法再上訴，本案已取得法院判決確定證明書並依法進行強制執行程序，此案件對本公司之財務業務並無產生重大影響。

(3)妨害秘密之刑事告訴案

本公司主張員工呂君於在職時將本公司建置生產線及設備規格等資料以電子郵件寄發至競爭對手之供應商，楊君等四人則涉嫌協助呂君或將本公司機密檔案寄至私人信箱，且前述五人先後於98年~99年間自本公司離職，並先後至競爭對手宏寶科技(股)公司任職，本公司遂主張呂君等五人違反保密條款，並有利用電腦洩露秘密罪嫌、背信罪嫌及無故取得電磁紀錄罪嫌，而於99年6月7日向台灣新竹地方法院檢察署提起刑事訴訟。呂君等五人雖承認利用電子郵件寄發檔案，然並未為自己及第三人圖任何不法利益，本公司舉證不足無法證明呂君等五人上開行為造成之損害，業於101年1月9日分別與前述五人達成和解，並撤回告訴，呂君及楊君之和解書中除為前述行為道歉外，並承諾若有違反保證事項除負擔民、刑事責任外，尚須給付本公司200萬之懲罰性違約金，其餘三名離職員工亦為前述行為道歉，且承諾應盡永久保密義務。因本案件已達成和解，對本公司財務業務尚無產生重大影響。

(4)非訟案

強友企業股份有限公司(以下簡稱強友)所提供之晶圓框架規格與品質未符合本公司要求，雙方經由多次開會及103年2月20日經桃園縣中壢市調解委員會調解後，協議本公司退還該等框架予強友，本公司並需支付該筆訂單之50%貨款共計1,772仟元(含稅)(帳列雜項購置)予強友，本公司已於103年3月3日付訖，對本公司之財務業務並無重大影響。

綜上所述，截至目前為止，尚有1案仍在審理中，其餘5案已和解或勝訴，前述訴訟案件對本公司均不足使公司解散或變動其組織、資本、業務計劃、財務狀況或停頓生產，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。

- 2.公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司，最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：

本公司董事台灣積體電路製造股份有限公司(以下簡稱台積公司) 最近二年度及截至公開說明書刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件如下：

- (1) Keranos 公司於 99 年 6 月，在美國東德州地方法院對台積公司、TSMC North America 以及數十家居於領先地位的科技公司，提出對三篇已過期的美國專利之專利權侵害訴訟。99 年 11 月，台積公司、TSMC North America 以及德州訴訟案件中的數家共同被告在美國北加州地方法院提出訴訟，要求判決該等公司並未侵害 Keranos 公司的專利權以及判決訴訟標的專利權為無效。此兩訟案已於美國東德州地方法院併成一案處理。103 年 2 月，法院宣布有利於台積公司之判決，駁回 Keranos 公司提出之所有請求。Keranos 公司目前已對上述判決於美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴。
- (2) Ziptronix 公司於 99 年 12 月，在美國北加州地方法院對台積公司、TSMC North America 以及另一公司，提出對若干美國專利之專利權侵害訴訟。103 年 9 月，法院作成有利於台積公司及 TSMC North America 之未侵權判決 (Summary Judgment)。Ziptronix 公司可對上述法院判決提出上訴。
- (3) Zond 公司於 102 年 9 月，於美國麻州地方法院對台積公司、部分台積公司子公司以及其他公司，提出對若干美國專利之專利權侵害訴訟，法官於 103 年 6 月裁定暫停該案之訴訟審理。其後，台積公司及 Zond 公司於美國德拉瓦州地方法院及美國麻州地方法院對 Zond 公司的若干其他美國專利各自提出訴訟。
- (4) Tela Innovations 公司 (簡稱「Tela 公司」) 於 102 年 12 月，於美國德拉瓦州地方法院及美國國際貿易委員會對台積公司及 TSMC North America 提出對一篇美國專利之專利權侵害訴訟。台積公司於 103 年 1 月於美國北加州地方法院對 Tela 公司提起不當使用本公司之營業秘密及違反合約之訴訟。上述美國德拉瓦州地方法院、美國國際貿易委員會及美國北加州地方法院之案件均已於 103 年 9 月撤回。
- (5) DSS Technology Management, Inc. 於 103 年 3 月，於美國東德州地方法院對台積公司、TSMC North America 及 TSMC Development 及若干其他公司提出對一篇美國專利之專利權侵害訴訟。
- (6) 台積公司於 95 年 8 月，在美國加州阿拉米達高等法院對中芯國際集成電路製造有限公司、中芯國際集成電路製造(上海)有限公司以及中芯國際美國子公司 (合稱「中芯公司」) 提起訴訟，主張中芯公司違反雙方於 94 年所簽訂，針對中芯公司不當使用台積公司之營業秘密及專利侵權所達成之和解協議，並於不當使用營業秘密之部分請求禁制令與金錢賠償。中芯公司於 95 年 9 月對台積公司於同一法院提起反訴，主張違反和解協議及默示承諾之善意及公平原則。中芯公司並於 95 年 11 月於北京市高級人民法院提起民事訴訟，主張商業詆毀及違反誠信原則。98 年 6 月 10 日，北京市高級人民法院做出對台積公司有利的判決並駁回中芯公司之訴訟。98 年 11 月 4 日，在歷經兩個月的審判後，美國加州阿拉米達高等法院的陪審團判決中芯公司違反與台積公司於 94 年簽訂之和解協議，且有不當使用台積公司營業秘密之情形。台積公司與中芯公司立即就上述之判決結果達成和解。根據新的和解協議，雙方均同意請求美國加

州法院依據此一和解條件，對此項訴訟做出有利台積公司的合意判決；而中芯公司因北京市高級人民法院做出對台積公司有利判決所提出之上訴，也由中芯公司撤回。根據這份和解協議及合意判決，中芯公司同意除依先前 94 年和解協議下已支付台積公司的美金 135,000 仟元之外，再分期支付台積公司美金 200,000 仟元，以及在相關政府法規許可下，無償授予台積公司中芯國際集成電路製造有限公司 1,789,493,218 股普通股股份，及可以每股約 1.30 港元（依合約規定予以調整）認購中芯國際集成電路製造有限公司約 695,914,030 股（依合約規定予以調整）普通股股份之 3 年期認股權證。台積公司已於 99 年 7 月取得上述普通股股份，帳列備供出售金融資產，並陸續依約取得上述現金賠償收入。上述認股權證已於 102 年 7 月到期，台積公司並未執行該認股權證。

上述董事-台積電之訟訴事件係屬法人董事之商業行為所致，且與本公司並無關係，故對本公司股東權益或證券價格並無重大影響。

3.公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至公開說明書刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(三)公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之大股東最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難或喪失債信情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無。

(四)發行人於最近一會計年度或申請上櫃會計年度內，符合會計師查核簽證財務報表規則第二條之一第二項重要子公司標準之一者，或推薦證券商認為對發行人財務報告有重大影響者，應增列其風險事項說明：不適用。

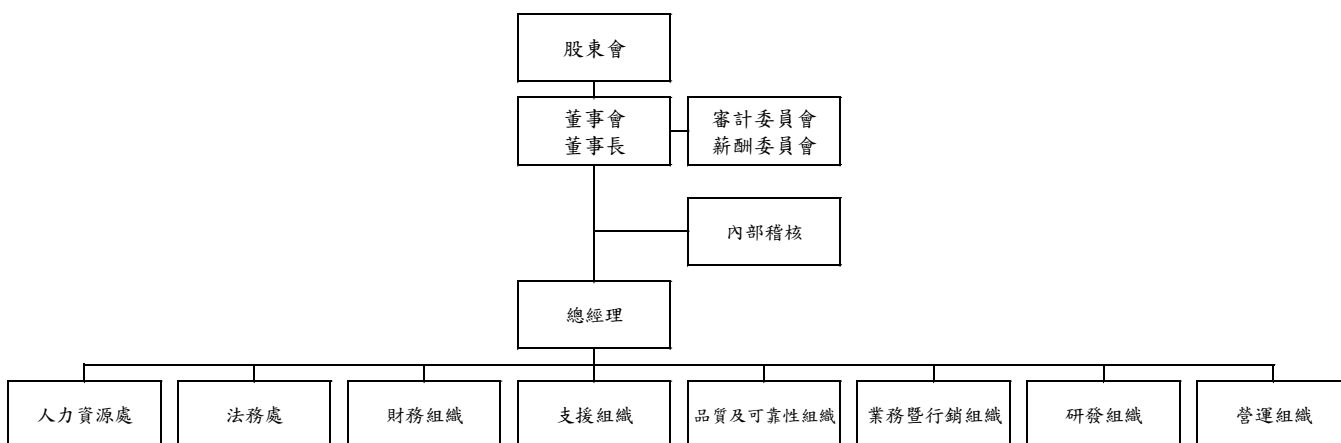
(五)外國發行人申請股票登錄興櫃或第一上櫃者，應增列敘明外國發行人註冊地國及主要營運地國之總體經濟、政經環境變動、相關法令、外匯管制及租稅，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項，並說明所採行之因應措施：不適用。

(六)其他重要事項：無。

三、公司組織

(一)組織系統

1.組織結構



2.各主要部門所營業務

部門	主要職掌
內部稽核	協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及做為檢討修正內部控制制度之依據。
人力資源處	人力規劃、招募任用、薪酬管理、訓練發展、員工服務及員工關係。
法務處	智權法律事務處理及智權授權談判處理、合約審閱談判管理、公司法律事務處理、法律爭議或訴訟處理。
財務組織	財務及會計帳務服務、稅務管理、投資管理、財務規劃、資金調度及年度成效評估。
支援組織	應用系統之統籌開發、擬訂物料需求計劃、採購業務管理、進出口及倉儲管理、生產計劃及管制、工廠產能及規劃。
品質及可靠性組織	品質與可靠性管理。
業務暨行銷組織	業務發展、客戶協商、中長程需求預測與市場情報蒐集、策劃新產品/事業與定義產品發展藍圖、訂價指導方針提案與核決、業務支援。
研發組織	專案導入、新製程開發、研發專案技術及光罩模具設計。
營運組織	製造封裝、產品工程、設備維護、製程整合、廠務、環安衛及風險管理。

(二)關係企業圖

- 1.關係企業組織圖：無。
- 2.與關係企業間之關係、相互持股比例、股份與實際投資金額：無。

(三)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管：

104 年 3 月 23 日

職 稱	姓 名	國 籍	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司 之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			經理人取得 員工認股權 憑證情形
				股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)	股數	持股比例(%)			職 稱	姓 名	關 係	
總 經 理	關 欣	中華民國	100/9/2	0	0	0	0	0	0	台積公司特殊計劃處長/後段技術暨服務處處長 Systems on Silicon Manufacturing Co.營運副總 清華大學材料科學與工程研究所碩士	采鈺科技(股)公司 董事長暨執行長 英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company(註 1)董事	無	無	無	註 2
支 援 組 織 副 總 經 理	林中安	中華民國	95/1/6	155,412	0.07	0	0	0	0	瀚宇彩晶(股)公司資深處長 台積公司製造技術中心薄膜技術委員會經理 成功大學材料工程碩士	無	無	無	無	
業務暨行銷組織 副 總 經 理	溫英男	中華民國	96/9/3	101,023	0.04	0	0	0	0	台積公司企業發展處資深經理 冠華科技(股)產品業務處長 米輯電子(股)行銷處長 矽品精密工業(股)BUMPING 處協理 艾克爾國際科技(股)有限公司產品工程處資深經理 悠立半導體(股)公司業務及技術開發處協理 乾坤科技(股)公司研發處經理 工業技術研究院電子所研發課長/材料所副研究員 成功大學礦冶材料科學碩士	無	無	無	無	
研 發 組 織 副 總 經 理	何彥仕	中華民國	99/8/2	40,586	0.02	0	0	0	0	台積公司六廠擴散工程部經理 高雄應用科技大學電機工程學系助理教授 清華大學電機工程學博士	無	無	無	無	
品質及可靠性 組織副總經理	尤龍生	中華民國	97/11/10	29,798	0.01	1,009	0.00	0	0	台積公司客戶品質及可靠度部經理/後段品質工程 部經理/先進技術品質工程部經理 美國休士頓大學材料工程碩士	無	無	無	無	
營 運 組 織 副 總 經 理	方文良	中華民國	100/9/1	0	0	0	0	0	0	台積公司特殊專案副處長/八廠副處長 台灣大學材料工程碩士	無	無	無	無	
財務及會計協理	林恕敏	中華民國	90/8/1	78,762	0.03	0	0	0	0	致福電子(股)公司會計經理 敦南科技(股)公司會計主任 東吳大學會計系	無	無	無	無	
稽 核 處 長	黃亮凱	中華民國	103/3/6	36,300	0.02	0	0	0	0	本公司資材暨資訊處處長 瀚斯寶麗(股)公司供應鏈運籌總管理處處長 台積公司製造策略技術中心經理 清華大學工業工程博士	無	無	無	無	

註 1：英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company 為台積電與 OmniVision Technologies, Inc.間接投資之合資公司。

註 2：請詳八、員工認股權憑證辦理情形之揭露說明。

(四)董事及監察人：

1.董事及監察人資料

104 年 3 月 23 日

職 稱	姓 名	國籍或 註冊地	初次選 任日期	選 任 日 期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經 (學) 歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管 、董事或監察人		
						股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)	股數	持 股 比 率 (%)			職 稱	姓 名	關 係
董事長	關欣	中華民國	100/4/29	102/6/13	3 年	0	0	0	0	0	0	0	0	台積公司特殊計劃處長/後段技術 暨服務處處長 Systems on Silicon Manufacturing Co.營運副總 國立清華大學材料科學與工程研 究所碩士	本公司總經理 采鈺科技(股)公司董事長暨執行長 英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company 董事	無	無	無
	台灣積體電路製造股份 有限公司代表人	中華民國	96/3/5	102/6/13	3 年	94,950,005	40.18	94,950,005	39.85	0	0	0	0	-	-	-	-	-
董事	何麗梅	中華民國	96/3/5	102/6/13	3 年	0	0	0	0	0	0	0	0	台積公司副總經理暨財務長兼發 言人 德基半導體公司副總經理暨財務 長 國立台灣大學商學碩士	台積公司資深副總經理暨財務長兼發言人 TSMC Japan Limited 監察人、台積電 (中國) 有限 公司監察人、TSMC Technology, Inc. 董事長、 TSMC Development, Inc. 董事長兼總經理、TSMC Partners, Ltd. 董事兼總經理、TSMC Global Ltd. 董 事、台積太陽能股份有限公司董事、TSMC Solar North America, Inc. 董事、TSMC Solar Europe B.V. 董事、TSMC Solar Europe GmbH 董事、TSMC Lighting North America, Inc. 董事、台積光能投資 有限公司董事、Systems on Silicon Manufacturing Company Pte Ltd. 董事、創意電子股份有限公司董 事	無	無	無
	台灣積體電路製造股份 有限公司代表人	中華民國	96/3/5	102/6/13	3 年	94,950,005	40.18	94,950,005	39.85	0	0	0	0	-	-	-	-	-
董事	林錦坤 (註 1)	中華民國	103/1/10	103/1/10	3 年	0	0	0	0	0	0	0	0	台積公司成熟技術事業總廠長、十 二廠廠長、六廠廠長及三廠廠長 國立彰化師範大學工業教育與技 術學系學士	台積公司營運/六吋及八吋廠暨製造技術中心副 總經理 采鈺科技股份有限公司董事 英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company(註 3)董 事	無	無	無
	台灣積體電路製造股份 有限公司代表人	中華民國	96/3/5	102/6/13	3 年	94,950,005	40.18	94,950,005	39.85	0	0	0	0	-	-	-	-	-
董事	Hongli Yang(註 2)	美 國	103/5/8	103/5/8	3 年	0	0	0	0	0	0	0	0	B.E./M.E./Ph.D.E.E.TsingHua University	OmniVision Technologies, Inc. – Director/COO OmniVision Technologies (Shanghai) Co. Ltd. – Director OmniVision Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd. - Director OmniVision Optoelectronics Technologies (Shanghai) Company Limited – Director OmniVision Technologies Norway AS – Director OmniVision Technologies Singapore Pte. Ltd. – Director OmniVision Technologies (Wuhan) Co. Ltd. – Director	無	無	無

職 稱	姓 名	國籍或 註冊地	初次選 任日期	選 任 日 期	任期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子 女現在持有股份		利用他人名 義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務	具配偶或二親等以 內關係之其他主管 、董事或監察人		
						股數	持股 比率 (%)	股數	持股 比率 (%)	股數	持股 比率 (%)	股數	持股 比率 (%)			職 稱	姓 名	關 係
															英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company(註 3)董事 台灣豪威光電科技股份有限公司董事 采鈺科技股份有限公司董事			
	台灣豪威投資控股 股份有限公司代表人	中華民國	97/6/12	102/6/13	3 年	9,809,211	4.15	9,809,211	4.12	0	0	0	0	-	-	-	-	-
獨立 董事	王文宇	中華民國	102/6/13	102/6/13	3 年	0	0	0	0	0	0	0	0	臺灣期貨交易所監察人 國立臺灣大學法律學院財經法研 究中心主任 百一電子股份有限公司獨立董事 合作金庫商業銀行法人代表董事 台灣法學會理事/監察人 台灣參加亞洲開發銀行 (Asian Development Bank)會議代表 美國史丹福大學法學博士	本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會召集人 國立臺灣大學法律學院教授 國際比較法學會(IACL)台灣分會召集人 萬泰銀行獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬 委員會委員 創意電子公司獨立董事、審計委員會委員及薪資 報酬委員會召集人 統一超商公司獨立董事、審計委員會委員及薪資 報酬委員會召集人	無	無	無
獨立 董事	徐中時	中華民國	102/6/13	102/6/13	3 年	0	0	0	0	0	0	0	0	世界先進公司總經理/副總經理/顧 問 台積公司美國總經理專案顧問/全 球行銷暨業務專案副總經理 台灣聯測美國總經理 華邦電子資深副總經理 華隆微電子副總經理 三星電子研發處長 美國哥倫比亞大學物理博士	本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員	無	無	無
獨立 董事	謝徽榮	中華民國	102/6/13	102/6/13	3 年	0	0	0	0	0	0	0	0	世界先進公司財務副總經理 美商美國銀行副總經理 國立臺灣大學企管碩士	本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員 茂達電子公司獨立董事及薪資報酬委員會委員 寶勝國際(控股)公司獨立董事及薪酬委員會主席	無	無	無

註 1：法人代表已於 103/1/10 由魏哲家先生改派為林錦坤先生。

註 2：法人代表已於 103/5/8 由 Xiaoying Hong 先生改派為 Hongli Yang 先生。

註 3：英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company 為台積電與 OmniVision Technologies, Inc.間接投資之合資公司。

2.法人股東之主要股東

法 人 名 稱	法 人 之 主 要 股 東	持 股 比
台灣積體電路製造股份有限公司 (註 1)	花旗託管台積電存託憑證專戶	20.78%
	行政院國家發展基金管理會	6.38%
	摩根大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶	3.20%
	花旗（台灣）商業銀行受託保管新加坡政府投資專戶	2.50%
	美商摩根大通託管阿布達比投資局投資專戶	1.40%
	大通託管歐洲太平洋成長基金大衛費雪等專戶	1.17%
	美商摩根大通銀行台北分行受託保管 S t i c h t i n g 存託 A P G 新興市場股票共同基金投資專戶	1.06%
	國泰人壽保險股份有限公司	1.01%
	渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶	0.92%
	美渣打託管 iSharesMSCI 新興市場指數基金投資專戶	0.89%
台灣豪威投資控股股份有限公司 (註 2)	英屬蓋曼群島商豪威國際控股公司 (OmniVision International Holding Ltd.)	100.00%
英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company (註 2)	OmniVision Investment Holding (BVI) Ltd.	49.14%
	TSMC Partners, Ltd.	49.14%
	Dai Nippon Printing Co., Ltd.	1.72%

註1：基準日為103年6月24日。

註2：基準日為104年3月23日。

3.法人股東之主要股東屬法人股東者其主要股東：

法 人 名 稱	法 人 之 主 要 股 東	持 股 比
國泰人壽保險股份有限公司 (註 1)	國泰金融控股股份有限公司	100.00%
英屬蓋曼群島商豪威國際控股公司(註 1)	OmniVision Technologies Inc.	100.00%
OmniVision Investment Holding (BVI) Ltd. (註 1)	OmniVision International Holding, Ltd	100.00%
TSMC Partners, Ltd. (註 1)	台灣積體電路製造股份有限公司	100.00%
Dai Nippon Printing Co., Ltd. (註 2)	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust A/C)	6.39%
	Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust A/C)	4.88%
	The Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd.	4.79%
	Mizuho Bank, Ltd.	3.40%
	Employees' Shareholding Association	2.43%
	Nippon Life Insurance Company	1.57%
	The Bank of New York Mellon as Depositary Bank for Depositary Receipts Holders	1.26%
	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225	1.20%
	Trust & Custody Services Bank, Ltd. As trustee for Mizuho Bank, Ltd. Retirement Benefit Trust Account re-entrusted by Mizuho Trust and Banking Co., Ltd.	1.03%
	The Bank of New York Mellon SANV 10	1.00%

註1：基準日為104年3月23日。

註2：基準日為103年3月31日。

4.董事及監察人獨立性資料：

條件 姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形(註)										兼任其 他公開 發行公 司獨立 董事家 數
	商 務 、 法 務、財務、 會計或公司 業務所須相 關科系之公 私立大專院 校講師以上	法官、檢察官、 律師、會計師或 其他與公司業 務所需之國家 考試及格領有 證書之專門職 業及技術人員	商 務、法 務、財務、 會計或公 司業務所 須之工作 經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
關 欣			✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		無
何麗梅			✓			✓	✓			✓	✓	✓		無
林錦坤			✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓		無
Hongli Yang			✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		無
王文字	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3
徐中時			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
謝徽榮			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

(五) 發起人：不適用。

(六)董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1.最近年度(103)支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金之酬金：

(1)董事(含獨立董事)之酬金：

103 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元；千股

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C 及 D 等四項總額占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金												A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之比例		有無領取來自子公司以外轉投資業酬金	
		報酬(A) (註 3)		退職退休金(B)		盈餘分配之酬勞(C) (註 3)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)(註 4)		退職退休金(F)		盈餘分配員工紅利(G)				員工認股權憑證得認購股數(H)		取得限制員工權利新股股數(I)					
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司		
董事長	關欣 台灣積體電路製造(股)公司代表人	1,800	1,800	0	0	2,400	2,400	1,237	1,237	0.9%	0.9%	26,613	26,613	0	0	2,618	0	2,618	0	0	0	0	0	0	5.5%	5.5%	無
董事	何麗梅 台灣積體電路製造(股)公司代表人																										
董事	林錦坤 (註 1) 台灣積體電路製造(股)公司代表人																										
董事	Hongli Yang(註 2) 台灣豪威投資控股(股)公司代表人																										
獨立董事	王文宇																										
獨立董事	徐中時																										
獨立董事	謝徽榮																										

註 1：代表人原為魏哲家，於 103 年 1 月 10 日改派林錦坤為代表人。

註 2：代表人原為 Xiaoying Hong，於 103 年 5 月 8 日改派 Hongli Yang 為代表人。

註 3：本公司董事會於 104 年 2 月 4 日決議，擬訂 103 年度董事酬勞計新台幣 4,200 仟元(惟依董事酬勞、報酬及車馬費給付辦法規定扣除獨立董事已領取之報酬 1,800 仟元)，俟股東常會決議通過後生效。

註 4：包括現金交割之股份基礎給付計畫於 103 年度認列之費用為 22,434 仟元。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司
低於 2,000,000 元	關欣-台灣積體電路製造(股)公司代表人、何麗梅-台灣積體電路製造(股)公司代表人及林錦坤-台灣積體電路製造(股)公司代表人、Hongli Yang-台灣豪威投資控股(股)公司代表人、王文字、徐中時、謝徽榮	關欣-台灣積體電路製造(股)公司代表人、何麗梅-台灣積體電路製造(股)公司代表人及林錦坤-台灣積體電路製造(股)公司代表人、Hongli Yang-台灣豪威投資控股(股)公司代表人、王文字、徐中時、謝徽榮	何麗梅-台灣積體電路製造(股)公司代表人及林錦坤-台灣積體電路製造(股)公司代表人、Hongli Yang-台灣豪威投資控股(股)公司代表人、王文字、徐中時、謝徽榮	何麗梅-台灣積體電路製造(股)公司代表人及林錦坤-台灣積體電路製造(股)公司代表人、Hongli Yang-台灣豪威投資控股(股)公司代表人、王文字、徐中時、謝徽榮
2,000,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-	關欣-台灣積體電路製造(股)公司代表人	關欣-台灣積體電路製造(股)公司代表人
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總 計	7	7	7	7

(2)最近年度(103)支付監察人之酬金：

業於 102 年 6 月 13 日由全體獨立董事組成審計委員會並取代監察人，故不適用。

(3)最近年度(103)支付總經理及副總經理之酬金

103 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元；千股

職 稱	姓 名	薪資(A) (註 1)		退職退休金(B) (註 2)		獎金及特支費等 等(C)		盈餘分配之員工紅利金額(D) (註 3)				A、B、C 及 D 等 四項總額占稅後 純益之比例 (%)		取得員工認股權 憑證數額		取得限制員工權 利新股股數		有無領取來自 子公司以外轉 投資事業酬金
		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	
								現金紅利 金額	股票紅利 金額	現金紅利 金額	股票紅利 金額							
總 經 理	關 欣	46,129	46,129	648	648	3,949	3,949	11,022	0	11,022	0	9.8%	9.8%	0	0	0	0	無
副總經理	林中安																	
副總經理	溫英男																	
副總經理	何彥仕																	
副總經理	尤龍生																	
副總經理	方文良																	
協 理	林恕敏																	

註 1：包括現金交割之股份基礎給付計畫於 103 年度認列之費用 22,434 仟元。

註 2：退職退休金金額全數為提列提撥數，並無實際支付數。

註 3：本公司 103 年度盈餘於 104 年分配之員工紅利金額尚未完全確定，上列為暫估數字。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 2,000,000 元	-	-
2,000,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	尤龍生、林恕敏	尤龍生、林恕敏
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	林中安、溫英男、 何彥仕、方文良	林中安、溫英男、 何彥仕、方文良
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	-	-
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	關欣	關欣
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	-	-
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總 計	7	7

(4)配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

103 年 12 月 31 日 單位：新台幣仟元

	職 稱	姓 名	股票紅利金額	現金紅利金額	總 計	總額占稅後純益之比例(%)
經 理 人	總 經 理	關 欣	0	11,022	11,022	1.8%
	副 總 經 理	林中安				
	副 總 經 理	溫英男				
	副 總 經 理	何彥仕				
	副 總 經 理	尤龍生				
	副 總 經 理	方文良				
	財務及會計協理	林恕敏				

註：本公司 103 年度盈餘於 104 年分配之員工紅利金額尚未完全確定，上列為暫估數字。

2.分別比較說明本公司及合併報告所有公司於最近兩年度支付公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

(1)最近兩年度支付公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析：

職 稱	102 年度		103 年度	
	酬金總額	佔稅後純益比例	酬金總額	佔稅後純益比例
董事	5,597	1.9%	5,437	0.9%
監察人	705	0.2%	0	0
總經理及副總經理	40,961	14.2%	61,748	9.8%

(2) 給付酬金政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性：

本公司支付董事及監察人之酬金主要為執行職務之報酬、車馬費及依公司章程規定所提撥之董監酬勞，而酬勞給付之政策訂於本公司章程內，並由股東會通過，係依其對公司營運參與程度及貢獻價值，暨國內外業界水準後訂定，並經薪酬委員會審核及董事會通過後執行。

本公司支付總經理及副總經理之酬金分係依本公司招募暨任用管理辦法等相關管理規章制度辦理，並經薪酬委員會審核及董事會通過後執行。本公司酬金政策，係依據個人能力與績效表現、對公司整體營運貢獻度，且參酌市場同業水準訂定，已與經營績效相連結。又本公司對未來風險已有控管，故酬金政策與未來風險之關聯性較低。

(七)發行人之非董事，而實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營而實質指揮董事執行業務者，應增列敘明上開人士之姓名、經(學)歷、持有股份、目前兼任發行人及其他公司職務、並與發行人董事及監察人之關係及對發行人實質控制情形：無。

四、資本及股份

(一)股本來源：

104年3月6日 單位:股

股份 種類	核 定 股 本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	238,120,681	21,879,319	260,000,000	

(二)股本形成經過

1.最近五年度及截至公開說明書刊印日止股本變動之情形

104年3月6日 單位：新台幣仟元；千股

年/月	發行價格 新台幣 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之 財產抵充股款 者(仟元)	其 他
87/9	10	64,000	640,000	28,000	280,000	創立 216,000	技術股 64,000	87/9/11 經(○八七)商字第 087127301 號核准在案
88/7	10	64,000	640,000	43,250	432,500	現增 152,500	無	88/7/26 經(○八八)商字第 088127212 號核准在案
89/9	10	64,000	640,000	55,000	550,000	現增 117,500	無	89/9/20 經(○八九)商字第 089134667 號核准在案
91/8	12	64,000	640,000	64,000	640,000	現增 90,000	無	91/8/19 經授商字第 09101336780 號核准在案
92/3	12	88,000	880,000	73,000	730,000	現增 90,000	無	92/3/19 經授商字第 09201078970 號核准在案
92/4	11	88,000	880,000	83,000	830,000	現增 100,000	無	92/4/30 經授商字第 09201130010 號核准在案
92/9	15	120,000	1,200,000	103,000	1,030,000	現增 200,000	無	92/9/1 經授商字第 09201260090 號核准在案
92/12	20	120,000	1,200,000	115,000	1,150,000	現增 120,000	無	92/12/4 經授商字第 09201327560 號核准在案
95/4	10	120,000	1,200,000	120,000	1,200,000	現增 50,000	無	95/4/10 經授商字第 09501063960 號核准在案
95/7	-	180,000	1,800,000	120,000	1,200,000	核定股本變更	無	95/7/4 經授商字第 09501131570 號核准在案
96/2	15	260,000	2,600,000	210,526	2,105,260	私募現增 905,260	無	96/2/16 經授商字第 09601036790 號核准在案
96/8	-	260,000	2,600,000	215,739	2,157,391	盈餘轉增資： 27,368 員工紅利轉增資： 24,763	無	96/8/6 經授商字第 09601184170 號核准在案
97/7	-	260,000	2,600,000	221,279	2,212,794	盈餘轉增資： 21,574 員工紅利轉增資： 33,829	無	97/7/24 經授商字第 09701180530 號核准在案
97/11	-	260,000	2,600,000	221,909	2,219,091	行使員工認股權 憑證 6,297	無	97/11/27 經授商字第 09701302390 號核准在案
98/3	-	260,000	2,600,000	222,225	2,222,251	行使員工認股權 憑證 3,160	無	98/3/30 經授商字第 09801056560 號核准在案
98/6	-	260,000	2,600,000	222,660	2,226,601	行使員工認股權 憑證 4,350	無	98/6/26 經授商字第 09801127190 號核准在案
98/7	-	260,000	2,600,000	224,629	2,246,289	盈餘轉增資: 11,111 員工紅利轉增資: 8,577	無	98/7/22 經授商字第 09801153270 號核准在案
98/9	-	260,000	2,600,000	225,533	2,255,327	行使員工認股權 憑證 9,038	無	98/9/9 經授商字第 09801206430 號核准在案
98/12	-	260,000	2,600,000	225,766	2,257,657	行使員工認股權 憑證 2,330	無	98/12/18 經授商字第 09801290970 號核准在案
99/4	-	260,000	2,600,000	226,529	2,265,287	行使員工認股權 憑證 7,630	無	99/4/8 經授商字第 09901068120 號核准在案
99/7	-	260,000	2,600,000	227,275	2,272,746	行使員工認股權 憑證 7,459	無	99/7/16 經授商字第 09901144980 號核准在案

年/月	發行價格 新台幣 (元)	核定股本		實收股本		備 註		
		股 數	金 額	股 數	金 額	股本來源	以現金以外之 財產抵充股款 者(仟元)	其 他
99/9	-	260,000	2,600,000	227,367	2,273,666	行使員工認股權 憑證 920	無	99/9/2 經授商字第 09901200650 號核准在案
99/12	-	260,000	2,600,000	227,968	2,279,684	行使員工認股權 憑證 6,018	無	99/12/6 經授商字第 09901271820 號核准在案
100/4	-	260,000	2,600,000	228,561	2,285,607	行使員工認股權 憑證 5,923	無	100/4/11 經授商字第 10001069460 號核准在案
100/7	-	260,000	2,600,000	229,026	2,290,265	行使員工認股權 憑證 4,658	無	100/7/1 經授商字第 10001142280 號核准在案
100/8	-	260,000	2,600,000	233,256	2,332,557	盈餘轉增資: 22,883 員工紅利轉增資: 19,410	無	100/8/10 經授商字第 10001184920 號核准在案
100/9	-	260,000	2,600,000	233,396	2,333,962	行使員工認股權 憑證 1,405	無	100/9/6 經授商字第 10001207740 號核准在案
100/12	-	260,000	2,600,000	233,579	2,335,794	行使員工認股權 憑證 1,831	無	100/12/2 經授商字第 10001274670 號核准在案
101/4	-	260,000	2,600,000	233,581	2,335,811	行使員工認股權 憑證 17	無	101/4/2 經授商字第 10101055600 號核准在案
101/6	-	260,000	2,600,000	233,785	2,337,846	行使員工認股權 憑證 2,035	無	101/6/27 經授商字第 10101120250 號核准在案
101/7	-	260,000	2,600,000	236,121	2,361,209	盈餘轉增資: 23,363	無	101/7/30 經授商字第 10101155880 號核准在案
101/9	-	260,000	2,600,000	236,153	2,361,526	行使員工認股權 憑證 317	無	101/9/13 經授商字第 10101188740 號核准在案
101/12	-	260,000	2,600,000	236,205	2,362,046	行使員工認股權 憑證 520	無	101/12/12 經授商字第 10101253820 號核准在案
102/4	-	260,000	2,600,000	236,208	2,362,079	行使員工認股權 憑證 33	無	102/4/1 經授商字第 10201058510 號核准在案
102/8	-	260,000	2,600,000	236,267	2,362,667	行使員工認股權 憑證 588	無	102/8/6 經授商字第 10201152570 號核准在案
102/8	-	260,000	2,600,000	236,290	2,362,896	行使員工認股權 憑證 229	無	102/8/30 經授商字第 10201179150 號核准在案
102/12	-	260,000	2,600,000	236,371	2,363,714	行使員工認股權 憑證 818	無	102/12/11 經授商字第 10201249330 號核准在案
103/3	-	260,000	2,600,000	236,402	2,364,019	行使員工認股權 憑證 305	無	103/3/28 經授商字第 10301053810 號核准在案
103/7	-	260,000	2,600,000	236,474	2,364,739	行使員工認股權 憑證 720	無	103/7/8 經授商字第 10301136750 號核准在案
103/9	-	260,000	2,600,000	236,481	2,364,814	行使員工認股權 憑證 75	無	103/9/4 經授商字第 10301184300 號核准在案
103/12	-	260,000	2,600,000	238,051	2,380,508	行使員工認股權 憑證 15,694	無	103/12/5 經授商字第 10301253830 號核准在案
104/3	-	260,000	2,600,000	238,121	2,381,207	行使員工認股權 憑證 699	無	104/3/6 經授商字第 10401033070 號核准在案

2.最近三年度及截至公開說明書刊印日止，私募普通股辦理情形：無。

(三)最近股權分散情形

1.股東結構：

103年9月30日 單位：股

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構 及外國人	合計
人 數	0	14	34	6,842	17	6,907
持 有 股 數	0	3,984,834	109,205,284	77,911,710	46,948,953	238,050,781
持 股 比 例	0%	1.67%	45.88%	32.73%	19.72%	100.00%

2.股權分散情形：(每股面額 10 元)

103 年 9 月 30 日 單位：人；股

持 股 分 級	股 東 人 數	持 有 股 數	持 股 比 例(%)
1 至 999	1,541	210,746	0.09
1,000 至 5,000	3,193	6,781,352	2.85
5,001 至 10,000	820	6,083,204	2.55
10,001 至 15,000	351	4,268,252	1.79
15,001 至 20,000	171	3,083,898	1.30
20,001 至 30,000	267	6,632,157	2.79
30,001 至 40,000	136	4,771,541	2.00
40,001 至 50,000	85	3,896,636	1.64
50,001 至 100,000	185	13,493,295	5.67
100,001 至 200,000	96	12,994,669	5.46
200,001 至 400,000	33	8,980,141	3.77
400,001 至 600,000	13	6,401,295	2.69
600,001 至 800,000	4	2,764,991	1.16
800,001 至 1,000,000	2	1,670,000	0.70
1,000,001 以上	10	156,018,604	65.54
合 計	6,907	238,050,781	100.00

3.主要股東名單：

持股比例達5%以上之股東或持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例：

103年9月30日 單位：股

主要股東名稱	持 有 股 數	持 股 比 例
台灣積體電路製造股份有限公司	94,950,005	39.89
英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company	37,235,172	15.64
台灣豪威投資控股股份有限公司	9,809,211	4.12
渣打國際商業銀行敦北分行受託保管富達基金投資專戶	4,958,179	2.08
三商美邦人壽保險股份有限公司	2,288,000	0.96
香港上海滙豐銀行台北分行受託保管富達南韓－中國證券投資信託－母基金投資專戶	1,653,307	0.69
邵建華	1,556,000	0.65
侯全興	1,504,000	0.63
瞿宗輝	1,039,002	0.44
新光紡織股份有限公司	1,025,728	0.43

4.最近二年度及當年度董事、監察人及持股比例超過百分之十之股東放棄現金增資認股之情形：本公司最近兩年度及當年度未辦理現金增資。

5.最近二年度及截至公開說明書刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，尚應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、監察人、持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數：

(1)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

單位：股

職 稱	姓 名	102 年 度		103 年 度		104年度截至2月28日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數增 (減)數
董 事	台灣積體電路製造股份有限公司	0	0	0	0	0	0
	代表人-關欣	0	0	0	0	0	0
	代表人-何麗梅	0	0	0	0	0	0
	代表人—魏哲家(註1)	0	0	0	0	0	0
	代表人—林錦坤(註1)	0	0	0	0	0	0
董 事	台灣豪威投資控股股份有限公司	0	0	0	0	0	0
	代表人- Xiaoying Hong(註2)	0	0	0	0	0	0
	代表人- Hongli Yang(註2)	0	0	0	0	0	0
董 事	陳俊瑛(註3)	0	0	-	-	-	-
獨立董事	王文字(註4)	0	0	0	0	0	0
獨立董事	徐中時(註4)	0	0	0	0	0	0
獨立董事	謝徽榮(註4)	0	0	0	0	0	0
監 察 人	英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company(註4)	0	0	0	0	0	0
	代表人-沈維民(註4)	0	0	0	0	0	0
	代表人-侯政(註4)	0	0	0	0	0	0
總 經 理	關欣	0	0	0	0	0	0
副總經理	林中安	(34,000)	0	(97,000)	0	0	0
副總經理	溫英男	(13,000)	0	(134,000)	0	0	0
副總經理	何彥仕	0	0	0	0	0	0
副總經理	尤龍生	0	0	(25,000)	0	0	0
副總經理	方文良	0	0	0	0	0	0

職 稱	姓 名	102 年 度		103 年 度		104年度截至2月28日止	
		持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持有股數 增(減)數	質押股數 增(減)數	持 有 股 數 增 (減) 數	質押股數增 (減) 數
財 務 及 會 計 協 理	林恕敏	0	0	(68,000)	0	0	0
協 理	張佩文(註5)	0	0	(76,887)	0	-	-
大 股 東	台灣積體電路製造股份有限公司	0	0	0	0	0	0
大 股 東	英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company	0	0	0	0	0	0

註1：法人代表已於103/1/10由魏哲家先生改派為林錦坤先生。

註2：法人代表已於103/5/8由Xiaoying Hong先生改派為Hongli Yang先生。

註3：陳俊瑛先生因董事任期於102年6月13日屆滿，故僅揭露陳俊瑛先生卸任前之持股變動數。

註4：因董事於102年6月13日全面改選，由新任三名獨立董事組成審計委員會，並取消監察人制度；監察人沈維民與侯政任期至102年6月13日止。

註5：協理張佩文於103年9月30日辭任，此為辭任前之持股變動數。

(2)董事、監察人、經理人及大股東股權移轉之相對人為關係人者之資訊：無。

(3)董事、監察人、經理人及大股東股權質押之相對人為關係人者之資訊：無。

6.持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

103年9月30日；單位:仟股;%

姓名	本 持 有 股 份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	股數	持股比率(%)	名 稱	關 係	
台灣積體電路製造股份有限公司	94,950	39.89	0	0	0	0	英屬蓋曼群島商VisEra Holding Company	台積電轉投資公司	
英屬蓋曼群島商VisEra Holding Company	37,235	15.64	0	0	0	0	英屬蓋曼群島商豪威國際控股公司	英屬蓋曼群島商豪威國際控股公司直接投資之公司	
							台灣積體電路製造股份有限公司	台積電轉投資公司	
台灣豪威投資控股股份有限公司	9,809	4.12	0	0	0	0	英屬蓋曼群島商豪威國際控股公司	英屬蓋曼群島商豪威國際控股公司直接投資之公司	
渣打國際商業銀行敦北分行受託保管富達基金投資專戶	4,958	2.08	0	0	0	0	無	無	
三商美邦人壽保險股份有限公司	2,288	0.96	0	0	0	0	無	無	
香港上海匯豐銀行台北分行受託保管富達南韓－中國證券投資信託－母基金投資專戶	1,653	0.69	0	0	0	0	無	無	
邵建華	1,556	0.65	0	0	0	0	侯全興	配偶	
侯全興	1,504	0.63	0	0	0	0	邵建華	配偶	
瞿宗輝	1,039	0.44	0	0	0	0	無	無	
新光紡織股份有限公司	1,026	0.43	0	0	0	0	無	無	

(四)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料：

單位：股/新台幣元

項 目 \ 年 度		102 年	103 年
每股市價	最 高	未上市櫃	未上市櫃
	最 低	未上市櫃	未上市櫃
	平 均	未上市櫃	未上市櫃
每股淨值	分 配 前	17.41	19.55
	分 配 後	16.86	(註 1)
每股盈餘	加權平均股數		236,318
	每股盈餘	調整前	2.65
		調整後	(註 1)
每股股利 (註 2)	現 金 股 利		0.55
	無償配股	盈餘配股	-
		資本公積配股	-
	累積未付股利		-
投資報酬分析	本益比		未上市櫃
	本利比		未上市櫃
	現金股利殖利率		未上市櫃

註 1：以年底發行之股數為準，並依據次年度之股東會決議分配之情形填列。

註 2：本公司 103 年度盈餘分配案尚未經股東會決議通過。

(五)公司股利政策及執行狀況：

1.公司章程所訂之股利政策

本公司章程第廿七條之一內容如下：

本公司股利發放政策係依據公司資本預算、中長期營運規劃及財務狀況，依下列原則經股東會決議後分派之：

- (1)除依下列第二項規定以公積分派外，公司無盈餘時，不得分派股息及紅利，但法定盈餘公積已超過資本總額百分之五十時，得以其超過部份派充股息及紅利。盈餘之分派得以股票股利或現金股利之方式為之，但因本公司目前正處於營運成長期，未來將視擴充計劃及投資資金之需求，於分派當年度可分配盈餘時，現金股利分派之比例以不低於股利總額之百分之五十。
- (2)於當年度公司無盈餘可分派，或雖有盈餘但盈餘數額遠低於公司前一年度實際分派之盈餘，或依公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將公積全部或一部依法令或主管機關規定分派。

2.本次股東會決議之股利分配情形：

盈餘分配議案業經 104 年 2 月 4 日董事會擬議配發 103 年度股東現金股利新台幣 285,745 仟元(每股新台幣 1.20 元)，惟尚未經股東會決議同意。

(六)本年度擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用

(七)員工分紅及董事、監察人酬勞：

1. 本公司章程第廿七條內容如下：

本公司每年度決算如有盈餘，應先完納稅捐，彌補以往年度虧損，次提撥百分之十為法定盈餘公積，如法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限，次依法令或主管機關規定應提列及迴轉特別盈餘公積後，再就其餘額依序作下列之分配：

(1)提撥不低於百分之一為員工紅利。

(2)提撥不高於百分之二為董事酬勞，且給付之對象不包括擔任本公司經理人之董事。

(3)餘額由董事會擬具股東紅利分派議案，提請股東會決議分派之。

(4)前項有關員工紅利部份，如為分配股票紅利，其對象得包括從屬公司員工，其條件及分配方式，授權董事會決定之。

2.本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司對於員工紅利及董監事酬勞之估列係依過去經驗以可能發放之金額為基礎，103 年度按稅後淨利扣除應提列之法定盈餘公積及特別盈餘公積後之餘額，提撥 15%為員工分紅，提撥 0.42%為董事酬勞，於股東會決議日時，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。如股東會決議採股票發放員工紅利，股票紅利股數以決議分紅之金額除以股票公允價值決定，以國際財務報導準則第 2 號「股份基礎給付」規定之公允價值計算股票紅利股數。

3.盈餘分配案業經董事會通過，尚未經股東會決議者：

(1)配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額：

103 年度之盈餘分配議案業經 104 年 2 月 4 日董事會擬議配發員工現金紅利新台幣 84,787 仟元及董事酬勞 4,200 仟元。

(2)擬議配發員工股票紅利金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工紅利總額合計數之比例：

本期無擬議配發員工股票紅利之情事，故不適用。

(3)考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：

因應員工紅利及董事、監察人酬勞已費用化，故不適用。

4.盈餘分配議案業經股東會決議者：不適用。

5.前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

本公司 103 年 6 月 12 日股東會決議配發 102 年度之員工現金紅利為新台幣 38,957 仟元，董事及監察人酬勞新台幣 5,194 仟元。前述擬議配發金額與本公司 102 年度所估列之費用並無差異。

(八)公司買回本公司股份情形：無

五、公司債(含海外公司債)辦理情形：無。

六、特別股辦理情形：無。

七、參與發行海外存託憑證辦理情形：無。

八、員工認股權憑證辦理情形：

(一)員工認股權憑證辦理情形：

截至 104 年 3 月 23 日止

員工認股權憑證種類	第一次發行	第二次發行	第三次發行	第四次發行	第五次發行
申報生效日期	95/7/3	95/7/3	96/6/26	96/6/26	101/1/10
發行日期	95/9/29	96/1/16	96/6/27	96/12/14	101/6/14
發行單位數	5,025,000	975,000	2,580,000	2,000,000	6,000,000
存續期間	10 年	10 年	10 年	10 年	5 年
發行得認購股數占已發行股份總數比率	4.19%	0.46%	1.23%	0.93%	2.57%
得認股期間	97/9/29~105/9/28	98/1/16~106/1/15	98/6/27~106/6/26	98/12/14~106/12/13	103/6/14~106/6/13
履約方式	發行新股	發行新股	發行新股	發行新股	發行新股
限制認股期間及比率(%)	屆滿 2 年 50% 屆滿 3 年 75% 屆滿 4 年 100%	屆滿 2 年 50% 屆滿 3 年 75% 屆滿 4 年 100%	屆滿 2 年 50% 屆滿 3 年 75% 屆滿 4 年 100%	屆滿 2 年 50% 屆滿 3 年 75% 屆滿 4 年 100%	屆滿 2 年 50% 屆滿 3 年 75% 屆滿 4 年 100%
已執行取得股數	3,823,250	581,750	1,409,250	1,006,500	1,652,340
已執行認股金額	46,577,301	8,213,950	21,268,250	19,111,138	35,360,079
未執行認股數量	72,500	0	9,000	0	2,760,410
未執行認股者其每股認購價格	10.1 元	11.9 元	14.8 元	18.6 元	21.4 元
未執行認股數量占已發行股份總數比率(%)	0.03%	0%	0.00%	0%	1.16%
對股東權益影響	對原有普通股股東 股權稀釋影響不大	無影響	對原有普通股股東 股權稀釋影響不大	無影響	對原有普通股股東 股權稀釋影響不大

(二)累積至公開說明書刊印日止，取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大員工之姓名、取得及認購情形：

職稱		姓 名	取得認股數量	取得認股數量占已發行股份總數比率	已執行				未執行(註 2)			
					認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率	認股數量	認股價格	認股金額	認股數量占已發行股份總數比率
經 理 人	總經理	關欣	2,515,000	1.1%	908,250	13.71	12,450,425	0.38%	746,000	20.68	15,424,075	0.31%
	總經理(註 1)	陳立惇										
	副總經理	林中安										
	副總經理(註 1)	曾漢良										
	副總經理(註 1)	胡頂達										
	副總經理	溫英男										
	副總經理(註 1)	田正人										
	副總經理(註 1)	陳偉銘										
	副總經理	尤龍生										
	副總經理	何彥仕										
	副總經理	方文良										
	協理	林恕敏										
	協理(註 1)	張佩文										
	協理(註 1)	王學春										
	協理(註 1)	蕭博文										

註 1：已離職。

註 2：扣除已離職經理人之未執行員工認股權憑證 860,750 股，認股金額 12,573,725 元。

職稱		姓 名	取 得 認 股 數 量	取 得 認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率	已 執 行				未 執 行(註 4)			
					認 股 數 量	認 股 價 格	認 股 金 額	認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率	認 股 數 量	認 股 價 格	認 股 金 額	認 股 數 量 占 已 發 行 股 份 總 數 比 率
員 工	廠長	范振梅	1,045,800	0.4%	727,640	15.38	11,192,009	0.30%	188,160	21.40	4,026,624	0.08%
	處長	劉建宏										
	處長	黃亮凱										
	處長	周正德										
	處長	劉滄宇										
	處長(註 3)	蔡琪銘										
	處長	胡益誠										
	處長(註 3)	陳世明										
	處長(註 3)	錢文正										
	副廠長(註 3)	王思堯										

註 3：已離職。

註 4：扣除已離職員工之未執行員工認股權憑證 130,000 股，認股金額 2,188,000 元。

(三)最近三年度私募員工認股權憑證辦理情形：無。

九、限制員工權利新股辦理情形：無。

十、併購辦理情形：無。

十一、受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

參、營運概況

一、公司之經營

(一)業務內容

1.業務範圍

(1)業務之主要內容及其營業比重：

單位：新台幣仟元

項 目	103 年度營業額	營 業 比 重 (%)
晶圓級尺寸封裝	3,028,799	61.39
晶圓級後護層封裝	1,879,970	38.10
其 他	25,309	0.51
合 計	4,934,078	100.00

(2)公司目前之產品及服務項目：

A.目前商品(服務)項目：

(a)晶圓級尺寸封裝(Wafer Level Chip Scale Packaging)

(b)晶圓級後護層封裝(Wafer Level Post Passivation Interconnection)

B.計劃開發之新商品(服務)：

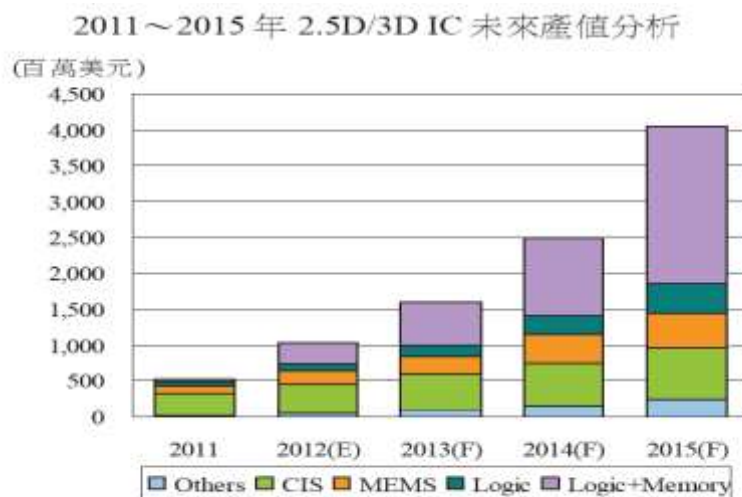
(a)應用於手機、筆記型電腦、個人行動電子裝置、穿戴式裝置、汽車環景安全、倒車影像及安全監測裝置之晶圓級封裝影像感測器。

(b)應用於各種輕薄短小之消費性電子、電腦、通訊、資訊電子、光學電子之各式微機電，感測元件及電源管理元件之晶圓級晶方尺寸封裝及測試。

2.產業概況

(1)產業之現況與發展：

2013雖然電腦產業之PC出貨量不如預期，然半導體產業受惠於中低階智慧手機與平板電腦興起帶來高規平價風潮，使得半導體產業從晶圓代工乃至封裝、測試依然持續成長，全球半導體於2013年有4.5%的成長。展望2014年除原有之中低階智慧手機與平板電腦之需求外，受惠行動裝置搭載4G LTE通訊晶片之需求帶動通訊晶片成長，預估2014年半導體成長4.2%，而封測產業預計有5.8%的成長。另受到終端產品訴求面板高解析、產品輕薄、省電、長待機時間及直覺操控等趨勢影響，將帶動高速傳輸IC、感測器、觸控IC、電源管理IC及無線通訊IC等所需晶片多元發展，促使異質多層封裝與2.5D/3D IC發展受到矚目。根據TRI的預估，2.5D/3D IC的產值於2015年將達40億美元，其中CIS及MEMS為最早進入量產之應用。



Source：拓璞產業研究所整理，2012/11

由產品需求面觀察，2014 CES展可發現7個重要趨勢，分別是汽車、網路/雲端、穿戴式、感應器、UHD TV、高品質聲音及遊戲。進而分類可歸納成3個方向，第一個是汽車方面，包括相機模組等各種感應器、網路的運用，使得汽車更加智慧化。第二個是穿戴式裝置，得依靠不同的感測器、網路雲端的輔助使其功能更加多元，創造更多消費者價值。第三個為高品質影音，如新一代遊戲機PS4、XBOX One的高銷售，並未因手機App的興起而沒落，反而逆向成長。這些皆代表著影像感測、人機介面感測等需求之應用與成長。



根據拓璞產業研究報告CIS (CMOS Image Sensor影像感測晶片)市場因移動終端出貨大爆發，有著驚人的成長，CIS作為終端移動之關鍵零組件，是行動裝置行銷之一大賣點，CIS市場規模自2012~2016年之年複合成長率達6.8%，預計2016年可達160億美元。

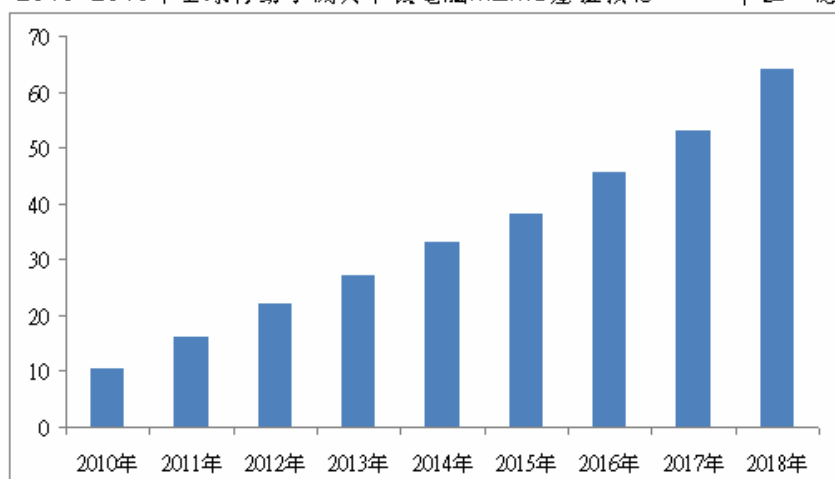


除了智慧型手機，車用領域將因安全因素而大量採用CIS，包含車前鏡頭帶來的主動式剎車，或是車體四周鏡頭帶來環景顯示，以及不可或缺的車後鏡頭帶來的停車及後方來車指示。預計一台車至少將搭載6~8顆以上之CIS，未來有機會成長到10顆以上，將為這個產業帶來爆發性的貢獻，同時也是TRI預期成長性最大的應用產品。



根據市調機構 Yole Développement 最新調查報告顯示，2012 年智慧型手機與平板電腦用微機電感測器市場產值達到 22 億美元，根據該市調機構分析師 Laurent Robin 預測，微機電感測器 2013~2018 年的年複合成長率將為 18.5%，2018 年預估可達到 64 億美元市場產值。

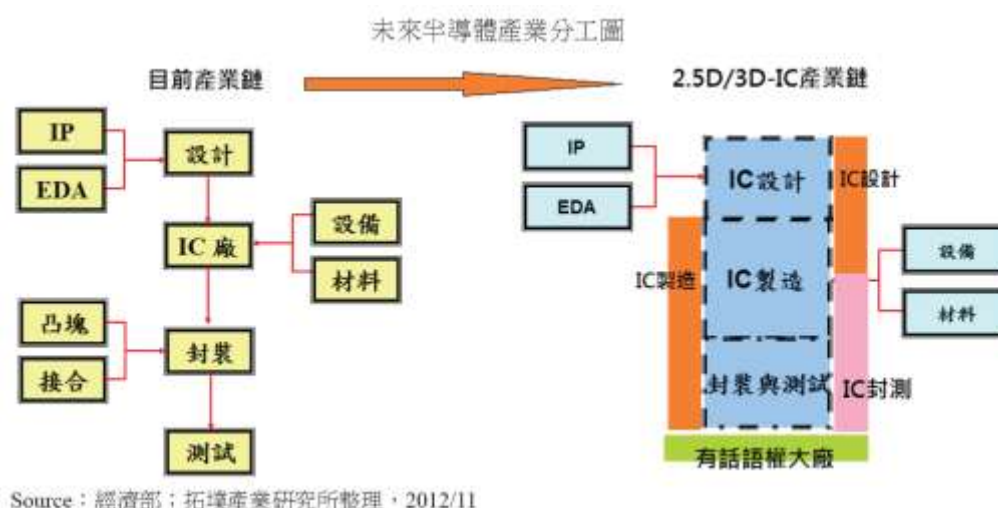
2010~2018年全球行動手機與平板電腦MEMS產值預估 單位：億美元



資料來源：Yole Developpement，2013/8

(2)產業上、中、下游之關聯性

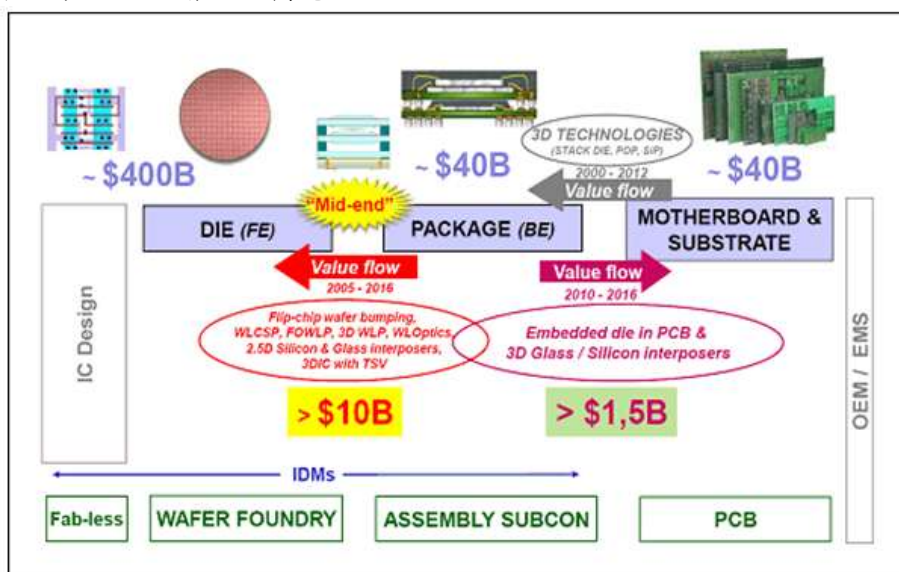
本公司係一專業晶圓層級封裝代工廠，其產品(服務)為各項積體電路之封裝，所提供之產品(服務)與整體產業之關聯性概括如下表所示：



(3)產品之發展趨勢

近幾年半導體元件之製造發展新興技術，則以介於前段（Front-End）和後段（Back-End）製程之間的中段（Mid-End）製程為代表，包含晶圓凸塊技術（Wafer Bumping）、晶圓級封裝（Wafer Level Package），如 Fan-out WLP、WLCSP、3D WLP、WL Optics 及 3D IC 等技術型態，其產值已超過 15 億美元。而本公司為專業晶圓層級 IC 封裝之領導者，也是第一家將三維晶圓層級封裝技術商品化的公司。三維晶圓層級封裝技術可應用到各種不同的市場領域，包括消費性電子、通訊、可攜式電腦和汽車等。產品應用包括影像感測器、光學感測器、電源管理積體電路、功率分離式元件、類比積體電路、混合信號積體電路、微機電系統感測器、指紋感測器和整合式被動元件等。

鑒於高階封裝製程的需求，如覆晶封裝(Flip Chip BGA or Flip Chip CSP)、晶圓層級封裝(Wafer Level CSP)、銅打線(Cu Wire Bond)、銅柱凸塊(Cu Pillar)等。尤其是在未來 2.5D/3D IC 或矽穿孔(Through Silicon Via-TSV)封裝興起，晶圓層級封測服務將扮演關鍵性角色。



資料來源：Yole(2012)。

新興中段 (Mid-End) 產業

(4)競爭情形：

本公司之主要產品為影像感測器、指紋辨識感測器、微機電及電源控制元件之晶圓層級封裝，其主要競爭對手如下：

主要產品	主要競爭對手
影像感測器	華天科技、晶方
指紋辨識感測器	頤邦、南茂、晶方

3.技術及研發概況

(1)所營業務之技術層次與研究發展：

- TSV（矽穿孔封裝）封裝技術：成功導入 CIS(CMOS Image Sensor)產品量產，並可應用於 MEMS 等相關封裝製程。
- CIS-CSP 製程改善技術：導入車規影像封裝產品，已完成車規封裝驗證導入量產。
- 導入特殊光學鍍層玻璃並應用於各式先進光學感測器。
- 開發厚銅製程，成功應用於整合式被動元件產品，已進入驗證階段。
- 通過多達 422 件之專利提案數，業已取得 60 件台灣專利、44 件大陸專利、2 件日本專利及 102 件美國專利，其他各案也陸續進行申請中，其中大部分為有關先進封裝技術之結構設計及製造方法等專利，大幅提高了公司的技術競爭力。

(2)研發人員與其學經歷：

單位：人

年度 項目	100 年度	101 年度	102 年度	103 年度
博士	5	5	6	7
碩士	69	68	79	103
大學(專)	38	49	38	46
高中職	20	37	13	19
合計	132	159	136	175
平均年資	2.7	3.2	3.9	3.7

(3)最近五年度每年投入之研發費用

單位：新台幣仟元

年度 項目	99 年度	100 年度	101 年度	102 年度	103 年度
研發費用	195,683	191,870	206,117	216,971	276,681
營業收入淨額	3,962,254	3,866,586	3,139,385	4,256,761	4,934,078
研發費用/營業收入淨額	4.94%	4.96%	6.57%	5.10%	5.61%

(4)最近五年度成功開發之技術或產品

年度	研發成果	主要功能/效益
99	矽穿孔(integrated circuits through silicon vias，縮寫 TSV)製程導入量產	Taper Via 製程技術導入量產並採用 Al 導線製程，提供可靠度佳的封裝方式。
	2D Fan in/out	提供 BGA 製程來連接晶片表面 pad
100	Lead tail 保護製程導入	提升模組對於高溼氣環境的抵抗能力
	黑色遮光層製程導入	遮蔽背景光源雜訊，提供車用 CMOS 影像感測器更佳的影像品質。
101	矽穿孔(TSV)製程導入量產	Vertical Via 製程技術導入量產並採用 Cu 導線製程，提供傳輸速率更快的封裝方式。
	建立電路 spice model 資料庫	提供客戶封裝的電性 model，讓客戶針對電路設計做先期評估。
102	溝渠式打線結構製程量產	提供溝渠式打線結構封裝製程。
	V 型矽穿孔(TSV)製程導入量產	採用鋁導線製程 Taper Via (low cost)的矽穿孔製程，技術導入量產，並提供更佳可靠度的封裝方式。
103	暫時性 Bond 製程導入	提升薄晶圓製程的處理能力，採用製程中暫時性載板技術，降低破片的風險。
	功率節能元件的厚銅製程	應用於系統晶片和被動元件(電阻、電感等)產品整合。

4.長、短期業務發展計畫

在面對國內外同業競爭壓力及市場變化快速的要求，本公司擬訂之長短期計畫如下：

(1)短期計畫：

a.建立以客戶導向之專業封裝服務，強化顧客滿意度

提升本公司所有客戶值得信賴的高品質服務，以更快、更好的技術與服務，滿足客戶的需求；並在晶圓級製程平台上提供更多樣的封裝技術，以因應多元化產品的需求。

b.加強上、中、下游產業鏈之合作

先進製程需求越來越高之際，上、中、下游之合作與整合是先進高階製程能否成功之重要關鍵，本公司致力與晶圓代工業者及測試大廠共同策略聯盟，並與國際整合元件製造大廠之技術合作開發，將可望成為先進封裝技術服務之龍頭。

c.健全公司經營體質，以職能為培育核心，提昇管理及經營績效

透過教育訓練達成公司經營策略目標，以提升管理及技術專業為訴求，有效發揮職能作為培育核心，並以改善工作成效為導向，進一步提升員工工作效率，使公司能因應環境的快速變化與不斷的挑戰。

(2)中長期計劃：

a.注重客戶與供應商長期合作發展關係

強調與上下游廠商的長期合作，在產業專業分工的趨勢中，本公司將成為客戶信賴的封裝加工廠，提供客戶需要的品質與服務，同時也與供應商建立良好的合作關係。

b.加強研發創新能力

致力於衍生製程與新製程之研究發展，如先進 3D 晶圓層級堆疊之應用、矽晶圓連接之載板等。產品之應用將從消費性與電腦之應用提昇至汽車電子產業。

(二)市場及產銷概況

1.市場分析

(1)主要商品之銷售地區

單位：新台幣仟元

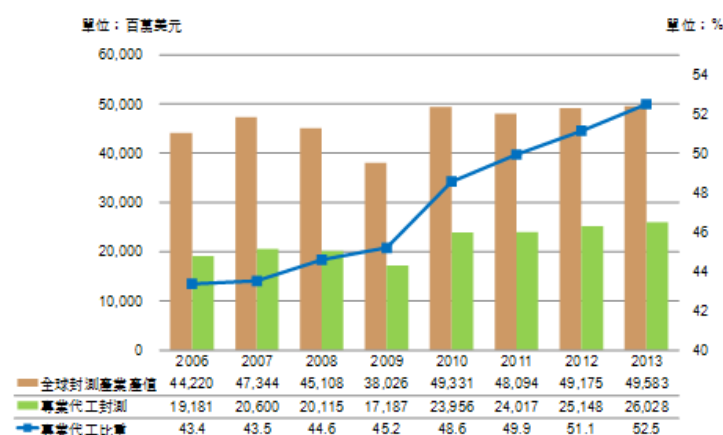
年 度 地 區	102年度		103年度	
	金 額	%	金 額	%
美 國	1,630,592	38	1,528,052	31
台 灣	1,190,213	28	2,069,314	42
亞 洲	960,429	23	686,177	14
歐 洲	475,527	11	650,535	13
合 計	4,256,761	100	4,934,078	100

(2)市場占有率

全球封測產業主要由整合元件廠(Integrated Device Manufacturer; IDM)及專業封裝測試廠所構成。隨 IC 製造微縮製程技術演進，資本支出與研發費用即呈現快速攀升。因此，多數日、歐系 IDM 除停止對 45/40 奈米及其以下先進製程投入研發與資本支出外，亦先後關閉或出售不具效益封測產能，並將先進封測業務委外代工。在此消彼長的情況下，造成來自專業封測廠產值金額成長力道大於來自 IDM 產值。造就來自專業封測廠商產值佔全球封測產業產值比重從 2001 年 28.7%逐年成長至 2013 年 52.5%。DIGITIMES Research 預估，在 IDM

資產輕量化策略持續實施，加上半導體產業採用先進製程比重持續增加的預期下，專業封測廠商佔全球封測產業產值比重將持續攀升，並將成為全球封測產業重要成長動能。

2006~2013年全球專業封測佔全球封測產業產值比重



資料來源：DIGITIMES，2014/3

(3)市場未來之供需狀況與成長性

2014 年智慧型手機與平板電腦出貨仍將維持兩位數百分點成長動能的預期下，全球專業封測產業來自通訊與先進封裝製程產值仍將成為帶動產值成長重要動能。本公司主要產品為晶圓層級之封裝代工服務，應用產品包含行動裝置如智慧型手機及平板電腦、汽車電子及穿戴式裝置等應用。其主要應用領域之供需狀況與成長性分析如下：

A.行動裝置

2013 年全球智慧型手機出貨量將首次超越基本功能手機；根據 NPD DisplaySearch 近期發佈的智慧型手機季報顯示，2013 年全球智慧型手機出貨量預計將達到 9.37 億支，而基本功能型手機只有 8.89 億支；估計 2011 到 2016 年間，智慧型手機出貨量將以 26%的複合年成長率(CAGR)增加至 14.5 億支，佔全體手機市場的三分之二。另至 2015 年全球 Tablet 產品出貨量約 15.2%年成長率。全球包括 PC、平板，及智慧型手機在內的「智慧連網裝置」(Smart Connected Devices)於 2014 年總出貨將超過 17 億台，其中智慧型手機與平板合計將達 14 億台，產值超過 5,000 億美金，PC 佔 3 億台及 2,000 億美金產值。



B. 汽車電子

全球汽車業發展迄今，已有 80% 的創新成果來自車輛與電子科技、數位化趨勢的深度融合，且繼續朝節能動力、安全科技與車載資、通訊等領域發展。IC Insights 更推估到 2015 年隨著車用電子佔整車製造成本比重達 50%，全球市場規模將上看 4,000 億美元，可為相關供應鏈帶來龐大商機。由於未來智慧車輛技術以主動安全、舒適便利及節能為三大主軸，目前各大國際車廠都特別以智慧車輛之主動安全暨自動防撞為未來車輛設計重點，其中又以影像辨識系統加上影像感測器，讓汽車「看」得見周遭路況，並且利用快速運算的電腦分析判斷以獲得的影像資料。未來甚至可以進一步預知車輛可能遭遇到的狀況，再主動提出避開危險的警示，直接指揮車輛進行避險動作。由此可見，動態影像辨識將為未來車輛智慧化主動安全系統之關鍵要素。



C. 穿戴式裝置

根據拓樸產業研究所(TRI) 推估 2014 年全球智慧穿戴式裝置出貨量出貨量將會成長到 7,330 萬台，年成長 87%；至於 2015 年則會超過 1 億台，年成長率達 36.5%。雖然年成長率會逐年下降，但是這也是因為出貨量的起始基期比較低；以數量來看，智慧穿戴式裝置將會逐步成長。其應用範圍橫跨各大產業，包含安全、醫療、健康、運動、生活運算、通訊及穿著等。智慧穿戴式裝置會有 4 個關鍵的發展方向：感應器、雲端網路、資料分析及整合服務。在感應器方面，就是透過大量感應器來抓取各種不同的資料，使得感應器種類逐漸增多，讓裝置能獲得的資料種類增加，也會導致感應種類的需求增加，新的感應器出現或是原本既有的裝置開始小型化，進而帶動先進封裝在穿戴式裝置之應用。



(4)競爭利基

A.生產效率提升，降低成本提升競爭優勢

近年積極加速設備自動化、產線流程優配化以提升產能稼動率，並整合資源利用各廠區產能機動調配之方式，快速提供產品及服務，取得客戶長期穩定之信賴。

B.技術領先暨產品應用多樣化

本公司經營團隊具備多年 IC 半導體研發、生產暨銷售經驗，除產品優良、交期迅速、售後服務良好深受客戶信賴外，市場行銷與研發團隊建立完善的新技術專利，並配合客戶產品需求開發出多種先進之晶圓層級封裝，並獲得國際品牌大廠認證之合格供應商。

C.產業鏈優化整合

本公司身為台積電策略投資之公司，不僅利用本身之技術與行銷能力，建立強大之客戶群，更結合台積電在半導體供應鏈中提供完整之一條龍服務 (Turn-key service) 包含研發及生產等服務。

D.國際分工之優勢

台灣封裝業的發展，即以扮演全球半導體業供應鏈夥伴的定位，藉先進技術發展策略，並整合品質、成本、交期、產能及服務之總體運籌優勢，締造在國際分工體系中的總體競爭地位。本公司身為先進晶圓層級封裝服務之提供者，不僅提供國內外客戶上游 IC 設計公司完整之供應生產鏈體系，並藉由與 IC foundry 公司合作，解決生產過程衍生之相關議題。

(5)發展遠景之有利、不利因素與因應對策

①有利因素

A.先進晶圓層級封裝之成長

因應終端產品需求，晶圓層級封裝製程發展不斷往前推進，目前封裝產品追求的製程目標包括：尺寸縮小、功率降低、功能與頻寬增加，以期超越

摩爾定律，希望將半導體元件與模組的功能性與整合度發揮到極致。其中晶圓層級封裝堆疊技術已從嵌入式晶圓級封裝(Embedded WLP)，一直發展到堆疊式晶圓級封裝(Stacked Chip Scale Package；SCSP)、封裝層疊(Package on Package，PoP)以及矽穿孔(TSV)等。從技術發展脈絡可以發現，半導體封裝產業不斷在追求可以減少晶片厚度及材料成本、提升晶片效能、降低電磁干擾與功率消耗的 3D 堆疊封裝技術。面對晶圓層級封裝趨勢所帶動的市場機會，臺灣因半導體產業鏈完整，因此具有晶圓層級封裝生態發展優勢。預計未來晶圓層級封裝技術應用領域將會十分寬廣。

B.新興亞洲將成最大的消費性電子產品銷售區

探究 2014 年全球消費性電子成長最主要是來自於新興亞洲、中東、非洲及東歐這四大新興地區的高成長所帶動；而新興亞洲地區的全球消費性電子銷售額更將首次超越北美地區，成為全球最大的消費性電子銷售地區，占全球比重達 24%。除了中國消費電子產品銷售額的成長外，近年來國民所得大增的馬來西亞、泰國與中產階級崛起的印尼、越南及菲律賓等，都帶動了新興亞洲消費電子產品銷售額大幅成長。

C.關鍵技術之自主研發

本公司持續強化研發能量，近年亦開發出可應用於作動感測器、指紋辨識感測器及汽車電子相關之晶圓後護層封裝，由於產品品質優異，因而獲得多家國際級品牌大廠及汽車廠之合格供應商。另本公司近年亦開發多種微機電感測器之晶圓後護層封裝技術，該技術可達成產品輕薄短小之需求，對新興之行動裝置及穿戴式裝置之輕量化有極大助益。

②不利因素

A.終端產品生命週期短，平均售價下滑

產品替代性高，在眾多競爭者同時分食市場大餅的情況下，競爭激烈，使得價格下跌快速，產品利潤薄。

因應對策：

因應電子產業及半導體產業市場與其技術的不斷變化，本公司的競爭利基為持續開發先進製程與新衍生技術，強化與關鍵客戶合作並整合上游產業龍頭技術，提供客戶高附加價值之封裝解決方案，並確保客戶產品即時導入市場，持續精進製造管理以提高生產力並降低營運成本，進而提升或維持利潤。

B.中國大力扶植本土半導體產業

中國政府重金支持半導體先進製程技術之開發包含 IC 設計、晶圓代工、封裝測試乃至設備研發等產業，藉由資金的挹助，降低市場價格，以掠奪市場佔有率及人才獵取。

因應對策：

聚焦發展先進晶圓層級封裝，因應各種功能應用來達到產品差異化的效果，導入自動化設備，提升產能及品質，並有效降低成本。選擇及轉進利基應用市場，包括綠能、醫療及車用電子等領域。對於類比、感測器等晶片出現高度需求，同時強力佈局專利地圖，以提升並拉大競爭力之差異化。

2.主要產品之重要用途及產製過程

(1)主要產品之重要用途

產品別	主要用途	主要應用領域
晶圓級尺寸封裝	影像感測器、環境感測器	手機、平板、筆記型電腦、汽車、醫療
晶圓級後護層封裝	指紋辨識感測器、作動感測器、微機電元件、功率、類比及 RF 元件	手機、平板、筆記型電腦、汽車

(2)產製過程

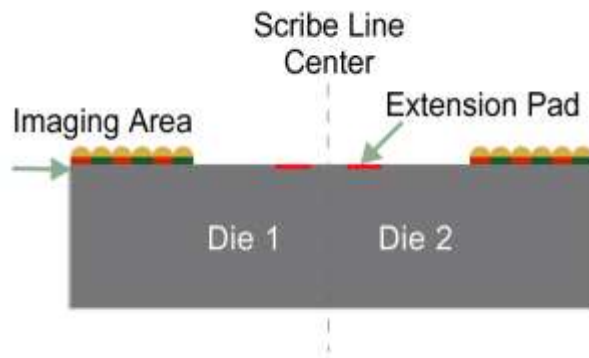
A.晶圓級 CSP 封裝技術製程：

在晶片尚未切割前即進行，整片晶片經由薄膜，黃光及蝕刻等晶圓製程完成封裝，最後再切割成單顆的 IC，此種製程可視為前段半導體晶圓廠製程的延伸。最大優點是在封裝的過程中，藉由整片晶片的製程方式，但卻同時將個別的 IC 封裝完成來降低封裝過程中的支出。整個封裝製程的基本步驟如下列所述：

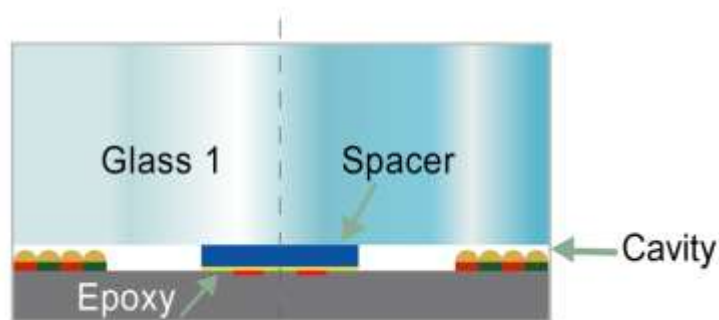
- 以黏著劑將一片高透光性之薄玻璃黏貼於客戶晶片的正面以保護晶圓表面不受污染。
- 研磨黏有玻璃的晶片背面，使晶片的厚度變薄，藉此降低之後的封裝厚度。並以蝕刻的方式將晶片切割道背面的矽材料去除，使一顆顆獨立 IC 產生於黏著的玻璃保護片上。
- 將玻璃保護層黏貼於晶片背面，以達到完全包覆 IC 的保護作用。
- 在玻璃表面準備製作銲接點(Solder Joint)的所在位置覆上一層有機材料作為絕緣緩衝層。
- 在個別的 IC 之間切割露出 IC 銲墊的截面再濺鍍上金屬層，再利用三度空間之曝光、顯影及蝕刻等製程完成所需的金屬線路，使線路與 IC 銲墊的截面相連通。
- 在金屬線路上覆蓋上一層保護層。
- BGA 型式的元件則以印刷的方式將錫膏印在整片晶片上銲接點的所在位置，在經過迴銲(Reflow)形成錫球。
- 切割晶片成為單顆封裝完成的 IC。

Wafer Level CSP –Shell 3D Process Flow

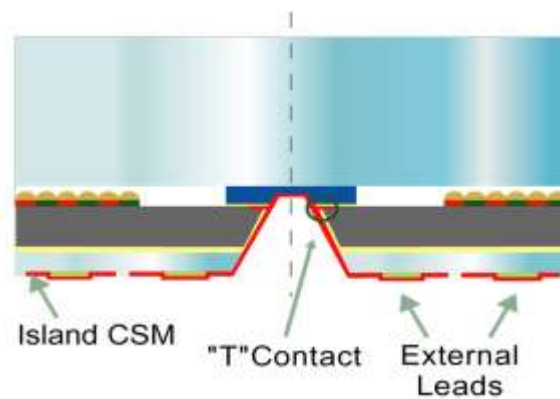
Step A: Passivation and Pad Extension Layers



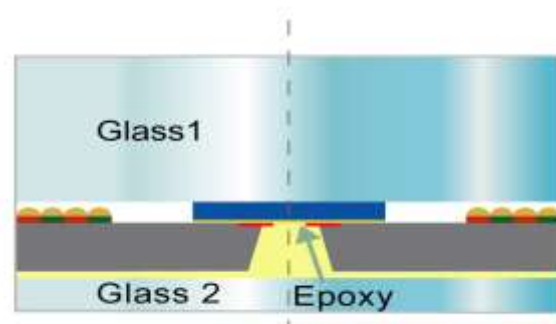
Step B: Glass 1 Attachment



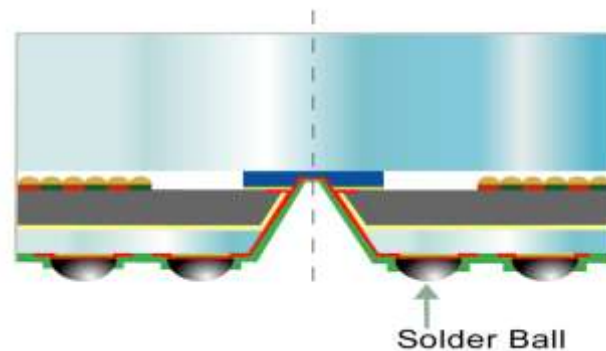
Step C: Etching and Glass-2 bonding



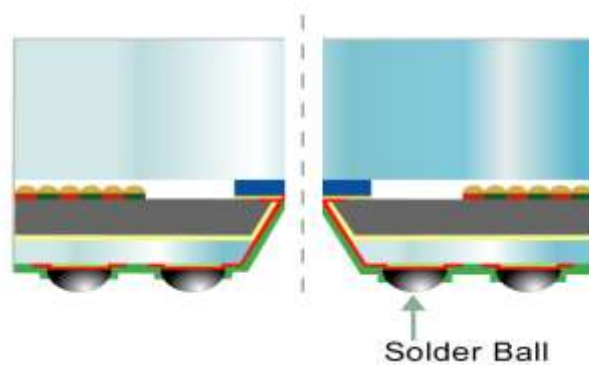
Step D: Barrier deposition and T-contact formation



Step E: Passivation coating and BGA formation



Step F: Dicing and Final inspection



B.TSV(矽穿孔封裝)技術步驟說明：

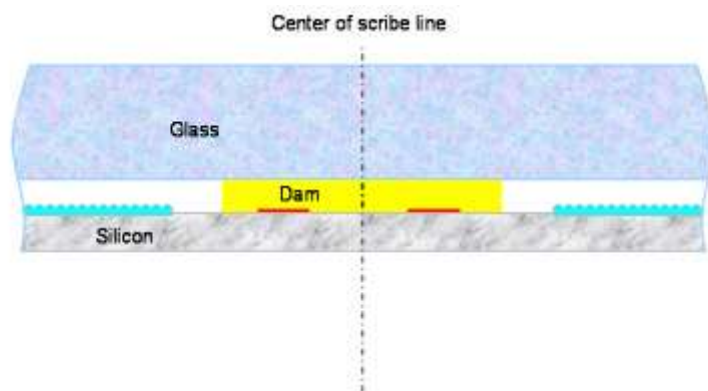
- 以黏著劑將一片高透光性之薄玻璃黏貼於客戶晶片的正面以保護晶圓表面不受污染。
- 研磨黏有玻璃的晶片背面，使晶片的厚度變薄，藉此降低之後的封裝厚度。
- 以蝕刻的方式從晶片背面的矽材料去除，作為 RDL 線路連接之孔洞。
- 在晶片表面覆上一層二氧化矽作為絕緣層。
- 在晶片表面濺鍍上金屬層，再利用三度空間之曝光、顯影及蝕刻等製程完成所需的金屬線路，使線路與 IC 鐳墊的截面相連通。
- 在金屬線路上覆蓋上一層保護層。
- BGA 型式的元件則以印刷的方式將錫膏印在整片晶片上鐳接點的所在位置，在經過迴鐳(Reflow)形成錫球。最後切割晶片成為單顆封裝完成的 IC。

TSV Wafer Level Package – Process Flow

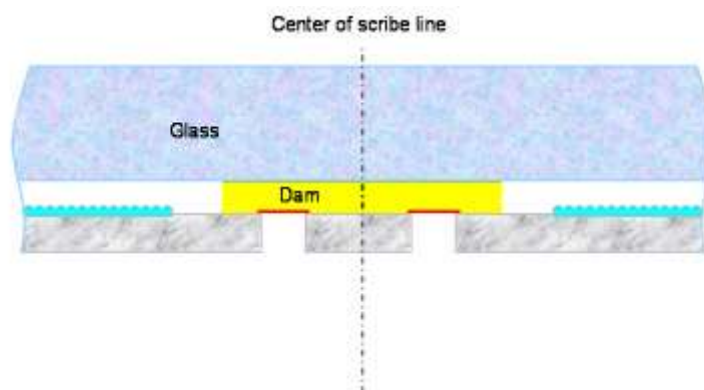
Step A: Glass attachment



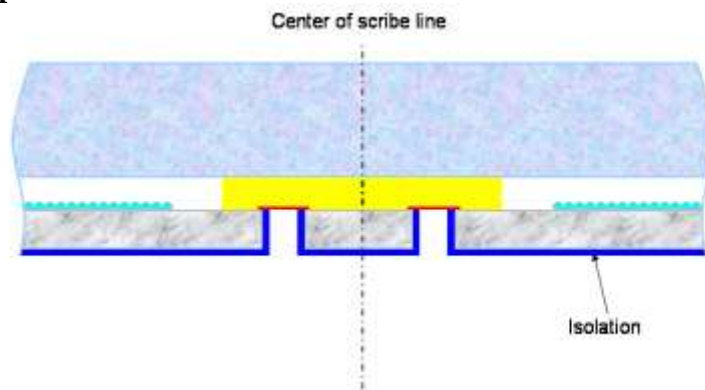
Step B: Wafer thin down



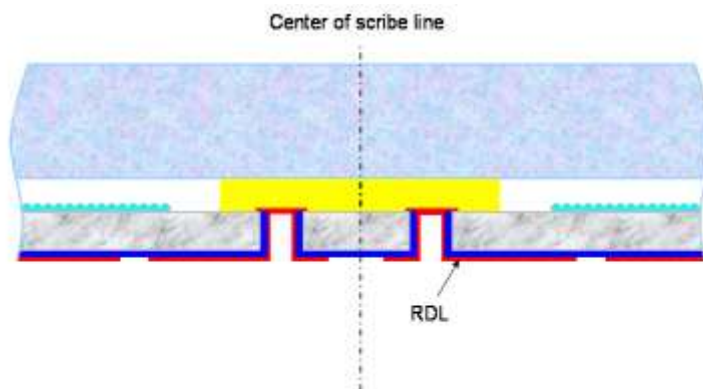
Step C: TSV formation



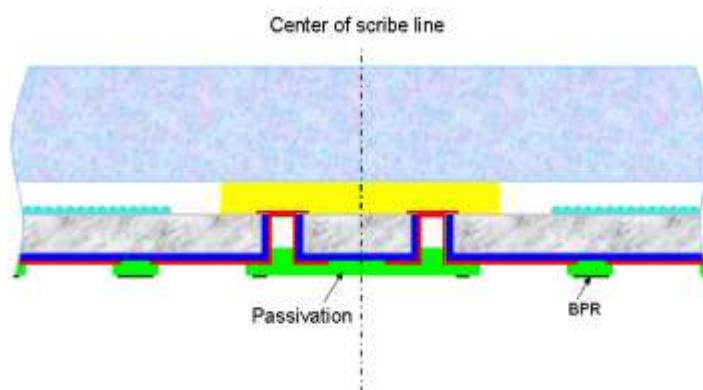
Step D: Isolation formation



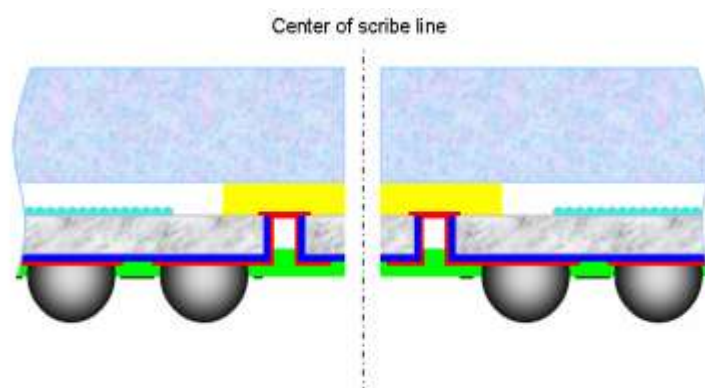
Step E: RDL process



Step F: Passivation process



Step G: BGA & Dicing processes



3.主要原料之供應狀況

主要原料	供應商名稱	國外	國內	供應情形
薄型玻璃	SCHOTT、NEG	✓		良好
電解光阻	台灣羅門哈斯		✓	良好
AP8000	台灣陶氏		✓	良好
靶材	優美科、有研、臺灣萬騰		✓	良好
鍍金液	MITSUYA、奧野製藥	✓		良好

4.最近二年度產品別或部門別毛利率重大變化之說明

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	102 年度		103 年度	
	毛利率(%)	變動率(%)	毛利率(%)	變動率(%)
晶圓級尺寸封裝	15.18	-	7.41	(51.15)
晶圓級後護層封裝	24.34	-	37.92	55.80
其他	(111.97)	-	42.45	137.91
毛利率(%)	16.33	-	19.22	17.68

103 年度毛利率增加之原因說明如下：

單位：新台幣仟元

項 目	前 後 期 增 (減)變動數	差 異 原 因			
		售 價 差 異	成 本 價 格 差 異	銷 售 組 合 差 異	數 量 差 異
晶圓級尺寸封裝	(277,538)	193,634	(399,349)	(25,288)	(46,535)
晶圓級後護層封裝	488,823	446,309	(82,353)	(67,856)	192,723
其他	41,776	(2,406)	44,182	0	0
說 明	1.晶圓級尺寸封裝： (1)售價有利差異：係高單價客戶比重增加所致。 (2)成本價格不利差異：主要係因高成本的客戶比重增加及 12 吋建廠成本增加所致。 2.晶圓級後護層封裝： (1)售價有利差異：係因新產品加入，致平均售價上升。 (2)成本價格不利差異：主要係因新產品之製程較複雜，故單位成本較高所致。				

5.主要進銷貨客戶名單

(1)最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例：最近二年度均無供應商占進貨總額百分之十以上。

(2)最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上客戶名稱及其銷貨金額與比例

單位：新台幣仟元

項目	102 年度				103 年度			
	名 稱	金 額	占全年度 銷貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係	名 稱	金 額	占全年度 銷貨淨額 比率(%)	與發行人 之關係
1	OVTI 集團	1,580,579	37.13	本公司法人董 事之母公司	台積電 集團	1,732,290	35.11	對本公司採權 益法評價之投 資公司
2	台積電 集團	862,283	20.26	對本公司採權 益法評價之投 資公司	OVTI 集團	1,425,860	28.90	本公司法人董 事之母公司
3	A 公司	484,182	11.37	無	B 公司	667,339	13.52	無
4	B 公司	422,281	9.92	無	A 公司	476,558	9.66	無
	其他	907,436	21.32	-	其他	632,031	12.81	-
銷貨淨額		4,256,761	100.00	-	銷貨淨額	4,934,078	100.00	-

變動說明：主要係積極拓展新客戶，降低客戶過度集中之風險以及新產品指紋辨識感測器量產。

6.最近二年度生產量值

單位：新台幣仟元、仟片(約當八吋晶圓)

年度 生產量值 主要商品	102 年度			103 年度		
	產能	產量	產值	產能	產量	產值
晶圓級尺寸封裝	422	375	2,929,007	437	314	2,783,245
晶圓級後護層封裝	352	260	598,589	554	397	1,158,335
其 他	0	0	62,626	0	0	14,567
合 計	774	635	3,590,222	991	711	3,956,147

7.最近二年度銷售量值

單位：新台幣仟元、仟片(約當八吋晶圓)

年度 銷售量值 主要商品	102 年度				103 年度			
	內銷		外銷		內銷		外銷	
	銷售量	銷售值	銷售量	銷售值	銷售量	銷售值	銷售量	銷售值
晶圓級尺寸封裝	36	345,564	334	2,962,850	30	286,285	287	2,742,514
晶圓級後護層封裝	170	834,213	85	86,419	311	1,769,507	86	110,463
其 他	0	10,436	0	17,279	0	13,522	0	11,787
合 計	206	1,190,213	419	3,066,548	341	2,069,314	373	2,864,764

(三)從業員工最近二年度及截至公開說明書刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

年 度		102 年度	103 年度	當 年 度 截 至 104 年 2 月 28 日
員 工 人 數	直 接 人 員	1,192	1,278	1,280
	間 接 人 員	555	693	700
	合 計	1,747	1,971	1,980
平 均 年 歲		32	33	33
平 均 服 務 年 資		3.3	3.4	3.4
學 歷 分 布 比 率	博 士	8	11	10
	碩 士	230	305	313
	大 專	772	913	927
	高 中	679	688	673
	高 中 以 下	58	54	57

(四)環保支出資訊

- 1.依法令規定，應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防治費用或應設立環保專責單位人員者，其申領、繳納或設立情形之說明：

(1)許可證申請

廠別	許可證名稱	許可證字號	審查/發證機關	有效期限
Line-A	固定汙染源設置許可證	府環空字第1020091609號	桃園市環保局	107.12.24
Line-A	固定汙染源操作許可證	府環空字第1020069378號	桃園市環保局	108.01.08
Line-A	水汙染防治許可證	府環水字第1030176246號	桃園市環保局	108.01.21
Line-B	水汙染防治措施許可證	桃縣環排許字第H2666-06號	桃園市環保局	106.11.11
Line-B	固定汙染源操作許可證	操證字第H4450-03號	桃園市環保局	107.10.20
Line-C	水汙染防治許可證	府環水字第1030110477號	桃園市環保局	108.05.11
Line-C	固定汙染源設置許可證	府環空字第1030132114號	桃園市環保局	108.06.06

(2)專責人員設置

廠別	專責種類	專責設置	核可文號	審查機關
Line-A	空氣污染	甲級空氣污染防制專責人員1位	府環空字第0950003588號	桃園市環保局
Line-A	水汙染	甲級廢水專責人員1位	府環水字第0950009303號	桃園市環保局
Line-A	廢棄物	甲級廢棄物專業技術人員1位	府環廢字第0950003756號	桃園市環保局
Line-B	空氣污染	甲級空氣污染防制專責人員1位	府環空字第0980085060號	桃園市環保局
Line-B	水汙染	甲級廢水處理專責人員1位	府環水字第0980088816號	桃園市環保局
Line-B	廢棄物	甲級廢棄物處理技術員1位	府環廢字第0980088812號	桃園市環保局
Line-C	空氣污染	甲級空氣污染防制專責人員1位	府環空字第1040011502號	桃園市環保局
Line-C	水汙染	甲級廢水處理專責人員1位	府環水字第1040010045號	桃園市環保局
Line-C	廢棄物	甲級廢棄物處理技術員1位	府環事字第1040008346號	桃園市環保局

(3)防治污染費繳納情形

單位：新台幣仟元

	102 年度	103 年度
污水處理費	21,191	20,236
空污處理費	9,848	542
委外廢棄物處理費用	14,795	25,965
其他	338	288
合計	46,172	47,031

2.列示公司有關對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益：

103 年 12 月 31 日，單位：新台幣仟元

設備名稱	數量	取得日期	投資成本	未折減餘額	用途及預計可能產生效益
廢水廠工程	1	2004-10-18	1,700	0	處理廢水達至排放標準
水洗回收系統	1	2006-11-30	9,000	0	生產用水回收以降低排放量
廢水處理設備	1	2009-02-28	3,180	861	處理廢水達至排放標準
廢水處理設備	1	2009-12-31	12,200	7,653	處理廢水達至排放標準
軟水及生產水回收	1	2010-10-29	5,650	2,707	生產用水回收以降低排放量
污泥脫水機	1	2010-11-30	1,720	842	處理廢水達至排放標準
污泥脫水機	1	2011-04-30	3,600	1,950	處理廢水達至排放標準
中園廠污水處理廠槽體工程	1	2012-06-29	4,980	3,735	收集廢液進行處理
建築物排水工程	1	2012-06-29	3,000	2,250	建築物排水
3F 酸鹼廢氣洗滌塔	1	2011-12-30	1,430	894	處理酸鹼廢氣達到空氣污染排放標準
酸鹼廢水回收設備	1	2012-11-30	18,250	14,448	處理酸鹼廢水達到排放標準
研磨廢水回收處理系統	1	2012-09-27	22,730	17,616	處理研磨廢水達到排放標準
酸鹼廢水回收處理系統	1	2012-09-27	20,281	15,731	處理酸鹼廢水達到排放標準
VOCs 之 RTO 設備	1	2012-11-30	2,063	1,633	處理有機廢氣達到空氣污染排放標準
VOCs 之 RTO 設備	1	2012-11-30	1,169	925	處理有機廢氣達到空氣污染排放標準
VOCs 之 RTO 設備	1	2013-08-31	24,305	18,084	處理有機廢氣達到空氣污染排放標準
中園廠污水處理廠槽體 FRP 塗裝工程	1	2013-01-29	11,000	8,892	收集廢水進行處理
VOCs 處理設備	1	2013-08-30	12,600	10,500	處理有機廢氣達到空氣污染排放標準
氫氟酸廢水處理系統	1	2013-03-29	1,960	1,617	處理氫氟酸廢水達到污染排放標準
VOCs 廢氣處理設備	1	2013-08-30	19,312	16,742	處理有機廢氣達到空氣污染排放標準
排酸排氣工程	1	2013-08-30	2,530	2,193	處理酸鹼廢氣達到空氣污染排放標準
氫氟酸廢水處理系統	1	2013-12-31	3,480	3,132	處理氫氟酸廢水達到污染排放標準

設備名稱	數量	取得日期	投資成本	未折減餘額	用途及預計可能產生效益
製程排氣工程	1	2013-11-29	1,100	930	處理酸鹼廢氣達到空氣污染排放標準
酸鹼廢氣洗滌塔	1	2014-04-29	2,950	2,789	處理酸鹼廢氣達到空氣污染排放標準
製程廢水處理	1	2007-06-24	7,579	53	處理製程廢水達到降低排放量
水洗回收系統工程	1	2007-07-31	10,673	788	回收水再利用以降低排水量
回收水、廢水、純水監控系統	1	2008-01-31	1,417	0	監控廢水處理情形
廢水改善工程	1	2009-09-30	9,063	3,116	處理廢水達至降低排放量
廢水處理系統	1	2014-12-31	28,000	28,000	處理廢水達至降低排放量

- 3.說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司改善環境污染之經過，其有污染糾紛事件者，並應說明其處理經過：無。
- 4.說明最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因污染環境所受損失（包括賠償）、處分之總額，並說明未來因應對策（包括改善措施）及可能之支出：無。
- 5.說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出：無。

(五)勞資關係

1.公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

「員工是公司最重要的資產」，本公司成立以來即強調人性管理的公司文化，並著重多項的福利措施，因此，在彼此關心共創未來的氣氛下，勞資關係和諧。

(1)員工福利措施：

- a.本公司已依照「職工福利金條例」之規定，提撥福利金，組織職工福利委員會，辦理職工福利事項，從業人員得享有各項福利措施及年節獎金。
- b.本公司從業人員一律參加全民健保、勞工保險及團體保險，享有各項保險給付權利及在職教育訓練等。
- c.本公司每年發放年終獎金，於年度結算時，如有盈餘，除繳納稅捐彌補虧損及提撥股息、公積金外，依年度考核之結果及相關制度配發紅利。
- d.本公司訂有員工績效獎金發放制度，總經理會視每季實際營運成果，決定季激勵獎金的發放。

(2)員工學習與發展：

培育專業人才、改善人力素質一直是本公司秉持的信念。為增進員工工作技能、讓員工快速融入工作環境、改善產品與服務品質、提升組織整體競爭力，本公司透過系統化的訓練藍圖展開教育訓練計劃，讓員工與公司一同成長。

103 年度共舉辦了 34 個班次的實體訓練課程，總訓練時數為 168.5 小時，總參與人次為 1,789 人次。另外，錄製了 132 堂專業技術的數位課程，總時數為 57.3 小時。總訓練費用為新台幣 1,325 仟元，平均每位員工的訓練時數為 37.9 小時。訓練類別包含：

a.新進人員訓練

由人資單位安排新進人員訓練活動，內容包含公司簡介、環安衛介紹、品質與環境限用物質管理系統介紹。

b.個人效能訓練

為提升個人工作能力、加強工作技能，以提升工作效率，規劃個人效能提升課程，如簡報技巧、溝通技巧等相關課程。

c.技術訓練

為強化研發能力與改善產品技術以增加公司競爭力，提供技術類專業訓練課程，以強化工程與研發人員之專業技術能力。

d.OJT 訓練

為使工程技術得以傳承，透過工作中學習，以培養技術人才，確保產品品質。

e.管理學習

根據不同階層的管理職能，系統化的規劃管理人員學習計劃，並依此展開相關的管理課程。

f.特定資格人員訓練

依相關法令規定或工作需求辦理特定資格人員訓練，並定期檢定，以增進工作技能，進而提升產品之品質。

(3)退休制度：

依勞動基準法相關規定，按每月薪資總額百分之二提撥員工退休準備金，專戶存入臺灣銀行信託部。並依勞動基準法規定，辦理員工退休金支付。自 94 年 7 月 1 日起，員工選擇適用勞工退休金條例之退休金制度者，按其每月薪資百分之六提撥至勞工保險局之個人退休金專戶。

(4)勞資間之協議情形：

本公司制訂人事管理規則及人事作業準則，從員工進用、升遷至退休、撫卹福利皆有完整規劃，作為公司與員工共同的規範。

2.最近二年度及截至公開說明書刊印日止，公司因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額及因應措施，如無法合理估計者，應說明無法合理估計之原因：請參閱第 48 頁。

(六)公司及其子公司於申請上櫃年度及其前二年度如有委託單一加工工廠於年度內加工金額達五千萬元以上者，應揭露該加工工廠之名稱、地址、電話、董事成員、持股百分之十大股東及最近期財務報表：

單位：新台幣仟元

公司名稱	地址	電話	董事成員	持股10%以上大股東	103 年度財務報表損益
耀穎光電股份有限公司	台北市中山北路2段112號11樓	(03)568-7700	清隆企業股份有限公司代表人：鄭祺耀 郭晉辰 劉魁 鄭偉國	清隆企業股份有限公司(84.95%)	9.604

(七)有無爭訟事件，及勞資間關係有無尚須協調之處：爭訟事件請參閱第48~49頁，勞資間並無尚須協調之處。

(八)有無因應景氣變動之能力：

本公司因應景氣變動能力落實在日常經營政策中。

- 1.加強客戶管理及信用額度之控制，降低營業風險並維持合理之利潤。
- 2.重視員工之在職訓練，以提高員工素質，增加對外在環境之敏感度及應變能力，使員工在不景氣之環境下能有群策群力之解決能力。
- 3.提供客戶完整之技術支援服務，充分運用現有客戶之優勢，掌握產品推出時機以提升競爭力。
- 4.積極推動公司股票上櫃掛牌，藉以取得長期穩健之營運資金，並提昇公司知名度吸引優秀專才。

(九)關係人間交易事項是否合理：

本公司與關係人交易，其價格及收款條件與一般交易無重大差異，與關係人交易應屬合理，請參閱本公司經會計師查核簽證之財務報告附註。

(十)如其事業係屬生物技術工業、製藥工業或醫療儀器工業者，應增列其依法令取得主管機關許可進行人體臨床試驗或田間實驗者或在國內從事生物技術工業或醫療儀器工業研究發展，且已有生物技術或醫療儀器相關產品製造及銷售或提供技術服務之實績暨

最近一年度產品及相關技術服務之營業額、研究發展費用所占本公司總營業額之比例情形：不適用。

(十一)公司如於提出上櫃申請前一年度因調整事業經營，終止其部分事業，或已將其部分之事業獨立另設公司、移轉他公司或與他公司合併者，應分別予以記載說明其終止，移出或合併之事業暨目前存續之營業項目，並提出目前存續營業項目前一年度之營業額研究、發展費用占公司該年度總營業額之比例情形：不適用。

二、不動產、廠房及設備及其他不動產

(一)自有資產

1.取得成本達實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上之不動產、廠房及設備：

103年12月31日，單位：新台幣仟元

不動產、廠房及設備名稱	單位	數量	取得 年 月	原 始 成 本	重 估 增 值	未 折 減 餘 額	利 用 狀 況			保 險 情 形	設定擔保及 權利受限制 之其他情事
							本 公 司 使用部門	出 租	閒 置		
中園路土地	平方公尺	28,356	100.03~ 103.08	668,500	0	668,500	生產事業	無	無	已投保	無
中園路廠房	式	1	101.06~ 103.08	484,761	0	428,876	生產事業	無	無	已投保	無
無塵室廠房、機電設備	式	1	103.12	327,120	0	327,120	生產事業	無	無	已投保	無

2.閒置不動產及以投資為目的持有期間達五年以上之不動產：無。

(二)租賃資產

1.融資租賃(成本達實收資本額百分之十或新台幣一億元以上)：無。

2.營業租賃(每年租金達五百萬元以上)：

資 產 名 稱	單 位	數 量	租 賃 期 間	租 金	出 租 人	租 金 之 計 算 及 支 付 方 式	租 約 所 定 之 限 制
中壢工業區 A棟及C棟之 廠房及辦公室	平方公尺	18,612	92/5~ 107/12	每月新台幣 3,132 仟元	經濟部	每季支付	不得轉租、出借或以其 他方式供他人使用

(三)各生產工廠現況及最近二年度設備產能利用率

1.各生產工廠現況：

各生產工廠之使用狀況

104 年 2 月 28 日，單位：平方公尺、人

項目 工廠	建物面積	員工人數	生產商品種類	目前使用狀況
Line-A	11,000	1,119	晶圓級尺寸封裝、 晶圓級後護層封裝	良好
Line-B	6,000	655	晶圓級尺寸封裝、 晶圓級後護層封裝	良好
Line-C	57,007	206	晶圓級尺寸封裝	良好

2.最近二年度設備產能利用率：

單位：仟片、新台幣仟元

年度 主要產品	102 年度				103 年度			
	產能	產量	產能利用率	產值	產能	產量	產能利用率	產值
晶圓級尺寸封裝	422	375	89%	2,929,007	437	314	72%	2,783,245
晶圓級後護層封裝	352	260	74%	598,589	554	397	72%	1,158,335
其 他	0	0	0	62,626	0	0	0	14,567
合 計	774	635	82%	3,590,222	991	711	72%	3,956,147

三、轉投資事業

(一)轉投資事業概況：無。

(二)綜合持股比例：無。

(三)上市或上櫃公司最近二年度及截至公開說明書刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司財務績效及財務狀況之影響：無。

(四)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，發生公司法第一百八十五條情事或有以部分營業、研發成果移轉子公司者，應揭露放棄子公司現金增資認購情形，認購相對人之名稱及其與公司、董事、監察人及持股比例超過百分之十股東之關係及認購股數：無。

(五)已赴或擬赴大陸地區從事間接投資者，應增列該投資事業之名稱、地址、電話、董事成員、持股百分之十大股東及最近期財務報表：無。

四、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
授權契約	Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. (原以色列商 ShellCase Ltd.)	89/6~(註 1)	WLCSP(晶圓級晶方尺寸封裝技術權利金)	保密責任
租賃契約	經濟部	101/8~104/8	中壢工業區 A 棟(A1-1)	不得將本契約為轉讓、贈與、分割或為其他方式之處分 不得轉租、出借或以其他方式供他人使用
		99/9~105/12	中壢工業區 A 棟(A4-1~A4-4)	
		92/5~108/12	中壢工業區 A 棟(A5-3)	
		92/10~108/12	中壢工業區 A 棟(A1-3,A1-4,A2-4)	
		92/11~108/12	中壢工業區 A 棟(A5-1)	
		95/3~105/3	中壢工業區 A 棟(A6-1,A6-2,A8-2)	
		99/10~105/12	中壢工業區 A 棟(A8-1)	
		103/1~107/12	中壢工業區 C 棟(C7-1,C7-2)	
		101/8~104/8	中壢工業區自強一路 6 號	
		103/1~107/12	中壢工業區 A 棟(A7-3)	
		103/1~107/12	中壢工業區 A 棟(A3-1)	
		103/1~107/12	中壢工業區 C 棟(C9-1,C9-2)	
		103/1~107/12	中壢工業區 C 棟(C8-2,C10-1,C10-2)	
		99/5~109/4	中壢工業區 A 棟(A5-4、A7-2、A8-3)	
	宏惠光電	99/11~109/10	中壢工業區 A 棟(A3-3, A3-4)	保密責任不得轉讓契約利益或設備，亦不得設定質權。
	優群科技	102/5~106/4	中壢工業區 C 棟(C2-2)	
	達楷生醫科技	103/7~104/7	中壢工業區 A 棟(A8-4)	
	台灣積體電路製造股份有限公司	102/5~104/12	晶圓封裝設備	
借款合同	遠東銀行	100/02~105/06	營運週轉	大股東持股承諾、未經銀行同意不得將 Line-C 之土地廠房設定質權予他人及其他財務比例承諾。
	遠東銀行	102/06~107/06	營運週轉	
	遠東銀行	102/06~107/06	機器設備擔保	
	遠東銀行	103/09~108/09	機器設備擔保	
	台北富邦銀行	102/05~105/05	營運週轉	
	台北富邦銀行	102/05~105/05	營運週轉	
	中華開發工業銀行	103/09~106/09	營運週轉	
	遠東銀行	101/08~104/08	保證	無
後段服務合約	台灣積體電路製造股份有限公司	102/6~(註 2)	後段封裝服務	保密責任

註 1：本契約除經雙方合意終止，本契約仍屬有效。

註 2：本契約至任一方重大違約，經他方終止為止。

肆、發行計畫及執行情形

一、前次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債資金運用計畫分析應記載事項：無。

二、本次現金增資、發行公司債、員工認股權憑證計劃或限制員工權利新股計畫應記載事項：

(一)資金來源：

1.本計畫所需資金總額：新台幣1,140,000千元。

2.資金來源：發行辦理國內現金增資發行普通股新股30,000 仟股，每股面額新台幣10元，發行價格為每股新台幣42元，實際募集總金額為新台幣1,260,000千元。原預計募集資金總額為1,140,000仟元，募集超過部分計120,000仟元，本公司將用以充實營運資金。

3.計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益：

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度
			104 年度
			第一季
償還銀行借款	104/3/31	1,140,000	1,140,000
預期可能產生效益	本公司辦理本次現金增資所募集 1,140,000 仟元係用以償還銀行借款，減少利息支出，以降低利息費用對獲利之侵蝕程度，並強化公司財務結構，改善償債能力。若以本公司擬償還之銀行借款利率(1.2380%~1.5063%)設算，104 年度可節省 11,322 仟元，未來可節省之利息支出每年約為 15,095 仟元。		

(二)本次發行公司債者，應參照公司法第二百四十八條之規定，揭露有關事項及其償債款項之籌集計畫與保管方法：不適用。

(三)本次發行特別股者，應揭露每股面額、發行價格、發行條件對特別股股東權益影響、股權可能稀釋情形、對股東權益影響及公司法第一百五十七條所規定之事項：不適用。

(四)上市或上櫃公司發行未上市或未上櫃特別股者，應揭露發行目的、不擬上市或上櫃原因、對現有股東及潛在投資人權益之影響及未來有無申請上市或上櫃之計畫：不適用。

(五)股票依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第五條規定核准在證券商營業處所買賣之公司發行新股者，應說明未來上市（櫃）計畫：不適用。

(六)本次發行員工認股權憑證者，應揭露員工認股權憑證發行及認股辦法：不適用。

(七)本次發行限制員工權利新股者，應揭露限制員工權利新股之發行辦法：不適用。

(八)說明本次計畫之可行性、必要性及合理性，並應分析各種資金調度來源對公司申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋影響：

1.本次募集計畫之可行性：

(1)法定程序之可行性：

本公司本次辦理現金增資發行普通股30,000仟股，係作為初次上櫃前辦理公開承銷之股份來源。本次現金增資業經103年6月12日股東會通過扣除依相關法令規定保留供公司員工承購部分之股數後，其餘股數由原股東全數放棄認購，以供一般投資人認購。另本次現金增資之重要內容業經104年2月4日董事會決議通過，本公司本次現金增資發行新股與「公司法」、「證券交易法」、「發行人募集與發行有價證券處理準則」、「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」等相關法令規定並無不符，故本次募集資金於法定程序上應屬適法可行。

(2)募集資金完成之可行性：

本次現金增資發行新股係依公司法第267 條規定，保留增資發行新股15%由員工認購；其餘股份則依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」之規定，以現金增資發行新股方式委託證券商承銷商辦理上櫃前公開銷售。而員工認購不足或放棄認購部分，經本公司 104年2月4日董事會授權董事長洽特定人認購，對外公開承銷認購不足部分，則擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理，故本次現金增資計畫之募集完成應具可行性。

(3)資金運用計畫之可行性

本公司擬以本次增資募集金額用以償還銀行借款，預計於本籌資計畫申報生效並完成資金募集後，即可於104年第一季將資金償還銀行借款，除減少利息費用外，更能強化公司財務結構，以因應未來營運規模擴充及業務成長所產生之資金需求，故本次充實營運資金之計畫應屬可行。

綜上所述，本公司本次現金增資發行新股計畫，法定程序上具適法性，且資金募集完成及資金運用計畫均具可行性，故整體而言，本公司籌資計畫應屬可行。

2.本次募集計畫之必要性：

本公司本次辦理現金增資發行新股係依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」及「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款之規定，以現金增資發行新股方式委託證券商承銷商辦理上櫃前公開銷售，故本次增資計畫得不適用有關募集資金計畫必要性之規定。

3.本次資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益之合理性：

(1)資金運用計畫及預計進度之合理性

本公司本次辦理現金增資發行新股係作為初次上櫃前之公開承銷，募集金額為新台幣1,260,000仟元。經考量本次向主管機關申報、審查時間、公開承銷及繳款作業等因素，預計於104年3月底可收足股款募資完成，於募集資金到位後，即可償還銀行借款。透過本次計畫，除強化本公司之財務結構外，更可有效提升本公司之競爭力，降低營運及財務風險，故本次資金運用計畫及預計進度應屬合理。

(2)預計可能產生效益之合理性

	103年12月31日	104年3月31日 (募資前)	104年3月31日 (募資後)
負債比率(%)	47.27	46.34	31.98

註：104年3月31日(募資後)所列數據係以103年底數據設算104年3月底增資後之情形。

本次辦理現金增資發行新股募集1,260,000仟元，主要用以償還銀行借款，將使本公司之財務結構更形健全。預估本次辦理現金增資償還銀行借款後，財務結構及償債能力均較募資前佳，故對本公司整體營運發展、健全財務結構及強化償債能力均有正面之助益，有效提昇公司資金調度能力及維持競爭力，降低營業及財務風險，其效益應屬合理。

4.各種資金調度來源對發行人申報年度及未來一年度每股盈餘稀釋之影響

本公司本次辦理現金增資發行新股，係依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第6條第2項第2款規定辦理現金增資發行新股方式辦理初次上櫃前之公開銷售案件，故僅就發行新股對當年度每股盈餘稀釋情形進行評估。

本公司本次辦理現金增資係依「發行人募集及發行有價證券處理準則」第6條第2項第2款規定辦理現金增資發行新股，並委託證券承銷商辦理初次上櫃前公開銷售，本次預計發行新股30,000仟股於104年3月底募集完成，以本公司現有股本238,287仟股估算，增資後已發行股份總額將增加至268,287仟股，本次現金增資發行新股占本公司增資後股數之11.18%，故本次發行新股對本公司104年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦尚無重大影響。

5.以低於票面金額發行股票者，應說明公司折價發行新股之必要性與合理性、未採用其他籌資方式之原因與其合理性及所沖減資本公積或保留盈餘之數額：不適用。

(九)說明本次發行價格、轉換價格、交換價格或認股價格之訂定方式：

本次現增發行價格之訂定，主要係依據本公司最近一個月興櫃平均股價，復參酌本公司之經營績效、資本市場狀況、產業前景發展、股票市場流動性等因素及投資人權益等條件，並依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，以每股發行價格為新台幣42元。本次承銷價格應尚能合理反映本公司之市場價值，且辦理公開承銷時，將針對市場對案件承銷價格的接受條件及認購情形進行調查，作為調整承銷價格之參考依據，故實際發行價格之說明，請另行參考承銷價格計算書。

(十)說明資金運用概算及可能產生之效益：說明資金之運用進度及本計畫完成後預計可能產生之效益：

1. 收購其他公司、擴建或新建不動產、廠房及設備者，應說明本次計畫完成後，預計可能增加之產銷量、值、成本結構（含總成本及單位成本）、獲利能力之變動情形、產品品質之改善情形及其他可能產生之效益：不適用。
2. 轉投資其他公司，應列明下列事項：不適用。
3. 充實營運資金、償還債務者，應列明下列事項：

(1)公司債務逐年到期金額、償還計畫及預計財務負擔減輕情形、目前營運資金狀況、所需之資金額度及預計運用情形，並列示所編製之申報年度及未來一年度各月份之現金收支預測表：

A.公司債務逐年到期金額：無。

B.償還計畫及預計財務負擔減輕情形：

單位：新台幣仟元

貸款機構	利率 (註 1)	契約期間	原貸款 用途	原貸款 金額	擬償還金 額	減少利息支出	
					104 年 第一季	104 年度	以後 年度
遠東銀行	1.2380%	100/6/7~10 5/6/7	營運週轉金	500,000	500,000	4,643	6,190
遠東銀行	1.2380%	100/6/7~10 5/6/7	營運週轉金	100,000	100,000	929	1,238
遠東銀行	1.2380%	100/6/7~10 5/6/7	營運週轉金	100,000	100,000	929	1,238
台北富邦銀行	1.5011%	100/02~ 106/05	營運週轉金	300,000	120,000	1,351	1,801
台北富邦銀行	1.5063%	100/02~ 106/05	營運週轉金	300,000	120,000	1,356	1,808
台北富邦銀行	1.4186%	103/07~ 106/05	營運週轉金	100,000	100,000	1,064	1,419
台北富邦銀行	1.4006%	103/07~ 106/05	營運週轉金	100,000	100,000	1,050	1,401
合計				1,500,000	1,140,000	11,322	15,095

註 1：因利率為每月/每季議價，故此為預估金額。

C：目前營運資金狀況：請詳本公開說明書之現金收支預測表。

D：所需之資金額度及預計運用情形：請詳本公開說明書「肆、二、(一)」。

E：列示所編製之申報年度及未來一年度各月份之現金收支預測表：請詳下頁。

申報年度(104年)之現金收支預測表

104年(單位：新台幣仟元)	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份	合計
期初現金餘額 1	806,445	887,112	1,040,823	871,529	838,896	804,837	764,586	788,192	752,651	741,059	837,136	828,874	806,445
加：非融資性收入2													
應收帳款收現	437,248	560,371	463,082	479,304	447,678	445,902	449,051	463,945	410,868	412,867	416,697	427,597	5,414,610
其他	125,079	12,947	517	130,162	438	457	130,139	435	446	130,190	467	449	531,726
合計(2)	562,327	573,318	463,599	609,466	448,116	446,359	579,190	464,380	411,314	543,057	417,164	428,046	5,946,336
減：非融資性支出3													
應付帳款付現	232,665	219,725	230,000	217,026	236,878	245,246	265,978	274,170	225,977	207,077	210,183	235,178	2,800,103
薪資付現	211,514	86,943	86,000	124,500	83,000	83,000	124,500	83,000	83,000	124,500	83,000	83,000	1,255,957
利息支出	2,900	2,446	1,460	1,403	1,572	1,664	1,889	1,889	2,149	2,149	2,093	2,184	23,798
不動產、廠房及設備	85,362	111,199	160,283	249,020	227,575	237,800	73,632	140,712	342,880	113,104	80,000	274,129	2,095,696
董事報酬及酬勞	150	150	150	150	150	150	2,550	150	150	150	150	150	4,200
所得稅繳稅					83,000								83,000
合計(3)	532,591	420,463	477,893	592,099	632,175	567,860	468,549	499,921	654,156	446,980	375,426	594,641	6,262,754
要求最低現金餘額4	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
所需資金總額5=3+4	1,032,591	920,463	977,893	1,092,099	1,132,175	1,067,860	968,549	999,921	1,154,156	946,980	875,426	1,094,641	6,762,754
融資前可供支用現金餘額6=1+2-5	336,181	539,967	526,529	388,896	154,837	183,336	375,227	252,651	9,809	337,136	378,874	162,279	(9,973)
融資淨額7													
發行新股	0	0	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,000
借款-中期借款	100,000	0	0	0	150,000	100,000	250,000	0	250,000	50,000	0	100,000	1,000,000
償債-中期借款	(50,000)	0	(1,415,000)	(50,000)	0	(18,750)	(50,000)	0	(18,750)	(50,000)	(50,000)	(18,750)	(1,721,250)
支付股利	0	0	0	0	0	0	(287,035)	0	0	0	0	0	(287,035)
其他	931	856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,787
合計(7)	50,931	856	(155,000)	(50,000)	150,000	81,250	(87,035)	0	231,250	0	(50,000)	81,250	253,502
期末現金餘額8=1+2-3+7	887,112	1,040,823	871,529	838,896	804,837	764,586	788,192	752,651	741,059	837,136	828,874	743,529	743,529

未來一年度(105年)之現金收支預測表

105年(單位：新台幣仟元)	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份	合計
期初現金餘額 1	743,529	718,801	786,112	754,902	768,557	784,023	795,205	818,701	854,858	783,709	815,675	839,366	743,529
加：非融資性收入2													
應收帳款收現	417,414	453,151	405,583	391,469	427,068	485,107	488,378	504,847	489,722	492,798	496,776	433,096	5,485,409
其他	130,116	423	521	130,169	510	526	130,083	420	538	130,215	538	602	524,661
合計(2)	547,530	453,574	406,104	521,638	427,578	485,633	618,461	505,267	490,260	623,013	497,314	433,698	6,010,070
減：非融資性支出3													
應付帳款付現	229,578	249,233	223,070	215,308	234,887	266,809	268,608	277,666	269,347	271,039	273,227	238,203	3,016,975
薪資付現	249,000	83,000	83,000	124,500	83,000	83,000	124,500	83,000	83,000	124,500	83,000	83,000	1,286,500
利息支出	2,128	2,128	1,994	1,825	1,825	1,692	1,657	1,544	1,312	1,108	996	764	18,973
不動產、廠房及設備	41,402	51,752	10,350	16,200	20,250	4,050	5,400	6,750	1,350	13,000	16,250	3,250	190,004
董事報酬及酬勞	150	150	150	150	150	150	2,550	150	150	150	150	150	4,200
所得稅繳稅					72,000								72,000
合計(3)	522,258	386,263	318,564	357,983	412,112	355,701	402,715	369,110	355,159	409,797	373,623	325,367	4,588,652
要求最低現金餘額4	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
所需資金總額5=3+4	1,022,258	886,263	818,564	857,983	912,112	855,701	902,715	869,110	855,159	909,797	873,623	825,367	5,088,652
融資前可供支用現金餘額6=1+2-5	268,801	286,112	373,652	418,557	284,023	413,955	510,951	454,858	489,959	496,925	439,366	447,697	1,664,947
融資淨額7													
發行新股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借款-中期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償債-中期借款	(50,000)	0	(118,750)	(150,000)	0	(118,750)	(31,250)	(100,000)	(206,250)	(181,250)	(100,000)	(206,250)	(1,262,500)
支付股利	0	0	0	0	0	0	(161,000)	0	0	0	0	0	(161,000)
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計(7)	(50,000)	0	(118,750)	(150,000)	0	(118,750)	(192,250)	(100,000)	(206,250)	(181,250)	(100,000)	(206,250)	(1,423,500)
期末現金餘額8=1+2-3+7	718,801	786,112	754,902	768,557	784,023	795,205	818,701	854,858	783,709	815,675	839,366	741,447	741,447

- (2)就公司申報年度及預計未來一年度應收帳款收款與應付帳款付款政策、資本支出計畫、財務槓桿及負債比率（或自有資產與風險性資產比率），說明償債或充實營運資金之原因：

A.應收帳款收款政策及應付帳款付款政策

本公司對客戶之授信期間原則上為月結30天至60天。本公司每月應收款項收現數之編製基礎係以103年度實際收款情形作為參考依據，再考量本公司之銷售、收款狀況，按保守穩健原則估計，作為預測104~105年各月份現金收支預測表之估算基礎，其編製基礎假設尚屬合理。

本公司每月應付款項付現之基礎係以103年度應付帳款平均付款期間及預估未來之付款條件、薪資、勞務等費用作為參考依據，再推算104~105年未來每各月份應付款項之付現情形，其編製之基礎假設尚屬合理。

B.資本支出計畫

本公司之資本支出計畫係依未來公司之經營策略及營運發展而定，主要係支付購置生產設備等相關支出。因此本次現金增資發行新股所取得之資金以償還銀行借款，並不影響本年度資本支出計畫，且可增加資金運用之彈性。綜上所述，本公司係依未來投資計畫編製104及105年現金收支預測表之資本支出，編製基礎尚屬合理。

- (3)增資計畫如用於償債，應說明原借款用途及其效益達成情形：

本公司本次籌資預計用於償還之銀行借款共計 1,140,000仟元，原借款用途主要為營運週轉之用，主係因最近三年度營運穩定成長，故用以支應貨款、營業費用等營運週轉需求支出。本公司受惠於智慧行動裝置需求增加，帶動整體半導體產業成長，本公司業績跟著上揚，除光學元件封裝服務訂單仍維持一定水準外，因應行動裝置對於個人隱私的保護需求，指紋辨識感測器之市場需求大幅增加，本公司於102年下半年並成功導入該項封裝產品之驗證且進入量產，對於102年度及103年度之營收與獲利均有顯著之貢獻，可見本公司舉借之銀行營運週轉金確實替該公司帶來正面效益。

- (4)現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，應敘明其必要性、預計資金來源及效益。

104年資本支出預計為新台幣2,115,990仟元，包括12吋晶圓級尺寸封裝生產線、8吋晶圓級尺寸封裝及後護層封裝生產線之製程改善、研究發展設備及自動化、提升良率或生產力之年度經常性資本支出。本公司於3月底以現金增資款項12.6億元償還銀行借款及充實營運資金後，4~12月尚有資本支出1,738,852仟元，將透過自有資金或銀行借款支應。105年度預計190,004仟元之資本支出，主要用來製程改善、提升良率或生產力之年度經常性支出，亦將透過自有資金或銀行借款支應。

4.如為購買營建用地、支付營建工程款或承攬工程者，應詳列預計自購買土地至營建個案銷售完竣或承攬工程所需之資金總額、不足資金之來源及各階段資金投入及工程進度，並就認列損益之時點、金額說明預計可能產生效益：不適用。

5.如為購買未完工程並承受賣方未履行契約者，應列明買方轉讓理由、受讓價格決定依據及受讓過程對契約相對人權利義務之影響：不適用。

三、本次受讓他公司股份發行新股應記載事項：無。

四、本次併購發行新股應記載事項：無。

伍、財務概況

一、最近五年度簡明財務資料

(一)最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

1.簡明資產負債表-國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

年 度 項 目			最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)							
			99 年度		100 年度		101 年度	102 年度	103 年度	
流 動 資 產			不		1,413,118		2,211,767		2,035,251	
不動產、廠房及設備					4,453,092		6,026,007		6,591,778	
無 形 資 產					82,535		71,694		87,437	
其 他 資 產					82,211		52,689		112,803	
資 產 總 額					6,030,956		8,362,157		8,827,269	
流動負債		分配前	適		807,479		2,309,199		1,760,450	
		分配後			831,101		2,439,220		(註 2)	
非 流 動 負 債					1,387,844		1,937,542		2,412,576	
負債總額		分配前			2,195,323		4,246,741		4,173,026	
		分配後			2,218,945		4,376,762		(註 2)	
歸屬於母公司業主之權益			用		3,835,633		4,115,416		4,654,243	
股 本					2,362,079		2,364,018		2,381,207	
資 本 公 積					513,458		524,855		547,724	
保 留 盈 餘		分配前			960,096		1,226,824		1,726,135	
		分配後			936,474		1,096,803		(註 2)	
其 他 權 益					-		(281)		(823)	
庫 藏 股 票					-		-		-	
非 控 制 權 益					-		-		-	
權 益 總 額		分配前			3,835,633		4,115,416		4,654,243	
		分配後			3,812,011		3,985,395		(註 2)	

註 1：以上各年度財務資料均經會計師查核簽證。

註 2：俟股東會決議後定案。

2. 簡明綜合損益表-國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	最 近 五 年 度 財 務 資 料 (註 1)				
	99 年度	100 年度	101 年度	102 年度	103 年度
營 業 收 入	不 適 用		3,139,385	4,256,761	4,934,078
營 業 毛 利			249,852	695,142	948,204
營 業 (損) 益			(96,240)	380,636	675,630
營 業 外 收 入 及 支 出			(11,529)	(31,873)	(15,704)
稅 前 淨 利 (損)			(107,769)	348,763	659,926
繼 續 營 業 單 位 本 期 淨 利 (損)			(90,205)	288,881	628,653
停 業 單 位 損 失			-	-	-
本 期 淨 利 (損)			(90,205)	288,881	628,653
本期其他綜合損益 (稅 後 淨 額)			571	1,188	137
本 期 綜 合 損 益 總 額			(89,634)	290,069	628,790
淨 利 (損) 歸 屬 於 母 公 司 業 主			(90,205)	288,881	628,653
淨 利 (損) 歸 屬 於 非 控 制 權 益			-	-	-
綜合損益總額歸屬於母 公 司 業 主			(89,634)	290,069	628,653
綜合損益總額歸屬於非 控 制 權 益			-	-	-
每 股 盈 餘 (淨 損)			(0.38)	1.22	2.65

註 1：以上各年度財務資料均經會計師查核簽證。

3.簡明資產負債表-我國財務會計準則

單位：新台幣仟元

項目		最近五年度財務資料(註)				
		99 年度	100 年度	101 年度	102 年度	103 年度
流動資產		1,534,297	1,362,652	1,396,755	不適 用	
基金及投資		-	-	-		
固定資產		3,745,083	4,980,991	4,453,092		
無形資產		-	-	-		
其他資產		169,532	148,801	166,917		
資產總額		5,448,912	6,492,444	6,016,764		
流動負債	分配前	1,114,060	920,559	776,126		
	分配後	1,342,886	943,922	799,748		
長期負債		329,101	1,612,036	1,383,911		
其他負債		-	-	-		
負債總額	分配前	1,443,161	2,532,595	2,160,037		
	分配後	1,671,987	2,555,958	2,183,659		
股本		2,283,849	2,335,811	2,362,079		
資本公積		486,336	505,177	513,458		
保留盈餘	分配前	1,236,380	1,119,093	981,190		
	分配後	984,671	1,072,367	957,568		
金融商品未實現損益		(814)	(232)	-		
累積換算調整數		-	-	-		
未認列為退休金成本之淨損失		-	-	-		
股東權益總額	分配前	4,005,751	3,959,849	3,856,727		
	分配後	3,810,969	3,936,486	3,833,105		

註：以上各年度財務資料均經會計師查核簽證，但 102 年起適用國際財務報導準則，請參閱採用國際財務報導準則之報表。

4.簡明損益表-我國財務會計準則

單位：新台幣仟元

項目	最近五年度財務資料(註)				
	99 年度	100 年度	101 年度	102 年度	103 年度
營業收入	3,962,254	3,866,586	3,139,385	不適 用	
營業毛利	921,446	587,154	249,240		
營業(損)益	573,390	248,699	(82,100)		
營業外收入及利益	14,877	49,556	36,050		
營業外費用及損失	26,867	141,186	62,691		
繼續營業部門稅前(損)益	561,400	157,069	(108,741)		
繼續營業部門(損)益	505,260	134,422	(91,177)		
停業部門損益	-	-	-		
非常損益	-	-	-		
會計原則變動之累積影響數	-	-	-		
本期(損)益	505,260	134,422	(91,177)		
每股盈餘(淨損)	2.18	0.57	(0.39)		

註：以上各年度財務資料均經會計師查核簽證，但 102 年起適用國際財務報導準則，請參閱採用國際財務報導準則之報表。

(二)影響上述簡明財務報表一致性比較之重要事項如會計變動、公司合併或營業部門停工等及其發生對當年度財務報表之影響：

- 1.本公司自一〇〇年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」。主要之修訂包括(一)將應收租賃款之減損納入公報適用範圍；(二)修訂保險相關合約之會計準則適用規範；(三)將原始產生之放款及應收款納入公報適用範圍；(四)增訂以攤銷後成本衡量之金融資產於債務困難修改條款時之減損規範；及(五)債務條款修改時債務人之會計處理。此項會計變動，對本公司一〇〇年度財務報表並無重大影響。
- 2.本公司自一〇〇年一月一日起，採用新發布之財務會計準則公報第四十一號「營運部門資訊之揭露」。該公報之規定係以管理階層制定營運事項決策時所使用之企業組成部分相關資訊為基礎，營運部門之辨識則以主要營運決策者定期複核用以分配資源予部門與評量績效之內部報告為基礎。該公報係取代財務會計準則公報第二十號「部門別財務資訊之揭露」。本公司依據該公報所辨識之營運部門，與原第二十號公報之部門辨認結果並無差異，故對本公司營運部門資訊之報導並無重大改變。

(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見

1.最近五年度簽證會計師及查核意見：

年度	會計師事務所	會計師姓名	查核意見
99 年	勤業眾信聯合會計師事務所	黃鴻文、林鴻鵬	無保留意見
100 年	勤業眾信聯合會計師事務所	黃鴻文、林鴻鵬	無保留意見
101 年	勤業眾信聯合會計師事務所	林鴻鵬、黃裕峰	無保留意見
102 年	勤業眾信聯合會計師事務所	林鴻鵬、黃裕峰	無保留意見
103 年	勤業眾信聯合會計師事務所	林鴻鵬、黃裕峰	無保留意見

2.最近五年度更換會計師情事者，應列示公司、前任及繼任會計師對更換原因說明：

配合勤業眾信聯合會計師事務所內部業務調整。

(四)財務分析

1.財務分析-國際財務報導準則

年 度 分析項目		最 近 五 年 度 財 務 分 析				
		99 年	100 年	101 年	102 年	103 年
財務結構	負債占資產比率(%)	不 適 用	36.40	50.79	47.27	
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)		117.30	100.45	107.21	
償債能力	流動比率(%)		175.00	95.78	115.61	
	速動比率(%)		147.64	83.34	99.33	
	利息保障倍數(倍)		(4.75)	13.39	20.43	
經營能力	應收款項週轉率(次)		7.05	7.28	5.84	
	平均收現日數		51.77	50.13	62.50	
	存貨週轉率(次)		19.17	19.45	18.52	
	應付款項週轉率(次)		18.53	17.83	15.02	
	平均銷貨日數		19.04	18.76	19.70	
	不動產、廠房及設備週轉率(次)		0.70	0.81	0.78	
	總資產週轉率(次)		0.52	0.59	0.57	
	獲利能力		資產報酬率(%)	(1.26)	4.34	7.64
權益報酬率(%)			(2.32)	7.27	14.34	
稅前純益占實收資本額比率(%)			(4.56)	14.75	27.71	
純益率(%)			(2.87)	6.79	12.74	
基本每股盈餘(淨損)(元)			(0.38)	1.22	2.65	
現金流量	現金流量比率(%)		80.22	88.09	67.99	
	現金流量允當比率(%)		96.53	85.96	79.63	
	現金再投資比率(%)		6.65	18.09	8.05	
槓桿度	營運槓桿度		(13.34)	4.82	3.42	
	財務槓桿度		0.88	1.08	1.05	
請說明最近二年度各項財務比率變動原因。(若增減變動未達 20% 者可免分析)						
1.流動比率增加，主要係 103 年度產能保證金減少所致。						
2.利息保障倍數增加，主要係稅前純益增加所致。						
3.平均收現日數增加主要係 103 年底銷貨收入大增導致期末應收帳款增加。						
4.資產報酬率及權益報酬率增加，主要係 103 年度純益增加所致。						
5.稅前純益占實收資本額比率、純益率及基本每股盈餘增加，主要係 103 年度純益增加所致。						
6.現金流量比率減少，主要係 103 年度產能保證金減少所致。						
7.現金再投資比率減少，主要係因退還與客戶協議補償未來訂單風險之產能保證金致營業活動淨現金流量減少所致。						
8.營運槓桿度減少，主要係因 103 年營收及營業利益較 102 年增加，承受固定成本能力增加，營運風險減少，故營運槓桿度下降。						

計算公式如下：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝（權益總額＋非流動負債）／不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／平均資產總額。

(2)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（歸屬於母公司業主之損益－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其他非流動資產＋營運資金)。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／(營業利益－利息費用)。

2.財務分析-我國財務會計準則

年 度 分析項目			最 近 五 年 度 財 務 分 析					
			99 年	100 年	101 年	102 年 (註)	103 年 (註)	
財務結構	負債占資產比率(%)		26.49	39.01	35.90	不適用		
	長期資金占固定資產比率(%)		115.75	111.86	117.69			
償債能力	流動比率(%)		137.72	148.02	179.96			
	速動比率(%)		120.55	126.29	151.49			
	利息保障倍數(倍)		54.02	8.90	(4.80)			
經營能力	應收款項週轉率(次)		9.10	9.82	7.63			
	應收款項平均收現日數		40.10	37.16	47.83			
	存貨週轉率(次)		20.54	22.03	19.18			
	應付款項週轉率(次)		16.45	21.15	18.54			
	平均銷貨日數		17.77	16.56	19.03			
	固定資產週轉率(次)		1.06	0.78	0.70			
	總資產週轉率(次)		0.73	0.60	0.52			
獲利能力	資產報酬率(%)		9.88	2.39	(1.28)			
	股東權益報酬率(%)		13.47	3.38	(2.33)			
	占實收資本比率(%)	營業利益(損失)	25.11	10.65	(3.48)			
		稅前利益(損失)	24.58	6.72	(4.60)			
	純益率(%)		12.75	3.48	(2.90)			
	基本每股盈餘(淨損)(元)		2.18	0.57	(0.39)			
現金流量	現金流量比率(%)		133.37	94.60	82.36			
	現金流量允當比率(%)		86.03	79.75	96.34			
	現金再投資比率(%)		20.59	7.21	6.67			
槓桿度	營運槓桿度		3.49	6.77	(15.65)			
	財務槓桿度		1.02	1.04	0.86			
請說明最近二年度各項財務比率變動原因（若增減變動未達 20% 者可免分析）：不適用。								

請說明最近二年度各項財務比率變動原因（若增減變動未達 20% 者可免分析）：不適用。

註：102年起適用國際財務報導準則，請參閱採用國際財務報導準則之報表。

計算公式如下：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。

(2)長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債）／ 固定資產淨額。

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債。

(2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。

(3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。

3.經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。

(6)固定資產週轉率＝銷貨淨額／固定資產淨額。

(7)總資產週轉率＝銷貨淨額／資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（1－稅率）〕／ 平均資產總額。

(2)股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額。

(3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。

(4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）／加權平均已發行股數。

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。

(2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(固定資產毛額＋長期投資＋其他資產＋營運資金)。

6.槓桿度：

(1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用)／ 營業利益。

(2)財務槓桿度＝營業利益／ (營業利益－利息費用)。

(五)會計項目重大變動說明

比較最近兩年度資產負債表及綜合損益表之會計科目，若金額變動達百分之十以上，且金額達當年度資產總額百分之一者，分析變動原因如下：

單位：新台幣仟元

年 度 項 目	103 年度	102 年度	差異		說明
			金 額	%	
現金及約當現金	806,445	1,031,142	(224,697)	(21.79)	主要係退還產能保證金，致現金及約當現金減少。
應收關係人款項	673,319	516,431	156,888	30.38	主要係營收大幅成長，致應收關係人款項增加。
其他應收關係人款項	0	141,190	(141,190)	(100.00)	係與客戶協議補償未來訂單風險之應收產能保證金已於 103 年收訖。
應付工程及設備款	460,129	305,961	154,168	50.39	主要係因應客戶產能需求而增加資本支出，致應付工程及設備款增加。
存入保證金	0	1,016,977	(1,016,977)	(100.00)	係退還客戶協議補償未來訂單風險之產能保證金。
長期銀行借款	2,387,500	1,912,500	475,000	24.84	主要係因擴充產能增加資本支出，致長期銀行借款增加。
未分配盈餘	1,529,166	1,059,024	470,142	44.39	主要係 103 年度淨利增加。
營業收入淨額	4,934,078	4,256,761	677,317	15.91	主係因自 103 年起受惠於全球半導體市場在智慧行動裝置的帶動下開始恢復成長態勢，且隨行動裝置產品影像畫質需求殷切，以及對個人隱私的保護需求，公司在持續開發其晶圓級封裝技術並在指紋辨識感測器量產成功量產下，致 103 年度營業收入大幅成長，連帶使得營業成本、營業毛利及本年度淨利也跟著增加。
營業成本	3,985,874	3,561,619	424,255	11.91	主要係出租資產淨收益增加 236,952 仟元及減損損失增加 82,263 仟元。
營業毛利	948,204	695,142	253,062	36.40	
營業淨利	675,630	380,636	294,994	77.50	主要係出租資產淨收益增加 236,952 仟元及減損損失增加 82,263 仟元。
稅前淨利	659,926	348,763	311,163	89.22	
本年度淨利	628,653	288,881	339,772	117.62	主要係出租資產淨收益增加 236,952 仟元及減損損失增加 82,263 仟元。
其他營業收益及費損淨額	190,921	51,008	139,913	274.30	

(六)本國發行人自公開發行後最近連續五年或外國發行人最近連續五年由相同會計師查核簽證者，應增列說明未更換之原因、目前簽證會計師之獨立性暨發行公司對強化會計師簽證獨立性之具體因應措施：不適用。

(七)外國發行人申請股票登錄興櫃者，得僅列示最近二年度之財務資料；外國發行人申請股票第一上櫃者，得僅列示最近三年度之財務資料：不適用。

二、財務報表應記載事項

(一)發行人申報募集發行有價證券時之最近二年度財務報告及會計師查核報告，並應加列最近一季依法公告申報之財務報告：

1.一〇二年度財務報告及會計師查核報告：請參閱第203~267頁。

2.一〇三年度財務報告及會計師查核報告：請參閱第268~325頁。

(二)最近二年度發行人經會計師查核簽證之年度個體財務報告：

因本公司無子公司，無需編製合併財務報告，故個體財務報告與上述(一)之財務報告相同。

(三)發行人申報募集發行有價證券後，截至公開說明書刊印日前，如有最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告及個體財務報告，應併予揭露：無。

三、財務概況其他重要事項

(一)公司及其關係企業最近二年度及截至公開說明書刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，應列明其對公司財務狀況之影響：無。

(二)最近二年度及截至公開說明書刊印日止，有發生公司法第一百八十五條情事者：無。

(三)期後事項：無。

(四)其他：無。

四、財務狀況及經營結果檢討分析

(一)財務狀況

國際財務報導準則

單位：新台幣仟元

項目	103 年度	102 年度	差異	
			金額	變動比率
流動資產	2,035,251	2,211,767	(176,516)	(7.98)
不動產、廠房及設備	6,591,778	6,026,007	565,771	9.39
無形資產	87,437	71,694	15,743	21.96
其他資產	112,803	52,689	60,114	114.09
資產總額	8,827,269	8,362,157	465,112	5.56
流動負債	1,760,450	2,309,199	(548,749)	(23.76)
非流動負債	2,412,576	1,937,542	475,034	24.52
負債總額	4,173,026	4,246,741	(73,715)	(1.74)
股本	2,381,207	2,364,018	17,189	0.73
資本公積	547,724	524,855	22,869	4.36
保留盈餘	1,726,135	1,226,824	499,311	40.70
其他權益	(823)	(281)	(542)	192.88
股東權益總額	4,654,243	4,115,416	538,827	13.09
重大變動項目說明(變動達 20%以上，且變動金額達新台幣一仟萬元者)： 1.無形資產增加主要係電腦軟體及專利權增加。 2.其他資產增加主要係遞延所得稅資產增加。 3.流動負債減少主要係產能保證金減少。 4.非流動負債增加主要係銀行借款增加。 5.保留盈餘增加主要係 103 年度淨利增加。				

(二)財務績效

1.最近二年度經營結果分析

國際財務報導準則：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	103 年度	102 年度	增減金額	變動比例 (%)
營業收入淨額	4,934,078	4,256,761	677,317	15.91
營業成本	3,985,874	3,561,619	424,255	11.91
營業毛利	948,204	695,142	253,062	36.40
營業費用	463,495	365,514	97,981	26.81
其他營業收益及費損淨額	190,921	51,008	139,913	274.30
營業淨利	675,630	380,636	294,994	77.50
營業外收入及支出	(15,704)	(31,873)	16,169	(50.73)
稅前淨利	659,926	348,763	311,163	89.22
所得稅費用	(31,273)	(59,882)	28,609	(47.78)
稅後淨利	628,653	288,881	339,772	117.62
說明：(變動達 20%以上，且變動金額達新台幣一仟萬元者)：				
1.營業毛利增加主要係因銷售數量增加所致。				
2.營業費用增加主要係用人費用、員工分紅及研究發展費增加。				
3.其他營業收益及費損淨額增加主要係出租資產淨收益增加 236,952 仟元及減損損失增加 82,263 仟元。				
4.營業淨利增加主要係因銷售數量增加及出租資產淨收益增加。				
3.營業外收入及支出增加主要係保險理賠收入增加及兌換損失減少。				

2.預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務可能影響及因應計劃

- (1)本公司預期未來一年度業務量將與103年相當，主要係依據總體經濟環境變化、產業動向及公司未來之發展方向，並參酌公司近期營運概況所擬定之營運目標。
- (2)對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：無。

(三)現金流量

1.最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析：

(1)最近一年度流動性分析：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	103 年度	102 年度	增 (減) 金 額	變 動 比 例 (%)
營業活動	1,196,897	2,034,265	(837,368)	(41)
投資活動	(1,844,684)	(2,346,442)	501,758	(21)
籌資活動	423,090	572,569	(149,479)	(26)
合 計	(224,697)	260,392	(485,089)	(186)
1. 本期營業活動之淨現金流入較上期減少，主要係產能保證金減少。				
2. 本期投資活動之淨現金流出較上期減少，主要係購置不動產、廠房及設備減少。				
3. 本期籌資活動之淨現金流入較上期減少，主要係償還銀行借款及發放現金股利增加。				

(2)流動性不足之改善計畫：

本公司資金需求將以自有資金、銀行借款籌募資金，截至公開說明書刊印日止，尚無流動性不足之疑慮。

(3)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金 餘額(1)	預計全年來自 營業活動淨現 金流量(2)	預計全年現金 流出量(3)	預計現金 剩 餘 (不 足) 之 數 額 (1)+(2)-(3)	現金不足額之補救措 施	
				投資計劃	理財計劃
806,445	1,664,178	(1,727,094)	743,529	—	現金增資及 銀行借款
1.未來一年度現金流量變動情形分析：					
(1)營業活動淨現金流入主要來自於營業收現。					
(2)現金流出量主要擴充產能所需，擬購入機器設備，以及償還銀行借款。					
2.預計現金不足額之補救措施及流動性分析：以銀行借款及現金增資發行新股因應。					

(四)最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

103 年度資本支出主要係因應業務擴展而購置所需生產設備，本公司係以銀行借款或自有資金支應，故對本公司之財務業務應無重大不利之影響。

(五)最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

無。

(六)其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、內部控制制度執行狀況：

(一)最近三年度會計師提出之內部控制改進建議：最近三年度會計師無出具內部控制改進建議。

(二)最近三年度內部稽核發現重大缺失之改善情形：本公司內部稽核人員執行查核過程中，未有發現重大缺失之情形。

(三)內部控制聲明書：請參閱第 137~138 頁。

(四)委託會計師專案審查內部控制者，應列明其原因、會計師審查意見、公司改善措施及缺失事項改善情形：請參閱第 139 頁。

二、委託經金管會核准或認可之信用評等機構進行評等者，應揭露該信用評等機構所出具之評等報告：不適用。

三、證券承銷商評估總結意見：請參閱第140頁。

四、律師法律意見書：請參閱第141~142頁。

五、由發行人填寫並經會計師複核之案件檢查表彙總意見：不適用。

六、前次募集與發行有價證券於申報生效(申請核准)時經金融監督管理委員會證券期貨局通知應自行改進事項之改進情形：無。

七、本次募集與發行有價證券於申報生效時經金管會通知應補充揭露之事項：無。

八、公司初次上市、上櫃或前次及最近三年度申報(請)募集與發行有價證券時，於公開說明書中揭露之聲明書或承諾事項及其目前執行情形：請參閱第143頁。

九、最近年度及截至公開說明書刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

十、最近年度及截至公開說明書刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

十一、本國發行人自行評估內部控制制度作成之內部控制聲明書及委託會計師進行專案審查取具之報告書：請參閱上述「一、(三)及(四)」。

十二、發行人及其聯屬公司各出具之財務業務往來無非常規交易情事之書面承諾，及其重要業務之政策：請參閱第144~150頁。

十三、發行人是否有與其他公司共同使用申請貸款額度：：無。

十四、發行人有無因非正當理由仍有大量資金貸與他人：無。

十五、發行人申請公司債上櫃者，其公司債本金及利息償還之資金來源，暨發行標的或保證金融機構之信用評等等級，評等理由及評等展望等信用評等結果：不適用。

十六、發行人有證券櫃檯買賣中心審查準則第十條第一項第四款或外國審查準則第九條第一項第三款情事者，應將該重大未改善之非常規交易詳細內容及處理情形充分揭露，並提報股東會：無。

十七、充分揭露發行人與證券承銷商共同訂定承銷價格之依據及方式：請參閱附件之承銷價格計算書。

十八、發行人分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至且採內含價值法之員

工認股權憑證，於股票上櫃後所產生之費用對財務報表可能之影響：不適用。

十九、其他基於相關規定出具之書面承諾或聲明：申請公司、申請公司之董事與申請公司申請上櫃案有關之經理人及受僱人、輔導上櫃之仲介機構及專業人士於申請上櫃時出具誠信聲明書，請參閱第151頁~第170頁。

二十、證券承銷商、發行人及其董事、監察人、總經理、財務或會計主管以及與本次申報募集發行有價證券案件有關之經理人等人出具不得退還或收取承銷相關費用之聲明書：請參閱第171頁~第187頁。

二十一、發行人辦理現金增資或募集具股權性質之公司債，並採詢價圈購對外公開承銷之案件，證券承銷商及發行人等出具不得配售予關係人及內部人等對象之聲明書：請參閱第188頁~第193頁。

二十二、其他必要補充說明事項：無。

二十三、上市上櫃公司應就公司治理運作情形應記載下列事項

(一)董事會運作情形：

本公司董事會於最近年度(103)及截至公開說明書刊印日止共召開 9 次(A)董事會，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列) 席次數(B)	委託出 席次數	實際出(列)席率 (%) (B/A)	備 註
董事長	關欣 台灣積體電路製造股份有限公司 代表人	9	0	100%	
董 事	林錦坤 台灣積體電路製造股份有限公司 代表人	7	2	78%	代表人已於 103 年 1 月 10 日 由魏哲家先生改派為林錦坤 先生
董 事	何麗梅 台灣積體電路製造股份有限公司 代表人	7	1	78%	
董 事	Xiaoying Hong 台灣豪威投資控股股份有限公司 代表人	0	2	0%	代表人已於 103 年 5 月 8 日 由 Xiaoying Hong 先生改派為 Hongli Yang 先生
董 事	Hongli Yang 台灣豪威投資控股股份有限公司 代表人	2	4	33%	代表人已於 103 年 5 月 8 日 由 Xiaoying Hong 先生改派為 Hongli Yang 先生
獨立董事	王文宇	9	0	100%	
獨立董事	徐中時	3	6	33%	
獨立董事	謝徽榮	9	0	100%	

其他應記載事項：

- 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事或監察人反對或保留意見且有記錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。
- 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因及參與表決情形：
 - 103 年 3 月 6 日召開第七屆第五次董事會決議核准與台積公司簽訂 Amendment to Equipment Lease Agreement，並授權獨立董事王文宇先生代表本公司簽署，為避免利益衝突，台積公司法人代表關欣先生、林錦坤先生及何麗梅女士迴避未參與表決，本案經當日出席之其他董事無異議通過。
 - 103 年 3 月 6 日召開第七屆第五次董事會決議核准本公司 102 年度董事及監察人之酬勞分派及其 102 年、103 年之薪資報酬及酬勞，各董事於有自身利害關係之事項皆已迴避。
 - 103 年 3 月 6 日召開第七屆第五次董事會決議核准本公司具董事身份之經理人 102 年第三季、第四季激勵獎金及年終獎金，102 年度之績效評核及 102 年度、103 年度薪資報酬，董事長暨執行長關欣先生因自身利益迴避未參與表決，本案經當日出席之其他董事無異議通過。
 - 103 年 6 月 12 日召開第七屆第七次董事會決議核准本公司一〇二年度具董事身份經理人及經理人之員工現金紅利，本案除董事長暨執行長關欣先生因自身利益迴避外，其他出席董事無異議通過。

- (5) 103 年 8 月 7 日召開第七屆第八次董事會決議核准追認本公司向台積公司購買供營業使用之機器設備合計美金 781,000 元整，為避免利益衝突，台積公司法人代表關欣先生、林錦坤先生及何麗梅女士迴避未參與表決，本案經當日出席之其他董事無異議通過。
- (6) 103 年 8 月 7 日召開第七屆第八次董事會決議核准本公司具董事身份之經理人及經理人之民國一〇三年第二季激勵獎金，董事長暨執行長關欣先生因自身利益迴避未參與表決，本案經當日出席之其他董事無異議通過。
- (7) 103 年 9 月 24 日召開第七屆第九次董事會決議核准修訂本公司具董事身份經理人之薪資報酬及股票增值權計畫，董事長暨總經理關欣先生因自身利益迴避未參與表決，本案經當日出席之其他董事無異議通過。
- (8) 103 年 11 月 12 日召開第七屆第十次董事會決議核准與台積公司簽訂 Amendment 2 to Equipment Lease Agreement，並授權獨立董事王文宇先生代表本公司簽署，為避免利益衝突，台積公司法人代表關欣先生、林錦坤先生及何麗梅女士迴避未參與表決，本案經當日出席之其他董事無異議通過。
- (9) 104 年 3 月 11 日召開第七屆第十二次董事會決議核准本公司 103 年度及 104 年度各董事之薪資報酬及酬勞，各董事於有自身利害關係之事項皆已迴避並無異議通過。
- (10) 104 年 3 月 11 日召開第七屆第十二次董事會決議核准本公司 103 年度具董事身份經理人及經理人之員工現金紅利，本案除董事長暨總經理關欣先生因自身利益迴避外，其他出席董事無異議通過。
- (11) 104 年 3 月 11 日召開第七屆第十二次董事會決議核准具董事身分之經理人及經理人 103 年度之績效評核及 103 年度薪資報酬、104 年度薪資調整及報酬，本案除董事長暨總經理關欣先生因自身利益迴避外，其他出席董事無異議通過。
- (12) 104 年 3 月 11 日召開第七屆第十二次董事會決議核准本公司具董事身份經理人及經理人得以特定人身份認購一〇四年第一次現金增資員工認股案，本案除董事長暨總經理關欣先生因自身利益迴避外，其他出席董事無異議通過。
3. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形業評估：
- (1) 本公司已於 100 年 11 月 11 日成立薪酬委員會，以協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策及經理人之報酬。
- (2) 本公司 102 年度業經股東會通過設置審計委員會，並由三位獨立董事組成，強化董事會公司治理職能。

(二) 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形

1. 本公司於 102 年 6 月 13 日股東會通過設置審計委員會，取代原監察人職能。
2. 審計委員會運作情形：

本公司於民國 102 年 6 月 13 日設置審計委員會，於最近年度(103)及截至公開說明書刊印日止召開 8 次(A)審計委員會，出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備 註
獨立董事	王文宇	8	0	100%	
獨立董事	徐中時	4	4	50%	
獨立董事	謝徽榮	8	0	100%	

其他應記載事項：

- 一、證交法第 14 條之 5 所列事項暨其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：無。
- 二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
- 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：
 1. 本公司內部稽核主管定期與審計委員會溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
 2. 本公司獨立董事得隨時要求會計師針對財務報表查核情形及其相關法令要求事項，向獨立董事進行報告與溝通。

3. 監察人參與董事會運作情形：

本公司於 102 年 6 月 13 日改選，由新任三名獨立董事組成審計委員會，並取消監察人制度。

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

評 估 項 目	運 作 情 形			與上市上櫃公司治 理實務守則差異情 形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？		V	本公司目前雖尚未訂定公司治理實務守則，但本公司實質上已依據公司治理精神改善中，未來將考量實際運作情形，並評估內外部環境作為修訂公司治理實務守則之依據。	未來將適時予以訂定。
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ (二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ (三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？ (四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	V V V V		(一) 本公司設有發言人制度，統一由發言人或代理發言人處理股東建議、疑義及糾紛等問題。 (二) 本公司每月向董事及持股10%以上大股東取得持股變動申報書，以確實掌握實際控制公司之主要股東名單，並與主要股東保持密切聯繫，以掌握其最終控制者之名單。 (三) 制定及落實內部控制制度及相關管理辦法，稽核單位並定期監督執行情形。 (四) 公司定有內部重大資訊處理作業程序，以規範內部重大資訊保密作業程序，並定期宣導不得利用市場上未公開資訊買賣本公司之有價證券。	符合上市上櫃公司 治理實務守則規定。
三、董事會之組成及職責 (一) 董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行？	V		(一) 本公司在設定董事會成員組合時會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括(但不限於)性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件顧及董事會成員多元化的益處。	符合上市上櫃公司 治理實務守則規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會，是否自願設置其他各類功能性委員會？ (三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估？ (四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	V	V	(二) 公司雖未設置其他功能性委員會，惟透過獨立董事及審計委員會的運作，可有效監督公司業務之執行。 (三) 本公司已訂定董事績效評估辦法，並定期進行績效評估。 (四) 定期評估簽證會計師之獨立性，目前本公司之簽證會計師與公司及董事均非關係人，其獨立性並無疑慮。	
四、公司是否建立與利害關係人溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		本公司設有發言人及代理發言人擔任公司對外溝通管道，並於公司網站設置違反從業道德行為舉報系統，提供客戶、廠商或其他利害關係人檢舉本公司人員不當行為之管道。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
五、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司已委任台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理股東會事務	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
六、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形？ (二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）	V	V	(一) 本公司已架設公司網站，並責成相關部門維護及揭露公司財務業務等相關資訊。 (二) 本公司已指定專人負責定期及不定期於公開資訊觀測站申報各項財務業務資訊並依相關規定發佈重大訊息，並設有發言人及代理發言人制度。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。
七、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量	V		(一) 在環境保護方面，遵守環保、安全與綠色產品等永續發展相關之法令規章或要求，並持續關注國際環保發展趨勢，強化綠色環保責任，並致力規劃與執行各項節能減碳專案，以減少各項用電及溫室效應氣體排放量，降低地球溫室氣體效應，善盡地球公民職責。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）？			(二)在勞動權益方面，持續改善就業環境與安全衛生管理制度，以提供平等就業機會及預防傷害事故與職業疾病的發生。 (三)在員工權益方面，成立職工福利委員會、實施退休金制度、辦理員工團體保險及定期舉辦健康檢查，並提供各項員工訓練課程等持續進修管道。 (四)在供應商管理方面，本公司設有供應商考核制度確保供應商能符合本公司的品質及環境政策，訂有供應商評鑑制度以確保稽核之執行，並與供應商維持順暢的溝通管道，保持良好的上下游關係，促進產業鏈永續發展。 (五)在資訊保密方面，尊重與保護客戶之技術文件與資料。對外，本公司與客戶及供應商簽有保密協議，明訂具法律效力的權利及義務；對內，本公司設有機密資訊保護委員會，要求員工遵守相關保密規定，並落實保安全管理，以保障公司及客戶之機密資訊安全。 (六)本公司依法令規定公開公司資訊，以保障投資人及利害關係人之權利。 (七)本公司並未強制要求董事進修專業知識課程，係以積極態度鼓勵董事依個人需求參與。 (八)本公司為落實公司治理已為本公司董事購買責任保險。	
八、公司是否有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告？（若有，請敘明其董事會意見、自評或委外評鑑結果、主要缺失或建議事項及改善情形）	V		本公司已完成公司治理自評報告，並無重大缺失。	符合上市上櫃公司治理實務守則規定。

(四) 公司如有設置薪資報酬委員會者，應揭露其組成、職責及運作情形：

1.組成：本公司於 100 年 11 月 11 日成立薪酬委員會，並於 102 年 6 月 13 日改選後由王文字先生(召集人)、徐中時先生及謝徽榮先生三位獨立董事組成薪酬委員會。

身份別	姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形 (註 1)								兼任其 他公開 發行公 司薪資 報酬委 員會成 員家數	備註 (註 2)
		商務、法 務、會計 或公司業 務所需相 關料系之 公私立大 專院校講 師以上	法官、檢 察官、律 師、會計 師或其他 與公司業 務所需之 國家考試 及格領有 證書之專 門職業及 技術人員	具有商 務、法 務、財 務、會計 或公司 業務所 需之工 作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8		
獨立董事	王文字	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3	是
獨立董事	徐中時			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0	是
獨立董事	謝徽榮			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	是

註 1：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1)非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
- (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
- (8)未有公司法第 30 條各款情事之一。

註 2：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權辦法」第 6 條第 5 項之規定。

2.薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1)本公司之薪資報酬委員會委員共計三人。

(2)本屆委員任期：102 年 6 月 13 日至 105 年 6 月 12 日，103 年度及截至公開說明書刊印日止薪資報酬委員會共開會 8 次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	王文字	8	0	100%	
委員	謝徽榮	8	0	100%	
委員	徐中時	3	5	38%	
其他應記載事項：					
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。					
二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。					

(五) 履行社會責任情形：

評 估 項 目	運 作 情 形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、落實公司治理 (一) 公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形？ (二) 公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？ (三) 公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？ (四) 公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確有效之獎勵與懲戒制度？	V	V	(一) 本公司雖未訂定企業社會責任政策或制度，但本公司仍將持續實踐社會責任。 (二) 公司每年均會定期舉辦社會責任教育訓練，經由高階主管與員工溝通會議，定期宣導政府相關政令、公司願景、使命與目標，並傳達誠信、創新、務實、卓越之經營理念。 (三) 由人力資源處與安全環保部，共同負責與建立良好溝通諮詢管道，加強對員工、供應商、承攬廠商、客戶、政府機構及社會團體等互動，善盡企業社會責任。 (四) 將公司經營理念與績效管理系統結合，設定明確之獎勵及懲處制度，並定期考核員工績效。	未來將適時予以訂定。 符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。 符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。 符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。
二、發展永續環境 (一) 公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形？ (二) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形？ (三) 公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形？	V	V	(一) 公司致力於提升資源使用及再利用之效能，已訂定相關資源使用管理程序及設置水資源回收再利用系統。 (二) 公司已建立健全環境管理程序及制度，並已於94年1月取得ISO14001環境管理系統驗證迄今。 (三) 於2012年度完成GHG溫室氣體排放盤查、重要產品的碳足跡盤查及外部認證機構的查證。	符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、維護社會公益 (一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ (二) 公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？ (三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育之情形？ (四) 公司是否建立員工定期溝通之機制，以及以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動之情形？ (五) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		(一) 公司為樹立制度，健全組織，保障員工合法權益，特遵照勞動基準法與政府相關法令，訂定工作規則，以作為全體同仁管理與遵守之依據，對求職者或受僱者之招募、甄試、進用、考核、升遷等，不因性別而有差別待遇（但工作性質僅適合特定性別者，不在此限）。招募員工，視實際業務需要而遴用，並以公開甄選方式力求機會均等，使人盡其才為選用原則。新進同仁需先經甄試或審核合格，再依公司新人進用規定，經簽呈核准後正式僱用之。 (二) 公司內部網站建有員工申訴管道，並由專責人員負責處理。 (三) 公司每年定期舉辦員工健檢與特殊作業體檢，依法設置駐廠醫師與專任護士，每月規劃健康促進活動，積極參與政府相關推展活動，並獲頒企業健康職場自主認證標章；每月定期召開全廠環安衛會議，以稽查、追蹤、檢討與改善部門環安衛相關議題，以確保同仁身心健康及防範於未然。 (四) 公司建有暢通的溝通管道，並定期舉辦員工溝通會及部門月會，達成溝通目的。 (五) 為增進員工工作技能、讓員工快速融入工作環境、改善產品與服務品質、提升組織整體競爭力，本公司透過系統化的訓練藍圖展開教育訓練計畫，讓員工與公司一同成長。	符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(六) 公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？ (七) 對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則？ (八) 公司與供應商來往前，是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄？ (九) 公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？	V V V V		(六) 公司遵循品質系統要求，建有完善之缺陷防範機制及客訴反應系統，配合上下游整套供應鏈檢核機制為消費者層層把關且迅速回應。 (七) 本公司秉持誠信正直的理念來對待客戶，以客戶為導向，提供客戶所需的技術、嚴謹的生產、優良的品質和優質的服務。 (八) 新供應商建立時，會評估該新供應商之環境管理政策是否符合法規。 (九) 新版供應商合約中之責任條款中要求「乙方作為甲方之供應商，其營運應透明、公開，注重股東權益，並努力達到企業的社會責任。」	
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。	V		(一) 本公司將於年報及公開說明書中揭露社會責任執行情形。	符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司尚未訂定企業社會責任實務守則，未來將視情況考量訂定。				
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）： - 為落實綠色地球之環保意識，已全面採用環保筷以減少衛生筷之使用，並落實垃圾分類與減量、減排、綠化、循環、節約用水、用電等環境保護措施。 - 配合政府 "1+1" 進用身障宣導方案執行成功，獲頒績優獎狀一面。 - 連續進用中壢啟智訓練中心身障員工並捐助課桌椅給中壢啟智訓練中心，獲頒感謝狀。 - 參與捐助99年新竹縣之公益活動國際身心障礙日獎品。 - 熱心公益，當選100年中壢標準廠房管理委員會主委。				

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
• 獲得100年衛生署國民健康局頒給之「健康職場自主認證標章」殊榮。 • 96年建置中壢標準廠辦園區中庭水景綠美化工程，經費超過新台幣200萬元，並持續每月回饋植栽園丁一名。 • 每年回饋中壢標準廠辦園區綠美化植栽捐款活動。 • 長期認養中壢標準廠辦園區員工宿舍旁綠帶，種植蔬果綠化有成。 • 長期認養中壢工業區自強二路Line-B廠房，週邊人行道之路樹修剪與植栽綠美化。 • 參與98年北區工業局舉辦企業綠美化競賽，獲得績優廠商第一名以及全國第四名。 • 創造中壢新竹地區民眾就業機會，分別與6所高職學校建教合作，善盡學生與老師實務理論相輔相成之企業責任。 • 不定期參與台中博物館導覽義工及台積電志工社慰問榮民之家。 • 不定期參與桃園怡德養護中心與新竹慈善社會團體之慰勞老人活動。 • 發動公司與員工共同捐助八八水災，發揮人飢己飢人溺己溺的精神，捐款總額約計新台幣100多萬元，協助災後重建。 • 針對員工之安全與健康，提供舒適安全的工作環境、教育員工並加強對環保及安全認知。 • 101年響應萬海慈善基金會公益活動募集寒冬送暖二手外套活動。 • 晉用視障按摩師，提供視障人員穩定就業機會。 • 102年海燕颱風重創菲律賓災情慘重，發動員工捐助菲國風災。 • 依事業廢棄物清理計畫書內容執行廢棄物清理，並依法上網申報廢棄物流向，合法清理廢棄物及回收資源廢棄物。 • 102年8月完成中壢廠區揮發性有機化合物(VOC)排放處理設施性能提昇投資建設，排放處理效率有效達到97%以上，達到節能減碳及降低空氣污染排放之目的。				
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：不適用。				

(六) 公司履行誠信經營情形及採行措施：

評 估 項 目	運 作 情 形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二) 公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？ (三) 公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？	V		(一) 本公司訂有「誠信經營守則」，並在「工作規則」明定所有員工均應清楚了解且遵守從業道德規範及個人誠信，並秉持誠實、嚴謹及敬業之精神執行職務。 (二) 誠信正直係本公司企業文化中最重要之核心價值，會於新進員工教育訓練及員工在職訓練中宣導，並建立完善的違規懲戒及申訴制度。 (三) 本公司「工作規則」規定不得要求、接受或給予任何可能損及忠於職守或專業判斷之餽贈、招待或任何形式的賄賂。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？ (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專（兼）職單位，並定期向董事會報告其執行情形？	V	V	(一) 本公司與他人簽訂契約時，均儘可能充分了解對方誠信經營情形，並宜將誠信經營納入商業契約中。 (二) 本公司尚未設立推動企業誠信經營專（兼）職單位。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。

(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？ (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V V V	(三)本公司已於「工作規則」明訂應迴避任何可能造成個人利益與公司利益之間的衝突。董事會各項議案，有利益衝突時，皆依迴避原則，不參與討論，並離席不參與表決。 (四)本公司均依照會計制度、內部控制制度運作，內部稽核人員定期查核其遵循情形，並未發現員工或管理階層有違反誠信經營事項。 (五)公司均會定期舉辦誠信經營之教育訓練。	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V	本公司已於「工作規則」明訂懲戒制度，並於公司網站中載明若有任何人發現本公司員工或利害關係人進行任何疑似或可能違反本公司從業道德之行為時，請務必通知本公司；且此舉報行為，將交由董事長或其指定之高階主管直接進行處理，對於檢舉人均屬以保密，免於遭受不當之處置。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	V	(一)已於本公司架設之網站中，揭露公司之經營理念係以誠信/創新/客戶導向為宗旨，並於年報及公開說明書中揭露誠信經營情形。	符合上市上櫃公司誠信經營守則規定。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司尚未訂定誠信經營守則，未來將視情況考量訂定。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：無。			

(七) 公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：無。

(八) 最近年度及截至公開說明書刊印日止，與財務報告有關人士（包括公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等）辭職解任情形之彙總：

104 年 3 月 23 日

職 稱	姓 名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
內部稽核主管	胡 益 誠	102/3/8	102/8/9	內 部 職 務 調 整
內部稽核主管	李 湘 怡	102/8/9	103/3/6	內 部 職 務 調 整
執 行 長	關 欣	100/4/29	103/9/24	基於組織扁平化之考量，取消執行長職務編制。

(九) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無。

柒、重要決議、公司章程及相關法規

一、與本次發行有關之決議文(含章程新舊條文對照表及盈餘分配表)：請參閱第194頁~第202頁。

二、未來股利發放政策

(一)公司章程所訂之股利政策：請參閱本公開說明書「貳、四、(五)1.」之說明。

(二)本年度已議股利分配之情形：請參閱本公開說明書「貳、四、(五)2.」之說明。

三、截至公開說明書刊印日止之背書保證相關資訊：無。

**精材科技股份有限公司
內部控制制度聲明書**

日期：一〇三年三月六日

本公司民國一〇二年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機能，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及 5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國一〇二年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一〇三年三月六日董事會通過，出席董事七人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

精 材 科 技 股 份 有 限 公 司

董事長暨執行長兼總經理：關欣



簽章



**精材科技股份有限公司
內部控制制度聲明書**

日期：一〇三年八月七日

本公司民國一〇二年七月一日至一〇三年六月三十日之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機能，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國一〇三年六月三十日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、為申請股票上櫃之需要，本公司依據「處理準則」第二十八條及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心審查有價證券上櫃作業程序」第六條之規定，委託會計師專案審查上開期間與財務報導之可靠性及與保障資產安全(使資產不致在未經授權之情形下取得、使用或處分)有關的內部控制制度，如前項所述，其設計及執行係屬有效，並無影響財務資訊之記錄、處理、彙總及報告可靠性之重大缺失，亦無影響保障資產安全，使資產在未經授權之情形下逕行取得、使用或處分之重大缺失。
- 七、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 八、本聲明書業經本公司民國一〇三年八月七日董事會通過，出席董事七人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

精 材 科 技 股 份 有 限 公 司

董事長暨執行長兼總經理：關欣

簽章



內部控制制度審查報告

後附精材科技股份有限公司民國103年8月7日謂經評估認為其與財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國102年7月1日至103年6月30日係有效設計及執行之聲明書，業經本會計師審查竣事。維持有效之內部控制制度及評估其有效性係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據審查結果對公司內部控制制度之有效性及上開公司之內部控制制度聲明書表示意見。

本會計師係依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及一般公認審計準則規劃並執行審查工作，以合理確信公司上述內部控制制度是否在所有重大方面維持有效性。此項審查工作包括瞭解公司內部控制制度、評估管理階層評估整體內部控制制度有效性之過程、測試及評估內部控制制度設計及執行之有效性，以及本會計師認為必要之其他審查程序。本會計師相信此項審查工作可對所表示之意見提供合理之依據。

任何內部控制制度均有其先天上之限制，故精材科技股份有限公司上述內部控制制度仍可能未能預防或偵測出業已發生之錯誤或舞弊。此外，未來之環境可能變遷，遵循內部控制制度之程度亦可能降低，故在本期有效之內部控制制度，並不表示在未來亦必有效。

依本會計師意見，依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之內部控制有效性判斷項目判斷，精材科技股份有限公司與財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度，於民國102年7月1日至103年6月30日之設計及執行，在所有重大方面可維持有效性；精材科技股份有限公司於民國103年8月7日所出具謂經評估認為其上述與財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度係有效設計及執行之聲明書，在所有重大方面則屬允當。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 鴻 鵬



會計師 黃 裕 峰



中 華 民 國 103 年 9 月 15 日

承銷商總結意見

精材科技股份有限公司(以下簡稱精材或該公司)本次為辦理現金增資發行新股普通股 30,000,000 股，每股面額新臺幣 10 元，合計發行總金額新台幣 300,000,000 元整，依法向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申報。業經本承銷商採用必要之輔導及評估程序，包括實地了解該公司之營運狀況，與公司董事、經理人、及其他相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證及比較分析相關資料等，予以審慎評估。特依金融監督管理委員會「發行人募集與發行有價證券處理準則」及中華民國證券商業同業公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券評估報告之評估查核程序」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，精材科技股份有限公司本次募集與發行有價證券符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

凱基證券股份有限公司



負責人：許道義



承銷部門主管：林能顯



中華民國一〇四年二月六日

律師法律意見書

精材科技股份有限公司本次為申請股票上櫃，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申請股票上櫃。經本律師採取必要審核程序，包括實地瞭解，與公司相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證公司議事錄、重要契約及其他相關文件、資料，並參酌相關專家之意見等。特依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心審查有價證券上櫃作業程序」、「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心初次申請上櫃用之公開說明書應行記載事項準則」及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」等規定，出具本律師法律意見書。

依本律師意見，精材科技股份有限公司本次向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃，並未發現有違反法令致影響股票上櫃之情事。

此致

精材科技股份有限公司

翰辰法律事務所
邱雅文律師



中 華 民 國 1 0 3 年 9 月 2 9 日

律師法律意見書

精材科技股份有限公司本次為募集與發行記名式普通股30,000,000股，每股面額新台幣10元，發行總金額新台幣300,000,000元，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出申報。經本律師採取必要審核程序，包括實地瞭解，與公司董事、經理人及相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證公司議事錄、重要契約及其他相關文件、資料，並參酌相關專家之意見等。特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本律師法律意見書。

依本律師意見，精材科技股份有限公司本次向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出之法律事項檢查表所載事項，並未發現有違反法令致影響有價證券募集與發行之情事。

此致

精材科技股份有限公司

翰辰法律事務所

邱雅文律師



中 華 民 國 一 〇 四 年 二 月 六 日

承諾書

承諾 貴中心於必要時得要求本公司委託經 貴中心指定之會計師或機構，依貴中心指定之查核範圍進行外部專業檢查，並將檢查結果提交 貴中心，且由本公司負擔相關費用。

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心



立 承 諾 書 人：精材科技股份有限公司

董事長暨總經理：關 欣



中 華 民 國 1 0 4 年 1 月 8 日

聲 明 書

茲聲明本公司與台灣積體電路製造股份有限公司、台積(中國)有限公司、TSMC North America 及采鈺科技股份有限公司之財務、業務往來無非常規交易之情事。

特 此 聲 明

立聲明書人：精材科技股份有限公司 (蓋章)



代 表 人：關欣



(簽章或蓋章)

中 華 民 國 一 ○ 三 年 九 月 二 十 九 日

聲 明 書

茲聲明本公司與同屬集團企業(詳附表列示)並無財務、業務往來之情事、未來配合營運若有財務、業務往來時，悉依本公司財務、業務往來規章辦理，並承諾將無非常規交易之情事。

特 此 聲 明

立聲明書人：精材科技股份有限公司 (蓋章)



代 表 人：關欣



(簽章或蓋章)

中 華 民 國 一 〇 三 年 九 月 二 十 九 日

附表

集	團	企	業	名	稱
1	TSMC Europe B.V.	14	VentureTech Alliance Fund II, L.P.		
2	TSMC Japan Limited	15	VentureTech Alliance Fund III, L.P.		
3	TSMC Korea Limited	16	Growth Fund Limited		
4	TSMC Technology, Inc.	17	VentureTech Alliance Holdings, LLC		
5	InveStar Semiconductor Development Fund, Inc.	18	台積太陽能(股)公司		
6	InveStar Semiconductor Development Fund, Inc. (II) LDC.	19	TSMC Solar North America, Inc.		
7	TSMC Development, Inc.	20	TSMC Solar Europe B.V.		
8	WaferTech, LLC	21	TSMC Solar Europe GmbH		
9	TSMC Partners, Ltd.	22	台積固態照明(股)公司		
10	TSMC Design Technology Canada Inc.	23	TSMC Lighting North America, Inc.		
11	TSMC Global Ltd.	24	台積光能投資有限公司		
12	相豐科技(股)公司	25	創意電子股份有限公司		
13	Emerging Alliance Fund, L.P.	26	VisEra Holding Company		

聲 明 書

茲聲明本公司與精材科技股份有限公司之財務、業務往來，均依相關規章辦理，並無非常規交易之情事。

特 此 聲 明



立聲明書人：台灣積體電路製造股份有限公司（蓋章）

代 表 人：張忠謀



（簽章或蓋章）

中 華 民 國 一 〇 三 年 九 月 二 十 九 日

聲 明 書

茲聲明本公司與精材科技股份有限公司之財務、業務往來，均依相關規章辦理，並無非常規交易之情事。

特 此 聲 明

立聲明書人：台積電(中國)有限公司 (蓋章)



代 表 人：曾繁城 (簽章或蓋章)



中 華 民 國 一 〇 三 年 九 月 二 十 九 日

STATEMENT OF FACTS

This Statement of Facts ("Statement"), true as of September 22, 2014, is made with respect to the sales transactions between:

TSMC North America, a California corporation having its principal place of business at 2585 Junction Avenue, San Jose, CA 95134 ("TSMC NA"), and

Xintec, a company duly incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C, having its principal office located at 9FL., No.23, Jilin Rd., Jhongli Industrial Park, Jhongli City, Taoyuan County, Taiwan, R.O.C. ("Xintec").

From January 5, 2011 to January 26, 2012, TSMC NA and Xintec completed twenty sales transactions for short loop wafers. All twenty transactions were made on an arm's length basis and on terms comparable to those made in the ordinary course of business. Furthermore, Xintec's account with TSMC NA has been closed since January 2012.

Signed:

TSMC North America

By:

Name: R.B. Cassidy II

Title: President

聲 明 書

茲聲明本公司與精材科技股份有限公司之財務、業務往來，均依相關規章辦理，並無非常規交易之情事。

特 此 聲 明

立聲明書人：采鈺科技股份有限公司



代 表 人：關 欣



(簽章或蓋章)

中 華 民 國 一 〇 三 年 九 月 十 九 日

本公司、本公司之董事、以及與本公司申請上櫃案有關之經理人、受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦理」第 43 條之 1 及準用第 36 條有關詢價圈購禁止配售對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人：精材科技股份有限公司

負責人：關 欣



中 華 民 國 一 〇 四 年 二 月 六 日

本公司為精材科技股份有限公司之現任法人董事及持股百分之十以上股東，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 43 條之 1 及準用第 36 條有關詢價圈購禁止配售對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人：台灣積體電路製造股份有限公司

負責人：張忠謀



中華民國 一〇四 年 二 月 六 日

本人為精材科技股份有限公司現任法人董事代表人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦理」第 43 條之 1 及準用第 36 條有關詢價圈購禁止配售對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人：關 欣



中華民國 一〇四 年 二 月 六 日

本人為精材科技股份有限公司之現任法人董事（台灣積體電路製造股份有限公司）之指派代表人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

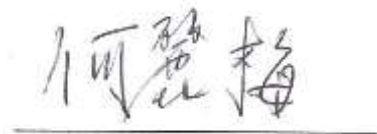
二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 43 條之 1 及準用第 36 條有關詢價圈購禁止配售對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人：



(何 麗 梅)

中華民國 一〇四 年 二 月 六 日

本人為精材科技股份有限公司之現任法人董事（台灣積體電路製造股份有限公司）之指派代表人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 43 條之 1 及準用第 36 條有關詢價圈購禁止配售對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人： 
(林 錦 坤)

中華民國 一〇四 年 二 月 六 日

本公司為精材科技股份有限公司現任法人董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦理」第 43 條之 1 及準用第 36 條有關詢價圈購禁止配售對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人：台灣豪威投資控股股份有限公司

負責人：洪筱英(Xiaoying Hong)



中華民國 一〇四 年 二 月 六 日

本人為精材科技股份有限公司現任法人董事代表人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦理」第 43 條之 1 及準用第 36 條有關詢價圈購禁止配售對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人：


Hongli Yang

中 華 民 國 一 〇 四 年 二 月 六 日

本人為精材科技股份有限公司現任獨立董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦理」第 43 條之 1 及準用第 36 條有關詢價圈購禁止配售對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人：


王文字

中 華 民 國 一 〇 四 年 二 月 六 日

本人為精材科技股份有限公司現任獨立董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦理」第 43 條之 1 及準用第 36 條有關詢價圈購禁止配售對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人：



徐中時

中 華 民 國 一 〇 四 年 二 月 六 日

本人為精材科技股份有限公司現任獨立董事，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

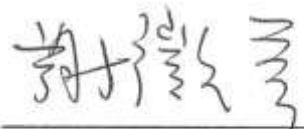
一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦理」第 43 條之 1 及準用第 36 條有關詢價圈購禁止配售對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人： 
謝徽榮

中華民國 一 ○ 四 年 二 月 六 日

本人為精材科技股份有限公司持股百分之十以上股東，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及本公司之關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦理」第 43 條之 1 及準用第 36 條有關詢價圈購禁止配售對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

聲明人：英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company

負責人：



Hsin Kuan

中華民國 一〇四 年 二 月 六 日

本人為精材科技股份有限公司之經理人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦理」第 43 條之 1 及準用第 36 條有關詢價圈購禁止配售對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

經 理 人：關欣



經 理 人：林中安



經 理 人：溫英男



經 理 人：何彥仕



經 理 人：尤龍生



經 理 人：方文良



財會主管：林恕敏



稽核主管：黃亮凱



法務主管：周正德



中華民國 一 〇 四 年 二 月 六 日

本人為精材科技股份有限公司之受僱人，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

- 一、切實遵守「上市上櫃公司誠信經營守則」，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦理」第 43 條之 1 及準用第 36 條有關詢價圈購禁止配售對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

受僱人：馮中玉



范振梅



陳育如



林佳昇



薛介倫



賴素惠



郭婷婷



孫雅萍



李湘怡



簡良玉



陳坤宏



中 華 民 國 一 〇 四 年 二 月 六 日

本公司及本公司相關人員輔導並承銷精材科技股份有限公司申請有價證券上櫃案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 56 條、第 66 條、第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦理」第 43 條之 1 及準用第 36 條有關詢價圈購禁止配售對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心



主辦證券承銷商：凱基證券股份有限公司

負 責 人：許 道 義



中華民國 一〇四 年 二 月 六 日

本公司及本公司相關人員輔導並承銷精材科技股份有限公司申請有價證券上櫃案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 56 條、第 66 條、第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦理」第 43 條之 1 及準用第 36 條有關詢價圈購禁止配售對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

協辦證券承銷商：第一金證券股份有限公司

負責人：林 漢 奇



中華民國 一 ○ 四 年 二 月 六 日

本公司及本公司相關人員輔導並承銷精材科技股份有限公司申請有價證券上櫃案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 56 條、第 66 條、第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦理」第 43 條之 1 及準用第 36 條有關詢價圈購禁止配售對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

協辦證券承銷商：華南永昌綜合證券股份有限公司

負 責 人：黃 崇 健



中華民國 一〇四 年 二 月 六 日

本公司及本公司相關人員輔導並承銷精材科技股份有限公司申請有價證券上櫃案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願依 貴中心相關規定處理，並自負證券交易法第 56 條、第 66 條、第 171 條、第 174 條及其他相關法律之責任。

一、本案絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或其所指定之人等，亦絕無虛偽或隱匿之情事。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦理」第 43 條之 1 及準用第 36 條有關詢價圈購禁止配售對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

協辦證券承銷商：元富證券股份有限公司

董 事 長：陳 俊 宏



中華民國 一〇四 年 二 月 六 日

本律師承辦精材科技股份有限公司申請有價證券上櫃案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願自負法律責任。

一、絕對保持超然獨立之精神並本於誠信，本案審查期間絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 43 條之 1 有關詢價圈購禁止配售對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

律師事務所：維和法律事務所

律師：莊振農



中 華 民 國 1 0 4 年 2 月 6 日

本律師承辦精材科技股份有限公司申請有價證券上櫃案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願自負法律責任。

- 一、絕對保持超然獨立之精神並本於誠信，本案審查期間絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為。
- 二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 43 條之 1 有關詢價圈購禁止配售對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

律師事務所：翰辰法律事務所

律師：邱雅文



中 華 民 國 104 年 2 月 6 日

本會計師承辦精材科技股份有限公司申請有價證券上櫃案，茲承諾遵守下列事項，如有違反，願自負法律責任。

一、絕對保持超然獨立之精神並本於誠信，本案審查期間絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為。

二、知悉並遵守「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦理」第 43 條之 1 有關詢價圈購禁止配售對象之規定。

特此聲明

此致

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 鴻



會計師 黃 裕



中 華 民 國 1 0 4 年 2 月 4 日

聲明書

本公司、本公司之董事、總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行 104 年度現金增資發行新股 乙案有關之經理人，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

聲明人：精材科技股份有限公司



負責人：關欣



中 華 民 國 一 ○ 四 年 二 月 六 日

聲明書

本公司為精材科技股份有限公司(以下簡稱「該公司」)之現任法人董事，於該公司申報募集與發行 104 年度現金增資發行新股 乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

聲明人：



台灣積體電路製造股份有限公司

負責人：



(張 忠 謀)

中 華 民 國 一 ○ 四 年 二 月 六 日

聲明書

本人係精材科技股份有限公司(以下簡稱「該公司」)之現任法人董事代表人，於該公司申報募集與發行 104 年度現金增資發行新股 乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

聲明人：關欣



中 華 民 國 一 ○ 四 年 二 月 六 日

聲明書

本人係精材科技股份有限公司(以下簡稱「該公司」)之現任法人董事代表人，於該公司申報募集與發行 104 年度現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

聲明人： 
(何 麗 梅)

中 華 民 國 一 ○ 四 年 二 月 六 日

聲明書

本人係精材科技股份有限公司(以下簡稱「該公司」)之現任法人董事代表人，於該公司申報募集與發行 104 年度現金增資發行新股 乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

聲明人： 林錦坤
(林 錦 坤)

中 華 民 國 一 ○ 四 年 二 月 六 日

聲明書

本公司為精材科技股份有限公司(以下簡稱「該公司」)之現任法人董事，於該公司申報募集與發行 104 年度現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

聲明人：



(台灣豪威投資控股股份有限公司)

負責人：

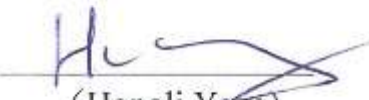


(洪 筱 英)

中 華 民 國 一 ○ 四 年 二 月 六 日

本人係精材科技股份有限公司(以下簡稱「該公司」)之現任法人董事代表人，於該公司申報募集與發行 104 年度現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

聲明人：

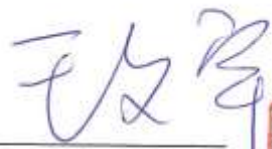

(Hongli Yang)

中 華 民 國 一 ○ 四 年 二 月 六 日

聲明書

本人係精材科技股份有限公司(以下簡稱「該公司」)之現任獨立董事，於該公司申報募集與發行 104 年度現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

聲明人：


(王 文 宇) 

中 華 民 國 一 ○ 四 年 二 月 六 日

聲明書

本人係精材科技股份有限公司(以下簡稱「該公司」)之現任獨立董事，於該公司申報募集與發行 104 年度現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

聲明人：



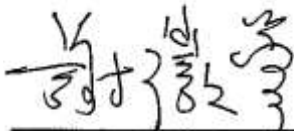
(徐 中 時)

中 華 民 國 一 ○ 四 年 二 月 六 日

聲明書

本人係精材科技股份有限公司(以下簡稱「該公司」)之現任獨立董事，於該公司申報募集與發行 104 年度現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予該公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

聲明人：


(謝 徽 榮)

中 華 民 國 一 ○ 四 年 二 月 六 日

聲明書

本公司總經理、財務或會計主管以及與本公司申報募集與發行
104 年度現金增資發行新股乙案有關之經理人，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

總經理：關欣



經理人：林中安



經理人：溫英男



經理人：何彥仕



經理人：尤龍生



經理人：方文良



財會主管：林恕敏



稽核主管：黃亮凱



法務主管：周正德



中 華 民 國 一 ○ 四 年 二 月 六 日

聲明書

本人於精材科技股份有限公司申報募集與發行 104 年度現金增資發行新股乙案，絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且無收取或要求證券承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予本人或其關係人或其指定之人等，絕無虛偽或隱匿之情事，如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條、第二十條之一及第三十二條等規定，應負證券交易法第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

受僱人： 范振梅



馮中玉



陳育如



林佳昇



薛介倫



賴素惠



郭婷婷



孫雅萍



李湘怡



簡良玉



陳坤宏



中 華 民 國 一 ○ 四 年 二 月 六 日

聲 明 書

本公司受精材科技股份有限公司委託，擔任精材科技股份有限公司募集與發行 104 年度現金增資發行新股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、精材科技股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。



證券承銷商：凱基證券股份有限公司

負責人：許 道 義



中華民國 一〇四 年 二 月 六 日

聲 明 書

本公司受精材科技股份有限公司委託，擔任精材科技股份有限公司募集與發行 104 年度現金增資發行新股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、精材科技股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：第一金證券股份有限公司

負責人：林 漢 奇



中華民國 一〇四 年 二 月 六 日

聲 明 書

本公司受精材科技股份有限公司委託，擔任精材科技股份有限公司募集與發行 104 年度現金增資發行新股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、精材科技股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：元富證券股份有限公司

董 事 長：陳俊宏



日期：一〇四年二月六日

聲 明 書

本公司受精材科技股份有限公司委託，擔任精材科技股份有限公司募集與發行 104 年度現金增資發行新股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

- 一、精材科技股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。
- 二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。
- 三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：華南永昌綜合證券股份有限公司

負責人：黃 崇 健



日期：一〇四年二月六日

聲 明 書

本公司受精材科技股份有限公司委託，擔任精材科技股份有限公司募集與發行 104 年度現金增資發行新股乙案之證券承銷商，茲聲明將善盡注意下列事項，絕無虛偽或隱匿之情事：

一、精材科技股份有限公司本次募集與發行有價證券價格之訂定及相關作業程序，應遵守「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」等相關規定。

二、本公司絕無直接或間接要求、行求、期約、交付賄賂及收受賄賂之行為，且承銷相關費用之收取，不以其他方式或名目補償或退還予發行人或其關係人或前二者所指定之人等。

三、如有上開情事者，涉及違反證券交易法第二十條及第三十二條等規定，除依中華民國證券商業同業公會訂定之相關規定處理，並應負證券交易法第五十六條、第六十六條、第一百七十一條、第一百七十四條及其他相關法律責任。

證券承銷商：國泰綜合證券股份有限公司



負 責 人：莊 順 裕



日 期：一 〇 四 年 三 月 一 三 日

聲明書

本公司在此聲明，因本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股之承銷案件，證券承銷商受理詢價圈購之對象，有下列之人參與詢價圈購時，將依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43-1 條規定辦理，拒絕之：

- 一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶或二親等關係者。
- 四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。
- 七、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之二親等親屬。
- 八、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶、二親等親屬。
- 九、發行公司之員工。
- 十、與承銷商有承銷業務往來公司之董事、監察人、經理人及其配偶及子女。
- 十一、承銷商本身所屬金融控股公司及該金融控股公司其他子公司；惟同屬金融控股公司之證券投資信託公司募集之證券投資信託基金則不在此限。
- 十二、承銷商本身所屬金融控股公司及該金融控股公司其他子公司之董事、監事、經理人及其配偶及子女。
- 十三、與發行公司、承銷商具實質關係者。
- 十四、發行公司簽證會計師、其事務所之其他會計師及其配偶。
- 十五、就該承銷案件出具法律意見書之律師及其配偶。
- 十六、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

聲 明 人：精材科技股份有限公司

負 責 人：關欣



中 華 民 國 1 0 4 年 2 月 6 日

聲明書

本公司凱基證券股份有限公司在此聲明，因辦理精材科技股份有限公司初次上櫃現金增資發行之承銷案件，受理詢價圈購之對象不具「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43-1 條所列情事之身份：

- 一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶或二親等關係者。
- 四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。
- 七、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之二親等親屬。
- 八、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶、二親等親屬。
- 九、發行公司之員工。
- 十、與承銷商有承銷業務往來公司之董事、監察人、經理人及其配偶及子女。
- 十一、承銷商本身所屬金融控股公司及該金融控股公司其他子公司；惟同屬金融控股公司之證券投資信託公司募集之證券投資信託基金則不在此限。
- 十二、承銷商本身所屬金融控股公司及該金融控股公司其他子公司之董事、監事、經理人及其配偶及子女。
- 十三、與發行公司、承銷商具實質關係者。
- 十四、發行公司簽證會計師、其事務所之其他會計師及其配偶。
- 十五、就該承銷案件出具法律意見書之律師及其配偶。
- 十六、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

證券商承銷商：凱基證券股份有限公司
負責人：許道義



中 華 民 國 一 〇 四 年 二 月 六 日

聲明書

本公司第一金證券股份有限公司在此聲明，因辦理精材科技股份有限公司初次上櫃現金增資發行之承銷案件，受理詢價圈購之對象不具「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43-1 條所列情事之身份：

- 一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶或二親等關係者。
- 四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。
- 七、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之二親等親屬。
- 八、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶、二親等親屬。
- 九、發行公司之員工。
- 十、與承銷商有承銷業務往來公司之董事、監察人、經理人及其配偶及子女。
- 十一、承銷商本身所屬金融控股公司及該金融控股公司其他子公司；惟同屬金融控股公司之證券投資信託公司募集之證券投資信託基金則不在此限。
- 十二、承銷商本身所屬金融控股公司及該金融控股公司其他子公司之董事、監事、經理人及其配偶及子女。
- 十三、與發行公司、承銷商具實質關係者。
- 十四、發行公司簽證會計師、其事務所之其他會計師及其配偶。
- 十五、就該承銷案件出具法律意見書之律師及其配偶。
- 十六、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

證券商承銷商：第一金證券股份有限公司
負責人：林 漢 奇



中 華 民 國 一 ○ 四 年 二 月 六 日

聲明書

本公司元富證券股份有限公司在此聲明，因辦理精材科技股份有限公司初次上櫃現金增資發行之承銷案件，受理詢價圈購之對象不具「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43-1 條所列情事之身份：

- 一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶或二親等關係者。
- 四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。
- 七、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之二親等親屬。
- 八、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶、二親等親屬。
- 九、發行公司之員工。
- 十、與承銷商有承銷業務往來公司之董事、監察人、經理人及其配偶及子女。
- 十一、承銷商本身所屬金融控股公司及該金融控股公司其他子公司；惟同屬金融控股公司之證券投資信託公司募集之證券投資信託基金則不在此限。
- 十二、承銷商本身所屬金融控股公司及該金融控股公司其他子公司之董事、監事、經理人及其配偶及子女。
- 十三、與發行公司、承銷商具實質關係者。
- 十四、發行公司簽證會計師、其事務所之其他會計師及其配偶。
- 十五、就該承銷案件出具法律意見書之律師及其配偶。
- 十六、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

證券承銷商：元富證券股份有限公司

董 事 長：陳俊宏



中 華 民 國 一 ○ 四 年 二 月 六 日

聲明書

本公司華南永昌綜合證券股份有限公司在此聲明，因辦理精材科技股份有限公司初次上櫃現金增資發行之承銷案件，受理詢價圈購之對象不具「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43-1 條所列情事之身份：

- 一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶或二親等關係者。
- 四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。
- 七、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之二親等親屬。
- 八、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶、二親等親屬。
- 九、發行公司之員工。
- 十、與承銷商有承銷業務往來公司之董事、監察人、經理人及其配偶及子女。
- 十一、承銷商本身所屬金融控股公司及該金融控股公司其他子公司；惟同屬金融控股公司之證券投資信託公司募集之證券投資信託基金則不在此限。
- 十二、承銷商本身所屬金融控股公司及該金融控股公司其他子公司之董事、監事、經理人及其配偶及子女。
- 十三、與發行公司、承銷商具實質關係者。
- 十四、發行公司簽證會計師、其事務所之其他會計師及其配偶。
- 十五、就該承銷案件出具法律意見書之律師及其配偶。
- 十六、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

證券商承銷商：華南永昌綜合證券股份有限公司
負責人：黃崇健



中 華 民 國 一 ○ 四 年 二 月 六 日

聲明書

本公司國泰綜合證券股份有限公司在此聲明，因辦理精材科技股份有限公司初次上櫃現金增資發行之承銷案件，受理詢價圈購之對象不具「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第 36 條及第 43-1 條所列情事之身份：

- 一、發行公司（發行機構）採權益法評價之被投資公司。
- 二、對發行公司（發行機構）之投資採權益法評價之投資者。
- 三、公司之董事長或總經理與發行公司（發行機構）之董事長或總經理為同一人，或具有配偶或二親等關係者。
- 四、受發行公司（發行機構）捐贈之金額達其實收基金總額三分之一以上之財團法人。
- 五、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理、副總經理、協理及直屬總經理之部門主管。
- 六、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之配偶。
- 七、發行公司（發行機構）之董事、監察人、總經理之二親等親屬。
- 八、承銷團之董事、監察人、受僱人及其配偶、二親等親屬。
- 九、發行公司之員工。
- 十、與承銷商有承銷業務往來公司之董事、監察人、經理人及其配偶及子女。
- 十一、承銷商本身所屬金融控股公司及該金融控股公司其他子公司；惟同屬金融控股公司之證券投資信託公司募集之證券投資信託基金則不在此限。
- 十二、承銷商本身所屬金融控股公司及該金融控股公司其他子公司之董事、監事、經理人及其配偶及子女。
- 十三、與發行公司、承銷商具實質關係者。
- 十四、發行公司簽證會計師、其事務所之其他會計師及其配偶。
- 十五、就該承銷案件出具法律意見書之律師及其配偶。
- 十六、前各款之人利用他人名義參與應募者（指具證券交易法施行細則第二條規定要件等之實質關係人）。

證券承銷商：國泰綜合證券股份有限公司

負責人：莊順裕



中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 十 三 日



精材科技股份有限公司
第七屆第五次董事會會議記錄(節錄)

時 間： 民國一〇三年三月六日下午一時整

地 點： 新竹科學工業園區新竹市篤行一路十二號

出席董事： 關欣、林錦坤、何麗梅、王文宇、謝徽榮

未出席董事：Xiaoying Hong（林錦坤代理）、徐中時（謝徽榮代理）

主 席： 關欣



記 錄： 林恕敏



列席人員： 略

議 程：

一、 董事長致辭(略)

二、 報告事項(略)

三、 決議事項

第 一 項 ~ 第 三 項：(略)

第 四 項： 請核准本公司上櫃申請案。其相關事項擬授權董事長及其指定之人參酌市場狀況辦理之。

經討論後，主席徵詢全體出席董事無異議一致通過決議如下：

決議：照案通過。

第 五 項： 請核准辦理現金增資發行新股，作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。依上櫃審查準則之規定，本公司申請上櫃時至少應提出上櫃股份總數百分之十或一仟萬股以現金增資發行新股之方式委託證券承銷商辦理公開銷售。

上述現金增資發行新股，除依公司法規定保留百分之十至十五供員工認購外，餘由原股東依持股比例優先認購之部份，提請股東全數放棄優先認購權，並同意委託證券承銷商辦理公開承銷。

本公司辦理股票上櫃公開承銷之相關事宜，提請股東會授權董事會決定之。

經討論後，主席徵詢全體出席董事無異議一致通過決議如下：

決議：照案通過。

第 六 項 ~ 第 二十 項：

四、 臨時動議

經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。



精材科技股份有限公司
第七屆第八次董事會會議記錄(節錄)

時 間： 民國一〇三年八月七日下午二時十分

地 點： 新竹科學工業園區新竹市篤行一路十二號五樓

出席董事： 關欣、何麗梅、林錦坤、Hongli Yang、王文宇、謝徽榮

未出席董事：徐中時（謝徽榮代理）

主 席： 關欣



記 錄： 林恕敏



列席人員：（略）

議 程：

一、 董事長致詞 (略)

二、 報告事項 (略)

三、 決議事項

第 一 項：請核准本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案，並授權董事長及其授權之人協調特定股東配合辦理自願集保及簽訂過額配售協議書相關事宜。

經討論後，主席徵詢全體出席董事無異議一致通過決議如下：

決議：照案通過。

第 二 ~ 十二 項：(略)

四、 臨時動議

經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。



精材科技股份有限公司
第七屆第十一次董事會會議記錄(節錄)

時 間： 民國一〇四年二月四日下午五時整

地 點： 新竹科學工業園區新竹市篤行一路十二號五樓

出席董事： 關欣、林錦坤、王文宇、謝徽榮

未出席董事：Hongli Yang（關欣代理）、何麗梅、徐中時（謝徽榮代理）

主 席： 關欣

記 錄： 林恕敏

列席人員：（略）

議 程：

一、 董事長致詞（略）

二、 報告事項（略）

三、 決議事項

第一～三項：（略）

第四項：請核准本公司辦理現金增資發行新股30,000,000股普通股，以供上櫃掛牌前公開承銷。

發行條件如下：

- 一、本次現金增資發行新股 30,000,000 股，每股面額新台幣 10 元，承銷價格區間暫訂為每股新台幣 33 元至 43 元之間，募資總金額為 990,000 仟元至 1,290,000 仟元，承銷價格則授權董事長於該範圍內與證券承銷商議定之。
- 二、本次現金增資發行新股依公司法第 267 條規定，保留 15%計 4,500,000 股由本公司員工認購，若員工未認購之股份，授權董事長洽特定人認購之；其餘 85%計 25,500,000 股，全數悉由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷。
- 三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。
- 四、本次現金增資計畫目的係償還銀行借款，資金運用計畫及預計可能產生效益，請參閱附件五。

發行計畫之主要內容（包括發行價格/承銷價格）、實際發行數量、發行條件、計畫項目、預計進度、可能產生效益，及經核准後之增資基準日、股款繳納期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及其他等相關事項），暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。

經討論後，主席徵詢全體出席董事無異議一致通過決議如下：

決議：照案通過。

第五～七項：（略）

四、臨時動議

經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。



精材科技股份有限公司
第七屆第十二次董事會議事錄(節錄)

時 間： 民國一〇四年三月十一日下午四時四十五分整

地 點： 新竹科學工業園區新竹市篤行一路十二號五樓

出席董事： 關欣、何麗梅、林錦坤、王文宇、謝徽榮

委託出席董事：Hongli Yang（關欣代理）、徐中時（謝徽榮代理）

主 席： 關欣  記 錄： 林恕敏 

列席人員：（略）

議 程：

一、 董事長致詞(略)

二、 報告事項(略)

三、 討論事項

第一項~第十一項：(略)。

第十二項：請核准本公司調整現金增資發行新股之發行價格（承銷價格）區間，以供上櫃掛牌前之公開承銷。除調整發行價格（承銷價格）區間以外，其餘發行條件均依本年度2月4日董事會之決議。發行新股之發行價格（承銷價格）提請董事會授權董事長全權處理之。

經討論後，主席徵詢全體出席董事無異議一致通過決議如下：

決議：本次發行新股之發行價格（承銷價格）區間由原新台幣 33 元至 43 元間調整為新台幣 40 元至 43 元間，並授權董事長於調整後之區間與證券承銷商完成發行價格（承銷價格）之訂定。其餘發行條件及授權董事長之範圍悉依本年度 2 月 4 日董事會之決議辦理。

四、 臨時動議

經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。

精材科技股份有限公司
民國一〇三年股東常會議事錄(節錄)

時 間： 中華民國一〇三年六月十二日下午一時
地 點： 中壢市中壢工業區吉林路二十三號地下一樓（本公司會議室）
本公司已發行總股數：236,481,391股
出席股東及代理人所持股數：160,452,032股
出席股數占全部已發行股數：67.84%

主 席：關欣董事長



記 錄：林恕敏



議 程：

壹、大會報告出席股數已達法定數，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞（略）

參、報告事項（略）

肆、承認及討論事項

第一案、（略）

第二案、核准民國一〇二年度盈餘分派之議案。（董事會提）

說明：（一） 本次盈餘分派案，係分配一〇二年度可分配盈餘，普通股現金股利每股配發新台幣0.55元，現金配發至元為止（元以下捨去），配發不足一元之畸零款，列入本公司之其他收入。

（二） 本案俟股東常會通過後，由董事會另訂配息基準日。本次盈餘分派案，嗣後如因員工認股權之行使，而須發行新股，致影響本公司流通在外股份總數，請授權董事長依本案決議之普通股擬分配盈餘總額按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

(三) 民國一〇二年度盈餘分派表，請參閱附件。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案、(略)

第四案、新股承銷原股東放棄案。(董事會提)

說明：(一) 本公司辦理現金增資發行新股，作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。依上櫃審查準則之規定，本公司申請上櫃時至少應提出上櫃股份總數百分之十或一仟萬股以現金增資發行新股之方式委託證券承銷商辦理公開銷售。

(二) 本次現金增資發行新股除依公司法規定保留百分之十至十五供員工認購，若員工放棄或認購不足部分，委由董事長及其授權之人洽特定人認購之；餘由原股東依持股比例優先認購之部份，提請股東全數放棄優先認購權，並同意委託證券承銷商進行公開承銷。

(三) 本次現金增資發行之新股，其權利及義務與原有股份相同，並採無實體發行。

(四) 本公司辦理股票上櫃公開承銷之相關事宜(包括增資用途、發行股數、發行價格、募集金額、計劃項目、預計進度及可能產生效益等相關事項)及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時，提請股東會授權董事會決定之。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案、(略)

伍、臨時動議、(略)

經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢散會。



精材科技股份有限公司

盈餘分派表
民國一〇二年度

期初未分配盈餘	NT\$789,767,590	
減：首次採用TIFRS調整數	(21,093,780)	註3
調整後期初未分配盈餘	NT\$768,673,810	
加：確定福利計劃之精算利益	1,469,202	
調整後未分配盈餘	NT\$770,143,012	
加：民國一〇二年度純益	288,880,677	註1&2
減：提撥百分之十法定盈餘公積	(28,888,068)	
減：提列特別盈餘公積	(281,293)	
截至民國一〇二年底可分配保留盈餘	NT\$1,029,854,328	
分派項目：		
減：普通股現金股利（每股新台幣0.55元）	(130,021,040)	
期末未分配盈餘	NT\$899,833,288	

附註：

- 1.已扣除配發員工現金紅利新台幣 38,956,697 元
- 2.已扣除配發董事及監察人酬勞新台幣 5,194,226 元。
- 3.因應民國一〇二年起採用國際財務報導準則對民國一〇一年十二月三十一日可分配保留盈餘所作之追溯調整，業於民國一〇二年一月一日減少可分配保留盈餘新台幣 21,093,780 元。另，本公司依據金管證發字第 1010012865 號函說明二（一）規定，無應提列之特別盈餘公積。

董事長：關欣



經理人：關欣



會計主管：林恕敏



精材科技股份有限公司

財務報告暨會計師查核報告
民國 102 及 101 年度

地址：桃園縣中壢市中壢工業區吉林路23號9樓

電話：(03)4331818

會計師查核報告

精材科技股份有限公司 公鑒：

精材科技股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日暨 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之資產負債表，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表與現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達精材科技股份有限公司民國 102 年 12 月 31 日暨 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日之財務狀況，暨民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

精材科技股份有限公司民國 102 年度財務報告重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師意見，該等明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信聯合會計師事務所
會計師 林 鴻 鵬

林 鴻 鵬



會計師 黃 裕 峰

黃 裕 峰



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國 103 年 3 月 6 日

精材科技股份有限公司

資 產 負 債 表

民國 102 年 12 月 31 日暨 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	102 年 12 月 31 日		101 年 12 月 31 日		101 年 1 月 1 日		代 碼	負 債 及 權 益	102 年 12 月 31 日		101 年 12 月 31 日		101 年 1 月 1 日	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%			金 額	%	金 額	%	金 額	%
	流動資產								流動負債						
1100	現金及約當現金（附註六）	\$1,031,142	12	\$ 770,750	13	\$ 675,441	11	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債						
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）	172	-	504	-	223	-	2125	避險之衍生金融負債（附註八）	\$ 7,235	-	\$ 55	-	\$ 1,666	-
1170	應收票據及帳款淨額（附註九）	235,348	3	178,294	3	214,021	3	2170	應付帳款（附註三一）	243,857	3	155,760	3	156,073	2
1180	應收關係人款項（附註三一）	516,431	6	239,621	4	258,659	4	2201	應付薪資及獎金	147,858	2	115,288	2	108,429	2
1210	其他應收關係人款項（附註三一）	141,190	2	-	-	19,686	-	2206	應付員工紅利及董監酬勞（附註十九）	43,161	1	-	-	20,666	-
1310	存貨（附註五及十）	216,770	2	149,449	2	151,975	2	2213	應付工程及設備款（附註三一）	305,961	4	192,214	3	310,557	5
1476	其他金融資產（附註三二）	310	-	2,984	-	99	-	2230	當期所得稅負債（附註二六）	28,914	-	-	-	15,455	-
1479	其他流動資產（附註十四及三一）	70,404	1	71,516	1	48,065	1	2250	負債準備（附註五及十五）	50,640	1	31,353	-	36,033	1
11XX	流動資產合計	2,211,767	26	1,413,118	23	1,368,169	21	2399	存入保證金（附註十六）	1,016,977	12	-	-	-	-
	非流動資產							2399	應付費用及其他流動負債（附註三一）	267,440	3	184,684	3	244,981	4
1543	以成本衡量之金融資產（附註十一）	-	-	-	-	-	-	2320	一年內到期之長期銀行借款（附註十七）	196,875	2	128,125	2	62,500	1
1600	不動產、廠房及設備（附註五、十二及三二）	6,026,007	72	4,453,092	74	4,980,991	76	21XX	流動負債合計	2,309,199	28	807,479	13	956,592	15
1780	無形資產（附註十三）	71,694	1	82,535	2	99,900	2		非流動負債						
1840	遞延所得稅資產（附註五及二六）	44,139	1	73,942	1	55,456	1	2541	長期銀行借款（附註十七及三二）	1,912,500	23	1,359,375	23	1,587,500	25
1920	存出保證金	8,550	-	8,269	-	7,776	-	2550	負債準備（附註十五）	24,536	-	24,536	-	24,536	-
15XX	非流動資產合計	6,150,390	74	4,617,838	77	5,144,123	79	2640	應計退休金負債（附註十八）	506	-	3,933	-	6,220	-
								25XX	非流動負債合計	1,937,542	23	1,387,844	23	1,618,256	25
								2XXX	負債合計	4,246,741	51	2,195,323	36	2,574,848	40
									權 益						
									股本（附註十九）						
								3110	普通股股本	2,364,018	28	2,362,079	39	2,335,811	36
								3200	資本公積（附註十九）	524,855	6	513,458	9	505,177	7
									保留盈餘（附註十九）						
								3310	法定盈餘公積	167,800	2	167,800	3	154,358	2
								3320	特別盈餘公積	-	-	232	-	814	-
								3350	未分配盈餘	1,059,024	13	792,064	13	941,516	15
								3300	保留盈餘合計	1,226,824	15	960,096	16	1,096,688	17
								3400	其他權益（附註十九）	(281)	-	-	-	(232)	-
								3XXX	權益合計	4,115,416	49	3,835,633	64	3,937,444	60
1XXX	資 產 總 計	\$8,362,157	100	\$6,030,956	100	\$6,512,292	100		負 債 與 權 益 總 計	\$8,362,157	100	\$6,030,956	100	\$6,512,292	100

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：

經理人：

會計主管：

精材科技股份有限公司

綜 合 損 益 表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟每股
盈餘（淨損）為元

代 碼		102年度		101年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註五、二一及三一）	\$ 4,256,761	100	\$ 3,139,385	100
5000	營業成本（附註十、二八及三一）	<u>3,561,619</u>	<u>84</u>	<u>2,889,533</u>	<u>92</u>
5950	營業毛利	<u>695,142</u>	<u>16</u>	<u>249,852</u>	<u>8</u>
	營業費用（附註二八及三一）				
6100	行銷費用	38,049	1	34,305	1
6200	管理費用	110,494	2	90,558	3
6300	研究發展費用	<u>216,971</u>	<u>5</u>	<u>206,117</u>	<u>7</u>
6000	合 計	<u>365,514</u>	<u>8</u>	<u>330,980</u>	<u>11</u>
6500	其他營業收益及費損淨額（附註二二）	<u>51,008</u>	<u>1</u>	(<u>15,112</u>)	<u>-</u>
6900	營業淨利（淨損）	<u>380,636</u>	<u>9</u>	(<u>96,240</u>)	(<u>3</u>)
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二三）	4,575	-	4,194	-
7050	財務成本（附註二四）	(28,158)	(1)	(13,406)	-
7020	其他利益及損失（附註二五）	(<u>8,290</u>)	<u>-</u>	(<u>2,317</u>)	<u>-</u>
7000	合 計	(<u>31,873</u>)	(<u>1</u>)	(<u>11,529</u>)	<u>-</u>
7900	稅前淨利（淨損）	348,763	8	(107,769)	(3)
7950	所得稅利益（費用）（附註二六）	(<u>59,882</u>)	(<u>1</u>)	<u>17,564</u>	<u>-</u>
8200	本年度淨利（淨損）	<u>288,881</u>	<u>7</u>	(<u>90,205</u>)	(<u>3</u>)

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		102年度		101年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8330	現金流量避險（附註十九）	(\$ 281)	-	\$ 232	-
8360	確定福利之精算利益（附註十八）	<u>1,469</u>	<u>-</u>	<u>339</u>	<u>-</u>
8300	本年度其他綜合損益	<u>1,188</u>	<u>-</u>	<u>571</u>	<u>-</u>
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 290,069</u>	<u>7</u>	<u>(\$ 89,634)</u>	<u>(3)</u>
	每股盈餘(淨損)(附註二七)				
9750	基本每股盈餘（淨損）	<u>\$ 1.22</u>		<u>(\$ 0.38)</u>	
9850	稀釋每股盈餘（淨損）	<u>\$ 1.21</u>		<u>(\$ 0.38)</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



精材科技股份有限公司

權益變動表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		股 股 數 (仟 股)	本 金 額	資 本 公 積	保 法 定 盈 餘 公 積	留 特 別 盈 餘 公 積	盈 未 分 配 盈 餘	餘 保 留 盈 餘 合 計	其 他 權 益 項 目 現 金 流 量 避 險	權 益 合 計
A1	101 年 1 月 1 日 餘 額	233,581	\$ 2,335,811	\$ 505,177	\$ 154,358	\$ 814	\$ 941,516	\$ 1,096,688	(\$ 232)	\$ 3,937,444
	100 年度盈餘分配									
B1	法定盈餘公積	-	-	-	13,442	-	(13,442)	-	-	-
B17	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(582)	582	-	-	-
B5	股東現金股利－每股 0.10 元	-	-	-	-	-	(23,363)	(23,363)	-	(23,363)
B9	股東股票股利－每股 0.10 元	2,336	23,363	-	-	-	(23,363)	(23,363)	-	-
	盈餘分配合計	2,336	23,363	-	13,442	(582)	(59,586)	(46,726)	-	(23,363)
D1	101 年度淨損	-	-	-	-	-	(90,205)	(90,205)	-	(90,205)
D3	101 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	339	339	232	571
D5	101 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	(89,866)	(89,866)	232	(89,634)
N1	員工執行認股權	291	2,905	2,062	-	-	-	-	-	4,967
N1	認列員工認股權酬勞成本	-	-	6,219	-	-	-	-	-	6,219
Z1	101 年 12 月 31 日 餘 額	236,208	2,362,079	513,458	167,800	232	792,064	960,096	-	3,835,633
	101 年度盈餘分配									
B17	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(232)	232	-	-	-
B5	股東現金股利－每股 0.10 元	-	-	-	-	-	(23,622)	(23,622)	-	(23,622)
	盈餘分配合計	-	-	-	-	(232)	(23,390)	(23,622)	-	(23,622)
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	-	288,881	288,881	-	288,881
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	1,469	1,469	(281)	1,188
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	290,350	290,350	(281)	290,069
N1	員工執行認股權	194	1,939	864	-	-	-	-	-	2,803
N1	認列員工認股權酬勞成本	-	-	10,533	-	-	-	-	-	10,533
Z1	102 年 12 月 31 日 餘 額	236,402	\$ 2,364,018	\$ 524,855	\$ 167,800	\$ -	\$ 1,059,024	\$ 1,226,824	(\$ 281)	\$ 4,115,416

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



精材科技股份有限公司

現金流量表

民國 102 年及 101 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		102 年度	101 年度
	營業活動之現金流量：		
A10000	稅前淨利（淨損）	\$ 348,763	(\$ 107,769)
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	869,000	727,206
A20200	攤銷費用	33,976	38,801
A20300	備抵呆帳迴轉數	(3,157)	(4)
A20900	財務成本	28,158	13,406
A21200	利息收入	(4,575)	(4,194)
A21900	員工認股權酬勞成本	10,533	6,219
A22500	處分不動產、廠房及設備淨益	(2,670)	(2,107)
A23700	提列不動產、廠房及設備減損損失	3,804	26,175
A24100	外幣兌換淨損（益）	642	(2,936)
A30000	營業資產及負債之淨變動數：		
A31110	衍生金融工具	7,512	(1,892)
A31150	應收票據及帳款淨額	(53,897)	35,731
A31160	應收關係人款項	(276,810)	19,038
A31190	其他應收關係人款項	(141,190)	19,686
A31200	存 貨	(67,321)	2,526
A31240	其他流動資產	2,070	(22,954)
A31250	其他金融資產	331	(630)
A32150	應付帳款	88,097	(313)
A32180	應付薪資及獎金	32,570	6,859
A32200	負債準備	19,287	(4,680)
A32230	存入保證金	1,016,977	-
A32230	應付費用及其他流動負債	82,127	(61,010)
A32240	應計退休金負債	(1,958)	(1,948)
A32990	應付員工紅利及董監酬勞	43,161	(20,666)
A33000	營運產生之現金	2,035,430	664,544
A33500	支付所得稅	(1,165)	(16,786)
AAAA	營業活動之淨現金流入	2,034,265	647,758

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		102 年度	101 年度
	投資活動之現金流量：		
B02700	購置不動產、廠房及設備	(\$ 2,334,007)	(\$ 393,281)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	4,063	54,499
B03700	存出保證金增加	(688)	(878)
B03800	存出保證金減少	407	385
B04500	購置無形資產	(23,135)	(21,436)
B06600	質押銀行存款減少(增加)	2,255	(2,255)
B07500	收取之利息	<u>4,663</u>	<u>4,106</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>2,346,442</u>)	(<u>358,860</u>)
	籌資活動之現金流量：		
C01600	舉借長期借款	1,620,000	50,000
C01700	償還長期借款	(998,125)	(212,500)
C04500	發放現金股利	(23,622)	(23,363)
C04800	員工行使認股權發行新股	2,803	4,967
C05600	支付之利息	(<u>28,487</u>)	(<u>12,693</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(出)	<u>572,569</u>	(<u>193,589</u>)
EEEE	現金及約當現金淨增加數	260,392	95,309
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>770,750</u>	<u>675,441</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,031,142</u>	<u>\$ 770,750</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



精材科技股份有限公司

財務報表附註

民國 102 及 101 年度

(除另予註明者外，金額以新台幣仟元為單位)

一、公司沿革

精材科技股份有限公司（以下簡稱本公司）於 87 年 9 月 11 日經經濟部核准設立，主要營業項目為晶圓級晶方尺寸之封裝業務。本公司股票自 93 年 9 月 8 日起經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准，並於該中心之興櫃股票櫃檯買賣。本公司註冊地及業務主要營運據點為桃園縣中壢市中壢工業區吉林路 23 號 9 樓。

本公司之母公司原為台灣積體電路製造股份有限公司（以下簡稱台積公司），於 102 年 6 月起對本公司之財務及營運政策不具控制力，故對本公司改採權益法評價。

二、通過財務報告之日期及程序

本財務報告業已於 103 年 3 月 6 日經本公司董事會核准並通過發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

(一) 已發布但尚未生效之新發布／修正／修訂準則及解釋

本公司未適用下列業經國際會計準則理事會（IASB）發布之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告。依據金融監督管理委員會（以下稱「金管會」）於 103 年 1 月 28 日宣布之「我國全面升級採用國際財務報導準則版本之推動架構」，上市上櫃公司及興櫃公司應自 104 年起由金管會認可之 2010 年版國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告（以下稱「IFRSs」）升級至 2013 年版 IFRSs（不含 IFRS 9「金融工具」）。截至本財務報告通過發布日止，金管會尚未認可下列歸屬於 2013 年版 IFRSs 之新發布／修正／修訂準則及解釋，且尚未發布非屬 2013 年版 IFRSs 之新發布／修正／修訂準則及解釋生效日。

新 發 布 / 修 正 / 修 訂 準 則 及 解 釋	IASB 發布之生效日 (註 1)
已納入 2013 年版 IFRSs	
國際財務報導準則之修正「國際財務報導準則之改善—對國際會計準則第 39 號之修正 (2009 年)」	2009 年 1 月 1 日或 2010 年 1 月 1 日
國際會計準則第 39 號之修正「嵌入式衍生工具」	於 2009 年 6 月 30 日 以後結束之年度 期間生效
「國際財務報導準則之改善 (2010 年)」	2010 年 7 月 1 日或 2011 年 1 月 1 日
「2009 年-2011 年週期之國際財務報導準則年度改善」	2013 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 1 號之修正「國際財務報導準則第 7 號之比較揭露對首次採用者之有限度豁免」	2010 年 7 月 1 日
國際財務報導準則第 1 號之修正「嚴重高度通貨膨脹及首次採用者固定日期之移除」	2011 年 7 月 1 日
國際財務報導準則第 1 號之修正「政府貸款」	2013 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 7 號之修正「揭露—金融資產及金融負債互抵」	2013 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 7 號之修正「揭露—金融資產之移轉」	2011 年 7 月 1 日
國際財務報導準則第 10 號「合併財務報表」	2013 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 11 號「聯合協議」	2013 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 12 號「對其他個體權益之揭露」	2013 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 10 號、第 11 號及第 12 號之修正「合併財務報表、聯合協議及對其他個體權益之揭露：過渡規定指引」	2013 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 10 號、第 12 號及國際會計準則第 27 號之修正「投資個體」	2014 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 13 號「公允價值衡量」	2013 年 1 月 1 日
國際會計準則第 1 號之修正「其他綜合損益項目之表達」	2012 年 7 月 1 日
國際會計準則第 12 號之修正「遞延所得稅：標的資產之回收」	2012 年 1 月 1 日
國際會計準則第 19 號之修正「員工福利」	2013 年 1 月 1 日
國際會計準則第 27 號之修正「單獨財務報表」	2013 年 1 月 1 日
國際會計準則第 28 號之修正「投資關聯企業及合資」	2013 年 1 月 1 日
國際會計準則第 32 號之修正「金融資產及金融負債互抵」	2014 年 1 月 1 日
國際財務報導解釋第 20 號「露天礦場於生產階段之剝除成本」	2013 年 1 月 1 日

(接 次 頁)

(承前頁)

新發布／修正／修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日 (註 1)
<u>未納入 2013 年版 IFRSs</u>	
「2010 年-2012 年週期之國際財務報導準則年度改善」	2014 年 7 月 1 日 (註 2)
「2011 年-2013 年週期之國際財務報導準則年度改善」	2014 年 7 月 1 日
國際財務報導準則第 9 號「金融工具」	尚未發布
國際財務報導準則第 9 號及第 7 號之修正「強制生效日及過渡揭露」	尚未發布
國際財務報導準則第 14 號「管制遞延帳戶」	2016 年 1 月 1 日
國際會計準則第 19 號之修正「確定福利計畫：員工提撥」	2014 年 7 月 1 日
國際會計準則第 36 號之修正「非金融資產可回收金額之揭露」	2014 年 1 月 1 日
國際會計準則第 39 號之修正「衍生工具之合約更替及避險會計之繼續」	2014 年 1 月 1 日
國際財務報導解釋第 21 號「徵收款」	2014 年 1 月 1 日

註 1：除另註明外，上述新發布／修正／修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度期間生效。

註 2：給與日於 2014 年 7 月 1 日以後之股份基礎給付交易開始適用 IFRS 2 之修正；收購日於 2014 年 7 月 1 日以後之企業合併開始適用 IFRS 3 之修正；IFRS 13 於修正時即生效。其餘修正係適用於 2014 年 7 月 1 日以後開始之年度期間。

(二) 已發布但尚未生效之新發布／修正／修訂準則及解釋造成之會計政策重大變動說明

本公司認為除下列各項外，適用上述準則及解釋將不致對本公司會計政策造成重大變動：

1. 國際財務報導準則第 9 號「金融工具」

所有屬於國際會計準則第 39 號「金融工具：認列與衡量」範圍內之金融資產後續衡量係以攤銷後成本衡量或以公允價值衡量。若本公司係以收取合約現金流量為目的而持有金融資產之經營模式下持有，且其合約現金流量完全為支付本金及流通在外本金金額之利息，則該金融資產係以攤銷後成本衡量。所有其他金融資產係以報導期間結束日之公允價值衡量。

國際財務報導準則第 9 號在一般避險會計之主要改變，係調整避險會計之適用條件，以使適用避險會計之財務報表更能反映企業實際進行之風險管理活動。與國際會計準則第 39 號相較，其主要修正內容包括：(1)增加可適用避險會計之交易型態，例如放寬非財務風險適用避險會計之條件；(2)修改避險衍生工具之損益認列方式，以減緩損益波動程度；及(3)避險有效性方面，以避險工具與被避險項目間之經濟關係取代實際有效性測試。

國際財務報導準則第 9 號刪除原訂自 2015 年 1 月 1 日以後開始之年度期間生效之規定，待完成新減損模式及分類與衡量之有限度修正後，將予以重新考量適當之生效日。

2. 國際財務報導準則第 13 號「公允價值衡量」

國際財務報導準則第 13 號「公允價值衡量」提供公允價值衡量指引，該準則定義公允價值、建立衡量公允價值之架構，並規定公允價值衡量之揭露。此外，該準則規定之揭露內容較現行準則更為廣泛，例如，現行準則僅要求以公允價值衡量之金融工具須按公允價值三層級揭露，依照國際財務報導準則第 13 號「公允價值衡量」規定，適用該準則之所有資產及負債皆須提供前述揭露。

3. 修正國際會計準則第 1 號「財務報表之表達」－其他綜合損益項目之表達

國際會計準則第 1 號修正其他綜合損益之表達方式，規定列示於其他綜合損益之項目應依據後續是否可能重分類至損益予以分組（即按照後續可能重分類至損益之項目及後續不可能重分類至損益之項目分組）。該修正同時規定以稅前金額列示之其他綜合損益項目，其相關稅額應隨前述兩分組類別予以單獨列示。本公司預期上述修正將改變本公司綜合損益表之表達方式。

4. 修訂國際會計準則第 19 號「員工福利」

國際會計準則第 19 號「員工福利」修訂內容包括要求認列淨確定給付負債（資產）之變動數、拆分確定給付成本之組成部分、刪除精算損益得採「緩衝區法」之會計政策選擇並規定精算損益應於發生時列入其他綜合損益，以及前期服務成本應於發生時認列為損益，不再於符合既得條件前之平均期間內按直線法分攤認列為費用。此外，該修訂同時增加確定給付計畫之揭露。

5. 修訂國際會計準則第 36 號「非金融資產可回收金額之揭露」之修正

本次國際會計準則第 36 號之修正係釐清本公司僅須於認列或迴轉減損損失當年度揭露該等可回收金額。此外，若可回收金額係以現值法計算之公允價值減處分成本衡量，則須增加揭露所採用之折現率。本公司預期上述修正將使本公司增加有關非金融資產可回收金額之揭露。

(三) 尚未生效之新發布／修正／修訂準則及解釋對本公司財務報表影響之說明

截至本財務報告通過發布日止，本公司仍持續評估上述準則及解釋對財務狀況與經營結果之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

依據金管會於 98 年 5 月 14 日宣布之「我國企業採用國際會計準則推動架構」，上市上櫃公司及興櫃公司應自 102 年起依證券發行人財務報告編製準則暨經金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告（以下稱「IFRSs」）編製財務報告。

本公司 102 年度財務報告係為首份 IFRSs 年度財務報告。本公司轉換至 IFRSs 日（轉換日）為 101 年 1 月 1 日。轉換至 IFRSs 對本公司財務報告之影響說明，係列於附註三七。

本公司之重大會計政策彙總說明如下：

(一) 遵循聲明

本財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製。

(二) 編製基礎

除按公允價值衡量之金融工具外，本財務報告係依歷史成本基礎編製。歷史成本通常係依取得資產所支付對價之公允價值決定。

本公司於轉換日之初始資產負債表係依據國際財務報導準則第1號「首次採用國際財務報導準則」之規定認列與衡量，除該準則所規定禁止追溯適用部分 IFRSs 之規定，以及對部分 IFRSs 之規定給予豁免選擇外（本公司之豁免選擇參閱附註三七），本公司係追溯適用 IFRSs 之規定。

(三) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括預期於資產負債表日後 12 個月內變現或耗用之資產，資產不屬於流動資產者為非流動資產。流動負債為須於資產負債表日後 12 個月內清償之負債，負債不屬於流動負債者為非流動負債。

(四) 外 幣

編製財務報告時，以功能性貨幣以外之貨幣（外幣）交易者，係按交易日匯率予以換算認列。於報導期間結束日時，外幣貨幣性項目以該日即期匯率重新換算，兌換差額於發生當年度認列為損益；以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目，按決定公允價值當日之匯率重新換算，所產生之兌換差額列為當年度損益；以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目則不予重新換算。

(五) 約當現金

約當現金係可隨時轉換成定額現金，且價值變動甚小之短期並具高度流動性之投資。

(六) 存 貨

存貨包括原物料、在製品及製成品。存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項

目為基礎。淨變現價值係指在正常情況之下估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。存貨成本之計算採加權平均法。

(七) 不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備係以成本減累計折舊及累計減損衡量。成本包括可直接歸屬於取得或建置資產之增額成本。直接可歸屬於取得、建造或生產符合要件之資產之借款成本，係作為該資產成本之一部分，直到該資產幾乎已達預定使用或出售狀態為止。除上述者外，所有其他借款成本係於發生當年度認列為損益。

建造過程中之不動產、廠房及設備係以成本減除累計減損後之金額認列。該等資產於完工並達預期使用狀態時，分類至不動產、廠房及設備之適當類別並開始提列折舊。

折舊係採直線法提列，於資產耐用年限內沖銷其成本減除殘值後之金額。折舊係按下列耐用年數計提：房屋及建築，3 至 35 年；機器設備，3 至 8 年；辦公設備，3 至 11 年；租賃改良，3 至 16 年；其他設備，3 至 11 年。估計耐用年限、殘值及折舊方法於報導期間結束日進行檢視，任何估計變動之影響係推延適用，土地不提列折舊。

於處分或預期無法由使用或處分產生未來經濟效益時，將不動產、廠房及設備予以除列。除列不動產、廠房及設備所產生之利益或損失，係處分價款與該資產帳面金額兩者間之差額，並認列於當年度損益。

(八) 無形資產

單獨取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量，後續係以成本減除累計攤銷及累計減損衡量。攤銷金額係依直線法按下列耐用年數計提：專門技術，20 年；電腦軟體成本，3 年；其他，2 至 6 年。估計耐用年限及攤銷方法於報導期間結束日進行檢視，任何估計變動之影響係推延適用。

研究階段之支出於發生時認列為費用；發展階段之支出於符合規定條件時，認列為無形資產，採用直線法依其耐用年限分年攤銷，不符合規定條件之支出則列為當年度費用。

(九) 有形及無形資產之減損

本公司於報導期間結束日檢視有形及無形資產之帳面金額以決定該等資產是否有減損跡象。若顯示有減損跡象，則估計資產之可回收金額以決定應認列之減損金額。倘無法估計個別資產之可回收金額，則本公司估計該項資產所屬現金產生單位之可回收金額。若可按合理基礎分攤時，共用資產亦分攤至個別之現金產生單位，反之，則分攤至按可依合理基礎分攤之最小現金產生單位群組。

可回收金額為公允價值減出售成本與其使用價值較高者。評估使用價值時，係將估計未來現金流量以稅前折現率加以折現，該折現率係反映現時市場對貨幣時間價值及尚未用以調整未來現金流量估計數之資產特定風險之評估。

個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於帳面金額時，該資產或現金產生單位之帳面金額調減至其可回收金額，減損損失立即認列於當年度損失。

當減損損失於後續期間迴轉時，該個別資產或現金產生單位之帳面金額則調增至修正後之估計可回收金額，惟增加後之帳面金額以不超過該資產或現金產生單位在未認列減損損失之情況下應有之帳面金額為限。迴轉之減損損失係立即認列於當年度損益。

(十) 金融工具

金融資產與金融負債於本公司成為該金融工具合約條款之一方時認列。

原始認列金融資產與金融負債時，若金融資產或金融負債非屬透過損益按公允價值衡量者，係按公允價值加計直接可歸屬於取得或發行金融資產或金融負債之交易成本衡量。直接可歸屬於取得或發行透過損益按公允價值衡量之金融資產及金融負債之交易成本，則立即認列為損益。

(十一) 金融資產

本公司持有之金融資產係分為透過損益按公允價值衡量之金融資產、備供出售金融資產與放款及應收款等。該分類係於金融資產原始認列時視其性質及目的而決定。所有慣例交易金融資產之認列與除列，採交易日會計處理。慣例交易係指金融資產之購買或出售，其交付期間係在因法規或市場慣例所訂之期間內者。

1. 透過損益按公允價值衡量之金融資產

係未能符合避險會計條件之衍生金融工具，以公允價值衡量，任何因再衡量產生之利益或損失係認列為損益。

2. 備供出售金融資產

備供出售金融資產係非衍生金融資產被指定為備供出售，或未被分類為放款及應收款、持有至到期日金融資產及透過損益按公允價值衡量之金融資產。

備供出售金融資產若屬無活絡市場公開報價且公允價值無法可靠衡量之權益工具投資，係以成本減除減損損失衡量，並單獨列為「以成本衡量之金融資產」。該等金融資產於後續能可靠衡量公允價值時，係按公允價值再衡量，其帳面金額與公允價值間之差額認列於其他綜合損益，若有減損時，則認列於損益。

3. 放款及應收款

放款及應收款係指無活絡市場公開報價，且具固定或可決定付款金額之非衍生金融資產。放款及應收款主要包括現金及約當現金、應收票據及帳款（含關係人）及其他應收款項，係按有效利息法按攤銷後成本減除減損損失後衡量，惟短期應收款項之折現效果不具重大性者除外。

4. 金融資產減損

除透過損益按公允價值衡量之金融資產外，本公司於報導期間結束日評估其他金融資產是否有減損跡象，當有客觀證據顯示，因金融資產原始認列後發生之單一或多項事件，致使金

融資產之估計未來現金流量受影響者，該金融資產則視為已減損。

以攤銷後成本衡量之金融資產，如應收帳款，該資產若經個別評估未有客觀減損，另再以組合基礎來評估減損。本公司係依據對客戶之應收帳款帳齡分析及客戶評等分析等因素，定期評估應收帳款之收回可能性。

以成本衡量之金融資產之減損損失金額係該資產帳面金額與估計未來現金流量按類似金融資產之現時市場報酬率折現之現值間之差額。此種減損損失於後續期間不得迴轉。

所有金融資產之減損損失係直接自金融資產之帳面金額中扣除，惟應收帳款係藉由備抵帳戶調降其帳面金額。當應收帳款視為無法回收時，係沖銷備抵帳戶。原先已沖銷而後續回收之款項係貸記備抵帳戶。

5. 金融資產之除列

本公司僅於對來自該資產現金流量之合約權利失效，或已移轉金融資產且該資產所有權幾乎所有之風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

除列一金融資產之整體時，其帳面金額與已收取或可收取對價總額加計已認列於其他綜合損益之任何累計利益或損失之總和間之差額係認列於損益。

(十二) 金融負債及權益工具

1. 金融負債或權益工具之分類

本公司發行之債務及權益工具係依據合約協議之實質與金融負債及權益工具之定義分類為金融負債或權益。

2. 權益工具

權益工具係指表彰本公司於資產減除其所有負債後剩餘權益之任何合約。本公司發行之權益工具係以取得之價款扣除直接發行成本後之金額認列。

3. 金融負債

金融負債係按有效利息法計算之攤銷後成本或透過損益按公允價值作後續衡量。

透過損益按公允價值衡量之金融負債係未能符合避險會計要件之衍生金融工具，以公允價值衡量，任何因再衡量產生之利益或損失係認列為損益。

金融負債非屬持有供交易目的且未指定為透過損益按公允價值衡量者，於後續報導期間結束日係按攤銷後成本衡量。

4. 金融負債之除列

本公司僅於義務解除、取消或到期時，始將金融負債除列。除列金融負債時，其帳面金額與所支付或應支付對價總額之差額認列為損益。

(十三) 衍生金融工具

本公司簽訂遠期外匯及利率交換合約等衍生金融工具，以管理相關匯率及利率波動所產生之風險。

衍生金融工具於原始認列時以公允價值認列，後續於報導期間結束日按公允價值重新衡量，後續衡量產生之利益或損失直接列入損益，然指定且為有效避險工具之衍生工具，其認列於損益之時點則將視避險關係之性質而定。

指定且符合現金流量避險之衍生金融工具，其公允價值變動屬於有效避險部分係認列於其他綜合損益並累計列入其他權益項目之現金流量避險。當被避險項目認列於損益時，原先認列於其他綜合損益並累計列入其他權益項目之現金流量避險之金額將重分類至損益。

(十四) 負債準備

本公司因過去事件負有現時義務（法定或推定義務），且很有可能須清償該義務，並對該義務金額能可靠估計時，認列負債準備。

認列為負債準備之金額係考量義務之風險及不確定性，而為報導期間結束日清償義務所須支出之最佳估計。若負債準備係以清償

該現時義務之估計現金流量衡量，其帳面金額係為該等現金流量之現值。

(十五) 收入認列

收入係按已收或應收對價之公允價值衡量，並扣除估計之客戶退貨、折扣及其他類似之折讓。

1. 商品之銷售

銷售商品係於下列條件完全滿足時認列收入：(1)本公司已經將商品所有權之重大風險及報酬移轉予買方；(2)本公司對於已經出售之商品既不持續參與管理，亦未維持有效控制；(3)收入金額能可靠衡量；(4)與交易有關之經濟效益很有可能流入本公司；及(5)與交易有關之已發生或將發生之成本能可靠衡量。

2. 利息收入

金融資產之利息收入係於經濟效益很有可能流入本公司，且收入金額能可靠衡量時認列。利息收入係依時間之經過按流通在外本金與所適用之有效利率採應計基礎認列。

(十六) 租賃

當租賃條款係移轉附屬於資產所有權之幾乎所有風險與報酬予承租人時，則將其分類為融資租賃；所有其他租賃則分類為營業租賃。

營業租賃之租賃收入係按直線基礎於租賃期間內認列為收入。

營業租賃給付係按直線基礎於租賃期間認列為費用。

(十七) 退職後福利

屬確定提撥退休福利計畫者，係於員工提供服務期間，就應提撥之數額認列為當期費用；屬確定福利退休計畫者，則按精算結果認列退休福利成本。

在確定福利退休計畫下，提供退休福利之成本係使用預計單位福利法決定，並於報導期間結束日進行精算評價。精算損益係於發生年度立即全數認列為其他綜合損益。

(十八) 股份基礎給付協議

本公司對於轉換日前已既得之員工認股權，選擇適用國際財務報導準則第 1 號「首次採用國際財務報導準則」之豁免，相關說明請參閱附註三七、(二)之說明。

本公司於 101 年 1 月 1 日後給與之員工認股權，係以給與日員工認股權之公允價值衡量。員工認股權係按給與日所決定之公允價值及預期既得員工認股權之最佳估計數量，於既得期間內以直線基礎認列費用，並同時調整資本公積－員工認股權。後續資訊顯示預期既得之認股權數量與估計不同時，則修正原估計數。

本公司給與之現金交割股份基礎給付協議，係認列為取得商品或勞務所產生之負債，並以所承擔負債之公允價值作為原始衡量。該負債係於清償前之每一資產負債表日及清償日再衡量其公允價值，並將公允價值變動認列為損益。

(十九) 稅 捐

所得稅係當年度應付所得稅及遞延所得稅之總和。

1. 當年度所得稅

依所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵 10%所得稅列為股東會決議年度之所得稅費用。

以前年度應付所得稅之調整，列入當年度所得稅。

2. 遞延所得稅

遞延所得稅係依帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算予以認列。遞延所得稅負債一般係就所有未來應課稅暫時性差異予以認列；遞延所得稅資產則係於未來很可能有課稅所得供可減除暫時性差異、虧損扣抵或購置機器設備、研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減使用時認列。

遞延所得稅資產之帳面金額於報導期間結束日予以重新檢視，並針對已不再很可能有足夠之課稅所得以供其回收所有或部分資產者予以調整減少。原未認列為遞延所得稅資產者，

亦於報導期間結束日予以重新檢視，並在未來很有可能產生課稅所得以供其回收所有或部分資產者予以調整認列。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當年度之稅率衡量，該稅率係以報導期間結束日已立法或已實質性立法之稅率及稅法為基礎。遞延所得稅負債及資產之衡量係反映企業於報導期間結束日預期回收或清償其資產及負債帳面金額之方式所產生之租稅效果。

3. 當年度及遞延所得稅

當年度及遞延所得稅係認列於損益，惟與認列於其他綜合損益或直接計入權益之項目相關之當年度及遞延所得稅係分別認列於其他綜合損益或直接計入權益。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本公司於採用附註四所述之會計政策時，對於不易自其他來源取得有關資產及負債帳面金額之資訊作出相關之判斷、估計及假設。估計及相關假設係基於歷史經驗及其他視為攸關之因素，實際結果可能與估計有所不同。

估計與基本假設係持續予以檢視。若估計之修正僅影響當年度，則於會計估計修正當年度認列。若會計估計之修正同時影響當年度及未來年度，則於估計修正當年度及未來年度認列。

以下係有關未來所作主要假設及估計之資訊，以及於財務報導結束日估計不確定性之主要來源，該等假設及估計具有導致資產及負債帳面金額於下一財務年度重大調整之風險。

(一) 收入認列

商品銷售收入原則上係於獲利過程完成時認列，其條件如附註四、(十五)所述。相關退貨及折讓負債準備係依歷史經驗及其他已知原因估計可能發生之產品退回及折讓，於產品出售當年度列為商品銷售收入之減項，且管理階層定期檢視估計之合理性。

(二) 不動產、廠房及設備之減損評估

資產減損評估過程中，本公司需依賴主觀判斷並依據資產使用模式及產業特性，決定特定資產群組之獨立現金流量、資產耐用年

數及未來可能產生之收益與費損，任何由於經濟狀況之變遷或公司策略所帶來之估計改變均可能在未來造成重大減損。

(三) 遞延所得稅資產之可實現性

遞延所得稅資產係於未來很有可能有足夠之課稅所得供可減除暫時性差異使用時方予以認列。評估遞延所得稅資產之可實現性時，必須涉及管理階層之重大會計判斷及估計，包含預期未來銷貨收入成長及利潤率、免稅期間、可使用之所得稅抵減及稅務規劃等假設。任何關於全球經濟環境、產業環境變遷及法令之改變，均可能引起遞延所得稅資產之重大調整。

(四) 存貨之評價

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低者計價，故本公司必須運用判斷及估計決定報導期間結束日存貨之淨變現價值。

由於科技快速變遷，本公司評估報導期間結束日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎，故可能產生重大變動。

六、現金及約當現金

	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
現金及銀行存款	\$ 736,242	\$ 770,750	\$ 635,441
附買回條件公司債	294,900	-	-
附買回條件政府公債	-	-	40,000
	<u>\$ 1,031,142</u>	<u>\$ 770,750</u>	<u>\$ 675,441</u>

七、透過損益按公允價值衡量之金融資產及金融負債

	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
衍生金融資產			
遠期外匯合約	<u>\$ 172</u>	<u>\$ 504</u>	<u>\$ 223</u>
衍生金融負債			
遠期外匯合約	<u>\$ 7,235</u>	<u>\$ 55</u>	<u>\$ 1,666</u>

本公司從事衍生金融工具交易之目的，主要係為規避因匯率波動所產生之風險。本公司上述之衍生金融工具因不符合有效避險條件，故不適用避險會計。

本公司尚未到期之遠期外匯合約如下：

	到 期 期 間	合 約 金 額 (仟 元)
<u>102 年 12 月 31 日</u>		
Sell USD/ Buy NTD	103 年 1 月~103 年 2 月	USD 24,210/ NTD 714,395
<u>101 年 12 月 31 日</u>		
Sell USD/ Buy NTD	102 年 1 月~102 年 3 月	USD 13,700/ NTD 398,239
<u>101 年 1 月 1 日</u>		
Sell USD/ Buy NTD	101 年 1 月~101 年 2 月	USD 16,900/ NTD 510,122

八、避險之衍生金融工具

	<u>102年12月31日</u>	<u>101年12月31日</u>	<u>101年1月1日</u>
<u>金融負債－流動</u>			
現金流量避險			
利率交換合約	\$ <u>281</u>	\$ <u>-</u>	\$ <u>232</u>

本公司目前所承擔之長期銀行借款係屬浮動利率之債務，因此市場利率之變動極易造成未來現金流量之波動，故另簽訂利率交換合約以規避利率變動之現金流量風險。

本公司尚未到期之利率交換合約如下：

<u>合 約 金 額 (仟 元)</u>	<u>到 期 日</u>	<u>支 付 利 率 區 間</u>	<u>收 取 利 率 區 間</u>
<u>102 年 12 月 31 日</u>			
\$ 900,000	103 年 12 月 31 日	0.979%	0.868%~0.897%
<u>101 年 1 月 1 日</u>			
\$ 80,000	101 年 8 月 31 日	1.38%	0.625%~0.861%

本公司 102 及 101 年度因操作利率交換合約而認列於其他綜合損益並累計列入其他權益項目之金額分別為淨損 511 仟元及淨益 5 仟元；由權益重分類至當年度損失之金額分別為 230 仟元及 227 仟元，並列入綜合損益表之財務成本項下。

九、應收票據及帳款

	<u>102年12月31日</u>	<u>101年12月31日</u>	<u>101年1月1日</u>
應收票據及帳款	\$ 235,348	\$ 181,451	\$ 217,182
備抵呆帳	<u>-</u>	<u>(3,157)</u>	<u>(3,161)</u>
應收票據及帳款淨額	<u>\$ 235,348</u>	<u>\$ 178,294</u>	<u>\$ 214,021</u>

本公司對客戶之授信期間原則上為月結 30 天至 45 天，部分客戶則為發票日後 30 天，少數客戶為月結 60 天。備抵呆帳係參考帳齡分析、歷史經驗及客戶目前財務狀況分析等，以估計無法回收之金額。

除已提列減損者，其餘應收票據及帳款金額於報導期間結束日之帳齡分析請參閱下表。本公司針對已逾期但未提列減損之應收帳款，經評估其信用品質並未發生重大改變且相關帳款仍可回收，故尚無減損疑慮。

應收票據及帳款淨額之帳齡分析

	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
未逾期亦未減損	\$ 235,348	\$ 174,003	\$ 213,115
已逾期但未減損			
逾期 30 天內	-	4,162	752
逾期 31 至 60 天	-	129	-
合 計	<u>\$ 235,348</u>	<u>\$ 178,294</u>	<u>\$ 213,867</u>

備抵呆帳之變動

	102年度	101年度
年初餘額	\$ 3,157	\$ 3,161
本年度迴轉	(3,157)	(4)
年底餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3,157</u>

已減損應收帳款之帳齡

	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
逾期 30 天內	\$ -	\$ -	\$ 158
逾期 61 天以上	-	3,157	3,157
合 計	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3,157</u>	<u>\$ 3,315</u>

十、存 貨

	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
製 成 品	\$ 43,864	\$ 7,118	\$ 10,916
在 製 品	66,569	54,710	37,034
原 物 料	<u>106,337</u>	<u>87,621</u>	<u>104,025</u>
	<u>\$ 216,770</u>	<u>\$ 149,449</u>	<u>\$ 151,975</u>

本公司與存貨相關之營業成本中，分別包括下列收益及費損：

	102年度	101年度
存貨回升利益（跌價損失）	<u>\$ 977</u>	<u>(\$ 1,527)</u>
出售下腳收入	<u>\$ 7,222</u>	<u>\$ 12,389</u>

十一、以成本衡量之金融資產

本公司於 87 年投資美商坎伯狄吉有限公司（Compositech Ltd.），本公司已於 91 年下市，本公司認為其價值業已減損，已於 91 年全數認列減損損失。

十二、不動產、廠房及設備

	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
土地	\$ 772,029	\$ 772,029	\$ 753,529
房屋及建築	755,730	784,308	309,299
機器設備	3,867,828	2,184,650	2,545,464
辦公設備	13,858	17,220	15,957
租賃改良	248,043	290,786	342,978
其他設備	287,585	174,501	78,081
未完工程及待驗設備	<u>80,934</u>	<u>229,598</u>	<u>935,683</u>
	<u>\$ 6,026,007</u>	<u>\$ 4,453,092</u>	<u>\$ 4,980,991</u>

	102 年度				
	年 初 餘 額	增 加	出 售 或 報 廢	減 損 損 失	年 底 餘 額
成 本					
土地	\$ 772,029	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 772,029
房屋及建築	978,995	37,548	-	-	1,016,543
機器設備	5,603,086	2,396,814	52,023	-	7,947,877
辦公設備	82,070	2,700	129	-	84,641
租賃改良	644,624	9,320	-	-	653,944
其他設備	<u>310,447</u>	<u>149,394</u>	<u>22,558</u>	-	<u>437,283</u>
	<u>8,391,251</u>	<u>\$ 2,595,776</u>	<u>\$ 74,710</u>	<u>\$ -</u>	<u>10,912,317</u>
累積折舊及減損					
房屋及建築	194,687	\$ 66,126	\$ -	\$ -	260,813
機器設備	3,418,436	708,439	50,630	3,804	4,080,049
辦公設備	64,850	6,062	129	-	70,783
租賃改良	353,838	52,063	-	-	405,901
其他設備	<u>135,946</u>	<u>36,310</u>	<u>22,558</u>	-	<u>149,698</u>
	<u>4,167,757</u>	<u>\$ 869,000</u>	<u>\$ 73,317</u>	<u>\$ 3,804</u>	<u>4,967,244</u>
未完工程及待驗設備	<u>229,598</u>	<u>(\$ 148,664)</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>80,934</u>
	<u>\$ 4,453,092</u>				<u>\$ 6,026,007</u>

		101 年度						
		年 初 餘 額	增 加	出 售 或 報 廢	減 損 損 失	重 分 類	年 底 餘 額	
成 本								
土 地	\$	753,529	\$ 18,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 772,029	
房屋及建築		452,309	526,686	-	-	-	978,995	
機器設備		5,435,793	287,590	120,262	-	(35)	5,603,086	
辦公設備		79,515	9,177	6,657	-	35	82,070	
租賃改良		643,633	1,453	462	-	-	644,624	
其他設備		172,722	140,553	2,828	-	-	310,447	
		<u>7,537,501</u>	<u>\$ 983,959</u>	<u>\$ 130,209</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>8,391,251</u>	
累積折舊及減損								
房屋及建築		143,010	\$ 51,677	\$ -	\$ -	\$ -	194,687	
機器設備		2,890,329	591,991	67,870	3,993	(7)	3,418,436	
辦公設備		63,558	7,942	6,657	-	7	64,850	
租賃改良		300,655	53,645	462	-	-	353,838	
其他設備		94,641	21,951	2,828	22,182	-	135,946	
		<u>3,492,193</u>	<u>\$ 727,206</u>	<u>\$ 77,817</u>	<u>\$ 26,175</u>	<u>\$ -</u>	<u>4,167,757</u>	
未完工程及待驗設備		935,683	(\$ 706,085)	\$ -	\$ -	\$ -	229,598	
		<u>\$ 4,980,991</u>					<u>\$ 4,453,092</u>	

本公司建築物之重大組成部分主要有廠房主建物、機電動力設備及無塵潔淨室等，分別按其耐用年限 18 至 32 年、7 至 11 年及 10 至 11 年提列折舊；機器設備之重大組成部分主要有蝕刻機、濺鍍機等，按其耐用年限 3 至 8 年提列折舊。

本公司評估部分機器設備之帳面價值無法回收，故於 102 及 101 年度按其可回收金額評估分別認列減損損失計 3,804 仟元及 26,175 仟元。

本公司於 101 年度將不動產、廠房及設備購建期間為該資產所支出款項而負擔之利息，予以資本化列為不動產、廠房及設備之成本。資本化金額為 6,442 仟元，利息資本化利率為 1.08%~1.20%。

十三、無形資產

	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
專門技術	\$ 43,919	\$ 49,586	\$ 55,253
電腦軟體成本	13,699	12,097	14,800
其 他	14,076	20,852	29,847
	<u>\$ 71,694</u>	<u>\$ 82,535</u>	<u>\$ 99,900</u>

102 年度				
	年 初 餘 額	增	加 報	廢 年 底 餘 額
成 本				
專門技術	\$ 113,340	\$ -	\$ -	\$ 113,340
電腦軟體成本	36,961	9,263	15,873	30,351
其 他	58,506	13,872	23,549	48,829
	<u>208,807</u>	<u>\$ 23,135</u>	<u>\$ 39,422</u>	<u>192,520</u>
累計攤銷				
專門技術	63,754	\$ 5,667	\$ -	69,421
電腦軟體成本	24,864	7,661	15,873	16,652
其 他	37,654	20,648	23,549	34,753
	<u>126,272</u>	<u>\$ 33,976</u>	<u>\$ 39,422</u>	<u>120,826</u>
	<u>\$ 82,535</u>			<u>\$ 71,694</u>

101 年度				
	年 初 餘 額	增	加 報	廢 年 底 餘 額
成 本				
專門技術	\$ 113,340	\$ -	\$ -	\$ 113,340
電腦軟體成本	51,557	6,669	21,265	36,961
其 他	135,582	14,767	91,843	58,506
	<u>300,479</u>	<u>\$ 21,436</u>	<u>\$ 113,108</u>	<u>208,807</u>
累計攤銷				
專門技術	58,087	\$ 5,667	\$ -	63,754
電腦軟體成本	36,757	9,372	21,265	24,864
其 他	105,735	23,762	91,843	37,654
	<u>200,579</u>	<u>\$ 38,801</u>	<u>\$ 113,108</u>	<u>126,272</u>
	<u>\$ 99,900</u>			<u>\$ 82,535</u>

十四、其他流動資產

	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
預付費用	\$ 49,822	\$ 47,257	\$ 33,212
應收退稅款	6,193	12,786	11,313
預付貨款	2,417	8,055	2,439
其 他	11,972	3,418	1,101
	<u>\$ 70,404</u>	<u>\$ 71,516</u>	<u>\$ 48,065</u>

十五、負債準備

	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
退貨及折讓	\$ 50,640	\$ 31,353	\$ 36,033
除役成本	24,536	24,536	24,536
	<u>\$ 75,176</u>	<u>\$ 55,889</u>	<u>\$ 60,569</u>
流 動	\$ 50,640	\$ 31,353	\$ 36,033
非 流 動	24,536	24,536	24,536
	<u>\$ 75,176</u>	<u>\$ 55,889</u>	<u>\$ 60,569</u>

	退貨及折讓 負債準備	除役成本 負債準備	合計
<u>102 年度</u>			
年初餘額	\$ 31,353	\$ 24,536	\$ 55,889
本年度提列	137,133	-	137,133
本年度給付	(117,846)	-	(117,846)
年底餘額	<u>\$ 50,640</u>	<u>\$ 24,536</u>	<u>\$ 75,176</u>
<u>101 年度</u>			
年初餘額	\$ 36,033	\$ 24,536	\$ 60,569
本年度提列	29,372	-	29,372
本年度給付	(34,052)	-	(34,052)
年底餘額	<u>\$ 31,353</u>	<u>\$ 24,536</u>	<u>\$ 55,889</u>

退貨及折讓負債準備係本公司依歷史經驗、管理階層判斷及其他已知原因所估計可能發生之產品退回及折讓，並於相關產品出售當年度認列為營業收入之減項。

除役成本負債準備係拆卸、移除相關設備及復原其所在地點所產生之除役負債準備，其金額以預期清償義務之現金流量估計折現值衡量，於報導期間結束日進行適當之評估及調整。

十六、存入保證金

本公司於 102 年度受某客戶委任提供特定產品之封裝服務，並收取補償未來訂單風險之產能保證金計 1,016,977 仟元。截至本財務報告通過發布日止，本公司及該客戶依對市場及未來訂單需求之評估，預計該款項於 103 年上半年度將陸續返還。

十七、長期銀行借款

	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
銀行信用借款：			
原應於 105 年 6 月到期 一次償還，惟於 102 年及 101 年分別提前 償還 50,000 仟元及 100,000 仟元，年利率 102 年為 1.21%~ 1.25%；101 年為 1.08%~1.21%	\$ 500,000	\$ 550,000	\$ 650,000

(接次頁)

(承前頁)

	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
自 104 年 5 月起，每 3 個月為一期，分 5 期償還，年利率為 1.45%~1.48%	\$ 400,000	\$ -	\$ -
自 103 年 7 月起，每 3 個月為一期，分 16 期償還，年利率為 1.23%~1.25%	300,000	-	-
自 101 年 7 月起，每 3 個月為一期，分 16 期償還，年利率 102 年為 1.24%~1.25%；101 年為 1.21%~1.24%	187,500	262,500	300,000
自 103 年 10 月起，每 3 個月為一期，分 16 期償還，年利率為 1.25%	150,000	-	-
原應於 105 年 5 月到期一次償還，惟於 102 年及 101 年分別提前償還 320,000 仟元及 50,000 仟元，年利率 102 年為 1.18%~1.48%；101 年為 1.16%~1.18%	130,000	450,000	500,000
自 101 年 9 月起，每 3 個月為一期，分 16 期償還，年利率 102 年為 1.21%~1.25%；101 年為 1.21%~1.24%	125,000	175,000	200,000
自 103 年 9 月起，每 3 個月為一期，分 16 期償還，年利率為 1.23%~1.25%	100,000	-	-
於 107 年 8 月到期一次償還，年利率為 1.28%~1.31%	100,000	-	-

(接次頁)

(承前頁)

	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
自 102 年 10 月起，每 3 個月為一期，分 16 期償還，年利率 102 年為 1.24%~1.25%； 101 年 為 1.23%~ 1.24%	\$ 46,875	\$ 50,000	\$ -
擔保借款：			
於 107 年 8 月到期一次 償還，年 利率 為 1.17%~1.20%	70,000 <u>\$ 2,109,375</u>	- <u>\$ 1,487,500</u>	- <u>\$ 1,650,000</u>
流 動	\$ 196,875	\$ 128,125	\$ 62,500
非 流 動	<u>1,912,500</u> <u>\$ 2,109,375</u>	<u>1,359,375</u> <u>\$ 1,487,500</u>	<u>1,587,500</u> <u>\$ 1,650,000</u>

依銀行借款合同規定，銀行信用借款要求本公司於借款存續期間內，其半年度及年度財務報表須符合某些財務比例限制；截至 102 年 12 月 31 日止，本公司未有違反上述財務比率限制之情形。

本公司另以部分機器設備抵押擔保借款，請參閱附註三二。

十八、退職後福利計畫

(一) 確定提撥計畫

本公司依「勞工退休金條例」訂定之員工退休計畫，係屬確定提撥退休辦法。本公司依員工每月薪資 6%提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。依上述相關規定，本公司於 102 及 101 年度於綜合損益表認列為費用之金額分別為 45,632 仟元及 40,220 仟元。

(二) 確定福利計畫

本公司依「勞動基準法」訂定之員工退休辦法，係屬確定福利退休辦法。依該辦法之規定，員工退休金係按服務年資及退休前 6 個月之平均薪資計算。本公司按員工每月薪資總額百分之二提撥員工退休金基金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶。

本公司係採用預計單位福利法衡量確定福利義務現值、相關當期服務成本及前期服務成本。

本公司之計畫資產及確定福利義務現值，係由合格精算師進行精算。精算評價於衡量日之主要假設列示如下：

	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
折現率	2.00%	1.50%	1.75%
薪資預期增加率	2.00%	2.00%	2.50%
計畫資產之預期報酬率	1.75%	1.75%	2.00%

有關確定福利計畫認列於損益之退休金費用（利益）金額，係列於管理費用，並列示如下：

	102年度	101年度
利息成本	\$ 589	\$ 687
計畫資產之預期報酬	(<u>635</u>)	(<u>680</u>)
	<u>(\$ 46)</u>	<u>\$ 7</u>

本公司於 102 及 101 年度分別認列 1,469 仟元及 339 仟元之精算利益於其他綜合損益。截至 102 年及 101 年 12 月 31 日止，精算利益認列於其他綜合損益之累積金額分別為 1,808 仟元及 339 仟元。

本公司因確定福利計畫所產生之義務列入資產負債表之金額列示如下：

	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
已提撥確定福利義務之現值	\$ 38,198	\$ 39,255	\$ 39,257
計畫資產之公允價值	(<u>37,692</u>)	(<u>35,322</u>)	(<u>33,037</u>)
應計退休金負債	<u>\$ 506</u>	<u>\$ 3,933</u>	<u>\$ 6,220</u>

確定福利義務現值之變動列示如下：

	102 年度	101 年度
年初餘額	\$ 39,255	\$ 39,257
利息成本	589	687
精算利益	(<u>1,646</u>)	(<u>689</u>)
年底餘額	<u>\$ 38,198</u>	<u>\$ 39,255</u>

計畫資產公允價值之變動列示如下：

	102 年度	101 年度
年初餘額	\$ 35,322	\$ 33,037
計畫資產預期報酬	635	680
精算損失	(177)	(350)
雇主提撥數	<u>1,912</u>	<u>1,955</u>
年底餘額	<u>\$ 37,692</u>	<u>\$ 35,322</u>

計畫資產之主要類別於報導期間結束日公允價值之百分比列示如下：

	計 畫 資 產 公 允 價 值 (%)		
	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
現 金	23	25	24
權益工具	45	38	41
債務工具	<u>32</u>	<u>37</u>	<u>35</u>
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>

整體資產預期報酬率係根據歷史報酬趨勢以及分析師對於相關義務存續期間內，該資產所處市場之預測，並參考勞工退休基金監理會對勞工退休基金之運用情形，於考量最低收益不低於當地銀行 2 年定期存款利率之收益之影響所作之估計。

本公司選擇自轉換至 IFRSs 日起揭露經驗調整之歷史資訊如下：

	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
確定福利義務現值	\$ 38,198	\$ 39,255	\$ 39,257
計畫資產公允價值	(<u>37,692</u>)	(<u>35,322</u>)	(<u>33,037</u>)
提撥短絀	<u>\$ 506</u>	<u>\$ 3,933</u>	<u>\$ 6,220</u>
計畫負債之經驗調整	<u>\$ 1,646</u>	<u>\$ 690</u>	<u>\$ -</u>
計畫資產之經驗調整	(<u>\$ 177</u>)	(<u>\$ 351</u>)	(<u>\$ -</u>)

本公司預期於 102 年 12 月 31 日後 1 年內對確定福利計畫提撥 1,815 仟元。

十九、權益

(一) 普通股股本

	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
額定股數(仟股)	<u>260,000</u>	<u>260,000</u>	<u>260,000</u>
額定股本	<u>\$ 2,600,000</u>	<u>\$ 2,600,000</u>	<u>\$ 2,600,000</u>
已發行且付清股款之股數(仟股)	<u>236,402</u>	<u>236,208</u>	<u>233,581</u>
已發行股本	<u>\$ 2,364,018</u>	<u>\$ 2,362,079</u>	<u>\$ 2,335,811</u>

已發行之普通股每股面額為 10 元，每股享有一表決權及收取股利之權利。

額定股本中供發行員工認股權憑證所保留之股本為 12,000 仟股。

(二) 資本公積

	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
股票發行溢價	\$ 508,103	\$ 507,239	\$ 505,177
員工認股權	<u>16,752</u>	<u>6,219</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 524,855</u>	<u>\$ 513,458</u>	<u>\$ 505,177</u>

依照法令規定，超過票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股等）產生之資本公積得用以彌補虧損，亦得於公司無虧損時，用以發放現金股利或撥充股本，惟撥充股本時每年以實收股本之一定比率為限。

因員工認股權產生之資本公積，不得作為任何用途。

(三) 保留盈餘及股利政策

依本公司章程規定，本公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。每年度決算如有盈餘，應先完納稅捐，彌補以往年度虧損，次提撥百分之十為法定盈餘公積，如法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限，次依法令或主管機關規定應提列及迴轉特別盈餘公積後，再就其餘額依序作下列之分配：

1. 提撥不低於百分之一為員工紅利；
2. 提撥不高於百分之二為董事酬勞，且給付之對象不包括擔任本公司經理人之董事；

3. 餘額由董事會擬具股東紅利分派議案，提請股東會決議分派之；
4. 前項有關員工紅利部分，如為分配股票紅利，其對象得包括從屬公司員工，其條件及分配方式，授權董事會決定之。

本公司股利發放政策係依據公司資本預算、中長期營運規劃及財務狀況，依下列原則經股東會決議後分派之：

1. 公司得依財務、業務及經營面等因素之考量將當年度可分配盈餘全數分派。盈餘之分派得以股票股利或現金股利之方式為之，但因本公司目前正處於營運成長期，未來將視擴充計劃及投資資金之需求，於分派當年度可分配盈餘時，現金股利分派之比例以不低於股利總額之百分之五十。
2. 於當年度公司無盈餘可分派，或雖有盈餘但盈餘數額遠低於公司前一年度實際分派之盈餘，或依公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將公積全部或一部依法令或主管機關規定分派。上述盈餘分配案應於翌年召開股東常會時予以決議承認。

本公司 102 年度員工紅利及董事酬勞之估列金額為 44,151 仟元，係按稅後淨利並扣除應提列之法定盈餘公積及特別盈餘公積後之 17%計算。於股東會決議日時，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。如股東會決議採股票發放員工紅利，股票紅利股數按決議分紅之金額除以股票公允價值決定，以國際財務報導準則第 2 號「股份基礎給付」規定之公允價值計算股票紅利股數。

本公司 101 年度為虧損，故未估列員工紅利及董監酬勞。

法定盈餘公積應提撥至其總額達公司實收股本總額為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損；公司無虧損者，得以法定盈餘公積超過實收股本總額 25%之部分按股東原有股份之比例發給新股或現金。

本公司分配盈餘時，必須依法令規定就當年底之股東權益減項淨額（如現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具損益等累計餘額）提列特別盈餘公積。嗣後股東權益減項金額如有減少，可就減少金額自特別盈餘公積轉回未分配盈餘。

本公司分別於 102 年 6 月 13 日及 101 年 6 月 14 日舉行股東常會，分別決議 101 及 100 年度盈餘分配案及每股股利如下：

	盈 餘 分 配 案		每 股 股 利 (元)	
	101年度	100年度	101年度	100年度
法定盈餘公積	\$ -	\$ 13,442		
特別盈餘公積	(232)	(582)		
股東現金股利	23,622	23,363	\$ 0.10	\$ 0.10
股東股票股利	-	23,363	-	0.10
	<u>\$ 23,390</u>	<u>\$ 59,586</u>		

另本公司於 101 年 6 月 14 日股東常會亦決議配發 100 年度員工現金紅利 18,235 仟元及董監酬勞 2,431 仟元，前述決議配發金額與本公司於 101 年 3 月 9 日之董事會決議並無差異，並已於 100 年度以費用入帳。本公司 101 年度為虧損，故未配發員工紅利及董監酬勞。

101 年度之盈餘分配案係按本公司依據修訂前證券發行人財務報告編製準則及中華民國一般公認會計原則所編製之 101 年度財務報告，作為董事會擬議盈餘分配議案之基礎。

本公司董事會另於 103 年 3 月 6 日擬議通過 102 年度之盈餘分配案及每股股利如下：

	盈 餘 分 配 案	每股股利 (元)
法定盈餘公積	\$ 28,888	
特別盈餘公積	281	
股東現金股利	130,021	\$ 0.55
	<u>\$159,190</u>	

本公司董事會亦同時擬議配發 102 年員工紅利及董事酬勞 44,151 仟元，前述擬配發金額與本公司 102 年度以費用列帳之金額並無差異。

有關 102 年度之盈餘分配案、員工分紅及董事酬勞尚待預計於 103 年 6 月 12 日召開之股東會決議。

上述有關本公司董事會通過擬議及股東會決議之員工紅利及董監酬勞資訊，請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。

本公司分配屬於 87 年度（含）以後未分配盈餘時，除屬非中華民國境內居住者之股東外，其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣抵稅額。

(四) 其他權益項目

現金流量避險項目之變動數如下：

	102年度	101年度
<u>現金流量避險</u>		
年初餘額	\$ -	(\$ 232)
現金流量避險之避險工具公允價值變動	(511)	5
現金流量避險之避險工具公允價值變動重分類至損益	<u>230</u>	<u>227</u>
年底餘額	(\$ <u>281</u>)	\$ <u>-</u>

與現金流量避險相關之其他權益項目，係避險工具於現金流量避險中公允價值變動屬有效避險部分之累計利益或損失，此累計利益或損失僅當避險交易影響損益時重分類至損益。

二十、股份基礎給付

(一) 選擇豁免適用國際財務報導準則第 2 號「股份基礎給付」者

本公司對所有在 101 年 1 月 1 日前已給與並已既得之股份基礎給付之交易，選擇豁免追溯適用國際財務報導準則第 2 號。該等認股權計畫如下：

本公司分別於 96 年 6 月 26 日（96 年員工認股權計畫）及 95 年 7 月 3 日（95 年員工認股權計畫）經行政院金融監督管理委員會證券期貨局（證期局）核准發行員工認股權憑證各 6,000 仟單位，每單位可認購普通股票一股，授予對象包含本公司及子公司符合特定條件之員工，認股權憑證之存續期間各分別為 10 年，憑證持有人自被授予認股權憑證屆滿 2 年後，得依認股辦法分年行使認股權利。

本公司 102 及 101 年度員工認股權憑證之相關資訊如下：

	96 年員工認股權計畫		95 年員工認股權計畫	
	單位 (仟)	加權平均行使價格 (元)	單位 (仟)	加權平均行使價格 (元)
<u>102年度</u>				
年初流通在外	314	\$ 15.86	201	\$ 10.60
本年度執行	(157)	15.34	(36)	10.62
本年度取消	(7)	18.60	-	-
年底流通在外	<u>150</u>	16.26	<u>165</u>	10.60
年底可執行	<u>150</u>		<u>165</u>	
<u>101年度</u>				
年初流通在外	585	\$ 16.67	240	\$ 10.79
本年度執行	(256)	17.86	(35)	11.51
本年度取消	(15)	16.16	(4)	10.70
年底流通在外	<u>314</u>	15.86	<u>201</u>	10.70
年底可執行	<u>314</u>		<u>198</u>	

上述認股價格遇有無償配股及現金股利發放之情形時，業已依照本公司員工認股權憑證發行及認股辦法調整。

本公司流通在外之員工認股權憑證相關資訊如下：

102 年 12 月 31 日		101 年 12 月 31 日	
執行價格之範圍 (元)	加權平均剩餘合約期限 (年)	執行價格之範圍 (元)	加權平均剩餘合約期限 (年)
\$10.60~\$12.40	2.75~3.04	\$10.70~\$12.50	3.74~4.04
\$14.80~\$18.60	3.49~3.95	\$14.80~\$18.60	4.48~4.95
101 年 1 月 1 日			
執行價格之範圍 (元)	加權平均剩餘合約期限 (年)		
\$10.90~\$12.70	4.75~5.04		
\$14.90~\$18.80	5.50~5.96		

(二) 適用國際財務報導準則第 2 號「股份基礎給付」者

1. 權益交割之股份基礎給付

本公司對所有在 101 年 1 月 1 日後已給與並已既得之股份基礎給付之交易，選擇適用國際財務報導準則第 2 號。該等認股權計畫說明如下：

本公司於 101 年 1 月 10 日（100 年員工認股權計畫）經證期局核准發行員工認股權憑證 6,000 仟單位，每單位可認購普通股一股，授予對象包含本公司及子公司符合特定條件之員工；認股權憑證之存續期間為 5 年，憑證持有人自被授予認股權憑證屆滿 2 年後，得依認股辦法分年行使認股權利。

本公司 102 及 101 年度員工認股權憑證之相關資訊如下：

	100 年員工認股權計畫	
	單 位 (仟)	加權平均行使價格 (元)
<u>102 年度</u>		
年初流通在外	5,528	\$ 22.10
本年度取消	(754)	22.10
年底流通在外	<u>4,774</u>	22.10
年底可執行	<u>-</u>	-
<u>101 年度</u>		
年初流通在外	-	\$ -
本年度給與	6,000	22.30
本年度取消	(472)	22.10
年底流通在外	<u>5,528</u>	22.10
年底可執行	<u>-</u>	-
本年度給與之認股權加 權平均公允價值（元 ／股）	<u>\$ 5.82</u>	

上述認股價格遇有無償配股及現金股利發放之情形時，業已依照本公司員工認股權憑證發行及認股辦法調整。

本公司流通在外之員工認股權憑證相關資訊如下：

102 年 12 月 31 日		101 年 12 月 31 日	
執行價格 之範圍（元）	加權平均剩餘 合約期限（年）	執行價格 之範圍（元）	加權平均剩餘 合約期限（年）
\$22.10	3.46	\$22.10	4.46

上述員工認股權計畫之給與日為 101 年 6 月 14 日。本公司按 Black-Scholes 選擇權評價模式計算認股權公允價值，於給與日之評價假設資訊如下：

評價假設

給與日股票市價（元／股）	\$ 19.42
行使價格（元／股）	22.30
預期波動率	43.73%
預期存續期間	3.875 年
預期股利率	-
無風險利率	0.96%

給與日股票市價係以市場法評估；預期波動率係採與本公司相似之類比公司歷史股價資訊為基礎計算。

本公司 102 及 101 年度所認列之員工認股權計畫酬勞成本分別為 10,533 仟元及 6,219 仟元。

2. 現金交割之股份基礎給付

本公司於 101 年 6 月 14 日經董事會決議通過以現金交割之股份基礎給付計畫（股票增值計畫），授予對象包含本公司符合特定條件之員工，前述之員工現金股票增值權之存續期間為 10 年，增值權之持有人自被授予現金股票增值權之次日可按股票增值計畫逐年累積比例行使現金股票增值權。本公司依約定於員工執行時按股票增值權之內含價值支付現金予員工。

本公司之股票增值計畫如下：

	101年度股票 增值計畫
給與日	101 年 6 月 14 日
給與數量（仟單位）	2,000
合約期間	10 年
本年度實際離職率	-
估計未來離職率	-
給與日之執行價（元／股）	\$49.4

本公司 102 及 101 年度股票增值計劃之相關資訊如下：

	單 位 (仟)	加權平均行使價格 (元)
<u>102 年度</u>		
年初流通在外	2,000	\$ 49.4
年底流通在外	2,000	49.3
年底可執行	800	49.3
<u>101 年度</u>		
年初流通在外	-	\$ -
本年度給與	2,000	49.4
年底流通在外	2,000	49.4
年底可執行	400	49.4

上述行使價格遇有無償配股及現金股利發放之情形時，業已依照本公司股票增值計劃辦法調整。

本公司於資產負債表日按 Black-Scholes 選擇權評價模式計算增值權公允價值，於 102 年及 101 年 12 月 31 日之評價假設資訊如下：

	102 年度	101 年度
衡量日股票市價 (元/股)	\$ 31.6	\$ 18.5
行使價格 (元/股)	\$ 49.3	\$ 49.4
預期波動率	42.20%~45.42%	42.90%~47.30%
預期存續期間	3.45~5.45 年	4.45~6.45 年
預期股利率	-	-
無風險利率	0.95%~1.31%	1.03%~1.27%

預期波動率係採與本公司相似之類比公司歷史股價資訊為基礎計算。

本公司 102 年度認列之股票增值計畫酬勞成本為 10,374 仟元。截至 102 年 12 月 31 日止，本公司股票增值計劃之負債及股票增值計劃之負債已符合既得條件之內含價值總額分別為 10,374 仟元及 0 元，加權平均剩餘合約期間為 8.45 年。

二一、營業收入

本公司所產生收入之分析如下：

	102年度	101年度
商品銷售收入	\$ 4,229,046	\$ 3,112,169
其 他	<u>27,715</u>	<u>27,216</u>
	<u>\$ 4,256,761</u>	<u>\$ 3,139,385</u>

二二、其他營業收益及費損淨額

	102年度	101年度
出租資產收益（費損）		
租金收入	\$151,006	\$ -
出租資產折舊	(95,197)	-
其 他	<u>(6,825)</u>	<u>-</u>
	48,984	-
處分不動產、廠房及設備淨益	2,670	2,107
不動產、廠房及設備減損損失	(3,804)	(26,175)
其 他	<u>3,158</u>	<u>8,956</u>
	<u>\$ 51,008</u>	<u>(\$ 15,112)</u>

二三、利息收入

	102年度	101年度
利息收入		
銀行存款	<u>\$ 4,575</u>	<u>\$ 4,194</u>

二四、財務成本

	102年度	101年度
利息費用		
銀行借款	\$ 27,928	\$ 18,867
其 他	<u>-</u>	<u>754</u>
	27,928	19,621
現金流量避險自權益轉列之損失	230	227
利息資本化	<u>-</u>	<u>(6,442)</u>
	<u>\$ 28,158</u>	<u>\$ 13,406</u>

二五、其他利益及損失

	102年度	101年度
外幣兌換淨益（損）	\$ 12,117	(\$ 22,333)
透過損益按公允價值衡量之金融工具淨益（損）	(20,661)	19,339
其他	254	677
	<u>(\$ 8,290)</u>	<u>(\$ 2,317)</u>

二六、所得稅

（一）認列於損益之所得稅

本年度認列於損益之所得稅組成如下：

	102年度	101年度
當年度所得稅費用（利益）		
當年度產生者	\$ 29,381	\$ -
以前年度所得稅調整	698	922
	<u>30,079</u>	<u>922</u>
遞延所得稅費用（利益）		
與暫時性差異產生及迴轉有關	(4,488)	(1,643)
與所得稅抵減及虧損扣抵有關	34,291	(16,843)
	<u>29,803</u>	<u>(18,486)</u>
認列於損益之所得稅費用（利益）	<u>\$ 59,882</u>	<u>(\$ 17,564)</u>

會計所得與當年度所得稅費用之調節如下：

	102年度	101年度
稅前淨利（淨損）	<u>\$348,763</u>	<u>(\$107,769)</u>
稅前淨利（淨損）按法定稅率計算之所得稅費用（17%）	\$ 59,289	(\$ 18,321)
調節項目之所得稅影響數		
決定課稅所得時應予調整增（減）項目	4,407	(6,379)
免稅所得	(21,995)	-
未分配盈餘加徵	-	7,484
暫時性差異之產生及迴轉	(4,488)	(1,643)
所得稅抵減再衡量	21,971	373
以前年度所得稅調整	698	922
認列於損益之所得稅費用（利益）	<u>\$ 59,882</u>	<u>(\$ 17,564)</u>

(二) 遞延所得稅

資產負債表中之遞延所得稅資產分析如下：

	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
投資抵減及虧損扣抵	\$ 12,982	\$ 47,273	\$ 30,430
暫時性差異			
折 舊	18,428	18,777	16,143
退貨及折讓負債準備	8,609	5,330	6,126
未實現存貨損失	1,296	1,462	1,203
其 他	2,824	1,100	1,554
	<u>\$ 44,139</u>	<u>\$ 73,942</u>	<u>\$ 55,456</u>

遞延所得稅資產之變動如下：

	年 初 餘 額	認列於(損)益	年 底 餘 額
<u>102 年度</u>			
投資抵減及虧損扣抵	\$ 47,273	(\$ 34,291)	\$ 12,982
暫時性差異			
折 舊	18,777	(349)	18,428
退貨及折讓負債準備	5,330	3,279	8,609
未實現存貨損失	1,462	(166)	1,296
其 他	1,100	1,724	2,824
	<u>\$ 73,942</u>	<u>(\$ 29,803)</u>	<u>\$ 44,139</u>
<u>101 年度</u>			
投資抵減及虧損扣抵	\$ 30,430	\$ 16,843	\$ 47,273
暫時性差異			
折 舊	16,143	2,634	18,777
退貨及折讓負債準備	6,126	(796)	5,330
未實現存貨損失	1,203	259	1,462
其 他	1,554	(454)	1,100
	<u>\$ 55,456</u>	<u>\$ 18,486</u>	<u>\$ 73,942</u>

(三) 未於資產負債表中認列遞延所得稅資產之投資抵減及虧損扣抵之金額

未於資產負債表中認列遞延所得稅資產之投資抵減如下：

到 期 年 度	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
101	\$ -	\$ -	\$ 9,194
102	-	32,168	35,707
103	34,761	19,001	34,761
104	22,863	22,864	19,416
	<u>\$ 57,624</u>	<u>\$ 74,033</u>	<u>\$ 99,078</u>

未於資產負債表中認列遞延所得稅資產之虧損扣抵如下：

到 期 年 度	102 年 12 月 31 日
111 年度	<u>\$ 14,909</u>

(四) 未使用之投資抵減、虧損扣抵及免稅相關資訊

截至 102 年 12 月 31 日止，本公司投資抵減相關資訊如下：

法 令 依 據	抵 減 項 目	尚未抵減金額	到 期 年 度
促進產業升級條例	機器設備投資抵減	\$ 34,761	103
		<u>22,863</u>	104
		<u>\$ 57,624</u>	

截至 102 年 12 月 31 日止，本公司虧損扣抵相關資訊如下：

到 期 年 度	尚未扣抵金額
108 年度	\$ 19,260
111 年度	<u>144,807</u>
	<u>\$164,067</u>

截至 102 年 12 月 31 日止，本公司從事先進積體電路封裝之所得可享受 5 年免稅如下：

增 資 擴 展 案	免 稅 期 間
第二次增資擴展免徵所得稅	99 至 103 年度

(五) 兩稅合一相關資訊：

	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
可扣抵稅額帳戶餘額	<u>\$ 72,058</u>	<u>\$ 73,054</u>	<u>\$ 61,394</u>

本公司 102 年度預計及 101 年度實際盈餘分配之稅額扣抵比率分別為 6.80%及 9.22%。依台財稅字第 10204562810 號規定，本公司計算首次採用 IFRSs 年度稅額扣抵比率時，其帳載累積未分配盈餘已包含因首次採用 IFRSs 產生之保留盈餘調整數。

實際分配予股東之可扣抵稅額，係以股利盈餘分配日之股東可扣抵稅額帳戶之餘額為準，因是預計盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅額扣抵比率有所差異。

本公司無屬於 86 年（含）以前之未分配盈餘。

(六) 所得稅核定情形

本公司截至 100 年度止之所得稅申報案件，業經稅捐稽徵機關核定。各年度經國稅局核定之各項投資抵減稅額差額，業已適當調整入帳。

二七、每股盈餘（淨損）

	102年度	101年度
基本每股盈餘（淨損）	<u>\$ 1.22</u>	<u>(\$ 0.38)</u>
稀釋每股盈餘（淨損）	<u>\$ 1.21</u>	<u>(\$ 0.38)</u>

計算每股盈餘（淨損）之分子及分母揭露如下：

	金額（分子）	股數（分母） （ 仟 股 ）	每 股 盈 餘 （淨損）（元）
<u>102年度</u>			
基本及稀釋每股盈餘			
屬於普通股股東之本年度			
淨利	\$ 288,881	236,318	<u>\$ 1.22</u>
具稀釋作用潛在普通股之影響	<u>-</u>	<u>2,938</u>	
稀釋每股盈餘			
屬於普通股股東之本年度			
淨利加潛在普通股之影響	<u>\$ 288,881</u>	<u>239,256</u>	<u>\$ 1.21</u>
<u>101年度</u>			
基本及稀釋每股淨損			
屬於普通股股東之本年度			
淨損	<u>(\$ 90,205)</u>	<u>236,146</u>	<u>(\$ 0.38)</u>

計算稀釋每股盈餘時，係假設員工紅利將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。計算稀釋每股盈餘時，以該潛在普通股於資產負債表日之公允價值，作為發行股數之判斷基礎。於次年度股東會決議員工分紅發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

二八、費用性質之額外資訊

本年度淨利（淨損）係包含以下項目：

	102年度	101年度
(一) 不動產、廠房及設備之折舊		
認列於營業成本	\$ 766,391	\$ 721,542
認列於營業費用	7,412	5,664
認列於其他營業收益及費損	95,197	-
	<u>\$ 869,000</u>	<u>\$ 727,206</u>
(二) 無形資產之攤銷		
認列於營業成本	\$ 21,428	\$ 29,267
認列於營業費用	12,548	9,534
	<u>\$ 33,976</u>	<u>\$ 38,801</u>
(三) 發生即認列為費用之研究及發展支出	<u>\$ 216,971</u>	<u>\$ 206,117</u>
(四) 員工福利費用		
退職後福利計畫（參閱附註十八）		
確定提撥計畫	\$ 45,632	\$ 40,220
確定福利計畫	(46)	7
	<u>45,586</u>	<u>40,227</u>
股份基礎給付		
權益交割之股份基礎給付	10,533	6,219
現金交割之股份基礎給付	10,374	-
	<u>20,907</u>	<u>6,219</u>
其他員工福利	<u>1,218,145</u>	<u>992,473</u>
	<u>\$ 1,284,638</u>	<u>\$ 1,038,919</u>
員工福利費用依功能別彙總		
認列於營業成本	\$ 1,040,220	\$ 822,474
認列於營業費用	244,418	216,445
	<u>\$ 1,284,638</u>	<u>\$ 1,038,919</u>

二九、資本管理

本公司資本管理係以確保能夠繼續經營之前提下，藉由維持債務及權益餘額之平衡及最適化，以使股東報酬極大化。本公司之資本管理乃確保具有足夠之財務資源，以支應未來 12 個月內之營運資金需求、資本支出、研究發展活動支出、股利支出、債務償還及其他營業需求。

三十、金融工具

(一) 金融工具之種類

	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
<u>金融資產</u>			
透過損益按公允價值衡 量			
持有供交易者	\$ 172	\$ 504	\$ 223
備供出售金融資產			
以成本衡量之金融 資產	-	-	-
放款及應收款			
現金及約當現金	1,031,142	770,750	675,441
應收票據及帳款淨 額（含關係人）	751,779	417,915	472,680
其他應收關係人款 項	141,190	-	19,686
其他應收款項	310	729	99
存出保證金	8,550	8,269	7,776
	<u>\$ 1,933,143</u>	<u>\$ 1,198,167</u>	<u>\$ 1,175,905</u>
<u>金融負債</u>			
透過損益按公允價值衡 量			
持有供交易者	\$ 7,235	\$ 55	\$ 1,666
指定為避險會計關係之衍 生金融工具	281	-	232
以攤銷後成本衡量			
應付帳款	243,857	155,760	156,073
應付工程及設備款	305,961	192,214	310,557
存入保證金	1,016,977	-	-
應付費用及其他流 動負債	262,625	180,856	241,175
長期銀行借款	2,109,375	1,487,500	1,650,000
	<u>\$ 3,946,311</u>	<u>\$ 2,016,385</u>	<u>\$ 2,359,703</u>

(二) 財務風險管理目的

本公司致力於確保公司於必要時具有足夠且具成本效益之營運資本。本公司積極管理與營運活動相關之外幣匯率風險、利率風險、信用風險及流動性風險等，以降低市場之不確定性對公司財務績效之潛在不利影響。

本公司之重要財務規劃，均經董事會依相關規範及內部控制制度進行覆核。本公司財務部門於執行財務計劃時，均恪遵關於整體財務風險管理及權責劃分之相關財務操作程序。

(三) 市場風險

本公司曝露於外幣匯率變動及利率變動等市場風險，並使用衍生金融工具以管理相關風險。

1. 外幣匯率風險

本公司營運活動主要係以外幣進行交易，因此產生外幣匯率風險。為避免因匯率變動造成外幣資產價值下跌及未來現金流量之波動，本公司使用遠期外匯合約等衍生金融工具來規避匯率風險。此類衍生金融工具之使用，可協助本公司減少但仍無法完全排除外幣匯率變動所造成之影響。

有關外幣匯率風險之敏感性分析，主要係針對報導期間結束日之外幣貨幣性項目，因匯率變動產生之不利影響計算。當外幣對新台幣產生不利之變動達百分之十，本公司於 102 及 101 年度之淨損將分別增加 1,406 仟元及 713 仟元，上述數字業已考慮避險合約及被避險項目之影響。

2. 利率風險

本公司之長期銀行借款係為浮動利率，利率變動將會影響未來現金流量，但不影響公允價值。故本公司簽定利率交換合約，以規避部分因利率變動造成之現金流量風險。

有關利率風險之敏感度分析，係假設報導期間結束日之浮動利率借款於整個報導期間持有，當利率上升一百個基點（1%），且其他條件固定不變的情況下，本公司上述浮動利率借款之利息費用稅後淨額於 102 及 101 年度將分別增加 10,038 仟元及 12,346 仟元。

(四) 信用風險管理

信用風險係指交易對方違反合約義務並對本公司造成財務損失之風險。本公司之信用風險，主要係來自於營運活動產生之應收款項與投資活動產生之銀行存款。截至資產負債表日，本公司可能因

交易對方未履行義務造成財務損失之最大信用風險曝險係資產負債表所認列之金融資產帳面價值。

1. 營運相關信用風險

本公司流通在外之應收帳款主要係來自於全球之客戶群，且大部分應收帳款並未提供擔保品或信用保證。雖然本公司訂有相關程序監督管理並減少應收帳款之信用風險，但並不能保證該程序可以完全有效排除信用風險並避免損失。

本公司之信用風險主要係集中於本公司之最大客戶。截至 102 年 12 月 31 日暨 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日止，對該客戶之應收帳款餘額分別佔本公司應收帳款餘額之 30%、49%及 51%。

2. 財務信用風險

本公司定期根據市場狀況以及履約交易對象之財務及信用狀況調整交易額度。此外，本公司亦透過挑選信用良好之金融機構作為交易對象以降低信用風險。

(五) 流動性風險管理

本公司管理流動性風險之目標，係為確保本公司有足夠之流動資金以支應未來營運需求。本公司係透過維持適當之資金及銀行額度，以支應各項合約義務。

銀行借款對本公司而言係為一項重要流動性來源。截至 102 年 12 月 31 日暨 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日止，本公司未動用之銀行融資額度分別為 2,576,231 仟元、2,494,943 仟元及 3,518,847 仟元。

下表係按到期日及未折現之到期金額（含本金及利息）彙總列示本公司已約定還款期間之金融負債分析：

	102年12月31日						合計
	短於1年	1年至2年	2年至3年	3年至4年	4年至5年	5年以上	
非衍生金融負債							
應付帳款	\$ 243,857	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 243,857
應付工程及設備款	305,961	-	-	-	-	-	305,961
存入保證金	1,016,977	-	-	-	-	-	1,016,977
應付費用及其他流動負債	262,625	-	-	-	-	-	262,625
長期銀行借款	223,035	1,548,493	400,251	-	-	-	2,171,779
	2,052,455	1,548,493	400,251	-	-	-	4,001,199

(接次頁)

(承前頁)

102年12月31日					
	短 於 1 年	2 至 3 年	4 至 5 年	5 年 以 上	合 計
衍生金融負債					
遠期外匯合約					
流 出	\$ 721,458	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 721,458
流 入	(714,395)	-	-	-	(714,395)
	<u>7,063</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7,063</u>
利率交換合約					
流 出	4,601	-	-	-	4,601
流 入	(4,080)	-	-	-	(4,080)
	<u>521</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>521</u>
	<u>\$ 2,060,039</u>	<u>\$ 1,548,493</u>	<u>\$ 400,251</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,008,783</u>

101年12月31日					
	短 於 1 年	2 至 3 年	4 至 5 年	5 年 以 上	合 計
非衍生金融負債					
應付帳款	\$ 155,760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155,760
應付工程及設備款	192,214	-	-	-	192,214
應付費用及其他流動負債	180,856	-	-	-	180,856
長期銀行借款	<u>146,571</u>	<u>745,174</u>	<u>637,580</u>	<u>-</u>	<u>1,529,325</u>
	<u>675,401</u>	<u>745,174</u>	<u>637,580</u>	<u>-</u>	<u>2,058,155</u>
衍生金融負債					
遠期外匯合約					
流 出	397,821	-	-	-	397,821
流 入	(398,239)	-	-	-	(398,239)
	<u>(418)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(418)</u>
	<u>\$ 674,983</u>	<u>\$ 745,174</u>	<u>\$ 637,580</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,057,737</u>

101年1月1日					
	短 於 1 年	2 至 3 年	4 至 5 年	5 年 以 上	合 計
非衍生金融負債					
應付帳款	\$ 156,073	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 156,073
應付工程及設備款	310,557	-	-	-	310,557
應付費用及其他流動負債	241,175	-	-	-	241,175
長期銀行借款	<u>79,558</u>	<u>778,190</u>	<u>849,021</u>	<u>-</u>	<u>1,706,769</u>
	<u>787,363</u>	<u>778,190</u>	<u>849,021</u>	<u>-</u>	<u>2,414,574</u>
衍生金融負債					
遠期外匯合約					
流 出	511,867	-	-	-	511,867
流 入	(510,122)	-	-	-	(510,122)
	<u>1,745</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,745</u>
利率交換合約					
流 出	706	-	-	-	706
流 入	(442)	-	-	-	(442)
	<u>264</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>264</u>
	<u>\$ 789,372</u>	<u>\$ 778,190</u>	<u>\$ 849,021</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,416,583</u>

(六) 金融工具之公允價值

1. 以攤銷後成本衡量金融工具之公允價值

本公司以攤銷後成本衡量之金融資產及金融負債於財務報表中之帳面金額趨近公允價值。

2. 認列於資產負債表之公允價值衡量

本公司以公允價值衡量之金融資產及金融負債，其衡量方式依照公允價值可觀察程度分為第一至三級：

- (1) 第一級公允價值衡量係指活絡市場相同資產或負債之公開報價（未經調整）。
- (2) 第二級公允價值衡量係指除第一級之公開報價外，以屬於該資產或負債直接（亦即價格）或間接（亦即由價格推導而得）可觀察之輸入值推導公允價值。
- (3) 第三級公允價值衡量係指評價技術係非以可觀察市場資料為基礎之資產或負債之輸入值（不可觀察之輸入值）推導公允價值。

102年12月31日				
	第一級	第二級	第三級	合計
<u>透過損益按公允價值衡量之金融資產</u>				
衍生金融工具	\$ -	\$ 172	\$ -	\$ 172
<u>透過損益按公允價值衡量之金融負債</u>				
衍生金融工具	\$ -	\$ 7,235	\$ -	\$ 7,235
<u>避險之衍生金融負債</u>				
利率交換合約	\$ -	\$ 281	\$ -	\$ 281
101年12月31日				
	第一等級	第二等級	第三等級	合計
<u>透過損益按公允價值衡量之金融資產</u>				
衍生金融工具	\$ -	\$ 504	\$ -	\$ 504
<u>透過損益按公允價值衡量之金融負債</u>				
衍生金融工具	\$ -	\$ 55	\$ -	\$ 55
101年1月1日				
	第一等級	第二等級	第三等級	合計
<u>透過損益按公允價值衡量之金融資產</u>				
衍生金融工具	\$ -	\$ 223	\$ -	\$ 223
<u>透過損益按公允價值衡量之金融負債</u>				
衍生金融工具	\$ -	\$ 1,666	\$ -	\$ 1,666
<u>避險之衍生金融負債</u>				
利率交換合約	\$ -	\$ 232	\$ -	\$ 232

本公司於 102 及 101 年度均未有第一級與第二級公允價值衡量間移轉之情形。

本公司於 102 及 101 年度均未有取得或處分以第三級公允價值衡量之金融資產等情形。

3. 衡量公允價值所採用之評價技術及假設

本公司金融資產及金融負債之公允價值係依下列方式決定：

(1) 遠期外匯合約公允價值係以遠期匯率報價及相對應之殖利率曲線衡量。利率交換合約係以未來估計之現金流量按相對之殖利率曲線折現之現值衡量。

(2) 其他金融資產及金融負債之公允價值係採用以現金流量折現分析為基礎之一般公認評價模式決定其公允價值。

三一、關係人交易

本公司與關係人間之交易明細揭露如下：

(一) 營業交易

	營業收入	淨額	製造費用	
	102年度	101年度	102年度	101年度
具重大影響力之投資者	\$ 2,335,155	\$ 1,261,163	\$ 1,067	\$ -
母 公 司	107,626	185,554	1,058	2,178
其他關係人	1,884	183	9,859	958
	<u>\$ 2,444,665</u>	<u>\$ 1,446,900</u>	<u>\$ 11,984</u>	<u>\$ 3,136</u>

	營業費用	租金收入	
	102年度	101年度	102年度
母 公 司	\$ 170	\$ 454	\$ -
具重大影響力之投資者	39	937	151,006
其他關係人	672	1,289	-
	<u>\$ 881</u>	<u>\$ 2,680</u>	<u>\$ 151,006</u>

	購置固定資產價款	
	102年度	
具重大影響力之投資者	\$ 57,943	
其他關係人	47,358	
母 公 司	26,978	
	<u>\$132,279</u>	

報導期間結束日之流通在外餘額如下：

	應 收	關 係 人	款 項
	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
具重大影響力之投資者	\$ 516,348	\$ 203,159	\$ 241,333
母 公 司	-	36,434	17,326
其他關係人	83	28	-
	<u>\$ 516,431</u>	<u>\$ 239,621</u>	<u>\$ 258,659</u>

	其 他 應	收 關 係	人 款 項
	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
具重大影響力之投資者	\$ 141,190	\$ -	\$ -
母 公 司	-	-	19,686
	<u>\$ 141,190</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 19,686</u>

	其 他	流 動	資 產
	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
具重大影響力之投資者	\$ 678	\$ 771	\$ 225
母 公 司	-	293	371
	<u>\$ 678</u>	<u>\$ 1,064</u>	<u>\$ 596</u>

	應 付 費 用 及 其 他	流 動 負 債	
	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
具重大影響力之投資者	\$ 3,310	\$ -	\$ -
母 公 司	-	364	181
其他關係人	-	4	740
	<u>\$ 3,310</u>	<u>\$ 368</u>	<u>\$ 921</u>

	應 付 工 程 及 設 備 款		
	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
具重大影響力之投資者	\$ 55,130	\$ -	\$ -

本公司與關係人之銷貨交易，其交易價格與收款條件與非關係人並無重大差異，其餘關係人交易，因無相關同類交易可循，其交易條件係由雙方協商決定。

本公司出租機器設備與台積公司，租約內容係由租賃雙方協議決定，租金按季支付，相關之租金收入帳列其他收益及費損項下。

(二) 對主要管理階層之獎酬

本公司 102 及 101 年度對董事及其他主要管理階層成員之薪酬總額如下：

	102年度	101年度
短期員工福利	\$ 41,460	\$ 28,404
退職後福利	756	805
股份基礎給付	<u>11,933</u>	<u>859</u>
	<u>\$ 54,149</u>	<u>\$ 30,068</u>

董事及其他主要管理階層之薪酬係由薪酬委員會依照個人績效及市場趨勢決定。

三二、質抵押之資產

本公司於 102 年及 101 年 12 月 31 日分別提供機器設備 135,288 仟元及銀行定期存款（帳列其他金融資產項下）2,255 仟元作為長期銀行借款及承租辦公室之擔保品。

三三、重大營業租賃協議

本公司廠房及辦公室主係向經濟部工業局中壢工業區承租，租期將於 103 年 8 月至 109 年 10 月陸續到期，其中經濟部工業局中壢工業區得依規定調整租金，所有租約到期時均可再續約。

本公司認列為費用之租賃給付如下：

	102年度	101年度
最低租賃給付	<u>\$ 48,624</u>	<u>\$ 45,920</u>

本公司因上述不可取消之營業租賃所負擔之未來最低租賃給付如下：

	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
1 年 內	\$ 46,372	\$ 42,112	\$ 33,860
超過 1 年但未超過 5 年	105,115	70,281	72,249
超過 5 年	<u>9,327</u>	<u>9,007</u>	<u>21,607</u>
	<u>\$ 160,814</u>	<u>\$ 121,400</u>	<u>\$ 127,716</u>

三四、重大或有負債及未認列之合約承諾

除已於其他附註揭露者外，本公司於資產負債表日尚有下列重大或有負債及未認列之合約承諾：

(一) 依本公司於 89 年 5 月與 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. (原以色列商雪兒凱斯 ShellCase Ltd.) 簽訂之技術授權合約，本公司於合約有效期間內分期支付之技術授權費已於 90 年 6 月全數支付完畢。該技術授權費帳列無形資產之專門技術項下，且按合約年限攤銷。另依該合約規定，自 92 年 4 月起連續 12 年，若使用該特定技術製造及銷售產品時，依合約規定應按其特定產品銷貨收入淨額之若干比率支付權利金。

(二) 本公司承諾購置之固定資產合約總價約為 583,576 仟元。

三五、外幣金融資產及負債之匯率資訊

本公司具重大影響之外幣金融資產及負債資訊如下：

單位：各外幣仟元

	外	幣	匯 率 (註)	帳 面 金 額
<u>102 年 12 月 31 日</u>				
金融資產				
貨幣性項目				
美 金	\$	30,280	29.800	\$ 902,358
日 幣		6,751	0.2839	1,917
歐 元		343	41.09	14,109
瑞士法郎		247	33.49	8,263
金融負債				
貨幣性項目				
美 金		5,474	29.800	163,128
日 幣		8,303	0.2839	2,357
歐 元		353	41.09	14,498
瑞士法郎		247	33.49	8,263

(接 次 頁)

(承前頁)

	外	幣	匯 率 (註)	帳 面 金 額
<u>101 年 12 月 31 日</u>				
金融資產				
貨幣性項目				
美 金	\$	18,368	29.038	\$ 533,359
日 幣		1,965	0.3364	660
歐 元		39	38.49	1,502
瑞士法郎		211	31.83	6,721
金融負債				
貨幣性項目				
美 金		4,375	29.038	127,046
日 幣		2,916	0.3364	980
歐 元		28	38.49	1,091
瑞士法郎		211	31.83	6,721
<u>101 年 1 月 1 日</u>				
金融資產				
貨幣性項目				
美 金		19,673	30.288	595,852
日 幣		21,740	0.3906	8,492
歐 元		235	39.18	9,196
瑞士法郎		443	32.18	14,265
英 鎊		17	46.73	815
金融負債				
貨幣性項目				
美 金		3,209	30.288	97,194
日 幣		19,267	0.3906	7,530
歐 元		249	39.18	9,773
瑞士法郎		437	32.18	14,074
英 鎊		17	46.73	815

註：匯率係每單位外幣兌換為新台幣之金額。

三六、營運部門資訊

(一) 營運部門資訊

經依據主要營運決策者定期複核用以分配資源及績效衡量之營運結果，本公司係屬單一營運部門。營運部門損益、資產及負債之衡量基礎與財務報表編製基礎相同，相關營運部門資訊請參閱前述之財務報表。

(二) 地區別資訊如下：

地 區	102 年度	101 年度
美 國	\$ 1,630,592	\$ 1,481,268
台 灣	1,190,213	510,443
歐 洲	475,527	482,356
香 港	484,393	443,477
亞 洲	476,036	219,359
其 他	-	2,482
	<u>\$ 4,256,761</u>	<u>\$ 3,139,385</u>

本公司地區別收入係以收款地區為計算基礎；非流動資產全部皆在台灣，故無需揭露非流動資產資訊。

(三) 產品別資訊如下：

產 品 別	102 年度	101 年度
晶圓封裝	\$ 4,229,046	\$ 3,112,169
其 他	27,715	27,216
	<u>\$ 4,256,761</u>	<u>\$ 3,139,385</u>

(四) 重要客戶資訊如下：

佔本公司營業收入淨額百分之十以上之客戶明細如下：

客 戶	102 年度		101 年度	
	金 額	所佔比例 (%)	金 額	所佔比例 (%)
甲 公 司	\$ 1,580,579	37	\$ 1,261,163	40
乙 公 司	862,202	20	185,554	6
丙 公 司	484,182	11	443,542	14
丁 公 司	422,281	10	628,443	20

三七、首次採用國際財務報導準則

(一) 國際財務報導準則財務資訊之編製基礎

本公司 102 年度之財務報告之編製基礎除遵循附註四說明之重大會計政策外，亦遵循國際財務報導準則第 1 號之規定。

(二) 國際財務報導準則第 1 號之豁免

國際財務報導準則第 1 號係說明當本公司首次採用國際財務報導準則作為編製財務報告之基礎時應遵循之程序。依據該準則，本公司須建立國際財務報導準則下之會計政策，且應追溯適用該等會

計政策以決定轉換日之初始資產負債表，惟該準則亦對追溯適用之原則提供若干選擇性豁免及強制性例外規定。本公司所採用之主要選擇性豁免彙總說明如下：

1. 員工福利

本公司選擇將與員工福利計畫有關之所有累積精算損益於101年1月1日認列於保留盈餘。

此外，本公司亦選擇適用國際財務報導準則第1號所提供之豁免揭露規定，得就自轉換日起各會計期間推延決定之金額，揭露確定福利義務現值、計畫資產公允價值、計畫盈虧以及經驗調整等資訊。

2. 股份基礎給付

本公司對所有在101年1月1日前已給與並已既得之股份基礎給付交易，選擇豁免追溯適用國際財務報導準則第2號「股份基礎給付」之規定。

(三) 轉換至國際財務報導準則之影響

轉換至國際財務報導準則後，對本公司101年12月31日及1月1日（轉換日）之資產負債表暨101年度綜合損益表之影響如下：

1. 101年12月31日資產負債表項目之調節

中華民國一般公認會計原則	轉換至國際財務報導準則之影響	國際財務報導準則	國際財務報導準則
項目金額	認列及衡量差異	表達差異	金額項目說明
流動資產			
現金及約當現金	\$ 770,750	\$ -	\$ 770,750 現金及約當現金
公平價值變動列入損益之金融資產	504	-	504 透過損益按公允價值衡量之金融資產
應收關係人款項	239,621	-	239,621 應收關係人款項
應收票據及帳款	181,451	(3,157)	178,294 應收票據及帳款
備抵呆帳	(3,157)	-	-
備抵銷貨退回及折讓	(31,353)	-	-
其他金融資產	2,984	-	2,984 其他金融資產
存貨	149,449	-	149,449 存貨
遞延所得稅資產	14,990	(14,990)	-
預付費用及其他流動資產	71,516	-	71,516 其他流動資產
流動資產合計	1,396,755	-	1,413,118 流動資產合計
固定資產	4,453,092	-	4,453,092 不動產、廠房及設備
無形資產	82,535	-	82,535 無形資產
其他資產			
遞延所得稅資產	58,952	-	73,942 遞延所得稅資產
存出保證金	8,269	-	8,269 存出保證金
預付退休金	17,161	(17,161)	-
其他資產合計	84,382	(17,161)	14,990
資產總計	\$ 6,016,764	(\$ 17,161)	\$ 6,030,956 資產總計

(接次頁)

(承前頁)

中華民國一般公認會計原則	轉換至國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務		
項	金	認列及衡量差異	表	達	金	項	說
目	額		達	差	額	目	明
流動負債							
公平價值變動列入損益之金融負債	\$ 55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55	透過損益按公允價值衡量之金融負債	
應付票據及帳款	155,760	-	-	-	155,760	應付票據及帳款	
應付工程及設備款	192,214	-	-	-	192,214	應付工程及設備款	
應付費用及其他流動負債	299,972	-	-	-	299,972	應付費用及其他流動負債	
一年內到期之長期銀行借款	128,125	-	-	-	128,125	一年內到期之長期銀行借款	
—	-	-	31,353	-	31,353	負債準備	(1)
流動負債合計	776,126	-	31,353	-	807,479		
長期負債							
長期銀行借款	1,359,375	-	-	-	1,359,375	長期銀行借款	
長期應付款項	24,536	-	-	-	24,536	負債準備	
長期負債合計	1,383,911	-	-	-	1,383,911		
其他負債							
應計退休金負債	-	3,933	-	-	3,933	應計退休金負債	(4)
其他負債合計	-	3,933	-	-	3,933		
負債合計	2,160,037	3,933	31,353	-	2,195,323	負債合計	
股本						股本	
普通股股本	2,362,079	-	-	-	2,362,079	普通股股本	
資本公積						資本公積	
股本溢價	507,239	-	-	-	507,239	股本溢價	
員工認股權	6,219	-	-	-	6,219	員工認股權	
資本公積合計	513,458	-	-	-	513,458	資本公積合計	
保留盈餘							
法定盈餘公積	167,800	-	-	-	167,800	法定盈餘公積	
特別盈餘公積	232	-	-	-	232	特別盈餘公積	
未分配盈餘	813,158	(21,094)	-	-	792,064	未分配盈餘	
保留盈餘合計	981,190	(21,094)	-	-	960,096	保留盈餘合計	
股東權益合計	3,856,727	(21,094)	-	-	3,835,633	權益合計	
負債及股東權益總計	\$ 6,016,764	(\$ 17,161)	\$ 31,353	-	\$ 6,030,956	負債及權益總計	

2. 101 年 1 月 1 日資產負債表項目之調節

中華民國一般公認會計原則	轉換至國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務
項	報	導	準	則	之	影
目	金	額	認列及衡量差異	表	達	差異
金	額	項	目	說	明	
流動資產						
現金及約當現金	\$ 675,441	\$ -	\$ -	\$ 675,441	現金及約當現金	
公平價值變動列入損益之金融資產	223	-	-	223	透過損益按公允價值衡量之金融資產	
應收關係人款項	258,659	-	-	258,659	應收關係人款項	
應收票據及帳款	217,182	(3,161)	(3,161)	214,021	應收票據及帳款	
備抵呆帳	(3,161)	-	3,161	-	—	
備抵銷貨退回及折讓	(36,033)	-	36,033	-	—	(1)
其他金融資產	99	-	-	99	其他金融資產	
其他應收關係人款項	19,686	-	-	19,686	其他應收關係人款項	
存貨	151,975	-	-	151,975	存貨	
遞延所得稅資產	30,516	-	(30,516)	-	—	(2)
預付費用及其他流動資產	48,065	-	-	48,065	其他流動資產	
流動資產合計	1,362,652	-	5,517	1,368,169	流動資產合計	
固定資產	4,980,991	-	-	4,980,991	不動產、廠房及設備	(3)
無形資產	99,900	-	-	99,900	無形資產	
其他資產						
遞延所得稅資產	24,940	-	30,516	55,456	遞延所得稅資產	(2)
存出保證金	7,776	-	-	7,776	存出保證金	
預付退休金	16,185	(16,185)	-	-	—	(4)
其他資產合計	48,901	(16,185)	30,516	63,232		
資產總計	\$ 6,492,444	(\$ 16,185)	\$ 36,033	\$ 6,512,292	資產總計	

(接次頁)

(承前頁)

中華民國一般公認會計原則	轉換至國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際財務	國際

3. 101 年度綜合損益表項目之調節

中 華 民 國 一 般 公 認 會 計 原 則		轉 換 至 國 際 財 務 報 導 準 則 之 影 響		國 際 財 務 報 導 準 則			
項 目	金 額	認 列 及 衡 量 差 異	表 達 差 異	金 額	項 目	說 明	
營業收入淨額	\$ 3,139,385	\$ -	\$ -	\$ 3,139,385	營業收入淨額		
營業成本	2,890,145	(612)	-	2,889,533	營業成本	(4)	
營業毛利	249,240	612	-	249,852	營業毛利		
營業費用							
行銷費用	34,341	(36)	-	34,305	行銷費用	(4)	
管理費用	90,705	(147)	-	90,558	管理費用	(4)	
研究發展費用	206,294	(177)	-	206,117	研究發展費用	(4)	
合 計	331,340	(360)	-	330,980			
—	-	-	(15,112)	(15,112)	其他營業收益及費損淨額	(5)	
營業淨損	(82,100)	972	(15,112)	(96,240)	營業淨損		
營業外收入及利益							
金融商品評價淨益	19,339	-	(19,339)	-	—	(5)	
賠償收入	8,956	-	(8,956)	-	—	(5)	
利息收入	4,194	-	-	4,194	利息收入		
處分固定資產利益	2,792	-	(2,792)	-	—	(5)	
其他收入	769	-	(769)	-	—	(5)	
—	-	-	(2,317)	(2,317)	其他利益及損失	(5)	
合 計	36,050	-	(34,173)	1,877			

(接次頁)

(承前頁)

中華民國一般公認會計原則	轉換至國際財務報告準則之影響	國際財務報告準則
項 目	金 額	金 額
營業外費用及損失		
閒置資產減損損失	\$ 26,175	\$ - (\$ 26,175)
兌換淨損	22,333	- (22,333)
利息費用	13,406	- 13,406
處分固定資產損失	727	- (727)
其他損失	50	- (50)
合 計	62,691	(49,285)
稅前淨損	(108,741)	972 - (107,769)
所得稅利益	17,564	- 17,564
本年度淨損	(\$ 91,177)	\$ 972 \$ - (90,205)
		232
		現金流量避險
		確定福利之精算
		利益
		339
		本年度其他綜合
		損益（稅後淨
		額）
		571
		本年度綜合損益
		總額
		(\$ 89,634)

4. 權益之調節

	說 明	101年12月31日	101年1月1日
中華民國一般公認會計原則下之			
權益調整項目		\$ 3,856,727	\$ 3,959,849
確定福利計畫之調整	4	(<u>21,094</u>)	(<u>22,405</u>)
國際財務報導準則下之權益		<u>\$ 3,835,633</u>	<u>\$ 3,937,444</u>

5. 101 年度現金流量表重大調整說明

本公司依中華民國原一般公認會計原則按間接法編製之現金流量表，係將利息收現數及利息支付數作為營業活動之現金流量，且未被要求單獨揭露利息收現數。惟依國際會計準則第 7 號「現金流量表」之規定，本公司 101 年度之利息收現數為 4,106 仟元應單獨揭露，且依其性質將利息收現數表達為投資活動之現金流量，而利息支付數為 12,693 仟元則表達為籌資活動之現金流量。

除上述差異外，依國際財務報導準則編製之現金流量表與依中華民國原一般公認會計原則所編製者，並無其他重大差異。

(四) 轉換至國際財務報導準則之調節說明

1. 備抵退貨及折讓

於中華民國一般公認會計原則下，銷貨退回及折讓係依經驗估計可能發生之產品退回及折讓，於產品出售當期列為銷貨收入之減項，並認列備抵銷貨退回及折讓作為應收帳款之減

項；轉換為 IFRSs 後，由於原帳列備抵退貨及折讓係因過去事件所產生之現時義務，且金額及時點並不確定，故依國際會計準則第 37 號「負債準備、或有負債及或有資產」重分類為負債準備（帳列流動負債項下）。

截至 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日，本公司重分類至負債準備之金額分別為 31,353 仟元及 36,033 仟元。

2. 遞延所得稅之分類及備抵評價科目

依中華民國一般公認會計原則之規定，遞延所得稅資產及負債依其相關資產或負債之分類劃分為流動或非流動項目，無相關之資產或負債者，依預期迴轉期間之長短劃分為流動或非流動項目。轉換至 IFRSs 後，遞延所得稅資產或負債一律分類為非流動項目。

另依中華民國一般公認會計原則之規定，遞延所得稅資產於評估其可實現性後，認列相關備抵評價金額。轉換至 IFRSs 後，依國際會計準則第 12 號「所得稅」之規定，僅當所得稅利益「很有可能」實現時始認列為遞延所得稅資產，故不再使用備抵評價科目。

截至 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日，本公司遞延所得稅資產重分類至非流動資產之金額分別為 14,990 仟元及 30,516 仟元。

3. 閒置資產之分類

轉換為 IFRSs 後，原帳列其他資產項下之閒置資產依其性質重分類為不動產、廠房及設備。

截至 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日，本公司將閒置資產成本重分類至不動產、廠房及設備之金額分別為 180,171 仟元及 155,648 仟元；累計折舊及減損重分類至不動產、廠房及設備之金額亦分別為 180,171 仟元及 155,648 仟元；上述重分類淨額均為零。

4. 員工福利

依中華民國一般公認會計原則之規定，本公司對確定福利義務進行精算評價並認列相關退休金成本及應計退休金負債；轉換至 IFRSs 後，應依國際會計準則第 19 號「員工福利」之規定，對確定福利義務進行精算評價。

另依中華民國一般公認會計原則之規定，不允許直接將退休金計畫相關精算損益直接認列於權益項下，而須採用緩衝區法認列。採用緩衝區法認列精算損益時，應按可獲得退休金給付在職員工之平均剩餘服務年限攤銷。

惟依國際會計準則第 19 號「員工福利」規定，本公司選擇將來自於確定福利計畫之精算損益立即認列於其他綜合損益項下。認列於其他綜合損益者係立即認列於保留盈餘，於後續期間不得重分類至損益。

截至 101 年 12 月 31 日及 1 月 1 日，預付退休金因上述差異分別調整減少 17,161 仟元及 16,185 仟元，應計退休金負債分別調整增加 3,933 仟元及 6,220 仟元；101 年度退休金成本調整減少 972 仟元及認列確定福利之精算利益 339 仟元於其他綜合損益項下。

5. 綜合損益表之調節說明

本公司原依中華民國修正前證券發行人財務報告編製準則編製之損益表，其營業利益僅包含營業收入、營業成本及營業費用。轉換至 IFRSs 後，本公司依營業交易之性質將處分不動產、廠房及設備之淨損益、不動產、廠房及設備減損損失及賠償收入重分類至其他營業收益及費損項下，並包含於營業利益內，而兌換淨損益及金融商品評價損益等重分類至其他利益及損失項下，利息費用則重分類至財務成本項下。

三八、附註揭露事項

(一) 重大交易事項：

1. 資金貸與他人：無。
2. 為他人背書保證：無。

3. 期末持有有價證券情形：

單位：新台幣仟元

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目	期 末				備註
				股數／單位數(仟)	帳面金額	持股比例(%)	公允價值	
本公司	美商坎伯狄吉有限公司 (Compositech Ltd.)	—	以成本衡量之金融資產	587	\$ -	2.67	\$ -	註一

註一：本公司於 91 年度下市，本公司已於該年度全數提列減損損失。

註二：截至 102 年 12 月 31 日止，上述有價證券並未提供擔保、質押或其他依約定而受限制使用者。

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
5. 取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
6. 處分不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上：無。
7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣仟元

進(銷)貨之公司	交易對象	關係	交 易 情 形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	OmniVision	本公司法人董事之母公司	銷貨	\$1,580,579	37%	月結 30 天	參閱附註三一	參閱附註三一	\$ 222,084	30%	—
	台積公司	對本公司採權益法評價之投資公司	銷貨	862,202	20%	月結 30 天	參閱附註三一	參閱附註三一	294,264	39%	—

8. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：

單位：新台幣仟元

帳列應收款項之公司	交易對象	關係	應收關係人款項餘額	週轉天數	逾期應收關係人款項金額	處理方式	應收關係人款項期後收回金額	提列備抵呆帳金額
本公司	台積公司	對本公司採權益法評價之投資公司	\$ 294,264	70	\$ -	—	\$ 294,243	\$ -
	OmniVision	本公司法人董事之母公司	222,084	49	-	—	222,084	-

9. 從事衍生性金融商品交易：請詳附註七及八。

(二) 轉投資事業相關資訊：無。

(三) 大陸投資資訊：無。

精材科技股份有限公司

財務報告暨會計師查核報告

民國 103 及 102 年度

地址：桃園市中壢區吉林路23號9樓

電話：(03)4331818

會計師查核報告

精材科技股份有限公司 公鑒：

精材科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表與現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達精材科技股份有限公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 鴻 鵬

林 鴻 鵬



會計師 黃 裕 峰

黃 裕 峰



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

中 華 民 國

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號

台財證六字第 0920123784 號

1 0 4 年 2 月 4 日



精材科技股份有限公司

資產負債表

民國 103 年及 102 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼	資 產	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		代 碼	負 債 及 權 益	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日	
		金	%	金	%			金	%	金	%
	流動資產						流動負債				
1100	現金及約當現金（附註六）	\$ 806,445	9	\$ 1,031,142	12	2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債（附註七）	12,644	-	\$ 7,235	-
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產（附註七）	389	-	172	-	2125	避險之衍生金融負債（附註八）	823	-	281	-
1170	應收帳款淨額（附註九）	265,766	3	235,348	3	2170	應付帳款（附註三一）	287,046	3	243,857	3
1180	應收關係人款項（附註九及三一）	673,319	8	516,431	6	2201	應付薪資及獎金	199,664	2	147,858	2
1210	其他應收關係人款項（附註三一）	-	-	141,190	2	2206	應付員工紅利及董事酬勞（附註十九）	87,187	1	43,161	1
1310	存貨（附註五及十）	213,777	2	216,770	2	2213	應付工程及設備款（附註三一）	460,129	5	305,961	4
1476	其他金融資產	2,697	-	310	-	2230	當期所得稅負債（附註二六）	83,678	1	28,914	-
1479	其他流動資產（附註十四及三一）	<u>72,858</u>	<u>1</u>	<u>70,404</u>	<u>1</u>	2250	負債準備（附註五及十五）	60,155	1	50,640	1
11XX	流動資產合計	<u>2,035,251</u>	<u>23</u>	<u>2,211,767</u>	<u>26</u>	2320	一年內到期之長期銀行借款（附註十七及三二）	275,000	3	196,875	2
	非流動資產					2399	存入保證金（附註十六）	-	-	1,016,977	12
1543	以成本衡量之金融資產（附註十一）	-	-	-	-	2399	應付費用及其他流動負債（附註三一）	<u>294,124</u>	<u>4</u>	<u>267,440</u>	<u>3</u>
1600	不動產、廠房及設備（附註五、十二及三二）	6,591,778	75	6,026,007	72	21XX	流動負債合計	<u>1,760,450</u>	<u>20</u>	<u>2,309,199</u>	<u>28</u>
1780	無形資產（附註十三）	87,437	1	71,694	1		非流動負債				
1840	遞延所得稅資產（附註五及二六）	102,010	1	44,139	1	2541	長期銀行借款（附註十七及三二）	2,387,500	27	1,912,500	23
1920	存出保證金	8,904	-	8,550	-	2550	負債準備（附註十五）	25,076	-	24,536	-
1975	預付退休金（附註十八）	<u>1,889</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	2640	應計退休金負債（附註十八）	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>506</u>	<u>-</u>
15XX	非流動資產合計	<u>6,792,018</u>	<u>77</u>	<u>6,150,390</u>	<u>74</u>	25XX	非流動負債合計	<u>2,412,576</u>	<u>27</u>	<u>1,937,542</u>	<u>23</u>
						2XXX	負債合計	<u>4,173,026</u>	<u>47</u>	<u>4,246,741</u>	<u>51</u>
							權 益				
							股本（附註十九）				
						3110	普通股股本	<u>2,381,207</u>	<u>27</u>	<u>2,364,018</u>	<u>28</u>
						3200	資本公積（附註十九）	<u>547,724</u>	<u>6</u>	<u>524,855</u>	<u>6</u>
							保留盈餘（附註十九）				
						3310	法定盈餘公積	196,688	2	167,800	2
						3320	特別盈餘公積	281	-	-	-
						3350	未分配盈餘	<u>1,529,166</u>	<u>18</u>	<u>1,059,024</u>	<u>13</u>
						3300	保留盈餘合計	<u>1,726,135</u>	<u>20</u>	<u>1,226,824</u>	<u>15</u>
						3400	其他權益（附註十九）	<u>(823)</u>	<u>-</u>	<u>(281)</u>	<u>-</u>
						3XXX	權益合計	<u>4,654,243</u>	<u>53</u>	<u>4,115,416</u>	<u>49</u>
1XXX	資 產 總 計	<u>\$ 8,827,269</u>	<u>100</u>	<u>\$ 8,362,157</u>	<u>100</u>		負 債 與 權 益 總 計	<u>\$ 8,827,269</u>	<u>100</u>	<u>\$ 8,362,157</u>	<u>100</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董 事 長：



經 理 人：



會 計 主 管：



精材科技股份有限公司

綜合損益表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入淨額（附註五、二一及三一）	\$ 4,934,078	100	\$ 4,256,761	100
5000	營業成本（附註十、二八及三一）	<u>3,985,874</u>	<u>81</u>	<u>3,561,619</u>	<u>84</u>
5950	營業毛利	<u>948,204</u>	<u>19</u>	<u>695,142</u>	<u>16</u>
	營業費用（附註二八及三一）				
6100	行銷費用	39,809	1	38,049	1
6200	管理費用	147,006	3	110,494	2
6300	研究發展費用	<u>276,680</u>	<u>5</u>	<u>216,971</u>	<u>5</u>
6000	合 計	<u>463,495</u>	<u>9</u>	<u>365,514</u>	<u>8</u>
6500	其他營業收益及費損淨額（附註二二、二八及三一）	<u>190,921</u>	<u>4</u>	<u>51,008</u>	<u>1</u>
6900	營業淨利	<u>675,630</u>	<u>14</u>	<u>380,636</u>	<u>9</u>
	營業外收入及支出				
7100	利息收入（附註二三）	6,114	-	4,575	-
7050	財務成本（附註二四）	(33,958)	-	(28,158)	(1)
7020	其他利益及損失（附註二五）	<u>12,140</u>	<u>-</u>	<u>(8,290)</u>	<u>-</u>
7000	合 計	<u>(15,704)</u>	<u>-</u>	<u>(31,873)</u>	<u>(1)</u>
7900	稅前淨利	659,926	14	348,763	8
7950	所得稅費用（附註二六）	<u>(31,273)</u>	<u>(1)</u>	<u>(59,882)</u>	<u>(1)</u>
8200	本年度淨利	<u>628,653</u>	<u>13</u>	<u>288,881</u>	<u>7</u>

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103年度		102年度	
		金 額	%	金 額	%
	其他綜合損益				
8330	現金流量避險（附註十九）	(542)	-	(281)	-
8360	確定福利之精算利益（附註十八）	679	-	1,469	-
8300	本年度其他綜合損益	137	-	1,188	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 628,790</u>	<u>13</u>	<u>\$ 290,069</u>	<u>7</u>
	每股盈餘（附註二七）				
9750	基本每股盈餘	<u>\$ 2.65</u>		<u>\$ 1.22</u>	
9850	稀釋每股盈餘	<u>\$ 2.60</u>		<u>\$ 1.21</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



精材科技股份有限公司

權益變動表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		股	本	資 本 公 積	保	留	盈	餘	其 他 權 益 項 目	權 益 合 計
		股 數 (仟 股)	金 額		法 定 盈 餘 公 積	特 別 盈 餘 公 積	未 分 配 盈 餘	保 留 盈 餘 合 計	現 金 流 量 避 險	
A1	102 年 1 月 1 日餘額	236,208	\$ 2,362,079	\$ 513,458	\$ 167,800	\$ 232	\$ 792,064	\$ 960,096	\$ -	\$ 3,835,633
	101 年度盈餘分配									
B17	迴轉特別盈餘公積	-	-	-	-	(232)	232	-	-	-
B5	股東現金股利—每股 0.10 元	-	-	-	-	-	(23,622)	(23,622)	-	(23,622)
	盈餘分配合計	-	-	-	-	(232)	(23,390)	(23,622)	-	(23,622)
D1	102 年度淨利	-	-	-	-	-	288,881	288,881	-	288,881
D3	102 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	1,469	1,469	(281)	1,188
D5	102 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	290,350	290,350	(281)	290,069
N1	員工執行認股權	194	1,939	864	-	-	-	-	-	2,803
N1	認列員工認股權酬勞成本	-	-	10,533	-	-	-	-	-	10,533
Z1	102 年 12 月 31 日餘額	236,402	2,364,018	524,855	167,800	-	1,059,024	1,226,824	(281)	4,115,416
	102 年度盈餘分配									
B1	提列法定盈餘公積	-	-	-	28,888	-	(28,888)	-	-	-
B3	提列特別盈餘公積	-	-	-	-	281	(281)	-	-	-
B5	股東現金股利—每股 0.55 元	-	-	-	-	-	(130,021)	(130,021)	-	(130,021)
	盈餘分配合計	-	-	-	28,888	281	(159,190)	(130,021)	-	(130,021)
D1	103 年度淨利	-	-	-	-	-	628,653	628,653	-	628,653
D3	103 年度稅後其他綜合損益	-	-	-	-	-	679	679	(542)	137
D5	103 年度綜合損益總額	-	-	-	-	-	629,332	629,332	(542)	628,790
N1	員工執行認股權	1,719	17,189	18,058	-	-	-	-	-	35,247
N1	認列員工認股權酬勞成本	-	-	4,811	-	-	-	-	-	4,811
Z1	103 年 12 月 31 日餘額	238,121	\$ 2,381,207	\$ 547,724	\$ 196,688	\$ 281	\$ 1,529,166	\$ 1,726,135	(\$ 823)	\$ 4,654,243

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



精材科技股份有限公司

現金流量表

民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼		103 年度	102 年度
	營業活動之現金流量：		
A10000	稅前淨利	\$ 659,926	\$ 348,763
A20010	不影響現金流量之收益費損項目		
A20100	折舊費用	1,289,574	869,000
A20200	攤銷費用	26,877	33,976
A20300	呆帳費用提列（迴轉）數	522	(3,157)
A20900	財務成本	33,958	28,158
A21200	利息收入	(6,114)	(4,575)
A21900	員工認股權酬勞成本	4,811	10,533
A22500	處分不動產、廠房及設備淨益	(236)	(2,670)
A22600	不動產、廠房及設備轉列費損	15,222	-
A23700	提列不動產、廠房及設備減損損失	86,067	3,804
A24100	外幣兌換淨損（益）	(2,946)	642
A30000	營業資產及負債之淨變動數：		
A31110	衍生金融工具	5,192	7,512
A31150	應收票據及帳款淨額	(30,731)	(53,897)
A31160	應收關係人款項	(157,097)	(276,810)
A31190	其他應收關係人款項	141,190	(141,190)
A31200	存 貨	2,993	(67,321)
A31240	其他流動資產	5,213	2,070
A31250	其他金融資產	177	331
A32150	應付帳款	43,189	88,097
A32180	應付薪資及獎金	51,806	32,570
A32200	負債準備	9,515	19,287
A32230	存入保證金	(1,016,977)	1,016,977
A32230	應付費用及其他流動負債	26,426	82,127
A32240	應計退休金負債	(1,716)	(1,958)
A32990	應付員工紅利及董監酬勞	44,026	43,161
A33000	營運產生之現金	1,230,867	2,035,430
A33500	支付所得稅	(33,970)	(1,165)
AAAA	營業活動之淨現金流入	1,196,897	2,034,265

投資活動之現金流量：

（接次頁）

(承前頁)

代 碼		103 年度	102 年度
B02700	購置不動產、廠房及設備	(1,808,000)	(2,334,007)
B02800	處分不動產、廠房及設備價款	236	4,063
B03700	存出保證金增加	(3,564)	(688)
B03800	存出保證金減少	3,210	407
B04500	購置無形資產	(42,620)	(23,135)
B06600	質押銀行存款減少	-	2,255
B07500	收取之利息	<u>6,054</u>	<u>4,663</u>
BBBB	投資活動之淨現金流出	(<u>1,844,684</u>)	(<u>2,346,442</u>)
籌資活動之現金流量：			
C01600	舉借長期借款	1,650,000	1,620,000
C01700	償還長期借款	(1,096,875)	(998,125)
C04500	發放現金股利	(130,021)	(23,622)
C04800	員工行使認股權發行新股	35,247	2,803
C05600	支付之利息	(<u>35,261</u>)	(<u>28,487</u>)
CCCC	籌資活動之淨現金流入	<u>423,090</u>	<u>572,569</u>
EEEE	現金及約當現金淨增加（減少）數	(224,697)	260,392
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>1,031,142</u>	<u>770,750</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 806,445</u>	<u>\$ 1,031,142</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：



經理人：



會計主管：



精材科技股份有限公司

財務報表附註

民國 103 及 102 年度

(除另註明外，金額以新台幣仟元為單位)

一、公司沿革

一、公司沿革

精材科技股份有限公司（以下簡稱本公司）於 87 年 9 月 11 日經經濟部核准設立，主要營業項目為半導體之晶圓級尺寸封裝及晶圓級後護層封裝業務。本公司股票自 93 年 9 月起經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准於興櫃股票櫃檯買賣，並於 104 年 1 月 23 日經該中心董事會通過上櫃申請案，待辦理後續相關程序後，預計於 104 年上半年掛牌上櫃買賣。本公司註冊地及業務主要營運據點為桃園市中壢區吉林路 23 號 9 樓。

本公司之母公司原為台灣積體電路製造股份有限公司（以下簡稱台積公司），於 102 年 6 月起對本公司之財務及營運政策不具控制力，故對本公司改採權益法評價。

二、通過財務報告之日期及程序

本財務報告業已於 104 年 2 月 4 日經本公司董事會核准並通過發布。

三、新發布及修訂準則及解釋之適用

截至本財務報告通過發布日止，本公司尚未適用下列經國際會計準則理事會（IASB）發布之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告（以下稱「IFRSs」）。

(一) 已發布但未生效之證券發行人財務報告編製準則及 2013 年版之 IFRSs

依據金融監督管理委員會（以下稱「金管會」）發布之金管證審字第 1030029342 號及金管證審字第 1030010325 號函，本公司應自 104 年起開始適用下列業經 IASB 發布且經金管會認可之 2013 年版 IFRSs 及相關證券發行人財務報告編製準則修正規定。

新 發 布 / 修 正 / 修 訂 準 則 及 解 釋	I A S B 發 布 之 生 效 日
國際財務報導準則之修正「國際財務報導準則之改善—對國際會計準則第 39 號之修正 (2009 年) 國際會計準則第 39 號之修正「嵌入式衍生工具」	2009 年 1 月 1 日或 2010 年 1 月 1 日
「國際財務報導準則之改善 (2010 年)」	於 2009 年 6 月 30 日以後結束之年度期間生效 2010 年 7 月 1 日或 2011 年 1 月 1 日
「2009 年-2011 年週期之年度改善」	2013 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 1 號之修正「國際財務報導準則第 7 號之比較揭露對首次採用者之有限度豁免」	2010 年 7 月 1 日
國際財務報導準則第 1 號之修正「嚴重高度通貨膨脹及首次採用者固定日期之移除」	2011 年 7 月 1 日
國際財務報導準則第 1 號之修正「政府貸款」	2013 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 7 號之修正「揭露—金融資產及金融負債互抵」	2013 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 7 號之修正「揭露—金融資產之移轉」	2011 年 7 月 1 日
國際財務報導準則第 10 號「合併財務報表」	2013 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 11 號「聯合協議」	2013 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 12 號「對其他個體權益之揭露」	2013 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 10 號、第 11 號及第 12 號之修正「合併財務報表、聯合協議及對其他個體權益之揭露：過渡規定指引」	2013 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 10 號、第 12 號及國際會計準則第 27 號之修正「投資個體」	2014 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 13 號「公允價值衡量」	2013 年 1 月 1 日
國際會計準則第 1 號之修正「其他綜合損益項目之表達」	2012 年 7 月 1 日
國際會計準則第 12 號之修正「遞延所得稅：標的資產之回收」	2012 年 1 月 1 日
國際會計準則第 19 號之修正「員工福利」	2013 年 1 月 1 日
國際會計準則第 27 號之修正「單獨財務報表」	2013 年 1 月 1 日
國際會計準則第 28 號之修正「投資關聯企業及合資」	2013 年 1 月 1 日
國際會計準則第 32 號之修正「金融資產及金融負債互抵」	2014 年 1 月 1 日
國際財務報導解釋第 20 號「露天礦場於生產階段之剝除成本」	2013 年 1 月 1 日

註：除另註明外，上述新發布／修正／修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度期間生效。

除下列說明外，適用上述 2013 年版 IFRSs 及相關證券發行人財務報告編製準則修正規定將不致造成本公司會計政策之重大變動：

1. 國際財務報導準則第 13 號「公允價值衡量」

國際財務報導準則第 13 號「公允價值衡量」提供公允價值衡量指引，該準則定義公允價值、建立衡量公允價值之架構，並規定公允價值衡量之揭露。此外，該準則規定之揭露內容較現行準則更為廣泛，例如，現行準則僅要求以公允價值衡量之金融工具須按公允價值三層級揭露，依照國際財務報導準則第 13 號「公允價值衡量」規定，適用該準則之所有資產及負債皆須提供前述揭露。

國際財務報導準則第 13 號之衡量規定係自 104 年起推延適用。

2. 國際會計準則第 1 號之修正「其他綜合損益項目之表達」

依修正準則之規定，其他綜合損益項目需按性質分類且分組為(1)不重分類至損益之項目及(2)後續可能重分類至損益之項目。相關所得稅亦應相同基礎分組。適用該修正規定前，並無上述分組之強制規定。

本公司將於 104 年適用上述修正編製綜合損益表，不重分類至損益之項目預計將包含確定福利計畫之精算損益。後續可能重分類至損益之項目預計將包含現金流量避險。

3. 國際會計準則第 19 號之修訂「員工福利」

該修訂準則規定確定福利義務變動及計畫資產公允價值變動係於發生時認列，因而排除過去得按「緩衝區法」處理之選擇，並加速前期服務成本之認列。該修訂規定所有精算損益將立即認列於其他綜合損益，俾使已認列之淨退休金資產或負債反映計畫短絀或剩餘之整體價值。

此外，「淨利息」將取代適用修訂準則前之利息成本及計畫資產之預期報酬，並以淨確定福利負債（資產）乘以折現率決定淨利息。

本公司若追溯適用上述準則，103 年度營業費用及其他綜合損益之確定福利計畫精算利益皆應調整減少 96 仟元。

(二) IASB 已發布但尚未經金管會認可之 IFRSs

本公司未適用下列業經 IASB 發布但尚未經金管會認可之 IFRSs。

截至本合併財務報告通過發布日止，金管會尚未發布生效日。

新發布／修正／修訂準則及解釋	IASB 發布之生效日(註1)
「2010-2012 週期之年度改善」	2014 年 7 月 1 日 (註2)
「2011-2013 週期之年度改善」	2014 年 7 月 1 日
「2012-2014 週期之年度改善」	2016 年 1 月 1 日 (註3)
國際財務報導準則第 9 號「金融工具」	2018 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 9 號及第 7 號之修正「強制生效日及過渡揭露」	2018 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 10 號及國際會計準則第 28 號之修正「投資者與其關聯企業或合資間之資產出售或投入」	2016 年 1 月 1 日 (註4)
國際財務報導準則第 10 號、第 12 號及國際會計準則第 28 號之修正「投資個體：合併報表例外規定之適用」	2016 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 11 號之修正「聯合營運權益之取得」	2016 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 14 號「管制遞延帳戶」	2016 年 1 月 1 日
國際財務報導準則第 15 號「來自客戶合約之收入」	2017 年 1 月 1 日
國際會計準則第 1 號之修正「揭露計畫」	2016 年 1 月 1 日
國際會計準則第 16 號及第 38 號之修正「可接受之折舊及攤銷方法之闡釋」	2016 年 1 月 1 日
國際會計準則第 16 號及第 41 號之修正「農業：生產性植物」	2016 年 1 月 1 日
國際會計準則第 19 號之修正「確定福利計畫：員工提撥金」	2014 年 7 月 1 日
國際會計準則第 27 號之修正「單獨財務報表中之權益法」	2016 年 1 月 1 日
國際會計準則第 36 號之修正「非金融資產可回收金額之揭露」	2014 年 1 月 1 日
國際會計準則第 39 號之修正「衍生工具之合約更替及避險會計之繼續」	2014 年 1 月 1 日
國際財務報導解釋第 21 號「公課」	2014 年 1 月 1 日

註 1：除另註明外，上述新發布／修正／修訂準則或解釋係於各該日期以後開始之年度期間生效。

註 2：給與日於 2014 年 7 月 1 日以後之股份基礎給付交易開始適用國際財務報導準則第 2 號之修正；收購日於 2014 年 7 月 1 日以後之企業合併開始適用國際財務報導準則第 3 號之修正；國際財務報導準則第 13 號於修正時即生效。其餘修正係適用於 2014 年 7 月 1 日以後開始之年度期間。

註 3：除國際財務報導準則第 5 號之修正推延適用於 2016 年 1 月 1 日以後開始之年度期間外，其餘修正係追溯適用於 2016 年 1 月 1 日以後開始之年度期間。

註 4：推延適用於 2016 年 1 月 1 日以後開始之年度期間所發生之交易。

除下列說明外，適用上述新發布／修正／修訂準則或解釋將不致造成本公司會計政策之重大變動：

1. 國際財務報導準則第 9 號「金融工具」

就金融資產方面，所有原屬於國際會計準則第 39 號「金融工具：認列與衡量」範圍內之金融資產後續衡量係以攤銷後成本衡量或以公允價值衡量。國際財務報導準則第 9 號對金融資產之分類規定如下。

本公司投資之債券工具，若其合約現金流量完全為支付本金及流通在外本金金額之利息，分類及衡量如下：

(1) 本公司以收取合約現金流量為目的之經營模式而持有該金融資產，則該金融資產應以攤銷後成本衡量。此類金融資產後續應按有效利率認列利息收入於損益，並應持續評估減損，減損損益認列於損益。

(2) 本公司以收取合約現金流量與出售金融資產為目的之經營模式而持有該金融資產，則該金融資產應以透過其他綜合損益按公允價值衡量。此類金融資產後續應按有效利率認列利息收入於損益，並應持續評估減損，減損損益與兌換損益亦認列於損益，其他公允價值變動則認列於其他綜合

損益。於該金融資產除列或重分類時，原先累積於其他綜合損益之公允價值變動應重分類至損益。

本公司投資非屬前述條件之金融資產，應以公允價值衡量，公允價值變動認列於損益。惟本公司得選擇於原始認列時，將非持有供交易之權益投資指定為透過其他綜合損益按公允價值衡量。此類金融資產除股利收益認列於損益外，其他相關利益及損失係認列於其他綜合損益，後續無須評估減損，累積於其他綜合損益之公允價值變動亦不重分類至損益。

國際財務報導準則第 9 號改採用「預期信用損失模式」認列金融資產之減損。以攤銷後成本衡量之金融資產及強制透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產，應認列備抵信用損失。若前述金融資產之信用風險自原始認列後並未顯著增加，則其備抵信用損失應按未來 12 個月之預期信用損失衡量。若前述金融資產之信用風險自原始認列後已顯著增加且非低信用風險，則其備抵信用損失應按剩餘存續期間之預期信用損失衡量。但未包括重大財務組成部分之應收帳款必須按存續期間之預期信用損失衡量備抵信用損失。

國際財務報導準則第 9 號在一般避險會計之主要改變，係調整避險會計之適用條件，以使適用避險會計之財務報表更能反映企業實際進行的風險管理活動。與國際會計準則第 39 號相較，其主要修正內容包括：(1)增加可適用避險會計之交易型態，例如放寬非財務風險適用避險會計之條件；(2)修改避險衍生工具之損益認列方式，以減緩損益波動程度；及(3)避險有效性方面，以避險工具與被避險項目間的經濟關係取代實際有效性測試。

2. 國際財務報導準則第 15 號「來自客戶合約之收入」

該準則將取代國際會計準則第 18 號「收入」、國際會計準則第 11 號「建造合約」及相關解釋。

本公司於適用該準則時，係以下列步驟認列收入：

- (1) 辨認客戶合約；
- (2) 辨認合約中之履約義務；
- (3) 決定交易價格；
- (4) 將交易價格分攤至合約中之履約義務；及
- (5) 於滿足履約義務時認列收入。

該準則生效時，本公司得選擇追溯適用至比較期間或將首次適用之累積影響數認列於首次適用日。

3. 國際會計準則第 36 號「非金融資產可回收金額之揭露」之修正

該準則之修正係釐清本公司僅須於認列或迴轉減損損失當年度揭露該等可回收金額。若可回收金額係以現值法計算之公允價值減處分成本衡量，則須增加揭露所採用之折現率。本公司預期上述修正將使本公司增加有關非金融資產可回收金額之揭露。

除上述影響外，截至本財務報告通過發布日止，本公司仍持續評估其他準則及解釋之修正對財務狀況與財務績效之影響，相關影響待評估完成時予以揭露。

四、重大會計政策之彙總說明

本公司之重大會計政策彙總說明如下：

(一) 遵循聲明

本財務報告係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金管會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製。

(二) 編製基礎

除按公允價值衡量之金融工具外，本財務報告係依歷史成本基礎編製。歷史成本通常係依取得資產所支付對價之公允價值決定。

(三) 資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括預期於資產負債表日後 12 個月內變現或耗用之資產，資產不屬於流動資產者為非流動資產。流動負債為須於資產負債表日後 12 個月內清償之負債，負債不屬於流動負債者為非流動負債。

(四) 外 幣

編製財務報告時，以功能性貨幣以外之貨幣（外幣）交易者，係按交易日匯率予以換算認列。於報導期間結束日時，外幣貨幣性項目以該日即期匯率重新換算，兌換差額於發生當年度認列為損益；以公允價值衡量之外幣非貨幣性項目，按決定公允價值當日之匯率重新換算，所產生之兌換差額列為當年度損益，惟屬公允價值變動認列於其他綜合損益者，其產生之兌換差額列於其他綜合損益；以歷史成本衡量之外幣非貨幣性項目係以交易日之匯率換算，不再重新換算。

(五) 約當現金

約當現金係可隨時轉換成定額現金，且價值變動甚小之短期並具高度流動性之投資。

(六) 存 貨

存貨包括原物料、在製品及製成品。存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值時除同類別存貨外係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況之下估計售價減除至完工尚需投入之估計成本及完成出售所需之估計成本後之餘額。存貨成本之計算採加權平均法。

(七) 不動產、廠房及設備

不動產、廠房及設備係以成本減累計折舊及累計減損衡量。成本包括可直接歸屬於取得或建置資產之增額成本。直接可歸屬於取得、建造或生產符合要件之資產之借款成本，係作為該資產成本之一部分，直到該資產幾乎已達預定使用或出售狀態為止。除上述者外，所有其他借款成本係於發生當年度認列為損益。

建造過程中之不動產、廠房及設備係以成本減除累計減損後之金額認列。該等資產於完工並達預期使用狀態時，分類至不動產、廠房及設備之適當類別並開始提列折舊。

折舊係採直線法提列，於資產耐用年限內沖銷其成本減除殘值後之金額。折舊係按下列耐用年數計提：房屋及建築，3 至 35 年；機器設備，3 至 8 年；辦公設備，3 至 11 年；租賃改良，3 至 16 年；

其他設備，3 至 11 年。估計耐用年限、殘值及折舊方法於報導期間結束日進行檢視，任何估計變動之影響係推延適用，土地不提列折舊。

於處分或預期無法由使用或處分產生未來經濟效益時，將不動產、廠房及設備予以除列。除列不動產、廠房及設備所產生之利益或損失，係處分價款與該資產帳面金額兩者間之差額，並認列於當年度損益。

(八) 無形資產

單獨取得之有限耐用年限無形資產原始以成本衡量，後續係以成本減除累計攤銷及累計減損衡量。攤銷金額係依直線法按下列耐用年數計提：專門技術，20 年；電腦軟體成本，3 年；其他，2 至 6 年。估計耐用年限及攤銷方法於報導期間結束日進行檢視，任何估計變動之影響係推延適用。

研究階段之支出於發生時認列為費用；發展階段之支出於符合規定條件時，認列為無形資產，採用直線法依其耐用年限分年攤銷，不符合規定條件之支出則列為當年度費用。

(九) 有形及無形資產之減損

本公司於報導期間結束日檢視有形及無形資產之帳面金額以決定該等資產是否有減損跡象。若顯示有減損跡象，則估計資產之可回收金額以決定應認列之減損金額。倘無法估計個別資產之可回收金額，則本公司估計該項資產所屬現金產生單位之可回收金額。若可按合理基礎分攤時，共用資產亦分攤至個別之現金產生單位，反之，則分攤至按可依合理基礎分攤之最小現金產生單位群組。

可回收金額為公允價值減出售成本與其使用價值較高者。評估使用價值時，係將估計未來現金流量以稅前折現率加以折現，該折現率係反映現時市場對貨幣時間價值及尚未用以調整未來現金流量估計數之資產特定風險之評估。

個別資產或現金產生單位之可回收金額若低於帳面金額時，該資產或現金產生單位之帳面金額調減至其可回收金額，減損損失立即認列於當年度損失。

當減損損失於後續期間迴轉時，該個別資產或現金產生單位之帳面金額則調增至修正後之估計可回收金額，惟增加後之帳面金額以不超過該資產或現金產生單位在未認列減損損失之情況下應有之帳面金額為限。迴轉之減損損失係立即認列於當年度損益。

(十) 金融工具

金融資產與金融負債於本公司成為該金融工具合約條款之一方時認列。

原始認列金融資產與金融負債時，若金融資產或金融負債非屬透過損益按公允價值衡量者，係按公允價值加計直接可歸屬於取得或發行金融資產或金融負債之交易成本衡量。直接可歸屬於取得或發行透過損益按公允價值衡量之金融資產及金融負債之交易成本，則立即認列為損益。

(十一) 金融資產

本公司持有之金融資產係分為透過損益按公允價值衡量之金融資產、備供出售金融資產與放款及應收款等。該分類係於金融資產原始認列時視其性質及目的而決定。所有慣例交易金融資產之認列與除列，採交易日會計處理。慣例交易係指金融資產之購買或出售，其交付期間係在因法規或市場慣例所訂之期間內者。

1. 透過損益按公允價值衡量之金融資產

係未能符合避險會計條件之衍生金融工具，以公允價值衡量，任何因再衡量產生之利益或損失係認列為損益。

2. 備供出售金融資產

備供出售金融資產係非衍生金融資產被指定為備供出售，或未被分類為放款及應收款、持有至到期日金融資產及透過損益按公允價值衡量之金融資產。

備供出售金融資產若屬無活絡市場公開報價且公允價值無法可靠衡量之權益工具投資，係以成本減除減損損失衡量，並單獨列為「以成本衡量之金融資產」。該等金融資產於後續能可靠衡量公允價值時，係按公允價值再衡量，其帳面金額與公允

價值間之差額認列於其他綜合損益，若有減損時，則認列於損益。

3. 放款及應收款

放款及應收款係指無活絡市場公開報價，且具固定或可決定付款金額之非衍生金融資產。放款及應收款主要包括現金及約當現金、應收票據及帳款（含關係人）及其他應收款項，係按有效利息法按攤銷後成本減除減損損失後衡量，惟短期應收款項之折現效果不具重大性者除外。

4. 金融資產減損

除透過損益按公允價值衡量之金融資產外，本公司於報導期間結束日評估其他金融資產是否有減損跡象，當有客觀證據顯示，因金融資產原始認列後發生之單一或多項事件，致使金融資產之估計未來現金流量受影響者，該金融資產則視為已減損。

以攤銷後成本衡量之金融資產，如應收帳款，該資產若經個別評估未有客觀減損，另再以組合基礎來評估減損。本公司係依據對客戶之應收帳款帳齡分析及客戶評等分析等因素，定期評估應收帳款之收回可能性。

以成本衡量之金融資產之減損損失金額係該資產帳面金額與估計未來現金流量按類似金融資產之現時市場報酬率折現之現值間之差額。此種減損損失於後續期間不得迴轉。

所有金融資產之減損損失係直接自金融資產之帳面金額中扣除，惟應收帳款係藉由備抵帳戶調降其帳面金額。當應收帳款視為無法回收時，係沖銷備抵帳戶。原先已沖銷而後續回收之款項係貸記備抵帳戶。

5. 金融資產之除列

本公司僅於對來自該資產現金流量之合約權利失效，或已移轉金融資產且該資產所有權幾乎所有之風險及報酬已移轉予其他企業時，始將金融資產除列。

除列一金融資產之整體時，其帳面金額與已收取或可收取對價總額加計已認列於其他綜合損益之任何累計利益或損失之總和間之差額係認列於損益。

(十二) 金融負債及權益工具

1. 金融負債或權益工具之分類

本公司發行之債務及權益工具係依據合約協議之實質與金融負債及權益工具之定義分類為金融負債或權益。

2. 權益工具

權益工具係指表彰本公司於資產減除其所有負債後剩餘權益之任何合約。本公司發行之權益工具係以取得之價款扣除直接發行成本後之金額認列。

3. 金融負債

金融負債係按有效利息法計算之攤銷後成本或透過損益按公允價值作後續衡量。

透過損益按公允價值衡量之金融負債係未能符合避險會計要件之衍生金融工具，以公允價值衡量，任何因再衡量產生之利益或損失係認列為損益。

金融負債非屬持有供交易目的且未指定為透過損益按公允價值衡量者，於後續報導期間結束日係按攤銷後成本衡量。

4. 金融負債之除列

本公司僅於義務解除、取消或到期時，始將金融負債除列。除列金融負債時，其帳面金額與所支付或應支付對價總額之差額認列為損益。

(十三) 衍生金融工具

本公司簽訂遠期外匯及利率交換合約等衍生金融工具，以管理相關匯率及利率波動所產生之風險。

衍生金融工具於原始認列時以公允價值認列，後續於報導期間結束日按公允價值重新衡量，後續衡量產生之利益或損失直接列入損益，然指定且為有效避險工具之衍生工具，其認列於損益之時點則將視避險關係之性質而定。

指定且符合現金流量避險之衍生金融工具，其公允價值變動屬於有效避險部分係認列於其他綜合損益並累計列入其他權益項目之現金流量避險。當被避險項目認列於損益時，原先認列於其他綜合損益並累計列入其他權益項目之現金流量避險之金額將重分類至損益。

(十四) 負債準備

本公司因過去事件負有現時義務（法定或推定義務），且很有可能須清償該義務，並對該義務金額能可靠估計時，認列負債準備。

認列為負債準備之金額係考量義務之風險及不確定性，而為報導期間結束日清償義務所須支出之最佳估計。若負債準備係以清償該現時義務之估計現金流量衡量，其帳面金額係為該等現金流量之現值。

(十五) 收入認列

收入係按已收或應收對價之公允價值衡量，並扣除估計之客戶退貨、折扣及其他類似之折讓。

1. 商品之銷售

銷售商品係於下列條件完全滿足時認列收入：(1)本公司已經將商品所有權之重大風險及報酬移轉予買方；(2)本公司對於已經出售之商品既不持續參與管理，亦未維持有效控制；(3)收入金額能可靠衡量；(4)與交易有關之經濟效益很有可能流入本公司；及(5)與交易有關之已發生或將發生之成本能可靠衡量。

2. 利息收入

金融資產之利息收入係於經濟效益很有可能流入本公司，且收入金額能可靠衡量時認列。利息收入係依時間之經過按流通在外本金與所適用之有效利率採應計基礎認列。

(十六) 租賃

當租賃條款係移轉附屬於資產所有權之幾乎所有風險與報酬予承租人時，則將其分類為融資租賃；所有其他租賃則分類為營業租賃。

營業租賃之租賃收入係按直線基礎於租賃期間內認列為收入。

營業租賃給付係按直線基礎於租賃期間認列為費用。

(十七) 退職後福利

屬確定提撥退休福利計畫者，係於員工提供服務期間，就應提撥之數額認列為當期費用；屬確定福利退休計畫者，則按精算結果認列退休福利成本。

在確定福利退休計畫下，提供退休福利之成本係使用預計單位福利法決定，並於報導期間結束日進行精算評價。精算損益係於發生年度立即全數認列為其他綜合損益。

(十八) 股份基礎給付協議

本公司對於轉換日前已既得之員工認股權，選擇適用國際財務報導準則第1號「首次採用國際財務報導準則」之豁免。

本公司於101年1月1日後給與之員工認股權，係以給與日員工認股權之公允價值衡量。員工認股權係按給與日所決定之公允價值及預期既得員工認股權之最佳估計數量，於既得期間內以直線基礎認列費用，並同時調整資本公積－員工認股權。後續資訊顯示預期既得之認股權數量與估計不同時，則修正原估計數。

本公司給與之現金交割股份基礎給付協議，係認列為取得商品或勞務所產生之負債，並以所承擔負債之公允價值作為原始衡量。該負債係於清償前之每一資產負債表日及清償日再衡量其公允價值，並將公允價值變動認列為損益。

(十九) 稅 捐

所得稅係當年度應付所得稅及遞延所得稅之總和。

1. 當年度所得稅

依所得稅法規定計算之未分配盈餘加徵10%所得稅列為股東會決議年度之所得稅費用。

以前年度應付所得稅之調整，列入當年度所得稅。

2. 遞延所得稅

遞延所得稅係依帳載資產及負債帳面金額與計算課稅所得之課稅基礎二者所產生之暫時性差異計算予以認列。遞延所得

稅負債一般係就所有未來應課稅暫時性差異予以認列；遞延所得稅資產則係於未來很有可能具有課稅所得可供減除暫時性差異、虧損扣抵或購置機器設備、研究發展及人才培訓等支出所產生之所得稅抵減使用時認列。

遞延所得稅資產之帳面金額於報導期間結束日予以重新檢視，並針對已不再很有可能具有足夠之課稅所得以供其回收所有或部分資產者予以調整減少。原未認列為遞延所得稅資產者，亦於報導期間結束日予以重新檢視，並在未來很有可能產生課稅所得以供其回收所有或部分資產者予以調整認列。

遞延所得稅資產及負債係以預期負債清償或資產實現當年度之稅率衡量，該稅率係以報導期間結束日已立法或已實質性立法之稅率及稅法為基礎。遞延所得稅負債及資產之衡量係反映企業於報導期間結束日預期回收或清償其資產及負債帳面金額之方式所產生之租稅效果。

3. 當年度及遞延所得稅

當年度及遞延所得稅係認列於損益，惟與認列於其他綜合損益或直接計入權益之項目相關之當年度及遞延所得稅係分別認列於其他綜合損益或直接計入權益。

五、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本公司於採用附註四所述之會計政策時，對於不易自其他來源取得有關資產及負債帳面金額之資訊作出相關之判斷、估計及假設。估計及相關假設係基於歷史經驗及其他視為攸關之因素，實際結果可能與估計有所不同。

估計與基本假設係持續予以檢視。若估計之修正僅影響當年度，則於會計估計修正當年度認列。若會計估計之修正同時影響當年度及未來年度，則於估計修正當年度及未來年度認列。

以下係有關未來所作主要假設及估計之資訊，以及於財務報導結束日估計不確定性之主要來源，該等假設及估計具有導致資產及負債帳面金額於下一財務年度重大調整之風險。

(一) 收入認列

商品銷售收入原則上係於獲利過程完成時認列，其條件如附註四、(十五)所述。相關退貨及折讓負債準備係依歷史經驗及其他已知原因估計可能發生之產品退回及折讓，於產品出售當年度列為商品銷售收入之減項，且管理階層定期檢視估計之合理性。

(二) 不動產、廠房及設備之減損評估

資產減損評估過程中，本公司需依賴主觀判斷並依據資產使用模式及產業特性，決定特定資產群組之獨立現金流量、資產耐用年數及未來可能產生之收益與費損，任何由於經濟狀況之變遷或公司策略所帶來之估計改變均可能在未來造成重大減損。

(三) 遞延所得稅資產之可實現性

遞延所得稅資產係於未來很有可能擁有足夠之課稅所得供可減除暫時性差異使用時方予以認列。評估遞延所得稅資產之可實現性時，必須涉及管理階層之重大會計判斷及估計，包含預期未來銷貨收入成長及利潤率、免稅期間、可使用之所得稅抵減及稅務規劃等假設。任何關於全球經濟環境、產業環境變遷及法令之改變，均可能引起遞延所得稅資產之重大調整。

(四) 存貨之評價

由於存貨須以成本與淨變現價值孰低者計價，故本公司必須運用判斷及估計決定報導期間結束日存貨之淨變現價值。

由於科技快速變遷，本公司評估報導期間結束日存貨因正常損耗、過時陳舊或無市場銷售價值之金額，並將存貨成本沖減至淨變現價值。此存貨評價主要係依未來特定期間內之產品需求為估計基礎，故可能產生重大變動。

六、現金及約當現金

	103年12月31日	102年12月31日
現金及銀行存款	\$ 632,945	\$ 736,242
附買回條件公司債	173,500	294,900
	<u>\$ 806,445</u>	<u>\$ 1,031,142</u>

七、透過損益按公允價值衡量之金融資產及金融負債

	<u>103年12月31日</u>	<u>102年12月31日</u>
衍生金融資產		
遠期外匯合約	<u>\$ 389</u>	<u>\$ 172</u>
衍生金融負債		
遠期外匯合約	<u>\$ 12,644</u>	<u>\$ 7,235</u>

本公司從事衍生金融工具交易之目的，主要係為規避因匯率波動所產生之風險。本公司上述之衍生金融工具因不符合有效避險條件，故不適用避險會計。

本公司尚未到期之遠期外匯合約如下：

	<u>到 期 期 間</u>	<u>合 約 金 額 (仟 元)</u>
<u>103 年 12 月 31 日</u>		
Sell USD/ Buy NTD	104 年 1 月~104 年 2 月	USD 26,000/ NTD 809,449
<u>102 年 12 月 31 日</u>		
Sell USD/ Buy NTD	103 年 1 月~103 年 2 月	USD 24,210/ NTD 714,395

八、避險之衍生金融工具

	<u>103年12月31日</u>	<u>102年12月31日</u>
金融負債－流動		
現金流量避險		
利率交換合約	<u>\$ 823</u>	<u>\$ 281</u>

本公司目前所承擔之長期銀行借款係屬浮動利率之債務，因此市場利率之變動極易造成未來現金流量之波動，故另簽訂利率交換合約以規避利率變動之現金流量風險。

本公司尚未到期之利率交換合約如下：

<u>合 約 金 額 (仟 元)</u>	<u>到 期 日</u>	<u>支 付 利 率 區 間</u>	<u>收 取 利 率 區 間</u>
<u>103 年 12 月 31 日</u>			
\$ 500,000	105 年 12 月 15 日	0.979%~1.108%	0.868%~0.885%
<u>102 年 12 月 31 日</u>			
\$ 900,000	103 年 12 月 31 日	0.979%	0.868%~0.897%

本公司 103 及 102 年度因操作利率交換合約而認列於其他綜合損益並累計列入其他權益項目之金額分別為淨損 1,042 仟元及 511 仟元；

由權益重分類至當年度損失之金額分別為 500 仟元及 230 仟元，並列入綜合損益表之財務成本項下。

九、應收帳款

	103年12月31日	102年12月31日
<u>非關係人</u>		
應收帳款	\$266,080	\$235,348
備抵呆帳	(314)	-
應收帳款淨額	<u>265,766</u>	<u>235,348</u>
<u>關 係 人</u>		
應收帳款	673,527	516,431
備抵呆帳	(208)	-
應收帳款淨額	<u>673,319</u>	<u>516,431</u>
合 計	<u>\$939,085</u>	<u>\$751,779</u>

本公司對客戶之授信期間原則上為月結 30 天至 45 天，部分客戶則為發票日後 30 天，少數客戶為月結 60 天。備抵呆帳係參考帳齡分析、歷史經驗及客戶目前財務狀況分析等，以估計無法回收之金額。

除已提列減損者，其餘應收票據及帳款金額於報導期間結束日之帳齡分析請參閱下表。本公司針對已逾期但未提列減損之應收帳款，經評估其信用品質並未發生重大改變且相關帳款仍可回收，故尚無減損疑慮。

應收帳款淨額之帳齡分析

	103年12月31日	102年12月31日
未逾期亦未減損	\$938,563	\$751,779
未逾期但已減損	522	-
合 計	<u>\$939,085</u>	<u>\$751,779</u>

備抵呆帳之變動

	個 別 評 估 減 損 損 失	群 組 評 估 減 損 損 失	合 計
103 年 1 月 1 日餘額	\$ -	\$ -	\$ -
本年度提列	-	522	522
103 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 522</u>	<u>\$ 522</u>
102 年 1 月 1 日餘額	\$ 3,157	\$ -	\$ 3,157
本年度迴轉	(3,157)	-	(3,157)
102 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>

已減損應收帳款之帳齡

	103年12月31日	102年12月31日
未逾期	<u>\$ 522</u>	<u>\$ -</u>

十、存 貨

	103年12月31日	102年12月31日
製 成 品	\$ 16,424	\$ 43,864
在 製 品	53,601	66,569
原 物 料	<u>143,752</u>	<u>106,337</u>
	<u>\$213,777</u>	<u>\$216,770</u>

本公司與存貨相關之營業成本中，分別包括下列收益及費損：

	103年度	102年度
存貨回升利益（跌價損失）	<u>(\$ 10,446)</u>	<u>\$ 977</u>
出售下腳收入	<u>\$ 10,706</u>	<u>\$ 7,222</u>

十一、以成本衡量之金融資產

本公司於 87 年投資美商坎伯狄吉有限公司（Compositech Ltd.），該公司已於 91 年下市，本公司認為其價值業已減損，已於 91 年全數認列減損損失。

十二、不動產、廠房及設備

	土 地	房屋及建築	機器設備	辦公設備	租賃改良	其他設備	未完工程及待驗設備	合 計
成 本								
103 年 1 月 1 日餘額	\$ 772,029	\$ 1,016,543	\$ 7,947,877	\$ 84,641	\$ 653,944	\$ 437,283	\$ 80,934	\$10,993,251
增 加	-	375,828	302,144	34,433	28,606	222,043	1,003,725	1,966,779
出售或報廢	-	-	(87,631)	(2,722)	(40,706)	(17,564)	-	(148,623)
重 分 類	-	-	(12,791)	-	-	-	(12,576)	(25,367)
103 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 772,029</u>	<u>\$ 1,392,371</u>	<u>\$ 8,149,599</u>	<u>\$ 116,352</u>	<u>\$ 641,844</u>	<u>\$ 641,762</u>	<u>\$ 1,072,083</u>	<u>\$12,786,040</u>
累計折舊及減損								
103 年 1 月 1 日餘額	\$ -	\$ 260,813	\$ 4,080,049	\$ 70,783	\$ 405,901	\$ 149,698	\$ -	\$ 4,967,244
增 加	-	71,781	1,102,553	6,622	53,526	55,092	-	1,289,574
出售或報廢	-	-	(87,631)	(2,722)	(40,706)	(17,564)	-	(148,623)
減損損失	-	-	86,067	-	-	-	-	86,067
103 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 332,594</u>	<u>\$ 5,181,038</u>	<u>\$ 74,683</u>	<u>\$ 418,721</u>	<u>\$ 187,226</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 6,194,262</u>
103 年 12 月 31 日淨額	<u>\$ 772,029</u>	<u>\$ 1,059,777</u>	<u>\$ 2,968,561</u>	<u>\$ 41,669</u>	<u>\$ 223,123</u>	<u>\$ 454,536</u>	<u>\$ 1,072,083</u>	<u>\$ 6,591,778</u>
成 本								
102 年 1 月 1 日餘額	\$ 772,029	\$ 978,995	\$ 5,603,086	\$ 82,070	\$ 644,624	\$ 310,447	\$ 229,598	\$ 8,620,849
增 加	-	37,548	2,396,814	2,700	9,320	149,394	(148,664)	2,447,112
出售或報廢	-	-	(52,023)	(129)	-	(22,558)	-	(74,710)
102 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 772,029</u>	<u>\$ 1,016,543</u>	<u>\$ 7,947,877</u>	<u>\$ 84,641</u>	<u>\$ 653,944</u>	<u>\$ 437,283</u>	<u>\$ 80,934</u>	<u>\$10,993,251</u>
累計折舊及減損								
102 年 1 月 1 日餘額	\$ -	\$ 194,687	\$ 3,418,436	\$ 64,850	\$ 353,838	\$ 135,946	\$ -	\$ 4,167,757
增 加	-	66,126	708,439	6,062	52,063	36,310	-	869,000
出售或報廢	-	-	(50,630)	(129)	-	(22,558)	-	(73,317)
減損損失	-	-	3,804	-	-	-	-	3,804
102 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 260,813</u>	<u>\$ 4,080,049</u>	<u>\$ 70,783</u>	<u>\$ 405,901</u>	<u>\$ 149,698</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 4,967,244</u>
102 年 12 月 31 日淨額	<u>\$ 772,029</u>	<u>\$ 755,730</u>	<u>\$ 3,867,828</u>	<u>\$ 13,858</u>	<u>\$ 248,043</u>	<u>\$ 287,585</u>	<u>\$ 80,934</u>	<u>\$ 6,026,007</u>

本公司建築物之重大組成部分主要有廠房主建物、機電動力設備及無塵潔淨室等，分別按其耐用年限 18 至 32 年、7 至 11 年及 10 至 11 年提列折舊；機器設備之重大組成部分主要有蝕刻機、濺鍍機等，按其耐用年限 3 至 8 年提列折舊。

本公司評估部分機器設備之帳面價值無法回收，故於 103 及 102 年度按其可回收金額評估分別認列減損損失計 86,067 仟元及 3,804 仟元，帳列其他營業收益及費損項下。

本公司部分機器設備以營業租賃方式出租予台積公司，租約內容係由租賃雙方協議決定，租賃期間自 102 年 5 月至 104 年 12 月止，租金按季收取，租金收入及出租資產折舊帳列其他營業收益及費損項下。出租機器設備淨額暨未來最低租賃給付總額分別如下：

	103年12月31日	102年12月31日
出租機器設備淨額	<u>\$ 725,907</u>	<u>\$ 1,127,410</u>
未來最低租賃給付總額	<u>\$ 518,926</u>	<u>\$ 697,958</u>

十三、無形資產

	專 門 技 術	電腦軟體成本	專利權及其他	合 計
<u>成 本</u>				
103 年 1 月 1 日餘額	\$ 113,340	\$ 30,351	\$ 48,829	\$ 192,520
增 加	-	19,564	23,056	42,620
103 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 113,340</u>	<u>\$ 49,915</u>	<u>\$ 71,885</u>	<u>\$ 235,140</u>
<u>累計攤銷</u>				
103 年 1 月 1 日餘額	\$ 69,421	\$ 16,652	\$ 34,753	\$ 120,826
增 加	5,667	9,172	12,038	26,877
103 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 75,088</u>	<u>\$ 25,824</u>	<u>\$ 46,791</u>	<u>\$ 147,703</u>
103 年 12 月 31 日淨額	<u>\$ 38,252</u>	<u>\$ 24,091</u>	<u>\$ 25,094</u>	<u>\$ 87,437</u>
<u>成 本</u>				
102 年 1 月 1 日餘額	\$ 113,340	\$ 36,961	\$ 58,506	\$ 208,807
增 加	-	9,263	13,872	23,135
報 廢	-	(15,873)	(23,549)	(39,422)
102 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 113,340</u>	<u>\$ 30,351</u>	<u>\$ 48,829</u>	<u>\$ 192,520</u>
<u>累計攤銷</u>				
102 年 1 月 1 日餘額	\$ 63,754	\$ 24,864	\$ 37,654	\$ 126,272
增 加	5,667	7,661	20,648	33,976
報 廢	-	(15,873)	(23,549)	(39,422)
102 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 69,421</u>	<u>\$ 16,652</u>	<u>\$ 34,753</u>	<u>\$ 120,826</u>
102 年 12 月 31 日淨額	<u>\$ 43,919</u>	<u>\$ 13,699</u>	<u>\$ 14,076</u>	<u>\$ 71,694</u>

十四、其他流動資產

	103年12月31日	102年12月31日
預付費用	\$ 52,423	\$ 49,822
應收退稅款	12,032	6,193
預付貨款	1,177	2,417
其 他	7,226	11,972
	<u>\$ 72,858</u>	<u>\$ 70,404</u>

十五、負債準備

	103年12月31日	102年12月31日
退貨及折讓	\$ 60,155	\$ 50,640
除役成本	<u>25,076</u>	<u>24,536</u>
	<u>\$ 85,231</u>	<u>\$ 75,176</u>
流 動	\$ 60,155	\$ 50,640
非 流 動	<u>25,076</u>	<u>24,536</u>
	<u>\$ 85,231</u>	<u>\$ 75,176</u>

	退 貨 及 折 讓 負 債 準 備	除 役 成 本 負 債 準 備	合 計
<u>103 年度</u>			
年初餘額	\$ 50,640	\$ 24,536	\$ 75,176
本年度提列	105,277	540	105,817
本年度給付	(95,762)	-	(95,762)
年底餘額	<u>\$ 60,155</u>	<u>\$ 25,076</u>	<u>\$ 85,231</u>
<u>102 年度</u>			
年初餘額	\$ 31,353	\$ 24,536	\$ 55,889
本年度提列	137,133	-	137,133
本年度給付	(117,846)	-	(117,846)
年底餘額	<u>\$ 50,640</u>	<u>\$ 24,536</u>	<u>\$ 75,176</u>

退貨及折讓負債準備係本公司依歷史經驗、管理階層判斷及其他已知原因所估計可能發生之產品退回及折讓，並於相關產品出售當年度認列為營業收入之減項。

除役成本負債準備係拆卸、移除相關設備及復原其所在地點所產生之除役負債準備，其金額以預期清償義務之現金流量估計折現值衡量，於報導期間結束日進行適當之評估及調整。

十六、存入保證金

本公司於 102 年度受某客戶委任提供特定產品之封裝服務，並收取補償未來訂單風險之產能保證金計 1,016,977 仟元。該客戶補償本公司設備採購訂單取消之損失計 7,778 仟元，已於 103 年上半年度轉列收入，帳列其他收益及費損項下；後因訂單風險已大幅降低，故與客戶協議歸還，故其餘產能保證金於 103 年 6 月 30 日前已全數返還。

十七、長期銀行借款

	103年12月31日	102年12月31日
銀行信用借款：		
自 105 年 6 月到期一次償還，年利率 103 年為 1.21%~1.24%；102 年為 1.21%~1.25%	\$ 600,000	\$ 500,000
自 105 年 5 月起，每 3 個月為一期，分 5 期償還，年利率 103 年為 1.45%~1.51%；102 年為 1.45%~1.48%	600,000	400,000
自 103 年 7 月起，每 3 個月為一期，分 16 期償還，年利率為 1.23%~1.25%	262,500	300,000
於 106 年 5 月到期一次償還，年利率 103 年為 1.38%~1.42%	200,000	-
自 103 年 10 月起，每 3 個月為一期，分 16 期償還，年利率 103 年為 1.23%~1.25%；102 年為 1.25%	140,625	150,000
自 101 年 7 月起，每 3 個月為一期，分 16 期償還，年利率 103 年為 1.21%~1.25%；102 年為 1.24%~1.25%	112,500	187,500
自 103 年 9 月起，每 3 個月為一期，分 16 期償還，年利率 103 年為 1.23%~1.24%；102 年為 1.23%~1.25%	87,500	100,000

(接次頁)

(承前頁)

	103年12月31日	102年12月31日
自 101 年 9 月起，每 3 個月 為一期，分 16 期償還， 年 利 率 103 年 為 1.21%~1.25%；102 年為 1.21%~1.25%	\$ 75,000	\$ 125,000
於 108 年 12 月到期一次償 還，年 利 率 103 年 為 1.30%	50,000	-
自 102 年 10 月起，每 3 個 月為一期，分 16 期償還， 年 利 率 103 年 為 1.23%~1.25%；102 年為 1.24%~1.25%	34,375	46,875
原訂於 105 年 5 月到期一次 償還，惟於 103 年提前償 還 130,000 仟元，年 利 率 102 年為 1.18%~1.48%	-	130,000
原訂於 107 年 8 月到期一次 償還，惟於 103 年 2 月全 數清償，年 利 率 102 年 為 1.28%~1.31%	-	100,000
擔保借款：		
於 107 年 8 月到期一次償 還，年 利 率 為 103 年 為 1.16%~1.19%；102 年 為 1.17%~1.20%	<u>500,000</u> <u>\$ 2,662,500</u>	<u>70,000</u> <u>\$ 2,109,375</u>
流 動	\$ 275,000	\$ 196,875
非 流 動	<u>2,387,500</u> <u>\$ 2,662,500</u>	<u>1,912,500</u> <u>\$ 2,109,375</u>

依銀行借款合同規定，銀行信用借款要求本公司於借款存續期間內，其半年度及年度財務報表須符合某些財務比例限制；截至 103 年 12 月 31 日止，本公司未有違反上述財務比率限制之情形。

本公司另以部分機器設備抵押擔保借款，請參閱附註三二。

十八、退職後福利計畫

(一) 確定提撥計畫

本公司依「勞工退休金條例」訂定之員工退休計畫，係屬確定提撥退休辦法。本公司依員工每月薪資 6% 提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。依上述相關規定，本公司於 103 及 102 年度於綜合損益表認列為費用之金額分別為 50,932 仟元及 45,632 仟元。

(二) 確定福利計畫

本公司依「勞動基準法」訂定之員工退休辦法，係屬確定福利退休辦法。依該辦法之規定，員工退休金係按服務年資及退休前 6 個月之平均薪資計算。本公司按員工每月薪資總額 2% 提撥員工退休金基金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶。

本公司係採用預計單位福利法衡量確定福利義務現值、相關當期服務成本及前期服務成本。

本公司之計畫資產及確定福利義務現值，係由合格精算師進行精算。精算評價於衡量日之主要假設列示如下：

	103年12月31日	102年12月31日
折現率	2.00%	2.00%
薪資預期增加率	2.00%	2.00%
計畫資產之預期報酬率	1.75%	1.75%

有關確定福利計畫認列於損益之退休金費用（利益）金額，係列於管理費用，並列示如下：

	103年度	102年度
利息成本	\$ 763	\$ 589
計畫資產之預期報酬	(675)	(635)
	<u>\$ 88</u>	<u>(\$ 46)</u>

本公司於 103 及 102 年度分別認列 679 仟元及 1,469 仟元之精算利益於其他綜合損益。截至 103 年及 102 年 12 月 31 日止，精算利益認列於其他綜合損益之累積金額分別為 2,487 仟元及 1,808 仟元。

本公司因確定福利計畫所產生之義務列入資產負債表之金額列示如下：

	103年12月31日	102年12月31日
已提撥確定福利義務之現值	\$ 38,495	\$ 38,198
計畫資產之公允價值	(40,384)	(37,692)
應計退休金負債（預付退休金）	(\$ 1,889)	\$ 506

確定福利義務現值之變動列示如下：

	103年度	102年度
年初餘額	\$ 38,198	\$ 39,255
利息成本	764	589
精算利益	(467)	(1,646)
年底餘額	\$ 38,495	\$ 38,198

計畫資產公允價值之變動列示如下：

	103年度	102年度
年初餘額	\$ 37,692	\$ 35,322
計畫資產預期報酬	676	635
精算利益（損失）	212	(177)
雇主提撥數	1,804	1,912
年底餘額	\$ 40,384	\$ 37,692

計畫資產之主要類別於報導期間結束日公允價值之百分比列示如下：

	計畫資產公允價值（%）	
	103年12月31日	102年12月31日
現金	19	23
權益工具	50	45
債務工具	31	32
	100	100

整體資產預期報酬率係根據歷史報酬趨勢以及分析師對於相關義務存續期間內，該資產所處市場之預測，並參考勞工退休基金監理會對勞工退休基金之運用情形，於考量最低收益不低於當地銀行 2 年定期存款利率之收益之影響所作之估計。

本公司選擇自轉換至 IFRSs 日起揭露經驗調整之歷史資訊如下：

	103年12月31日	102年12月31日	101年12月31日	101年1月1日
確定福利義務現值	\$ 38,495	\$ 38,198	\$ 39,255	\$ 39,257
計畫資產公允價值	(40,384)	(37,692)	(35,322)	(33,037)
提撥短絀（剩餘）	(\$ 1,889)	\$ 506	\$ 3,933	\$ 6,220
計畫負債之經驗調整	\$ 467	\$ 1,646	\$ 690	\$ -
計畫資產之經驗調整	\$ 212	(\$ 177)	(\$ 351)	\$ -

本公司預期於 103 年 12 月 31 日後 1 年內對確定福利計畫提撥 1,812 仟元。

十九、權益

(一) 普通股股本

	103年12月31日	102年12月31日
額定股數（仟股）	<u>260,000</u>	<u>260,000</u>
額定股本	<u>\$ 2,600,000</u>	<u>\$ 2,600,000</u>
已發行且付清股款之股數（仟股）	<u>238,121</u>	<u>236,402</u>
已發行股本	<u>\$ 2,381,207</u>	<u>\$ 2,364,018</u>

已發行之普通股每股面額為 10 元，每股享有一表決權及收取股利之權利。

額定股本中供發行員工認股權憑證所保留之股本為 12,000 仟股。

(二) 資本公積

	103年12月31日	102年12月31日
股票發行溢價	<u>\$534,167</u>	<u>\$508,103</u>
員工認股權	<u>13,557</u>	<u>16,752</u>
	<u>\$547,724</u>	<u>\$524,855</u>

依照法令規定，超過票面金額發行股票所得之溢額（包括以超過面額發行普通股等）產生之資本公積得用以彌補虧損，亦得於公司無虧損時，用以發放現金股利或撥充股本，惟撥充股本時每年以實收股本之一定比率為限。

因員工認股權產生之資本公積，不得作為任何用途。

(三) 保留盈餘及股利政策

依本公司章程規定，本公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。每年度決算如有盈餘，應先完納稅捐，彌補以往年度虧損，次提撥10%為法定盈餘公積，如法定盈餘公積累積已達本公司實收資本額時，不在此限，次依法令或主管機關規定應提列及迴轉特別盈餘公積後，再就其餘額依序作下列之分配：

1. 提撥不低於1%為員工紅利；
2. 提撥不高於2%為董事酬勞，且給付之對象不包括擔任本公司經理人之董事；
3. 餘額由董事會擬具股東紅利分派議案，提請股東會決議分派之；
4. 前項有關員工紅利部分，如為分配股票紅利，其對象得包括從屬公司員工，其條件及分配方式，授權董事會決定之。

本公司股利發放政策係依據公司資本預算、中長期營運規劃及財務狀況，依下列原則經股東會決議後分派之：

1. 公司得依財務、業務及經營面等因素之考量將當年度可分配盈餘全數分派。盈餘之分派得以股票股利或現金股利之方式為之，但因本公司目前正處於營運成長期，未來將視擴充計劃及投資資金之需求，於分派當年度可分配盈餘時，現金股利分派之比例以不低於股利總額之50%。
2. 於當年度公司無盈餘可分派，或雖有盈餘但盈餘數額遠低於公司前一年度實際分派之盈餘，或依公司財務、業務及經營面等因素之考量，得將公積全部或一部依法令或主管機關規定分派。上述盈餘分配案應於翌年召開股東常會時予以決議承認。

本公司103及102年度員工紅利暨董事酬勞之估列金額分別為87,187仟元及44,151仟元。103及102年度之員工紅利均按稅後淨利並扣除應提列之法定盈餘公積及特別盈餘公積後之15%計算；董事酬勞係按稅後淨利並扣除應提列之法定盈餘公積及特別盈餘公積後約0.42%及2%計算。於股東會決議日時，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。如股東會決議採股票發放員工紅利，股票紅利股數按決議分紅之金額除以股票公允

價值決定，以國際財務報導準則第 2 號「股份基礎給付」規定之公允價值計算股票紅利股數。

法定盈餘公積應提撥至其總額達公司實收股本總額為止。法定盈餘公積得用以彌補虧損；公司無虧損者，得以法定盈餘公積超過實收股本總額 25% 之部分按股東原有股份之比例發給新股或現金。

本公司分配盈餘時，必須依法令規定就當年底之股東權益減項淨額（如現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具損益等累計餘額）提列特別盈餘公積。嗣後股東權益減項金額如有減少，可就減少金額自特別盈餘公積轉回未分配盈餘。

本公司分別於 103 年 6 月 12 日及 102 年 6 月 13 日舉行股東常會，分別決議 102 及 101 年度盈餘分配案及每股股利如下：

	盈 餘 分 配 案		每 股 股 利 (元)	
	102年度	101年度	102年度	101年度
法定盈餘公積	\$ 28,888	\$ -		
特別盈餘公積提 列(迴轉)	281	(232)		
股東現金股利	<u>130,021</u>	<u>23,622</u>	\$ 0.55	\$ 0.10
	<u>\$ 159,190</u>	<u>\$ 23,390</u>		

另本公司於 103 年 6 月 12 日股東常會亦決議配發 102 年度員工現金紅利及董事酬勞 44,151 仟元，前述決議配發金額與本公司於 103 年 3 月 6 日之董事會擬議並無差異，並已於 102 年度以費用入帳。本公司 101 年度為虧損，故未配發員工紅利及董監酬勞。

本公司董事會另於 104 年 2 月 4 日擬議通過 103 年度之盈餘分配案及每股股利如下：

	盈 餘 分 配 案	每 股 股 利 (元)
法定盈餘公積	\$ 62,865	
特別盈餘公積	542	
股東現金股利	<u>285,745</u>	\$ 1.20
	<u>\$349,152</u>	

本公司董事會亦同時擬議配發 103 年員工紅利暨董事酬勞 87,187 仟元，前述擬配發金額與本公司 103 年度以費用列帳之金額並無差異。

有關 103 年度之盈餘分配案、員工分紅及董事酬勞尚待預計於 104 年 6 月 16 日召開之股東會決議。

上述有關本公司董事會通過擬議及股東會決議之員工紅利及董監酬勞資訊，請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。

本公司分配屬於 87 年度（含）以後未分配盈餘時，除屬非中華民國境內居住者之股東外，其餘股東可獲配按股利分配日之稅額扣抵比率計算之股東可扣抵稅額。

(四) 其他權益項目

現金流量避險項目之變動數如下：

	103年度	102年度
現金流量避險		
年初餘額	(\$ 281)	\$ -
現金流量避險之避險工具公允價值變動	(1,042)	(511)
現金流量避險之避險工具公允價值變動重分類至損益	500	230
年底餘額	(\$ 823)	(\$ 281)

與現金流量避險相關之其他權益項目，係避險工具於現金流量避險中公允價值變動屬有效避險部分之累計利益或損失，此累計利益或損失僅當避險交易影響損益時重分類至損益。

二十、股份基礎給付

(一) 選擇豁免適用國際財務報導準則第 2 號「股份基礎給付」者

本公司對所有在 101 年 1 月 1 日前已給與並已既得之股份基礎給付之交易，選擇豁免追溯適用國際財務報導準則第 2 號。該等認股權計畫如下：

本公司分別於 96 年 6 月 26 日（96 年員工認股權計畫）及 95 年 7 月 3 日（95 年員工認股權計畫）經行政院金融監督管理委員會證券期貨局（證期局）核准發行員工認股權憑證各 6,000 仟單位，每單位可認購普通股票 1 股，授予對象包含本公司及子公司符合特定條件之員工，認股權憑證之存續期間各分別為 10 年，憑證持有人自被授予認股權憑證屆滿 2 年後，得依認股辦法分年行使認股權利。

本公司員工認股權憑證之相關資訊如下：

	96 年員工認股權計畫		95 年員工認股權計畫	
	單位 (仟)	加權平均行使價格 (元)	單位 (仟)	加權平均行使價格 (元)
<u>103年度</u>				
年初流通在外	150	\$ 16.26	165	\$ 10.60
本年度執行	(105)	16.49	(92)	10.33
年底流通在外	<u>45</u>	15.74	<u>73</u>	10.10
年底可執行	<u>45</u>		<u>73</u>	
<u>102年度</u>				
年初流通在外	314	\$ 15.86	201	\$ 10.60
本年度執行	(157)	15.34	(36)	10.62
本年度取消	(7)	18.60	-	-
年底流通在外	<u>150</u>	16.26	<u>165</u>	10.60
年底可執行	<u>150</u>		<u>165</u>	

上述認股價格遇有無償配股及現金股利發放之情形時，業已依照本公司員工認股權憑證發行及認股辦法調整。

本公司流通在外之員工認股權憑證相關資訊如下：

103年12月31日		102年12月31日	
執行價格 之範圍 (元)	加權平均剩餘 合約期限 (年)	執行價格 之範圍 (元)	加權平均剩餘 合約期限 (年)
\$10.10	1.75~2.04	\$10.60~\$12.40	2.75~3.04
\$14.80~\$18.60	2.49~2.95	\$14.80~\$18.60	3.49~3.95

(二) 適用國際財務報導準則第 2 號「股份基礎給付」者

1. 權益交割之股份基礎給付

本公司對所有在 101 年 1 月 1 日後已給與並已既得之股份基礎給付之交易，選擇適用國際財務報導準則第 2 號。該等認股權計畫說明如下：

本公司於 101 年 1 月 10 日（100 年員工認股權計畫）經證期局核准發行員工認股權憑證 6,000 仟單位，每單位可認購普通股 1 股，授予對象包含本公司及子公司符合特定條件之員工；認股權憑證之存續期間為 5 年，憑證持有人自被授予認股權憑證屆滿 2 年後，得依認股辦法分年行使認股權利。

本公司員工認股權憑證之相關資訊如下：

100 年員工認股權計畫		
	單 位 (仟)	加權平均行使價格 (元)
<u>103 年度</u>		
年初流通在外	4,774	\$ 22.10
本年度執行	(1,522)	21.40
本年度取消	(342)	21.98
年底流通在外	<u>2,910</u>	21.40
年底可執行	<u>704</u>	
<u>102 年度</u>		
年初流通在外	5,528	\$ 22.10
本年度取消	(754)	22.10
年底流通在外	<u>4,774</u>	22.10
年底可執行	<u>-</u>	-

上述認股價格遇有無償配股及現金股利發放之情形時，業已依照本公司員工認股權憑證發行及認股辦法調整。

本公司流通在外之員工認股權憑證相關資訊如下：

103年12月31日		102年12月31日	
執 行 價 格 之 範 圍 (元)	加 權 平 均 剩 餘 合 約 期 限 (年)	執 行 價 格 之 範 圍 (元)	加 權 平 均 剩 餘 合 約 期 限 (年)
\$21.40	2.46	\$22.10	3.46

上述員工認股權計畫之給與日為 101 年 6 月 14 日。本公司按 Black-Scholes 選擇權評價模式計算認股權公允價值，於給與日之評價假設資訊如下：

評價假設

給與日股票市價 (元／股)	\$ 19.42
行使價格 (元／股)	22.30
預期波動率	43.73%
預期存續期間	3.875 年
預期股利率	-
無風險利率	0.96%

給與日股票市價係以市場法評估；預期波動率係採與本公司相似之類比公司歷史股價資訊為基礎計算。

本公司 103 及 102 年度所認列之員工認股權計畫酬勞成本分別為 4,811 仟元及 10,533 仟元。

2. 現金交割之股份基礎給付

本公司於 101 年 6 月 14 日經董事會決議通過以現金交割之股份基礎給付計畫（股票增值計畫），授予對象包含本公司符合特定條件之員工，前述之員工現金股票增值權之存續期間為 10 年，增值權之持有人自被授予現金股票增值權之次日可按股票增值計畫逐年累積比例行使現金股票增值權。本公司依約定於員工執行時按股票增值權之內含價值支付現金予員工。

本公司之股票增值計畫如下：

	101 年度股票 增 值 計 劃
給 與 日	101年6月14日
給與數量（仟單位）	2,000
合約期間	10 年
本年度實際離職率	-
估計未來離職率	-
給與日之執行價（元／股）	\$ 49.40

本公司 103 及 102 年度股票增值計畫之相關資訊如下：

	單 位 （ 仟 ）	加權平均行使價格 （ 元 ）
<u>103 年度</u>		
年初流通在外	<u>2,000</u>	\$ 49.30
年底流通在外	<u>2,000</u>	48.80
年底可執行	<u>1,200</u>	48.80
<u>102 年度</u>		
年初流通在外	<u>2,000</u>	\$ 49.40
年底流通在外	<u>2,000</u>	49.30
年底可執行	<u>800</u>	49.30

上述行使價格遇有無償配股及現金股利發放之情形時，業已依照本公司股票增值計畫辦法調整。

本公司於資產負債表日按 Black-Scholes 選擇權評價模式計算增值權公允價值，其評價假設資訊如下：

	103年12月31日	102年12月31日
衡量日股票市價（元／股）	\$ 50.91	\$ 31.60
行使價格（元／股）	\$ 48.80	\$ 49.30
預期波動率	44.81%~49.20%	42.20%~45.42%
預期存續期間	2.45~4.45 年	3.45~5.45 年
預期股利率	-	-
無風險利率	0.78%~1.15%	0.95%~1.31%

預期波動率係採與本公司相似之類比公司歷史股價資訊為基礎計算。

本公司 103 及 102 年度認列之股票增值計畫酬勞成本分別為 22,433 仟元及 10,374 仟元。截至 103 年及 102 年 12 月 31 日止，本公司股票增值計畫之負債分別為 32,807 仟元及 10,374 仟元；股票增值計畫之負債已符合既得條件之內含價值總額分別為 2,532 仟元及 0 元，加權平均剩餘合約期間分別為 7.45 年及 8.45 年。

二一、營業收入

本公司所產生收入之分析如下：

	103年度	102年度
晶圓級尺寸封裝	\$ 3,028,799	\$ 3,308,413
晶圓級後護層封裝	1,879,970	920,633
其 他	25,309	27,715
	<u>\$ 4,934,078</u>	<u>\$ 4,256,761</u>

二二、其他營業收益及費損淨額

	103年度	102年度
出租資產收益（費損）		
租金收入	\$697,958	\$151,006
出租資產折舊	(410,563)	(95,197)
其 他	(1,481)	(6,825)
	285,914	48,984
處分不動產、廠房及設備淨益	236	2,670
不動產、廠房及設備減損損失	(86,067)	(3,804)
其 他	(9,162)	3,158
	<u>\$190,921</u>	<u>\$ 51,008</u>

二三、利息收入

	103年度	102年度
利息收入		
銀行存款	<u>\$ 6,114</u>	<u>\$ 4,575</u>

二四、財務成本

	103年度	102年度
利息費用		
銀行借款	\$ 31,219	\$ 27,928
其 他	<u>2,239</u>	<u>-</u>
	33,458	27,928
現金流量避險自權益轉列之 損失	<u>500</u>	<u>230</u>
	<u>\$ 33,958</u>	<u>\$ 28,158</u>

二五、其他利益及損失

	103年度	102年度
外幣兌換淨益	\$ 49,819	\$ 12,117
保險理賠收入	8,856	-
透過損益按公允價值衡量之金 融工具淨損	(51,338)	(20,661)
其 他	<u>4,803</u>	<u>254</u>
	<u>\$ 12,140</u>	<u>(\$ 8,290)</u>

二六、所得稅

(一) 認列於損益之所得稅

本年度認列於損益之所得稅組成如下：

	103年度	102年度
當年度所得稅費用		
當年度產生者	\$ 84,268	\$ 29,381
以前年度所得稅調整	<u>4,876</u>	<u>698</u>
	89,144	30,079
遞延所得稅費用（利益）		
與暫時性差異產生及迴 轉有關	(38,503)	(4,488)
與所得稅抵減及虧損扣 抵有關	<u>(19,368)</u>	<u>34,291</u>
	<u>(57,871)</u>	<u>29,803</u>
認列於損益之所得稅費用	<u>\$ 31,273</u>	<u>\$ 59,882</u>

會計所得與當年度所得稅費用之調節如下：

	103年度	102年度
稅前淨利	<u>\$659,926</u>	<u>\$348,763</u>
稅前淨利按法定稅率計算之		
所得稅費用（17%）	\$112,187	\$ 59,289
調節項目之所得稅影響數		
決定課稅所得時應予調		
整增（減）項目	37,967	4,407
免稅所得	(30,689)	(21,995)
未分配盈餘加徵	12,969	-
暫時性差異之產生及迴轉	(38,503)	(4,488)
所得稅抵減再衡量	(67,534)	21,971
以前年度所得稅調整	<u>4,876</u>	<u>698</u>
認列於損益之所得稅費用	<u>\$ 31,273</u>	<u>\$ 59,882</u>

(二) 遞延所得稅

資產負債表中之遞延所得稅資產分析如下：

	103年12月31日	102年12月31日
投資抵減及虧損扣抵	<u>\$ 32,350</u>	<u>\$ 12,982</u>
暫時性差異		
折 舊	55,278	18,428
退貨及折讓負債準備	10,226	8,609
未實現存貨損失	3,072	1,296
其 他	<u>1,084</u>	<u>2,824</u>
	<u>\$102,010</u>	<u>\$ 44,139</u>

遞延所得稅資產之變動如下：

	年 初 餘 額	認列於（損）益	年 底 餘 額
103 年度			
投資抵減及虧損扣抵	\$ 12,982	\$ 19,368	\$ 32,350
暫時性差異			
折 舊	18,428	36,850	55,278
退貨及折讓負債準備	8,609	1,617	10,226
未實現存貨損失	1,296	1,776	3,072
其 他	<u>2,824</u>	(<u>1,740</u>)	<u>1,084</u>
	<u>\$ 44,139</u>	<u>\$ 57,871</u>	<u>\$ 102,010</u>

(接次頁)

(承前頁)

	年 初 餘 額	認列於(損)益	年 底 餘 額
102 年度			
投資抵減及虧損扣抵	\$ 47,273	(\$ 34,291)	\$ 12,982
暫時性差異			
折 舊	18,777	(349)	18,428
退貨及折讓負債準備	5,330	3,279	8,609
未實現存貨損失	1,462	(166)	1,296
其 他	1,100	1,724	2,824
	<u>\$ 73,942</u>	<u>(\$ 29,803)</u>	<u>\$ 44,139</u>

(三) 未於資產負債表中認列遞延所得稅資產之投資抵減及虧損扣抵之金額

未於資產負債表中認列遞延所得稅資產之投資抵減如下：

到 期 年 度	103年12月31日	102年12月31日
103 年度	\$ -	\$ 34,761
104 年度	-	22,863
	<u>\$ -</u>	<u>\$ 57,624</u>

未於資產負債表中認列遞延所得稅資產之虧損扣抵如下：

到 期 年 度	103年12月31日	102年12月31日
111 年度	<u>\$ 5,751</u>	<u>\$ 14,909</u>

(四) 未使用之投資抵減、虧損扣抵及免稅相關資訊

截至 103 年 12 月 31 日止，本公司投資抵減相關資訊如下：

法 令 依 據	抵 減 項 目	尚未抵減金額	到 期 年 度
促進產業升級條例	機器設備投資抵減	<u>\$ 10,210</u>	104

截至 103 年 12 月 31 日止，本公司虧損扣抵相關資訊如下：

到 期 年 度	尚未扣抵金額
108年度	\$ 19,260
111年度	<u>144,807</u>
	<u>\$164,067</u>

截至 103 年 12 月 31 日止，本公司從事先進積體電路封裝之所得可享受 5 年免稅如下：

增 資 擴 展 案	免 稅 期 間
第二次增資擴展免徵所得稅	99 至 103 年度
第三次增資擴展免徵所得稅	104 至 108 年度

(五) 兩稅合一相關資訊：

	103年12月31日	102年12月31日
可扣抵稅額帳戶餘額	<u>\$ 89,836</u>	<u>\$ 72,058</u>

本公司 103 年度預計之稅額扣抵比率為 11.35%，但依新修正之所得稅法第 66 條之 6，屬中國民國境內居住之個人股東其可扣抵稅額比率予以減半，並自 104 年 1 月 1 日起分配盈餘時開始適用；本公司 102 年度實際盈餘分配之稅額扣抵比率為 9.98%，係依台財稅字第 10204562810 號規定，計算首次採用 IFRSs 年度稅額扣抵比率時，其帳載累積未分配盈餘已包含因首次採用 IFRSs 產生之保留盈餘調整數。

實際分配予股東之可扣抵稅額，係以股利盈餘分配日之股東可扣抵稅額帳戶之餘額為準，因是預計盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅額扣抵比率有所差異。

本公司無屬於 86 年（含）以前之未分配盈餘。

(六) 所得稅核定情形

本公司截至 101 年度止之所得稅申報案件，業經稅捐稽徵機關核定。各年度經國稅局核定之各項投資抵減稅額差額，業已適當調整入帳。

二七、每股盈餘

	103年度	102年度
基本每股盈餘	<u>\$ 2.65</u>	<u>\$ 1.22</u>
稀釋每股盈餘	<u>\$ 2.60</u>	<u>\$ 1.21</u>

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下：

	金額（分子）	股數（分母） （ 仟 股 ）	每 股 盈 餘 （ 元 ）
<u>103年度</u>			
基本每股淨利			
屬於普通股股東之本年度淨利	\$ 628,653	237,258	\$ <u>2.65</u>
具稀釋作用潛在普通股之影響	<u>-</u>	<u>4,551</u>	
稀釋每股盈餘			
屬於普通股股東之本年度淨利加潛在普通股之影響	\$ <u>628,653</u>	<u>241,809</u>	\$ <u>2.60</u>
<u>102年度</u>			
基本每股盈餘			
屬於普通股股東之本年度淨利	\$ 288,881	236,318	\$ <u>1.22</u>
具稀釋作用潛在普通股之影響	<u>-</u>	<u>2,938</u>	
稀釋每股盈餘			
屬於普通股股東之本年度淨利加潛在普通股之影響	\$ <u>288,881</u>	<u>239,256</u>	\$ <u>1.21</u>

計算稀釋每股盈餘時，係假設員工紅利將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。計算稀釋每股盈餘時，以該潛在普通股於資產負債表日之公允價值，作為發行股數之判斷基礎。於次年度股東會決議員工分紅發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

二八、費用性質之額外資訊

本年度淨利係包含以下項目：

	103年度	102年度
(一) 不動產、廠房及設備之折舊		
認列於營業成本	\$ 867,980	\$ 766,391
認列於營業費用	11,031	7,412
認列於其他營業收益及費損	<u>410,563</u>	<u>95,197</u>
	<u>\$ 1,289,574</u>	<u>\$ 869,000</u>

	103年度	102年度
(二) 無形資產之攤銷		
認列於營業成本	\$ 9,281	\$ 21,428
認列於營業費用	<u>17,596</u>	<u>12,548</u>
	<u>\$ 26,877</u>	<u>\$ 33,976</u>
(三) 發生即認列為費用之研究及 發展支出	<u>\$ 276,680</u>	<u>\$ 216,971</u>
(四) 員工福利費用		
退職後福利計畫（參閱附註十 八）		
確定提撥計畫	\$ 50,932	\$ 45,632
確定福利計畫	<u>88</u>	(<u>46</u>)
	<u>51,020</u>	<u>45,586</u>
股份基礎給付		
現金交割之股份基礎給付	22,433	10,374
權益交割之股份基礎給付	<u>4,811</u>	<u>10,533</u>
	<u>27,244</u>	<u>20,907</u>
其他員工福利	<u>1,396,442</u>	<u>1,218,145</u>
	<u>\$ 1,474,706</u>	<u>\$ 1,284,638</u>
員工福利費用依功能別彙總		
認列於營業成本	\$ 1,169,403	\$ 1,040,220
認列於營業費用	<u>305,303</u>	<u>244,418</u>
	<u>\$ 1,474,706</u>	<u>\$ 1,284,638</u>

二九、資本管理

本公司資本管理係以確保能夠繼續經營之前提下，藉由維持債務及權益餘額之平衡及最適化，以使股東報酬極大化。本公司之資本管理乃確保具有足夠之財務資源，以支應未來 12 個月內之營運資金需求、資本支出、研究發展活動支出、股利支出、債務償還及其他營業需求。

三十、金融工具

(一) 金融工具之種類

	103年12月31日	102年12月31日
<u>金融資產</u>		
透過損益按公允價值衡量		
持有供交易者	\$ 389	\$ 172
備供出售金融資產		
以成本衡量之金融資產	-	-
放款及應收款		
現金及約當現金	806,445	1,031,142
應收票據及帳款淨額(含 關係人)	939,085	751,779
其他應收關係人款項	-	141,190
其他應收款項	2,697	310
存出保證金	8,904	8,550
	<u>\$ 1,757,520</u>	<u>\$ 1,933,143</u>
<u>金融負債</u>		
透過損益按公允價值衡量		
持有供交易者	\$ 12,644	\$ 7,235
指定為避險會計關係之衍生 金融工具	823	281
以攤銷後成本衡量		
應付帳款	287,046	243,857
應付工程及設備款	460,129	305,961
存入保證金	-	1,016,977
應付費用及其他流動負 債	287,957	262,625
長期銀行借款	2,662,500	2,109,375
	<u>\$ 3,711,099</u>	<u>\$ 3,946,311</u>

(二) 財務風險管理目的

本公司致力於確保公司於必要時具有足夠且具成本效益之營運資本。本公司積極管理與營運活動相關之外幣匯率風險、利率風險、信用風險及流動性風險等，以降低市場之不確定性對公司財務績效之潛在不利影響。

本公司之重要財務規劃，均經董事會依相關規範及內部控制制度進行覆核。本公司財務部門於執行財務計劃時，均恪遵關於整體財務風險管理及權責劃分之相關財務操作程序。

(三) 市場風險

本公司曝露於外幣匯率變動及利率變動等市場風險，並使用衍生金融工具以管理相關風險。

1. 外幣匯率風險

本公司營運活動主要係以外幣進行交易，因此產生外幣匯率風險。為避免因匯率變動造成外幣資產價值下跌及未來現金流量之波動，本公司使用遠期外匯合約等衍生金融工具來規避匯率風險。此類衍生金融工具之使用，可協助本公司減少但仍無法完全排除外幣匯率變動所造成之影響。

有關外幣匯率風險之敏感性分析，主要係針對報導期間結束日之外幣貨幣性項目，因匯率變動產生之不利影響計算。當外幣對新台幣產生不利之變動達百分之十，本公司於 103 及 102 年度之淨利將分別減少 4,264 仟元及 1,406 仟元，上述數字業已考慮避險合約及被避險項目之影響。

2. 利率風險

本公司之長期銀行借款係為浮動利率，利率變動將會影響未來現金流量，但不影響公允價值。故本公司簽定利率交換合約，以規避部分因利率變動造成之現金流量風險。

有關利率風險之敏感度分析，係假設報導期間結束日之浮動利率借款於整個報導期間持有，當利率上升一百個基點（1%），且其他條件固定不變的情況下，本公司上述浮動利率借款之利息費用稅後淨額於 103 及 102 年度將分別增加 17,949 仟元及 10,038 仟元。

(四) 信用風險管理

信用風險係指交易對方違反合約義務並對本公司造成財務損失之風險。本公司之信用風險，主要係來自於營運活動產生之應收款項與投資活動產生之銀行存款。截至資產負債表日，本公司可能因交易對方未履行義務造成財務損失之最大信用風險曝險係資產負債表所認列之金融資產帳面價值。

1. 營運相關信用風險

本公司流通在外之應收帳款主要係來自於全球之客戶群，且大部分應收帳款並未提供擔保品或信用保證。雖然本公司訂有相關程序監督管理並減少應收帳款之信用風險，但並不能保證該程序可以完全有效排除信用風險並避免損失。

本公司之信用風險主要係集中於本公司之前二大客戶。截至 103 年及 102 年 12 月 31 日止，對該客戶之應收帳款餘額分別佔本公司應收帳款餘額之 72% 及 69%。

2. 財務信用風險

本公司定期根據市場狀況以及履約交易對象之財務及信用狀況調整交易額度。此外，本公司亦透過挑選信用良好之金融機構作為交易對象以降低信用風險。

(五) 流動性風險管理

本公司管理流動性風險之目標，係為確保本公司有足夠之流動資金以支應未來營運需求。本公司係透過維持適當之資金及銀行額度，以支應各項合約義務。

銀行借款對本公司而言係為一項重要流動性來源。截至 103 年及 102 年 12 月 31 日止，本公司未動用之銀行融資額度分別為 3,059,207 仟元及 2,576,231 仟元。

下表係按到期日及未折現之到期金額（含本金及利息）彙總列示本公司已約定還款期間之金融負債分析：

	103年12月31日					
	短 於 1 年	2 至 3 年	4 至 5 年	5 年 以 上	合 計	
<u>非衍生金融負債</u>						
應付帳款	\$ 287,046	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 287,046	
應付工程及設備款	460,129	-	-	-	460,129	
應付費用及其他流動負債	287,957	-	-	-	287,957	
長期銀行借款	<u>307,730</u>	<u>1,792,342</u>	<u>633,044</u>	<u>-</u>	<u>2,733,116</u>	
	<u>1,342,862</u>	<u>1,792,342</u>	<u>633,044</u>	<u>-</u>	<u>3,768,248</u>	
<u>衍生金融負債</u>						
<u>遠期外匯合約</u>						
流 出	821,704	-	-	-	821,704	
流 入	(<u>809,449</u>)	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	(<u>809,449</u>)	
	<u>12,255</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12,255</u>	
	<u>1,355,117</u>	<u>1,792,342</u>	<u>633,044</u>	<u>-</u>	<u>3,780,503</u>	
<u>利率交換合約</u>						
流 出	5,540	5,297	-	-	10,837	
流 入	(<u>4,440</u>)	(<u>4,245</u>)	<u>-</u>	<u>-</u>	(<u>8,685</u>)	
	<u>1,100</u>	<u>1,052</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,152</u>	
	<u>\$ 1,356,217</u>	<u>\$ 1,793,394</u>	<u>\$ 633,044</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3,782,655</u>	

102年12月31日						
	短 於 1 年	2 至 3 年	4 至 5 年	5 年 以 上	合	計
<u>非衍生金融負債</u>						
應付帳款	\$ 243,857	\$ -	\$ -	\$ -	\$	243,857
應付工程及設備款	305,961	-	-	-		305,961
存入保證金	1,016,977	-	-	-		1,016,977
應付費用及其他流動負債	262,625	-	-	-		262,625
長期銀行借款	<u>223,035</u>	<u>1,548,493</u>	<u>400,251</u>	-		<u>2,171,779</u>
	<u>2,052,455</u>	<u>1,548,493</u>	<u>400,251</u>	-		<u>4,001,199</u>
<u>衍生金融負債</u>						
<u>遠期外匯合約</u>						
流 出	721,458	-	-	-		721,458
流 入	(<u>714,395</u>)	-	-	-	(	<u>714,395</u>)
	<u>7,063</u>	-	-	-		<u>7,063</u>
<u>利率交換合約</u>						
流 出	4,601	-	-	-		4,601
流 入	(<u>4,080</u>)	-	-	-	(	<u>4,080</u>)
	<u>521</u>	-	-	-		<u>521</u>
	<u>\$ 2,060,039</u>	<u>\$ 1,548,493</u>	<u>\$ 400,251</u>	<u>\$ -</u>		<u>\$ 4,008,783</u>

(六) 金融工具之公允價值

1. 以攤銷後成本衡量金融工具之公允價值

本公司以攤銷後成本衡量之金融資產及金融負債於財務報表中之帳面金額趨近公允價值。

2. 認列於資產負債表之公允價值衡量

本公司以公允價值衡量之金融資產及金融負債，其衡量方式依照公允價值可觀察程度分為第一至三級：

- (1) 第一級公允價值衡量係指活絡市場相同資產或負債之公開報價（未經調整）。
- (2) 第二級公允價值衡量係指除第一級之公開報價外，以屬於該資產或負債直接（亦即價格）或間接（亦即由價格推導而得）可觀察之輸入值推導公允價值。
- (3) 第三級公允價值衡量係指評價技術係非以可觀察市場資料為基礎之資產或負債之輸入值（不可觀察之輸入值）推導公允價值。

103年12月31日				
	第一等級	第二等級	第三等級	合 計
<u>透過損益按公允價值衡量之金融資產</u>				
衍生金融工具	\$ -	\$ 389	\$ -	\$ 389
<u>透過損益按公允價值衡量之金融負債</u>				
衍生金融工具	\$ -	\$ 12,644	\$ -	\$ 12,644
<u>避險之衍生金融負債</u>				
利率交換合約	\$ -	\$ 823	\$ -	\$ 823

102年12月31日				
	第一等級	第二等級	第三等級	合計
<u>透過損益按公允價值衡量</u>				
<u>之金融資產</u>				
衍生金融工具	\$ -	\$ 172	\$ -	\$ 172
<u>透過損益按公允價值衡量</u>				
<u>之金融負債</u>				
衍生金融工具	\$ -	\$ 7,235	\$ -	\$ 7,235
<u>避險之衍生金融負債</u>				
利率交換合約	\$ -	\$ 281	\$ -	\$ 281

本公司於 103 及 102 年度均未有第一級與第二級公允價值衡量間移轉之情形。

本公司於 103 及 102 年度均未有取得或處分以第三級公允價值衡量之金融資產等情形。

3. 衡量公允價值所採用之評價技術及假設

本公司金融資產及金融負債之公允價值係依下列方式決定：

(1) 遠期外匯合約公允價值係以遠期匯率報價及相對應之殖利率曲線衡量。利率交換合約係以未來估計之現金流量按相對之殖利率曲線折現之現值衡量。

(2) 其他金融資產及金融負債之公允價值係採用以現金流量折現分析為基礎之一般公認評價模式決定其公允價值。

三一、關係人交易

本公司與關係人間之交易明細揭露如下：

(一) 營業交易

	營業收入	淨額	製造費用	
	103年度	102年度	103年度	102年度
具重大影響力之投資者	\$ 3,158,150	\$ 2,335,155	\$ 2,034	\$ 1,067
母 公 司	-	107,626	-	1,058
其他關係人	-	1,884	151	9,859
	<u>\$ 3,158,150</u>	<u>\$ 2,444,665</u>	<u>\$ 2,185</u>	<u>\$ 11,984</u>
	營業費用	租金	收入	
	103年度	102年度	103年度	102年度
具重大影響力之投資者	\$ 5,304	\$ 39	\$ 697,958	\$ 151,006
其他關係人	1,089	672	-	-
母 公 司	-	170	-	-
	<u>\$ 6,393</u>	<u>\$ 881</u>	<u>\$ 697,958</u>	<u>\$ 151,006</u>

	進	貨
	103年度	102年度
具重大影響力之投資者	<u>\$ 2,127</u>	<u>\$ -</u>
	購 置 固 定 資 產 價 款	
	103年度	102年度
具重大影響力之投資者	\$ 23,447	\$ 57,943
其他關係人	757	47,358
母 公 司	-	26,978
	<u>\$ 24,204</u>	<u>\$132,279</u>

報導期間結束日之流通在外餘額如下：

	應 收 關 係 人 款 項	
	103年12月31日	102年12月31日
具重大影響力之投資者	\$673,319	\$516,348
其他關係人	-	83
	<u>\$673,319</u>	<u>\$516,431</u>
	其 他 應 收 關 係 人 款 項	
	103年12月31日	102年12月31日
具重大影響力之投資者	<u>\$ -</u>	<u>\$141,190</u>
	其 他 流 動 資 產	
	103年12月31日	102年12月31日
具重大影響力之投資者	<u>\$ 792</u>	<u>\$ 678</u>
	應 付 帳 款	
	103年12月31日	102年12月31日
具重大影響力之投資者	<u>\$ 517</u>	<u>\$ -</u>
	應 付 工 程 及 設 備 款	
	103年12月31日	102年12月31日
具重大影響力之投資者	<u>\$ -</u>	<u>\$ 55,130</u>
	應 付 費 用 及 其 他 流 動 負 債	
	103年12月31日	102年12月31日
具重大影響力之投資者	\$ 683	\$ 3,310
其他關係人	380	-
	<u>\$ 1,063</u>	<u>\$ 3,310</u>

本公司與關係人之銷貨及進貨交易，其交易價格與收款條件與非關係人並無重大差異，其餘關係人交易，因無相關同類交易可循，其交易條件係由雙方協商決定。

本公司出租機器設備與台積公司，租約內容係由租賃雙方協議決定，租金按季支付，相關之租金收入帳列其他收益及費損項下。

(二) 對主要管理階層之獎酬

本公司 103 及 102 年度對董事及其他主要管理階層成員之薪酬總額如下：

	103年度	102年度
短期員工福利	\$ 44,367	\$ 41,460
退職後福利	729	756
股份基礎給付	23,398	11,933
	<u>\$ 68,494</u>	<u>\$ 54,149</u>

董事及其他主要管理階層之薪酬係由薪酬委員會依照個人績效及市場趨勢決定。

三二、質抵押之資產

本公司提供部分機器設備作為長期銀行借款之擔保品，列示如下：

	103年12月31日	102年12月31日
擔保機器設備	<u>\$684,708</u>	<u>\$135,288</u>

三三、重大營業租賃協議

本公司廠房及辦公室主係向經濟部工業局中壢工業區承租，租期將於 103 年 8 月至 109 年 10 月陸續到期，其中經濟部工業局中壢工業區得依規定調整租金，所有租約到期時均可再續約。

本公司認列為費用之租賃給付如下：

	103年度	102年度
最低租賃給付	<u>\$ 51,955</u>	<u>\$ 48,624</u>

本公司因上述不可取消之營業租賃所負擔之未來最低租賃給付如下：

	103年12月31日	102年12月31日
1 年 內	\$ 45,789	\$ 46,372
超過 1 年但未超過 5 年	97,320	105,115
超過 5 年	3,187	9,327
	<u>\$146,296</u>	<u>\$160,814</u>

三四、重大或有負債及未認列之合約承諾

除已於其他附註揭露者外，本公司於資產負債表日尚有下列重大或有負債及未認列之合約承諾：

- (一) 依本公司於 89 年 6 月與 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd. (原以色列商雪兒凱斯 ShellCase Ltd.) 簽訂之技術授權合約，本公司於合約有效期間內分期支付之技術授權費已於 90 年 6 月全數支付完畢。該技術授權費帳列無形資產之專門技術項下，且按耐用年限 20 年攤銷。另依該合約規定，自 92 年 4 月起連續 12 年，若使用該特定技術製造及銷售產品時，依合約規定應按其特定產品銷售收入淨額之若干比率支付權利金。
- (二) 截至 103 年及 102 年 12 月 31 日止，本公司因購買機器設備已開立未使用之信用狀金額分別為 4,243 仟元及 0 元。
- (三) 本公司承諾購置之固定資產合約總價約為 434,935 仟元。

三五、外幣金融資產及負債之匯率資訊

本公司具重大影響之外幣金融資產及負債資訊如下：

單位：各外幣仟元

	外	幣	匯 率 (註)	帳 面 金 額
<u>103 年 12 月 31 日</u>				
<u>金融資產</u>				
<u>貨幣性項目</u>				
美 金	\$	32,882	31.604	\$1,039,207
日 幣		21,090	0.2646	5,580
歐 元		1,451	38.47	55,831
瑞士法郎		178	31.98	5,681
<u>金融負債</u>				
<u>貨幣性項目</u>				
美 金		5,256	31.604	166,126
日 幣		21,126	0.2646	5,590
歐 元		1,451	38.47	55,831
瑞士法郎		178	31.98	5,681

(接 次 頁)

(承前頁)

	外	幣	匯 率 (註)	帳 面 金 額
<u>102 年 12 月 31 日</u>				
<u>金融資產</u>				
貨幣性項目				
美 金	\$	30,280	29.800	\$ 902,358
日 幣		6,751	0.2839	1,917
歐 元		343	41.09	14,109
瑞士法郎		247	33.49	8,263
<u>金融負債</u>				
貨幣性項目				
美 金		5,474	29.800	163,128
日 幣		8,303	0.2839	2,357
歐 元		353	41.09	14,498
瑞士法郎		247	33.49	8,263

註：匯率係每單位外幣兌換為新台幣之金額。

三六、營運部門資訊

(一) 營運部門資訊

經依據主要營運決策者定期覆核用以分配資源及績效衡量之營運結果，本公司係屬單一營運部門。營運部門損益、資產及負債之衡量基礎與財務報表編製基礎相同，相關營運部門資訊請參閱前述之財務報表。

(二) 地區別資訊如下：

地 區	103年度	102年度
台 灣	\$ 2,069,314	\$ 1,190,213
美 國	1,528,052	1,630,592
亞 洲	686,177	960,429
歐 洲	650,535	475,527
	<u>\$ 4,934,078</u>	<u>\$ 4,256,761</u>

本公司地區別收入係以收款地區為計算基礎；非流動資產全部皆在台灣，故無需揭露非流動資產資訊。

(三) 產品別資訊如下：

產 品 別	103年度	102年度
晶圓級尺寸封裝	\$ 3,028,799	\$ 3,308,413
晶圓級後護層封裝	1,879,970	920,633
其 他	25,309	27,715
	<u>\$ 4,934,078</u>	<u>\$ 4,256,761</u>

(四) 重要客戶資訊如下：

佔本公司營業收入淨額百分之十以上之客戶明細如下：

客 戶	103年度		102年度	
	金 額	所佔比例 (%)	金 額	所佔比例 (%)
甲 公 司	\$ 1,732,290	35	\$ 862,202	20
乙 公 司	1,425,860	29	1,580,579	37
丙 公 司	667,339	14	422,281	10
丁 公 司	476,558	10	484,182	11

三七、附註揭露事項

(一) 重大交易事項：

1. 資金貸與他人：無。
2. 為他人背書保證：無。
3. 期末持有有價證券情形：

單位：新台幣仟元

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳 列 科 目	期 末				備 註
				股 數 單位數(仟)	帳 面 金 額	持 股 比 例 (%)	公 允 價 值	
本公司	美商坎伯狄吉有限公司 (Compositech Ltd.)	—	以成本衡量之 金融資產	587	\$ -	2.67	\$ -	註一

註一：該公司於 91 年度下市，本公司已於該年度全數提列減損損失。

註二：截至 103 年 12 月 31 日止，上述有價證券並未提供擔保、質押或其他依約定而受限制使用者。

4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣 3 億元或實收資本額 20%以上：無。
5. 取得不動產之金額達新台幣 3 億元或實收資本額 20%以上：無。
6. 處分不動產之金額達新台幣 3 億元或實收資本額 20%以上：無。

7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣 1 億元或實收資本額 20% 以上：

單位：新台幣仟元

進(銷)貨之公司	交易對象	關係	交易情形				交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)之比率	授信期間	單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率	
本公司	台積公司	對本公司採權益法評價之投資公司	銷貨	\$1,732,290	35%	月結 30 天	參閱附註三一	參閱附註三一	\$ 461,494	49%	—
	OmniVision	本公司法人董事之母公司	銷貨	1,425,860	29%	月結 30 天	參閱附註三一	參閱附註三一	211,825	23%	—

8. 應收關係人款項達新台幣 1 億元或實收資本額 20% 以上：

單位：新台幣仟元

帳列應收款項之公司	交易對象	關係	應收關係人款項餘額	週轉天數	逾期應收關係人款項金額	處理方式	應收關係人款項期後收回金額	提列備抵呆帳金額
本公司	台積公司	對本公司採權益法評價之投資公司	\$ 461,494	80	\$ -	—	\$ 211,821	\$ -
	OmniVision	本公司法人董事之母公司	211,825	56	-	—	77,900	208

9. 從事衍生性金融商品交易：請詳附註七及八。

(二) 轉投資事業相關資訊：無。

(三) 大陸投資資訊：無。

精材科技股份有限公司

股票初次申請上櫃 推薦證券商評估報告

推薦證券商：凱基證券股份有限公司



華南永昌綜合證券股份有限公司



元富證券股份有限公司



第一金證券股份有限公司



中 華 民 國 一 〇 三 年 九 月 三 十 日 編 撰

中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 三 日 修 訂

精材科技股份有限公司

產業、營運及其他重要風險

一、產業風險

(一)受產業景氣波動影響

由於 IC 封裝業屬半導體產業之後段製程，半導體產業與全球經濟景氣相關，而該公司封裝之產品終端應用領域以手機、筆記型電腦及平板電腦等消費性電子產品為主，故該公司所屬之產業亦受景氣波動之影響。

因應對策：

該公司耕耘半導體封裝服務領域多年，由於該公司封裝之產品終端應用領域以消費性電子產品為主，該公司除致力於衍生製程與新製程之研究發展，並將產品之應用由消費性電子產品進而提昇至汽車電子產業，以降低景氣循環所帶來之衝擊。

(二)市場競爭者增加

中國政府重金支持半導體先進製程技術之開發，包含 IC 設計、晶圓代工、封裝測試乃至設備研發等產業，其供應鏈所形成的群聚效應，將影響客戶之產能配置，且可能以具有市場競爭力之價格，進而侵蝕市場佔有率。

因應對策：

聚焦發展先進晶圓層級封裝，因應各種功能應用來達到產品差異化的效果，導入自動化設備，提升產能及品質並有效降低成本，選擇及轉進利基應用市場，包括綠能、醫療、車用電子等領域，對於類比、感測器等晶片出現高度需求，同時強力佈局專利地圖，以提升並拉大競爭力之差異化。

二、營運風險

(一)銷貨客戶集中

該公司耕耘半導體後段封裝服務領域多年，主要銷貨戶客戶包括國際知名影像感測器大廠、國內外半導體設計公司及半導體晶圓大廠等，前十大客戶銷貨金額佔各年度營收淨額之比重為九成以上。

因應對策：

該公司業已持續精進二維及三維晶圓級相關先進製程技術之開發，並建置 12 吋晶圓級封裝之產線，以因應影像感測器客戶之產能需求，希冀藉由封裝服務技術暨應用產品之多元化增加客戶群及擴大終端產品應用。未來期能將業務擴展至晶圓級系統整合封裝(System in Package)。

(二)資本支出大

由於 IDM 廠(Integrated Device Manufacture 整合元件廠，簡稱 IDM)委外代工訂單趨增，使得封裝廠商大舉擴充採購機器設備，而各家半導體晶圓製造廠陸續邁入更高階先進製程，封裝技術難度亦同步提高，所需投入之資本支出亦將增加。

因應對策：

該公司擁有產業經驗豐富之經營及研發團隊，隨時掌握市場需求，藉以了解封裝技術之未來趨勢，開發出符合市場及客戶需求的封裝技術，並審慎評估資金運用、設備投資及人員招募計畫，隨著市場需求適時調整機器設備組合。

(三)終端產品價格下跌快速

終端產品生命週期短，平均售價下滑，產品替代性高，在眾多競爭者同時分食市場大餅的情況下，競爭激烈，使得價格下跌快速，產品利潤薄。

因應對策：

因應電子產業及半導體產業市場與其技術的不斷變化，該公司的競爭利基為持續開發先進製程與新衍生技術，以提供予客戶最佳之封裝解決方案，並積極降低製造成本以及提升生產效能，進而提升或維持利潤。

三、其他重要風險

另其他有關產業現況及發展性以及公司營運風險，請詳評估報告第 12~41 頁之說明。

綜上所述，就該公司產業、營運及其他風險三方面，分別予以評估其各項可能風險之因應措施，該公司已具備降低風險之能力，其措施尚屬穩當。

目錄

壹、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃董事會暨審議委員會要求補充揭露事項.....	1
一、對該公司業績變化合理性及未來發展性之說明。.....	1
二、對該公司之銷售客戶 OVTI 集團最近三年度營收占比分別為 40.17%、37.13%及 28.90%，OVTI 集團於 103 年 8 月中接獲北京清芯華創投資管理有限公司(Hua Capital Management)和上海浦東科技投資有限公司等所組成財團主導之收購邀約，有關此一收購案對未來財務業務之影響及所採行具體因應措施之說明。.....	1
三、對該公司屬資本密集產業，有關新興產品未來發展趨勢對公司封裝技術需求改變，以及產能利用率不佳等可能造成虧損之風險及所採行具體因應措施之說明。.....	1
四、對該公司面臨終端消費性電子產品生命週期短及售價快速下滑之風險所採行具體因應措施之說明。.....	1
五、對該公司為提供台積電公司感測器封裝服務而與其有設備採購及租賃等交易合理性之說明.....	1
六、對該公司未來研發技術布局策略及如何避免侵犯他人專利與被他人侵權具體作法之說明。.....	1
七、對該公司關鍵技術及與同業優劣勢分析之說明。.....	1
八、對該公司擴建廠房之必要性、目前進度、資金來源及預計未來效益之說明。.....	1
貳、評估報告總評.....	2
一、承銷股數總說明.....	2
二、具體說明申請公司與推薦證券商共同訂定承銷價格之依據及方式.....	3
三、承銷風險因素說明.....	9
四、總結.....	11
參、推薦證券商就外國申請公司應列示說明其註冊地國及主要營運地國之總體經濟、政經環境變動、相關法令、外匯管制及租稅，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項，並評估外國申請公司所採行相關因應措施之適當性.....	12
肆、產業狀況及營運風險.....	13
一、申請公司所屬行業營運風險.....	13
二、申請公司營運風險.....	21
伍、業務狀況.....	42
一、營業概況.....	42
二、存貨概況.....	60
三、申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止之業績概況.....	65
四、併購他公司尚未屆滿一完整會計年度者，評估購併之目的、效益、交易合理性等因素.....	70
陸、財務狀況.....	71

一、申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止財務比率之分析，與同類別上櫃、上市公司及未上櫃、未上市同業財務比率之比較分析—應包括財務結構、償債能力、經營能力、獲利能力與現金流量.....	71
二、申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止申請公司及其各子公司暨母子公司間背書保證、重大承諾、資金貸與他人、衍生性商品交易及重大資產交易之情形，並評估對其財務狀況之影響.....	78
三、申請公司申請年度截至最近期止之擴廠計畫及資金來源、工作進度、預計效益，並評估其可行性.....	81
四、個體及合併財務報告之轉投資事業.....	82
五、申請公司分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至且採內含價值法之員工認股權憑證，於股票上櫃後所產生之費用對財務報表可能之影響.....	83
六、公營事業申請股票上櫃時，其檢送之財務報告以經審計機關審定之審定報告書替代者，應洽會計師就如適用一般公認會計原則與審計機關審定數之差異，及其對財務報告之影響表示意見.....	83
七、推薦證券商應評估外國申請公司依註冊地國法令規定發行之員工認股權憑證及具股權性質有價證券之發行辦法合理性暨對股東權益之影響.....	83
柒、關係人交易評估.....	84
一、針對申請公司交易金額重大或性質特殊之關係人交易執行相關評估程序（包括與同業及非關係人交易之比較），以瞭解其交易之必要性，決策過程合法性，暨價格與款項收付情形之合理性.....	84
二、瞭解申請公司金額重大之關係企業應收款項是否逾期，針對逾期者，應查明其原因及有無重大異常情事.....	91
三、申請公司與關係企業、股東或關係人間有鉅額資金往來者，應查明其原因，及利率、收付息情形有無重大異常之情事.....	91
捌、推薦證券商派員實地瞭解申請公司之重要子公司營運情形者，應具體列示是否有重大營運風險或其他重大異常情事之評估意見.....	91
玖、法令之遵循及對公司營運影響.....	91
一、申請公司是否違反相關法令規章.....	91
二、申請時之董事、監察人、大股東、總經理及實質負責人是否違反相關法令，而有違誠信原則或影響其職務之行使.....	92
三、是否違反著作權、專利權、商標權或其他智慧財產權之情事.....	92
四、繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件.....	92
五、申請公司是否有重大勞資糾紛或污染環境事件.....	94
六、外國申請公司之推薦證券商應洽律師對申請公司、申請時之董事、監察人、大股東、總經理及實質負責人最近三年內就下列事項出具之法律意見書，依據其意見，推薦證券商再就該等項目具體評估對申請公司營運影響及因應之道.....	94
拾、依財團法人櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第十條第一項各款	

所列不宜上櫃情事之評估意見(詳附件一).....	94
拾壹、列明申請公司設置之薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項是否依我國證券法令規定辦理之評估意見.....	94
一、成員之專業資格.....	94
二、職權行使及相關事項.....	94
拾貳、評估申請公司之公司治理自評報告是否允當表達其公司治理運作情形.....	95
拾參、評估本國申請公司是否符合集團企業、建設公司、資訊軟體公司、投資控股公司、金融控股公司、參與公共建設之民間機構申請股票上櫃之補充規定.....	96
拾肆、以投資控股公司身分申請其股票為櫃檯買賣者，推薦證券商亦應就其被控股公司依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃之推薦證券商評估報告應行記載事項要點」第五條、第七條第四項、第十條及第十一條規定逐項評估.....	104
拾伍、本國上櫃（市）公司之海外子公司申請其股票為櫃檯買賣者，推薦證券商應就下列事項詳加評估說明.....	104
拾陸、自推薦證券商評估報告完成日起至股票上櫃用公開說明書列印日前，如有重大期後事項，推薦證券商對上列各項目應加以更新說明與評估.....	104
拾柒、其他補充揭露事項.....	105
附件一、依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所有價證券審查準則」第十條第一項所列各款不宜上櫃情事，推薦承銷商審查意見.....	106

壹、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃董事會暨審議委員會要求補充揭露事項

一、對該公司業績變化合理性及未來發展性之說明。

請詳公開說明書「壹、二、(一)」之說明。

二、對該公司之銷售客戶OVTI集團最近三年度營收占比分別為40.17%、37.13%及28.90%，OVTI集團於103年8月中接獲北京清芯華創投資管理有限公司(Hua Capital Management)和上海浦東科技投資有限公司等所組成財團主導之收購邀約，有關此一收購案對未來財務業務之影響及所採行具體因應措施之說明。

請詳公開說明書「壹、一、(一)、1」之說明。

三、對該公司屬資本密集產業，有關新興產品未來發展趨勢對公司封裝技術需求改變，以及產能利用率不佳等可能造成虧損之風險及所採行具體因應措施之說明。

請詳公開說明書「壹、一、(一)、2」之說明。

四、對該公司面臨終端消費性電子產品生命週期短及售價快速下滑之風險所採行具體因應措施之說明。

請詳公開說明書「壹、一、(一)、3」之說明。

五、對該公司為提供台積電公司感測器封裝服務而與其有設備採購及租賃等交易合理性之說明

請詳公開說明書「壹、一、(二)、1」之說明。

六、對該公司未來研發技術布局策略及如何避免侵犯他人專利與被他人侵權具體作法之說明。

請詳公開說明書「壹、一、(二)、2」之說明。

七、對該公司關鍵技術及與同業優劣勢分析之說明。

請詳公開說明書「壹、一、(二)、3」之說明。

八、對該公司擴建廠房之必要性、目前進度、資金來源及預計未來效益之說明。

請詳公開說明書「壹、一、(三)、1」之說明。

貳、評估報告總評

一、承銷股數總說明

(一)精材股份有限公司(以下簡稱精材或該公司)申請上櫃時之實收資本額為新台幣2,380,508仟元，每股面額新台幣10元整，已發行股數為238,051仟股，另該公司於申請上櫃後至股票掛牌前，因已執行員工認股權憑證而新增之股數為236仟股，故預計該公司於辦理股票公開承銷前已發行股數為238,287仟股。該公司擬於股票初次申請上櫃經主管機關審查通過後，預計辦理現金增資發行新股30,000仟股作為股票公開承銷作業之用，預計股票上櫃掛牌時之實收資本額為2,682,869仟元，發行股數為268,287仟股。

(二)公開承銷股數來源

該公司本次申請股票上櫃，爰依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第四條之規定，採用現金增資發行新股辦理上櫃前公開承銷，另依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對公開發行公司申請股票櫃檯買賣應委託推薦證券商辦理承銷規定」第二條之規定，應至少提出擬上櫃股份總額10%委託推薦證券商辦理承銷，但依該比率計算之承銷股數如超過一千萬股以上者，以不低於一千萬股之股數辦理承銷。該公司依擬上櫃股份總額之10%計算應提出公開承銷股數已超過一千萬股，且將預計以現金增資發行新股30,000仟股，並依公司法第267條之規定，保留發行股份之15%，計4,500仟股予員工認購外，其餘25,500仟股則依證券交易法第28條之規定排除公司法第267條第3項原股東優先認購之適用，全數辦理上櫃前公開承銷。

(三)過額配售

該公司爰依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第四條及「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」第二條之規定，於103年8月7日經董事會通過，與推薦證券商簽訂「過額配售協議書」，協議提出委託推薦證券商辦理公開承銷股數之15%額度內，提供已發行普通股股票供推薦證券商辦理過額配售，惟推薦證券商得依市場需求決定過額配售數量。

(四)符合股權分散標準

截至103年9月30日止，該公司內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東為6,898人，且其所持股份總額合計95,649,803股，佔目前已發行股份總額40.18%，該公司已符合股票上櫃股權分散標準。

二、具體說明申請公司與推薦證券商共同訂定承銷價格之依據及方式

(一)承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式

股價評估之方法有很多種，各有其優劣，評估的結果亦有所差異，茲將目前市場上常用的股價評價方式分述如下：

1.市場基礎法

市場基礎法主要係與上市、櫃公司中產業性質相近的同業，透過已公開資訊與被評價公司歷史軌跡比較，作為評價企業的價值。市場上運用市價計算股價之方法，主要為本益比法及股價淨值比法。本益比法及股價淨值比法係依據該公司之財務資料，計算每股盈餘及每股淨值，比較同業公司平均本益比及股價淨值比估算股價，再參考同業之市場價格及流動性、知名度、公司規模等等進行折溢價調整，因其乃以同業已公開之市場資訊作為基礎，客觀易懂又能貼近市場價值，是目前市場上最常用亦最為投資人接受之價格評定方式。

2.成本法

成本法近似重置成本的理論，所謂重置成本法，本指企業如要重置或重購相似資產所需花費之數額。以重置成本來估計資產之價值，即是以企業重置或重購相同獲利能力之資產所需花費之成本數額來估計其價值，且必須有相似且合理之資產價格可供參考，另外使用成本法的限制有下列四種：

- (1)無法表達目前真正及外來的經濟貢獻值。
- (2)忽略了技術經濟壽年。
- (3)技術廢舊及變革對於其所造成的風險無法預測。
- (4)成本法中對於折舊項目及金額有量化的困難。

由於上述種種限制，故國際上採成本法評估企業價值者並不多見，因此本推薦證券商不擬採用此種方式作為承銷價格訂定之參考依據。

3.收益基礎法

收益基礎法係根據該公司未來預估之獲利及現金流量，以涵蓋風險的折現率來折算現金流量，同時考慮實質現金及貨幣之時間價值。

茲就各種評價方法之優點、缺點及適用時機彙總說明如下：

項目	本益比法	股價淨值比法	成本法	收益基礎法
計算方式	依據公司之財務資料，計算每股帳面盈餘，並以上市櫃公司或產業性質相近的同業平均本益比估算股價，最後再調整溢價和折價以反應與類似公司不同之處。	依據公司之財務資料，計算每股帳面淨值，比較上市櫃公司或產業性質相近的同業平均股價淨值比估算股價，最後再調整溢價和折價以反應與類似公司不同之處。	以帳面之歷史成本資料為公司價值評定之基礎，即以資產負債表帳面資產總額減去帳面負債總額，並考量資產及負債之市場價格而進行帳面價值調整。	根據公司預估之獲利及現金流量，以涵蓋風險的折現率來折算現金流量，同時考慮實質現金及貨幣之時間價值。

項目	本益比法	股價淨值比法	成本法	收益基礎法
優點	1.具經濟效益與時效性，為一般投資人投資股票最常用之參考依據。 2.市場價格資料較易取得。	1.淨值係長期且穩定之指標，盈餘為負時之另一種評估選擇。 2.市場價格資料容易取得。	1.資料取得容易。 2.使用財務報表之資料，較客觀公正。	1.符合學理上對價值的推論，能依不同變數預期來評價公司。 2.較不受會計原則或會計政策不同影響，且可反應企業之永續經營價值。 3.考量企業之成長性及風險。
缺點	1.盈餘品質易受會計方法之選擇而受影響。 2.企業每股盈餘為負值或接近於零時不適用。 3.使用歷史性財務資訊，無法反應公司未來之績效。	1.帳面價值易受會計方法之選擇而受影響。 2.使用歷史性財務資訊，無法反應公司未來之績效。	1.資產帳面價值與市場價值差距甚大。 2.未考量公司經營成效之優劣。	1.程式繁瑣，需估計大量變數，花費成本大且不確定性高。 2.投資者不易瞭解現金流量觀念。
適用時機	評估風險水準、股利政策及成長率穩定的公司。	評估產業具有獲利波動幅度大之特性的公司。	評估如公營事業或傳統產業類股。	1.可取得公司詳細的現金流量與資金成本的預測資訊時。 2.企業經營穩定，無鉅額資本支出。

該公司為專業3D晶圓級IC 封裝之領導者，主要業務為提供影像感測器、環境感測器等之晶圓級尺寸封裝，其指紋辨識感測器、微機電及電源控制元件之晶圓級後護層封裝服務技術已臻成熟，並深獲客戶肯定，故該公司近年來的營業收入呈現成長之勢，獲利表現亦屬良好，因此，在股價的評價上較不適用以評估資產投資金額較高的公司常用的股價淨值比法，或用於評估如傳統產業類股或公營事業之成本法；而收益基礎法對於公司未來數年的盈餘及現金流量均屬估算價格時必備之基礎，然因預測期間長，不僅因難度相對較高，且資料未必十分準確，較無法合理評估公司應有的價值；由於目前台灣市場上投資人對於獲利型、成長型或股利發放穩定的公司訂價多以每股盈餘為評價基礎，其最大優點在於簡單易懂，而且台灣市場投資人的認同度較高，因而廣為獲利型、成長型或股利發放穩定之公司所採用，故擬採用市場基礎法作為承銷價格訂定所採用的方法應屬較佳之評價模式。

(二)承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式及與適用國際慣用之市價法、成本法及收益基礎法之比較。

股價評估之方法有很多種，各有其優劣，評估的結果亦有所差異，目前市場上常用的股價評價方式包括市價法之本益比法與股價淨值比法、成本法之帳面價值法及收益基礎法等。

1.市場基礎法

該公司為專業晶圓級IC封裝之領導廠商，主要服務包括晶圓級尺寸封裝服務與晶圓級後護層封裝服務，晶圓級尺寸封裝主要應用於影像感測器及環境感測器等光學感測元件，晶圓級後護層封裝服務主要應用於功率分離式元件、微機電系統感測器元件、指紋辨識感測器元件和整合式被動元件等。綜觀目前國內上市櫃及興櫃公司，封裝技術及產品組合並無與該公司完全相同者，故以同為半導體封裝及測試產業及部分產品應用端相同作為取樣之依據：上市公司日月光主要係從事各型積體電路之製造、組合、加工、測試及外銷，亦有封裝影像感測器模組及指紋辨識感測器模組與該公司產品應用端相同；上市公司同欣主要係從事高頻無線通訊模組、混合積體電路模組、陶瓷電路板及影像產品等電子產品生產及銷售，亦有影像感測器封裝與該公司產品應用端相同；上市公司菱生主要係從事各積體電路及各種半導體零組件之封裝加工、測試、製造及買賣，亦有用於手機或行動裝置之環境光學感測器模組封裝測試與該公司產品應用端相同。在綜合考量比較上述公司之產品營收比重、業務內容、實收資本額及資產規模等，選取日月光(2311)、同欣(6271)及菱生(2369)為採樣同業，茲彙整該公司採樣同業公司之本益比如下：

(1)本益比法

月份/公司	日月光	同欣	菱生	上市 半導體業	上櫃 半導體業
103年12月	14.01	11.19	21.47	15.18	23.23
104年01月	14.67	11.81	22.94	15.29	23.34
104年02月	15.55	12.42	22.21	14.45	23.60
平均本益比	14.74	11.81	22.21	14.97	23.39

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及臺灣證券交易所網站

由上表得知，該公司之採樣同業、上市櫃半導體業最近三個月之平均本益比在11.81倍～23.39倍之間，若以該公司103年度之每股盈餘2.65元為計算基礎，按上述平均本益比區間計算其參考價格，價格約31.30元～61.98元之間。

(2)股價淨值比法

月份/公司	日月光	同欣	菱生	上市 半導體業	上櫃 半導體業
103 年 12 月	2.23	1.84	0.86	2.88	2.49
104 年 01 月	2.34	1.94	0.92	2.91	2.50
104 年 02 月	2.48	1.97	0.89	2.89	2.53
平均股價淨值比	2.35	1.92	0.89	2.89	2.51

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及臺灣證券交易所網站

由上表得知，該公司之採樣同業、上市櫃半導體業最近三個月之平均股價淨值比在0.89倍～2.89倍之間，若依據該公司103年度經會計師查核簽證之每股淨值為19.55元，按上述平均股價淨值比區間計算其參考價格，價格約在17.40元～56.50元之間。

2.成本法(帳面價值法)

成本法係為帳面價值法（Book Value Method），帳面價值乃是投資人對公司請求權價值之總和，包含債權人、普通股投資人及特別股投資人等，其中股票投資者對公司之請求權價值係公司資產總額扣除負債總額之淨資產價值。此種評價方式係以歷史成本為計算之依據，將忽略通貨膨脹因素且無法表達資產實際經濟價值，並深受財務報表採行之會計原則與方法影響，將可能低估成長型公司之企業價值，因此國際上以成本法評價初次上市（櫃）公司之企業價值者不多見。該公司103年度經會計師查核簽證之每股淨值約為19.55元，遠低於該公司103年12月～104年2月興櫃市場各月平均價格43.80元～49.73元，係因未能考量該公司實質企業價值，故本推薦證券商不擬採用此種評價方法。

3.收益基礎法

收益基礎法係根據公司預估之獲利及現金流量，以涵蓋風險的折現率來折算現金流量，同時考慮實質現金及貨幣之時間價值來進行估算，但考量現金流量折現法預測期間長，不僅困難度相對較高且資料未必十分準確，推薦證券商認為較不能合理評估公司應有之價值，又加以投資者不易瞭解現金流量觀念，故不擬採用本法為議定之承銷價格參考依據。

綜上所述，考量精材所處之產業應屬於營收獲利穩定之公司，並不適宜以成本法評價，而收益基礎法由於該方法需估計未來數年的營收獲利成長及現金流量、投資率等，估計參數不僅有其困難度，更難以佐證估計其正確性，以做合理之判斷。本推薦證券商能計算合理、客觀及具市場性之承銷價格，乃以市場基礎法中之本益比法作為精材上櫃申請之承銷價格計算依據。由於本益比法已考量該公司之獲利能力，暨市場對同業的認同度標準，應已具有市場性。

(三)申請公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形

1.財務狀況

分析項目		年度	101 年度	102 年度	103 年度
		公司			
財務結構 (%)	負債佔資產比率	精 材	36.40	50.79	47.27
		日 月 光	55.21	55.66	52.56
		同 欣	15.89	19.89	35.69
		菱 生	24.14	24.88	註
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率	精 材	117.30	100.45	107.21
		日 月 光	128.18	141.43	146.96
		同 欣	187.04	200.69	283.45
		菱 生	164.08	141.32	註

資料來源：各公司經會計師查核簽證之財務報告。

註：尚未公告 103 年度財務報告。

該公司101~103年度負債佔資產比率分別為36.40%、50.79%及47.27%，101年度因銀行長期借款陸續償還及設備款陸續支付，使負債佔資產比率較低；102年度為因應指紋辨識感測器封裝訂單之需求，增加長期借款以支應購置相關設備之資本支出，致應付設備款及長期借款大幅增加，另因收取終端客戶補償未來訂單風險之產能保證金(帳列存入保證金)，致102年底之負債較101年底之成長幅度高於資產成長幅度，造成負債比率由101年度之36.40%上升至50.79%；103年雖該公司於6月底已返還全數產能保證金，惟因建置12吋影像感測器生產線，增加銀行借款以支應購置相關設備之資本支出，致負債比率僅較102年度微幅下降。與採樣同業相較，該公司101~103年度之負債佔資產比率均介於採樣同業之間，尚無重大異常之情事。

該公司101~103年度之長期資金佔不動產、廠房及設備比率分別為117.30%、100.45%及107.21%，102年度為因應指紋辨識感測器封裝訂單而購置機器設備，致該公司之固定資產淨額較101年度增加，幅度高達35.32%，以致長期資金佔不動產、廠房及設備比率下降至100.45%；103年因營運所需增加銀行長期借款，使非流動負債較102年度增加24.52%，致長期資金佔不動產、廠房及設備比率上升至107.21%。與採樣同業相較，該公司101~103年度之長期資金佔不動產、廠房及設備比率均低於採樣同業，惟該公司最近三年度長期資金佔不動產、廠房及設備比率皆大於100%，尚無以短期資金支應固定資產支出之情事，顯示該公司整體財務結構尚屬健全。

綜上所述，該公司最近三年度之財務狀況各項比率尚屬健全，且變動情形尚屬合理，與採樣同業相較亦無重大異常情事。

2.獲利情形

分 析 項 目		年度	101 年度	102 年度	103 年度
		公司			
獲利能力(%)	權益報酬率	精 材	(2.32)	7.27	14.34
		日 月 光	12.76	13.57	16.96
		同 欣	15.73	17.35	15.46
		菱 生	6.09	5.43	註
	營業利益占實收資本額比率	精 材	(4.07)	16.10	28.37
		日 月 光	23.26	28.20	37.57
		同 欣	90.18	109.14	105.27
		菱 生	11.14	9.81	註
	稅前純益占實收資本額比率	精 材	(4.56)	14.75	27.71
		日 月 光	21.81	24.76	36.17
		同 欣	90.95	114.42	110.49
		菱 生	12.05	11.19	註
	純益率	精 材	(2.87)	6.79	12.74
		日 月 光	6.97	7.35	9.44
		同 欣	18.80	19.97	18.12
		菱 生	6.04	5.81	註
	每股稅後盈餘(元)	精 材	(0.38)	1.22	2.65
		日 月 光	1.75	2.09	3.07
		同 欣	8.09	9.72	9.27
		菱 生	1.01	0.97	註

資料來源：各公司經會計師查核簽證之財務報告。

註：尚未公告 103 年度財務報告。

該公司101~103年度權益報酬率則分別為(2.32)%、7.27%及14.34%，營業利益占實收資本額之比率分別為(4.07)%、16.10%及28.37%，稅前利益占實收資本額之比率分別為(4.56)%、14.75%及27.71%，純益率分別為(2.87)%、6.79%及12.74%，每股盈餘則分別為(0.38)元、1.22元及2.65元。101年度因半導體市場需求趨緩，銷貨客戶對備貨態度相對謹慎，營收規模減少，致該公司轉為虧損，各項指標呈負值；102年度因影像感測器及指紋辨識感測器封裝需求增加，帶動營收成長動能，致權益報酬率、營業利益占實收資本額之比率、稅前利益占實收資本額之比率、純益率及每股盈餘均較101年度上升；103年度因訂單熱度不減，致前述各項指標與102年度相較呈大幅成長趨勢。與採樣同業相較，該公司101年度之權益報酬率、營業利益占實收資本額之比率、稅前利益占實收資本額之比率、純益率及每股盈餘遜於採樣同業，102年度及103年度多已介於採樣同業之間。

綜上分析，該公司101~103年度獲利能力各項指標之變化，並無重大異常之情形。

3.本益比

依據上述市場基礎法中本益比法之評估說明，該公司之採樣同業、上市櫃半導體業最近三個月之平均本益比在11.81倍~23.39倍之間，本推薦證券商與該公司此次議定承銷價格每股新台幣42元，若以該公司103年度每股盈餘2.65元為計算基礎，其本益比為15.85倍，落於採樣同業本益比之區間內，尚無重大異常之情事。

(四)所議定之承銷價若參考財務專家意見或鑑價機構之鑑價報告者，應說明該專家意見或鑑價報告內容及結論

本推薦證券商與該公司共同議定股票公開承銷價格並未委請財務專家出具意見或委託鑑定機構出具鑑價報告，故不適用。

(五)發行公司於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價及成交量資料

單位：新台幣元；股

月份	成交數量(股)	平均成交價(元)
104年2月24日~104年3月20日	47,197,698	54.96

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心興櫃交易資訊

(六)推薦證券商就其與發行公司所共同議定承銷價格合理性之評估意見

本推薦證券商依一般市場承銷價格訂定方式，參考採樣同業之本益比區間，同時參考該公司最近一個月之興櫃市場平均成交價，作為該公司辦理股票承銷之參考價格訂定依據，基於流動性考量，並衡酌該公司之財務結構、公司規模、市場地位、經營績效、發行市場環境及該公司所處產業未來發展前景等因素，與該公司共同議定承銷價格為每股新台幣42元，另該價格並已符合不低於向券商公會報備詢圈約定書前興櫃有成交之10個營業日(104年2月26日~104年3月12日)成交均價簡單算術平均數54.20元之七成37.94元，故本次承銷價格之訂定應屬合理。

三、承銷風險因素說明

茲列示說明此次承銷相關風險如下：

(一)股價變化過鉅

上市櫃公司股票之漲跌，除受本身公司獲利能力、流通股數等影響之外，尚受外在環境之系統風險影響，如國際景氣波動、國內政治因素與兩岸關係等，另由於台灣股市以散戶居多亦常因外在原因影響投資人之心理，造成股票價格波動超漲或超跌，為使初次上櫃股票能充分反應市場現況及有效評估企業之價值，本承銷商已制定承銷價格議定程序，以確實表達承銷價格之合理性及訂定過程，並針對市場對案件承銷價格的接受條件及認購情形進行調查，作為調整承銷價格之參考依據。另本承銷商亦已依「中華民國證券商同業公會承銷商辦理初次上市櫃案件承銷作業應行注意事項要點規定」擬定穩定價格之機制，應可有效降低股票價格之變動。

(二)穩定價格策略

1.過額配售機制

依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，本推薦證券商已與該公司簽訂「過額配售協議書」，由該公司協調其股東提出對外公開銷售股數之15%額度內，提供已發行普通股股票供本推薦證券商辦理過額配售。本推薦證券商負責規劃及執行穩定價格操作，以穩定承銷價格。

2.特定股東限制賣出股票

依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，本推薦證券商已與該公司簽訂「過額配售協議書」，除依規定應提出強制集保股份外，並由該公司協調特定股東，就其所持有之已發行普通股股票，於掛牌日起不得少於三個月，自願送存臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理集保並不得賣出，以維持承銷價格穩定。

(三)本次承銷之相關費用及承銷手續費率

該公司本次辦理公開承銷所需之費用主要包括公開說明書印製費用、報紙公告、相關承銷書件印製費用、會計師與律師之勞務費以及承銷手續費等；而承銷手續費俟該公司上櫃案經主管機關核准後，再依承銷時市場行情與該公司協議。另依會計研究發展基金會(92)基秘字第 223 號函：「公司因發行新股而支出之必要外部成本，應作為發行溢價之資本公積之減項」，因此，相關發行新股而支出之必要外部成本，尚不致影響該公司之稅後純益。

(四)新股承銷導致股本膨脹稀釋獲利

該公司本次上櫃掛牌依規定採新股承銷方式，預計發行新股 30,000 仟股，其中除依公司法第二百六十七條規定保留 15%，即 4,500 仟股供員工認股外，其餘 25,500 仟股均委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷，該公司本次辦理現金增資發行新股，預計於 104 年 3 月下旬募足股款完成，其目前流通在外股數為 238,287 仟股，而本次擬發行 30,000 仟股，合計 268,287 仟股，股本膨脹比率為 12.59%，惟依據該公司對未來營運之預期，新股承銷對其獲利能力之影響應屬有限。

綜上分析，該公司已依法令規定計算應提出公開銷售股數，並全數以現金增資發行新股之方式，於扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購之股數後，其餘委託推薦證券商辦理上櫃前公開銷售，經評估此次新股承銷之相關費用對其獲利之稀釋程度有限，股本膨脹對該公司獲利之稀釋效果亦已於此次議定承銷價格時納入考量，另本推薦證券商已針對承銷價格擬定穩定價格策略，整體而言，其承銷風險應屬有限。

四、總結

本證券承銷商綜合各方面評估結果，茲將該公司之風險事項分為營運風險、財務風險及潛在風險等三個部分進行分析：

(一)營運風險及潛在風險

1.銷貨客戶集中

該公司耕耘半導體後段封裝服務領域多年，主要銷貨戶客戶包括國際知名影像感測器大廠、國內外半導體設計公司及半導體晶圓大廠等，前十大客戶銷貨金額佔各年度營收淨額之比重為九成以上。

因應對策：

該公司業已持續精進二維及三維晶圓級相關先進製程技術之開發，並建置12吋晶圓級封裝之產線，以因應影像感測器客戶之產能需求，希冀藉由封裝服務技術暨應用產品之多元化增加客戶群及擴大終端產品應用。未來期能將業務擴展至晶圓級系統整合封裝(System in Package)。

2.資本支出大

由於IDM廠(Integrated Device Manufacture整合元件廠，簡稱IDM)委外代工訂單趨增，使得封裝廠商大舉擴充採購機器設備，而各家半導體晶圓製造廠陸續邁入更高階先進製程，封裝技術難度亦同步提高，所需投入之資本支出亦將增加。

因應對策：

該公司擁有產業經驗豐富之經營及研發團隊，隨時掌握市場需求，藉以了解封裝技術之未來趨勢，開發出符合市場及客戶需求的封裝技術，並審慎評估資金運用、設備投資及人員招募計畫，隨著市場需求適時調整機器設備組合。

3.終端產品價格下跌快速

終端產品生命週期短，平均售價下滑，產品替代性高，在眾多競爭者同時分食市場大餅的情況下，競爭激烈，使得價格下跌快速，產品利潤薄。

因應對策：

因應電子產業及半導體產業市場與其技術的不斷變化，該公司的競爭利基為持續開發先進製程與新衍生技術，以提供予客戶最佳之封裝解決方案，並積極降低製造成本以及提升生產效能，進而提升或維持利潤。

(二)財務風險

該公司主要銷貨客戶以美元計價為主，原物料供應商主要以台幣及美元計價，應收、應付款項相沖抵雖會產生部分自然避險效果，惟在轉換成台幣時，仍有匯兌損益產生，因此匯率變動對該公司獲利有一定程度之影響。

因應對策：

該公司主要銷貨客戶以美元計價為主，原物料供應商主要以台幣及美元等幣別計價，應收、應付款項相沖抵產生自然避險效果，惟在轉換成台幣時，仍因持有外幣部位而產生匯兌損益，因此，任何顯著的國際匯率變動將影響該公司獲利。該公司主要使用遠期外匯之衍生性金融交易以規避因淨外幣資產、負債所產生之匯率風險。除此以外，並採取以下措施以管理匯率波動風險。

- 1.隨時蒐集有關匯率變化資訊，及參考銀行專業意見，以充分掌握匯率走勢。
- 2.該公司已訂定「取得或處分資產處理程序」，規範有關衍生性金融商品之交易、風險管理、監督及稽核等處理程序。

(三)整體評估結論

綜上所述，精材雖有前述風險，惟本推薦證券商認為該公司已具備降低或分散風險之能力，且本推薦證券商於輔導期間對該公司所進行之瞭解及評估，認為其各項基本條件均已符合「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」所規定之申請上櫃標準，為使該公司業務持續成長、延攬優秀人才，達到永續經營目的，並為國內資本市場提供良好的投資標的，故秉持客觀公正之態度，推薦精材申請股票上櫃。

參、推薦證券商就外國申請公司應列示說明其註冊地國及主要營運地國之總體經濟、政經環境變動、相關法令、外匯管制及租稅，暨是否承認我國法院民事確定判決效力之情形等風險事項，並評估外國申請公司所採行相關因應措施之適當性

該公司為本國申請公司，不適用本項評估。

肆、產業狀況及營運風險

一、申請公司所屬行業營運風險

該公司為專業晶圓級 IC 封裝之領導廠商，也是第一家將三維晶圓級封裝技術（3D Wafer Level Chip Scale Packaging，縮寫 3D CSP）商品化的公司，主要服務包括 3D 晶圓級尺寸封裝服務與晶圓級後護層封裝服務(Wafer Level Post Passivation Interconnection，縮寫為 PPI)。3D 晶圓級尺寸封裝主要應用於影像感測器及環境感測器等光學感測元件，晶圓級後護層封裝服務主要應用於功率分離式元件、微機電系統感測器元件、指紋辨識感測器元件和整合式被動元件等。所封裝之產品廣泛被應用在行動裝置，包括手機、筆記型電腦、平板電腦、汽車電子及未來之穿戴式裝置產業等領域。以下就 IC 封裝產業及產品終端應用領域分別說明如下：

(一)產業概況

1.IC 封裝產業之現況

台灣IC產業以特有之上下游垂直分工方式獨步全球，產業價值鏈分工極細且結構完整，包括上游化學材料與矽晶圓，中游IC設計業、IC製造業、IC封裝業、IC測試業，以及下游的終端PC/NB、手機及消費性電子之系統廠商。由IEK2014年5月之統計資料顯示，台灣IC封裝及測試業在全球IC封測市場自2011年迄2013年均保持55%以上之全球市占率。由於2011年受到日本311震災、歐盟債務和泰國水災等接連事件的交互影響下，全球經濟發展始終不如預期順遂，連帶拖累全球半導體產業產值表現，亦使得我國半導體各次產業產值呈現成長趨緩或衰退，我國IC封裝產業產值較2010年衰退6.1%(可參考表一)；而2012年全球景氣一片不明朗，歐、美、大陸三大經濟體的經濟狀況都持續呈現低迷景象，其中，歐洲在歐債與高失業率的雙重打擊下，以及美國財政懸崖的不確定性，消費市場終端需求持續不振，智慧型手機及平板電腦雖成長優異，惟因PC產業買氣不振，進而影響全球半導體產業的表現，我國IC封裝產業產值僅較2011年微幅成長0.9%；2013年由於智慧型手機及平板電腦市場需求趨緩，我國IC封裝產業產值較2012年微幅成長4.6%；2014年，由於已開發國家經濟開始復甦成長，PC市場經過幾年的成長停滯後，2015年可望持穩不再衰退，而中低階智慧型手機則因在新興市場大幅成長抵銷高階智慧型手機成長趨緩之不利影響，整體手機數量依舊成長，手機晶片之高階封測產能、覆晶及晶圓凸塊需求仍持續增加，足見智慧型手機及平板電腦是2014年推升預估IC封裝業主要成長動力，故IEK預估2014年我國IC封裝產業產值較2013年成長13.9%。

表一、2011 年~2016 年台灣 IC 產業產值

新台幣(億)	2011 年	2011 年 成長率	2012 年	2012 年 成長率	2013 年	2013 年 成長率	2014 年	2014 年 成長率	2015 年	2015 年 成長率	2016 年	2016 年 成長率
IC 產業產值	15,627	-11.7%	16,342	4.6%	18,886	15.6%	22,167	17.4%	22,555	1.75%	23,854	5.76%
IC 設計業	3,856	-15.2%	4,115	6.7%	4,811	16.9%	5,829	21.2%	5,876	0.81%	6,245	6.28%
IC 製造業	7,867	-12.6%	8,292	5.4%	9,965	20.2%	11,665	17.1%	11,924	2.22%	12,584	5.54%
晶圓代工	5,729	-1.7%	6,483	13.2%	7,592	17.1%	9,007	18.6%	9,312	3.39%	9,962	6.98%
記憶體製造	2,138	-32.5%	1,809	-15.4%	2,373	31.2%	2,658	12.0%	2,612	-1.73%	2,622	0.38%
IC 封裝業	2,696	-6.1%	2,720	0.9%	2,844	4.6%	3,238	13.9%	3,300	1.91%	3,485	5.61%
IC 測試業	1,208	-5.5%	1,215	0.6%	1,266	4.2%	1,435	13.3%	1,455	1.39%	1,540	5.84%
IC 產品產值	5,994	-22.3%	5,924	-1.2%	7,184	21.3%	8,487	18.1%	8,488	0.01%	8,867	4.47%
全球半導體成長率	-	0.4%	-	-2.7%	-	4.8%	-	6.5%	-	2.7%	-	1.8%

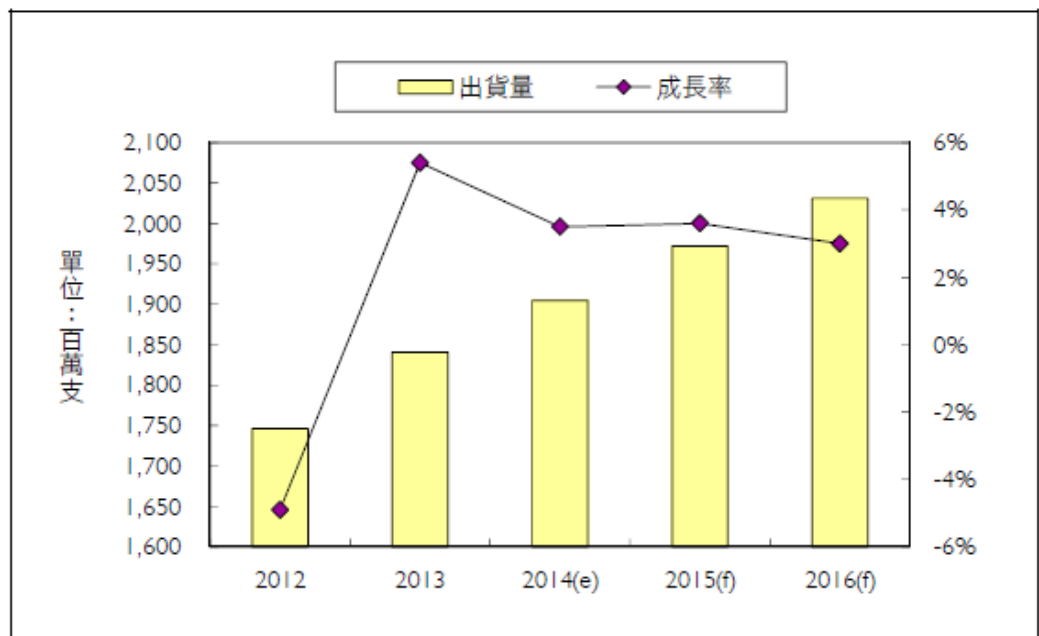
註：(e)表示預估值(estimate)。

資料來源：TSIA；工研院 IEK(2014/05、2014/08)；MIC(2014/04)；2014 半導體產業年鑑；凱基證券整理

2. 手機產業之現況與發展

2013年受北美、歐洲及日本之景氣尚未全面復甦，以及手機市場逐漸飽和且成長趨緩的影響，手機品牌大廠除積極布局高階智慧型手機外，亦紛紛推出中階旗艦款或中低價位之智慧型手機搶攻市場，促使以低價高規為訴求的新興市場(例如：中國大陸、印度及巴西等)之多數功能型手機用戶，將手機汰換為智慧型手機，致使2013年手機出貨量達18.4億支，仍較2012年成長5.4%，其中，中國大陸已成為全球最大的智慧型手機市場，故IEK預估2014年在中國大陸為主的新興市場需求強勁帶動下，手機出貨量將達19.0億支，成長率3.5%，且2015年及2016年亦維持成長趨勢。

圖一、2012~2016年全球手機出貨量

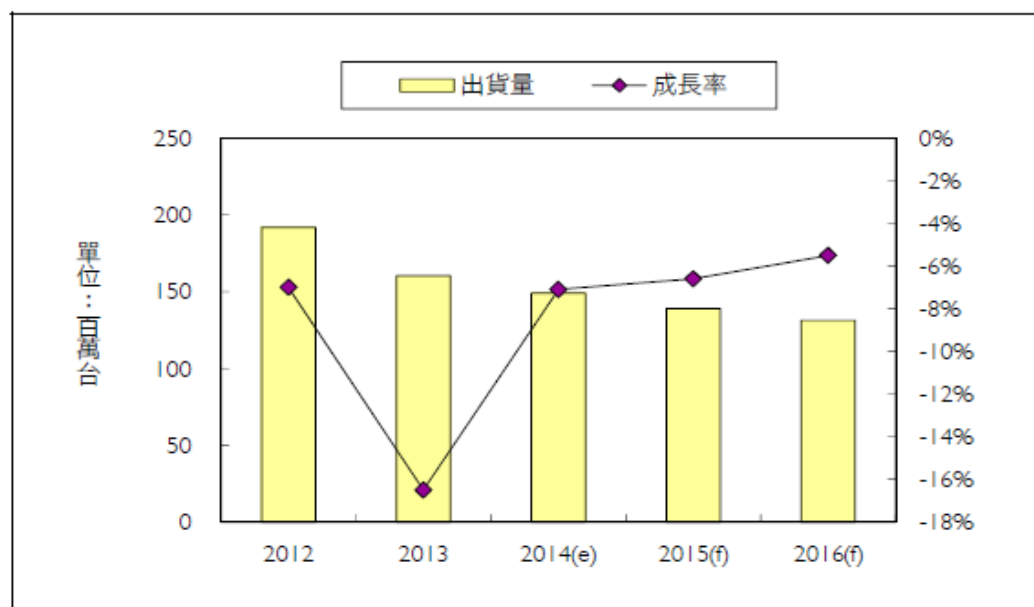


資料來源：工研院 IEK(2014/05)

3.筆記型電腦產業之現況與發展

2013年全球經濟雖未持續惡化，原市場預期之觸控筆記型電腦與Windows 8之換機潮均未明顯提升筆記型電腦之市場需求，致2013年全球筆記型電腦出貨量僅160.3百萬台，衰退幅度達16.5%。在面對平板電腦市場排擠效應下，筆記型電腦業者已持續致力於提升產品效能，希冀能與以娛樂功能為主之平板電腦做出市場區隔外，又將平板電腦輕薄及方便攜帶移動等優勢納入產品設計，然而，近來市面上出現能自由轉換平板電腦與筆記型電腦的二合一產品，同時兼納桌上型電腦、筆記型電腦及平板電腦的三合一產品，致使筆記型電腦及平板電腦的界線逐漸模糊。雖筆記型電腦出貨持續萎縮，但因Microsoft停止支援Windows XP，企業換機潮可望帶動商用筆記型電腦的出貨成長，故IEK預估2014年全球筆記型電腦出貨量可達148.9百萬台，成長率衰退幅度可降至10%以內。

圖二、2012~2016年全球筆記型電腦出貨量

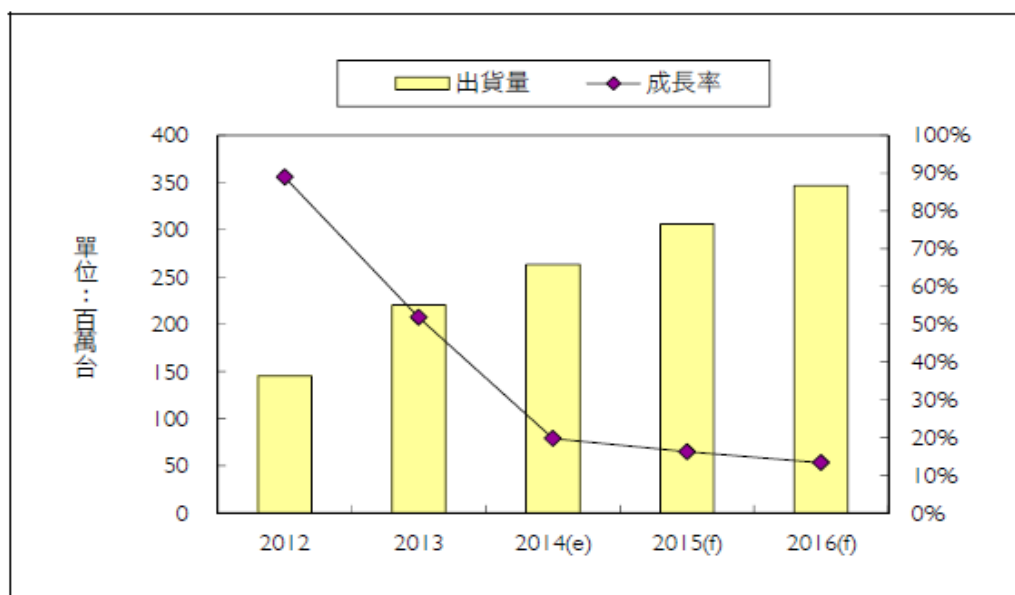


資料來源：Gartner；工研院 IEK(2014/05)

4.平板電腦產業之現況與發展

隨著平板電腦市場趨於成熟，已不見甫出現之高成長率，但相對於桌上型電腦及筆記型電腦，仍屬成長性高之產品。2013年全球平板電腦出貨量達220百萬台，較2012年成長51.8%，首度超越筆記型電腦，顯示對於行動裝置市場來說，平板電腦已逐漸取得領先地位。且由於市場開始進入成熟期，消費者更著重在平板電腦產品的多樣性，可通話之平板電腦、結合數位家電與大尺寸螢幕將為2014年平板電腦的新趨勢，而7吋低價平板電腦提升新興市場對平板電腦的接受度，也將持續帶動平板電腦產品出貨成長，故IEK預估2014年全球平板電腦出貨量將達263百萬台，成長率19.7%。

圖三、2012~2016年全球平板電腦出貨量



資料來源：工研院 IEK(2014/05)

5. 汽車電子產業之現況與發展

近年來技術逐漸成熟化的汽車，支援電子控制技術的汽車電子產品主要是搭配各種感測器(如影像、加速度、壓力或溫度等)、微電腦控制器、影音娛樂機器、衛星導航機、無線通訊等產品應用與服務，提供車輛及人員有關節能減碳、低噪音污染、舒適、主動與行車安全、保全、緊急救援與道路指引等功能，讓汽車操控更具人性化，更加聰明且符合智慧化需求。根據全球汽車產業分析機構IHS Automotive的統計數據顯示，2013年全球汽車銷售量約為8,280萬輛，較2012年成長4.2%，創全球年度汽車銷量新紀錄，預估2014年汽車出貨量將達8,500萬輛。

6. 穿戴式裝置產業之現況與發展

2014年國際消費電子展(47th International Consumer Electronics Show 2014, CES)中，以穿戴式技術產品之裝置成為CES展之焦點，全球之廠商紛紛開始進軍於穿戴式技術領域市場。目前智慧穿戴式裝置應用範圍橫跨數大產業，包含安全、醫療、健康、運動、生活運算、通訊及穿著等領域，尚包括安全與保全、軍事用途等特殊領域市場，其中，醫療居家照護、資訊娛樂相關及運動健身三大應用領域成長最快，其應用領域。智慧穿戴式裝置有四個關鍵的發展方向，分別為感應器、雲端網路、資料分析及整合服務。在感應器方面，透過大量感應器來抓取各種不同的資料，使得感測器種類逐漸增多，讓裝置能獲得之資料種類增加，亦可導致感測種類的需求增加，新的感測器出現或是原本既有的裝置開始小型化，進而帶動先進封裝在穿戴式裝置之應用。根據拓墣產業研究所研究報告指出，預估全球穿戴式消費電子出貨量在2014年達到3,930萬台，成長率49.32%，而2015年將出貨6,570萬台，成長率67.1%。

圖四、智慧型穿戴應用



資料來源：工研院 IEK(2014/05)

(二)行業營運風險

1.景氣循環之營運風險

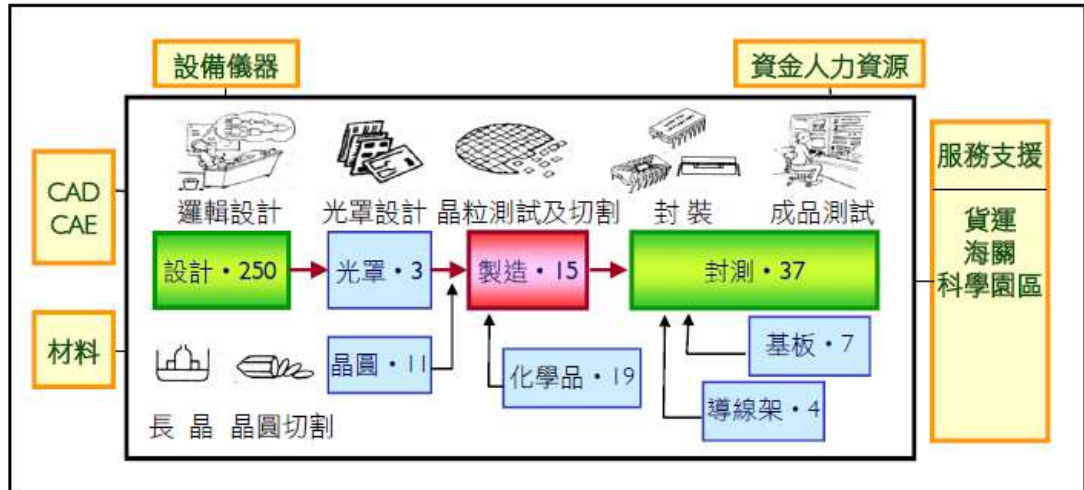
該公司主要從事影像感測器及環境感測器等光學感測元件之晶圓級尺寸封裝業務，以及應用於微機電(作動感測器)、指紋辨識感測器與MOSFET元件之晶圓後護層封裝服務。由於IC封裝業屬半導體產業鏈之後段製程，半導體產業與全球經濟景氣息息相關，又該公司所封裝產品之終端應用領域以手機、筆記型電腦及平板電腦等消費性電子產品為主，故該公司所屬之產業亦受景氣波動之影響，因此，該公司除謹慎評估資金運用、設備投資及人員招募計畫，並藉由本身技術整合及開發能力，持續精進技術並改良製程，以提供符合市場與客戶需求之多元化封裝服務外，同時積極進入車用電子領域，以降低消費性電子景氣循環對公司之衝擊。

2.行業上、中、下游之營運風險

(1)行業上、中、下游之關聯性

我國半導體產業隨著整體半導體的垂直分工整合，產業輪廓發展完整，依製造流程可區分為上游之IC設計、矽晶圓片、光罩製作、中游之IC晶圓製造廠及下游之IC封裝廠、測試廠。近年來由於我國IC產業蓬勃發展及分工專業化，產業鏈的生產環節皆有廠商投入，致垂直分工明確且各有所長，使我國IC產業之上、中、下游結構更加完整，而該公司主要從事封裝服務，位居半導體產業之下游。

圖五、半導體上、中、下游產業鏈



資料來源：工研院 IEK(2014/05)

(2)行業上、中、下游之營運風險

A.銷貨客戶集中

該公司耕耘半導體後段封裝服務領域多年，主要銷貨戶客戶包括國內外知名之 IC 設計公司，消費性產品終端客戶以及整合元件製造商 (IDM) 等，由於感測器產品所需之封裝服務客製化程度高，該公司需依客戶所設計不同產品特性提供創新之封裝解決方案，亦需與上游晶圓供應商製程技術緊密結合，該公司經過封裝服務提昇並與客戶、上游晶圓供應商的多年合作，近年來已掌握關鍵客戶產品需求並有效縮短產品開發時程，近年來其往來客戶變化並非重大，致有提供予前十大客戶封裝服務之金額佔各年度營收淨額之比重為九成以上之情事。

因應對策：

該公司業已持續精進晶圓級相關先進製程技術之開發，未來期能將業務擴展至晶圓級系統整合封裝(System in Package)外，並建置 12 吋晶圓級封裝之產線，以因應高端感測器客戶之需求，希冀藉由封裝服務技術暨應用產品之多元化，開發新客戶，並降低銷貨集中之風險。

B.終端產品價格下跌快速

由於該公司之封裝服務所應用之終端產品以消費電子類為大宗，電子產品推陳出新且生命週期短，在中國封裝廠商亦持續投入資金並積極投入市場競爭，加上終端電子產品市場競爭因素，產品之平均售價始終存在下滑的壓力，亦使該公司於終端產品推出後，持續面對調降價格之壓力，產品利潤薄。

因應對策：

因應電子產業及半導體產業市場與其技術的不斷變化，該公司的競爭利基為持續開發先進製程與新衍生技術，以提供予客戶最佳之封裝解決方案，並積極降低製造成本以及提升生產效能，進而提升或維持利潤。

3.該行業未來發展趨勢

(1)封裝技術方面

IC封裝產業隨著系統終端產品往大容量、高頻寬、高速、低功耗、小型化、高度整合等追求，尤其是智慧型手機及平板電腦，多功能整合晶片技術應運而生，近幾年介於前段（Front-End）和後段（Back-End）製程中之新興技術成型，包含晶圓凸塊技術（Wafer Bumping）、WLP（如Fan-out WLP、WLCSP、3D WLP、WL Optics等）及3D IC，即所謂中段（Mid-End）產業。

鑒於高階封裝製程的需求，如覆晶封裝(Flip Chip BGA or Flip Chip CSP)、晶圓級尺寸封裝(Wafer Level CSP)、銅打線(Cu Wire Bond)、銅柱凸塊(Cu Pillar)等，晶圓層級封裝服務將扮演關鍵性角色。而受到終端產品訴求面朝高解析、產品輕薄、省電、長待機時間及直覺操控等趨勢影響，將帶動高速傳輸IC、感測器、觸控IC、電源管理IC、無線通訊IC等所需晶片多元發展，促使異質多層封裝與2.5D/3D IC發展受矚目。依據拓璞產業研究所的預估，2.5D/3D IC的產值，於2015年將達40億美元，其中Logic IC（整合邏輯）、Memory IC（記憶體）、影像感測器晶片及MEMS(微機電)是最主要應用，而影像感測器晶片受惠於其先天就是異質堆疊，為最早進入量產之應用。

(2)產品需求方面

由2014年美國消費性電子展(CES)可發現七個重要趨勢，分別是汽車、網路/雲端、穿戴式、感應器、UHD TV、高品質聲音及遊戲。進而分類可歸納成三個方向，第一是汽車方面，包括相機模組等各種感應器、網路的運用，使得汽車更加智慧化。第二是穿戴式裝置，得依靠不同的感測器、網路雲端的輔助使其功能更加多元，創造更多消費者價值。第三為高品質影音，如新一代遊戲機PS4、XBOX One的高銷售，並未因手機App的興起而沒落，反而逆向成長，這些皆代表著影像感測、人機介面感測等需求之應用與成長。

圖六、感測器在3C電子之應用

	傳統應用	創新應用
影像感測器	照相、 影印/傳真機、 光學滑鼠	人機界面(深度感測): 遊戲機, 手機, TV,... 人機界面(光學觸控): 大尺寸應用 擴增實境: 手機, Tablet
環境光感測器		人機界面(近接感測): 手機, Tablet 人機界面(環境光感測): NB, TV
運動感測器	硬碟保護、 照相防手震	人機界面: 遊戲機, 手機, Tablet,...
磁感測器	馬達控制,...	LBS: 手機, Tablet,...
壓力感測器		LBS: 手機, Tablet,...

資料來源：MIC(2012/08)

根據拓璞產業研究報告影像感測器市場隨行動裝置出貨成長，2013年各智慧型手機大廠皆把旗艦機種搭載的影像感測器升級為800~1000萬畫素以上，影像感測器市場規模自2012~2016年之年複合成長率達6.8%，預計2016年可達100億美元。



除了智慧型手機，影像感測器於車用領域，將因安全因素獲得大量採用，包含車前鏡頭之主動式剎車、車體四周鏡頭之環景顯示，以及車後鏡頭之停車及後方來車指示等，預計一台車至少將搭載6~8顆以上之影像感測器，且未來有機會成長到10顆以上，將為影像感測器產業成長性最大的應用產品。

另外，隨著智慧型手機、平板電腦和遊戲機紛紛強打瀏覽多媒體影像、人機介面互動、行動導航和遊戲、影像防震等應用，採用微機電製程的麥克風、多軸陀螺儀、加速度計及電子羅盤等感測元件產品，已成為行動裝置不可或缺的關鍵零組件。根據市調機構Yole Developpement預測，全球微機電感測器2013~2018年的年複合成長率將為18.5%，2018年預估可達到64億美元市場產值。

(3)環保意識訴求

環保議題一直以來為全球所關注之問題，由於半導體封裝生產過程中會排放氣體、產生廢水及廢棄物，需設置相關防制汙染設備並委託專業機構回收後再處理，而近年來，因國內違規事件頻傳而造成環境汙染日益嚴重，可能造成的潛在健康風險更為廣泛重視，環保單位除加強監控外，若有發生違規情事，輕則處罰，重則勒令停工，對企業營運亦會造成損失，該公司亦重視每一環節，與供應鏈合作，善盡環境保護的社會責任，取得多項國際標準環保、安全與衛生證書，達成企業永續經營及成長的目標。

4.產品可替代性

IC封裝係指將晶片上的功能訊號透過一個載具將其引接到外部，且提供晶片免於受破壞的保護，係屬半導體製造中不可或缺之重要生產流程。

該公司主要從事影像感測器及環境感測器等光學感測元件之晶圓級尺寸封裝生產，主要係提供三維晶圓級尺寸封裝及晶圓級後護層封裝服務，相較於一般傳統封裝方式，具有低成本、最小封裝尺寸及符合感測器封裝所需之三維封裝等優勢，同時也簡化傳統供應鏈，使感測器設計公司得以開發其市場，成為新興感測器元件供應鏈不可或缺之一環。目前，該公司不僅為三維晶圓層級封裝之領導供應商，已成功建立影像感測器之標準封裝型式；同時亦藉由獨特開發之二/三維晶圓後護層封裝服務，已成功應用於生物辨識、作動感測器、MOSFET等元件，使客戶之產品可以利用該公司提供之服務實踐產品之創新，故其產品可替代性較低。

二、申請公司營運風險

就該公司之業務、技術能力、研發、專利權、人力資源、財務(包括成本、匯率變動)等之營運風險列示說明如下：

(一)業務之營運風險

1.該公司產品之市場佔有率、相關機器設備、人力資料、與同業上市櫃公司或知名公司比較及其在同業間之地位、該公司之營運風險

(1)該公司在同業間之地位及其市場佔有率

①該公司在同業間之地位

該公司於87年9月正式設立，為專業晶圓層級IC封裝公司，所使用之封裝技術為晶圓級尺寸封裝及晶圓級後護層封裝服務，綜觀目前國內上市櫃及興櫃公司，封裝技術及產品組合並無與該公司完全相同者，故以部分產品應用端相同或同為半導體封裝及測試產業為取樣之依據：上市公司日月光半導體製造股份有限公司(以下簡稱日月光)主要係從事各型積體電路之製造、組合、加工、測試及外銷，亦有封裝影像感測器模組及指紋辨識感測器模組與該公司產品應用端相同；上市公司同欣電子工業股份有限公司(以下簡稱同欣)主要係從事高頻無線通訊模組、混合積體電路模組、陶瓷電路板及影像產品等電子產品生產及銷售，亦有影像感測器封裝與該公司產品應用端相同；上市公司菱生精密工業股份有限公司(以下簡稱菱生)主要係從事積體電路及各種半導體零組件之封裝加工、測試、製造及買賣，亦有用於手機或行動裝置之環境光學感測器模組封裝測試與該公司產品應用端相同。在綜合考量比較上述公司之產品營收比重、業務內容、實收資本額及資產規模等，選取日月光(2311)、同欣(6271)及菱生(2369)為採樣同業。茲將主要競爭同業之營業項目資料列示如下：

單位：新台幣仟元

公司	營業項目	資本額	合併營業額	稅後淨利
精 材	晶圓級尺寸封裝及晶圓級後護層封裝	2,381,207	4,934,078	628,653
日 月 光	各型積體電路之製造、組合、加工、測試及外銷	78,715,179	256,591,447	24,222,086
同 欣	高頻無線通訊模組、混合積體電路模組、陶瓷電路板及影像產品等電子產品生產及銷售	1,629,071	8,337,547	1,510,642
菱 生	各型積體電路之封裝、測試及光電產品	3,801,023	6,047,661	351,315

資料來源：各公司經會計師查核簽證之合併財務報告。

註：菱生為 102 年度數值。

②市場占有率

該公司為專業晶圓層級 IC 封裝公司，其所使用之封裝技術除使用部分傳統封裝技術外(如：壓合技術、BGA 植球、晶圓切割等)，主係以半導體製造中的相關技術(例如：光刻技術、薄膜沉相技術等)來進行封裝，與傳統 IC 封裝同業不同，在國內上市櫃公司中亦無與該公司從事相之業務之同業，另由於國內 IC 封測業各家公司除了 IC 封裝業務外，亦有 IC 測試業務，而該公司僅有封裝業務，相關同業之封裝技術及所應用產品和功能皆有所不同，故礙難計算市場占有率。另從該公司主要銷貨客戶多為國際大廠且合作多年，足見該公司之銷貨客戶對其封裝技術及產品品質已相當肯定。

(2)相關機器設備

該公司為專業晶圓層級 IC 封裝公司，主係以半導體製造中的相關技術(例如：光刻技術、薄膜沉相技術等)來進行封裝，故機器設備主要為晶圓蝕刻機、氣象層積濺鍍機、銅鎳金電鍍機、化學沉積薄膜機、自動光學檢驗機、晶圓研磨機等。由於 IC 封裝技術密集度高，該公司透過不斷引進先進封裝所需設備，並致力於產品製程改良及開發，同時加強人員的操作訓練，以提高生產效率。

(3)人力資料

103年該公司與上市櫃同業員工平均營收及淨利貢獻度列示如下：

單位：仟元/人

公司名稱	合併營業收入(A)	稅後淨利(B)	員工人數(C)	員工平均營收貢獻度(A/C)	員工平均淨利貢獻度(B/C)
精 材	4,934,078	628,653	1,971	2,503	319
日 月 光	256,591,447	24,222,086	60,199	4,262	402
同 欣	8,337,547	1,510,642	3,149	2,648	480
菱 生	6,047,661	351,315	3,075	1,967	114

資料來源：各公司經會計師查核簽證之財務報告及股東會年報。

註：菱生為 102 年度數值。

該公司截至103年12月底止之員工人數計1,971人，將近六成以上均具備大專(含)以上之學歷，可見該公司員工素質優良，而該公司除提供員工良好的工作環境及完善員工福利制度，並提供多元化訓練課程、良好的在職專業訓練及國內外進修等，目的在使全體員工之專業知識及技能能更紮實，並進而培養出更優質之經營團隊。

該公司103年度之員工平均營收貢獻度為2,503仟元，員工平均淨利貢獻度為319仟元，該公司營收規模雖遠小於日月光、同欣及菱生，但該公司員工平均營收貢獻度及員工平均淨利貢獻度相較於同業均相去不遠，顯見該公司人力資源運用情形尚屬良好。

2. 該公司目的事業成就與不成就之關鍵因素

(1) 生產效率提升，降低成本提升競爭優勢

近年積極加速設備自動化、產線流程優配化以提升產品良率與產能稼動率，並整合資源利用各廠區產能機動調配之方式，快速提供產品及服務，取得客戶長期穩定之信賴。

(2) 技術領先暨產品應用多樣化

該公司經營團隊具備多年IC半導體研發、生產暨銷售經驗，除產品優良、交期迅速、售後服務良好深受客戶信賴外，市場行銷與研發團隊建立完整的新技術專利，目前所擁有之各國專利超過一百項，並配合客戶產品需求開發出多種先進之晶圓層級封裝解決方案，獲得國際品牌大廠認可。

(3) 產業鏈優化與整合

該公司為台積電策略投資之公司，除利用本身之先進技術與業務開發能力建立強大之客戶群外，更結台積電在半導體供應鏈中之龍頭地位提供上下游完整之一條龍服務(Turn-key service)，並透過與台積電(晶圓供應商)技術緊密整合，提供客戶最先進、快速且完整之封裝解決方案。

(4) 國際分工之優勢

我國封裝業的發展，即以扮演全球半導體業供應鏈夥伴的定位，藉先進技術發展策略及整合品質、成本、交期、產能、服務總體運籌優勢，締造在國際分工體系中的總體競爭地位。該公司身為先進晶圓層級封裝服務之提供者，不僅提供國內外客戶上游IC設計公司完整之供應生產體鍊系，並藉由與IC foundry公司合作，解決生產過程衍生之相關議題。

3. 蒐集國內外產業報導資料，以瞭解市場可能之供應變化情形，並加以評估影響申請公司未來發展之有利與不利因素及其所採行相關因應措施之適當性。

(1) 市場可能之供需變化情況

①IC封裝產業

由於 PC 市場可望持穩不再衰退，中低階行動裝置持續熱賣使得用在手機晶片之高階封測產能以及覆晶、晶圓凸塊也跟著吃緊。2014 年預估 IC 封裝業主要成長動力仍為智慧型手機及平板電腦，而 4G LTE 手機基頻晶片、ARM 應用處理器、影像感測器、蘋果及非蘋陣營生物辨識等 SiP 封測需求續強，預估 2014 年我國 IC 封裝產業產值較 2013 年成長 13.9%。

②手機產業

由於北美、歐洲及日本等成熟市場之多數消費者已經擁有智慧型手機，對於智慧型手機的需求強度逐漸放緩，而新興市場則需求強勁，已成為智慧型手機出貨量成長最快的區域市場，尤其是中國大陸在人口眾多，在所得提高、3G 網路布建逐漸普及智慧型手機低價化帶動下，將持續保持全球第一大智慧型手機市場的地位。此外，隨著中國大陸手機品牌廠商的崛起及新興市場對低價手機的需求，將導致智慧型手機的平均銷售單價快速下滑，面對智慧型手機低價高規的發展趨勢及激烈的價格競爭挑戰，手機大廠紛紛推出中階旗艦機種搶攻新興市場外，並往跨裝置、跨平台的應用發展(如醫療、車用、行動商務及物聯網等領域)，利用應用上的創新及加強應用整合來提高產品的價值與競爭力。預估 2014 年在中國大陸為主的新興市場需求強勁帶動下，手機出貨量將達 19.0 億支，成長率 3.5%。

③筆記型電腦產業

隨著筆記型電腦產業逐漸轉型，品牌業者除在產品上進行改革，一改變其行銷策略，針對品牌加強行銷而不再削價競爭，並積極轉型發展雲端領域，朝商用及伺服器領域佈局。由於 Microsoft 停止支援 Windows XP，企業換機潮可望帶動商用筆記型電腦的出貨成長，預估 2014 年全球筆記型電腦出貨量可達 148.9 百萬台，成長率衰退幅度可降至 10% 以內。

④平板電腦產業

雖然新興市場初以白牌、中低價位的產品為主，近來品牌廠商逐漸將新興市場視為重要的發展區域，而預期新興市場對智慧行動裝置的通話功能需求將大幅提高，因此積極於新興市場推出通話平板；另一發展產品趨勢則為大尺寸平板電腦，由於 7、8 吋的平板電腦市場逐漸趨於飽和，廠商積極推出大尺寸平板電腦以尋求差異化。主打商務市場的 Win 8 平板開始進入市場，逐漸調整平板僅為娛樂用途之定位，商務平板同時具有便利移動與作業的優勢，價格亦比傳統商務型筆電更具競爭力，因此也成為平板電腦廠商發展的舞台。預估 2014 年全球平板電腦出貨量將達 263 百萬台，成長率 19.7%。

⑤汽車電子產業

全球汽車業發展迄今，已有 80% 的創新成果來自車輛與電子科技、數位化趨勢的深度融合，且繼續朝節能動力、安全科技與車載資、通訊等領域發展。由於未來智慧車輛技術以主動安全、舒適便利及節能為三大主軸，目前各大國際車廠都特別以智慧車輛之主動安全暨自動防撞為未來車輛設計重點，其中又以影像辨識系統加上影像感測器，讓汽車「看」得見周遭路況，並且利用快速運算的電腦分析判斷以獲得的影像資料。未來甚至可以進一步預知車輛可能遭遇到的狀況，再主動提出避開危險的警示，直接指揮車輛進行避險動作。由此可見，動態影像辨識將為未來車輛智慧化主動安全系統之關鍵要素。根據全球汽車產業分析機構 IHS Automotive 的統計數據顯示，預估 2014 年汽車出貨量將達 8,500 萬輛。

⑥穿戴式裝置產業

隨著智慧型手機普及逐漸提高，智慧型手機產品同質化益趨顯著，如何打破同質化，以獨特性追求更多的市場機會，已成為智慧型手機品牌廠商在產品研發設計時首要考量重點。其中，由於智慧型手機已進入以應用為主導的後智慧型手機時代，如何讓智慧型手機與消費者日常生活更加緊密結合，亦成為各智慧型手機品牌大廠首要產品差異化方向，而各家智慧型手機廠商不約而同推出如智慧手環等配戴式穿戴產品或在高階旗艦機中搭載各式感測器，將心跳感測器、生物辨識等各式感測器及 WiFi、Bluetooth 等無線技術整合在一起。

在穿戴式產品後續發展上，如何開發出符合穿戴式產品特性，包括低功耗、輕薄短小、高環境容忍及高穩定等特性，並脫離智慧型手機而獨立生存，是配戴式穿戴產品長遠的發展目標，預期未來美學、實用性兼顧及創新之人機介面，為穿戴式裝置未來關鍵方向。根據拓墣產業研究所研究報告指出，預估全球穿戴式消費電子出貨量在 2014 年達到 3,930 萬台，成長率 49.32%，而 2015 年將出貨 6,570 萬台，成長率 67.1%。

4. 影響該公司未來發展之有利與不利因素及其相關因應措施

(1) 有利因素

①先進晶圓層級封裝之成長

精材從事晶圓級晶片尺寸封裝技術的開發、封裝代工及相關服務，其所提供之封裝技術包含密封及封裝尺寸最小等特色，而採用晶圓級晶片尺寸封裝能有效縮短製程時程、降低成本、提高封裝良率及品質。為因應終端產品需求，晶圓級尺寸封裝製程發展不斷往前推進，目前封裝產品追求的製程目標包括：尺寸縮小 35%、功率降低 50%、功能與頻寬增加 8 倍，以及超越摩爾定律，希冀能將半導體元件與模組的功能性與整合度發揮到極致。其中，晶圓級封裝堆疊技術已從嵌入式晶圓級封裝

(Embedded WLP)，一直發展到堆疊式晶圓級封裝 (Stacked Chip Scale Package; SCSP)、封裝層疊 (Package on Package, PoP) 以及矽穿孔 (TSV) 等。從技術發展脈絡可以發現，半導體封裝產業不斷在追求可以減少晶片厚度及材料成本、提升晶片效能、降低電磁干擾與功率消耗的 3D 堆疊封裝技術。面對晶圓層級封裝趨勢所帶動的市場機會，台灣因半導體產業鏈完整，因此，具有晶圓級封裝生態發展優勢。預計未來晶圓層級封裝技術應用領域將會十分寬廣。

②新興亞洲將成最大的消費性電子產品銷售區

探究 2013 年全球消費性電子成長最主要是來自於新興亞洲、中東、非洲、東歐這四大新興地區的高成長所帶動；而新興亞洲地區的全球消費性電子銷售額更將首次超越北美地區，成為全球最大的消費性電子銷售地區，占全球比重達 24%。除了中國消費電子產品銷售額的成長外，近年來國民所得大增的馬來西亞、泰國，與中產階級崛起的印尼、越南、菲律賓等，都帶動了新興亞洲消費電子產品銷售額大幅成長。

③關鍵技術之自主研發

該公司持續強化研發能量，近年亦開發出可應用於作動感測器、指紋辨識感測器及汽車電子相關之晶圓層級封裝，由於產品品質優異，因而獲得多家國際級品牌大廠及汽車廠之合格供應商。另該公司近年亦開發多種微機電感測器之晶圓層級封裝技術，該技術可達成產品輕薄短小之需求，對新興之行動裝置及穿戴式裝置之輕量化有極大助益。

(2)不利因素

①受產業景氣波動影響

由於 IC 封裝業屬半導體展業之後段製程，半導體產業與全球經濟景氣相關，而該公司封裝之產品終端應用領域以手機、筆記型電腦及平板電腦等消費性電子產品為主，故該公司所屬之產業亦受景氣波動之影響。

因應對策：

該公司耕耘半導體封裝服務領域多年，由於該公司封裝之產品終端應用領域以消費性電子產品為主，該公司除致力於衍生製程與新製程之研究發展，並將產品之應用由消費性電子產品進而提昇至汽車電子產業，以降低景氣循環所帶來之衝擊。

②市場競爭者增加

中國政府重金支持半導體先進製程技術之開發，包含 IC 設計、晶圓代工、封裝測試乃至設備研發等產業，其供應鏈所形成的群聚效應，將影響客戶之產能配置，且可能以具有市場競爭力之價格，進而侵蝕市場佔有率。

因應對策：

聚焦發展先進晶圓層級封裝，因應各種功能應用來達到產品差異化的效果，導入自動化設備，提升產能及品質並有效降低成本，選擇及轉進利基應用市場，包括綠能、醫療、車用電子等領域，對於類比、感測器等晶片出現高度需求，同時強力佈局專利地圖，以提升並拉大競爭力之差異化。

③銷貨客戶集中

該公司耕耘半導體後段封裝服務領域多年，主要銷貨戶客戶包括國際知名影像感測器大廠、國內外半導體設計公司及半導體晶圓大廠等，前十大客戶銷貨金額佔各年度營收淨額之比重為九成以上。

因應對策：

該公司業已持續精進二維及三維晶圓級相關先進製程技術之開發，並建置 12 吋晶圓級封裝之產線，以因應影像感測器客戶之產能需求，希冀藉由封裝服務技術暨應用產品之多元化增加客戶群及擴大終端產品應用。未來期能將業務擴展至晶圓級系統整合封裝(System in Package)。

④資本支出大

由於 IDM 廠(Integrated Device Manufacture 整合元件廠，簡稱 IDM)委外代工訂單趨增，使得封裝廠商大舉擴充採購機器設備，而各家半導體晶圓製造廠陸續邁入更高階先進製程，封裝技術難度亦同步提高，所需投入之資本支出亦將增加。

因應對策：

該公司擁有產業經驗豐富之經營及研發團隊，隨時掌握市場需求，藉以了解封裝技術之未來趨勢，開發出符合市場及客戶需求的封裝技術，並審慎評估資金運用、設備投資及人員招募計畫，隨著市場需求適時調整機器設備組合。

⑤終端產品價格下跌快速

終端產品生命週期短，平均售價下滑，產品替代性高，在眾多競爭者同時分食市場大餅的情況下，競爭激烈，使得價格下跌快速，產品利潤薄。

因應對策：

因應電子產業及半導體產業市場與其技術的不斷變化，該公司的競爭利基為持續開發先進製程與新衍生技術，以提供予客戶最佳之封裝解決方案，並積極降低製造成本以及提升生產效能，進而提升或維持利潤。

(二)技術能力、研發與專利權風險分析

1.取得技術專家之評估意見

本推薦證券商與該公司並未請技術專家就該公司之研發技術能力出具評估意見或報告，故不適用。

2.研究發展狀況

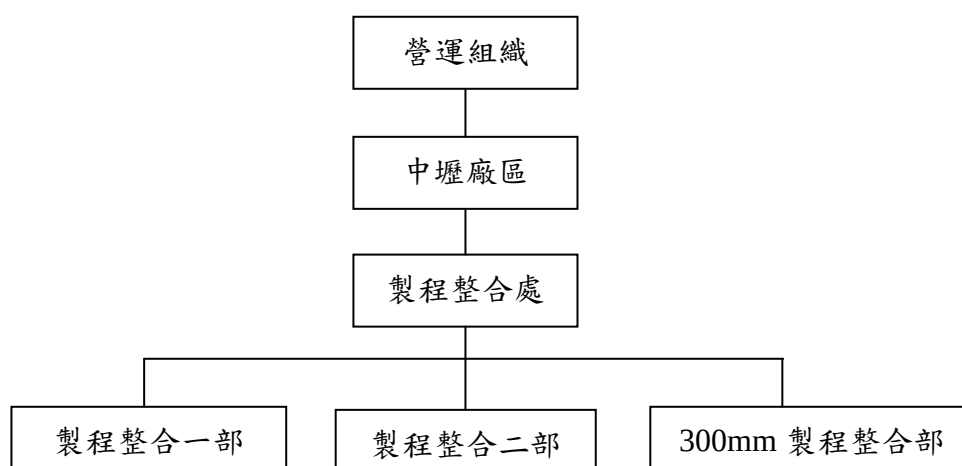
(1)公司研究發展部門之沿革與組織

該公司自 87 年 9 月成立以來即積極建構堅實的研發團隊，網羅來自 IC 半導體相關產業具有豐富實務經驗之人才，除持續先進封裝技術與製造技術之研發及創新外，歷年來為厚植研發實力，亦致力於培育研發專業人才並投入相當之資源於研究發展，截至 103 年底止，該公司研發團隊人數共 175 人，研發組織及製程整合處(隸屬營運組織)人數分別為 85 人及 90 人，茲將研發組織及製程整合處相關單位執掌列示如下：

①研發組織圖



②製程整合處組織圖(隸屬營運組織)



③各單位執掌

研發單位			工作執掌
研發組織	研發一處	整合專案-1 整合專案-2	新技術研究與開發、 新材料開發與導入、 因應量產之研發技術 移轉、客戶溝通與問 題解決、主導產品良 率分析等
	研發二處	300mm 研發專案 300mm 模組專案-1	
	研發三處	模組專案-1 模組專案-2 模組專案-3 模組專案-4	
	研發四處	整合專案-3 整合專案-4	
	產品可靠處	產品工程專案 設計專案	
製程整合處	製程整合一部	製程整合一課 製程整合二課 製程整合三課	新/先進產品製程規 劃及評估、新產品試 做及通過客戶驗證、 協助製程改善缺點提 升良率及穩定性等
	製程整合二部	先進製程整合一課 先進製程整合二課 先進製程整合三課	
	300mm 製程整合部	良率提升課	
		300mm 製程整合一課	

資料來源：該公司提供

(2)研發部門人員學經歷、平均年資及流動情形

單位：人

年 度		101 年度	102 年度	103 年度
員工 人數	期初人數	132	159	136
	本期新進(註 2)	43	29	61
	異動轉入(註 3)	30	2	10
	異動轉出(註 4)	14	33	11
	本期離職(註 2)	32	20	21
	本期資遣	0	1	0
	期末人數	159	136	175
平均服務年資		3.2	3.9	3.7
離職率(%) (註 1)		16.75	13.38	10.71
學歷 分布	博士	5	6	7
	碩士	68	79	103
	大專(學)	49	38	46
	高中(含)以下	37	13	19
合計		159	136	175

資料來源：該公司提供

註 1：離職率：離職人數/(期末人數+離職人數)

註 2：已扣除未滿試用期員工

註 3：係指由其他部門轉入，101 年度主係因新廠工程部及產品工程部部分人員轉至研發組織。

註 4：係指轉出至其他部門，102 年度主係因製程整合部部分人員轉至其他部門。

該公司研發人員截至 103 年底止共有 175 名，大專以上學歷之研發人員佔總研發人員比例達 89.14%，其中，具碩士以上人數為 110 人，佔總研發人員之 62.86%，且多畢業於相關科系或具備相關技能暨產業任職資歷，顯見該公司研發人力具備一定之研發專業素養與經驗，其研發團隊之素質良好。

在研發人員流動情形方面，101~103 年度之研發人員離職率分別為 16.75%、13.38%及 10.71%，主係因員工之個人生涯規劃、人員不適任或不適應工作環境為主，且離職員工多以基層研發人員為主，可見該公司核心研發人員異動情形並不高。此外，該公司業已建立完整研發循環之流程制度，研發技術文件均妥善保管備份，且所有員工到職時均需簽訂保密條款，離職員工亦需妥善辦理交接，該公司並積極尋求替補人選，故相關人員之異動對研發工作不致產生銜接困難之情事。

(3)最近三年度及申請年度之研發費用

研發費用占營收淨額比重

單位：仟元

年度 項 目	101 年度	102 年度	103 年度
研發費用	206,117	216,971	276,680
營業收入淨額	3,139,385	4,256,761	4,934,078
研發費用/營業收入淨額	6.57%	5.10%	5.61%

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告

該公司自成立研發部門以來，即積極從事封裝製程技術之開發與創新，並配合客戶產品需求開發出多種先進晶圓級封裝製程及技術，以建立自有核心技術為目標，並持續維持其先進封裝技術之競爭優勢。該公司101~103年度之研發費用分別為206,117仟元、216,971仟元及276,680仟元，分別占營業收入淨額之6.57%、5.10%及5.61%，隨營業規模逐年擴大，為能持續成長動能，遂持續擴充研發人力、投入研發相關經費，以建構優秀之研發技術團隊，並提升整體研發實力，惟101年度因半導體市場需求趨緩，該公司之主要銷售客戶調整產品組合策略而縮減對該公司之訂單量使營業收入淨額下滑，致101年度之研發費用占營業收入淨額比重較高。綜上所述，該公司持續致力於封裝製程之創新及改善，其最近三年度之研發費用變化情形尚屬合理。

(4)研發成果

該公司最近五年度及截至目前為止，研發重點在於衍生製程技術之開發、新製程技術之創新等，其研發成果列示如下：

年度	研發成果	主要功能/效益
98	CMOS 影像感測器模組整合應用	搭配外部鏡頭整合 CMOS 影像感測器成單一模組，提供完整解決方案。
	雙層重佈線技術(RDL)製程開發	提供客戶 Ball grid array 更彈性的繞線方式，可搭配原先 PCB 球墊配合設計。
99	矽穿孔(integrated circuits through silicon vias，縮寫 TSV)製程導入量產	Taper Via 製程技術導入量產並採用 Al 導線製程，提供可靠度佳的封裝方式。
	2D Fan in/out	提供 BGA 製程來連接晶片表面 pad
100	Lead tail 保護製程導入	提升模組對於高溼氣環境的抵抗能力
	黑色遮光層製程導入	遮蔽背景光源雜訊，提供車用 CMOS 影像感測器更佳的影像品質。
101	矽穿孔(TSV)製程導入量產	Vertical Via 製程技術導入量產並採用 Cu 導線製程，提供傳輸速率更快的封裝方式。
	建立電路 spice model 資料庫	提供客戶封裝的電性 model，讓客戶針對電路設計做先期評估。
102	溝渠式打線結構製程量產	提供溝渠式打線結構封裝製程。
	V 型矽穿孔(TSV)製程導入量產	採用鋁導線製程 Taper Via (low cost)的矽穿孔製程，技術導入量產，並提供更佳可靠度的封裝方式。
103	暫時性 Bond 製程導入	提升薄晶圓製程的處理能力，採用製程中暫時性載板技術，降低破片的風險。
	功率節能元件的厚銅製程	應用於系統晶片和被動元件(電阻、電感等)產品整合。

資料來源：該公司提供

(5)未來研發工作發展方向

研發項目	主要內容及功能	應用產品
CMOS 影像感測器超薄封裝製程開發	開發無玻璃封裝製程，增加入射光亮以提昇影像品質。	現行影像產品封裝
矽穿孔(TSV)製程在微機電(MEMS)元件之應用開發	配合客戶晶片設計	濕度感測計 壓力感測計
厚銅製程	針對不同圖樣設計，搭配不同的銅層厚度，達到客戶電性要求，並縮小封裝尺寸的目標。	高頻 IC 整合被動元件
建立 12 吋 CMOS 影像感測器封裝線	配合客戶 12 吋 CMOS 影像感測器晶片封裝需求。	現行影像產品封裝

資料來源：該公司提供

3.主要技術來源、技術報酬或權利金支付方式及金額

該公司於 89 年 6 月與 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.(以下簡稱 EIPA，其公司原名為以色列商 ShellCase Ltd.)簽訂之影像感測器晶圓級封裝技術授權合約，技術授權費已於 90 年 6 月全數支付完畢。另依該合約規定，自 92 年 4 月起，若使用合約所載明之特定技術製造及銷售產品時，應按其特定產品銷貨收入淨額之若干比率支付權利金，茲就相關契約內容摘錄如下：

技術授權來源	契約主要內容	契約起迄日期	權利金支付方式	重大限制條款
EIPA	WLCSP (晶圓級尺寸封裝技術權利金)	89/6 ~目前	(1)技術授權權利金已全數支付完畢。 (2)自 92 年 4 月起，使用合約所載明之特定技術製造及銷售產品時，應按其特定產品銷貨收入淨額之若干比率支付權利金。	保密責任

4.該公司目前重要技術合作契約及對該公司營運之風險

該公司與 EIPA 之技術授權合約持續有效，對該公司營運不致產生重大影響。

5.目前已登記或取得之專利權、商標權及著作權等資料，以了解有無涉及違反著作權、專利權及商標權等情事

該公司除 EIPA 之技術授權外，已自行開發多項技術並申請相關專利，其專利佈局以發明專利為主，目前截至 104 年 2 月 28 日止已取得台灣、中國、美國、日本及歐盟之專利共計 208 項，尚在申請中之專利共 422 項。

(1)專利權

國 別 申 請 類 別	台灣	中國	美國	日本	歐盟	PCT	合計
已取得	60	44	102	2	0	0	208
申請中	132	113	170	4	1	2	422
合計	192	157	272	6	1	2	630

資料來源：該公司提供

(2)商標權

①已取得

項次	申請名稱	申請國別	證書號碼	權利期間
1	XinPPI	中國	6560943	2010.08.07~2020.08.06
2	XinPPI	中國	6560944	2010.03.28~2020.03.27
3	XinPPI	中國	6560945	2010.04.21~2020.04.20
4	XinPac	中國	6560940	2010.08.07~2020.08.06
5	XinPac	中國	6560941	2010.03.28~2020.03.27
6	XinPac	中國	6560942	2010.04.21~2020.04.20
7	Xintec & DEVICE	中國	5991149	2010.05.07~2020.05.06
8	Xintec & DEVICE	中國	5991150	2010.02.28~2020.02.27
9	Xintec & DEVICE	中國	5991151	2010.01.07~2020.01.06
10	精材	中國	5991155	2010.05.07~2020.05.06
11	精材	中國	5991156	2010.02.28~2020.02.27
12	精材	中國	5991157	2010.01.07~2020.01.06
13	XINTEC	中國	5991152	2010.05.07~2020.05.06
14	XINTEC	中國	5991153	2010.02.28~2020.02.27
15	XINTEC	中國	5991154	2010.01.07~2020.01.06
16	XinPPI	台灣	1338793	2008.11.16~2018.11.15
17	XinPac	台灣	1338792	2008.11.16~2018.11.15
18	Xintec & DEVICE	台灣	1289640	2007.12.01~2017.11.30
19	Xintec & DEVICE	台灣	1296384	2008.01.01~2017.12.31
20	Xintec & DEVICE	台灣	1296280	2008.01.01~2017.12.31
21	精材	台灣	1296382	2008.01.01~2017.12.31
22	精材	台灣	1296278	2008.01.01~2017.12.31
23	精材	台灣	1294761	2008.01.01~2017.12.31
24	XINTEC	台灣	1289639	2007.12.01~2017.11.30
25	XINTEC	台灣	1296383	2008.01.01~2017.12.31
26	XINTEC	台灣	1296279	2008.01.01~2017.12.31

資料來源：該公司提供

②申請中

該公司目前無申請中之商標權。

(3)該公司有無涉及違反著作權、專利權及商標權等情事

該公司並無登記或取得著作權情事，且截至目前為止，亦無涉及違反專利權及商標權之情事。此外，該公司目前設法務處負責專利佈局策略之擬定、專利管理、專利申請、營業秘密之保護，同時亦緊密與研發部門及業務部門針對特定技術作專案開發研究，並提出必要之設計方案，以取得專利保護。

- 6.以科技事業或資訊軟體業申請股票上櫃者，取得現在主要產品之競爭價勢、生命週期、持續發展性暨新產品之研究開發計劃，以及生產開發技術之層次、來源等資料，以評估市場定位、需求及研究發展之內部控制暨保全措施

該公司非屬科技事業或資訊軟體業，故不適用。

- 7.以科技事業或資訊軟體業申請股票上櫃者，取得參與經營決策之董事、監察人、持股五%以上股東、以專利權或專門技術出資之股東及掌握生產技術開發經理人等之資歷、持股比例、最近二年度及申請年度內股權移轉變化暨實際投入經營之時間與情形等，並評估該等人員未來若未能繼續參與經營對申請公司之營運風險及其因應之措施

該公司非屬科技事業或資訊軟體業，故不適用。

(三)人力資源風險分析

1.最近三年度及申請年度截至最近期止依產品別區分之每人每年生產量值表，並就重大變動情形者，加以分析其原因

單位:片；仟元；人

項目(產品別)			年度		101 年度		102 年度		103 年度	
					量	值	量	值	量	值
晶圓級尺寸封裝服務	生產量值				288,762	2,673,873	374,930	2,929,007	313,425	2,783,245
	直接人員	平均量值			326	3,015	315	2,457	245	2,178
		員工人數			887		1,192		1,278	
	直接及間接人員	平均量值			210	1,940	215	1,677	159	1,412
		員工人數			1,378		1,747		1,971	
晶圓級後護層封裝服務	生產量值				125,112	180,309	260,355	598,589	397,095	1,158,335
	直接人員	平均量值			141	203	218	502	311	906
		員工人數			887		1,192		1,278	
	直接及間接人員	平均量值			91	131	149	343	201	588
		員工人數			1,378		1,747		1,971	
其他	生產量值				-	36,496	-	62,626	-	14,567
	直接人員	平均量值			-	41	-	53	-	11
		員工人數			887		1,192		1,278	
	直接及間接人員	平均量值			-	26	-	36	-	7
		員工人數			1,378		1,747		1,971	
合計	生產量值				413,874	2,890,678	635,285	3,590,222	710,520	3,956,147
	直接人員	平均量值			467	3,259	533	3,012	556	3,096
		員工人數			887		1,192		1,278	
	直接及間接人員	平均量值			300	2,098	364	2,055	360	2,007
		員工人數			1,378		1,747		1,971	

資料來源：該公司提供

註 1：約當 8 吋晶圓之片數換算。

註 2：由於其他種類產品種類極品項繁多，故產量及產值之統計數字較不具代表性。

該公司生產之產品依型態主要可區分為晶圓級尺寸封裝服務、晶圓級後護層封裝服務及其他三大類，晶圓級尺寸封裝服務及晶圓級後護層封裝服務占該公司產品成本約九成，其他主要係為出售原物料收入及設計收入，占該公司產品成本比率微小，茲就晶圓級尺寸封裝服務及晶圓級後護層封裝服務分析說明如下：

晶圓級尺寸封裝服務主係用於影像感測器、光感測器及環境感測器等光學元件之全製程封裝，產品之應用領域則包括手機、平板電腦、筆記型電腦、汽車及醫療等。101 年度因半導體市場需求趨緩，銷貨客戶對備貨態度相對

謹慎，且主要銷售客戶調整產品組合策略而縮減對該公司之訂單量，致晶圓級尺寸封裝服務之生產量及生產值皆較其他年度減少；102 年度由於影像感測器等光學元件之封裝需求回溫，致生產量及生產值皆較 101 年度增加，惟因增加招募生產線員工，致每人平均生產量值較 101 年度下滑；103 年度則受產品組合之影響，總生產量值略為降低，且每人平均生產量值亦降低。

晶圓級後護層封裝服務主要係指紋辨識感測器、作動感測器、微機電元件、功率、類比及 RF 元件之部分製程封裝，產品之應用領域包括手機、平板電腦、筆記型電腦、玩具、汽車等。101 年度因半導體市場需求趨緩，部分銷貨客戶對備貨態度相對謹慎而縮減對該公司之訂單量，致晶圓級後護層封裝服務之生產量及生產值皆較其他年度減少；102 年度因下半年度指紋辨識感測器封裝需求增加，其製程工序相對其他封裝服務之成本高，致晶圓級後護層封裝服務之生產量及生產值皆較 101 年度增加，且每人平均生產量值亦呈成長趨勢；103 年度因指紋辨識感測器封裝需求熱度未減，以及產品組合不同之影響，總生產量值仍呈成長趨勢。

綜上所述，該公司最近期及最近三個會計年度各主要產品別之產量、產值及每人每年生產量值變動情形尚屬合理。

2. 員工總人數、離職人數、資遣或退休人數、直接或間接人工數、平均年齡及平均服務年資等資料，評估離職率之變化情形及其合理性及對公司營運之風險

單位：人；年；歲

年 度			101 年度	102 年度	103 年度
員 工 人 數	期初人數		1,333	1,378	1,747
	本期新進(註 1)		297	684	545
	本期 減少	離職(註 1)	247	311	321
		資遣	5	4	0
		退休	0	0	0
		合計	252	315	321
	期末人數		1,378	1,747	1,971
平均服務年資		3.70	3.20	3.35	
平均年齡		33	32	33	
離職率(%)(註 2)		15.46	15.28	14.01	
直接人員		887	1,192	1,278	
間接人員		491	555	693	

資料來源：該公司提供

註 1：已扣除未滿試用期員工

註 2：離職率=離職人數/(期末人數+離職人數)

該公司 101~103 年度之員工人數分別為 1,378 人、1,747 人及 1,971 人，呈逐年增加趨勢，主要係因應營收規模逐漸成長之業務所需，近年來持續招募生產線人員、業務人員與研發人員，致員工人數逐步成長，整體而言，該公司之員工人數變動尚無重大異常之情形。

種類 \ 年度		101 年度		102 年度		103 年度	
		人數	%	人數	%	人數	%
離職 人數 (註 1) (註 2)	主管職員工	15	5.95	13	4.13	9	2.80
	一般職員	75	29.76	71	22.54	86	26.80
	生產線員工	162	64.29	231	73.33	226	70.40
	合計	252	100.00	315	100.00	321	100.00
期末人數		1,378		1,747		1,971	
離職率(%)(註 3)		15.46		15.28		14.01	

資料來源：該公司提供

註 1：已扣除未滿試用期員工

註 2：含退休及資遣員工

註 3：離職率=離職人數/(期末人數+離職人數)

該公司 101~103 年度之離職率分別為、15.46%、15.28%及 14.01%，離職人員多數為年資較淺之一般職員及生產線員工，其原因主要係該等人員對工作性質及工作績效均未達其個人或該公司之要求而離職或資遣，其人員之流動應屬正常之人員異動，由於一般職員及生產線員工職務替代性較高，人員遞補訓練上尚無困難，該公司亦得藉由人員調配及招募更適切人選，在員工離職後均能迅速於短期內填補；主管職員工方面，主要係因個人生涯規劃及家庭因素考量，該公司各部門職掌均訂有作業程序，並重視員工教育訓練，另有完備之代理人制度，對於工作銜接不致產生重大影響。整體而言，該公司人員異動情形對其營運狀況尚不致造成重大影響。

(四)各主要產品之成本分析

- 1.取得最近三年度及申請年度截至最近期止主要產品之原料、人工及製造費用資料，並分析各成本要素之比率變化對申請公司營運之風險

單位：新台幣仟元

產品	年度	101 年度		102 年度		103 年度	
	項目	金額	%	金額	%	金額	%
晶圓級尺寸封裝服務	原 物 料	419,550	15.69	530,698	18.12	416,856	14.98
	直 接 人 工	447,597	16.74	544,213	18.58	437,988	15.74
	製 造 費 用	1,806,726	67.57	1,854,096	63.30	1,928,401	69.29
	小 計	2,673,873	100.00	2,929,007	100.00	2,783,245	100.00
晶圓級後護層封裝服務	原 物 料	24,686	13.69	79,336	13.25	205,005	17.70
	直 接 人 工	25,369	14.07	76,654	12.81	231,289	19.97
	製 造 費 用	130,254	72.24	442,599	73.94	722,041	62.33
	小 計	180,309	100.00	598,589	100.00	1,158,335	100.00
其他	原 物 料	5,747	15.75	10,199	16.29	2,180	14.96
	直 接 人 工	5,790	15.86	10,800	17.24	2,373	16.29
	製 造 費 用	24,959	68.39	41,627	66.47	10,014	68.75
	小 計	36,496	100.00	62,626	100.00	14,567	100.00
合計	原 物 料	449,983	15.57	620,233	17.28	624,041	15.77
	直 接 人 工	478,756	16.56	631,667	17.59	671,650	16.98
	製 造 費 用	1,961,939	67.87	2,338,322	65.13	2,660,456	67.25
	小 計	2,890,678	100.00	3,590,222	100.00	3,956,147	100.00

資料來源：該公司提供

該公司為專業晶圓 IC 封裝公司，主要係於晶圓上利用相關製程技術從事晶圓加工，除晶圓係由銷貨客戶所提供外，因製程中需投入大量自動化設備，故其成本結構以製造費用所占比重最高，最近三年度占總成本之比重分別為 67.87%、65.13%及 67.25%，且製造費用中以折舊費用比重最高；而原物料與直接人工占總成本之比重相當。該公司主要封裝服務分為兩類，晶圓級尺寸封裝服務為全製程封裝服務(自晶圓尚未切割以至切割成單顆之 IC)，而晶圓級後護層封裝服務則為配合客戶需求以其製程技術從事晶圓加工(完成後直接以晶圓之形式運送至其他下游廠商)，故前述二類封裝服務對整體成本之比重仍以晶圓級尺寸封裝服務為重，經檢視最近三年度各封裝服務之成本結構，主要均係隨原物料價格波動及機器設備攤提折舊費用，致各期料、工、費相對比重產生變化，然整體變動情形尚稱穩定，並無重大異常情事。

2.取得最近三年度及申請年度截至最近期止主要產品之主要原料每年採購量及單價，並分析價格變動情形

單位：片/個/罐/桶；仟元

主要進貨 原料	101 年度			102 年度			103 年度		
	採購 數量	採購 金額	採購 單價	採購 數量	採購 金額	採購 單價	採購 數量	採購 金額	採購 單價
光學薄型 玻璃	415,512	158,480	0.38	526,865	179,793	0.34	463,398	173,618	0.37
靶材	1,183	30,906	26.13	1,506	39,006	25.90	2,001	36,763	18.37
鍍金液	455	32,659	71.78	575	35,883	62.41	575	32,691	56.85
電解光阻劑	523	25,879	49.48	860	42,324	49.21	1,037	48,589	46.86
黏著促進劑	2,040	18,734	9.18	3,952	35,841	9.07	3,316	30,193	9.11

資料來源：該公司提供

該公司主要係於晶圓上利用相關製程技術從事半導體晶圓加工，主要原料為光學薄型玻璃、靶材、鍍金液、電解光阻劑及黏著促進劑等，茲就每年採購量及單位價格變動情形，說明如下：

(1)光學薄型玻璃

光學薄型玻璃為晶圓級尺寸封裝服務之主要原料，101~103年度採購數量主要隨營收之增減而變化，另因封裝製程改良，部分製程僅需單片光學薄型玻璃，而非原有製程所需的雙片光學薄型玻璃，亦會影響該公司之採購量；101年度則為因應部分客戶需求，將光學薄型玻璃委外加工鍍膜以利後續封裝製程之進行，致使採購單價略為增加，惟整體而言，其光學薄型玻璃採購單價變化尚屬合理。

(2)靶材

靶材(主要材質為鋁銅合金等)為晶圓級尺寸封裝服務及晶圓級後護層封裝服務之主要原料，101~103年度採購數量主要隨營收及產品組合之增減而變化，而採購單價除係隨著國際貴金屬行情波動影響，經評估尚無重大異常。

(3)鍍金液

鍍金液為晶圓級尺寸封裝服務及晶圓級後護層封裝服務之主要原料，101~103年度採購數量主要隨營收及產品組合之增減而變化，而採購單價除係隨著國際貴金屬行情波動影響，經評估尚無重大異常。

(4)電解光阻劑

電解光阻劑為晶圓級尺寸封裝服務及晶圓級後護層封裝服務之主要原料，101~103年度採購數量主要隨營收及產品組合之增減而變化，而採購單價除103年度因供應商調降價格，使採購單價下降外，其他年度採購單價變化尚屬穩定，經評估尚無重大異常。

(5)黏著促進劑

黏著促進劑為晶圓級尺寸封裝服務及晶圓級後護層封裝服務之主要原料，101~103年度採購數量主要隨營收及產品組合之增減而變化，而採購單價變化尚屬穩定，經評估尚無重大異常。

- 3.最近三年度及申請年度截至最近期止長期供貨契約，暨供貨短缺或中斷情形資料，以評估供貨契約有無重大限制條款及貨源過度集中之風險

為避免氮氣及氧氣價格隨電費調漲而波動，該公司與一供應商簽定長期供貨合約以穩定採購價格，然氮氣及氧氣並非其主要原物料，且該公司亦未與其他供應商簽訂長期供貨合約，故對該公司並不致產生重大營運風險。且該公司與主要供應商已建立良好之合作關係，並多有二家以上之供應商合作，故過去三年度及申請年度皆未有供貨短缺或中斷之情事發生，供貨來源尚屬穩定，且未有貨源過度集中之情形。

- 4.建設公司申請股票上櫃者，取得當（鄰）地行情報導、同業資料及政府機關提供之房地價格比例（如評定現值及公告現值比例或房屋造價及地價比例等），以評估合建分售、合建分屋或合建分成者，申請公司與地主之分配比率是否合理

該公司非為建設公司，故不適用此項評估。

(五)匯率變動情形

- 1.最近三年度及申請年度最近期止兌換損益占營業利益之比率及內外銷、內外購比率以評估匯率變動對公司營運之風險

(1)最近三年度及申請年度截至最近期止內外銷、內外購比率

最近三年度及申請年度截至最近期止內外銷金額

單位：仟元

年度 項目		101 年度		102 年度		103 年度	
		金額	%	金額	%	金額	%
內銷		510,443	16.26	1,190,213	27.96	2,069,314	41.94
外銷	美洲	1,481,268	47.18	1,630,592	38.31	1,528,052	30.97
	亞洲	662,836	21.11	960,429	22.56	686,177	13.91
	歐洲	482,356	15.37	475,527	11.17	650,535	13.18
	澳洲	2,482	0.08	-	-	-	-
	小計	2,628,942	83.74	3,066,548	72.04	2,864,764	58.06
合計		3,139,385	100.00	4,256,761	100.00	4,934,078	100.00

資料來源：該公司提供

最近三年度及申請年度截至最近期止內外購金額

單位：仟元

項目 \ 年度		101 年度		102 年度		103 年度	
		金額	%	金額	%	金額	%
台幣付款		513,539	66.51	707,984	66.89	803,743	70.28
外幣付款	美金	157,192	20.36	236,551	22.35	237,050	20.73
	歐元	33,528	4.34	37,270	3.52	38,277	3.35
	日幣	42,217	5.47	46,698	4.41	42,076	3.68
	瑞士法郎	25,606	3.32	29,932	2.83	22,397	1.96
	小計	258,543	33.49	350,451	33.11	339,800	29.72
合計		772,082	100.00	1,058,435	100.00	1,143,543	100.00

資料來源：該公司提供

該公司之銷貨計價以美元為主，而進貨計價以新台幣及美元為主，應收、應付款項可相互沖抵產生自然避險效果，惟在轉換成新台幣時，仍會因持有外幣部位而產生匯兌損益，該公司採取遠期外匯等財務性避險措施來降低進銷貨產生之外幣部位之匯兌風險，故對匯兌波動對該公司之影響有限。

(2)最近三年度及申請年度兌換損益情形

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	101 年度	102 年度	103 年度
金融商品評淨(損)益 (A)	19,339	(20,661)	(51,338)
兌換(損)益 (B)	(22,333)	12,117	49,819
淨額 (C=A+B)	(2,994)	(8,544)	(1,519)
營業收入 (D)	3,139,385	4,256,761	4,934,078
營業淨利 (E)	(96,240)	380,636	675,630
C/D(%)	(0.10)%	(0.20)%	(0.03)%
C/E(%)	3.11%	(2.24)%	(0.22)%

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告

由上表可知，該公司 101~103 年度之淨兌換(損)益分別為占各年度營業收入淨額及營業淨利之比例分別為 (0.10)%、(0.20)%、(0.03)%及 3.11%、(2.24)%、(0.22)%，各年之淨兌換(損)益占營收淨額及營業淨利比重均尚非重大，故對匯兌波動對該公司之影響有限。

(3)公司因應匯率變動所採取之避險措施

該公司主要銷貨客戶以美元計價為主，原物料供應商主要以台幣及美元等幣別計價，應收、應付款項相沖抵產生自然避險效果，惟在轉換成台幣時，仍因持有外幣部位而產生匯兌損益，因此，任何顯著的國際匯率變

動將影響該公司獲利。該公司主要使用遠期外匯之衍生性金融交易以規避因淨外幣資產、負債所產生之匯率風險。除此以外，並採取以下措施以管理匯率波動風險：

- ①隨時蒐集有關匯率變化資訊，及參考銀行專業意見，以充分掌握匯率走勢。
- ②該公司已訂定「取得或處分資產處理程序」，規範有關衍生性金融商品之交易、風險管理、監督及稽核等處理程序。

伍、業務狀況

一、營業概況

(一)最近三年度及申請年度截至最近期止主要銷售對象及供應商(年度前 10 名或占年度營業收入淨額或進貨淨額 5%以上者) 之變化分析

1.最近三年度及申請年度截至最近期止主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例

單位:新台幣仟元

年度 名次	101 年度			102 年度			103 年度		
	公司名稱	銷售額	%	公司名稱	銷售額	%	公司名稱	銷售額	%
1	OVTI 集團	1,261,163	40.17	OVTI 集團	1,580,579	37.13	台積電集團	1,732,290	35.11
2	B 公司	628,443	20.02	台積電集團	862,283	20.26	OVTI 集團	1,425,860	28.90
3	A 公司	443,542	14.13	A 公司	484,182	11.37	B 公司	667,339	13.52
4	C 公司	206,208	6.57	B 公司	422,281	9.92	A 公司	476,558	9.66
5	台積電集團	185,554	5.91	C 公司	386,302	9.08	D 公司	184,350	3.74
6	D 公司	132,571	4.22	D 公司	124,266	2.92	C 公司	123,377	2.50
7	G 公司	67,744	2.16	H 公司	106,399	2.50	I 公司	70,579	1.43
8	F 公司	66,959	2.13	F 公司	66,657	1.57	H 公司	48,851	0.99
9	E 公司	66,716	2.13	I 公司	65,592	1.54	比亞迪	43,434	0.88
10	H 公司	30,183	0.96	無錫鴻圖	33,879	0.80	G 公司	39,232	0.79
小計		3,089,083	98.40	小計	4,132,420	97.09	小計	4,811,870	97.52
其他		50,302	1.60	其他	124,341	2.91	其他	122,208	2.48
銷貨淨額		3,139,385	100.00	銷貨淨額	4,256,761	100.00	銷貨淨額	4,934,078	100.00

資料來源：該公司提供

2.主要銷售對象、價格及條件之變化原因，並分析其合理性

(1)主要銷售對象變化原因，並分析其合理性

該公司為專業 3D 晶圓級 IC 封裝之領導者，主要業務為提供影像感測器、環境感測器等之晶圓級尺寸封裝，其指紋辨識感測器、微機電及電源控制元件之晶圓級後護層封裝服務技術已臻成熟，並深獲客戶肯定。該公司主要客戶為晶圓代工大廠、影像感測器 IC 設計大廠、環境感測器 IC 設計公司、電源管理元件 IC 設計大廠、印表機噴墨頭 IC 設計公司等，最近三年度對前十大銷售對象之銷售比重分別為 98.40%、97.09%及 97.52%，其銷貨對象、金額及比率之變化情形，主要受產業景氣波動、客戶營運情形及新產品開發進度等因素而變動，茲就其最近三年度主要銷售對象變化情形及原因分析如下：

- ①台積電集團(台灣積體電路製造股份有限公司，負責人：張忠謀；資本額：新台幣259,286,171仟元；設立地區：台灣新竹科學園區；授信條件：月結30天；網址：www.tsmc.com)

台灣積體電路製造(股)公司(以下簡稱台積電)(台灣 TSE：2330，美國 NYSE：TSM) 成立於 76 年，在半導體產業中首創專業積體電路製造服務模式，為全球規模最大的專業積體電路製造公司，持續提供客戶最先進的技術及設計服務。台積電為全球六百多個客戶提供服務，生產超過一萬一千多種的晶片，被廣泛地運用在電腦產品、通訊產品與消費性電子產品等多樣應用領域。台積電的全球總部位於台灣新竹科學園區，在北美、歐洲、日本、中國大陸、南韓、印度等地均設有子公司或辦事處，提供全球客戶即時的業務和技術服務。

該公司與台積電之合作已超過 9 年，主係台積電透過 Turnkey Service 交易模式，由該公司提供台積電晶圓級後護層封裝服務。(Turnkey Service 為半導體業常見之交易模式，係當 IC 設計公司向晶圓製造廠下單時，晶圓製造廠可以提供從晶圓代工、封裝、測試之全套解決方案服務)該公司最近三年度對其之銷售金額分別為 185,554 仟元、862,283 仟元及 1,732,290 仟元銷售比率分別為 5.91%、20.26%及 35.11%，(102 年度包含對台積電(中國)有限公司之銷售約新台幣 81 仟元(美金 3 仟元))。該公司 101 年度與台積電以 Turnkey Service 交易模式，由該公司提供晶圓級後護層封裝服務，產品主要應用在電源管理 IC 及作動感測器(如陀螺儀與加速度器等)。102 年起全球半導體產業復甦，智慧型手持裝置包括智慧型手機及平板電腦的市場需求成長，其中，行動裝置對於個人隱私的保護需求成為市場新趨勢，而指紋辨識感測器即為一獨特且安全之辨識方式。因該公司晶圓級後護層封裝服務所使用之先進封裝技術成熟深獲終端客戶青睞，惟終端客戶為確保產品良率、品質控管及責任分工，並考量整體產品的產能供應鏈生產順暢，遂與台積電合作以 Turnkey

之商業模式合作，由台積電完成晶圓生產再垂直整合下游供應鏈製程，以有效管理並降低產品風險及縮短產品交期，故在行動裝置市場大幅成長帶動指紋辨識感測器之需求下，該公司自 102 年下半年起持續提供台積電指紋辨識感測器之晶圓級後護層封裝服務，103 年延續訂單熱度，銷售金額持續增加，並首度超越 OVTI 集團，成為該公司第一大客戶。綜上，該公司對台積電之銷售變化情形尚屬合理。

②OVTI集團(OmniVision Technologies，負責人：Shaw Hong；股權淨值：美金1,082,671仟元；設立地區：美國加州；授信條件：月結30天；網址：www.ovt.com)

OmniVision Technologies, Inc.(美國 NASDAQ：OVTI)成立於 84 年，主要營業項目為影像感測器元件之設計、研發及市場銷售，為全球前十大影像感測器元件供應商，全球市佔率高達三成，產品廣泛應用於消費性及商務商品上(例如手機、筆記型電腦、安全監控系統、數位相機、車用顯示攝影及醫療攝影系統等)，其終端客戶包括國際知名品牌及非主流品牌廠商，並設有 19 家子公司，銷售市場遍及全球。

該公司主要提供其晶圓級尺寸封裝服務予 OVTI 集團，銷售對象主要包括 OmniVision Technologies, Inc.、OmniVision Technologies Singapore Pte. Ltd、OmniVision International Holding Ltd、台灣豪威科技有限公司及台灣豪威光電科技(股)公司等(以下通稱為 OVTI 集團)，產品主要應用於手機、平板及筆記型電腦等。該公司與 OVTI 集團之交易始於 92 年，與 OVTI 集團業務往來多年且合作關係良好穩定，101 年度為配合市場對更高階畫素的影像感測器需求，OVTI 集團進而調整其產品組合，並降低對該公司之下單量，以致該公司 101 年度對 OVTI 集團之總銷售淨額僅為 1,261,163 仟元，102 年度後則因銷售目標市場改變，OVTI 集團再度將重心移回中國大陸手機市場，並持續委託該公司進行影像感測器封裝，致 102 年度銷售淨額為 1,580,579 仟元；103 年度因配合市場需求增加對高階影像感測器需求，略為調整對該公司之下單量，致 103 年度該公司對其營業收入為 1,425,860 仟元。綜上，該公司對 OVTI 集團之銷售變化之情形尚合理。

③B公司

B 公司係國外上市公司，其主要營業項目為設計、製造及銷售類比及混合信號積體電路，產品主要應用在感測器、感測器介面、功率管理積體電路等，並可廣泛應用於消費、工業、醫療、流動通信及汽車市場。

該公司主要提供其晶圓級尺寸封裝服務，應用於影像感測器，101 年因 B 公司成功切入知名品牌手機供應鏈，使其業績上升，進而增加對該公司之封裝訂單，該公司自 101 年起對 B 公司之銷售數量穩定，102 年度銷貨淨額減少主要係因於產品製程共同開發階段(101 年前)，量產初

期部份批次之產品不良，該公司與 B 公司經協商後同意共同承擔損失，該公司以後續出貨折讓方式分期攤還相關補償款，另因 B 公司之良率要求較高，針對良率未達標準者另要求該公司以折讓方式補償，故隨 B 公司訂單成長而致 102 年折讓金額增加，該客戶銷售額排名與比重均下跌，103 年度因該公司製程逐漸成熟，致良率改善，折讓金額逐漸下降，故該公司對 B 公司之銷售金額與比重已持續回升。綜上，該公司對 B 公司之銷售變化情形尚屬合理。

④A公司

A 公司成立於 92 年，主要營業項目為積體電路及相關電子產品的設計、研發及測試，以及影像感測器的生產，並提供相關技術諮詢服務等，目標客群為中國及新興市場，產品主要應用在智慧型手機、平板電腦等移動裝置。該公司主要提供其晶圓級尺寸封裝服務，產品應用於影像感測器上，該公司配合 A 公司客製化需求而進行封裝服務，最近三年度 A 公司皆為該公司之前五大銷售客戶，對其銷售淨額分別為 443,542 仟元、484,182 仟元及 476,558 仟元，銷售比率分別為 14.13%、11.37% 及 9.66%，各年度大致呈穩定趨勢。綜上，該公司對 A 公司之銷售變化情形尚屬合理。

⑤D公司

D 公司其成立於 96 年，係國外上市公司之旗下子公司，技術核心聚焦於影像感測器、系統級晶片整合以及晶圓級攝影機解決方案，主要應用端包括手持式移動設備、消費性電子產品、監視安防攝影機及新興智慧型感測器市場。影像感測器之製造需要結合光學、美學、IC 設計與晶圓製造等四大領域專才，進入門檻高，D 公司於成立 2 年內即推出影像感測器產品，且產品深獲國際大廠採用，於近年在美國影像感測器應用市場之市佔率大幅提升。該公司主係提供 D 公司晶圓級尺寸封裝服務，產品應用於影像感測器，最近三年度該公司對其銷售金額分別為 132,571 仟元、124,266 仟元及 184,350 仟元，銷售比率分別為 4.22%、2.92% 及 3.74%，銷售金額及比重穩定，並無發現其銷售變化情形有重大異常情事。

⑥C公司

C 公司係國外上市公司，除耕耘記憶體市場有成外，基於記憶半導體領域所積累的技術競爭力，亦成功進入影像感測器市場，其產品得以廣泛應用於網路攝影機，微型醫療影像設備，以及搭載相機的行動電話與智慧型手機等。該公司主要提供其晶圓級尺寸封裝服務，產品應用於影像感測器，101 年至 102 年間 C 公司配合市場需求調整對該公司之訂單，致最近二年銷售金額分別為 206,208 仟元及 386,302 仟元；103 年度因 C 公司調整其產品組合，減少對該公司之下單量，以致該公司對 C 公

司銷貨金額下降至 123,377 仟元。綜上，該公司對 C 公司之銷售變化情形尚屬合理。

⑦I公司

I 公司為全球功率半導體及電源管理方案之領導廠商，係國外上市公司，其生產之整流器可應用於電腦、效率能源應用設備、照明、汽車、衛星、飛機及防衛系統上。過去該公司主要係提供 MOSFET 功率場效電晶體之封裝服務(此類產品對可靠度要求高)，惟當時之交易模式屬於台積電 Turnkey Service 一環，因該公司之封裝品質獲得 I 公司之肯定，故自 101 年起 I 公司開始調整其下單模式，逐步改與該公司直接交易，故 101 年度銷售金額僅 1,262 仟元，102 年起已全面改成直接交易模式，故 102 年度及 103 年度銷售金額分別為 65,592 仟元及 70,579 仟元。綜上，該公司對 I 公司之銷售變化尚屬合理。

⑧比亞迪(深圳比亞迪微電子有限公司，負責人：王傳福；資本額：人民幣 2,354,100 仟元；設立地區：深圳；授信條件：月結 30 天；網址：-)

深圳比亞迪微電子有限公司(以下簡稱比亞迪)設立於 93 年，是 BYD Company Ltd. (港交所：1211；深交所：002594)的子公司，致力於積體電路及功率器件的開發，並提供產品應用的整套解決方案，主要產品為影像感測器、IGBT 晶片及模組，智慧功率模組(IPM)、功率場效應管(MOSFET)、觸控板等。比亞迪擁有豐富的技術人才，獨立開發出多款具有世界先進水準的產品，並獲得多項中國及國際專利，以及多家國際手機大廠之認可。該公司主要提供其影像感測器之晶圓級尺寸封裝服務，101 年至 103 年度該公司對其銷售金額分別為 7,594 仟元、27,533 仟元及 43,434 仟元，呈向上趨勢，主要係因 102 年起隨着移動互聯網的快速普及和智能應用的不斷豐富，智慧型手機市場需求上升，帶動比亞迪對該公司之下單量，綜上，該公司對比亞迪之銷售變化情形尚屬合理。

⑨G公司

G 公司成立於 89 年，主要係生產噴墨印表頭晶片，該種印表機主要客群為商用印表機需求者及 SOHO 族，商品特色為可快速列印高畫質圖像。該公司主要提供其晶圓級後護層封裝服務，進行微機電元件(MEMS)之重佈線製程。該公司與 G 公司往來超過 5 年，101 年至 103 年間，除 102 年外皆為該公司之前十大銷售客戶。該公司 101 年至 103 年對其銷售金額分別為 67,744 仟元、21,446 仟元及 39,232 仟元，主係因高階智能噴墨列印機市場景氣不佳，造成 G 公司業績不穩定，連帶影響對該公司之下單量。綜上，該公司對 G 公司之銷售變化情形尚屬合理。

⑩H公司

H 公司成立於 86 年，為一專業晶片設計公司，並為全球平面顯示

螢幕驅動 IC 之主要供應商，產品成功獲得國際知名平面顯示器供應商之採用。其產品廣泛應用於手機、數位相機、MP3、iPod 等個人消費性電子產品，以及家庭及商業應用的顯示螢幕與數位產品。該公司主要提供其晶圓級尺寸封裝服務，產品應用於影像感測器。該公司自 98 年與 H 公司首次交易，101 年度之銷售額為 30,183 仟元，102 年度因 H 公司調整其產品組合，並將影像感測晶片應用於手機及相機模組上，故對該公司封裝服務需求大幅提升，銷售淨額成長為 106,399 仟元，並成為該公司之第七大銷售客戶，103 年度則因 H 公司持續消化庫存，雖該公司與 H 公司已合作開發其他高階產品方案，仍無法及時挹注 103 年度之銷貨金額，致銷售額大幅下降。綜上，該公司對 H 公司之銷售變化情形尚屬合理。

⑪F公司

F 公司成立於 97 年，係台灣上櫃公司之子公司，主營業務項目為影像感測元件的研發、設計、製造及其相關產品之進出口貿易業務。該公司主要提供其晶圓級尺寸封裝服務，產品應用於影像感測器，因 F 公司深耕中國大陸白牌手機市場多年，對該公司 101 年至 102 年之下單情形穩定，分別為 66,959 仟元、66,657 仟元，然因近年來中國手機市場競爭激烈，F 公司逐步調整產品組合，並轉戰至行車紀錄器及安全監控市場，故對該公司訂單金額大幅減少至 9,383 仟元。綜上，該公司對 F 公司之銷售變化情形尚屬合理。

⑫無錫鴻圖(無錫鴻圖微電子技術有限公司，負責人：魏玉；資本額：人民幣10,000仟元；設立地區：中國江蘇省；授信條件：月結30天；網址：www.hongtuic.com)

無錫鴻圖微電子技術有限公司(以下簡稱無錫鴻圖)成立於 101 年，為影像感測器核心晶片設計、開發、生產及銷售，產品廣泛應用於手機照相攝像、數碼相機和攝像機、筆記型電腦及網路攝像機、安防監控、汽車照相及醫療窺鏡等領域。該公司主要提供其晶圓級尺寸封裝服務，產品應用於影像感測器與環境感測器，並自 102 年起開始與其交易，102 年度及 103 年該公司對其銷售金額分別為 33,879 仟及 5,240 仟元，102 年度其亦為該公司前十大銷貨客戶之一，103 年因其改變產品組合，且逐漸淡出市場，故對該公司訂單數量減少。綜上，該公司對無錫鴻圖之銷售變化情形尚屬合理。

⑬E公司

E 公司成立於 87 年，主要致力於影像感測器及影像應用 IC 的設計、研發、生產與銷售。E 公司擁有豐富的類比 IC 設計、影像及色彩處理、混合訊號電路以及數位及類比電路整合技術，目前是全球影像感測器以及數位影像應用 IC 的領導廠商之一。產品主要應用於數位相

機、數位攝影機、玩具、PC camera、光學滑鼠、保全監視系統、行動電話等。該公司主要提供其晶圓級尺寸封裝服務，產品應用於影像感測器(遊戲產品用)，最近三年度該公司對其銷售金額分別為 66,716 仟元、28,257 仟元及 12,989 仟元，逐年減少主要係因遊戲機產品銷售狀況退潮，且其他產品之營運狀況不如預期，故逐漸減少對該公司之封裝服務需求。綜上，該公司對 E 公司之銷售變化情形尚屬合理。

(2)是否有銷售集中之風險

該公司耕耘半導體後段封裝服務領域多年，主要客戶包括國際知名影像感測器大廠、國內外半導體設計公司及半導體晶圓大廠等，其前十大銷售客戶 101~103 年佔各該年度營收淨額之比率分別為 98.40%、97.09%及 97.52%，其中，101~102 年對關係人 OVTI 集團之銷貨及 103 年對關係人台積電集團之銷貨分別有超過該公司銷售淨額之三成之情形。由於晶圓級尺寸封裝服務及後護層封裝服務，均涉及銷貨客戶(或終端客戶)之 IC 設計，需要在產品初期即與客戶密切合作，該公司與 OVTI 集團及台積電集團均往來多年且關係良好穩定，此種之合作模式得以更加強化半導體供應鏈之穩定性及可靠性，並產生規模經濟效應所致。該公司業將持續精進三維晶圓級相關先進製程技術之開發，未來期能將業務擴展至晶圓級系統整合封裝(System in Package)外，並於 103 年進軍 12 吋晶圓級封裝領域，逐步建置 12 吋晶圓級封裝之產線，以因應高端感測器客戶之需求，希冀藉由封裝服務技術暨應用產品之多元化，增加客戶群及創造營收，以分散銷售集中於關係人之風險。

(3)公司之銷售政策

①建立以客戶導向之專業封裝服務，掌握關鍵客戶產品需求

該公司建立完整技術專利，並藉由開發符合市場需求之先進晶圓級封裝解決方案，掌握關鍵客戶產品需求並強化與上游半導體產業技術之整合，以在晶圓級製程平台上提供客戶所需的技術、嚴謹的生產、優良的品質和優質的服務。

②加強上、中、下游產業鏈之合作關係

先進製程需求越來越高之際，上、中、下游之合作與整合是先進高階製程能否成功之重要關鍵，該公司藉由其先進技術之創新及整合能力建立並簡化半導體上、中、下游產業鏈虛擬一條龍式解決方案(Virtual Turnkey Solution)，提供無晶圓廠(Fabless)、系統客戶及輕晶圓廠(Fab-Lite IDM)封裝技術之解決方案。

③聚焦新興行動裝置市場，跨足其他領域

該公司之核心技術為三維晶圓級尺寸封裝、二維及三維晶圓級後護

層封裝，其致力於衍生製程與新製程之研究發展，如先進三維晶圓級堆疊之應用、矽晶圓連接之載板等，持續精進二維及三維晶圓級相關先進製程技術之開發，未來期能將業務擴展至晶圓級系統整合封裝(System in Package)，以提供客戶更完善之銷售服務，產品之應用將聚焦於作動感測器、加速度器、陀螺儀等，並將產品應用市場從消費性與電腦之應用提昇至穿戴式裝置更跨足汽車電子產業。

3.最近三年度及申請年度截至最近期止主要供應商之名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額

單位：新台幣仟元

年度	101 年度			102 年度			103 年度		
排名	供應商名稱	金額	%	供應商名稱	金額	%	供應商名稱	金額	%
1	NEG	78,839	10.21	NEG	100,190	9.47	台灣羅門哈斯	82,744	7.24
2	台灣羅門哈斯	51,701	6.70	琳得科	79,752	7.53	琳得科	81,855	7.16
3	耀穎	50,020	6.48	台灣羅門哈斯	78,694	7.43	NEG	80,249	7.02
4	琳得科	49,759	6.44	三福	56,712	5.36	三福	67,581	5.91
5	三福	38,240	4.95	台灣波律	47,557	4.49	耀穎	53,528	4.68
6	MITSUYA	37,606	4.87	MITSUYA	40,806	3.86	家榮	50,240	4.39
7	台灣波律	35,552	4.60	家榮	39,703	3.75	台灣波律	42,754	3.74
8	家榮	35,333	4.58	SCHOTT	37,067	3.50	安智	39,266	3.43
9	SCHOTT	32,877	4.26	台灣陶氏化學	35,841	3.39	SCHOTT	38,277	3.35
10	繼業	29,270	3.79	耀穎	35,586	3.36	MITSUYA	37,841	3.31
小計		439,197	56.88	小計	551,908	52.14	小計	574,335	50.23
其他		332,885	43.12	其他	506,527	47.86	其他	569,208	49.77
進貨淨額		772,082	100	進貨淨額	1,058,435	100	進貨淨額	1,143,543	100.00

資料來源：該公司提供

(1)主要供應商變化情形之原因並分析是否合理

該公司主要從事光學感測元件之晶圓級封裝服務，以及應用於其他感測器之晶圓級後護層封裝服務，主要進貨項目為光學薄型玻璃、電解光阻劑、切割刀、膠帶及氮氣等晶圓封裝過程中所需之原物料。101~103 年度十大供應商進貨金額佔年度進貨比例分別為 56.88%、52.14%及 50.23%，茲將 101~103 年度主要供應商之變化情形說明如下：

①台灣羅門哈斯電子材料股份有限公司(以下簡稱台灣羅門哈斯)

台灣羅門哈斯為美國上市公司陶氏化學(Dow Chemical Company，美國紐約證券交易所掛牌，股票代號：DOW)之成員企業，位於桃園；陶氏化學成立已超過一百年，總部位於美國密西根州，為全球特殊材料產業領域的創新技術與解決方案的領導廠商，台灣羅門哈斯的技術被廣泛應用於建築塗料和工業塗料、個人護理和家用及工業用化學品。該公司與台灣羅門哈斯自97年開始交易，主要向其購買半導體製程所需材料及特殊化學品(如電解光阻劑、防焊劑及黏著劑等)。101~103年度對其採購金額分別為51,701仟元、78,694仟元及82,744仟元，佔進貨淨額比重分別為6.70%、7.43%及7.24%，對其採購金額變動主要受客戶需求及製程考量影響，101年度全球半導體產業景氣低迷，致採購金額大幅減少；102年度隨著景氣復甦及新封裝產品之挹注，致相關採購金額大幅提升；103年度則因延續銷售訂單之需求，採購狀況呈穩定增加，整體而言，該公司對台灣羅門哈斯之採購變化尚屬合理。

②琳得科先進科技股份有限公司(以下簡稱琳得科)

琳得科為日本上市公司琳得科株式會社(東京證券交易所上市一部掛牌，股票代號：7966，成立於16年)於89年設立之台灣子公司，位於高雄。主要產品為工業用薄膜、黏著紙、黏著膠膜、半導體相關產品及液晶顯示器專用膠膜等。該公司與琳得科自96年開始交易，主要向其採購半導體產業常用之研磨或切割時晶片背面保護膠帶。101~103年度對其採購金額分別為49,759仟元、79,752仟元及81,855仟元，佔進貨淨額比重分別為6.44%、7.53%及7.16%，對其採購金額變動主要受客戶需求及製程考量影響，經評估其變化尚屬合理。

③NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. (以下簡稱NEG)

NEG成立於38年，為一日本公司，總部位於滋賀縣，主要從事各尺寸顯示器及電子產品之特殊玻璃製造、研發及銷售。該公司與NEG自94年開始交易，主要向其採購光學薄型玻璃，101~103年度對其採購金額分別為78,839仟元、100,190仟元及80,249仟元，佔進貨淨額比重分別為10.21%、9.47%及7.02%，對其採購金額變動主要受客戶需求及製程考量影響，101年度採購金額下降，除受全球半導體產業景氣低迷之影響外，

主係該公司在晶圓封裝製程上有所改良，部分製程中，晶圓加工僅需單片光學薄型玻璃，而非原先的雙片光學薄型玻璃；而102年度採購金額增加除受客戶需求及製程考量影響外，另考量外幣計價所生之匯率風險等因素，該公司逐漸將光學薄型玻璃的採購量集中於NEG；103年度主係因客戶之產品組合需求變化，致光學薄型玻璃採購量減少，經評估其變化尚屬合理。

④三福氣體股份有限公司(以下簡稱三福)

三福成立於63年，為台灣公司，位於台北，主要產品為工業氣體(如：氣態與液態氧、氮、氫、氬、氦及二氧化碳)及電子化學品(如：去光阻液、拋光研磨液等)。該公司與三福自96年開始交易，主要向其採購晶圓封裝製程常用之氮氣(用來保存晶片及清潔)及少量去光阻液等。該公司101~103年度對其採購金額分別為38,240仟元、56,712仟元及67,581仟元，佔進貨淨額比重分別為4.95%、5.36%及5.91%，101年度採購金額下降主係受全球景氣不佳影響客戶之需求所致，102年迄今因製程考量，對其採購之去光阻液增加，以致該公司對三福之採購金額持續提升，經評估其變化尚屬合理。

⑤耀穎光電股份有限公司(以下簡稱耀穎)

耀穎成立於92年，為台灣公司，其工廠位於新竹，主要業務為生產應用於光電產業之光學薄膜及其元件，其主要產品包括晶圓級封裝光學元件、光學儀器應用之濾波片、半導體光學元件及混合型吸收式紅外光截止濾光片等。該公司與耀穎自100年開始交易，主要委託其對光學薄型玻璃進行加工鍍膜。101~103年度對其採購金額分別為50,020仟元、35,586仟元及53,528仟元，佔進貨淨額比重分別為6.48%、3.36%及4.68%，101年度採購金額上升主係該公司部分銷售客戶之產品對加工鍍膜需求增加所致，102年度則因耀穎代工之某批鍍膜產品品質不良，影響該公司之成品良率，經協議提供該公司進貨折讓，103年度因該公司客戶需求變動且耀穎也改善其不良原因後，該公司委託其代工鍍膜金額亦提升，經評估其變化尚屬合理。

⑥家榮股份有限公司(以下簡稱家榮)

家榮成立於68年，為台灣公司，位於台北，主要營運項目為代理引進半導體及電子產品等領域之設備(例如半自動晶圓切割機、研磨機、清洗機、拋光機及溫控警示看板等)。該公司與家榮自96年開始交易，主要向其採購切割刀及研磨輪。101~103年度對其採購金額分別為35,333仟元、39,703仟元及50,240仟元，佔進貨淨額比重分別為4.58%、3.75%及4.39%，101年度採購金額上升主係該公司為分散對切割刀採購之供應商，而增加對家榮之採購所致；102年度迄今另因部分客戶持續對該公司下單，其該等製程所需之特定切割刀採購需求亦增加所致，經評估其變

化尚屬合理。

⑦台灣波律股份有限公司(以下簡稱台灣波律)

台灣波律成立於72年，為台灣公司，位於台北，主要業務為研發自製、代理進口化學原物料銷售，客戶群涵蓋電子業上中下游及化工業，諸如半導體、觸控面板、發光二極體、太陽能等產業。該公司與台灣波律自97年開始交易，主要向其採購清潔用之乙醇及丙酮。101~103年度對其採購金額分別為35,552仟元、47,557仟元及42,754仟元，佔進貨淨額比重分別為4.60%、4.49%及3.74%，對其採購金額變動主要受客戶需求及製程考量影響，經評估其變化尚屬合理。

⑧台灣安智電子材料股份有限公司(以下簡稱安智)

安智成立於75年，為世界知名的化工電子材料領導廠商AZ Electronic Material (以下簡稱AZ)的成員，103年AZ 經製藥與化學領域之高科技產品領導企業默克集團(Merck, NYSE 掛牌公司，股票代號 MRK) 收購，安智主要產品為正負光阻劑、顯影劑及黏著劑等。該公司與安智自93年開始交易，主要向其採購光阻劑，其常用於蝕刻製程中，利用曝光產生化學反應，進而達到想要的效果。101~103年度對其採購金額分別為15,208仟元、31,777仟元及39,266仟元，佔進貨淨額比重分別為1.97%、3.00%及3.43%，對其採購金額變動主要受客戶需求及製程考量影響，隨著該公司營業規模持續擴大，使用安智提供之光阻液數量增加，遂逐年增加採購金額，於103年度首次進入前十大供應商名單，經評估其變化尚屬合理。

⑨MITSUYA BOEKI LTD. (以下簡稱MITSUYA)

MITSUYA成立於西元1985年（昭和60年），為一日本代理商，位於大阪，主要業務為代理銷售各類化學藥品、醫藥原料、電子材料等產品。該公司與MITSUYA之交易係採購OKUNO Chemical Industries Co., LTD(以下簡稱OKUNO)之鍍金液(鍍金液多與電解光阻劑配合使用，主要功用為讓金沉積在製程所需的線路上)。OKUNO 成立於西元1905年，主要生產金屬表面處理之化學藥劑，98年起OKUNO指定MITSUYA為代理商，故該公司自98年開始與MITSUYA交易。101~103年度對其採購金額分別為37,606仟元、40,806仟元及37,841仟元，佔進貨淨額比重分別為4.87%、3.86%及3.31%，對其採購金額變動主要受客戶需求、製程考量及金價影響，101年度起採購金額下降主係該公司在晶圓封裝製程上有所改良，在化鍍製程中控制其他化學品產生之化學反應，進而降低鍍金液之使用量；103年度除因製程改進之影響外，亦受到金價價格下跌及日幣貶值等影響，致103年度採購金額減少，經評估其變化尚屬合理。

⑩Schott AG(以下簡稱SCHOTT)

SCHOTT為德國知名玻璃製造公司之成員，為一橫跨眾多產業的國際科技集團，主要業務涵蓋應用光學、特殊應用玻璃、太陽能及數位投影等。該公司與SCHOTT自90年開始交易，採購對象包括Schott AG及其子公司Schott Glass Malaysia Components Sdn Bhd，主要向其採購光學薄型玻璃。101~103年度對其採購金額分別為32,877仟元、37,067仟元及38,277仟元，佔進貨淨額比重分別為4.26%、3.50%及3.35%，對其採購金額變動主要受客戶需求及製程考量影響，自102年度起進貨淨額持續增加，經評估其變化尚屬合理。

⑪繼業企業股份有限公司(以下簡稱繼業)

繼業成立於65年，為台灣公司，位於台北，主要業務為電子器材及其零組件成品之買賣、設計、加工、製造及進出口。該公司與繼業自90年開始交易，主要向其採購切割刀。101~103年度對其採購金額分別為29,270仟元、34,226仟元及35,839仟元，佔進貨淨額比重分別為3.79%、3.23%及3.13%，102年度隨著景氣復甦及晶圓級尺寸封裝製程產品需求量增加，致採購金額逐年增加，然佔進貨淨額比重變化不大，經評估其變化尚屬合理。

⑫台灣陶氏化學股份有限公司(以下簡稱台灣陶氏化學)

台灣陶氏化學成立於73年，為美國上市公司陶氏化學(Dow Chemical Company，美國紐約證券交易所掛牌，股票代號：DOW)之成員企業，總部位於美國密西根州，為全球特殊材料產業領域的創新技術與解決方案的領導廠商，該公司技術被廣泛應用於建築塗料和工業塗料、個人護理和家用及工業用化學品。該公司與台灣陶氏化學自97年開始交易，主要向其採購光阻黏著促進劑。101~103年度對其採購金額分別為18,734仟元、35,841仟元及30,193仟元，佔進貨淨額比重分別為2.43%、3.39%及2.64%，對其採購金額變動主要受客戶需求及製程考量影響，於102年度首次進入前十大供應商名單，經評估其變化尚屬合理。

(2)各主要供應商價格及條件變化情形分析

該公司主要進貨項目為光學薄型玻璃、電解光阻劑、切割刀、膠帶及氮氣等晶圓封裝過程中所需之原物料，其中光學薄型玻璃、電解光阻劑、膠帶、切割刀等，係與供應商採年度議價方式採購，與原物料市場行情波動較無直接相關，其餘原物料之進貨價格變動則係隨原物料價格波動、產品規格及採購數量不同所致，整體而言，該公司之進貨價格變化情形應尚屬合理。於進貨交易付款條件部分，該公司與供應商之交易條件大致為月結30天至60天之間，經抽核該公司與供應商間進貨之相關憑證，並未發現與供應商之採購及交易條件之訂定有重大異常之情事。綜上所述，其該

公司進貨價格與付款條件變化情形並未有重大異常之情事。

(3)是否有進貨集中之風險

該公司於 101~103 年度對前十大供應商進貨金額佔年度進貨比例分別為 56.88%、52.14%及 50.23%，除 101 年度向 NEG 採購金額佔總進貨金額 10.21%外，因進貨品項繁多，並無對其他供應商有進貨比重超過 10%之情事。另因該公司採購之主要原物料多有兩家以上可供貨之來源，且與供應商均保持良好之合作關係，供貨來源尚屬穩定。綜上所述，該公司尚無進貨集中而導致供貨短缺或中斷之風險。

(4)公司之進貨政策

該公司進貨政策係依實際或預估之訂單狀況、考量庫存消耗量、生產排程及安全存量後，作為採購之計算標準，以維持適當之採購數量，同時定期每週召開產銷協調會議，使相關單位充分了解公司生產及去化狀況，作為採購部門及時調整之依據，避免因過度採購造成資金積壓或採購不足造成供應間斷之風險。在主要進貨項目上，該公司多能有至少二家以上之供應商，以滿足製程所需並減少進貨中斷或短缺之可能性，此外該公司亦經由定期評鑑供應商供貨品質及交期，以確保生產品質、效率及良率，並且定期觀察市場原料價格之變動，適時與現有之供應商進行議價以降低進貨成本，確保公司採購價格之合理性。觀察該公司最近三年度並未有供貨中斷或短缺之情事發生，經評估其進貨政策尚屬允當。

(二)申請公司最近二年度及申請年度截至最近期止個體及合併財務報告應收款項變動合理性、備抵呆帳提列適足性及收回可能性之評估，並與同業比較評估

1.合併財務報告

該公司最近兩年度及申請年度截至目前為止無須編製合併財務報告，故僅針對個體應收款項進行分析。

2.個體財務報告

(1)最近二年度及申請年度截至最近期止應收款項變動之合理性

單位：新台幣仟元

項目		102 年度	103 年度
營業收入淨額		4,256,761	4,934,078
應收款項 總額	應收票據	-	-
	應收帳款-關係人	516,431	673,527
	應收帳款-非關係人	235,348	266,080
	合計(A)	751,779	939,607
備抵呆帳提列數(B)		-	522
備抵銷貨退回與折讓(C)		50,640(註)	60,155(註)
應收款項淨額(A)-(B)-(C)		701,139	878,930
備抵呆帳提列比率(B)/(A)%		-	0.06
應收款項週轉率(次)		7.28	5.84
應收款項收現日數(天)		50	63
授信條件		考量個別客戶營運規模、財務狀況、信用紀錄及過去往來交易情形，給予不同授信條件，一般收款條件在月結 30~60 天間。	

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告

註：備抵銷貨退回及折讓於102年度起依國際財務報導準則規定重分類為負債準備(帳列流動負債項下)。該公司業務人員每月底依據歷史經驗及估計未來可能發生的金額訂定之，會計人員並據以調整入帳。

該公司 102 年底及 103 年底之應收款項總額分別為 751,779 仟元及 939,607 仟元，103 年底應收款項總額較 102 年底增加 187,828 仟元，增加幅度約為 24.98%，主係因受惠於全球半導體市場在智慧行動裝置的帶動下開始恢復成長態勢，且隨行動裝置產品影像品質需求殷切，以及對個人隱私的保護需求，該公司在持續開發其晶圓級尺寸封裝及晶圓級後護層封裝技術並成功量產下，營收呈成長趨勢，且因 103 年第四季營收較 102 年同期成長，致應收帳款部位亦增加，其變化應屬合理。

而在應收帳款週轉率變動方面，該公司 102 年度及 103 年之應收帳款週轉率分別為 7.28 次及 5.84 次，而週轉天數則分別為 50 天及 63 天。由於 103 年度營收與 102 年度相較成長幅度為 15.91%，而 103 年之平均應收款項淨額為 845,432 仟元 $((939,085+751,779)/2)$ ，與 102 年度之平均應收款項淨額 584,847 仟元 $((751,779+417,915)/2)$ 相較，平均應收款項之成長幅度高達 44.56%，在應收成長幅度高於營收成長幅度下，致該公司之週轉天數略為拉長，惟仍與該公司之授信政策月結 30~60 天約略相當，尚無重大異常。

綜上，該公司最近兩年度應收款項淨額及週轉率之變動，大致上隨

營業收入之增減變化及銷貨淡、旺季影響而變動，應尚屬合理且無重大異常。

(2)備抵呆帳提列之適足性

①備抵呆帳提列政策

該公司考量過去應收票據的期後兌現情形良好，未有跳票情事發生，故原則上該公司並不針對應收票據提列備抵呆帳，惟若特殊情況逾期有無法收回之虞時，則個別認定予以提列備抵呆帳。

該公司就應收帳款於每一資產負債表日評估其減損跡象，當有客觀證據顯示應收帳款之估計未來現金流量受影響時，應認列減損損失；另就未發現個別減損之客觀證據，該公司先將銷售客戶進行信用評鑑，依銷售客戶組織狀況、財務狀況及營運狀況給予評分，依評分結果分為五級，A 為評等分數最高者，依序為 A~E，並綜合考量業務單位對銷售客戶各應收款項收回可能性之評估後，除逾期帳齡超過 90 天以上者提列 100%之備抵呆帳外，逾期帳齡小於 90 天以下者，按其信用評等分別提列 0%~2.0%不等之備抵呆帳，茲將其應收帳款備抵呆帳提列比率列示如下：

評等	逾期天數		
	0	1-90	>90
A	0.00%	0.05%	100%
B	0.05%	0.10%	100%
C	0.10%	0.50%	100%
D	0.20%	1.00%	100%
E	0.40%	2.00%	100%

該公司根據保守穩健原則，已依據該公司訂定之備抵呆帳提列政策，對國內外銷貨客戶之應收帳款進行備抵呆帳提列，經評估其備抵呆帳提列政策尚屬合理，應無重大異常。

②備抵呆帳提列適足性

單位：新台幣仟元

項目	年度	102 年度	103 年
		金額	金額
期初備抵呆帳餘額		3,157	-
本期增加		-	522
本期減少		(3,157)	-
期末備抵呆帳餘額		-	522

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告

該公司 102 年底及 103 年底之備抵呆帳金額分別為 0 仟元及 522 仟元，占各該年底應收款項總額之比率分別為 0.00%及 0.06%，該公司因逾期帳款比率低，致備抵呆帳應提列金額較低，加上該公司每月相關業務人員會針對逾期未收回款項進行瞭解與催收，並依據該公司「應收款項作業辦法」提列相關備抵呆帳，經評估尚無重大異常情形。

而在提列適足性方面而言，該公司自 102 年度起，迄今未有實際發生之壞帳費用，且因其主要銷貨客戶多為長期合作之關係人或國際大廠，應收帳款品質相對穩定，款項收回情形尚無重大疑慮，又因該公司已針對所有應收帳款依其帳齡提列備抵呆帳，並個別認定可能發生壞帳之風險，按月定期評估應收帳款收回情形，對已逾收款期限仍未收款之客戶，亦藉由業務人員密集接觸加強掌握，進行瞭解分析，故該公司備抵呆帳提列適足性應尚屬允當。

(3)應收款項收回可能性之評估

單位：新台幣仟元；%

項目	103 年 12 月 31 日	截至 104 年 2 月 28 日 止之收回情形		截至 104 年 2 月 28 日 止之未收回情形	
		金額	比率(%)	金額	比率(%)
應收票據	-	-	-	-	-
應收帳款	939,607	909,217	96.77	30,390	3.23
合計	939,607	909,217	96.77	30,390	3.23

資料來源：該公司提供。

該公司 103 年底之應收款項總額為 939,607 仟元，截至 104 年 2 月 28 日止已收回 909,217 仟元，未收回金額為 30,390 仟元，主要多為未逾期帳款，整體應收款項收回情形良好。

(4)與同業比較

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 期間		102 年度	103 年度
營業收入淨額	精材	4,256,761	4,934,078
	日月光	219,862,446	256,591,447
	同欣	7,929,440	8,337,547
	菱生	6,047,661	註
應收款項總額	精材	751,779	939,607
	日月光	43,303,693	53,004,955
	同欣	1,036,177	1,095,478
	菱生	1,325,598	註
備抵呆帳	精材	-	522
	日月光	68,120	84,145
	同欣	23,382	28,508
	菱生	4,712	註
應收款項淨額	精材	751,779	939,085
	日月光	43,235,573	52,920,810
	同欣	1,012,795	1,066,970
	菱生	1,320,886	註
備抵呆帳損失占應收款項總額比例(%)	精材	-	-
	日月光	0.16	0.16
	同欣	2.26	2.60
	菱生	0.36	註
應收款項週轉率(次)	精材	7.28	5.84
	日月光	5.45	5.34
	同欣	7.49	8.02
	菱生	4.44	註
應收款項週轉天數(天)	精材	50	63
	日月光	67	68
	同欣	49	46
	菱生	82	註

資料來源：各公司經會計師查核簽證之財務報告。

註：截至評估報告出具日止，尚未公告 103 年度財務報告。

與採樣同業相較，該公司 102 年度及 103 年度之應收款項週轉率僅略遜於同欣，惟優於其他採樣同業，且因其最近二年度並無實際發生呆帳損失，加上應收款項期後收款情形良好，故應收款項品質相對穩定，備抵呆帳提列情形尚屬允當。

二、存貨概況

申請公司最近二年度及申請年度截至最近期止，個體及合併財務報告存貨淨額變動合理性及去化情形、備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列適足性之評估，並與同業比較評估。

(一)合併財務報告

該公司最近二年度及申請年度截至目前為止無須編製合併財務報告，故僅針對個體財務報告存貨進行說明。

(二)個體財務報告

1.申請公司最近二年度及申請年度財務報告存貨總額變化

單位：新台幣仟元

項目/年度	102 年度	103 年度
營業收入	4,256,761	4,934,078
營業成本	3,561,619	3,985,874
原物料	113,502	153,839
在製品	66,897	53,973
製成品	43,995	24,035
存貨總額	224,394	231,847
備抵存貨跌價及呆滯損失	(7,624)	(18,070)
期末存貨淨額	216,770	213,777
存貨週轉率(次)	19.45	18.52
存貨週轉天數(天)	19	20

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告；該公司提供

該公司 102 年底及 103 年底之存貨總額分別為 224,394 仟元及 231,847 仟元，103 年底與 102 年底相較增加幅度為 3.32%，主係因該公司 103 年度延續 102 年下半年度新訂單之需求，出貨狀況穩定，該公司業已積極備料，使得原物料大幅增加 35.54%，然該公司積極去化製成品，以致 103 年底之存貨總額僅微幅增加。整體而言，並無重大不合理。

存貨週轉率方面，受惠於 102 年下半年新訂單需求延續之影響，103 年度營業收入較 102 年度成長 15.91%，營業成本增幅為 11.91%，然因 103 年底之存貨平均水位高於 102 年底，致存貨週轉率由 102 年度之 19.45 次下降至 103 年度之 18.52 次，週轉天數則由 19 天上升至 20 天，整體而言，並無重大不合理。

2.申請公司截至最近期止存貨去化情形

單位：新台幣仟元

項 目	103 年 12 月底 存貨金額	截至 104 年 2 月 28 日存貨去 化情形		104 年 2 月 28 日未去化餘額
		金額	比率	
原 物 料	153,839	93,227	60.60%	60,612
在 製 品	53,973	52,672	97.59%	1,301
製 成 品	24,035	15,981	66.49%	8,054
合 計	231,847	161,880	69.82%	69,967

資料來源：該公司提供

該公司 103 年 12 月 31 日之存貨總額為 231,847 仟元，而截至 104 年 2 月底止該公司已去化之存貨金額為 161,880 仟元，占 103 年底存貨金額之比率為 69.82%，茲就該公司原物料、在製品、製成品之去化情形列示說明如下：

- (1)原物料：該公司 103 年底之原物料存貨金額為 153,839 仟元，截至 104 年 2 月底止之去化金額為 93,227 仟元，去化比率為 60.60%，未去化之原物料中以非生產性原物料(含 Spare parts)比重較高，其非生產性原物料(含 Spare parts)主係供機器定期保養或偶發損壞修繕所儲備且具較不易損壞或生命週期較長之特性，其去化情形尚屬正常。
- (2)在製品：該公司 103 年底之在製品存貨金額為 53,973 仟元，截至 104 年 2 月底止之去化金額為 52,672 仟元，去化比率為 97.59%，去化情形良好。
- (3)製成品：該公司 103 年底之製成品存貨金額為 24,035 仟元，而截至 104 年 2 月底止該公司已去化之存貨金額為 15,981 仟元，占 103 年底存貨金額之比率則為 66.49%，其去化情形尚屬正常。

3.申請公司備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列政策及其適足性

(1)備抵存貨跌價及呆滯損失提列政策合理性

該公司之存貨係採永續盤存制，以取得成本為入帳基礎，存貨成本之計算採加權平均法，存貨跌價損失依據國際會計準則公報第 2 號「存貨」規範，每季依成本與淨變現價值孰低法評估存貨價值，淨變現價值成本較低時，認列存貨跌價損失，另淨變現價值之決定以會計期間結束日為準，若結束日前物價波動巨大，得按當月平均數為準。其中，當原物料之價格下跌而製成品之成本超過淨變現價值時，該原物料宜沖減至淨變現價值。在此情況下，原物料之重置成本可能為其淨變現價值之最佳估計數，重置成本係指目前購入(製造)相同存貨所需之成本。存貨之成本與淨變現價值比較係採個別項目為比較基準。

存貨呆滯損失提列政策部分，該公司依存貨屬性提列不同的呆滯損失，原物料的留滯時間依料號逐項檢視，在製品依產品料號及製程站逐項檢視，而製成品則依產品料號逐項檢視。該公司將其原料細分為生產性、非生產性(不含 Spare Parts)及非生產性(含 Spare parts)係根據與生產是否具有直接性、使用頻率的高低而訂定，生產性原物料主要包括光學薄型玻璃、電解光阻劑等，其使用頻率高，故若未經購入或領用，則在1年以上即提列100%呆滯損失，非生產性原物料(不含 Spare Parts)包含膠帶及切割刀等，因其非直接生產相關及較不易因存放較久而損壞，故1年以上提列50%，而非生產性原物料(含 Spare Parts)係指小型彈簧、加熱帶及滾輪模組等，因其不常採購或領用，且不因存放較久而損壞，故超過1年以上始提列10%，然為求更嚴謹且穩健之備抵存貨呆滯損失提列政策，自103年起，非生產性原物料(不含 Spare Parts)超過2年以上提列100%，非生產性原物料(含 Spare Parts)超過3年以上提列100%。

在製品係由其銷售客戶所自行提供之晶圓來進行封裝，大多數製程中還會切割為晶粒，少部分製程為提供封裝服務後即成為製成品，由於在製品通常須經2~3週生產始轉為製成品，並經相關檢驗且配合客戶出貨時程後即進行後續出貨作業。由於晶圓之所有者為銷售客戶，且該公司進行之加工封裝所投入之成本對整體晶圓價值比重尚非重大，除部分在製品可能因製程中發生良率未達客戶要求而未能完成生產，然發生情形尚非頻繁，可見存貨發生呆滯無法出貨可能性不高，故帳齡在1年以上僅提列50%以上之呆滯損失，然為加強在製品及製成品之管理，該公司自103年起在製品及製成品超過半年以上提列50%，超過一年以上提列100%。

茲將新舊政策揭示如下：

①103年度以前之存貨呆滯損失提列政策：

存 貨	呆滯品備抵率
原物料	生產性原物料：存貨留滯時間超過 A. 半年~1年提50% B. 1年以上提100%
	非生產性原物料(不含 Spare Parts)：存貨留滯時間超過 A. 半年~1年提10% B. 1年以上提50%
	非生產性原物料(Spare Parts)：存貨留滯時間超過1年以上提10%
在製品/製成品	存貨留滯時間超過1年以上提50%

資料來源:該公司提供

②103 年度以後之存貨呆滯損失提列政策：

存 貨	呆滯品備抵率
原物料	生產性原物料：存貨留滯時間超過 A. 半年~ 1 年提 50% B. 1 年以上提 100%
	非生產性原物料(不含 Spare Parts)：存貨留滯時間超過 A. 半年~ 1 年提 10% B. 1 年~ 2 年提 50% C. 2 年以上提 100%
	非生產性原物料(Spare Parts)：存貨留滯時間超過 A. 1 年~ 2 年提 10% B. 2 年~ 3 年提 50% C. 3 年以上提 100%
在製品/製成品	存貨留滯時間超過 A. 半年~ 1 年提 50% B. 1 年以上提 100%

資料來源：該公司提供

(2)存貨備抵跌價及呆滯損失提列之適足性

單位：新台幣仟元

項 目	102 年度	103 年度
備抵存貨跌價及呆滯損失(A)	7,624	18,070
存貨總額(B)	224,394	231,847
提列比率 (A)/(B)	3.40%	7.79%

資料來源：該公司提供

該公司 102 年底及 103 年底之備抵存貨跌價與呆滯損失，業已按該公司之提列政策予以提列，金額分別為 7,624 仟元及 18,070 仟元，占各該年度期末存貨總額之比率分別為 3.40%及 7.79%。103 年度提列比率增加 4.39%，主要係部分客戶因市場銷售表現不佳而放緩拉貨速度，使得製成品 183 天~365 天間之庫齡比重較高，且該公司制訂更為嚴謹之存貨跌價損失及備抵存貨呆滯損失提列政策，致備抵存貨跌價損失提列比率升至 7.79%，備抵存貨跌價損失金額亦較 102 年度增加 10,446 仟元，然該公司業依存貨管理政策提列備抵存貨跌價或呆滯損失，且因新政策較為嚴謹，較能有效評估精材應提列之備抵存貨跌價及呆滯損失，經評估係屬合理。此外，該公司定期檢視是否有存貨損壞或無法使用而需報廢者，係依該公司之報廢作業程序處理，102 年度及 103 年度之原料報廢損失分別為 3,331 仟元及 290 仟元，另在製品因生產損壞而報廢，金額分別為 12,118 仟元及 13,688 仟元。綜上所述，該公司係根據過去之營運經驗，並參酌以往年度存貨的去化狀況，暨實際發生存貨呆滯及跌價損失之情形擬訂備抵提列政策，其 102 年底及 103 年度之存貨跌價及呆滯損失均依其政策提列，應足以涵蓋可能過時存貨之呆滯風險。

4.與同業比較

單位：新台幣仟元

年度 項目		102 年度	103 年度
存貨週轉率 (次)	精材	19.45	18.52
	日月光	11.26	11.14
	同欣	6.94	6.63
	菱生	13.59	(註 2)-
存貨週轉天數 (天)	精材	19	20
	日月光	32	33
	同欣	53	55
	菱生	27	
備抵存貨跌價 及呆滯損失 (A)	精材	7,624	18,070
	日月光	(註 1)-	(註 2)-
	同欣	(註 1)-	(註 1)-
	菱生	(註 1)-	(註 2)-
存貨總額(B)	精材	224,394	231,847
	日月光	(註 1)-	(註 2)-
	同欣	(註 1)-	(註 1)-
	菱生	(註 1)-	(註 2)-
提列比率(A / (B)	精材	3.40%	7.79%
	日月光	(註 1)-	(註 2)-
	同欣	(註 1)-	(註 1)-
	菱生	(註 1)-	(註 2)-

資料來源：各公司經會計師查核簽證之財務報告。

註 1：因 102 年度起財務報表改採用 IFRS 編制，同業財務報告未揭露備抵存貨跌價及呆滯損失之金額，故未能予以計算其提列比率並與同業相互比較。

註 2：截至評估報告出具日止，尚未公告 103 年度財務報告。

該公司 102 年度及 103 年度之存貨週轉率則分別為 19.45 次及 18.52 次，存貨週轉天數則分別為 19 天及 20 天，經與採樣同業相較，其存貨週轉率及週轉天數均優於採樣同業，可見其存貨管理良好，尚無重大異常情事。

三、申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止之業績概況

(一)最近三年度及申請年度截至最近期止之營業收入、營業毛利及營業利益與同業比較之情形

單位：新台幣仟元

分析項目	年度	101 年度		102 年度		103 年度	
	公司名稱	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	精材	3,139,385	100.00	4,256,761	100.00	4,934,078	100.00
	日月光	193,972,392	100.00	219,862,446	100.00	256,591,447	100.00
	同欣	6,984,993	100.00	7,929,440	100.00	8,337,547	100.00
	菱生	6,352,558	100.00	6,047,661	100.00	註	註
營業毛利	精材	249,852	7.96	695,142	16.33	948,204	19.22
	日月光	36,619,812	18.88	42,813,744	19.47	53,539,756	20.87
	同欣	2,154,222	30.84	2,477,098	31.24	2,488,995	29.85
	菱生	915,642	14.41	897,033	14.83	註	註
營業利益	精材	(96,240)	(3.07)	380,636	8.94	675,630	13.69
	日月光	17,761,382	9.16	22,044,323	10.03	29,571,257	11.52
	同欣	1,469,085	21.03	1,774,716	22.38	1,714,851	20.57
	菱生	423,338	6.66	373,067	6.17	註	註

資料來源：各公司經會計師查核簽證之財務報告。

註：截至評估報告出具日止，尚未公告 103 年度財務報告。

該公司為專業晶圓級 IC 封裝之領導廠商，主要服務包括晶圓級尺寸封裝服務與晶圓級後護層封裝服務，晶圓級尺寸封裝主要應用於影像感測器及環境感測器等光學感測元件，晶圓級後護層封裝服務主要應用於功率分離式元件、微機電系統感測器元件、指物辨識感測器元件和整合式被動元件等。綜觀目前國內上市櫃及興櫃公司，封裝技術及產品組合並無與該公司完全相同者，故以同為半導體封裝及測試產業及部分產品應用端相同作為取樣之依據：上市公司日月光主要係從事各型積體電路之製造、組合、加工、測試及外銷，亦有封裝影像感測器模組及生物辨識感測器模組與該公司產品應用端相同；上市公司同欣主要係從事高頻無線通訊模組、混合積體電路模組、陶瓷電路板及影像產品等電子產品生產及銷售，亦有影像感測器封裝與該公司產品應用端相同；上市公司菱生主要係從事各積體電路及各種半導體零組件之封裝加工、測試、製造及買賣，亦有用於手機或行動裝置之環境光學感測器模組封裝測試與該公司產品應用端相同。茲就該公司最近三年度之營業收入、營業毛利及營業利益與同業之比較分析如下：

1.營業收入

該公司 101~103 年度之營業收入分別為 3,139,385 仟元、4,256,761 仟元及 4,934,078 仟元，營業收入呈逐年成長趨勢，主係因 102 年度全球經濟景氣逐漸復甦，受惠於智慧行動裝置需求增加，帶動整體半導體產業成長，該公

司業績跟著上揚，且因應行動裝置對於個人隱私的保護需求，指紋辨識感測器之市場需求大幅增加，該公司於 102 年下半年成功導入該項封裝產品並進入量產，致 102 年度及 103 年度之營收與獲利均有顯著之貢獻。與採樣同業相較，由於封裝產業為高度客製化之產業，又各採樣公司封裝服務內容及營運規模互異，故營收成長趨勢不盡相同。日月光及同欣受惠於市場對影像感測器之需求大幅增加，營收皆呈成長趨勢，而菱生因 MEMS 元件市場成長趨緩，以及面對第一季為傳統淡季之影響，其營收呈衰退趨勢，該公司則受惠於指紋辨識感測器封裝產品的挹注，其營收成長率均優於採樣同業，變化原因尚屬合理。

2.營業毛利

該公司 101~103 年度之營業毛利分別為 249,852 仟元、695,142 仟元及 948,204 仟元；營業毛利率則分別為 7.96%、16.33%及 19.22%，由於封裝服務產業為資本密集之產業，其相關設備之折舊費用通常佔營業成本較高比重，而該公司 101 年度因銷量較少，導致產能利用率(即實際產量/建置之產能)偏低，以致毛利率較低；102 年度該公司因新訂單挹注，產能利用率增加，致整體毛利率大幅提升；103 年度延續訂單熱度，毛利率亦呈成長趨勢。與採樣同業相較，該公司雖 101 年度之毛利率遜於採樣同業，惟隨營收增加及新產品之挹注及產能利用率提升，毛利率逐年改善且介於或優於採樣同業，變化原因尚屬合理。

3.營業利益

該公司 101~103 年度之營業利益(損失)分別為(96,240)仟元、380,636 仟元 675,630 仟元，營業利益(損失)率則分別為(3.07)%、8.94%及 13.69%。該公司營業利益及營業利益率大致隨營業收入及毛利之變化而同步增減，雖其 101 年度營業利益率遜於採樣同業，惟自 102 年起其營業利益率已獲改善，且介於或優於採樣同業，變化原因尚屬合理。

(二)最近三年度及申請年度截至最近期止以「部門別」或「主要產品別」之營業收入、營業成本及營業毛利之變化情形是否合理

1.最近三年度及申請年度截至最近期止營業收入變動表

單位：新台幣仟元

年度 產品別	101年度		102年度		103年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
晶圓級尺寸封裝	2,863,412	91.21	3,308,413	77.72	3,028,799	61.39
晶圓級後護層封裝	248,757	7.92	920,633	21.63	1,879,970	38.10
其他	27,216	0.87	27,715	0.65	25,309	0.51
合 計	3,139,385	100.00	4,256,761	100.00	4,934,078	100.00

資料來源：該公司提供

2.最近三年度及申請年度截至最近期止營業成本變動表

單位：新台幣仟元

產 品 別 \ 年 度	101年度		102年度		103年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
晶圓級尺寸封裝	2,682,666	92.84	2,806,314	78.79	2,804,237	70.35
晶圓級後護層封裝	170,368	5.90	696,557	19.56	1,167,071	29.28
其他	36,499	1.26	58,748	1.65	14,566	0.37
合 計	2,889,533	100.00	3,561,619	100.00	3,985,874	100.00

資料來源：該公司提供

3.最近三年度及申請年度截至最近期止營業毛利變動表

單位：新台幣仟元

產 品 別 \ 年 度	101年度		102年度		103年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
晶圓級尺寸封裝	180,746	72.34	502,099	72.23	224,562	23.68
晶圓級後護層封裝	78,389	31.37	224,076	32.23	712,899	75.19
其他	(9,283)	(3.71)	(31,033)	(4.46)	10,743	1.13
合 計	249,852	100.00	695,142	100.00	948,204	100.00

資料來源：該公司提供

4.最近三年度主要產品別營業收入、營業成本及營業毛利變化情形說明

(1)晶圓級尺寸封裝

在營業收入方面，該公司最近三年度晶圓級尺寸封裝之營業收入分別為2,863,412仟元、3,308,413仟元及3,028,799仟元，占各年度營業收入淨額之比例則分別為91.21%、77.72%及61.39%，為占該公司營業收入最大宗之品項，終端產品主要應用於智慧型行動裝置，如智慧型手機筆記型電腦、平板電腦等之影像感測器及環境感測器，該項產品銷售金額之增減主要視終端產品出貨情況而定。101年受歐債及美國受財政赤字危機等影響，全球經濟景氣不若以往，使得消費者對智慧行動裝置等需求較保守，致全球半導體產業101年度呈現衰退趨勢，故在終端電子消費市場需求下降下，該公司晶圓級尺寸封裝之訂單量減少。102年起全球景氣逐漸復甦，受惠於智慧行動裝置需求增加，以及主要客戶積極拓展中國市場而對該公司之需求大幅提升，導致102年度該公司晶圓級尺寸封裝營業收入較101年度大幅增加，成長幅度達15.54%，然其占整體營業收入淨額之比重則因晶圓級後護層封裝業務成長而呈下降趨勢。103年在晶圓級後護層封裝業務持續成長下，其占整體營業收入淨額之比重則下滑至61.39%。整體而言，最近三年度晶圓級尺寸封裝服務之營業收入之變動，尚屬合理。

在營業成本方面，101~103年度晶圓級尺寸封裝之營業成本分別為2,682,666仟元、2,806,314仟元及2,804,237仟元；營業毛利及毛利率則分別為180,746仟元、502,099仟元、224,562仟元及6.31%、15.18%、7.41%。101年度隨客戶訂單量減少，該公司相關營業成本亦較低，且因

受產能利用率下降之影響，造成該公司 101 年度之毛利率較低；102 年度因該公司接單狀況良好，致營業成本微幅成長，然因產能利用率提升，致毛利率均大幅回升；103 年度受訂單量略為減少，致產能利用率下滑，又因新佈建 12 吋晶圓封裝生產線而認列相關建置成本，致毛利率下滑至 7.41%。整體而言，最近三年度晶圓級尺寸封裝服務之營業成本及毛利率之變動，尚屬合理。

(2)晶圓級後護層封裝

在營業收入方面，該公司最近三年度晶圓級後護層服務營收金額分別為 248,757 仟元、920,633 仟元及 1,879,970 仟元，占各年度銷貨收入淨額之比例則分別為 7.92%、21.63%及 38.10%，呈逐年大幅成長趨勢，主係因該公司 102 年接獲新產品指紋辨識器訂單大幅挹注營收，且 103 年市場需求持續暢旺所致。整體而言，最近三年度晶圓級後護層封裝之營業收入之變動，尚屬合理。

在營業成本方面，101~103 年度晶圓級後護層封裝服務之營業成本分別為 170,368 仟元、696,557 仟元及 1,167,071 仟元；營業毛利及毛利率則分別為 78,389 仟元、224,076 仟元、712,899 仟元及 31.51%、24.34%、37.92%，101 年度起因客戶需求及產品組合改變，致整體毛利率大幅提升；102 年則因新增之指紋辨識器製程較複雜，且量產初期試產及相關營業成本較高，其毛利率相對較低，致晶圓級後護層封裝服務之整體毛利率較 101 年微幅下滑；103 年因指紋辨識器製程逐漸成熟良率提升，且訂單暢旺，故毛利率大幅度提升。整體而言，最近三年度晶圓級後護層封裝之營業成本及毛利率之變動，尚屬合理。

(3)其他

該公司最近三年度其他類產品之營業收入分別為 27,216 仟元、27,715 仟元及 25,309 仟元，占各年度營業收入淨額之比例則分別為 0.87%、0.65%及 0.51%，主係設計收入及因應客戶或供應商研發需求，出售少量原物料之收入，然因佔營收比率均低，尚無發現重大異常情事。

在營業成本方面，101~103 年度其他類產品之營業成本分別為 36,499 仟元、58,748 仟元及 14,566 仟元；營業毛利(損)及毛利(損)率則分別為 (9,283) 仟元、(31,033) 仟元、10,743 仟元及 (34.11%)、(111.97%)、42.45%，101~102 年度營業毛損主係因屬其他項之營業成本中，除上述設計服務及出售原物料之成本外，該公司尚將新廠之廠務成本列入此項(103 年度因已開始佈建 12 吋晶圓級尺寸封裝生產線，故改列入晶圓級尺寸封裝項下)，故造成營業毛損，且因其他項收入金額較低，容易造成毛利(損)率計算出之數值變動劇烈。綜上所述，尚無重大異常之情事。

(三)最近三年度及申請年度截至最近期止營業收入或毛利率變動達 20%以上者，應做價量分析變動原因，並敘明是否合理

1.該公司最近三年度及申請年度截至最近期營業收入及毛利率變動情形

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	101 年度	102 年度		103 年度	
	金額	金額	變動比率(%)	金額	變動比率(%)
營業收入淨額	3,139,385	4,256,761	35.59	4,934,078	15.91
毛利率(%)	7.96	16.33	105.15	19.22	17.70

資料來源：該公司各年度經會計師查核簽證之財務報告

由上表得知，該公司僅101及102年度之毛利率變動均較前年度變動達20%以上，茲將101及102年度之主要產品別之價量變動分析說明如下：

單位：新台幣仟元

主要產品	分析項目	101、102 年度
晶圓級尺寸封裝	(一) 營業收入差異分析：	
	$P(Q' - Q)$	837,738
	$Q(P' - P)$	(303,843)
	$(P' - P)(Q' - Q)$	(88,894)
	$P'Q' - PQ$	445,001
	(二) 營業成本差異分析：	
	$P(Q' - Q)$	784,858
	$Q(P' - P)$	(511,549)
	$(P' - P)(Q' - Q)$	(149,662)
	$P'Q' - PQ$	123,647
	(三) 毛利變動金額：	321,354
晶圓級後護層封裝	(一) 營業收入差異分析：	
	$P(Q' - Q)$	261,561
	$Q(P' - P)$	200,010
	$(P' - P)(Q' - Q)$	210,305
	$P'Q' - PQ$	671,876
	(二) 營業成本差異分析：	
	$P(Q' - Q)$	179,137
	$Q(P' - P)$	169,172
	$(P' - P)(Q' - Q)$	177,880
	$P'Q' - PQ$	526,189
	(三) 毛利變動金額：	145,687

資料來源：該公司提供

註 1：P'及 Q'為最近年度單價及數量；P 及 Q 為上一年度單價及數量

(1)101~102 年度主要產品價量分析

①晶圓級尺寸封裝

A.營業收入增加445,001仟元

(A)數量有利差異為837,738仟元，102年起受惠於全球智慧行動裝置需求增加，該公司業績跟著上揚，致產生數量有利差異。

(B)價格不利差異為303,843仟元，因影像感測器畫素提高需藉由感測

器元件尺寸放大，致每片晶圓產生之晶粒減少(每晶粒的封裝成本增加)，該公司為維持此類服務之市場競爭力，故在晶圓級封裝之售價有所調降等因素，造成價格不利差異。

(C)組合不利差異為88,894仟元，主係102年度雖銷售數量增加，但因平均單位售價降低而產生組合不利差異。

B.營業成本增加123,647仟元

(A)數量不利差異為784,858仟元，主係102年度銷貨數量成長，致營業成本產生數量不利差異。

(B)價格有利差異為511,549仟元，主係因部份主要原物料價格下降，故平均成本較去年同期下滑，致產生價格有利差異。

(C)組合不利差異為149,662仟元，主係102年度銷售數量增加而平均單位成本降低所致。

綜上，該公司102年度晶圓級尺寸封裝之營業毛利較101年度增加321,354仟元。

②晶圓級後護層封裝

A.營業收入增加671,876仟元

(A)數量有利差異為261,561仟元，主係自102年下半年起新增生物辨識器封裝服務訂單，致產生數量有利差異。

(B)價格有利差異為200,010仟元，主係因該公司新增之製程服務報價較高，致產生價格有利差異。

(C)組合有利差異為210,305仟元，由於銷售數量與銷售單價均增加，致產生組合有利差異。

B.營業成本增加526,189仟元

(A)數量不利差異為179,137仟元，主係102年度銷售數量上升，致銷貨成本增加產生數量不利差異。

(B)價格不利差異為169,172仟元，主係該公司為因應客戶訂單需求，而使用部份較高單價之原物料進貨量增加，故平均成本較去年同期為高，致產生價格不利差異。

(C)組合不利差異為177,880仟元，主係因銷售數量與平均銷貨成本均增加，致產生組合不利差異。

綜上，該公司102年度晶圓級後護層封裝之營業毛利因營收增幅大於成本增幅，而較101年度增加145,687仟元。

四、併購他公司尚未屆滿一完整會計年度者，評估購併之目的、效益、交易合理性等因素

該公司最近一會計年度及申請年度並無併購他公司之情形，故不適用本項評估。

陸、財務狀況

- 一、申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止財務比率之分析，與同類別上櫃、上市公司及未上櫃、未上市同業財務比率之比較分析—應包括財務結構、償債能力、經營能力、獲利能力與現金流量

(一)選擇採樣公司之理由

該公司為專業晶圓級 IC 封裝之領導廠商，主要服務包括晶圓級尺寸封裝服務與晶圓級後護層封裝服務，晶圓級尺寸封裝主要應用於 CMOS 影像感測器及環境感測器等光學感測元件，晶圓級後護層封裝服務主要應用於功率分離式元件、微機電系統感測器元件、指紋辨識感測器元件和整合式被動元件等。綜觀目前國內上市櫃及興櫃公司，封裝技術及產品組合並無與該公司完全相同者，故以同為半導體封裝及測試產業及部分產品應用端相同作為取樣之依據：上市公司日月光主要係從事各型積體電路之製造、組合、加工、測試及外銷，亦有封裝 CMOS 影像感測器模組及指紋辨識感測器模組與該公司產品應用端相同；上市公司同欣主要係從事高頻無線通訊模組、混合積體電路模組、陶瓷電路板及影像產品等電子產品生產及銷售，亦有影像感測器封裝與該公司產品應用端相同；上市公司菱生主要係從事各積體電路及各種半導體零組件之封裝加工、測試、製造及買賣，亦有用於手機或行動裝置之環境光學感測器模組封裝測試與該公司產品應用端相同。在綜合考量比較上述公司之產品營收比重、業務內容、實收資本額及資產規模等，選取日月光(2311)、同欣(6271)及菱生(2369)為採樣同業，並參酌財團法人金融聯合徵信中心編印之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」中之「半導體封裝及測試業」及「半導體製造業」為該公司同業之比較依據。

(二)該公司與同類別上櫃、上市公司及未上櫃、未上市同業之財務比率

分析項目		年度 公司	101 年度	102 年度	103 年度
財務 結構	負債佔資產比率(%)	精 材	36.40	50.79	47.27
		日 月 光	55.21	55.66	52.56
		同 欣	15.89	19.89	35.69
		菱 生	24.14	24.88	註 4
		同 業	38.13	38.20-	註 1
	長期資金佔不動產、廠 房及設備比率(%)	精 材	117.30	100.45	107.21
		日 月 光	128.18	141.43	146.96
		同 欣	187.04	200.69	237.15
		菱 生	164.08	141.32	註 4
		同 業	201.61	168.92-	註 1
償債 能力	流動比率(%)	精 材	175.00	95.78	115.61
		日 月 光	115.15	131.08	143.85
		同 欣	408.31	360.41	575.91
		菱 生	232.97	190.97	註 4
		同 業	118.30	174.80	註 1

分析項目		年度 公司	101 年度	102 年度	103 年度
償債能力	速動比率(%)	精 材	147.64	83.34	99.33
		日 月 光	73.86	93.47	101.06
		同 欣	353.23	314.91	524.38
		菱 生	197.97	154.79	註 4
		同 業	101.50	127.20	註 1
	利息保障倍數(倍)	精 材	(4.75)	13.39	20.43
		日 月 光	9.27	9.58	13.25
		同 欣	224.84	141.16	48.74
		菱 生	32.45	52.48	註 4
		同 業	2,452.80	489.30	註 1
經營能力	應收款項週轉率(次)	精 材	7.05	7.28	5.84
		日 月 光	5.70	5.45	5.34
		同 欣	7.53	7.49	8.02
		菱 生	4.72	4.44	註 4
		同 業	5.80	4.00	註 1
	存貨週轉率(次)	精 材	19.17	19.45	18.52
		日 月 光	10.82	11.26	11.14
		同 欣	7.29	6.94	6.63
		菱 生	13.08	13.59	註 4
		同 業	14.60	8.10	註 1
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	精 材	0.67	0.81	0.78
		日 月 光	1.62	1.70	1.81
		同 欣	1.62	1.66	1.72
		菱 生	1.55	1.32	註 4
		同 業	1.30	1.90	註 1
	總資產週轉率(次)	精 材	0.50	0.59	0.57
		日 月 光	0.82	0.82	0.83
		同 欣	0.67	0.67	0.61
		菱 生	0.75	0.70	註 4
		同 業	0.50	0.80	註 1
獲利能力	權益報酬率(%)	精 材	(2.32)	7.27	14.34
		日 月 光	12.76	13.57	16.96
		同 欣	15.73	17.35	15.46
		菱 生	6.09	5.43	註 4
		同 業	10.20	(0.50)	註 1
	營業利益佔實收資本額比率(%)	精 材	(4.07)	16.10	28.37
		日 月 光	23.26	28.20	37.57
		同 欣	90.18	109.14	105.27
		菱 生	11.14	9.81	註 4
		同 業	註 2	註 2	註 1

分析項目		年度 公司	101 年度	102 年度	103 年度
獲利能力	稅前純益佔實收資本額比率(%)	精 材	(4.56)	14.75	27.71
		日 月 光	21.81	24.76	36.17
		同 欣	90.95	114.42	110.49
		菱 生	12.05	11.19	註 4
		同 業	註 2	註 2	註 1
	純益率(%)	精 材	(2.87)	6.79	12.74
		日 月 光	6.97	7.35	36.17
		同 欣	18.80	19.97	18.12
		菱 生	6.04	5.81	註 4
		同 業	12.30	(0.30)	註 1
	每股稅後盈餘(元)	精 材	(0.38)	1.22	2.65
		日 月 光	1.75	2.09	3.07
		同 欣	8.09	9.72	9.27
		菱 生	1.01	0.97	註 4
		同 業	註 2	註 2	註 1
現金流量	現金流量比率(%)	精 材	80.22	88.09	67.99
		日 月 光	39.02	40.95	41.25
		同 欣	140.42	150.94	103.00
		菱 生	78.43	95.05	註 4
		同 業	72.80	21.40	註 1
	現金流量允當比率(%)	精 材	96.53	85.96	79.63
		日 月 光	85.05	84.88	84.73
		同 欣	註 3	註 3	註 3
		菱 生	120.56	126.31	註 4
		同 業	註 2	註 2	註 1
	現金再投資比率(%)	精 材	6.65	18.09	8.05
		日 月 光	9.27	9.56	8.80
		同 欣	11.25	15.95	4.25
		菱 生	8.13	9.96	註 4
		同 業	15.60	10.40	註 1

資料來源：1.各公司經會計師查核簽證之合併財務報告。

2.同業之財務比率資料係取自「財團法人金融聯合徵信中心」出版之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」，行業類別為「半導體封裝及測試業」，統計數採綜合算術平均數。

註 1：截至評估報告日止，103 年度「中華民國台灣地區主要行業財務比率」尚未出版。

註 2：「中華民國台灣地區主要行業財務比率」未提供同業平均之營業利益佔實收資本額比率、稅前利益佔實收資本額比率、每股稅後盈餘及現金流量允當比率。

註 3：同業年報未提供相關資訊，故不予以計算。

註 4：截至評估報告日止，採樣同業尚未出具 103 年年報，故不予以計算。

財務分析計算公式：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額

(2)ROC GAAP 長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債）／固定資產淨額

IFRS 長期資金占不動產、廠房及設備比率 = (股東權益 + 非流動負債) / 不動產、廠房及設備淨額

2. 償債能力

(1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債

(2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債

(3) 利息保障倍數 = 稅前息前純益 / 本期利息支出

3. 經營能力

(1) 應收款項(含應收票據)週轉率 = 銷貨淨額 / 平均應收帳款(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)總額

(2) 應收款項收現天數 = 365 / 應收款項(含應收票據)週轉率

(3) 存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨總額

(4) 平均售貨天數 = 365 / 存貨週轉率

(5) ROC GAAP 固定資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均固定資產淨額

IFRS 不動產、廠房及設備週轉率 = 銷貨淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額

(6) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均資產總額

4. 獲利能力

(1) 權益報酬率 = 稅後損益 / 平均權益總額

(2) 營業利益佔實收資本額比率 = 營業利益 / 實收資本額

(3) 稅前純益佔實收資本額比率 = 稅前純益 / 實收資本額

(4) 純益率 = 稅後純益 / 營業收入淨額

(5) ROC GAAP 每股盈餘 = (稅後淨利 - 特別股股利) / 追溯後加權平均已發行普通股股數

IFRS 每股盈餘 = (歸屬於母公司業主之損益 - 特別股股利) / 加權平均已發行股數

5. 現金流量

(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債

(2) 淨現金流量允當比率 = 最近 5 年度營業活動淨現金流量 / 最近 5 年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)

(3) ROC GAAP 現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 營運資金)

IFRS 現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (不動產、廠房及設備毛額 + 長期投資 + 其它非流動資產 + 營運資金)

(三) 最近三年度及申請年度財務比率與同業比較分析說明

1. 財務結構

(1) 負債佔資產比率

該公司 101~103 年度負債占資產比率分別為 36.40%、50.79%及 47.27%，102 年度為因應指紋辨識感測器封裝訂單之需求，增加長期借款以支應購置相關設備之資本支出，致應付設備款及長期借款大幅增加，另因收取終端客戶補償未來訂單風險之產能保證金(帳列存入保證金)，致 102 年底之負債較 101 年底之成長幅度高於資產成長幅度，造成負債比率由 101 年度之 36.40% 上升至 50.79%；103 年度雖該公司於 6 月底已返還全數產能保證金，惟因建置 12 吋影像感測器生產線，增加銀行借款以支應購置相關設備之資本支出，致負債比率僅較 102 年度微幅下降。與採樣公司及同業相較，該公司 101~103 年度之負債佔資產比率均介於採樣公司及同業之間，尚無重大異常之情事。

(2)長期資金佔固定資產比率/長期資金佔不動產、廠房及設備比率

該公司 101~103 年度之長期資金占不動產、廠房及設備比率分別為 117.30%、100.45%及 107.21%，102 年度為因應指紋辨識感測器封裝訂單而購置機器設備，致該公司之不動產、廠房及設備淨額較 101 年度增加，幅度高達 35.32%，以致長期資金佔不動產、廠房及設備比率下降至 100.45%；103 年度因營運所需增加銀行長期借款，使非流動負債較 102 年度增加 24.52%，致長期資金佔不動產、廠房及設備比率上升至 107.21%。與採樣公司及同業相較，該公司 101~103 年度之長期資金占不動產、廠房及設備比率均低於採樣公司及同業，惟該公司最近三年度長期資金占不動產、廠房及設備比率皆大於 100%，尚無以短期資金支應定不動產、廠房及設備支出之情事，顯示該公司整體財務結構尚屬健全。

2.償債能力

(1)流動比率及速動比率

該公司 101~103 年度之流動比率分別為 175.00%、95.78%及 115.61%，速動比率分別為 147.64%、83.34%及 99.33%。102 年度因下半年度接獲指紋辨識感測器訂單及出租設備租金之挹注，又因收取終端客戶補償未來訂單風險之產能保證金(帳列存入保證金)，致現金部位、應收部位及存貨水位均較 101 年底成長，惟為因應指紋辨識感測器封裝訂單，而購置大批機器設備，並透過自有資金及長期借款等款項依設備付款進度支付，致流動資產及速動資產成長幅度，未若流動負債高，致流動比率及速動比率較 101 年度下降；103 年度指紋辨識感測器訂單出貨暢旺，雖持續挹注現金水位，惟因指紋辨識感測器市場接受度良好，經與終端客戶協議後已於 6 月返還產能保證金，又因建置 12 吋影像感測器生產線及購置相關設備，該公司增加長期借款，並透過自有資金及長期借款等款項依設備付款進度支付，在流動資產及速動資產變動幅度不大，惟流動負債較 102 年底低之情況下，致流動比率及速動比率較 102 年度上升。與採樣公司及同業相較，101 年度之流動比率及速動比率均介於採樣公司及同業之間；102 年度及 103 年度之流動比率及速動比率均低於採樣公司及同業。

(2)利息保障倍數

該公司 101~103 年度之利息保障倍數分別為 (4.75)倍、13.39 倍及 20.43 倍。102 年度及 103 年度因指紋辨識感測器封裝業務之挹注，帶動該公司之獲利，致利息保障倍數因而上升。與採樣公司及同業相較，雖 101 年遜於採樣公司及同業，惟 102 年度起已介於採樣公司及同業之間

綜上分析，該公司之流動比率、速動比率及利息保障倍數均大致介於採樣公司及同業之間，故其償債能力尚屬合理。

3.經營能力

(1)應收款項週轉率

該公司 101~103 年度應收款項週轉率分別為 7.05 次、7.28 次及 5.84 次，應收款項收現天數則分別為 52 天、50 天及 63 天。102 年度因指紋辨識感測器封裝業務之挹注使營收成長，而該公司收款政策一向良好，故應收款週轉率與 101 年度相較變化不大；103 年度因營收持續成長，使期末應收款項增加，應收款項週轉天數因而增加至 63 天，惟仍與該公司之授信政策月結 30~60 天相當，尚無重大異常。與採樣公司及同業相較，101~103 年度皆介於採樣公司及同業之間。

(2)存貨週轉率

該公司 101~103 年度之存貨週轉率分別為 19.17 次、19.45 次及 18.52 次，平均售貨天數則分別為 19 天、19 天及 20 天。102 年度指紋辨識感測器封裝業務之挹注，營收大幅成長，在市場反應良好且對未來出貨狀態保持樂觀下，該公司持續增加庫存水位，故存貨週轉率與 101 年度相較變化不大；103 年度因營收持續成長，該公司持續增加庫存水位，使期末存貨增加，存貨週轉率天數因而增加至 20 天。與採樣公司及同業相較，101~103 年度皆優於採樣公司及同業。

(3)不動產、廠房及設備週轉率

該公司 101~103 年度之不動產、廠房及設備週轉率分別為 0.67 次、0.81 次及 0.78 次，102 年度及 103 年度因影像感測器及指紋辨識感測器封裝需求增加，帶動營收成長動能，致固定資產週轉率呈成長趨勢。然近年該公司之資本支出持續增加，尤其新廠佈建中之 12 吋封裝生產線尚未產生營收，以及出租台積電之資產亦未能反映在營業收入上(認列於其他營業收益及費損項下)，致本項指標較遜於採樣公司及同業。若排除上述兩項資本支出的話，週轉率將成為 1.43 次且介於同業之間。

(4)總資產週轉率

該公司 101~103 年度之總資產週轉率分別為 0.50 次、0.59 次及 0.57 次，102 年度及 103 年度因影像感測器及指紋辨識感測器封裝需求增加，帶動營收成長動能，惟因仍持續增加資本支出，致整體總資產週轉率於 102 年度與 103 年度變化不大。與採樣公司及同業相較，該公司 101 年度之總資產週轉率均介於採樣公司及同業之間，102 年度及 103 年度低於採樣公司及同業。

綜上分析，該公司 101~103 年度經營能力各項指標之變化，尚無重大異常之情形。

4.獲利能力

該公司 101~103 年度權益報酬率則分別為(2.32)%、7.27%及 14.34%，營業利益占實收資本額之比率分別為(4.07)%、16.10%及 28.37%，稅前利益占實收資本額之比率分別為(4.56)%、14.75%及 27.71%，純益率分別為(2.87)%、6.79%及 12.74%，每股盈餘則分別為(0.38)元、1.22 元及 2.65 元。101 年度因半導體市場需求趨緩，銷貨客戶對備貨態度相對謹慎，營收規模減少，致該公司轉為虧損，各項指標呈負值；102 年度因影像感測器及指紋辨識感測器封裝需求增加，帶動營收成長動能，致權益報酬率、營業利益占實收資本額之比率、稅前利益占實收資本額之比率、純益率及每股盈餘均較 101 年度上升；103 年度因訂單熱度不減，致前述各項指標與 102 年度相較呈大幅成長趨勢。與採樣同業相較，該公司 101 年度之權益報酬率、營業利益占實收資本額之比率、稅前利益占實收資本額之比率、純益率及每股盈餘遜於採樣同業，102 年度及 103 年度多已介於採樣同業之間。

綜上分析，該公司 101~103 年度獲利能力各項指標之變化，尚無重大異常之情形。

5.現金流量

(1)現金流量比率

該公司 101~103 年度之營業活動之淨現金流入分別為 647,758 仟元、2,034,265 仟元及 1,196,897 仟元。101~103 年度之現金流量比率分別為 80.22%、88.09%及 67.99%。102 年度因影像感測器及指紋辨識感測器封裝需求增加，帶動營收成長動能，又因收取產能保證金，使營業活動之淨現金流入較 101 年度增加，致現金流量比率較 101 年度上升至 88.09%。103 年度因指紋辨識感測器市場接受度良好，經與終端客戶協議後已於 6 月返還產能保證金，使營業活動之淨現金流入較 102 年度減少，致現金流量比率較 102 年度下降至 67.99%。與採樣公司及同業相較，該公司 101~103 年度介於採樣公司及同業之間。

(2)現金流量允當比率

101~103 年度之現金流量允當比率分別為 96.53%、85.96%及 79.63%。102 年度為因應指紋辨識感測器封裝訂單而購置機器設備，使現金流量允當比率下降至 85.96%；103 年度因指紋辨識感測器市場接受度良好，經與終端客戶協議後已於 6 月返還產能保證金，使營業活動之淨現金流入數減少，致現金流量允當比率下降至 79.63%。與採樣公司及同業相較，該公司 101~102 年度係介於採樣公司及同業之間。

(3)現金再投資比率

公司 101~103 年度之現金再投資比率分別為 6.65%、18.09%及 8.05%，102 年度因影像感測器及指紋辨識感測器封裝需求增加，帶動營收成長動能，及收取產能保證金，使營業活動之淨現金流入增加，致現金再投資比率上升至 18.09%；103 年度因指紋辨識感測器市場接受度良好，經與終端客戶協議後已於 6 月返還產能保證金，使營業活動之淨現金流入數減少，致現金再投資比率下降至 8.05%。與採樣公司及同業相較，該公司 101 年度低於採樣公司及同業，102 年度及 103 年度則係優於或介於採樣公司及同業。

整體而言，該公司來自營運活動產生之資金尚稱充足，各項現金流量指標尚屬允當

二、申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止申請公司及其各子公司暨母子公司間背書保證、重大承諾、資金貸與他人、衍生性商品交易及重大資產交易之情形，並評估對其財務狀況之影響

(一)背書保證

該公司業已訂定「背書保證作業程序」，並經董事會及股東會決議通過，以作為辦理背書保證之依據。經查閱該公司董事會、股東會議事錄、會計師查核簽證之財務報告及至公開資訊觀測站查詢申報內容，該公司最近三年度及申請年度截至最近期止，並無為他人背書保證之情事。

(二)重大承諾事項

經參閱該公司最近三年度及申請年度截至最近期止之董事會、股東會議記錄及經會計師查核簽證之財務報告，該公司重大承諾事項如下：

1.營業租賃協議

該公司廠房及辦公室主係向經濟部工業局中壢工業區承租，租期將於 103 年 8 月至 109 年 10 月陸續到期，其中，經濟部工業局中壢工業區得依規定調整租金，所有租約到期時均可再續約。最近三年度及申請年度截至評估報告出具日止經會計師查核簽證之財務報告，該公司於 103 年 12 月 31 日止基於營運需求以簽訂租賃合約，不可取消之營業租賃所負擔之未來最低應付租賃給付如下：

單位：新台幣仟元

年度	不超過一年	超過一年但不超過五年	超過五年	合計
應付租金	45,789	97,320	3,187	146,296

資料來源：該公司103年度經會計師查核簽證之財務報告

上述租賃支出之承諾係該公司因營運所需，故對該公司財務狀況並無重大影響。

2.或有負債及未認列之合約承諾

(1)該公司於 89 年 6 月與 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.(原名為以色列商 ShellCase Ltd.)簽訂之技術授權合約，該公司於合約有效期間內分期支付之技術授權費已於 90 年 6 月全數支付完畢，該技術授權費帳列無形資產之專門技術項下，且按耐用年限 20 年攤銷。另依該合約規定，自 92 年 4 月起，若使用該特定技術製造及銷售產品時，依合約規定應按其特定產品銷售貨收入淨額之若干比率支付權利金，係因正常營運活動而產生，對該公司財務狀況尚無重大不利影響。

(2)該公司 101~103 年度承諾購置之固定資產合約總價如下表：

單位：新台幣仟元

項 目	101 年度	102 年度	103 年度
承諾購置之固定資產合約總價	229,997	583,576	434,935

資料來源：該公司各年度經會計師查核簽證之財務報告

上述項目主要係該公司因生產所需之設備，而與其他公司簽訂之承諾購置之固定資產合約，由於係正常營運活動而產生，且該公司尚有足夠自有資金及銀行額度得以支應，故對該公司財務狀況影響應屬有限。

(3)該公司 100~103 年度已開立未使用信用狀之餘額如下表：

單位：新台幣仟元

項 目	101 年度	102 年度	103 年度
已開立未使用信用狀餘額	12,557	-	4,243

資料來源：該公司各年度經會計師查核簽證之財務報告

上述項目主要係該公司向供應商購買機器設備時，銀行所開立之信用狀未使用餘額，係因正常營運活動而產生，對該公司財務狀況並無重大不利影響。

(三)資金貸與他人

該公司業已訂定「資金貸與他人作業程序」，並經董事會及股東會決議通過，以作為辦理資金貸與他人之依據。經查閱該公司董事會、股東會議事錄、會計師查核簽證之財務報告及至公開資訊觀測站查詢申報內容，該公司最近三年度並無資金貸與他人之情事。

(四)衍生性商品交易情形

該公司業已訂定「取得或處分資產處理程序」，並經董事會及股東會決議通過，作為從事衍生性商品交易之依據。該公司 101~103 年度從事之衍生性商品交易為買賣遠期外匯合約及利率交換合約，交易情形列示如下：

1.買賣遠匯合約及評價(損)益

該公司之銷貨、進貨多以美元為計價單位，為有效規避匯率波動對淨外幣債權所造成之風險，故從事買賣遠期外匯之衍生性金融商品交易，截至103年度尚未到期之遠期外匯合約如下：

單位：美金仟元；新台幣仟元

金融商品	到期期間	合約金額
遠匯合約(賣出美元/買入台幣)	104年1月~104年2月	USD 26,000 / NTD 809,449

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告。

該公司於從事買賣遠期外匯交易係依相關規定辦理，且交易對象均為信用良好之金融機構，該公司101~103年度之淨兌換(損)益分別為占各年度營業收入淨額及營業淨利之比例分別為(0.10)%、(0.20)%、(0.03)%及3.11%、(2.24)%、(0.22)%，各年度因匯率變動產生之損益已大致與被避險項目之損益相抵銷，故對該公司財務狀況並無重大不利影響。

衍生性商品認列之金融工具損益

單位：仟元

項目 \ 年度	101 年度	102 年度	103 年度
透過損益按公允價值衡量之金融工具淨(損)益(A)	19,339	(20,661)	(51,338)
外幣兌換(損)益 (B)	(22,333)	12,117	49,819
淨額 (C=A+B)	(2,994)	(8,544)	(1,519)
營業收入 (D)	3,139,385	4,256,761	4,934,078
營業淨利 (E)	(96,240)	380,636	675,630
C/D(%)	(0.10)%	(0.20)%	(0.03)%
C/E(%)	3.11%	(2.24)%	(0.22)%

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告

2.利率交換合約及評價(損)益

該公司目前所承擔之長期銀行借款係屬浮動利率之債務，因市場利率之變動極易造成未來現金流量之波動，故簽訂利率交換合約以規避利率變動之風險，截至103年12月底尚未到期之利率交換合約如下：

單位：仟元

合約金額	到期日	支付利率區間	收取利率區間
500,000	105年12月15日	0.979%~1.108%	0.868%~0.885%

資料來源：該公司103年度經會計師查核簽證之財務報告

該公司於101~103年度從事利率交換合約交易，由權益轉列至當期損失(帳列財務成本項下)分別為227仟元、230仟元及500仟元，占營業淨利分別為0.24%、(0.06)%及(0.07)%，所佔比重甚微，對該公司財務狀況應無重大影響。

(五)重大資產交易

該公司已訂定「取得或處分資產處理程序」，並業經董事會及股東會通過，以作為從事資產交易之依據。經查閱該公司董事會、股東會議事錄、會計師查核簽證之財務報告及至公開資訊觀測站查詢申報內容，101~103 年度並無重大資產達實收資本額百分之二十或金額達三億元以上之交易情形。

三、申請公司申請年度截至最近期止之擴廠計畫及資金來源、工作進度、預計效益，並評估其可行性

(一)擴廠計畫

1.計畫內容

該公司深耕晶圓級尺寸封裝技術多年，並以封裝高畫素之影像感測器為主，隨行動裝置產品對影像畫素需求日益殷切，影像感測器畫素隨市場需求不斷提升，因畫素提高需藉由感測器元件尺寸放大，故帶動晶圓數量需求大幅成長。因影像感測器於 12 吋晶圓製程已臻成熟，且現有 8 吋晶圓廠之產能已不敷市場需求，12 吋晶圓製造逐漸成為市場主流，因此將帶動下游封裝廠產線逐步由 8 吋往 12 吋產線佈局。該公司目前之現有兩座廠房以封裝 8 吋產品為主，為因應晶圓尺寸放大及預計現有產能不敷未來市場需求成長所需，遂規劃建置新廠房並增添相關機器設備。由於半導體封裝作業均需在無塵室裡進行，整體生產流程至少包括黃光區、蝕刻區、壓合區及切割區等，該公司該次擴建計畫除增加辦公室、品保實驗室及倉庫外，主要係建置無塵室及 12 吋晶圓級尺寸封裝產線，以提升該公司整體產能，支應未來影像感測器客戶需求。

2.資金來源

該公司之新廠房(以下稱 Line C)擴建計畫預計投資總金額為 3,830,045 仟元，包括土地與建物購置款、廠房整修等建置工程款、無塵室等廠務設施建置款及機器設備款等，資金來源多以中長期銀行借款及自有資金支應。其中，土地與建物購置款共計 1,050,000 仟元已於 101 年 2 月全數付訖，另截至 104 年 2 月底止，依工程進度及付款時程，該公司分別已支付廠房整修等建置工程款計 119,645 仟元、無塵室等廠務設施建置款計 512,159 仟元及機器設備款計 779,282 仟元，尚餘 1,368,959 仟元之款項，將可透過自有資金或中長期銀行借款支應，其資金來源應屬合理。

3.擴廠進度

該公司經 100 年 1 月 14 日之董事會決議得因應擴充產能需求購置不動產，考量廠房空間需求及廠區位址，故向佳鼎科技(股)公司(以下簡稱佳鼎)購置其位於桃園中壢市工業區中園路之土地及廠房，經取得不動產買賣合約書及鑑價報告等文件，該公司已於 100 年 3 月 23 日辦理過戶完成。因佳鼎之廠房原係供 PCB 之生產用，故該公司需進行相關廠務設施之改善後，再進行無塵

室之建置，而後才得將安裝設備機台以供驗證、試產及量產。因應前述各項建置工程，該公司分別經 100 年 3 月 15 日、100 年 11 月 11 日、102 年 3 月 25 日及 103 年 4 月 3 日董事會決議通過相關廠房建置計畫預算。該公司無塵室業已取得工廠使用執照。預計於 104 年上半年可開始進行試產及客戶認證等程序。

4. 預計效益

因現有八吋晶圓廠產能已無法滿足影像感測器市場需求，為銜接客戶於 12 吋影像感測器之封裝需求，以維持該公司於晶圓級尺寸封裝產能與技術上之競爭力及產業地位，同時有效掌握未來產業趨勢並強化與 IC 設計客戶之夥伴關係，係以此次擴廠計畫對該公司未來營運成長實有正面助益。

5. 可行性評估

由於大吋晶圓所生產之半導體晶片較具成本效益，遂使上游感測器晶圓大廠已逐步由 8 吋晶圓走向 12 吋晶圓，然該公司係屬半導體產業供應鏈中下游封裝廠商，故有鑑於上游晶圓大廠製程演進，該公司投入建置 12 吋晶圓級尺寸封裝生產線以銜接產業未來走向，應屬合理。此外，該公司預計擴充之 12 吋晶圓級尺寸封裝生產線將吸引影像感測器廠商訂單需求，挹注該公司未來成長動力，對該公司未來營運具有正面效益。

另就該公司擴廠時程觀之，該公司工程進度均依照公司擴廠計畫進行，工程已如期完竣並取得工廠使用執照，預計 104 年上半年即將進入試產階段，應屬合理可行。

另就資金來源觀之，該公司 Line C 擴廠計劃之資本支出共計 3,830,045 仟元，其中截至 104 年 2 月底止業已支付 2,460,546 仟元款項，剩餘未支付之款項共計 1,368,959 仟元，將可透過自有資金或中長期銀行借款(截至 104 年 2 月底止尚有 3,133,995 仟元之未動用銀行額度)支應。

整體而言，該公司之擴廠計畫、資金來源、工作進度及未來效益預估應屬合理可行。

四、個體及合併財務報告之轉投資事業

(一)申請公司申請年度截至最近期止轉投資事業概況，並評估重要轉投資事業（持股比例達二〇%以上或帳面金額或原始投資金額達新台幣五千萬元以上者）最近年度及申請年度截至最近期止之營運情形及獲利能力。

該公司於87年投資美商坎伯狄吉有限公司(Compositech Ltd.)，惟該被投資公司業於91年下市，故該公司業於91年度全數認列減損損失。另，截至目前為止，該公司未有轉投資事業之情事。

(二)申請公司申請年度截至最近期止尚未完成之投資案，其預估總投資金額占最近

一年度財務報告所列示股本二〇%以上，或逾新台幣五億元者，應詳加評估說明，但股票為無面額或每股面額非新台幣十元者，前開有關股本二〇%部分改以歸屬於母公司業主之權益一〇%計算之。

該公司截至目前為止，並無尚未完成之轉投資，其預估總投資金額占最近一年度財務報告所列示股本二〇%以上，或逾新台幣五億元者之情事。

- 五、申請公司分別以承銷價格及於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價為衡量依據，設算其已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至且採內含價值法之員工認股權憑證，於股票上櫃後所產生之費用對財務報表可能之影響

依照財務會計準則公報第 39 號「股份基礎給付之會計處理準則」之規定，員工認股權憑證給與日在 97 年 1 月 1 日以後，均適用該公報之規定，亦即未上市上櫃之公開發行公司發行員工認股權憑證採內含價值法評價，公司上市上櫃後，未來因履約價格與市價可能存有重大差異，致公司產生鉅額之費用

該公司分別於 95 年 7 月 3 日、96 年 6 月 26 日及 101 年 1 月 10 日經證期局核准發行員工認股權憑證，其中，95 年及 96 年之員工認股權計畫係採內含價值法，惟依據財務會計準則公報第 39 號規定，股份基礎給付協議日之給與日於 96 年 12 月 31 日（含）以前者，得不適用該公報，故該兩次員工認股計畫得不適用財務會計準則公報第 39 號規定辦理，且該公司業於 101 年 1 月 1 日針對上述兩次員工認股計畫選擇豁免追溯適用國際財務報導準則第 2 號規定，故該公司已發行但股份基礎給付交易最終確定日尚未屆至且採內含價值法之員工認股權對該公司上櫃後未有費用產生之影響。另該公司 100 年員工認股權計畫業已採公平價值計算認列相關費用及成本，故不適用本項評估。

- 六、公營事業申請股票上櫃時，其檢送之財務報告以經審計機關審定之審定報告書替代者，應洽會計師就如適用一般公認會計原則與審計機關審定數之差異，及其對財務報告之影響表示意見

該公司非屬公營事業申請股票上櫃，故不適用。

- 七、推薦證券商應評估外國申請公司依註冊地國法令規定發行之員工認股權憑證及具股權性質有價證券之發行辦法合理性暨對股東權益之影響

該公司非屬外國申請公司申請股票上櫃，故不適用

柒、關係人交易評估

推薦證券商應就申請公司最近三年度及申請年度截至最近期止個體及合併財務報告之關係人交易，評估以下事項：

- 一、針對申請公司交易金額重大或性質特殊之關係人交易執行相關評估程序(包括與同業及非關係人交易之比較)，以瞭解其交易之必要性，決策過程合法性，暨價格與款項收付情形之合理性

(一)個體之關係人交易

關係人名稱	與該公司之關係
采鈺科技股份有限公司(簡稱采鈺)	與該公司董事長同一人
OVTI 集團	該公司法人董事之母公司
台積電	102 年 6 月該公司股東常會全面改選董事前係具有實質控制能力之母公司；102 年該公司股東常會全面改選董事後，因台積電占該公司董事席次未過半，故僅對該公司採權益法評價且為具重大影響力投資者
台積電(北美)公司(簡稱台積(北美))	台積電之子公司
台積電(中國)公司(簡稱台積(中國))	台積電之子公司
世界先進積體電路股份有限公司(簡稱世界先進)	台積電採權益法評價之被投資公司，102 年 7 月該公司非台積電子公司後，世界先進已非為該公司之關係人

1.銷貨及應收帳款

銷貨

單位：新台幣仟元

名稱 \ 年度	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
OVTI 集團	1,261,163	40.17	1,580,579	37.13	1,425,860	28.90
台積電	185,554	5.91	862,202	20.25	1,732,290	35.11
世界先進	183	0.01	1,803	0.04	-	-
台積(中國)	-	-	81	0.01	-	-
合計	1,446,900	46.09	2,444,665	57.43	3,158,150	64.01

資料來源：該公司 101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

應收關係人款

單位：新台幣仟元

名稱 \ 年度	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
OVTI 集團	203,159	84.78	222,084	43.00	211,825	31.46
台積電	36,434	15.21	294,264	56.98	461,494	68.54
世界先進	28	0.01	-	-	-	-
台積(中國)	-	-	83	0.02	-	-
合計	239,621	100.00	516,431	100.00	673,319	100.00

資料來源：該公司 101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

(1)OVTI 集團

OVTI 係該公司法人董事-台灣豪威投資控股(股)有限公司之最終母公司，亦為該公司之主要銷售客戶，其係於美國上市掛牌公司(NASDAQ:OVTI)，為全球知名 CMOS 感測器大廠，其產品廣泛應用於消費性及商務商品上。該公司自 92 年即與其首次交易，主係提供影像感測器封裝業務。該公司最近三年度對 OVTI 集團之銷貨金額分別為 1,261,163 仟元、1,580,579 仟元及 1,425,860 仟元。其銷貨變化情形參閱本評估報告「伍、業務狀況 一、營業概況 (一)最近三年度及申請年度截至最近期止主要銷售對象之變化分析」之說明。對 OVTI 集團之應收關係人款項淨額係因一般銷貨產生之款項，經抽核相關憑證及期後收款狀況，尚無發現重大異常之情事。

(2)台積電

台積電係為專業積體電路技術及製造服務大廠，向來專注於先進晶圓代工服務，致力於晶圓先進製程之發展，以先進製程技術提供晶圓專業製造服務。該公司為專業封裝服務廠商，係以半導體製程在晶圓上進行相關封裝，歷年來對台積電主要多係提供晶圓級後護層封裝服務，其產品涵蓋指紋辨識、微機電及 MOSFET 功率元件等，為台積電下游供應鏈廠商之一。該公司最近三年度對台積電之銷貨金額分別為 185,554 仟元、862,202 仟元及 1,732,290 仟元，其銷貨變化情形參閱本評估報告「伍、業務狀況 一、營業概況 (一)最近三年度及申請年度截至 6 月底止主要銷售對象之變化分析」之說明。由於該公司先進封裝技術成熟獲終端特定客戶青睞，該終端特定客戶原係直接與該公司接洽開發合作新產品，然由於該終端特定客戶為確保新產品之良率、品質控管、交期及責任分工，並考量整體產品的產能供應鏈生產順暢，遂與台積電合作以 Turnkey 之商業模式合作，由該終端特定客戶將訂單交給其指定之晶圓代工廠-台積電負責統籌管理，台積電完成晶圓生產再垂直整合下游供應鏈製程，以有效管理並降低產品風險及縮短產品交期，然雖該公司係特定客戶指定之主要封裝廠商，為配合此交易(Turnkey)模式，終端特定客戶對該公司之訂單係透過台積電下單，致使該公司於 102 年度及 103 年度對台積電之銷貨金額大幅成長。對台積電之應

收關係人款項淨額係因一般銷貨產生之款項，經抽核相關憑證及期後收款狀況，尚無發現重大異常之情事。

(3)世界先進

世界先進係台積電採權益法評價之轉投資公司，主係從事晶圓代工服務。該公司自 101 年度起方與其交易往來，101 年度由於該公司取得世界先進特定製程之晶圓封裝訂單，故 101 年度及 102 年度上半年度分別對世界先進銷貨 183 仟元及 1,803 仟元，102 下半年度起，由於世界先進業已非為該公司之關係人故未揭露銷貨情形。對世界先進之應收關係人款項淨額係因一般銷貨產生之款項，經抽核相關憑證及期後收款狀況，尚無發現重大異常之情事。

(4)台積(中國)

台積(中國)係台積電於大陸之轉投資事業，從事製造與銷售積體電路業務。該公司 102 年度起，提供台積(中國)少量晶圓封裝業務，103 年起則因未取得訂單，故未再有交易。對台積(中國)之應收關係人款項淨額係因一般銷貨產生之款項，經抽核相關憑證，業已收回款項。

綜上所述，該公司對關係人之授信政策均為月結 30 天，與對一般銷貨客戶之授信政策相當，未有重大差異。另，就交易條件觀之，由於該公司係屬客製化訂單生產，故考量產品差異化、生產成本及各訂單生產數量需求不同，以致產品價格略有差異，然該公司對關係人與一般銷貨客戶銷售之產品均依照該公司內部政策制定價格，故應屬合理。

2.進貨與應付帳款

進貨

單位：新台幣仟元

名稱 \ 年度	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
台積電	-	-	-	-	2,127	0.19
合計	-	-	-	-	2,127	0.19

資料來源：該公司 101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

應付關係人款

單位：新台幣仟元

名稱 \ 年度	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
台積電	-	-	-	-	517	100.00
合計	-	-	-	-	517	100.00

資料來源：該公司 101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

該公司 103 年度對台積電進貨 2,127 仟元，主係因生產製程所需向台積電購置光阻劑及膠帶所致。對台積電之應付關係人款項係因一般進貨產生之款項，尚無發現重大異常之情事。另該公司對關係人之付款政策為月結 30 天，

與對一般進貨廠商之付款條件相當，未有重大差異。且該公司對關係人與一般進貨廠商之交易均依照該公司內部政策執行，故應屬合理。

3.租金收入(帳列其他收益及費損)

單位：新台幣仟元

名稱 \ 年度	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
台積電	-	-	151,006	100.00	697,958	100.00
合計	-	-	151,006	100.00	697,958	100.00

資料來源：該公司 101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

由於指紋辨識感測器為特定客戶產品之創新應用，對其產品問市時程影響甚鉅，特定客戶原係直接與該公司接洽開發合作新產品，惟因考量整體產品的產能供應鏈生產順暢，最後採由台積電 turnkey 的方式為特定客戶提供服務，並透過台積電發包(One-stop Shopping Service)委由該公司進行封裝業務。然而，當時因該公司現有廠房空間有限，且該公司於短期間內無法覓得或立即建置適合之無塵室廠房放置所有符合產能需求之相關設備，故該公司與台積電協議將部分設備出租並放置於台積電。且係因放置於台積電廠房，基於員工管理、營運風險及業務機密等因素之考量，又該公司於園區並無分公司之設置，無法於台積電廠房負責管理營運相關設備，遂以租賃設備方式，由台積電自行負責部分封裝服務。經檢視雙方簽立之租賃契約暨其增補修訂協議，該公司自 102 年 7 月按月認列租金收入並逐季收款，而 103 年因合約條件略有調整，故金額高於 102 年。經抽核相關憑證及收款情形，尚無發現重大異常之情事。此外，經檢視該設備租賃交易產生之利潤並與市場從事設備租賃業務之公司相較，該公司設備租賃利潤尚落於設備租賃採樣公司毛利區間，故應尚屬合理。

4.製造費用

單位：新台幣仟元

名 稱 \ 年 度	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
采鈺	958	0.05	9,859	0.41	151	-
台積電	2,178	0.11	2,125	0.09	2,034	0.08
合 計	3,136	0.16	11,984	0.50	2,185	0.08

資料來源：該公司 101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

(1)采鈺

該公司最近三年度對采鈺產生之製造費用分別為 958 仟元、9,859 仟元及 151 仟元。101 年度對采鈺之製造費用主要為顧問費用等，該公司因計畫建置新廠(C 廠)，希望藉助采鈺專業之經驗，故聘請采鈺相關人員協助新廠規劃、設計及施工等相關事宜至 101 年 4 月止；102 年度因該公司訂單暢旺，既有產線作業人員不足且有經驗之人員又一時招募不及，而采鈺尚有產線人力得提供協助，故該公司與采鈺簽立合作意願書，由采鈺提供部分產線

人員至該公司協助生產製造作業，故 102 年度該公司支付采鈺相關派遣人員費用，致使 102 年度對采鈺之製造費用增加。103 年度則因該公司已自行對外招募產線人員以滿足產能需求，故終止與采鈺產線人員之合作意願書，並未再支付其派遣費用，僅有因製程單位為產品測試所需，委託采鈺協助前段彩色濾光片(RBG 陣列)之製程，故產生少額之製造費用。

經檢視雙方簽立之廠房租賃契約及人員支援意願書，並抽核相關憑證與付款情形，尚無發現重大異常情事。

(2)台積電

該公司最近三年度對台積電產生之製造費用分別為 2,178 仟元、2,125 仟元及 2,034 仟元。該公司對台積電產生之製造費用主係因支付與廠務相關之顧問費等費用所致。由於該公司既有舊廠房年限已久，為提升舊廠房效能，該公司遂與台積電簽立合作意願書，由台積電派駐具備豐富廠務經驗之人員，提供 Line A 及 Line B 兩廠之廠務系統相關技術服務協助及水電氣化等相關廠務設備改善規劃與建議，該公司再依照協議內容支付台積電顧問費用。

經檢視雙方簽立之合作意願同意書及抽核相關憑證與付款情形，尚無發現重大異常情事。

5.營業費用

單位：新台幣仟元

年 度 名 稱	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
采鈺	1,115	0.34	672	0.18	1,089	0.04
OVTI 集團	937	0.28	-	-	-	-
台積電	454	0.14	209	0.06	5,304	0.20
台積(北美)	174	0.05	-	-	-	-
合 計	2,680	0.81	881	0.24	6,393	0.24

資料來源：101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

(1)采鈺

該公司最近三年度對采鈺產生之營業費用分別為 1,115 仟元、672 仟元及 1,089 仟元。該公司對采鈺產生之營業費用主係為研發用實驗品費用等。因該公司主要從事影像感測器封裝業務，相關產品製程技術之研發需搭配使用彩色濾光膜，故該公司若有研發所需，便向采鈺採購少量彩色濾光膜，致使該公司部分年度對采鈺之營業費用較為增加。

(2)OVTI 集團及台積(北美)

該公司 101 年度對 OVTI 集團及台積(北美)產生之營業費用主要係因為

產品研發所需，分別向 OVTI 集團及台積電(北美)採購少量晶圓供研發使用所致。由於該公司係屬半導體產業下游封裝供應商，相關產品製程技術之研發需耗用部分少量晶圓產品，係以該公司針對不同技術研發所需向上述關係人採購，應屬合理。

(3)台積電

該公司最近三年度對台積電產生之營業費用分別為 454 仟元、209 仟元及 5,304 仟元。該公司對台積電產生之營業費用大多係因該公司向台積電採購線上課程(e-learning)供公司員工內部訓練使用，課程主要以廠務概念、半導體相關製程教學簡介為主；另為產品研發所需，向台積電採購少量晶圓供研發使用所致。

綜上，該公司最近三年度對上述關係人產生之營業費用主係因購置研發材料、購置線上課程(e-learning)等，經抽核相關交易憑證及付款情形，尚無發現重大異常之情事。

6.購置固定資產及應付設備款

購置固定資產

單位：新台幣仟元

年 度 名 稱	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
台積電	-	-	84,921	1.41	23,447	0.36
台積(中國)	-	-	47,358	0.79	757	0.01
合 計	-	-	132,279	2.20	24,204	0.37

資料來源：101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

應付設備款

單位：新台幣仟元

年 度 名 稱	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
台積電	-	-	55,130	18.02	-	-
合 計	-	-	55,130	18.02	-	-

資料來源：101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

該公司每年均會評估次年度可能需汰換之相關機台設備並預估可能之資本支出，並依循取得或處份資產處理程序暨核決權限管理辦法，進行採購作業。由於晶圓封裝製程與上游晶圓製造商及其他下游製程供應商部分製程所使用之機器設備具共用性，故在評估設備採購交期是否能符合需求之前提下，再綜合考量設備之使用年限及狀況並依循內控制度辦理採購流程作業，再決議是否向該關係人採購。係以該公司分別於 102 年度及 103 年度向台積電及台積(中國)購置晶圓壓合機、自動傳送晶片檢測、金屬濺鍍機台及膜厚量測機等機器

設備。

經抽核相關表單，該公司向關係人採購之機器設備業經董事會提案決議或報備通過，且遵循採購標準程序進行採購作業，故其交易價格及原由應屬合理。另該公司對台積電(中國)及台積之付款條件分別為月結 60 天及月結 30 天付款，該公司採購流程均找尋多家設備供應廠商進行詢比議價，再經考量各供應廠商之設備報價及交期等因素決議採購對象，係以該公司向關係人及非關係人之採購設備價格均遵循該公司內控流程執行，與該公司一般採購廠商(非關係人)之交易條件相當，另經抽核該公司支付設備款項情形尚屬正常，並無發現重大異常之情事。

7.其他預付費用及暫付款

單位：新台幣仟元

年 度 名 稱	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
OVTI 集團	771	1.08	463	0.66	655	0.90
台積電	293	0.41	215	0.30	137	0.19
合 計	1,064	1.49	678	0.96	792	1.09

資料來源：101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

(1)OVTI 集團

該公司對 OVTI 集團之暫付款主要係因該公司代 OVTI 集團採購晶粒承載器具(Tray 盤)之款項所致。

(2)台積電

該公司對台積電之預付費用主要係向台積電採購線上課程供公司員工內部訓練所致。詳「柒、關係人交易評估一、(一)、5 營業費用、(3)台積電說明」。

8.其他應收款

單位：新台幣仟元

年 度 名 稱	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
台積電	-	-	141,190	100.00	-	-
合 計	-	-	141,190	100.00	-	-

資料來源：101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

該公司 102 年度因配合特定客戶量產訂單及時程，進行相關設備採購及生產，然上項產品在銷售初期市場的接受度難以預估，為維護公司利益並保障已投入之成本未來得以回收，由台積電與特定客戶協議支付本公司投入設備之產能保證金約 1,016,977 仟元，後因特定客戶產品推出市場反應良好，故經協議該公司償還前述保證金款項(截至 102 年底尚餘 141,190 仟元之其他應收款)，

該公司業於 103 年 6 月底前全數歸還。經檢視 102 年產能保證金協議備忘錄及抽核相關收款及還款情形，尚無發現重大異常情事。

9.應付費用

單位：新台幣仟元

年 度 名 稱	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
采鈺	4	-	-	-	380	0.13
台積電	364	0.20	3,310	1.24	683	0.23
合 計	368	0.20	3,310	1.24	1,063	0.36

資料來源：101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

該公司對關係人之應付費用，主係支付關係人製造、營業費用及購置設備產生之稅款所致，然該公司對關係人及非關係人之費用類付款條件均為月結 30 天，經抽核相關付款憑證尚無重大異常。

(二)合併之關係人交易

該公司未有轉投資事業，故未編製合併報表。

二、瞭解申請公司金額重大之關係企業應收款項是否逾期，針對逾期者，應查明其原因及有無重大異常情事

經查核該公司與關係企業間並無金額重大之逾期應收款項者，且尚無發現有重大異常情事。

三、申請公司與關係企業、股東或關係人間有鉅額資金往來者，應查明其原因，及利率、收付息情形有無重大異常之情事

經核閱該公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報告，該公司未有資金貸與他人之情形，係以該公司與關係企業、股東或關係人間未有鉅額資金往來之情事。

捌、推薦證券商派員實地瞭解申請公司之重要子公司營運情形者，應具體列示是否有重大營運風險或其他重大異常情事之評估意見

該公司未有轉投資事業，故不適用本項評估。

玖、法令之遵循及對公司營運影響

經取得維和法律事務莊振農律師出具之法律意見書，針對該公司是否違反相關法令規章，現任董事、監察人、總經理、持股百分之十以上股東及實質負責人等相關人員最近三年內是否違反相關法令，致使有違誠信原則或影響職務之行使，違反著作權、專利權、商標權或其他智慧財產權之情事，繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，以及重大勞資糾紛或環境污染事件表示意見，茲將其意見書及本承銷商之評估意見彙總如下：

一、申請公司是否違反相關法令規章

(一)所屬行業之目的事業中央主管機關及影響該行業之重要法律與相關規章

該公司所屬行業之目的事業中央主管機關為經濟部，影響該行業之重要法律與相關規章有公司法、證券交易法、銀行法、商業會計法等商事法、公平交易法等相關法令規章。經參酌維和法律事務莊振農律師出具之法律意見書，該公司截至評估報告出具日止，尚無違反該行業之重要法律與相關規章之情事。

(二)依公開發行公司資訊公開相關法令應公開之資訊

經參酌維和法律事務莊振農律師出具之法律意見書，並至公開資訊觀測站查詢該公司所公告申報之事項，該公司依公開發行公司資訊公開相關法令辦理資訊公開應行公告及申報事項，尚無發現重大未依法令規定辦理之情事。

(三)其他法令規章

經參酌維和法律事務莊振農律師出具之法律意見書，並核閱該公司之收發文紀錄該公司截至評估報告出具日止，並無因違反其他法令規章，致有重大影響該公司營運之情事。

二、申請時之董事、監察人、大股東、總經理及實質負責人是否違反相關法令，而有違誠信原則或影響其職務之行使

經參酌維和法律事務莊振農律師出具之法律意見書，並核閱該公司之收發文紀錄及取具上述人員聲明書、聯徵紀錄及無欠稅證明等資料，該公司之現任董事、大股東、總經理及實質負責人截至評估報告出具日止，並無違反相關法令，致違誠信原則或影響職務行使之情事。

三、是否違反著作權、專利權、商標權或其他智慧財產權之情事

經核閱該公司股東會年報、董事會與股東會議事錄及收發文紀錄，並參閱維和法律事務莊振農律師出具之意見書，該公司並無涉及重大著作權、專利權、商標權或其他智慧財產權侵權之情事。

四、繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件

(一)公司部分

經取具該公司之聲明書，並參酌維和法律事務莊振農律師出具之法律意見書，該公司目前繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件請參閱附件一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第十條第一項各款所列不宜上櫃情事之評估意見，經評估對該公司尚無重大之影響。

(二)董事、監察人及持股百分之十以上大股東

經取具該公司董事及持股百分之十以上大股東之聲明書，並參酌維和法律事務莊振農律師出具之法律意見書，僅法人董事台積電有繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，茲列示如下：

訴訟/非訟/行政 爭訟事件	訴訟相對人	訴訟原因及過程
專利權侵害訴訟	Keranos	Keranos 於 99 年 6 月，在美國東德州地方法院對台積電、TSMC North America 以及數十家居於領先地位的科技公司，提出對三篇已過期的美國專利之專利權侵害訴訟。 99 年 11 月，台積電、TSMC North America 以及德州訴訟案件中的數家共同被告在美國北加州地方法院提出訴訟，要求判決該等公司並未侵害 Keranos 公司的專利權以及判決訴訟標的專利權為無效。 此兩訟案已於美國東德州地方法院併成一案處理。103 年 2 月，法院宣布有利於台積電公司之判決，駁回 Keranos 提出之所有請求。103 年 3 月，Keranos 於美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴。
專利權侵害訴訟	Ziptronix	Ziptronix 於 99 年 12 月，在美國北加州地方法院對台積電、TSMC North America 以及另一公司，提出對若干美國專利之專利權侵害訴訟。103 年 9 月，法院作成有利於台積電公司及 TSMC North America 之判決(Summary Judgment)。Ziptronix 公司可對上述法院判決提出上訴。
專利權侵害訴訟	Zond	Zond 於 102 年 9 月，於美國麻州地方法院對台積電、部分台積電子公司以及其他公司，提出對若干美國專利權之專利權侵害訴訟。法官於 103 年 6 月裁定暫停該案之訴訟審理。其後，台積電及 Zond 公司於美國德拉瓦州地方法院及美國麻州地方法院對 Zond 公司的若干其他美國專利各自提出訴訟。
專利權侵害訴訟 及不當使用營業秘密 及違反合約訴訟	Tela Innovations (簡稱 Tela)	Tela 於 102 年 12 月，於美國德拉瓦州地方法院及美國國際貿易委員會對台積電及 TSMC North America 提出對一篇美國專利之專利權侵害訴訟。台積電於 103 年 1 月於美國北加州地方法院對 Tela 提起不當使用台積電之營業秘密及違反合約之訴訟。雙方已於 103 年 9 月撤回上述美國德拉瓦州地方法院、美國國際貿易委員會及美國北加州地方法院之案件。
專利權侵害訴訟	DSS Technology Management, Inc.(簡稱 DSS)	DSS 於 103 年 3 月，於美國東德州地方法院對台積電、TSMC North America 及 TSMC Development 及若干其他公司提出對一篇美國專利之專利權侵害訴訟。

經評估前述繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件均因該公司法人董事本身業務所致，目前尚無因違反誠信原則而遭判決有期徒刑，且同時該等事件與該公司並無實質上或法律上之牽連關係，其審理程序及判決結果均不致影響該董事執行該公司董事之職務，故對該公司之營運應無重大不利影響。

五、申請公司是否有重大勞資糾紛或污染環境事件

經核閱該公司收發文紀錄及函詢環保局與勞保局等主管機關，並參酌維和法律事務莊振農律師出具之法律意見書，該公司並無重大勞資糾紛或污染環境事件，請參閱附件一、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第十條第一項各款所列不宜上櫃情事之評估意見，經評估對該公司尚無重大之影響。

六、外國申請公司之推薦證券商應洽律師對申請公司、申請時之董事、監察人、大股東、總經理及實質負責人最近三年內就下列事項出具之法律意見書，依據其意見，推薦證券商再就該等項目具體評估對申請公司營運影響及因應之道

該公司非外國申請公司，故不適用。

拾、依財團法人櫃檯買賣中心「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第十條第一項各款所列不宜上櫃情事之評估意見(詳附件一)

本推薦證券商依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第十條第一項所列各款逐條評估結果，並未發現該公司有違法上述條文所列不宜櫃上之情事。

拾壹、列明申請公司設置之薪資報酬委員會，其成員之專業資格、職權行使及相關事項是否依我國證券法令規定辦理之評估意見

該公司第一屆薪資報酬委員會係於 100 年 11 月 11 日經董事會決議通過設置，並訂定薪資報酬委員會組織規程，委由王文宇先生、謝徽榮先生等、董事何麗梅三人擔薪資報酬委員會委員；102 年 6 月 13 日，該公司召開股東常會進行董事改選，薪資報酬委員改由三位獨立董事王文宇先生、徐中時先生及謝徽榮先生擔任，成員之專業資格，職權行使及相關事項評估如下：

一、成員之專業資格

經本推薦證券商檢視該公司薪資報酬委員會之學經歷資料，其委員會之成員組成尚屬健全，並符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及相關事項」第五條對於薪資報酬委員會成員專業資格條件規範之情事。

二、職權行使及相關事項

截至評估日止，該公司薪酬委員會計召開 10 次會議，針對董事及經理人之薪資報酬進行討論並決議，經評估該公司薪資報酬委員會之職權行使及相關事項，尚符合證券交易法第 14 條之 6 及「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定。

拾貳、評估申請公司之公司治理自評報告是否允當表達其公司治理運作情形

該公司業依自評報告所列各公司治理評量指標，包括股東權益、董事會職能、監察人職能、資訊透明度、內控內稽制度、經營策略及利害關係人與社會責任，進行逐項之評估，並簡述公司實際運作情形及引用相關規範、規則及法令如下：

一、股東權益

該公司重視股東權益，為鼓勵其股東踴躍出席股東會，積極參與董事之選舉或議案之討論事宜，已制定完備之議事規則，並依「股東會議事規則」定期召開股東常會，以確實依照召集程序之規定，且於開會通知書上載明召集事由，並作資訊公告，對於報告及討論事項部分，均給予股東適當、充分發問或提案之機會，股東會所議決事項，亦作成議事錄，將股東會議事錄妥善保存。另該公司對股東權益事項之回覆已設置發言人及代理發言人統一處理，以保障該公司股東之權益。

二、董事會職能

該公司董事會結構，目前設有七席董事，其中包括三席獨立董事，且依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制。該公司董事會成員分別具營運判斷能力、財務會計分析能力、經營管理能力、產業相關資訊等執行職務所必須之知識、技能及素養。另該公司已制定完備之「董事會議事規則」，以為議事有效運作依據。並每季定期召開董事會，開會過程並全程錄音，且獨立董事在會議中亦能自由充分表達其意見，以強化該公司董事會職能。

三、監察人職能

該公司由三席獨立董事組成審計委員會以取代監察人之職能，至少每季召開一次會議，並制訂完備之「審計委員會組織規程」，以為依循。

四、資訊透明度

該公司重視資訊公開之責任，已建立公開資訊之網路申報作業系統，並指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，並建立發言人及代理發言人，使股東及利害關係人能即時充分瞭解公司之財務業務狀況以及實施公司治理之情形。

五、內控內稽制度

該公司已考量其整體之營運活動，建立有效之書面內部控制制度，並經董事會通過，且隨時檢討改進。同時選任符合資格之人員擔任內部稽核主管，每年訂定稽核計劃且確實依計劃執行各項稽核工作，定期向各審計委員會報告稽核業務並列席董事會報告。

六、經營策略

該公司每年訂定年度營業目標，並定期召開會議檢視營運情形，檢討營業目標執行及達成進度，同時掌握重大財務、業務事項、研發進度及人力資源等資訊，

以穩健經營精神專注公司本業，並依據產品市場狀況、同業變化情形及產業發展趨勢等共同研議最適當之經營策略。

七、利害關係人與社會責任

該公司已建立良好之員工溝通管道，維護其合法權益。因此公司成立至今未有因任何重大勞資問題或重大違反勞工法令而受主管機關處罰之情事。另設有發言人及電子郵件信箱等溝通管道，如有需求可與公司聯絡溝通，以維護其應有之合法權益。

綜上所述，該公司之公司治理自評報告尚能允當表達公司治理目前運作情形。

拾參、評估本國申請公司是否符合集團企業、建設公司、資訊軟體公司、投資控股公司、金融控股公司、參與公共建設之民間機構申請股票上櫃之補充規定

一、評估是否符合集團企業申請股票上櫃之規定

(一)依據「集團企業申請股票上櫃之補充規定」所稱「集團企業」係指申請上櫃會計年度及其上一個會計年度內，與申請公司彼此間具有控制或從屬關係之企業整體。

1.具有下列各款情事之一者，即認定其彼此間具有控制或從屬關係，茲依補充規定之認定標準逐項評估如下：

集團企業認定標準	符合集團企業規範之公司	評估說明
(1)屬於母公司及其所有子公司關係者	(1)台積電	經檢視該公司 102 年度及 103 年第二季之財務報告，該公司並無任何轉投資事業；另檢視台積電 102 年度及 103 年第二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告，因該公司於 102 年 6 月 13 日股東會全面改選董事後，台積電之董事席次已未過半數，並認為對該公司之財務及營運政策已不具控制力，故台積電官網公告自 102 年 7 月起不再將該公司納入其合併財報中，故目前僅係對該公司採權益法評價且具重大影響力投資者，然因台積電於 102 年 6 月前為該公司之母公司，故仍符合左列標準。
	(1) TSMC North America	因台積電符合左列標準，經檢視台積電 102 年度及 103 年第
	(2) TSMC Europe B.V.	

集團企業認定標準	符合集團企業規範之公司	評估說明
	(3) TSMC Japan Limited (4) TSMC Korea Limited (5) 台積電(中國)有限公司 (6) TSMC Technology, Inc. (7) InveStar Semiconductor Development Fund, Inc. (8) InveStar Semiconductor Development Fund, Inc. (II) LDC. (9) TSMC Development, Inc. (10) WaferTech, LLC (11) TSMC Partners, Ltd. (12) TSMC Design Technology Canada Inc. (13) TSMC Global Ltd. (14) 相豐科技(股)公司 (15) Emerging Alliance Fund, L.P. (16) VentureTech Alliance Fund II, L.P. (17) VentureTech Alliance Fund III, L.P. (18) Growth Fund Limited (19) VentureTech Alliance Holdings, LLC (20) 台積太陽能(股)公司 (21) TSMC Solar North America, Inc. (22) TSMC Solar Europe B.V. (23) TSMC Solar Europe GmbH (24) 台積固態照明(股)公司 (25) TSMC Lighting North America, Inc. (26) 台積光能投資有限公司	二季經會計師查核簽證或核閱之財務報告及股東會年報，台積電之所有子公司共計有 26 家亦符合左列標準。
(2)申請公司直接或間接控制他公司之人事、財務或業務經營者；或他公司直接或間接控制申請公司之人事、財務或業務經營者。其判斷標準如下：		
①取得對方過半數之董事席位者	台積電	雖取得該公司最近期變更登記事項表，並未發現有由他公司取得該公司過半數董事席次情事，惟因 102 年 6 月前台積電

集團企業認定標準	符合集團企業規範之公司	評估說明
		擔任該公司之董事席次超過半數，故台積電仍符合左列評估標準。另該公司未有轉投資事業，故並未有該公司取得他公司過半數董事席次之情事。
②指派人員獲聘為對方總經理者	無	台積電於100年4月29日改派關欣為其代表人，並由董事會推選為董事長迄今，另因當時之總經理陳立惇因個人因素於100年9月2日請辭，故該公司總經理一職暫由關欣兼任，後該公司在100年11月11日之董事會任命關欣為該公司總經理，故無左列情事。另，該公司未有轉投資事業，故未有指派人員獲聘為他公司總經理之情事。
③依合資經營契約規定擁有對方經營權者	無	經核閱該公司現行有效契約，該公司並未有依合資經營契約規定擁有他公司經營權或他公司擁有該公司經營權之情事。
④為對方資金融通金額達對方總資產之三分之一以上者	無	經核閱該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告、明細帳及銀行借款契約，並未發現該公司有為他公司或他公司為該公司資金融通金額達對方總資產三分之一以上之情事。
⑤為對方背書保證金額達對方總資產之三分之一以上者	無	經核閱該公司經會計師查核簽證或核閱之財務報告、明細帳及銀行借款契約，並未發現該公司有為他公司或他公司為該公司背書保證金額達對方總資產三分之一以上之情事。
(3)申請公司與他公司相互投資各達對方有表決權之股份總數或資本總額三分之一以上者，並互可直接或間接控制對方之人事、財務或業務經營者	無	經核閱該公司最近期之股東名冊及財務報告，持有該公司股份總數或資本總額達三分之一以上之法人股東僅有台積電，然該公司並未有轉投資情事，故該公司未有與他公司相互投資各達對方有表決權股份總數或資本總額三分之一以上，並互可直接或間接控制對方之人事、財務或業務經營之情事。

2.申請公司與他公司間具有下列各款情事之一者，即認為其彼此間具有控制或從屬關係。但經檢具相關事證，證明無控制或從屬關係者，不在此限：

集團企業認定標準	符合集團企業規範之公司	評估說明
(1)申請公司與他公司之董事、監察人及總經理合計有半數以上相同者。其計算方式係包括該等人員之配偶、子女及二親等以內親屬	(1)創意電子股份有限公司	經查該公司之董事、總經理之投資聲明書及親屬表，創意電子股份有限公司與該公司董事及總經理合計有半數以上相同，故符合左列規定標準。
(2)申請公司與他公司之已發行有表決權之股份總數或資本總額，均有半數以上為相同之股東持有或出資者	(1)英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company (2)采鈺科技(股)公司	經核閱該公司最近期之股東名冊、董事及持股10%以上股東之轉投資聲明書、他公司之變更登記事項表及股東會年報，英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company及采鈺科技(股)公司符合左列認定標準之公司。
(3)對申請公司採權益法評價之他投資公司與其關係人總計持有申請公司超過半數之已發行有表決權股份者；或申請公司與其關係人總計持有申請公司採權益法評價之他投資公司超過半數之已發行有表決權股份者(但經檢具相關事證，證明無控制或從屬關係者，不在此限)	無	經核閱該公司最近期之股東名冊及經會計師查核簽證或核閱之財務報告，對該公司採權益法評價之他投資公司係為台積電，其與關係人持有該公司47.57%之股份，並未超過該公司已發行有表決權股份之半數，故未有符合左列認定標準之公司。

綜合以上各項結論，依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心集團企業申請股票上櫃之補充規定」第一條所列各項情形具體評估後，共計有下列30家公司符合集團企業之認定標準。

(二)依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心集團企業申請股票上櫃之補充規定」第二條規定，集團企業中之公開發行公司申請股票上櫃者，應符合下列各項情事：

1.申請公司與同屬集團企業公司之主要業務或產品(指最近二個會計年度均占各該年度總營業收入百分之三十以上者)，無相互競爭之情形且具有獨立行銷之開發潛力者，所稱「相互競爭」，應以企業型態、商品可否替代及對象客戶等一般性要素綜合判斷之

(1)該公司主要從事晶圓級尺寸封裝服務業務，經查核該公司之集團企業計有 30 家，茲將各集團企業公司之主要營業項目列表如下：

①主要從事專業積體電路研發、製造及銷售服務，共計 11 間集團公司。

公司名稱	主要業務或產品
台灣積體電路製造(股)公司	積體電路及其他半導體裝置之銷售業務
TSMC North America	積體電路及其他半導體裝置之銷售業務
TSMC Europe B.V.	市場行銷業務及工程支援業務
TSMC Japan Limited	市場行銷業務
TSMC Korea Limited	客戶服務及技術支援業務
台積電（中國）有限公司	依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路
TSMC Technology, Inc.	工程支援業務
WaferTech, LLC	積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售、測試與電腦輔助設計
TSMC Partners, Ltd.	半導體設計、製造等相關投資業務及一般投資業務
TSMC Design Technology Canada Inc.	工程支援業務
創意電子股份有限公司	積體電路之研發、生產、銷售相關諮詢服務

②主要從事投資業務之公司，共計 11 間集團公司。

公司名稱	主要業務或產品
InveStar Semiconductor Development Fund, Inc.	新創科技事業之投資
InveStar Semiconductor Development Fund, Inc. (II) LDC.	新創科技事業之投資
TSMC Development, Inc.	一般投資業務
TSMC Global Ltd.	一般投資業務
Emerging Alliance Fund, L.P.	新創科技事業之投資
VentureTech Alliance Fund II, L.P.	新創科技事業之投資
VentureTech Alliance Fund III, L.P.	新創科技事業之投資
Growth Fund Limited	新創科技事業之投資
VentureTech Alliance Holdings, LLC	新創科技事業之投資
台積光能投資有限公司	一般投資業務
英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company	半導體設計、製造及相關業務之投資

③主要從事太陽能產品之相關技術、研究開發、製造生產與銷售，共計 4 間集團公司。

公司名稱	主要業務或產品

台積太陽能股份有限公司	可再生能源及節能相關之技術與產品之研究、開發、設計、製造及銷售
TSMC Solar North America, Inc.	太陽能相關產品之銷售業務
TSMC Solar Europe B.V.	太陽能相關產品之銷售業務
TSMC Solar Europe GmbH	太陽能電池模組及相關產品之銷售及客戶服務

- ④主要從事固態照明產品之相關技術、研究開發、製造生產與銷售，共計 2 間集團公司。

公司名稱	主要業務或產品
台積固態照明股份有限公司(註 1)	固態照明裝置及相關應用產品與系統之研究、開發、設計、製造及銷售
TSMC Lighting North America, Inc.(註 2)	固態照明相關產品之銷售業務

註 1：經台積電 104 年 1 月董事會通過其出售案，已於 104 年 2 月底完成處分作業。

註 2：已於 103 年第 3 季清算結束。

- ⑤主要從事電子零組件製造、電子材料批發及零售與無線射頻辨識系統晶片(RFID)之研發及測試業務：相豐科技股份有限公司。

- ⑥主要從事彩色濾光膜製造及測試組裝業務：采鈺科技股份有限公司。

- (2)依據前項彙整，除從事投資為業務之公司外，該公司集團企業大致分為台積電及其子公司、采鈺科技股份有限公司及創意電子股份有限公司，以下茲就該公司主要業務或產品與集團企業競爭情形分析如下：

①台積電及其子公司

台積電成立於 76 年，並於 83 年於台灣證券交易所掛牌上市(股票代號：2330)，是目前全球最大之專業積體電路技術及製造服務業者，於全球晶圓代工市占率約莫五成，係為全球晶圓代工龍頭。台積電全球總部位於台灣新竹科學園區，負責研發、生產及銷售等業務，且服務據點(設置子公司)更遍及日本、韓國、大陸、及美洲與歐洲等地區，提供即時之晶圓代工技術服務及銷售業務，另外，亦設立美國及大陸子公司提供產能支援。近年，台積電除既有主營運項目晶圓代工業務外，亦投入固態照明及太陽能產品研發及生產銷售業務，並分別成立轉投資公司致力前述產業發展。

就企業型態觀之，台積電係定位為半導體產業中上游之專業積體電路技術及製造服務者，向來專注於先進晶圓代工服務，致力於晶圓先進製程之發展。台積電為確保客戶交付之先進晶圓代工訂單，其後在封裝供應鏈上無斷鏈之虞(例如傳統封裝技術無法匹配其先進晶圓製程)，有提供客戶先進封裝解決方案之佈局，惟前述先進晶圓製程主要適用於高端處理器、RF 射頻與記憶體相關產品之整合，其均屬高腳數及高性能

之產品。該公司係定位為專業封裝服務廠商，主係從事晶圓級尺寸封裝及晶圓級後護層封裝服務，專注感測器(Sensor)產品應用及其他封裝需求(3D CSP；3DPPI，低腳數及節能等)，與前述台積電之封裝業務內容完全不同，又該公司之封裝業務均需在上游晶圓廠所提供之晶圓上進行封裝加工作業，係以該公司與台積電及其從事晶圓代工相關業務之子公司實為半導體供應鏈之上下游。綜前所述，可知該公司與台積電之企業型態、主要技術應用及產品(服務)定位並不相同。

就產品(服務)可替代性及對象客戶觀之，半導體產業分工細密，從IC研發設計、晶圓製造、晶圓封裝至晶圓測試等，彼此作業關係緊密且環環相扣。台積電與該公司於半導體產業扮演上下游之角色，分別為客戶提供晶圓製造與晶圓封裝之服務，所提供之技術服務不同，應尚無產品(服務)可替代之情形。

該公司近年度因先進封裝技術已趨成熟且受終端特定客戶青睞，為配合該特定客戶產品上市時程需求暨整體產品的產能供應鏈生產順暢，以致台積電除提供自有的晶圓代工服務外，並建立一條龍式的 turnkey service 確保供應鏈之順暢，以滿足該特定客戶之需求，故有台積電對該公司下單要求提供晶圓級後護層封裝服務，以及由該公司出租相關設備予台積電提供相同封裝服務之情事(相關說明詳「陸、關係人交易」之評估說明)，然前述之關係人交易均係配合該特定客戶之要求所衍生之交易模式。其中，台積電從事與該公司相同封裝服務部分，並非為台積電之主要營業項目，且以台積電最近兩年度之營收淨額新台幣 5,970 億及 7,628 億元視之，所佔比重應不具重大性。此外，該公司除持續精進 CIS(影像感測器)封裝技術外，亦跨足其他感測器之封裝服務，如指紋辨識感測器、微機電等產品，足見該公司具有自主研發能力，且擁有超過 150 項專利，並成功獲得終端客戶之認可，打入國際品牌市場，業已證明該公司亦具備獨立開發產品與客戶之實力。

綜上所述，由於該公司最近二個會計年度及申請年度之主要產品為晶圓級尺寸封裝服務，與台積電及其子公司專注於晶圓製造銷售等服務並不相同外，該公司與台積電無論企業型態、商品(服務)替代性等均尚無構成相互競爭之情形且具有獨立行銷之開發能力。另外，台積電從事太陽能及固態照明業務之子公司因與該公司主營業務及產品屬性完全不同，係以未有主要業務或商品相互競爭之疑慮。

② 采鈺科技股份有限公司

采鈺科技成立於 92 年，主係從事影像感測器之彩色濾光膜之製造。(彩色濾光膜係影像感測器之元件，透過彩色濾光膜用以提升影像色彩)。該公司主要從事影像感測器之封裝業務，係將完成之晶圓與彩色濾光膜之產品，進行晶圓級封裝，故該公司與采鈺係屬產業鏈上下游關

係，雙方定位鮮明且產品核心技術應用迥異，產品(服務)亦無法取代，故應未有主要業務或產品(服務)相互競爭之疑慮。

③創意電子股份有限公司

創意電子係國內首家專業提供系統單晶片 (SoC) 設計代工服務，亦為國內第一大 IC 設計服務公司，同時提供客戶晶圓產品一元化(turnkey)服務，經由與世界級晶圓廠、封裝與測試業者以及其他支援供應商合作，提供客戶從設計到晶圓製造、系統封裝、測試的完整服務。創意電子係以 IC 設計為主要營運導向，並在為客戶縮短產品上市時間下，進行系統封裝業務作為提供終端客戶完整服務，故統籌中下游供應商以提供完成製程服務，而非以晶圓封裝業務為主要營運範疇；又該公司為晶圓級尺寸封裝與創意電子之系統封裝技術並不相同，故該公司與創意電子之主要營運產品定位鮮明且產品核心技術應用迥異。

另就產品可替代性及對象客戶觀之，創意電子主係從事 IC 設計與 ASIC(特殊用途之 IC)及晶圓產品一條龍式解決方案(Turnkey Service)，晶圓中下游製程係委託專業代工廠負責生產光罩、晶圓、切割與封裝等作業，而該公司為晶圓中下游之封裝廠商，故創意電子主要營業項目尚無法替代該公司之封裝業務。且創意電子主要客戶大多為終端品牌大廠，然該公司因係屬半導體產業下游供應商，主要客戶多為晶圓設計公司，故雙方應未有主要業務或商品相互競爭之疑慮。

綜上評估，就企業型態、商品可否替代及對象客戶等要素綜合評估，該公司與同屬集團企業公司之主要業務或產品(服務)尚無發生重大相互競爭情形。

2.申請公司與同屬集團企業公司間有業務往來者，除各應就相互間之財務業務相關作業規章訂定具體書面制度，並經董事會通過

該公司業已訂定「關係人及集團交易作業程序」並經董事會決議通過，規範該公司與集團企業間之財務業務交易往來事宜。另該公司與同屬集團企業公司間有業務往來者，已各出具無非常規交易情事之書面聲明，另對於無業務往來之集團企業，該公司業已書面承諾日後有往來時必無非常規交易之情事，並於公開說明書中充分揭露。

3.其財務業務狀況及前述之作業辦法與其他同業比較應無異常現象

該公司財務業務狀況及訂定之「關係人及集團交易作業程序」係參酌同業已制定之辦法，且考量本身業務經營狀況修訂完成，並無重大異常。

4.申請上櫃會計年度及最近二會計年度之進貨或營業收入金額來自集團企業公司不超過百分之五十。但對於來自母、子公司之進貨或營業收入金額，或依據公司法、企業併購法辦理分割者，不適用之。如係基於行業特性、市場供

需狀況、政府政策或其他合理原因所造成者，得不適用

該公司最近二年度銷售產品予集團企業之金額分別為862,283仟元及1,732,290仟元，佔營收淨額比重分別為20.26%及35.11%，可見該公司之主要銷售來源並非來自集團企業，且該公司應具有獨立行銷之能力。

(三)申請時屬母子公司關係者，母公司申請其股票上櫃者，依據櫃檯買賣中心審查準則有關規定辦理；子公司申請其股票上櫃者，雖合於同準則有關規定，但不能符合下列各款情事，櫃檯買賣中心認為不宜上櫃者，應不同意其股票上櫃：

該公司於102年6月董事全面改選後，台積電未能取得該公司董事會多數表決權之權力，且主張對該公司之財務及營運決策不再具有主導能力，故自102年6月起未再將該公司列入合併個體，故該公司非以母子公司申請上櫃，不適用本款之評估。

(四)結論

綜上所述，本推薦承銷商業依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心集團企業申請股票上櫃之補充規定」所列各項認定標準逐項評估，該公司應未有違反集團企業申請股票上櫃補充規定之情事。

二、評估本國申請公司是否符合建設公司、資訊軟體公司、投資控股公司、金融控股公司、參與公共建設之民間機構申請股票上櫃之補充規定

該公司非屬建設公司、資訊軟體公司、投資控股公司、金融控股公司、參與公共建設之民間機構申請股票上櫃，故不適用。

三、評估外國申請公司是否符合「外國有價證券櫃檯買賣審查準則」第十六條至第十九條有關集團企業及第二十條至第二十三條有關投資控股公司之規定

該公司非屬外國申請公司申請股票上櫃，故不適用。

拾肆、以投資控股公司身分申請其股票為櫃檯買賣者，推薦證券商亦應就其被控股公司依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃之推薦證券商評估報告應行記載事項要點」第五條、第七條第四項、第十條及第十一條規定逐項評估

該公司非以投資控股公司身分申請其股票為櫃檯買賣，故不適用。

拾伍、本國上櫃（市）公司之海外子公司申請其股票為櫃檯買賣者，推薦證券商應就下列事項詳加評估說明

該公司非本國上櫃（市）公司之海外子公司申請其股票為櫃檯買賣，故不適用。

拾陸、自推薦證券商評估報告完成日起至股票上櫃用公開說明書列印日前，如有重大期後事項，推薦證券商對上列各項目應加以更新說明與評估

該公司尚無應揭露之期後事項。

拾柒、其他補充揭露事項

截至評估報告出具日止該公司尚無其他補充揭露事項。

附件一、依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所有價證券審查準則」第十條第一項所列各款不宜上櫃情事，推薦承銷商審查意見

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
一、有證券交易法第 156 條第一項第一至三款所列情事者： (一)發行該有價證券之公司遇有訴訟事件或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計劃、財務狀況或停頓生產，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。	(一)經查閱該公司最近三年度及申請年度截至目前為止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、相關帳冊資料及主管機關往來函文、取得該公司出具之聲明書，並參酌維和法律事務所莊振農律師所出具之法律意見書，該公司最近三年度及申請年度截至目前為止發生之訴訟及非訟案件彙列如下： 1.確認僱傭關係民事訴訟案 該公司作業員湯君因足部病痛，經勞工保險局100年8月16日保給傷字第10010173570號函認定為職業傷病，湯君主張其於復健治療期遭調動工作多次，並於101年11月30日經該公司終止其勞動契約並資遣，雖分別在101年10月12日及101年11月19日向桃園縣人力資源管理協會及桃園縣政府勞資爭議調解委員會申請勞資調解，然未達成共識，故湯君於102年1月11日向台灣桃園地方法院提起確認僱傭關係存在之民事訴訟，103年6月20日業經台灣桃園地方法院判決，該公司一審敗訴在案，該公司另於103年7月19日再提起第二審上訴，然經評估業於103年7月25日與湯君達成庭外和解，約定由湯君撤回訴訟，並於103年8月13日向台灣桃園地方法院遞狀撤回本訴訟案。依據和解書之約定該公司應分三次給付湯君和解金(共計2,139仟元)，截至本評估報	✓			

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	告出具日止，該公司業已支付1,426千元，尚餘713千元亦將依約定付款，對該公司之財務業務並無重大不利影響。 2.返還價金民事訴訟案 (1)利昌案 該公司為進行機台設備升級，於99年12月30日與利昌機電企業社(以下簡稱利昌)簽訂機器開發契約，並依契約約定於100年8月30日以採購單號2000010755委由利昌進行一批機台設備之升級工程，總價為7,875千元(含稅)，該公司並於100年11月18日支付工程款50%之訂金共3,938千元(含稅)予利昌，然因設備逾期未能開發完成，故該公司於102年3月22日寄發存證信函通知利昌解除契約並要求返還已付價款3,938千元與利息，並於102年5月14日向台灣桃園地方法院提起返還價金之民事訴訟，本案業於103年2月13日經台灣桃園地方法院民事判決確定，該公司獲得勝訴，判決應由利昌返還之3,938千元款項及按月認列預付設備款返還應加記之利息收入計271千元。該公司已依強制執行法第27條聲請核發債權憑證，並止付應付利昌之設備款631千元。截至103年度，因利昌及其負責人無資產及所得可供執行且經多次約訪負責人未果，該公司評估無法收回之可能性極高，故於103年度認列損失計3,578千元。此案件對該公司之財務業務並無產生重大影響。 (2)鋒華案				

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	該公司向鋒華科技(股)公司(以下簡稱鋒華)購買晶圓 Tray 盤翻轉機一批，總價為 3,150 仟元(含稅)，該公司已依採購訂單先給付總價 80%即 2,520 仟元(含稅)予鋒華，然因鋒華所交付晶圓 Tray 盤翻轉機並未符合採購訂單所定規格，致無法完成驗收，該公司要求限期改正，然鋒華仍逾期未改正，故該公司於 102 年 12 月 31 日通知鋒華以書面解除此採購訂單，並於 103 年 1 月 10 日向台灣桃園地方法院提起返還價金之民事訴訟，要求鋒華返還其已付價款與利息。截至目前為止，本案件由台灣桃園地方法院民事庭審理中，尚不致對該公司之財務業務產生重大影響。 (3)一寶案 該公司向一寶科技(股)公司(以下簡稱一寶)採購 Lam 蝕刻機台，原已支付價金 10,105 仟元(未稅)，然一寶未達該公司所要求之特定蝕刻程度，且不斷要求展期致無法完成驗收，該公司遂於 103 年 2 月 19 日寄發存證信函要求其限期改善，然一寶拒絕該公司之要求，故該公司於 103 年 3 月 10 日再度寄發存證信函通知一寶解除此採購訂單，並於 103 年 3 月 31 日向台灣桃園地方法院提起返還價金之民事訴訟，要求一寶返還其已付價款與利息。一寶已於 103 年 7 月 3 日經台灣桃園地方法院判決敗訴，其另於 7 月 28 日提起二審上訴，然因未繳納裁判費，於 103 年 9 月 9 日經法院裁定予以駁回，一寶逾上訴期間已				

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	無法再上訴，本案已取得法院判決確定證明書並依法進行強制執行程序。該公司經評估扣除尚可回收金額 2,503 仟元並加計原機台配管資本支出 1,560 仟元後，於 103 年度認列其他營業損失 9,162 仟元，然此案件對該公司之財務業務並無產生重大影響。 3.妨害秘密之刑事告訴案 該公司主張員工呂君於在職時將該公司建置生產線及設備規格等資料以電子郵件寄發至競爭對手之供應商，楊君等四人則涉嫌協助呂君或將該公司機密檔案寄至私人信箱，且前述五人先後於98年~99年間自該公司離職，並先後至競爭對手宏寶科技(股)公司任職，該公司遂主張呂君等五人違反保密條款，並有利用電腦洩露秘密罪嫌、背信罪嫌及無故取得電磁紀錄罪嫌，而於99年6月7日向台灣新竹地方法院檢察署提起刑事訴訟。呂君等五人雖承認利用電子郵件寄發檔案，然並未為自己及第三人圖任何不法利益，該公司舉證不足無法證明呂君等五人上開行為造成之損害，業於101年1月9日分別與前述五人達成和解，並撤回告訴，呂君及楊君之和解書中除為前述行為道歉外，並承諾若有違反保證事項除負擔民、刑事責任外，尚須給付該公司200萬之懲罰性違約金，其餘三名離職員工亦為前述行為道歉，且承諾應盡永久保密義務。因本案件已達成和解，對該公司財務業務尚無產生重大影響。 4.非訟案 強友企業股份有限公司(以下				

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	簡稱強友)所提供之晶圓框架規格與品質未符合該公司要求，雙方經由多次開會及103年2月20日經桃園縣中壢市調解委員會調解後，協議該公司退還該等框架予強友，該公司並需支付該筆訂單之50%貨款共計1,772仟元(含稅)(帳列雜項購置)予強友，該公司已於103年3月3日付訖，對該公司之財務業務並無重大影響。 綜上所述，截至目前為止，尚有 1 案仍在審理中，其餘 5 案已和解或勝訴，前述訴訟案件對該公司均不足使公司解散或變動其組織、資本、業務計劃、財務狀況或停頓生產，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。				
(二)發行該有價證券之公司，遇有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計劃之重要內容，或退票，其結果足使公司之財務狀況有顯著重大之變更，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。	(二)經參閱該公司最近三年度及申請年度截至目前為止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、與主管機關往來函文、現行有效之重要契約、勞務費、其他費用及其他營業外收入及費用等相關明細分類帳及向台灣票據交換所取具有關該公司之無退票紀錄，並參閱維和法律事務所莊振農律師出具之法律意見書，及取得該公司出具之聲明書，該公司於 101 年 7 月 30 日因一批待驗收之空氣污染防制設備等機台發生燒燬事件，雖未造成其他災害，然因該批設備已無法再行使用，故於 101 年 12 月 31 日將已支付之設備款共計 22,181 仟元全數認列為減損損失，並於 103 年 6 月 23 日至 30 日取得保險公司給付之理賠收入共計 8,851 仟元(帳列保險理賠收入)，對該公司之財務業務並無產生重大影響。 前述重大災害事件其結果不足使公	✓			

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	司之財務狀況有顯著重大之變更，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。				
(三)發行該有價證券公司之行為，有虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。	(三)經詢問該公司並取得該公司出具之聲明書，並參閱該公司最近三年度及申請年度截至目前為止之董事會、股東會議紀錄、與主管機關往來函文，並參閱維和法律事務所莊振農律師所出具之法律意見書，該公司截至目前為止並無虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。 綜上所述，該公司並無有證券交易法第 156 條第一項第一至三款所列情事，或其行為有虛偽不實或違法情事，結果足以影響其證券價格，而及於市場秩序或損害公益之情形。	✓			
二、財務或業務未能與他人獨立劃分者。		✓			
(一)資金來源過度集中於非金融機構。	(一) 經參閱該公司最近三年度及申請年度截至目前為止經會計師查核簽證或核閱之財務報告、相關明細帳及取具該公司出具之聲明書，尚未發現該公司有向非金融機構借款之情事。				
(二)申請公司與他人簽訂對其營運有重大限制或顯不合理之契約，致生不利影響之虞者。	(二) 經核閱該公司截至目前之存續有效重要契約及取具該公司出具之聲明書，並未發現有與他公司簽訂對其營運有重大限制或顯不合理之契約，致生不利影響之情事。				

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
(三)與他人共同使用貸款額度而無法明確劃分者，但母子公司間共用貸款額度，不在此限。	(三) 經詢問該公司相關人員並參閱該公司最近三年度及申請年度截至目前為止經會計師查核簽證或核閱之財務報告、借款合同及取具該公司所出具之聲明書，該公司並無與他人有共同使用貸款額度而無法明確劃分之情事。 綜上評估，該公司並無財務業務未能與他人獨立劃分之情事。				
三、發生重大勞資糾紛或重大環境污染之情事，尚未改善者。 (一)重大勞資糾紛部分：	(一)重大勞資糾紛 1. 經查閱該公司最近三年度及申請年度截至目前為止與主管機關往來函文、明細帳、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、勞資會議紀錄，取得員工訪談紀錄表、該公司出具之聲明書，並參酌維和莊振農律師出具之法律意見書等，該公司除下列數起非重大之勞資爭議外，並無發生足以影響其財務業務正常營運之重大勞資糾紛： (1)依 100 年迄今之桃園縣政府勞動及人力資源局及相關單位函文通知，該公司分別與數名離職員工進行勞資爭議調解，均已和解或支付相關慰問金或工資，惟金額均屬微小。 (2)依行政院勞工委員會北區勞動檢查所 100 年 8 月 22 日及桃園縣政府 102 年 6 月 20 日之函文，該公司因違反勞動基準法第 32 條第 2 項規定，致 2 名員工有超時工作情事，該公司業依規定繳納共計 6	✓			

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	萬元之罰鍰，且已加強宣導相關事宜，落實排班制度。 (3)與湯君之確認僱傭關係民事訴訟案，請詳不宜條款第一款之說明。 2. 取得該公司職工福利委員會章程及設立資料，並抽核職工福利金提撥情形，尚無重大異常之情事。另該公司亦已依勞動基準法之規定設立勞工退休準備金監督委員會，並按月依退休準備金提撥率提撥，儲存於台灣銀行信託部退休準備金專戶；於勞工退休金新制條例實施後，亦依相關辦法提繳新制勞工退休金。 3. 經查閱該公司最近三年度及申請年度截至目前為止與主管機關往來函文，該公司並未因安全衛生設施不良而發生重大職災；或違反勞工安全衛生法被處以部分或全部停工者；或設置危險性機械、設備未檢查合格之情形。 4. 經抽核該公司勞、健保費繳納情形並函詢勞工保險局及中央健康保險局，該公司並無積欠勞工保險費、健保費及滯納金之情事。				
(二)重大環境污染之評估	(二)重大環境污染之評估 1. 經參閱該公司最近三年度及申請年度截至目前為止與主管機關往來函文，該公司並無依法令應取得汙染相關設置及操作許可證而未取得之情形。 2. 經查閱該公司最近三年度及申請年度截至目前為止與主管機關往	✓			

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	來函文、經會計師查核簽證或核閱之財務報告，另函詢桃園縣政府環境保護局，該公司除 2 起因廢棄物標示不清遭罰鍰處分，且其金額微小並已立即改善外，並未有違反環保法令之紀錄，且並無因環境污染而經環保機關按日連續處法或經限期改善，而未完成改善之情事。 3. 經查閱該公司最近三年度及申請年度截至目前為止與主管機關往來函文、經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司並無發生公害糾紛而無有效汙染防治設備，或未能提供汙染防治設備之正常運轉及定期檢修紀錄者之情事。 4. 經查閱該公司最近三年度及申請年度截至目前為止與主管機關往來函文、經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司並無因環境汙染情事而經有關機關命令停工、停業、歇業或撤銷汙染相關許可證者之情事。 5. 經查閱該公司最近三年度及申請年度截至目前為止與主管機關往來函文、經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司並無將廢棄物任意棄置或未依相關規定貯存、清除、處理或餘處理過程中造成環境重大汙染，因而致人於死或致重傷或危害人體健康導致疾病之情事。 6. 經查閱該公司最近三年度及申請年度截至目前為止與主管機關往來函文、經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司並非經中央主				

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	管機關指定公告之事業，其土地亦無因汙染土壤或地下水而被公告為控制場址或整治場址之情事。 7. 經查閱該公司最近三年度及申請年度截至目前為止與主管機關往來函文、經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司並無製造、加工或輸入偽禁環境用藥情事，其負責人經判刑確定者。 綜上所述，該公司並無發生重大勞資糾紛或重大環境污染，而尚未改善之情事。				
四、有重大非常規交易迄申請時尚未改善者	(一)進銷貨交易 經參閱該公司最近三年度及申請年度截至目前為止經會計師查核簽證或核閱之財務報告，並抽核該公司與關係人及主要進、銷貨對象之交易憑證，該公司與關係人及主要進、銷貨廠商及客戶之進銷貨條件及收付款情形，並無發現重大差異，亦未發現該公司進、銷貨交易之目的、價格、條件或交易發生過程及，或其交易之發生，或其交易之實質與形式，或其交易之處理程序與一般正常交易有顯不相當或顯欠合理而尚未改善之情事。 (二)取得或處分資產 該公司已依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」訂定「取得或處分資產處理程序」，並經董事會決議通過後提請股東會同意。另該公司於92年12月29日經證期局核准公開發行，經檢視自公開發行日迄申請上櫃日前之相關交易資料，其應行公告及申報之取得或處分資產交易，均依相關規章辦理，其取得或處分資產之交易行為均依上述作業辦法執行，且經評估其內	✓			

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	部決定過程之合法性、交易之必要性，或其有關報表揭露之充分性，暨價格與款項之收付，尚無重大異常或不合理之情事。 (三)不動產交易 經查閱該公司董事會議事錄、經會計師查核簽證或核閱之財務報告、財產目錄及會計帳冊資料，該公司於最近五年內並無向關係人買賣不動產之情事，此外該公司最近五年內亦無對關係人銷售或租賃不動產所產生之營業收入。 (四)資金貸與他人 該公司訂有「資金貸與他人作業辦法」，經查閱該公司董事會議紀錄、相關帳簿資料、最近一年度及申請年度經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司最近一年內並無實際資金貸與他人之情事。 綜上所述，該公司並無重大非常規交易迄申請時尚未改善之情事。				
五、申請上櫃會計年度已辦理及辦理中之增資發行新股併入最近一年度財務報告所列示股本計算，其獲利能力不符合上櫃規定條件者	經查閱該公司經濟部核准變更登記之變更登記表、最近一年度及申請年度截至最近期止之董事會及股東會議事錄等相關文件，該公司並無辦理盈餘或資本公積轉增資。該公司於申請年度送件時之股本為 2,380,508 千元，另為辦理上櫃前之公開承銷，預計辦理現金增資 300,000 仟元，故預計股票上櫃掛牌時之實收資本額為 2,680,508 仟元，其獲利能力評估如下： 該公司無須編製合併報表，其 102 年度個別財務報表之稅前純益為 348,763 仟元，佔併入增資新股後資本額 2,680,508 仟元之比率為 13.01%，達 4% 以上，且 102 年度並無累積虧損，其獲利能力尚符合上櫃規定條件。	✓			

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
六、未依相關法令及一般公認會計原則編製財務報告，或內部控制、內部稽核及書面會計制度未經健全建立且有效執行，其情節重大者。	(一)是否依相關法令及一般公認會計原則編製財務報告之評估如下： 1.經參酌該公司最近三年度及申請年度截至目前為止經會計師查核簽證之財務報告，101 年度~103 年度是由勤業眾信聯合會計師事務所林鴻鵬及黃裕峰會計師出具無保留意見之查核報告，未有會計師出具否定意見或無法表示意見之查核報告書，或經會計師出具保留意見之查核報告書而影響財務報告之允當表達者，且均依有關法令及一般公認會計原則編製。 2.經參酌該公司最近三年度及申請年度截至目前為止經會計師查核簽證或核閱之財務報告及與主管機關之往來文件，並未發現該公司有經主管機關函示財務報告有應改進事項而未改進之情事。 3.經參酌該公司最近三年度及申請年度截至目前為止經會計師查核簽證或核閱之財務報告及會計師查核工作底稿，並未發現有重大缺失致無法確認財務報告是否允當表達者。 (二)是否有未建立及未有效執行內部控制、內部稽核及書面會計制度之評估： 1.該公司業已訂定內部控制制度及內部稽核制度，並依「證券發行人財務報告編製準則」之規定編製書面會計制度，均經均該公司董事會通過在案，且據以有效執行，經抽核內控循環之相關表單，尚無重大異常情形。 2.根據勤業眾信聯合會計師事務所林鴻鵬及黃裕峰會計師針對該公司之內部控制及內部稽核作業執行情形於 103 年 9 月 15 日出具無保留意見之內部控制專案審查報告（審查期	✓			

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	間為 102 年 7 月 1 至 103 年 6 月 30 日)，故該公司內部控制及內部稽核制度之建立及執行應屬有效。 綜上所述，該公司已依相關法令及一般公認會計原則編製財務報告，且內部控制、內部稽核及書面會計制度亦健全建立且有效執行。				
七、公司或申請時之董事、監察人、總經理或實質負責人於最近三年內，有違反誠信原則之行為者。	(一)公司部分 1.經取得第一類票據信用資料查覆單、財團法人金融聯合徵信中心出具之信用報告、該公司出具之聲明書及維和法律事務所莊振農律師之法律意見書，該公司最近三年度及申請年度截至目前為止所開立之支票存款戶，並未有經票據交換所公告為拒絕往來戶，或因簽發支票或以金融業為擔當付款人之票據，發生存款不足退票列入記錄，未經達成櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第十二條第四項所列之補正程序並檢附相關書件證明之情事。 2.經取得財團法人金融聯合徵信中心出具之綜合信用報告回覆書及抽核該公司銀行借款還款紀錄，該公司最近三年度及申請年度截至目前為止並無向金融機構貸款有逾期還款之情事。 3.經函詢勞工主管機關及核閱該公司提供與主管機關之往來函文、取得該公司出具之聲明書及維和法律事務所莊振農律師出具之法律意見書，並未發現該公司有違反勞動基準法經判決有罪確定之情事。 4.經取得國稅局及稅捐稽徵處無違章欠稅紀錄證明、查閱該公司與稅捐稽徵機關之往來函文、取得該公司聲明書及維和法律事務所莊振農律師出具之法律意見書，該公司並無違反稅	✓			

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	捐稽徵法經判決有罪確定之情事。 5.經參閱維和法律事務所莊振農律師出具之法律意見書並取得該公司出具之聲明書，該公司並無違反申請上櫃時所出具聲明書之聲明事項。 6.經參閱該公司之股東會年報、最近三年度及申請年度截至目前為止經會計師查核簽證或核閱之財務報告、股東會或董事會會議紀錄及與主管機關往來函文，並取得維和法律事務所莊振農律師出具之法律意見書及該公司出具之聲明書，該公司並無其他重大虛偽不實、違反法令或喪失公司債信，而有損害公司利益、股東權益或公眾利益之情事。 (二)董事、監察人、總經理或實質負責人部分 1.經對該公司之董事、總經理或實質負責人執行上述(一)1.~5.公司部份所述之查核，未發現該公司之董事、總經理及實質負責人有違反誠信原則之情事。(該公司係設置審計委員會以取代監察人之職能) 2.經核閱該公司股東會年報、最近三年度及申請年度截至目前為止經會計師查核簽證或核閱之財務報告、取得該公司董事、總經理或實質負責人出具之聲明書、維和法律事務所莊振農律師出具之法律意見書及投保中心回函，尚無發現該公司董事、總經理或實質負責人有觸犯公司法、銀行法、保險法、金融控股公司法、證券交易法、期貨交易法、商業會計法、票券金融管理法等商事法所定之罪，或貪污、瀆職、詐欺、背信、侵佔等罪，經法院判決有期徒刑以上之刑者。 3.經核閱該公司股東會年報、取得該公				

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明									
		是	否	不適用										
	司董事、總經理或實質負責人出具之聲明書及維和法律事務所莊振農律師出具之法律意見書，尚無發現該公司董事、總經理或實質負責人有經營其他公司涉及惡性倒閉等不良經營行為之情事。 4.經取得該公司之董事、總經理及實質負責人之聲明書及維和法律事務所莊振農律師之法律意見書，該公司董事、總經理或實質負責人並無其他重大違反法令或誠實信用原則之行為。 5. 經取得該公司董事出具之聲明書，該公司法人董事-台積電有若干專利權訴訟案件如下所示： <table><tr><th>訴訟/ 非訟/ 行政爭 訟事件</th><th>訴訟相對人</th><th>訴訟原因及過程</th></tr><tr><td>專利權 侵害訴 訟</td><td>Keranos</td><td>Keranos 於 99 年 6 月，在美國東德州地方法院對台積電、TSMC North America 以及數十家居於領先地位的科技公司，提出對三篇已過期的美國專利之專利權侵害訴訟。 99 年 11 月，台積電、TSMC North America 以及德州訴訟案件中的數家共同被告在美國北加州地方法院提出訴訟，要求判決該等公司並未侵害 Keranos 公司的專利權以及判決訴訟標的專利權為無效。 此兩訟案已於美國東德州地方法院併成一案處理。103 年 2 月，法院宣布有利於台積公司之判決，駁回 Keranos 提出之所有請求。103 年 3 月，Keranos 於美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴。</td></tr><tr><td>專利權</td><td>Ziptronix</td><td>Ziptronix 於 99 年 12</td></tr></table>	訴訟/ 非訟/ 行政爭 訟事件	訴訟相對人	訴訟原因及過程	專利權 侵害訴 訟	Keranos	Keranos 於 99 年 6 月，在美國東德州地方法院對台積電、TSMC North America 以及數十家居於領先地位的科技公司，提出對三篇已過期的美國專利之專利權侵害訴訟。 99 年 11 月，台積電、TSMC North America 以及德州訴訟案件中的數家共同被告在美國北加州地方法院提出訴訟，要求判決該等公司並未侵害 Keranos 公司的專利權以及判決訴訟標的專利權為無效。 此兩訟案已於美國東德州地方法院併成一案處理。103 年 2 月，法院宣布有利於台積公司之判決，駁回 Keranos 提出之所有請求。103 年 3 月，Keranos 於美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴。	專利權	Ziptronix	Ziptronix 於 99 年 12				
訴訟/ 非訟/ 行政爭 訟事件	訴訟相對人	訴訟原因及過程												
專利權 侵害訴 訟	Keranos	Keranos 於 99 年 6 月，在美國東德州地方法院對台積電、TSMC North America 以及數十家居於領先地位的科技公司，提出對三篇已過期的美國專利之專利權侵害訴訟。 99 年 11 月，台積電、TSMC North America 以及德州訴訟案件中的數家共同被告在美國北加州地方法院提出訴訟，要求判決該等公司並未侵害 Keranos 公司的專利權以及判決訴訟標的專利權為無效。 此兩訟案已於美國東德州地方法院併成一案處理。103 年 2 月，法院宣布有利於台積公司之判決，駁回 Keranos 提出之所有請求。103 年 3 月，Keranos 於美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴。												
專利權	Ziptronix	Ziptronix 於 99 年 12												

項 目	就具體認定標準逐一評估情形			是否適宜上櫃			說明
				是	否	不適用	
	侵害訴訟		月，在美國北加州地方法院對台積電、TSMC North America 以及另一公司，提出對若干美國專利之專利權侵害訴訟。 103 年9 月，法院作成有利於台積電及 TSMC North America 之判決 (Summary Judgment)。Ziptronix 可對上述法院判決提出上訴。				
	專利權侵害訴訟	Zond	Zond 於 102 年 9 月，於美國麻州地方法院對台積電、部分台積電子公司以及其他公司，提出對若干美國專利權之專利權侵害訴訟。法官於 103 年6 月裁定暫停該案之訴訟審理。其後，台積電及 Zond 於美國德拉瓦州地方法院及美國麻州地方法院對 Zond 的若干其他美國專利各自提出訴訟。				
	專利權侵害訴訟及不當使用營業秘密及違反合約訴訟	Tela Innovations (簡稱 Tela)	Tela 於 102 年 12 月，於美國德拉瓦州地方法院及美國國際貿易委員會對台積電及 TSMC North America 提出對一篇美國專利之專利權侵害訴訟。台積電於 103 年1 月於美國北加州地方法院對 Tela 提起不當使用台積電之營業秘密及違反合約之訴訟。雙方已於 103 年9 月撤回上述美國德拉瓦州地方法院、美國國際貿易委員會及美國北加州地方法院之案件。				
	專利權侵害訴訟	DSS Technology Management, Inc.(簡稱 DSS)	DSS 於 103 年 3 月，於美國東德州地方法院對台積電、TSMC North America 及 TSMC Development 及若干				

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	其他公司提出對一篇美國專利之專利權侵害訴訟。 經評估上述案件均因該法人董事本身業務所致，目前尚無因違反誠信原則而遭判決有期徒刑，且同時該等事件與該公司並無實質上或法律上之牽連關係，其審理程序及判決結果均不致影響該法人董事執行該公司董事之職務，故對該公司之營運應無重大不利影響。 綜上所述，該公司或申請時之董事、總經理或實質負責人於最近三年度內尚無違反誠信原則之行為。				
八、申請公司之董事會或監察人，有無法獨立執行其職務者。	(一)經查閱該公司最近期經濟部核准之變更登記事項表，該公司現有董事共計七席，包括台灣積體電路製造(股)公司(以下簡稱台積電)法人代表人-關欣、台積電法人代表人-林錦坤、台積電法人代表人-何麗梅、台灣豪威投資控股(股)公司法人代表人-Hongli Yang、王文宇、徐中時及謝徽榮。其中，王文宇、徐中時及謝徽榮係為獨立董事，符合申請公司之公司章程-董事五至七人，其中獨立董事至少三人之規定。 (二)該公司係由全體獨立董事組成審計委員會並取代監察人制度，故不適用監察人至少三人之規定。 (三)經核閱該公司全體董事之轉投資資料及親屬表，其中除關欣、林錦坤及何麗梅等三席董事同屬台積電之法人代表人外，其餘董事彼此間並未具有配偶、二親等以內之親屬關係，亦無同一法人代表人之情事，故該公司董事會尚能獨立執行其職務。 (四)獨立董事任職條件之評估 1.經檢視該公司股東會議事錄及變更	✓			

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	事項表，該公司三席獨立董事-王文宇、徐中時及謝徽榮均以自然人身分當選，非為公司法第 27 條所定之法人或其代表人；另取具上述該人員所出具之聲明書，聲明亦無公司法第 30 條各款所列之情事。 2.獨立董事選任程序評估： 經參閱該公司章程，該公司獨立董事之選舉係依公司法192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定採候選人提名制度，三位獨立董事之選舉係於102年4月12日董事會通過受理股東提名獨立董事之期間及處所，並經102年5月3日董事會通過獨立董事選舉審核案，且於102年6月13日股東常會選任為獨立董事，其選任程序皆依規定辦理。 3.獨立董事資格要件評估： 經查閱獨立董事王文宇、徐中時及謝徽榮之學經歷資料，分別說明如下： (1)獨立董事王文宇 ①學歷：美國史丹佛大學法學博士 ②經歷： A.台灣期貨交易所監察人 B.台灣法學會理事 C.84.08~91.07：國立台灣大學法律學院法律學系副教授 D.91.08-102.01：國立台灣大學法律學院法律學系教授 E.102.02迄今：國立台灣大學法律學院科際整合法律學研究院教授 (2)獨立董事徐中時 ①學歷：美國哥倫比亞大學物理博士 ②經歷： A.韓國三星電子公司研發處長				

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	B.89.11~92.12：台積電副總經理 C.95.05~98.02：世界先進積體電路(股)公司總經理 D.98.02~99.02：世界先進積體電路(股)公司資深顧問 (3)獨立董事謝徽榮 ①學歷：國立台灣大學商學研究院碩士 ②經歷： A.美商美國銀行副總經理 B.84.02~100.04：世界先進積體電路(股)公司副總經理 綜上所述，該公司獨立董事均具有五年以上商務、法律、財務或公司業務所需之工作經驗，其中獨立董事謝徽榮為會計或財務之專業人士，符合需有一人以上為會計或財務專業人事資格之規定。 4.獨立董事獨立性身分評估： (1)經查閱該公司員工名單、關係企業董監名單、取得該公司獨立董事之聲明書及其工作資歷證明，上述獨立董事均未於選任前二年及任職期間於該公司或其關係企業任職，且未擔任該公司關係企業之董事、監察人及受僱人。 (2)經查閱該公司之股東名冊、獨立董事之聲明書及親屬表，上述獨立董事並無本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數百分之一以上或持股前十名之自然人股東之情事。 (3)經查閱該公司之股東名冊、獨立董事之聲明書及親屬表，上述獨立董事之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬非為該公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人，亦非直接或間接持有該公司已				

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	發行股份總數百分之一以上之自然人股東或持股前十名之自然人股東等人員。 (4)經查閱該公司之股東名冊、獨立董事之聲明書及任職相關資料，上述獨立董事並非直接持有該公司已發行股份百分之五以上法人股東之董事、監察人、受僱人或持股前五名法人股東之董事、監察人、受僱人。 (5)經取具獨立董事之聲明書、轉投資及任職相關資料，上述獨立董事並非與該公司有財務業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。 (6)經查閱該公司之明細帳、取具獨立董事之聲明書、轉投資及任職相關資料，上述獨立董事並非為申請公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 5.該公司獨立董事皆已就法律、財務或會計等專業知識進修達達三小時以上並取得進修體系所出具之研習證明。 6.經取具獨立董事之聲明書及其轉投資資料，王文字兼任萬泰銀行、創意電子及統一超商公司獨立董事，而謝徽榮兼任茂達電子及非公開發行公司-寶勝國際(控股)公司獨立董事。然上述獨立董事均尚無兼任其他公開發行公司之獨立董事超過三家以上之情事。此外，依「公司發行公司獨董設置及應遵循辦法」第 3 條第 1 項第 2 款之規定，以及「公司治理問答集-獨立董事篇」定義所稱				

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	之「關係企業」應依公司法關係企業專章之規定認定，獨立董事王文宇雖於當選該公司獨立董事之前二年及任職期間(100.06.13 迄今)，同時擔任創意電子之獨立董事職務，惟依公司法第 369 條評估，創意電子與該公司非屬關係企業，故獨立董事王文宇仍符合獨立董事消極資格之規定；獨立董事徐中時及謝徽榮雖曾任職於世界先進，依公司法第 369 條評估，世界先進亦非該公司之關係企業，且前述兩席獨立董事業於選任該公司獨立董事前兩年(100.06.13 前)均已自世界先進辭職或退休，故均符合獨立董事之消極資格規定。 綜上所述，該公司之董事會並未有無法獨立執行其職務之情形。				
九、申請公司於申請上櫃會計年度及其最近一個會計年度已登錄為證券商營業處所買賣興櫃股票，於掛牌日起，其現任董事、監察人及持股超過其股份總額百分之十之股東，有未於興櫃股票市場，而買賣申請公司發行之股票情事者。但因辦理第四條之承銷事宜或有其他正當事由者，不在此限。	經查詢該公司於公開資訊觀測站申報之資料，該公司自 93 年 9 月 8 日登錄為證券商營業處所買賣興櫃股票迄今，並未發現該公司現任董事、監察人及持股超過股份總額百分之十之股東，有未於興櫃股票市場買賣該公司股票之情事。	✓			
十、上櫃(市)公司進行分割之分割受讓公司於申請上櫃前三年內，被分割公司為降低對分割受讓公司之持股比例所進行之股權分散行為，有損及被分割公司之股東權益者。	該公司並非以上櫃(市)公司分割受讓公司型態申請上櫃，故不適用本條款。	✓			
十一、所營事業嚴重衰退者。	該公司 102 年度之稅前淨利不包含非控制權益之淨利為 348,763 仟元，股本	✓			

項 目	就具體認定標準逐一評估情形	是否適宜上櫃			說明
		是	否	不適用	
	為2,364,018仟元，稅前淨利不包含非控制權益之淨利占股本之比率為14.75%，大於6%，而103年度之稅前淨利不包含非控制權益之淨利為659,926仟元，股本為2,381,207仟元，稅前淨利不包含非控制權益之淨利占股本之比率為27.71%，大於6%，故不適用本款具體認定標準之相關評估。				
十二、其他因事業範圍、性質或特殊情況，本中心認為不宜上櫃者。	經查詢該公司董事會、股東會議事錄及相關帳冊，尚未發現該公司有因事業範圍、性質或特殊情況，而有不宜上櫃之情事。	✓			

推薦證券商：凱基證券股份有限公司



評估人簽章：劉其方



莊淑蕙



陳怡如



蔡佳蓓



林意儒



王奕偉



單位主管簽章：林能顯



負責人簽章：許道義



(本用印僅限於精材科技股份有限公司股票上櫃推薦證券商評估報告使用)

中華民國一〇三年九月三十日編撰

中華民國一〇四年三月二十三日修訂

推薦證券商：華南永昌綜合證券股份有限公司



評估人簽章：何 佩 璣



單位主管簽章：黃 崇 健



負責人簽章：陳 錦 峰



(本用印僅限於精材科技股份有限公司股票上櫃推薦證券商評估報告使用)

中 華 民 國 一 〇 三 年 九 月 三 十 日 編 撰
中 華 民 國 一 〇 四 年 三 月 二 十 三 日 修 訂

推薦證券商：元富證券股份有限公司



評估人簽章：洪雲萍



單位主管簽章：顏榮嗣



負責人簽章：陳俊宏



(本用印僅限於精材科技股份有限公司股票上櫃推薦證券商評估報告使用)

中華民國一〇三年九月三十日編撰

中華民國一〇四年三月二十三日修訂

推薦證券商：第一金證券股份有限公司



評估人簽章：楊安勤



單位主管簽章：劉文正



負責人簽章：林漢奇



(本用印僅限於精材科技股份有限公司股票上櫃推薦證券商評估報告使用)

中華民國一〇三年九月三十日編撰
中華民國一〇四年三月二十三日修訂

精材科技股份有限公司

一〇四年度現金增資發行新股 證券承銷商評估報告

推薦證券商：凱基證券股份有限公司



中 華 民 國 一 〇 四 年 二 月 六 日

目錄

壹、承銷商總結意見.....	1
貳、評估報告內容摘要.....	2
一、產業概況.....	2
二、發行人之競爭地位.....	8
三、發行人之營運風險.....	9
四、最近期及最近三個會計年度募集與發行有價證券籌資效益.....	28
參、發行人之業務財務狀況.....	29
一、業務狀況.....	29
二、財務狀況.....	67
肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形.....	81
一、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫尚未完成者之執行狀況，如執行進度未達預計目標者，應再具體評估其落後原因之合理性、對股東權益之影響及是否有具體改進計畫.....	81
二、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫如經重大變更且尚未完成者，應說明其變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因及變更前後效益.....	81
三、計畫實際完成日距申報時未逾三年之前各次現金增資、併購、受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫已完成者之原預計效益是否顯現，如執行效益未達預計目標者，應具體評估其原因之合理性及對股東權益之影響.....	81
四、曾發行公司債或舉借長期債務者，是否均如期還本付息，其契約對公司目前財務、業務或其他事項之重大限制條款，並說明最近期及最近三個會計年度有無財務週轉困難情事.....	81
五、是否確實依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理資訊公開.....	81
伍、本次募集與發行有價證券之適法性.....	82
一、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十三條第一項第二款所列之情事，如有，則應就其事項詳細評估對發行人財務狀況之影響及是否影響本次有價證券募集及發行.....	82
二、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條及第八條所列之情事，並應詳細說明其評估依據.....	82
三、是否符合「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定.....	90
四、法令之遵循及對公司營運影響.....	97
四之一、發行人委請填報其案件檢查表並出具法律意見書之律師，未具有下列情事.....	103

陸、就本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....	104
一、本次募集與發行有價證券資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益之合理性.....	104
二、分析比較各種資金調度來源對發行人當年度每股盈餘稀釋、財務負擔、股權之可能稀釋情形及對現有股東權益之影響。發行人如辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款規定之案件，得僅就發行新股對當年度每股盈餘稀釋情形進行評估.....	106
三、本次募集與發行有價證券資金計畫如用於轉投資、償債、充實營運資金、購買營建用地、支付營建工程款、購買未完工程並承受賣方未履行契約者，其必要性及合理性.....	107
四、本次增資計畫如非以現金出資時，其出資金額之合理性及取得資產之必要性.....	112
五、本次增資計畫如併同減資計畫辦理者，應就下列事項評估其可行性與合理性.....	113
六、以低於票面金額辦理現金發行新股者，應評估未採用其他籌資方式之原因及其合理性、發行價格訂定方式及對股東權益之影響.....	113
七、發行人向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報募集與發行有價證券，發行辦法依規定採彈性訂定方式之評估事項.....	113
八、就發行人申報發行人民幣債券者，應審慎評估到期償債資金來源計畫之可行性、必要性及合理性(至少應包括到期還款之來源及如何取得人民幣資金等).....	114
柒、就本次附認股權特別股、分離型附認股權特別股分離後之特別股及認股權憑證發行及認股辦法之合理性及對原股東及附認股權特別股持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....	114
捌、就本次公司債發行(及轉換)辦法之下列各款之合理性及對原股東及轉換公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....	114
玖、就本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債分離後之公司債及認股權憑證發行及認股辦法之下列各款之合理性及對原股東及附認股權公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....	114
拾、就本次發行公司債債權確保情形(列明有無擔保、擔保品種類與價值等)蒐集資料，說明其查核程序及其實際情形，如為經信用評等機構評等者，取得其相關項目及評等結果.....	114
拾壹、就本次轉換公司債設算理論價值之下列各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....	114
拾貳、就本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債設算理論價值之下列各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....	115
拾參、就發行人其他必要補充說明事項蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論.....	115

壹、承銷商總結意見

精材科技股份有限公司(以下簡稱精材或該公司)本次為辦理現金增資發行新股普通股30,000,000股，每股面額新台幣10元，合計發行總金額新台幣300,000,000元整，依法向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報。業經本承銷商採用必要之輔導及評估程序，包括實地了解該公司之營運狀況，與公司董事、經理人、及其他相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證及比較分析相關資料等，予以審慎評估。特依金融監督管理委員會「發行人募集與發行有價證券處理準則」及中華民國證券商業同業公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券評估報告之評估查核程序」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，精材科技股份有限公司本次募集與發行有價證券符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

凱基證券股份有限公司



負責人：許道義



承銷部門主管：林能顯



中 華 民 國 一 〇 四 年 二 月 六 日

貳、評估報告內容摘要

本承銷商經依「中華民國證券商業同業公會證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券評估報告之評估查核程序」規定辦理查核完竣，所獲結論如下：

一、產業概況

(一)IC封裝產業之現況

台灣IC產業以特有之上下游垂直分工方式獨步全球，產業價值鏈分工極細且結構完整，包括上游化學材料與矽晶圓，中游IC設計業、IC製造業、IC封裝業、IC測試業，以及下游的終端PC/NB、手機及消費性電子之系統廠商。由IEK2014年5月之統計資料顯示，台灣IC封裝及測試業在全球IC封測市場自2011年迄2013年均保持55%以上之全球市占率。由於2011年受到日本311震災、歐盟債務和泰國水災等接連事件的交互影響下，全球經濟發展始終不如預期順遂，連帶拖累全球半導體產業產值表現，亦使得我國半導體各次產業產值呈現成長趨緩或衰退，我國IC封裝產業產值較2010年衰退6.1%(可參考表一)；而2012年全球景氣一片不明朗，歐、美、大陸三大經濟體的經濟狀況都持續呈現低迷景象，其中，歐洲在歐債與高失業率的雙重打擊下，以及美國財政懸崖的不確定性，消費市場終端需求持續不振，智慧型手機及平板電腦雖成長優異，惟因PC產業買氣不振，進而影響全球半導體產業的表現，我國IC封裝產業產值僅較2011年微幅成長0.9%；2013年由於智慧型手機及平板電腦市場需求趨緩，我國IC封裝產業產值較2012年微幅成長4.6%；2014年由於已開發國家經濟開始復甦成長，PC市場經過幾年的成長停滯後，2015年可望持穩不再衰退，而中低階智慧型手機則因在新興市場大幅成長抵銷高階智慧型手機成長趨緩之不利影響，整體手機數量依舊成長，手機晶片之高階封測產能、覆晶及晶圓凸塊需求仍持續增加，足見智慧型手機及平板電腦是2014年推升預估IC封裝業主要成長動力，故IEK預估2014年我國IC封裝產業產值較2013年成長13.9%。

表一、2011年~2016年台灣IC產業產值

新台幣(億)	2011年	2011年	2012年	2012年	2013年	2013年	2014年	2014年	2015年	2015年	2016年	2016年
		成長率		成長率		成長率	(e)	成長率	(e)	成長率	(e)	成長率
IC產業產值	15,627	-11.7%	16,342	4.6%	18,886	15.6%	22,167	17.4%	22,555	1.75%	23,854	5.76%
IC設計業	3,856	-15.2%	4,115	6.7%	4,811	16.9%	5,829	21.2%	5,876	0.81%	6,245	6.28%
IC製造業	7,867	-12.6%	8,292	5.4%	9,965	20.2%	11,665	17.1%	11,924	2.22%	12,584	5.54%
晶圓代工	5,729	-1.7%	6,483	13.2%	7,592	17.1%	9,007	18.6%	9,312	3.39%	9,962	6.98%
記憶體製造	2,138	-32.5%	1,809	-15.4%	2,373	31.2%	2,658	12.0%	2,612	-1.73%	2,622	0.38%
IC封裝業	2,696	-6.1%	2,720	0.9%	2,844	4.6%	3,238	13.9%	3,300	1.91%	3,485	5.61%
IC測試業	1,208	-5.5%	1,215	0.6%	1,266	4.2%	1,435	13.3%	1,455	1.39%	1,540	5.84%
IC產品產值	5,994	-22.3%	5,924	-1.2%	7,184	21.3%	8,487	18.1%	8,488	0.01%	8,867	4.47%
全球半導體成長率	-	0.4%	-	-2.7%	-	4.8%	-	6.5%		2.7%		1.8%

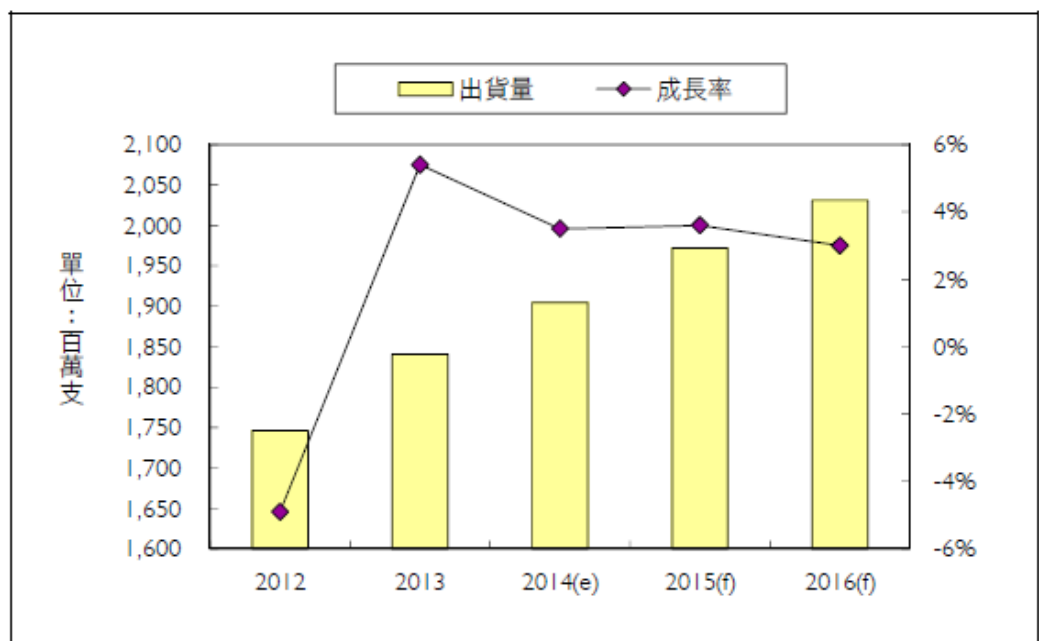
註：(e)表示預估值(estimate)。

資料來源：TSIA；工研院 IEK(2014/05、2014/08)；MIC(2014/04)；2014 半導體產業年鑑；凱基證券整理

(二)手機產業之現況與發展

2013年受北美、歐洲及日本之景氣尚未全面復甦，以及手機市場逐漸飽和且成長趨緩的影響，手機品牌大廠除積極布局高階智慧型手機外，亦紛紛推出中階旗艦款或中低價位之智慧型手機搶攻市場，促使以低價高規為訴求的新興市場(例如：中國大陸、印度及巴西等)之多數功能型手機用戶，將手機汰換為智慧型手機，致使2013年手機出貨量達18.4億支，仍較2012年成長5.4%，其中，中國大陸已成為全球最大的智慧型手機市場，故IEK預估2014年在中國大陸為主的新興市場需求強勁帶動下，手機出貨量將達19.0億支，成長率3.5%，且2015年及2016年亦維持成長趨勢。

圖一、2012~2016年全球手機出貨量

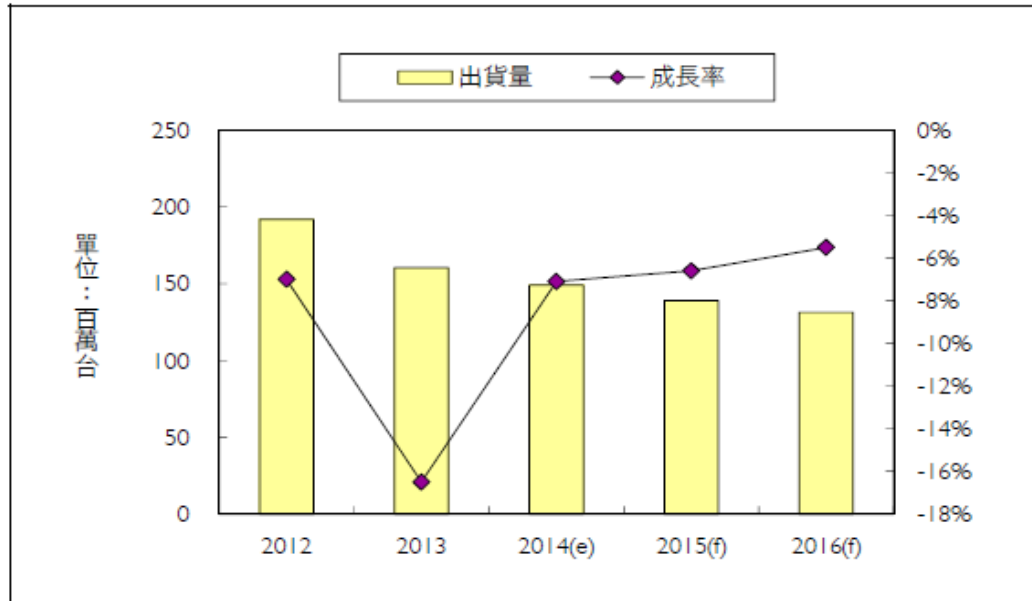


資料來源：工研院 IEK(2014/05)

(三)筆記型電腦產業之現況與發展

2013年全球經濟雖未持續惡化，原市場預期之觸控筆記型電腦與Windows 8之換機潮均未明顯提升筆記型電腦之市場需求，致2013年全球筆記型電腦出貨量僅160.3百萬台，衰退幅度達16.5%。在面對平板電腦市場排擠效應下，筆記型電腦業者已持續致力於提升產品效能，希冀能與以娛樂功能為主之平板電腦做出市場區隔外，又將平板電腦輕薄及方便攜帶移動等優勢納入產品設計，然而，近來市面上出現能自由轉換平板電腦與筆記型電腦的二合一產品，同時兼納桌上型電腦、筆記型電腦及平板電腦的三合一產品，致使筆記型電腦及平板電腦的界線逐漸模糊。雖筆記型電腦出貨持續萎縮，但因Microsoft停止支援Windows XP，企業換機潮可望帶動商用筆記型電腦的出貨成長，故IEK預估2014年全球筆記型電腦出貨量可達148.9百萬台，成長率衰退幅度可降至10%以內。

圖二、2012~2016年全球筆記型電腦出貨量

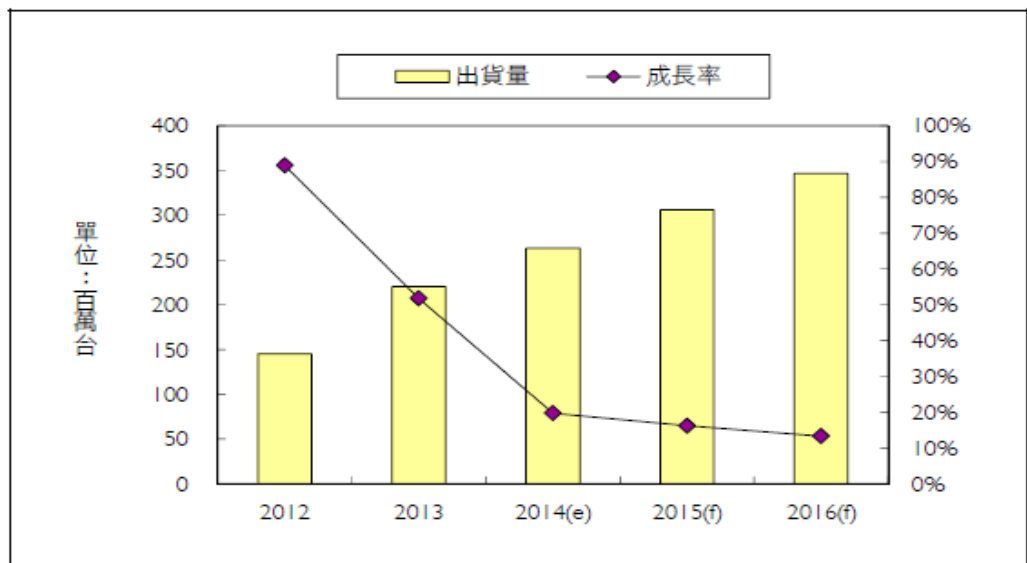


資料來源：Gartner；工研院 IEK(2014/05)

(四) 平板電腦產業之現況與發展

隨著平板電腦市場趨於成熟，已不見甫出現之高成長率，但相對於桌上型電腦及筆記型電腦，仍屬成長性高之產品。2013年全球平板電腦出貨量達220百萬台，較2012年成長51.8%，首度超越筆記型電腦，顯示對於行動裝置市場來說，平板電腦已逐漸取得領先地位。且由於市場開始進入成熟期，消費者更著重在平板電腦產品的多樣性，可通話之平板電腦、結合數位家電與大尺寸螢幕將為2014年平板電腦的新趨勢，而7吋低價平板電腦提升新興市場對平板電腦的接受度，也將持續帶動平板電腦產品出貨成長，故IEK預估2014年全球平板電腦出貨量將達263百萬台，成長率19.7%。

圖三、2012~2016年全球平板電腦出貨量



資料來源：工研院 IEK(2014/05)

(五)汽車電子產業之現況與發展

近年來技術逐漸成熟化的汽車，支援電子控制技術的汽車電子產品主要是搭配各種感測器(如影像、加速度、壓力或溫度等)、微電腦控制器、影音娛樂機器、衛星導航機、無線通訊等產品應用與服務，提供車輛及人員有關節能減碳、低噪音污染、舒適、主動與行車安全、保全、緊急救援與道路指引等功能，讓汽車操控更具人性化，更加聰明且符合智慧化需求。根據全球汽車產業分析機構IHS Automotive的統計數據顯示，2013年全球汽車銷售量約為8,280萬輛，較2012年成長4.2%，創全球年度汽車銷量新紀錄，預估2014年汽車出貨量將達8,500萬輛。

(六)穿戴式裝置產業之現況與發展

2014年國際消費電子展(47th International Consumer Electronics Show 2014, CES)中，以穿戴式技術產品之裝置成為CES展之焦點，全球之廠商紛紛開始進軍於穿戴式技術領域市場。目前智慧穿戴式裝置應用範圍橫跨數大產業，包含安全、醫療、健康、運動、生活運算、通訊及穿著等領域，尚包括安全與保全、軍事用途等特殊領域市場，其中，醫療居家照護、資訊娛樂相關及運動健身三大應用領域成長最快，其應用領域。智慧穿戴式裝置有四個關鍵的發展方向，分別為感應器、雲端網路、資料分析及整合服務。在感應器方面，透過大量感應器來抓取各種不同的資料，使得感測器種類逐漸增多，讓裝置能獲得之資料種類增加，亦可導致感測種類的需求增加，新的感測器出現或是原本既有的裝置開始小型化，進而帶動先進封裝在穿戴式裝置之應用。根據拓璞產業研究所研究報告指出，預估全球穿戴式消費電子出貨量在2014年達到3,930萬台，成長率49.32%，而2015年將出貨6,570萬台，成長率67.1%。

圖四、智慧型穿戴應用

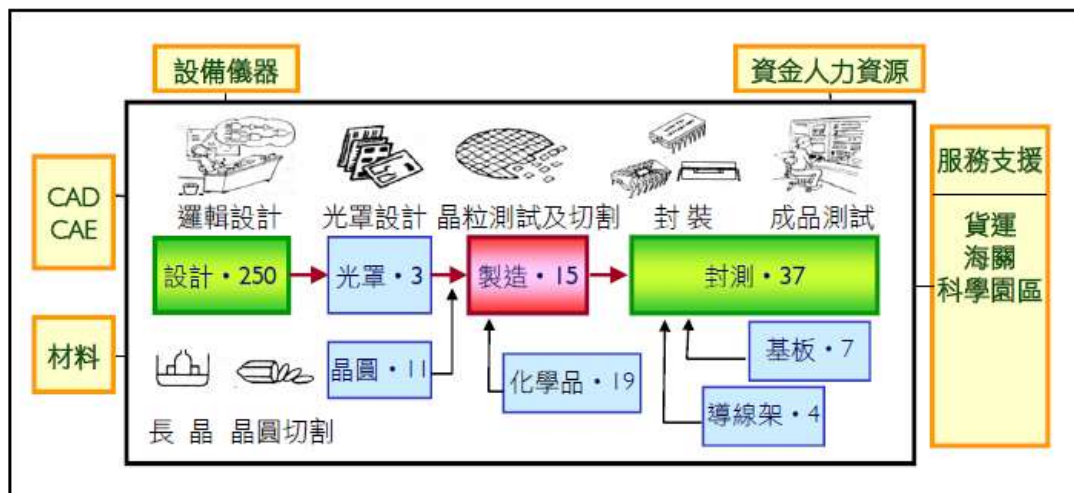


資料來源：工研院 IEK(2014/05)

(七)行業上、中、下游變化

我國半導體產業隨著整體半導體的垂直分工整合，產業輪廓發展完整，依製造流程可區分為上游之IC設計、矽晶圓片、光罩製作、中游之IC晶圓製造廠及下游之IC封裝廠、測試廠。近年來由於我國IC產業蓬勃發展及分工專業化，產業鏈的生產環節皆有廠商投入，致垂直分工明確且各有所長，使我國IC產業之上、中、下游結構更加完整，而該公司主要從事封裝服務，位居半導體產業之下游。

圖五、半導體上、中、下游產業鏈



資料來源：工研院 IEK(2014/05)

(八)該行業未來發展趨勢

1.封裝技術方面

IC封裝產業隨著系統終端產品往大容量、高頻寬、高速、低功耗、小型化、高度整合等追求，尤其是智慧型手機及平板電腦，多功能整合晶片技術應運而生，近幾年介於前段（Front-End）和後段（Back-End）製程中之新興技術成型，包含晶圓凸塊技術（Wafer Bumping）、WLP（如Fan-out WLP、WLCSP、3D WLP、WL Optics等）及3D IC，即所謂中段（Mid-End）產業。

鑒於高階封裝製程的需求，如覆晶封裝(Flip Chip BGA or Flip Chip CSP)、晶圓級尺寸封裝(Wafer Level CSP)、銅打線(Cu Wire Bond)、銅柱凸塊(Cu Pillar)等，晶圓層級封裝服務將扮演關鍵性角色。而受到終端產品訴求面朝向高解析、產品輕薄、省電、長待機時間及直覺操控等趨勢影響，將帶動高速傳輸IC、感測器、觸控IC、電源管理IC、無線通訊IC等所需晶片多元發展，促使異質多層封裝與2.5D/3D IC發展受矚目。依據拓璞產業研究所的預估，2.5D/3D IC的產值，於2015年將達40億美元，其中Logic IC（整合邏輯）、Memory IC（記憶體）、影像感測器晶片及MEMS(微機電)是最主要應用，而影像感測器晶片受惠於其先天就是異質堆疊，為最早進入量產之應用。

2. 產品需求方面

由2014年美國消費性電子展(CES)可發現七個重要趨勢，分別是汽車、網路/雲端、穿戴式、感應器、UHD TV、高品質聲音及遊戲。進而分類可歸納成三個方向，第一是汽車方面，包括相機模組等各種感應器、網路的運用，使得汽車更加智慧化。第二是穿戴式裝置，得依靠不同的感測器、網路雲端的輔助使其功能更加多元，創造更多消費者價值。第三為高品質影音，如新一代遊戲機PS4、Xbox One的高銷售，並未因手機App的興起而沒落，反而逆向成長，這些皆代表著影像感測、人機介面感測等需求之應用與成長。

圖六、感測器在3C電子之應用

	傳統應用	創新應用
影像感測器	照相、 影印/傳真機、 光學滑鼠	人機界面(深度感測): 遊戲機, 手機, TV,... 人機界面(光學觸控): 大尺寸應用 擴增實境: 手機, Tablet
環境光感測器		人機界面(近接感測): 手機, Tablet 人機界面(環境光感測): NB, TV
運動感測器	硬碟保護、 照相防手震	人機界面: 遊戲機, 手機, Tablet,...
磁感測器	馬達控制,...	LBS: 手機, Tablet,...
壓力感測器		LBS: 手機, Tablet,...

資料來源：MIC(2012/08)

根據拓璞產業研究報告影像感測器市場隨行動裝置出貨成長，2013年各智慧型手機大廠皆把旗艦機種搭載的影像感測器升級為800~1000萬畫素以上，影像感測器市場規模自2012~2016年之年複合成長率達6.8%，預計2016年可達100億美元。



除了智慧型手機，影像感測器於車用領域，將因安全因素獲得大量採用，包含車前鏡頭之主動式剎車、車體四周鏡頭之環景顯示，以及車後鏡頭

之停車及後方來車指示等，預計一台車至少將搭載6~8顆以上之影像感測器，且未來有機會成長到10顆以上，將為影像感測器產業成長性最大的應用產品。

另外，隨著智慧型手機、平板電腦和遊戲機紛紛強打瀏覽多媒體影像、人機介面互動、行動導航和遊戲、影像防震等應用，採用微機電製程的麥克風、多軸陀螺儀、加速度計及電子羅盤等感測元件產品，已成為行動裝置不可或缺的關鍵零組件。根據市調機構Yole Developpement預測，全球微機電感測器2013~2018年的年複合成長率將為18.5%，2018年預估可達到64億美元市場產值。

3.環保意識訴求

環保議題一直以來為全球所關注之問題，由於半導體封裝生產過程中會排放氣體、產生廢水及廢棄物，需設置相關防治汙染設備並委託專業機構回收後再處理，而近年來，因國內違規事件頻傳而造成環境汙染日益嚴重，可能造成的潛在健康風險更為廣泛重視，環保單位除加強監控外，若有發生違規情事，輕則處罰，重則勒令停工，對企業營運亦會造成損失，該公司亦重視每一環節，與供應鏈合作，善盡環境保護的社會責任，取得多項國際標準環保、安全與衛生證書，達成企業永續經營及成長的目標。

(九)產品可替代性

IC封裝係指將晶片上的功能訊號透過一個載具將其引接到外部，且提供晶片免於受破壞的保護，係屬半導體製造中不可或缺之重要生產流程。該公司主要從事影像感測器及環境感測器等光學感測元件之晶圓級尺寸封裝生產，主要係提供三維晶圓級尺寸封裝及晶圓級後護層封裝服務，相較於一般傳統封裝方式，具有低成本、最小封裝尺寸及符合感測器封裝所需之三維封裝等優勢，同時也簡化傳統供應鏈，使感測器設計公司得以開發其市場，成為新興感測器元件供應鏈不可或缺之一環。目前，該公司不僅為三維晶圓層級封裝之領導供應商，已成功建立影像感測器之標準封裝型式；同時亦藉由獨特開發之二/三維晶圓後護層封裝服務，已成功應用於指紋辨識、作動感測器、MOSFET等元件，使客戶之產品可以利用該公司提供之服務實踐產品之創新，故其產品可替代性較低。

二、發行人之競爭地位

該公司為專業晶圓層級IC封裝公司，其所使用之封裝技術除使用部分傳統封裝技術外(如：壓合技術、BGA植球、晶圓切割等)，主係以半導體製造中的相關技術(例如：光刻技術、薄膜沉相技術等)來進行封裝，與傳統IC封裝同業不同，在國內上市櫃公司中亦無與該公司從事相同業務之同業，另由於國內IC封測業各家公司除了IC封裝業務外，亦有IC測試業務，而該公司僅有封裝業務，相關同業之封裝技術及所應用產品和功能皆有所不同，故礙難計算市場占有率。另從該公司主要銷貨

客戶多為國際大廠且合作多年，足見該公司之銷貨客戶對其封裝技術及產品品質已相當肯定。

三、發行人之營運風險

(一)該公司所屬行業之營運風險

1.景氣循環之營運風險

該公司主要從事影像感測器及環境感測器等光學感測元件之晶圓級尺寸封裝業務，以及應用於微機電(作動感測器)、指紋辨識感測器與MOSFET元件之晶圓後護層封裝服務。由於IC封裝業屬半導體產業鏈之後段製程，半導體產業與全球經濟景氣息息相關，又該公司所封裝產品之終端應用領域以手機、筆記型電腦及平板電腦等消費性電子產品為主，故該公司所屬之產業亦受景氣波動之影響，因此，該公司除謹慎評估資金運用、設備投資及人員招募計畫，並藉由本身技術整合及開發能力，持續精進技術並改良製程，以提供符合市場與客戶需求之多元化封裝服務外，同時積極進入車用電子領域，以降低消費性電子景氣循環對公司之衝擊。

2.行業上、中、下游之營運風險

A.銷貨客戶集中

該公司耕耘半導體後段封裝服務領域多年，主要銷貨戶客戶包括國內外知名之 IC 設計公司，消費性產品終端客戶以及整合元件製造商(IDM)等，由於感測器產品所需之封裝服務客製化程度高，該公司需依客戶所設計不同產品特性提供創新之封裝解決方案，亦需與上游晶圓供應商製程技術緊密結合，該公司經過封裝服務提昇並與客戶、上游晶圓供應商的多年合作，近年來已掌握關鍵客戶產品需求並有效縮短產品開發時程，近年來其往來客戶變化並非重大，致有提供予前十大客戶封裝服務之金額佔各年度營收淨額之比重為九成以上之情事。

因應對策：

該公司業已持續精進晶圓級相關先進製程技術之開發，未來期能將業務擴展至晶圓級系統整合封裝(System in Package)外，並建置 12 吋晶圓級封裝之產線，以因應高端感測器客戶之需求，希冀藉由封裝服務技術暨應用產品之多元化，開發新客戶，並降低銷貨集中之風險。

B.終端產品價格下跌快速

由於該公司之封裝服務所應用之終端產品以消費電子類為大宗，電子產品推陳出新且生命週期短，在中國封裝廠商亦持續投入資金並積極投入市場競爭，加上終端電子產品市場競爭因素，產品之平均售價始終存在下滑的壓力，亦使該公司於終端產品推出後，持續面對調降價格之壓力，產品利潤薄。

因應對策：

因應電子產業及半導體產業市場與其技術的不斷變化，該公司的競爭利基為持續開發先進製程與新衍生技術，以提供予客戶最佳之封裝解決方案，並積極降低製造成本以及提升生產效能，進而提升或維持利潤。

(二)業務風險

1.市場可能之供需變化情況

(1)IC封裝產業

由於 PC 市場可望持穩不再衰退，中低階行動裝置持續熱賣使得應用在手機晶片之高階封測產能以及覆晶、晶圓凸塊也跟著吃緊。2014 年預估 IC 封裝業主要成長動力仍為智慧型手機及平板電腦，而 4G LTE 手機基頻晶片、ARM 應用處理器、影像感測器、蘋果及非蘋陣營指紋辨識等 SiP 封測需求續強，預估 2014 年我國 IC 封裝產業產值較 2013 年成長 13.9%。

(2)手機產業

由於北美、歐洲及日本等成熟市場之多數消費者已經擁有智慧型手機，對於智慧型手機的需求強度逐漸放緩，而新興市場則需求強勁，已成為智慧型手機出貨量成長最快的區域市場，尤其是中國大陸在人口眾多、所得提高、3G 網路佈建逐漸普及與智慧型手機低價化帶動下，將持續保持全球第一大智慧型手機市場的地位。此外，隨著中國大陸手機品牌廠商的崛起及新興市場對低價手機的需求，將導致智慧型手機的平均銷售單價快速下滑，面對智慧型手機低價高規的發展趨勢及激烈的價格競爭挑戰，手機大廠紛紛推出中階旗艦機種搶攻新興市場外，並往跨裝置、跨平台的應用發展(如醫療、車用、行動商務及物聯網等領域)，利用應用上的創新及加強應用整合來提高產品的價值與競爭力。預估 2014 年在中國大陸為主的新興市場需求強勁帶動下，手機出貨量將達 19.0 億支，成長率 3.5%。

(3)筆記型電腦產業

隨著筆記型電腦產業逐漸轉型，品牌業者除在產品上進行改革，一改變其行銷策略，針對品牌加強行銷而不再削價競爭，並積極轉型發展雲端領域，朝商用及伺服器領域佈局。由於 Microsoft 停止支援 Windows XP，企業換機潮可望帶動商用筆記型電腦的出貨成長，預估 2014 年全球筆記型電腦出貨量可達 148.9 百萬台，成長率衰退幅度可降至 10%以內。

(4)平板電腦產業

雖然新興市場初以白牌、中低價位的產品為主，近來品牌廠商逐漸將新興市場視為重要的發展區域，而預期新興市場對智慧行動裝置的通

話功能需求將大幅提高，因此積極於新興市場推出通話平板；另一發展產品趨勢則為大尺寸平板電腦，由於 7、8 吋的平板電腦市場逐漸趨於飽和，廠商積極推出大尺寸平板電腦以尋求差異化。主打商務市場的 Win 8 平板開始進入市場，逐漸調整平板僅為娛樂用途之定位，商務平板同時具有便利移動與作業的優勢，價格亦比傳統商務型筆電更具競爭力，因此也成為平板電腦廠商發展的舞台。預估 2014 年全球平板電腦出貨量將達 263 百萬台，成長率 19.7%。

(5)汽車電子產業

全球汽車業發展迄今，已有 80%的創新成果來自車輛與電子科技、數位化趨勢的深度融合，且繼續朝節能動力、安全科技與車載資、通訊等領域發展。由於未來智慧車輛技術以主動安全、舒適便利及節能為三大主軸，目前各大國際車廠都特別以智慧車輛之主動安全暨自動防撞為未來車輛設計重點，其中又以影像辨識系統加上影像感測器，讓汽車「看」得見周遭路況，並且利用快速運算的電腦分析判斷以獲得的影像資料。未來甚至可以進一步預知車輛可能遭遇到的狀況，再主動提出避開危險的警示，直接指揮車輛進行避險動作。由此可見，動態影像辨識將為未來車輛智慧化主動安全系統之關鍵要素。根據全球汽車產業分析機構 IHS Automotive 的統計數據顯示，預估 2014 年汽車出貨量將達 8,500 萬輛。

(6)穿戴式裝置產業

隨著智慧型手機普及逐漸提高，智慧型手機產品同質化益趨顯著，如何打破同質化，以獨特性追求更多的市場機會，已成為智慧型手機品牌廠商在產品研發設計時首要考量重點。其中，由於智慧型手機已進入以應用為主導的後智慧型手機時代，如何讓智慧型手機與消費者日常生活更加緊密結合，亦成為各智慧型手機品牌大廠首要產品差異化方向，而各家智慧型手機廠商不約而同推出如智慧手環等配戴式穿戴產品或在高階旗艦機中搭載各式感測器，將心跳感測器、指紋辨識等各式感測器及 WiFi、Bluetooth 等無線技術整合在一起。

在穿戴式產品後續發展上，如何開發出符合穿戴式產品特性，包括低功耗、輕薄短小、高環境容忍及高穩定等特性，並脫離智慧型手機而獨立生存，是配戴式穿戴產品長遠的發展目標，預期未來美學、實用性兼顧及創新之人機介面，為穿戴式裝置未來關鍵方向。根據拓璞產業研究所研究報告指出，預估全球穿戴式消費電子出貨量在 2014 年達到 3,930 萬台，成長率 49.32%，而 2015 年將出貨 6,570 萬台，成長率 67.1%。

2.該公司在同業間之地位及其市場佔有率

(1)該公司在同業間之地位

該公司於 87 年 9 月正式設立，為專業晶圓層級 IC 封裝公司，所使用

之封裝技術為晶圓級尺寸封裝及晶圓級後護層封裝服務，綜觀目前國內上市櫃及興櫃公司，封裝技術及產品組合並無與該公司完全相同者，故以部分產品應用端相同或同為半導體封裝及測試產業為取樣之依據：上市公司日月光半導體製造股份有限公司(以下簡稱日月光)主要係從事各型積體電路之製造、組合、加工、測試及外銷，亦有封裝影像感測器模組及指紋辨識感測器模組與該公司產品應用端相同；上市公司同欣電子工業股份有限公司(以下簡稱同欣)主要係從事高頻無線通訊模組、混合積體電路模組、陶瓷電路板及影像產品等電子產品生產及銷售，亦有影像感測器封裝與該公司產品應用端相同；上市公司菱生精密工業股份有限公司(以下簡稱菱生)主要係從事積體電路及各種半導體零組件之封裝加工、測試、製造及買賣，亦有用於手機或行動裝置之環境光學感測器模組封裝測試與該公司產品應用端相同。在綜合考量比較上述公司之產品營收比重、業務內容、實收資本額及資產規模等，選取日月光(2311)、同欣(6271)及菱生(2369)為採樣同業。茲將主要競爭同業之營業項目資料列示如下：

單位：新台幣仟元

公司	營業項目	資本額	合併營業額	稅後淨利
精 材	晶圓級尺寸封裝及晶圓級後護層封裝	2,381,207	4,934,078	628,653
日 月 光	各型積體電路之製造、組合、加工、測試及外銷	78,180,258	219,862,446	16,155,040
同 欣	高頻無線通訊模組、混合積體電路模組、陶瓷電路板及影像產品等電子產品生產及銷售	1,629,071	7,929,440	1,583,473
菱 生	各型積體電路之封裝、測試及光電產品	3,801,023	6,047,661	351,315

資料來源：各公司經會計師查核簽證之合併財務報告。

註：該公司為 103 年度數值，其餘公司為 102 年度數值。

(2)市場占有率

該公司為專業晶圓層級 IC 封裝公司，其所使用之封裝技術除使用部分傳統封裝技術外(如：壓合技術、BGA 植球、晶圓切割等)，主係以半導體製造中的相關技術(例如：光刻技術、薄膜沉相技術等)來進行封裝，與傳統 IC 封裝同業不同，在國內上市櫃公司中亦無與該公司從事相之業務之同業，另由於國內 IC 封測業各家公司除了 IC 封裝業務外，亦有 IC 測試業務，而該公司僅有封裝業務，相關同業之封裝技術及所應用產品和功能皆有所不同，故礙難計算市場占有率。另從該公司主要銷貨客戶多為國際大廠且合作多年，足見該公司之銷貨客戶對其封裝技術及產品品質已相當肯定。

3.相關機器設備

該公司為專業晶圓層級IC 封裝公司，主係以半導體製造中的相關技術(例如：光刻技術、薄膜沉相技術等)來進行封裝，故機器設備主要為晶圓蝕刻機、氣象層積濺鍍機、銅鎳金電鍍機、化學沉積薄膜機、自動光學檢驗機、晶圓研磨機等。由於IC 封裝技術密集度高，該公司透過不斷引進先進封裝所需設備，並致力於產品製程改良及開發，同時加強人員的操作訓練，以提高生產效率。

4.人力資料

103年該公司與上市櫃同業員工平均營收及淨利貢獻度列示如下：

單位：新台幣仟元/人

公司 名稱	合併營業收入 (A)	稅後淨利 (B)	員工人數 (C)	員工平均營收 貢獻度(A/C)	員工平均 淨利貢獻度 (B/C)
精 材	4,934,078	628,653	1,971	2,503	319
日 月 光	219,862,446	16,155,040	60,199	3,652	268
同 欣	7,929,440	1,583,473	3,149	2,518	503
菱 生	6,047,661	351,315	3,075	1,967	114

資料來源：各公司經會計師查核簽證之合併財務報告及股東會年報。

註：該公司為 103 年度數值，其餘公司為 102 年度數值。

該公司截至103年12月底止之員工人數計1,971人，將近六成以上均具備大專(含)以上之學歷，可見該公司員工素質優良，而該公司除提供員工良好的工作環境及完善員工福利制度，並提供多元化訓練課程、良好的在職專業訓練及國內外進修等，目的在使全體員工之專業知識及工作技能均能更紮實，並進而培養出更優質之經營團隊。

該公司103年度之員工平均營收貢獻度為2,503仟元，員工平均淨利貢獻度為319仟元，該公司營收規模雖遠小於日月光、同欣及菱生，但該公司員工平均營收貢獻度及員工平均淨利貢獻度相較於同業均相去不遠，顯見該公司人力資源運用情形尚屬良好。

5.該公司目的事業成就與不成就之關鍵因素

(1)生產效率提升，降低成本提升競爭優勢

近年積極加速設備自動化及產線流程優配化，以提升產品良率與產能稼動率，並整合資源利用各廠區產能機動調配之方式，快速提供產品及服務，取得客戶長期穩定之信賴。

(2)技術領先暨產品應用多樣化

該公司經營團隊具備多年IC半導體研發、生產暨銷售經驗，除產品優良、交期迅速、售後服務並良好深受客戶信賴外，市場行銷與研發團隊建立完整的新技術專利，目前所擁有之各國專利近兩百項，並配合客戶產品需求開發出多種先進之晶圓層級封裝解決方案，獲得國際品牌大廠認可。

(3)產業鏈優化與整合

該公司為台積電策略投資夥伴之公司，除利用本身之先進技術與業務開發能力建立強大之客戶群外，更結合台積電在半導體供應鏈中之龍頭地位提供上下游完整之一條龍服務(Turn-key service)，並透過與台積電(晶圓供應商)技術緊密整合，提供客戶最先進、快速且完整之一站購足(One stop shopping)封裝解決方案。

(4)國際分工之優勢

我國封裝業的發展，即以扮演全球半導體業供應鏈夥伴的定位，藉先進技術發展策略及整合品質、成本、交期、產能、服務總體運籌優勢，締造在國際分工體系中的總體競爭地位。該公司身為先進晶圓層級封裝服務之提供者，不僅提供國內外客戶上游IC設計公司完整之供應生產鏈，並藉由與IC foundry公司合作，解決生產過程衍生之相關議題。

6.影響該公司未來發展之有利與不利因素及其相關因應措施

(1)有利因素

①先進晶圓層級封裝之成長

精材從事晶圓級晶片尺寸封裝技術的開發、封裝代工及相關服務，其所提供之封裝技術包含密封及封裝尺寸最小等特色，而採用晶圓級晶片尺寸封裝能有效縮短製程時程、降低成本、提高封裝良率及品質。為因應終端產品需求，晶圓級尺寸封裝製程發展不斷往前推進，目前封裝產品追求的製程目標包括：尺寸縮小 35%、功率降低 50%、功能與頻寬增加 8 倍，以及超越摩爾定律，希冀能將半導體元件與模組的功能性與整合度發揮到極致。其中，晶圓級封裝堆疊技術已從嵌入式晶圓級封裝(Embedded WLP)，一直發展到堆疊式晶圓級封裝(Stacked Chip Scale Package; SCSP)、封裝層疊(Package on Package, PoP)以及矽穿孔(TSV)等。從技術發展脈絡可以發現，半導體封裝產業不斷在追求可以減少晶片厚度及材料成本、提升晶片效能、降低電磁干擾與功率消耗的 3D 堆疊封裝技術。面對晶圓層級封裝趨勢所帶動的市場機會，台灣因半導體產業鏈完整，因此，具有晶圓級封裝生態發展優勢。預計未來晶圓層級封裝技術應用領域將會十分寬廣。

②新興亞洲將成最大的消費性電子產品銷售區

探究 2013 年全球消費性電子成長最主要是來自於新興亞洲、中東、非洲、東歐這四大新興地區的高成長所帶動；而新興亞洲地區的全球消費性電子銷售額更將首次超越北美地區，成為全球最大的消費性電子銷售地區，占全球比重達 24%。除了中國消費電子產品銷售額的成長外，近年來國民所得大增的馬來西亞、泰國，與中產階級崛起的印尼、越南、菲律賓等，都帶動了新興亞洲消費電子產品銷售額大幅成長。

③關鍵技術之自主研發

該公司持續強化研發能量，近年亦開發出可應用於作動感測器、指紋辨識感測器及汽車電子相關之晶圓層級封裝，由於產品品質優異，因而獲得多家國際級品牌大廠及汽車廠之合格供應商認證。另該公司近年亦開發多種微機電感測器之晶圓層級封裝技術，該技術可達成產品輕薄短小之需求，對新興之行動裝置及穿戴式裝置之輕量化有極大助益。

(2)不利因素

①受產業景氣波動影響

由於 IC 封裝業屬半導體展業之後段製程，半導體產業與全球經濟景氣相關，而該公司封裝之產品終端應用領域以手機、筆記型電腦及平板電腦等消費性電子產品為主，故該公司所屬之產業亦受景氣波動之影響。

因應對策：

該公司耕耘半導體封裝服務領域多年，由於該公司封裝之產品終端應用領域以消費性電子產品為主，該公司除致力於衍生製程與新製程之研究發展，並將產品之應用由消費性電子產品進而提昇至汽車電子產業，以降低景氣循環所帶來之衝擊。

②市場競爭者增加

中國政府重金支持半導體先進製程技術之開發，包含 IC 設計、晶圓代工、封裝測試乃至設備研發等產業，其供應鏈所形成的群聚效應，將影響客戶之產能配置，且可能以具有市場競爭力之價格，進而侵蝕市場佔有率。

因應對策：

該公司聚焦發展先進晶圓層級封裝，因應各種功能應用來達到產品差異化的效果，導入自動化設備，提升產能及品質並有效降低成本，選擇及轉進利基應用市場，包括綠能、醫療、車用電子等領域，對於類比、感測器等晶片出現高度需求，同時強力佈局專利地圖，以提升並拉大競爭力之差異化。

③銷貨客戶集中

該公司耕耘半導體後段封裝服務領域多年，主要銷貨戶客戶包括國

際知名影像感測器大廠、國內外半導體設計公司及半導體晶圓大廠等，前十大客戶銷貨金額佔各年度營收淨額之比重為九成以上。

因應對策：

該公司業已持續精進二維及三維晶圓級相關先進製程技術之開發，並建置 12 吋晶圓級封裝之產線，以因應影像感測器客戶之產能需求，希冀藉由封裝服務技術暨應用產品之多元化增加客戶群及擴大終端產品應用。未來期能將業務擴展至晶圓級系統整合封裝(System in Package)。

④資本支出大

由於 IDM 廠(Integrated Device Manufacture 整合元件廠，簡稱 IDM)委外代工訂單趨增，使得封裝廠商大舉擴充採購機器設備，而各家半導體晶圓製造廠陸續邁入更高階之先進製程，封裝技術難度亦同步提高，所需投入之資本支出亦將增加。

因應對策：

該公司擁有產業經驗豐富之經營及研發團隊，隨時掌握市場需求，藉以了解封裝技術之未來趨勢，開發出符合市場及客戶需求的封裝技術，並審慎評估資金運用、設備投資及人員招募計畫，隨著市場需求適時調整機器設備組合。

⑤終端產品價格下跌快速

終端產品生命週期短，平均售價下滑，產品替代性高，在眾多競爭者同時分食市場大餅的情況下，競爭激烈，使得價格下跌快速，產品利潤薄。

因應對策：

因應電子產業及半導體產業市場與其技術的不斷變化，該公司的競爭利基為持續開發先進製程與新衍生技術，以提供予客戶最佳之封裝解決方案，並積極降低製造成本以及提升生產效能，進而提升或維持利潤。

(三)技術、研發及專利權之營運風險

1.取得技術專家之評估意見

本推薦證券商與該公司並未請技術專家就該公司之研發技術能力出具評估意見或報告，故不適用。

2.研究發展狀況

(1)公司研究發展部門之沿革與組織

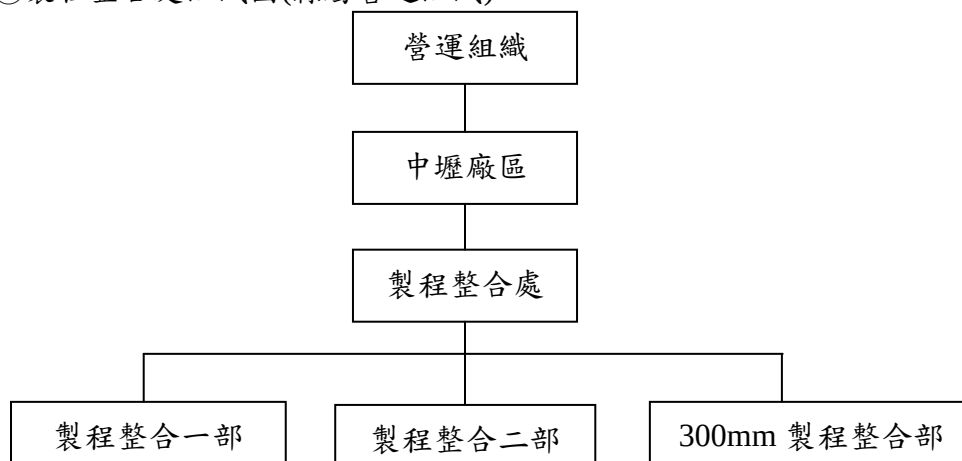
該公司自 87 年 9 月成立以來即積極建構堅實的研發團隊，網羅來自 IC 半導體相關產業具有豐富實務經驗之人才，除持續先進封裝技術與製造技術之研發及創新外，歷年來為厚植研發實力，亦致力於培育研發專業人

才並投入相當之資源於研究發展，截至 103 年底止，該公司研發團隊人數共 175 人，研發組織及製程整合處(隸屬營運組織)人數分別為 85 人及 90 人，茲將研發組織及製程整合處相關單位執掌列示如下：

①研發組織圖



②製程整合處組織圖(隸屬營運組織)



③各單位執掌

研發單位			工作執掌
研發組織	研發一處	整合專案-1 整合專案-2	新技術研究與開發、新材料開發與導入、因應量產之研發技術移轉、客戶溝通與問題解決、主導產品良率分析等
	研發二處	300mm 研發專案 300mm 模組專案-1	
	研發三處	模組專案-1 模組專案-2 模組專案-3 模組專案-4	
	研發四處	整合專案-3 整合專案-4	
	產品可靠處	產品工程專案 設計專案	
製程整合處	製程整合一部	製程整合一課 製程整合二課 製程整合三課	新/先進產品製程規劃及評估、新產品試做及通過客戶驗證、協助製程改善缺點提升良率及穩定性等
	製程整合二部	先進製程整合一課 先進製程整合二課 先進製程整合三課	
	300mm 製程整合部	良率提升課	
		300mm 製程整合一課	

資料來源：該公司提供

(2)研發部門人員學經歷、平均年資及流動情形

單位：人

年 度		101 年度	102 年度	103 年度
員工 人數	期初人數	132	159	136
	本期新進(註 2)	43	29	61
	異動轉入(註 3)	30	2	10
	異動轉出(註 4)	14	33	11
	本期離職(註 2)	32	20	21
	本期資遣	0	1	0
	期末人數	159	136	175
平均服務年資		3.2	3.9	3.7
離職率(%) (註 1)		16.75	13.38	10.71
學歷 分布	博士	5	6	7
	碩士	68	79	103
	大專(學)	49	38	46
	高中(含)以下	37	13	19
合計		159	136	175

資料來源：該公司提供。

註 1：離職率＝離職人數/(期末人數+離職人數)

註 2：已扣除未滿試用期員工。

註 3：係指由其他部門轉入，101 年度主係因新廠工程部及產品工程部部分人員轉至研發組織。

註 4：係指轉出至其他部門，102 年度主係因製程整合部部分人員轉至其他部門。

該公司研發人員截至 103 年底止共有 175 名，大專以上學歷之研發人員佔總研發人員比例達 89.14%，其中，具碩士以上人數為 110 人，佔總研發人員之 62.86%，且多畢業於相關科系或具備相關技能暨產業任職資歷，顯見該公司研發人力具備一定之研發專業素養與經驗，其研發團隊之素質良好。

在研發人員流動情形方面，101~103 年度之研發人員離職率分別為 16.75%、13.38%及 10.71%，主係因員工之個人生涯規劃、人員不適任或不適應工作環境為主，且離職員工多以基層研發人員為主，可見該公司核心研發人員異動情形並不高。此外，該公司業已建立完整研發循環之流程制度，研發技術文件均妥善保管備份，且所有員工到職時均需簽訂保密條款，離職員工亦需妥善辦理交接，該公司並積極尋求替補人選，故相關人員之異動對研發工作不致產生銜接困難之情事。

(3)最近三年度及申請年度之研發費用

研發費用占營收淨額比重

單位：仟元

項 目 \ 年 度	101 年度	102 年度	103 年度
研發費用	206,117	216,971	276,680
營業收入淨額	3,139,385	4,256,761	4,934,078
研發費用/營業收入淨額	6.57%	5.10%	5.61%

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告。

該公司自成立研發部門以來，即積極從事封裝製程技術之開發與創新，並配合客戶產品需求開發出多種先進晶圓級封裝製程及技術，以建立自有核心技術為目標，並持續維持其先進封裝技術之競爭優勢。該公司101~103年度之研發費用分別為206,117仟元、216,971仟元及276,680仟元，分別占營業收入淨額之6.57%、5.10%及5.61%。隨營業規模逐年擴大，為能持續成長動能，遂持續擴充研發人力、投入研發相關經費，以建構優秀之研發技術團隊，並提升整體研發實力，惟101年度因半導體市場需求趨緩，該公司之主要銷售客戶調整產品組合策略而縮減對該公司之訂單量使營業收入淨額下滑，致101年度之研發費用占營業收入淨額比重較高。綜上所述，該公司持續致力於封裝製程之創新及改善，其最近三年度之研發費用變化情形尚屬合理。

(4)研發成果

該公司最近五年度及截至目前為止，研發重點在於衍生製程技術之開發、新製程技術之創新等，其研發成果列示如下：

年度	研發成果	主要功能/效益
98	CMOS 影像感測器模組整合應用	搭配外部鏡頭整合 CMOS 影像感測器成單一模組，提供完整解決方案。
	雙層重佈線技術(RDL)製程開發	提供客戶 Ball grid array 更彈性的繞線方式，可搭配原先 PCB 球墊配合設計。
99	矽穿孔(integrated circuits through silicon vias，縮寫 TSV)製程導入量產	Taper Via 製程技術導入量產並採用 Al 導線製程，提供可靠度佳的封裝方式。
	2D Fan in/out	提供 BGA 製程來連接晶片表面 pad
100	Lead tail 保護製程導入	提升模組對於高溼氣環境的抵抗能力
	黑色遮光層製程導入	遮蔽背景光源雜訊，提供車用 CMOS 影像感測器更佳的影像品質。
101	矽穿孔(TSV)製程導入量產	Vertical Via 製程技術導入量產並採用 Cu 導線製程，提供傳輸速率更快的封裝方式。
	建立電路 spice model 資料庫	提供客戶封裝的電性 model，讓客戶針對電路設計做先期評估。
102	溝渠式打線結構製程量產	提供溝渠式打線結構封裝製程。
	V 型矽穿孔(TSV)製程導入量產	採用鋁導線製程 Taper Via (low cost)的矽穿孔製程，技術導入量產，並提供更佳可靠度的封裝方式。
103	暫時性 Bond 製程導入	提升薄晶圓製程的處理能力，採用製程中暫時性載板技術，降低破片的風險。
	功率節能元件的厚銅製程	應用於系統晶片和被動元件(電阻、電感等)產品整合。

資料來源：該公司提供。

3.主要技術來源、技術報酬或權利金支付方式及金額

該公司於89年6月與Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.(以下簡稱EIPA，其公司原名為以色列商ShellCase Ltd.)簽訂之影像感測器晶圓級

封裝技術授權合約，技術授權費已於 90 年 6 月全數支付完畢。另依該合約規定，自 92 年 4 月起，若使用合約所載明之特定技術製造及銷售產品時，應按其特定產品銷貨收入淨額之若干比率支付權利金，茲就相關契約內容摘錄如下：

技術授權來源	契約主要內容	契約起迄日期	權利金支付方式	重大限制條款
EIPA	WLCSP (晶圓級尺寸封裝技術權利金)	89/6 ~目前	(1)技術授權權利金已全數支付完畢。 (2)自 92 年 4 月起，使用合約所載明之特定技術製造及銷售產品時，應按其特定產品銷貨收入淨額之若干比率支付權利金。	保密責任

4.未來研發工作之發展方向

研發項目	主要內容及功能	應用產品
CMOS 影像感測器超薄封裝製程開發	開發無玻璃封裝製程，增加入射光亮以提昇影像品質。	現行影像產品封裝
矽穿孔(TSV)製程在微機電(MEMS)元件之應用開發	配合客戶晶片設計	濕度感測計 壓力感測計
厚銅製程	針對不同圖樣設計，搭配不同的銅層厚度，達到客戶電性要求，並縮小封裝尺寸的目標。	高頻 IC 整合被動元件
建立 12 吋 CMOS 影像感測器封裝線	配合客戶 12 吋 CMOS 影像感測器晶片封裝需求。	現行影像產品封裝

資料來源：該公司提供。

5.取得重要技術合作契約，就其內容評估對公司營運之風險

該公司與 EIPA 之技術授權合約持續有效，對該公司營運不致產生重大影響。

6.目前已登記或取得之專利權、商標權及著作權等資料，以了解有無涉及違反著作權、專利權及商標權等情事

該公司除 EIPA 之技術授權外，已自行開發多項技術並申請相關專利，其專利佈局以發明專利為主，目前截至 104 年 1 月 31 日止已取得台灣、中國、美國、日本、歐盟及 PCT 之專利共計 195 項，尚在申請中之專利共 414 項。

(1)專利權

國別 申請類別	台灣	中國	美國	日本	歐盟	PCT	合計
已取得	52	41	100	2	0	0	195
申請中	135	112	159	5	1	2	414
合計	187	153	259	7	1	2	609

資料來源：該公司提供。

(2)商標權

①已取得

項次	申請名稱	申請國別	證書號碼	權利期間
1	XinPPI	中國	6560943	2010.08.07~2020.08.06
2	XinPPI	中國	6560944	2010.03.28~2020.03.27
3	XinPPI	中國	6560945	2010.04.21~2020.04.20
4	XinPac	中國	6560940	2010.08.07~2020.08.06
5	XinPac	中國	6560941	2010.03.28~2020.03.27
6	XinPac	中國	6560942	2010.04.21~2020.04.20
7	Xintec & DEVICE	中國	5991149	2010.05.07~2020.05.06
8	Xintec & DEVICE	中國	5991150	2010.02.28~2020.02.27
9	Xintec & DEVICE	中國	5991151	2010.01.07~2020.01.06
10	精材	中國	5991155	2010.05.07~2020.05.06
11	精材	中國	5991156	2010.02.28~2020.02.27
12	精材	中國	5991157	2010.01.07~2020.01.06
13	XINTEC	中國	5991152	2010.05.07~2020.05.06
14	XINTEC	中國	5991153	2010.02.28~2020.02.27
15	XINTEC	中國	5991154	2010.01.07~2020.01.06
16	XinPPI	台灣	1338793	2008.11.16~2018.11.15
17	XinPac	台灣	1338792	2008.11.16~2018.11.15
18	Xintec & DEVICE	台灣	1289640	2007.12.01~2017.11.30
19	Xintec & DEVICE	台灣	1296384	2008.01.01~2017.12.31
20	Xintec & DEVICE	台灣	1296280	2008.01.01~2017.12.31
21	精材	台灣	1296382	2008.01.01~2017.12.31
22	精材	台灣	1296278	2008.01.01~2017.12.31
23	精材	台灣	1294761	2008.01.01~2017.12.31
24	XINTEC	台灣	1289639	2007.12.01~2017.11.30
25	XINTEC	台灣	1296383	2008.01.01~2017.12.31
26	XINTEC	台灣	1296279	2008.01.01~2017.12.31

資料來源：該公司提供

②申請中

該公司目前無申請中之商標權。

(3)該公司有無涉及違反著作權、專利權及商標權等情事

該公司並無登記或取得著作權情事，且截至目前為止，亦無涉及違反專利權及商標權之情事。此外，該公司目前設法務處負責專利佈局策略

之擬定、專利管理、專利申請、營業祕密之保護，同時亦緊密與研發部門及業務部門針對特定技術作專案開發研究，並提出必要之設計方案，以取得專利保護。

(四)人力資源風險

1.最近期及最近三個會計年度依產品別區分之每人每年生產量值表，並就重大變動情形者，加以分析其原因

單位:片；仟元；人

項目(產品別)			年度		101 年度		102 年度		103 年度	
					量	值	量	值	量	值
晶圓級 尺寸封 裝服務	生產量值				288,762	2,673,873	374,930	2,929,007	313,425	2,783,245
	直接 人員	平均量值			326	3,015	315	2,457	245	2,178
		員工人數			887		1,192		1,278	
	直接及 間接 人員	平均量值			210	1,940	215	1,677	159	1,412
		員工人數			1,378		1,747		1,971	
晶圓級 後護層 封裝服 務	生產量值				125,112	180,309	260,355	598,589	397,095	1,158,335
	直接 人員	平均量值			141	203	218	502	311	906
		員工人數			887		1,192		1,278	
	直接及 間接 人員	平均量值			91	131	149	343	201	588
		員工人數			1,378		1,747		1,971	
其他	生產量值				-	36,496	-	62,626	-	14,567
	直接 人員	平均量值			-	41	-	53	-	11
		員工人數			887		1,192		1,278	
	直接及 間接 人員	平均量值			-	26	-	36	-	7
		員工人數			1,378		1,747		1,971	
合計	生產量值				413,874	2,890,678	635,285	3,590,222	710,520	3,956,147
	直接 人員	平均量值			467	3,259	533	3,012	556	3,096
		員工人數			887		1,192		1,278	
	直接及 間接 人員	平均量值			300	2,098	364	2,055	360	2,007
		員工人數			1,378		1,747		1,971	

資料來源：該公司提供。

註 1：約當 8 吋晶圓之片數換算。

註 2：由於其他種類產品種類極品項繁多，故產量及產值之統計數字較不具代表性。

該公司生產之產品依型態主要可區分為晶圓級尺寸封裝服務、晶圓級後護層封裝服務及其他三大類，晶圓級尺寸封裝服務及晶圓級後護層封裝服務占該公司產品成本約九成，其他主要係為出售原物料收入及設計收入，占該公司產品成本比率微小，茲就晶圓級尺寸封裝服務及晶圓級後護層封裝服務分析說明如下：

晶圓級尺寸封裝服務主係用於影像感測器、光感測器及環境感測器等光學元件之全製程封裝，產品之應用領域則包括手機、平板電腦、筆記型電腦、汽車及醫療等。101 年度因半導體市場需求趨緩，銷貨客戶對備貨態度相對謹慎，且主要銷售客戶調整產品組合策略而縮減對該公司之訂單量，致晶圓級尺寸封裝服務之生產量及生產值皆較其他年度減少；102 年度由於影像感測器等光學元件之封裝需求回溫，致生產量及生產值皆較 101 年度增加，惟因增加招募生產線員工，致每人平均生產量值較 101 年度下滑；103 年度則受產品組合之影響，總生產量值略為降低，且每人平均生產量值亦降低。

晶圓級後護層封裝服務主要係指紋辨識感測器、作動感測器、微機電元件、功率、類比及 RF 元件之部分製程封裝，產品之應用領域包括手機、平板電腦、筆記型電腦、玩具、汽車等。101 年度因半導體市場需求趨緩，部分銷貨客戶對備貨態度相對謹慎而縮減對該公司之訂單量，致晶圓級後護層封裝服務之生產量及生產值皆較其他年度減少；102 年度因下半年度指紋辨識感測器封裝需求增加，其製程工序相對其他封裝服務之成本高，致晶圓級後護層封裝服務之生產量及生產值皆較 101 年度增加，且每人平均生產量值亦呈成長趨勢；103 年度因指紋辨識感測器封裝需求熱度未減，以及產品組合不同之影響，總生產量值仍呈成長趨勢。

綜上所述，該公司最近期及最近三個會計年度各主要產品別之產量、產值及每人每年生產量值變動情形尚屬合理。

- 2.最近期及最近三個會計年度員工總人數、離職人員、資遣或退休人數、直接或間接人工數、平均年齡及平均服務年資等資料，以評估離職率之變化情形及其合理性以及對申請公司營運之風險

單位：人；年；歲

年 度			101 年度	102 年度	103 年度
員 工 人 數	期初人數		1,333	1,378	1,747
	本期新進(註 1)		297	684	545
	本期 減少	離職(註 1)	247	311	321
		資遣	5	4	0
		退休	0	0	0
		合計	252	315	321
	期末人數		1,378	1,747	1,971
平均服務年資		3.70	3.20	3.35	
平均年齡		33	32	33	
離職率(%)(註 2)		15.46	15.28	14.01	
直接人員		887	1,192	1,278	
間接人員		491	555	693	

資料來源：該公司提供。

註 1：已扣除未滿試用期員工。

註 2：離職率=離職人數/(期末人數+離職人數)

該公司 101~103 年度之員工人數分別為 1,378 人、1,747 人及 1,971 人，呈逐年增加趨勢，主要係因應營收規模逐漸成長之業務所需，近年來持續招募生產線人員、業務人員與研發人員，致員工人數逐步成長，整體而言，該公司之員工人數變動尚無重大異常之情形。

種類		年度		101 年度		102 年度		103 年度	
				人數	%	人數	%	人數	%
離職 人數 (註 1) (註 2)	主管職員工			15	5.95	13	4.13	9	2.80
	一般職員			75	29.76	71	22.54	86	26.80
	生產線員工			162	64.29	231	73.33	226	70.40
	合計			252	100.00	315	100.00	321	100.00
期末人數				1,378		1,747		1,971	
離職率(%)(註 3)				15.46		15.28		14.01	

資料來源：該公司提供。

註 1：已扣除未滿試用期員工。

註 2：含退休及資遣員工。

註 3：離職率=離職人數/(期末人數+離職人數)

該公司 101~103 年度之離職率分別為、15.46%、15.28%及 14.01%，離職人員多數為年資較淺之一般職員及生產線員工，其原因主要係該等人員對工作性質及工作績效均未達其個人或該公司之要求而離職或資遣，其人員之流動應屬正常之人員異動，由於一般職員及生產線員工職務替代性較高，人員遞補訓練上尚無困難，該公司亦得藉由人員調配及招募更適切人選，在員工離職後均能迅速於短期內填補；主管職員工方面，主要係因個人生涯規劃及家庭因素考量，該公司各部門職掌均訂有作業程序，並重視員工教育訓練，另有完備之代理人制度，對於工作銜接不致產生重大影響。整體而言，該公司人員異動情形對其營運狀況尚不致造成重大影響。

(五)各主要產品之成本分析

- 1.最近期及最近三個會計年度主要產品之原料、人工及製造費用，並分析各成本要素之比率變化與同類別公司有無重大異常情事及對公司營運之風險

單位：新台幣仟元

產品	年度	101 年度		102 年度		103 年度	
	項目	金額	%	金額	%	金額	%
晶圓級 尺寸封裝 服務	原 物 料	419,550	15.69	530,698	18.12	416,856	14.98
	直 接 人 工	447,597	16.74	544,213	18.58	437,988	15.74
	製 造 費 用	1,806,726	67.57	1,854,096	63.30	1,928,401	69.29
	小 計	2,673,873	100.00	2,929,007	100.00	2,783,245	100.00
晶圓級後 護層封裝 服務	原 物 料	24,686	13.69	79,336	13.25	205,005	17.70
	直 接 人 工	25,369	14.07	76,654	12.81	231,289	19.97
	製 造 費 用	130,254	72.24	442,599	73.94	722,041	62.33
	小 計	180,309	100.00	598,589	100.00	1,158,335	100.00

產品	年度	101 年度		102 年度		103 年度	
	項目	金額	%	金額	%	金額	%
其他	原 物 料	5,747	15.75	10,199	16.29	2,180	14.96
	直 接 人 工	5,790	15.86	10,800	17.24	2,373	16.29
	製 造 費 用	24,959	68.39	41,627	66.47	10,014	68.75
	小 計	36,496	100.00	62,626	100.00	14,567	100.00
合計	原 物 料	449,983	15.57	620,233	17.28	624,041	15.77
	直 接 人 工	478,756	16.56	631,667	17.59	671,650	16.98
	製 造 費 用	1,961,939	67.87	2,338,322	65.13	2,660,456	67.25
	小 計	2,890,678	100.00	3,590,222	100.00	3,956,147	100.00

資料來源：該公司提供。

該公司為專業晶圓 IC 封裝公司，主要係於晶圓上利用相關製程技術從事晶圓加工，除晶圓係由銷貨客戶所提供外，因製程中需投入大量自動化設備，故其成本結構以製造費用所占比最高，最近三年度占總成本之比重分別為 67.87%、65.13%及 67.25%，且製造費用中以折舊費用比重最高；而原物料與直接人工占總成本之比重相當。該公司主要封裝服務分為兩類，晶圓級尺寸封裝服務為全製程封裝服務(自晶圓尚未切割以至切割成單顆之 IC)，而晶圓級後護層封裝服務則為配合客戶需求以其製程技術從事晶圓加工(完成後直接以晶圓之形式運送至其他下游廠商)，故前述二類封裝服務對整體成本之比重仍以晶圓級尺寸封裝服務為重，經檢視最近三年度各封裝服務之成本結構，主要均係隨原物料價格波動及機器設備攤提折舊費用，致各期料、工、費相對比重產生變化，然整體變動情形尚稱穩定，並無重大異常情事。

2.最近期及最近三個會計年度主要產品之主要原物料每年採購量及單位價格變化情形

單位：片/個/罐/桶；仟元

主要進貨 原料	101 年度			102 年度			103 年度		
	採購 數量	採購 金額	採購 單價	採購 數量	採購 金額	採購 單價	採購 數量	採購 金額	採購 單價
光學薄型 玻璃	415,512	158,480	0.38	526,865	179,793	0.34	463,398	173,618	0.37
靶材	1,183	30,906	26.13	1,506	39,006	25.90	2,001	36,763	18.37
鍍金液	455	32,659	71.78	575	35,883	62.41	575	32,691	56.85
電解光阻劑	523	25,879	49.48	860	42,324	49.21	1,037	48,589	46.86
黏著促進劑	2,040	18,734	9.18	3,952	35,841	9.07	3,316	30,193	9.11

資料來源：該公司提供。

該公司主要係於晶圓上利用相關製程技術從事半導體晶圓加工，主要原料為光學薄型玻璃、靶材、鍍金液、電解光阻劑及黏著促進劑等，茲就每年採購量及單位價格變動情形，說明如下：

(1)光學薄型玻璃

光學薄型玻璃為晶圓級尺寸封裝服務之主要原料，101~103年度採購數量主要隨營收之增減而變化，另因封裝製程改良，部分製程僅需單片光學薄型玻璃，而非原有製程所需的雙片光學薄型玻璃，亦會影響該公司之採購量；101年度則為因應部分客戶需求，將光學薄型玻璃委外加工鍍膜以利後續封裝製程之進行，致使採購單價略為增加，惟整體而言，其光學薄型玻璃採購單價變化尚屬合理。

(2)靶材

靶材(主要材質為鋁銅合金等)為晶圓級尺寸封裝服務及晶圓級後護層封裝服務之主要原料，101~103年度採購數量主要隨營收及產品組合之增減而變化，而採購單價除係隨著國際貴金屬行情波動影響，經評估尚無重大異常。

(3)鍍金液

鍍金液為晶圓級尺寸封裝服務及晶圓級後護層封裝服務之主要原料，101~103年度採購數量主要隨營收及產品組合之增減而變化，而採購單價除係隨著國際貴金屬行情波動影響，經評估尚無重大異常。

(4)電解光阻劑

電解光阻劑為晶圓級尺寸封裝服務及晶圓級後護層封裝服務之主要原料，101~103採購數量主要隨營收及產品組合之增減而變化，而採購單價除103年度因供應商調降價格，使採購單價下降外，其他年度採購單價變化尚屬穩定，經評估尚無重大異常。

(5)黏著促進劑

黏著促進劑為晶圓級尺寸封裝服務及晶圓級後護層封裝服務之主要原料，101~103年度採購數量主要隨營收及產品組合之增減而變化，而採購單價變化尚屬穩定，經評估尚無重大異常。

3.最近期及最近三個會計年度長期供貨契約，暨有關供貨有短缺或中斷情形資料，以評估供貨契約有否重大限制條款暨貨源是否有過度集中風險

為避免氮氣及氧氣價格隨電費調漲而波動，該公司與一供應商簽定長期供貨合約以穩定採購價格，然氮氣及氧氣並非其主要原物料，且該公司亦未與其他供應商簽訂長期供貨合約，故對該公司並不致產生重大營運風險。且該公司與主要供應商已建立良好之合作關係，並多有二家以上之供應商合作，故過去三年度及申請年度皆未有供貨短缺或中斷之情事發生，供貨來源尚屬穩定，且未有貨源過度集中之情形。

4.建設公司申請股票上櫃者，評估合建分售、合建分屋或合建分成者，申請公司與地主之分配比率是否合理

該公司非為建設公司，故不適用此項評估。

(六)匯率變動情形

1.最近三年度及申請年度最近期止兌換損益占營業利益之比率及內外銷、內外購比率以評估匯率變動對公司營運之風險

(1)最近三年度及申請年度截至最近期止內外銷、內外購比率

最近三年度及申請年度截至最近期止內外銷金額

單位：仟元

項目 \ 年度		101 年度		102 年度		103 年度	
		金額	%	金額	%	金額	%
內銷		510,443	16.26	1,190,213	27.96	2,069,314	41.94
外銷	美洲	1,481,268	47.18	1,630,592	38.31	1,528,052	30.97
	亞洲	662,836	21.11	960,429	22.56	686,177	13.91
	歐洲	482,356	15.37	475,527	11.17	650,535	13.18
	澳洲	2,482	0.08	-	-	-	-
	小計	2,628,942	83.74	3,066,548	72.04	2,864,764	58.06
合計		3,139,385	100.00	4,256,761	100.00	4,934,078	100.00

資料來源：該公司提供。

最近三年度及申請年度截至最近期止內外購金額

單位：仟元

項目 \ 年度		101 年度		102 年度		103 年度	
		金額	%	金額	%	金額	%
台幣付款		513,539	66.51	707,984	66.89	803,743	70.28
外幣付款	美金	157,192	20.36	236,551	22.35	237,050	20.73
	歐元	33,528	4.34	37,270	3.52	38,277	3.35
	日幣	42,217	5.47	46,698	4.41	42,076	3.68
	瑞士法郎	25,606	3.32	29,932	2.83	22,397	1.96
	小計	258,543	33.49	350,451	33.11	339,800	29.72
合計		772,082	100.00	1,058,435	100.00	1,143,543	100.00

資料來源：該公司提供。

該公司之銷貨計價以美元為主，而進貨計價以新台幣及美元為主，應收、應付款項可相互沖抵產生自然避險效果，惟在轉換成新台幣時，仍會因持有外幣部位而產生匯兌損益，該公司採取遠期外匯等財務性避險措施來降低進銷貨產生之外幣部位之匯兌風險，故對匯兌波動對該公司之影響有限。

2.評估匯率變動對公司營收及獲利之影響

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	101 年度	102 年度	103 年度
金融商品評淨(損)益 (A)	19,339	(20,661)	(51,338)
兌換(損)益 (B)	(22,333)	12,117	49,819
淨額 (C=A+B)	(2,994)	(8,544)	(1,519)
營業收入 (D)	3,139,385	4,256,761	4,934,078
營業淨利 (E)	(96,240)	380,636	675,630
C/D(%)	(0.10)%	(0.20)%	(0.03)%
C/E(%)	3.11%	(2.24)%	(0.22)%

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告

由上表可知，該公司 101~103 年度之淨兌換(損)益分別為占各年度營業收入淨額及營業淨利之比例分別為 (0.10)%、(0.20)%、(0.03)%及 3.11%、(2.24)%、(0.22)%，各年之淨兌換(損)益占營收淨額及營業淨利比重均尚非重大，故對匯兌波動對該公司之影響有限。

3.公司因應匯率變動所採取之避險措施

該公司主要銷貨客戶以美元計價為主，原物料供應商主要以台幣及美元等幣別計價，應收、應付款項相沖抵產生自然避險效果，惟在轉換成台幣時，仍因持有外幣部位而產生匯兌損益，因此，任何顯著的國際匯率變動將影響該公司獲利。該公司主要使用遠期外匯之衍生性金融交易以規避因淨外幣資產、負債所產生之匯率風險。除此以外，並採取以下措施以管理匯率波動風險：

(1)隨時蒐集有關匯率變化資訊，及參考銀行專業意見，以充分掌握匯率走勢。

(2)該公司已訂定「取得或處分資產處理程序」，規範有關衍生性金融商品之交易、風險管理、監督及稽核等處理程序。

四、最近期及最近三個會計年度募集與發行有價證券籌資效益

有關該公司最近期及最近三個會計年度前各次募集與發行有價證券其籌資計畫之執行情形及效益說明，請參閱本評估報告「肆、發行人前各次募集與發行及私募有價證券計畫之執行情形」之說明。

參、發行人之業務財務狀況

一、業務狀況

(一)最近期及最近三個會計年度財務報告主要銷售對象及供應商(年度前十名或占年度營業收入淨額或進貨淨額百分之五以上者)之變化分析

1.最近期及最近三個會計年度財務報告主要銷售對象(年度前 10 名或占年度營業收入淨額 5%以上者)之變化分析

(1)最近期及最近三個會計年度財務報告主要銷售對象之名稱、金額及占年度營業收入比例

單位:新台幣仟元

項 目	101 年度				102 年度				103 年度			
	名稱	金額	占全年度 營業淨額 比率%	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 營業淨額 比率%	與發行人 之關係	名稱	金額	占全年度 營業淨額 比率%	與發行人 之關係
1	OVTI 集團	1,261,163	40.17	註 1	OVTI 集團	1,580,579	37.13	註 1	台積電集團	1,732,290	35.11	註 2
2	B 公司	628,443	20.02	無	台積電集團	862,283	20.26	註 2	OVTI 集團	1,425,860	28.90	註 1
3	A 公司	443,542	14.13	無	A 公司	484,182	11.37	無	B 公司	667,339	13.52	無
4	C 公司	206,208	6.57	無	B 公司	422,281	9.92	無	A 公司	476,558	9.66	無
5	台積電集團	185,554	5.91	註 2	C 公司	386,302	9.08	無	D 公司	184,350	3.74	無
6	D 公司	132,571	4.22	無	D 公司	124,266	2.92	無	C 公司	123,377	2.50	無
7	G 公司	67,744	2.16	無	H 公司	106,399	2.50	無	I 公司	70,579	1.43	無
8	F 公司	66,959	2.13	無	F 公司	66,657	1.57	無	H 公司	48,851	0.99	無
9	E 公司	66,716	2.13	無	I 公司	65,592	1.54	無	比亞迪	43,434	0.88	無
10	H 公司	30,183	0.96	無	無錫鴻圖	33,879	0.80	無	G 公司	39,232	0.79	無
小計		3,089,083	98.40		小計	4,132,420	97.09		小計	4,811,870	97.52	
其他		50,302	1.60		其他	124,341	2.91		其他	122,208	2.48	
銷貨淨額		3,139,385	100.00		銷貨淨額	4,256,761	100.00		銷貨淨額	4,934,078	100.00	

資料來源：該公司提供。

註 1：該公司法人董事之母公司。

註 2：具有實質控制能力之母公司，102 年 6 月後為對該公司採權益法評價之投資公司。

(2)主要銷售對象變化情形之分析

該公司為專業 3D 晶圓級 IC 封裝之領導者，主要業務為提供影像感測器、環境感測器等之晶圓級尺寸封裝，其指紋辨識感測器、微機電及電源控制元件之晶圓級後護層封裝服務技術已臻成熟，並深獲客戶肯定。該公司主要客戶為晶圓代工大廠、影像感測器 IC 設計大廠、環境感測器 IC 設計公司、電源管理元件 IC 設計大廠、印表機噴墨頭 IC 設計公司等，最近三年度對前十大銷售對象之銷售比重分別為 98.40%、97.09%及 97.52%，其銷貨對象、金額及比率之變化情形，主要受產業景氣波動、客戶營運情形及新產品開發進度等因素而變動，茲就其最近三年度主要銷售對象變化情形及原因分析如下：

- ①台積電集團(台灣積體電路製造股份有限公司，負責人：張忠謀；資本額：新台幣259,286,171仟元；設立地區：台灣新竹科學園區；授信條件：月結30天；網址：www.tsmc.com)

台灣積體電路製造(股)公司(以下簡稱台積電)(台灣 TSE：2330，美國 NYSE：TSM) 成立於 76 年，在半導體產業中首創專業積體電路製造服務模式，為全球規模最大的專業積體電路製造公司，持續提供客戶最先進的技術及設計服務。台積電為全球六百多個客戶提供服務，生產超過一萬一千多種的晶片，被廣泛地運用在電腦產品、通訊產品與消費性電子產品等多樣應用領域。台積電的全球總部位於台灣新竹科學園區，在北美、歐洲、日本、中國大陸、南韓、印度等地均設有子公司或辦事處，提供全球客戶即時的業務和技術服務。

該公司與台積電之合作已超過 9 年，主係台積電透過 Turnkey Service 交易模式，由該公司提供台積電晶圓級後護層封裝服務。(Turnkey Service 為半導體業常見之交易模式，係當 IC 設計公司向晶圓製造廠下單時，晶圓製造廠可以提供從晶圓代工、封裝、測試之全套解決方案服務)該公司最近三年度對其之銷售金額分別為 185,554 仟元、862,283 仟元及 1,732,290 仟元銷售比率分別為 5.91%、20.26%及 35.11%，(102 年度包含對台積電(中國)有限公司之銷售約新台幣 81 仟元(美金 3 仟元))。該公司 101 年度與台積電以 Turnkey Service 交易模式，由該公司提供晶圓級後護層封裝服務，產品主要應用在電源管理 IC 及作動感測器(如陀螺儀與加速度器等)。102 年起全球半導體產業復甦，智慧型手持裝置包括智慧型手機及平板電腦的市場需求成長，其中，行動裝置對於個人隱私的保護需求成為市場新趨勢，而指紋辨識感測器即為一獨特且安全之辨識方式。因該公司晶圓級後護層封裝服務所使用之先進封裝技術成熟深獲終端客戶青睞，惟終端客戶為確保產品良率、品質控管及責任分工，並考量整體產品的產能供應鏈生產順暢，遂與台積電合作以 Turnkey 之商業模式合作，由台積電完成晶圓生產再垂直整合下游供應鏈製程，

以有效管理並降低產品風險及縮短產品交期，故在行動裝置市場大幅成長帶動指紋辨識感測器之需求下，該公司自 102 年下半年起持續提供台積電指紋辨識感測器之晶圓級後護層封裝服務，103 年延續訂單熱度，銷售金額持續增加，並首度超越 OVTI 集團，成為該公司第一大客戶。綜上，該公司對台積電之銷售變化情形尚屬合理。

- ②OVTI集團(OmniVision Technologies，負責人：Shaw Hong；股權淨值：美金1,082,671仟元；設立地區：美國加州；授信條件：月結30天；網址：www.ovt.com)

OmniVision Technologies, Inc.(美國 NASDAQ：OVTI)成立於 84 年，主要營業項目為影像感測器元件之設計、研發及市場銷售，為全球前十大影像感測器元件供應商，全球市佔率高達三成，產品廣泛應用於消費性及商務商品上(例如手機、筆記型電腦、安全監控系統、數位相機、車用顯示攝影及醫療攝影系統等)，其終端客戶包括國際知名品牌及非主流品牌廠商，並設有 19 家子公司，銷售市場遍及全球。

該公司主要提供其晶圓級尺寸封裝服務予 OVTI 集團，銷售對象主要包括 OmniVision Technologies, Inc.、OmniVision Technologies Singapore Pte. Ltd、OmniVision International Holding Ltd、台灣豪威科技有限公司及台灣豪威光電科技(股)公司等(以下通稱為 OVTI 集團)，產品主要應用於手機、平板及筆記型電腦等。該公司與 OVTI 集團之交易始於 92 年，與 OVTI 集團業務往來多年且合作關係良好穩定，101 年度為配合市場對更高階畫素的影像感測器需求，OVTI 集團進而調整其產品組合，並降低對該公司之下單量，以致該公司 101 年度對 OVTI 集團之總銷售淨額僅為 1,261,163 仟元，102 年度後則因銷售目標市場改變，OVTI 集團再度將重心移回中國大陸手機市場，並持續委託該公司進行影像感測器封裝，致 102 年度銷售淨額為 1,580,579 仟元；103 年度因配合市場需求增加對高階影像感測器需求，略為調整對該公司之下單量，致 103 年度該公司對其營業收入為 1,425,860 仟元。綜上，該公司對 OVTI 集團之銷售變化之情形尚合理。

- ③B公司

B 公司係國外上市公司，其主要營業項目為設計、製造及銷售類比及混合信號積體電路，產品主要應用在感測器、感測器介面、功率管理積體電路等，並可廣泛應用於消費、工業、醫療、流動通信及汽車市場。

該公司主要提供其晶圓級尺寸封裝服務，應用於影像感測器，101 年因 B 公司成功切入知名品牌手機供應鏈，使其業績上升，進而增加對該公司之封裝訂單，該公司自 101 年起對 B 公司之銷售數量穩定，102 年度銷貨淨額減少主要係因於產品製程共同開發階段(101 年前)，量產初期部份批次之產品不良，該公司與 B 公司經協商後同意共同承擔損失，

該公司以後續出貨折讓方式分期攤還相關補償款，另因 B 公司之良率要求較高，針對良率未達標準者另要求該公司以折讓方式補償，故隨 B 公司訂單成長而致 102 年折讓金額增加，該客戶銷售額排名與比重均下跌，103 年度因該公司製程逐漸成熟，致良率改善，折讓金額逐漸下降，故該公司對 B 公司之銷售金額與比重已持續回升。綜上，該公司對 B 公司之銷售變化情形尚屬合理。

④A公司

A 公司成立於 92 年，主要營業項目為積體電路及相關電子產品的設計、研發及測試，以及影像感測器的生產，並提供相關技術諮詢服務等，目標客群為中國及新興市場，產品主要應用在智慧型手機、平板電腦等移動裝置。該公司主要提供其晶圓級尺寸封裝服務，產品應用於影像感測器上，該公司配合 A 公司客製化需求而進行封裝服務，最近三年度 A 公司皆為該公司之前五大銷售客戶，對其銷售淨額分別為 443,542 仟元、484,182 仟元及 476,558 仟元，銷售比率分別為 14.13%、11.37% 及 9.66%，各年度大致呈穩定趨勢。綜上，該公司對 A 公司之銷售變化情形尚屬合理。

⑤D公司

D 公司其成立於 96 年，係國外上市公司之旗下子公司，技術核心聚焦於影像感測器、系統級晶片整合以及晶圓級攝影機解決方案，主要應用端包括手持式移動設備、消費性電子產品、監視安防攝影機及新興智慧型感測器市場。影像感測器之製造需要結合光學、美學、IC 設計與晶圓製造等四大領域專才，進入門檻高，D 公司於成立 2 年內即推出影像感測器產品，且產品深獲國際大廠採用，於近年在美國影像感測器應用市場之市佔率大幅提升。該公司主係提供 D 公司晶圓級尺寸封裝服務，產品應用於影像感測器，最近三年度該公司對其銷售金額分別為 132,571 仟元、124,266 仟元及 184,350 仟元，銷售比率分別為 4.22%、2.92% 及 3.74%，銷售金額及比重穩定，並無發現其銷售變化情形有重大異常情事。

⑥C公司

C 公司係國外上市公司，除耕耘記憶體市場有成外，基於記憶半導體領域所積累的技術競爭力，亦成功進入影像感測器市場，其產品得以廣泛應用於網路攝影機，微型醫療影像設備，以及搭載相機的行動電話與智慧型手機等。該公司主要提供其晶圓級尺寸封裝服務，產品應用於影像感測器，101 年至 102 年間 C 公司配合市場需求調整對該公司之訂單，致最近二年銷售金額分別為 206,208 仟元及 386,302 仟元；103 年度因 C 公司調整其產品組合，減少對該公司之下單量，以致該公司對 C 公

司銷貨金額下降至 123,377 仟元。綜上，該公司對 C 公司之銷售變化情形尚屬合理。

⑦I公司

I 公司為全球功率半導體及電源管理方案之領導廠商，係國外上市公司，其生產之整流器可應用於電腦、效率能源應用設備、照明、汽車、衛星、飛機及防衛系統上。過去該公司主要係提供 MOSFET 功率場效電晶體之封裝服務(此類產品對可靠度要求高)，惟當時之交易模式屬於台積電 Turnkey Service 一環，因該公司之封裝品質獲得 I 公司之肯定，故自 101 年起 I 公司開始調整其下單模式，逐步改與該公司直接交易，故 101 年度銷售金額僅 1,262 仟元，102 年起已全面改成直接交易模式，故 102 年度及 103 年度銷售金額分別為 65,592 仟元及 70,579 仟元。綜上，該公司對 I 公司之銷售變化尚屬合理。

⑧比亞迪(深圳比亞迪微電子有限公司，負責人：王傳福；資本額：人民幣 2,354,100 仟元；設立地區：深圳；授信條件：月結 30 天；網址：-)

深圳比亞迪微電子有限公司(以下簡稱比亞迪)設立於 93 年，是 BYD Company Ltd. (港交所：1211；深交所：002594)的子公司，致力於積體電路及功率器件的開發，並提供產品應用的整套解決方案，主要產品為影像感測器、IGBT 晶片及模組，智慧功率模組(IPM)、功率場效應管(MOSFET)、觸控板等。比亞迪擁有豐富的技術人才，獨立開發出多款具有世界先進水準的產品，並獲得多項中國及國際專利，以及多家國際手機大廠之認可。該公司主要提供其影像感測器之晶圓級尺寸封裝服務，101 年至 103 年度該公司對其銷售金額分別為 7,594 仟元、27,533 仟元及 43,434 仟元，呈向上趨勢，主要係因 102 年起隨着移動互聯網的快速普及和智能應用的不斷豐富，智慧型手機市場需求上升，帶動比亞迪對該公司之下單量，綜上，該公司對比亞迪之銷售變化情形尚屬合理。

⑨G公司

G 公司成立於 89 年，主要係生產噴墨印表頭晶片，該種印表機主要客群為商用印表機需求者及 SOHO 族，商品特色為可快速列印高畫質圖像。該公司主要提供其晶圓級後護層封裝服務，進行微機電元件(MEMS)之重佈線製程。該公司與 G 公司往來超過 5 年，101 年至 103 年間，除 102 年外皆為該公司之前十大銷售客戶。該公司 101 年至 103 年對其銷售金額分別為 67,744 仟元、21,446 仟元及 39,232 仟元，主係因高階智能噴墨列印機市場景氣不佳，造成 G 公司業績不穩定，連帶影響對該公司之下單量。綜上，該公司對 G 公司之銷售變化情形尚屬合理。

⑩H公司

H 公司成立於 86 年，為一專業晶片設計公司，並為全球平面顯示螢幕驅動 IC 之主要供應商，產品成功獲得國際知名平面顯示器供應商之採用。其產品廣泛應用於手機、數位相機、MP3、iPod 等個人消費性電子產品，以及家庭及商業應用的顯示螢幕與數位產品。該公司主要提供其晶圓級尺寸封裝服務，產品應用於影像感測器。該公司自 98 年與 H 公司首次交易，101 年度之銷售額為 30,183 仟元，102 年度因 H 公司調整其產品組合，並將影像感測晶片應用於手機及相機模組上，故對該公司封裝服務需求大幅提升，銷售淨額成長為 106,399 仟元，並成為該公司之第七大銷售客戶，103 年度則因 H 公司持續消化庫存，雖該公司與 H 公司已合作開發其他高階產品方案，仍無法及時挹注 103 年度之銷貨金額，致銷售額大幅下降。綜上，該公司對 H 公司之銷售變化情形尚屬合理。

⑪F公司

F 公司成立於 97 年，係台灣上櫃公司之子公司，主營業務項目為影像感測元件的研發、設計、製造及其相關產品之進出口貿易業務。該公司主要提供其晶圓級尺寸封裝服務，產品應用於影像感測器，因 F 公司深耕中國大陸白牌手機市場多年，對該公司 101 年至 102 年之下單情形穩定，分別為 66,959 仟元、66,657 仟元，然因近年來中國手機市場競爭激烈，F 公司逐步調整產品組合，並轉戰至行車紀錄器及安全監控市場，故對該公司訂單金額大幅減少至 9,383 仟元。綜上，該公司對 F 公司之銷售變化情形尚屬合理。

⑫無錫鴻圖(無錫鴻圖微電子技術有限公司，負責人：魏玉；資本額：人民幣10,000仟元；設立地區：中國江蘇省；授信條件：月結30天；網址：www.hongtuic.com)

無錫鴻圖微電子技術有限公司(以下簡稱無錫鴻圖)成立於 101 年，為影像感測器核心晶片設計、開發、生產及銷售，產品廣泛應用於手機照相攝像、數碼相機和攝像機、筆記型電腦及網路攝像機、安防監控、汽車照相及醫療窺鏡等領域。該公司主要提供其晶圓級尺寸封裝服務，產品應用於影像感測器與環境感測器，並自 102 年起開始與其交易，102 年度及 103 年該公司對其銷售金額分別為 33,879 仟及 5,240 仟元，102 年度其亦為該公司前十大銷貨客戶之一，103 年因其改變產品組合，且逐漸淡出市場，故對該公司訂單數量減少。綜上，該公司對無錫鴻圖之銷售變化情形尚屬合理。

⑬E公司

E 公司成立於 87 年，主要致力於影像感測器及影像應用 IC 的設

計、研發、生產與銷售。E 公司擁有豐富的類比 IC 設計、影像及色彩處理、混合訊號電路以及數位及類比電路整合技術，目前是全球影像感測器以及數位影像應用 IC 的領導廠商之一。產品主要應用於數位相機、數位攝影機、玩具、PC camera、光學滑鼠、保全監視系統、行動電話等。該公司主要提供其晶圓級尺寸封裝服務，產品應用於影像感測器(遊戲產品用)，最近三年度該公司對其銷售金額分別為 66,716 仟元、28,257 仟元及 12,989 仟元，逐年減少主要係因遊戲機產品銷售狀況退潮，且其他產品之營運狀況不如預期，故逐漸減少對該公司之封裝服務需求。綜上，該公司對 E 公司之銷售變化情形尚屬合理。

(3)是否有銷售集中之風險

該公司耕耘半導體後段封裝服務領域多年，主要客戶包括國際知名影像感測器大廠、國內外半導體設計公司及半導體晶圓大廠等，其前十大銷售客戶 101~103 年佔各該年度營收淨額之比率分別為 98.40%、97.09%及 97.52%，其中，101~102 年對關係人 OVTI 集團之銷貨及 103 年對關係人台積電集團之銷貨分別有超過該公司銷售淨額之三成之情形。由於晶圓級尺寸封裝服務及後護層封裝服務，均涉及銷貨客戶(或終端客戶)之 IC 設計，需要在產品初期即與客戶密切合作，該公司與 OVTI 集團及台積電集團均往來多年且關係良好穩定，此種之合作模式得以更加強化半導體供應鏈之穩定性及可靠性，並產生規模經濟效應所致。該公司業將持續精進三維晶圓級相關先進製程技術之開發，未來期能將業務擴展至晶圓級系統整合封裝(System in Package)外，並於 103 年進軍 12 吋晶圓級封裝領域，逐步建置 12 吋晶圓級封裝之產線，以因應高端感測器客戶之需求，希冀藉由封裝服務技術暨應用產品之多元化，增加客戶群及創造營收，以分散銷售集中於關係人之風險。

(4)銷售政策

①建立以客戶導向之專業封裝服務，掌握關鍵客戶產品需求

該公司建立完整技術專利，並藉由開發符合市場需求之先進晶圓級封裝解決方案，掌握關鍵客戶產品需求並強化與上游半導體產業技術之整合，以在晶圓級製程平台上提供客戶所需的技術、嚴謹的生產、優良的品質和優質的服務。

②加強上、中、下游產業鏈之合作關係

先進製程需求越來越高之際，上、中、下游之合作與整合是先進高階製程能否成功之重要關鍵，該公司藉由其先進技術之創新及整合能力建立並簡化半導體上、中、下游產業鏈虛擬一條龍式解決方案(Virtual Turnkey Solution)，提供無晶圓廠(Fabless)、系統客戶及輕晶圓廠(Fab-Lite IDM)封裝技術之解決方案。

③聚焦新興行動裝置市場，跨足其他領域

該公司之核心技術為三維晶圓級尺寸封裝、二維及三維晶圓級後護層封裝，其致力於衍生製程與新製程之研究發展，如先進三維晶圓級堆疊之應用、矽晶圓連接之載板等，持續精進二維及三維晶圓級相關先進製程技術之開發，未來期能將業務擴展至晶圓級系統整合封裝(System in Package)，以提供客戶更完善之銷售服務，產品之應用將聚焦於作動感測器、加速度器、陀螺儀等，並將產品應用市場從消費性與電腦之應用提昇至穿戴式裝置更跨足汽車電子產業。

2.最近期及最近三個會計年度財務報告主要供應商(年度前十名或占年度進貨淨額百分之五以上者)之變化分析

(1)最近期及最近三個會計年度各主要供應商名稱、進貨淨額占當年度進貨淨額百分比及其金額

單位：新台幣仟元

	101 年度				102 年度				103 年度			
項目	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行 人之關 係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行 人之關 係	名稱	金額	占全年度 進貨淨額 比率(%)	與發行 人之關 係
1	NEG	78,839	10.21	無	NEG	100,190	9.47	無	台灣羅門哈斯	82,744	7.24	無
2	台灣羅門哈斯	51,701	6.70	無	琳得科	79,752	7.53	無	琳得科	81,855	7.16	無
3	耀穎	50,020	6.48	無	台灣羅門哈斯	78,694	7.43	無	NEG	80,249	7.02	無
4	琳得科	49,759	6.44	無	三福	56,712	5.36	無	三福	67,581	5.91	無
5	三福	38,240	4.95	無	台灣波律	47,557	4.49	無	耀穎	53,528	4.68	無
6	MITSUYA	37,606	4.87	無	MITSUYA	40,806	3.86	無	家榮	50,240	4.39	無
7	台灣波律	35,552	4.60	無	家榮	39,703	3.75	無	台灣波律	42,754	3.74	無
8	家榮	35,333	4.58	無	SCHOTT	37,067	3.50	無	安智	39,266	3.43	無
9	SCHOTT	32,877	4.26	無	台灣陶氏化學	35,841	3.39	無	SCHOTT	38,277	3.35	無
10	繼業	29,270	3.79	無	耀穎	35,586	3.36	無	MITSUYA	37,841	3.31	無
	小計	439,197	56.88		小計	551,908	52.14		小計	574,335	50.23	
	其他	332,885	43.12		其他	506,527	47.86		其他	569,208	49.77	
	進貨淨額	772,082	100.00		進貨淨額	1,058,435	100.00		進貨淨額	1,143,543	100.00	

資料來源：該公司提供

(2)主要供應商變化情形之原因並分析是否合理

該公司主要從事光學感測元件之晶圓級封裝服務，以及應用於其他感測器之晶圓級後護層封裝服務，主要進貨項目為光學薄型玻璃、電解光阻劑、切割刀、膠帶及氮氣等晶圓封裝過程中所需之原物料。101~103 年度十大供應商進貨金額佔年度進貨比例分別為 56.88%、52.14%及 50.23%，茲將 101~103 年度主要供應商之變化情形說明如下：

①台灣羅門哈斯電子材料股份有限公司(以下簡稱台灣羅門哈斯)

台灣羅門哈斯為美國上市公司陶氏化學(Dow Chemical Company, 美國紐約證券交易所掛牌，股票代號：DOW)之成員企業，位於桃園；陶氏化學成立已超過一百年，總部位於美國密西根州，為全球特殊材料產業領域的創新技術與解決方案的領導廠商，台灣羅門哈斯的技術被廣泛應用於建築塗料和工業塗料、個人護理和家用及工業用化學品。該公司與台灣羅門哈斯自97年開始交易，主要向其購買半導體製程所需材料及特殊化學品(如電解光阻劑、防焊劑及黏著劑等)。101~103年度對其採購金額分別為51,701仟元、78,694仟元及82,744仟元，佔進貨淨額比重分別為6.70%、7.43%及7.24%，對其採購金額變動主要受客戶需求及製程考量影響，101年度全球半導體產業景氣低迷，致採購金額大幅減少；102年度隨著景氣復甦及新封裝產品之挹注，致相關採購金額大幅提升；103年度則因延續銷售訂單之需求，採購狀況呈穩定增加，整體而言，該公司對台灣羅門哈斯之採購變化尚屬合理。

②琳得科先進科技股份有限公司(以下簡稱琳得科)

琳得科為日本上市公司琳得科株式會社(東京證券交易所上市一部掛牌，股票代號：7966，成立於16年)於89年設立之台灣子公司，位於高雄。主要產品為工業用薄膜、黏著紙、黏著膠膜、半導體相關產品及液晶顯示器專用膠膜等。該公司與琳得科自96年開始交易，主要向其採購半導體產業常用之研磨或切割時晶片背面保護膠帶。101~103年度對其採購金額分別為49,759仟元、79,752仟元及81,855仟元，佔進貨淨額比重分別為6.44%、7.53%及7.16%，對其採購金額變動主要受客戶需求及製程考量影響，經評估其變化尚屬合理。

③NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. (以下簡稱NEG)

NEG成立於38年，為一日本公司，總部位於滋賀縣，主要從事各尺寸顯示器及電子產品之特殊玻璃製造、研發及銷售。該公司與NEG自94年開始交易，主要向其採購光學薄型玻璃，101~103年度對其採購金額分別為78,839仟元、100,190仟元及80,249仟元，佔進貨淨額比重分別為10.21%、9.47%及7.02%，對其採購金額變動主要受客戶需求及製程考量影響，101年度採購金額下降，除受全球半導體產業景氣低迷之影響外，主係該公司在晶圓封裝製程上有所改良，部分製程中，晶圓加工僅需單

片光學薄型玻璃，而非原先的雙片光學薄型玻璃；而102年度採購金額增加除受客戶需求及製程考量影響外，另考量外幣計價所生之匯率風險等因素，該公司逐漸將光學薄型玻璃的採購量集中於NEG；103年度主係因客戶之產品組合需求變化，致光學薄型玻璃採購量減少，經評估其變化尚屬合理。

④三福氣體股份有限公司(以下簡稱三福)

三福成立於63年，為台灣公司，位於台北，主要產品為工業氣體(如：氣態與液態氧、氮、氫、氬、氦及二氧化碳)及電子化學品(如：去光阻液、拋光研磨液等)。該公司與三福自96年開始交易，主要向其採購晶圓封裝製程常用之氮氣(用來保存晶片及清潔)及少量去光阻液等。該公司101~103年度對其採購金額分別為38,240仟元、56,712仟元及67,581仟元，佔進貨淨額比重分別為4.95%、5.36%及5.91%，101年度採購金額下降主係受全球景氣不佳影響客戶之需求所致，102年迄今因製程考量，對其採購之去光阻液增加，以致該公司對三福之採購金額持續提升，經評估其變化尚屬合理。

⑤耀穎光電股份有限公司(以下簡稱耀穎)

耀穎成立於92年，為台灣公司，其工廠位於新竹，主要業務為生產應用於光電產業之光學薄膜及其元件，其主要產品包括晶圓級封裝光學元件、光學儀器應用之濾波片、半導體光學元件及混合型吸收式紅外光截止濾光片等。該公司與耀穎自100年開始交易，主要委託其對光學薄型玻璃進行加工鍍膜。101~103年度對其採購金額分別為50,020仟元、35,586仟元及53,528仟元，佔進貨淨額比重分別為6.48%、3.36%及4.68%，101年度採購金額上升主係該公司部分銷售客戶之產品對加工鍍膜需求增加所致，102年度則因耀穎代工之某批鍍膜產品品質不良，影響該公司之成品良率，經協議提供該公司進貨折讓，103年度因該公司客戶需求變動且耀穎也改善其不良原因後，該公司委託其代工鍍膜金額亦提升，經評估其變化尚屬合理。

⑥家榮股份有限公司(以下簡稱家榮)

家榮成立於68年，為台灣公司，位於台北，主要營運項目為代理引進半導體及電子產品等領域之設備(例如半自動晶圓切割機、研磨機、清洗機、拋光機及溫控警示看板等)。該公司與家榮自96年開始交易，主要向其採購切割刀及研磨輪。101~103年度對其採購金額分別為35,333仟元、39,703仟元及50,240仟元，佔進貨淨額比重分別為4.58%、3.75%及4.39%，101年度採購金額上升主係該公司為分散對切割刀採購之供應商，而增加對家榮之採購所致；102年度迄今另因部分客戶持續對該公司下單，其該等製程所需之特定切割刀採購需求亦增加所致，經評估其變化尚屬合理。

⑦台灣波律股份有限公司(以下簡稱台灣波律)

台灣波律成立於72年，為台灣公司，位於台北，主要業務為研發自製、代理進口化學原物料銷售，客戶群涵蓋電子業上中下游及化工業，諸如半導體、觸控面板、發光二極體、太陽能等產業。該公司與台灣波律自97年開始交易，主要向其採購清潔用之乙醇及丙酮。101~103年度對其採購金額分別為35,552仟元、47,557仟元及42,754仟元，佔進貨淨額比重分別為4.60%、4.49%及3.74%，對其採購金額變動主要受客戶需求及製程考量影響，經評估其變化尚屬合理。

⑧台灣安智電子材料股份有限公司(以下簡稱安智)

安智成立於75年，為世界知名的化工電子材料領導廠商AZ Electronic Material (以下簡稱AZ)的成員，103年AZ 經製藥與化學領域之高科技產品領導企業默克集團(Merck, NYSE 掛牌公司, 股票代號 MRK)收購，安智主要產品為正負光阻劑、顯影劑及黏著劑等。該公司與安智自93年開始交易，主要向其採購光阻劑，其常用於蝕刻製程中，利用曝光產生化學反應，進而達到想要的效果。101~103年度對其採購金額分別為15,208仟元、31,777仟元及39,266仟元，佔進貨淨額比重分別為1.97%、3.00%及3.43%，對其採購金額變動主要受客戶需求及製程考量影響，隨著該公司營業規模持續擴大，使用安智提供之光阻液數量增加，遂逐年增加採購金額，於103年度首次進入前十大供應商名單，經評估其變化尚屬合理。

⑨MITSUYA BOEKI LTD. (以下簡稱MITSUYA)

MITSUYA成立於西元1985年（昭和60年），為一日本代理商，位於大阪，主要業務為代理銷售各類化學藥品、醫藥原料、電子材料等產品。該公司與MITSUYA之交易係採購OKUNO Chemical Industries Co., LTD(以下簡稱OKUNO)之鍍金液(鍍金液多與電解光阻劑配合使用，主要功用為讓金沉積在製程所需的線路上)。OKUNO 成立於西元1905年，主要生產金屬表面處理之化學藥劑，98年起OKUNO指定MITSUYA為代理商，故該公司自98年開始與MITSUYA交易。101~103年度對其採購金額分別為37,606仟元、40,806仟元及37,841仟元，佔進貨淨額比重分別為4.87%、3.86%及3.31%，對其採購金額變動主要受客戶需求、製程考量及金價影響，101年度起採購金額下降主係該公司在晶圓封裝製程上有所改良，在化鍍製程中控制其他化學品產生之化學反應，進而降低鍍金液之使用量；103年度除因製程改進之影響外，亦受到金價價格下跌及日幣貶值等影響，致103年度採購金額減少，經評估其變化尚屬合理。

⑩Schott AG(以下簡稱SCHOTT)

SCHOTT為德國知名玻璃製造公司之成員，為一橫跨眾多產業的國際科技集團，主要業務涵蓋應用光學、特殊應用玻璃、太陽能及數位投影等。該公司與SCHOTT自90年開始交易，採購對象包括Schott AG及其

子公司 Schott Glass Malaysia Components Sdn Bhd，主要向其採購光學薄型玻璃。101~103 年度對其採購金額分別為 32,877 仟元、37,067 仟元及 38,277 仟元，佔進貨淨額比重分別為 4.26%、3.50% 及 3.35%，對其採購金額變動主要受客戶需求及製程考量影響，自 102 年度起進貨淨額持續增加，經評估其變化尚屬合理。

⑪ 繼業企業股份有限公司(以下簡稱繼業)

繼業成立於 65 年，為台灣公司，位於台北，主要業務為電子器材及其零組件成品之買賣、設計、加工、製造及進出口。該公司與繼業自 90 年開始交易，主要向其採購切割刀。101~103 年度對其採購金額分別為 29,270 仟元、34,226 仟元及 35,839 仟元，佔進貨淨額比重分別為 3.79%、3.23% 及 3.13%，102 年度隨著景氣復甦及晶圓級尺寸封裝製程產品需求增加，致採購金額逐年增加，然佔進貨淨額比重變化不大，經評估其變化尚屬合理。

⑫ 台灣陶氏化學股份有限公司(以下簡稱台灣陶氏化學)

台灣陶氏化學成立於 73 年，為美國上市公司陶氏化學(Dow Chemical Company，美國紐約證券交易所掛牌，股票代號：DOW)之成員企業，總部位於美國密西根州，為全球特殊材料產業領域的創新技術與解決方案的領導廠商，該公司技術被廣泛應用於建築塗料和工業塗料、個人護理和家用及工業用化學品。該公司與台灣陶氏化學自 97 年開始交易，主要向其採購光阻黏著促進劑。101~103 年度對其採購金額分別為 18,734 仟元、35,841 仟元及 30,193 仟元，佔進貨淨額比重分別為 2.43%、3.39% 及 2.64%，對其採購金額變動主要受客戶需求及製程考量影響，於 102 年度首次進入前十大供應商名單，經評估其變化尚屬合理。

(3) 是否有進貨集中之風險

該公司於 101~103 年度對前十大供應商進貨金額佔年度進貨比例分別為 56.88%、52.14% 及 50.23%，除 101 年度向 NEG 採購金額佔總進貨金額 10.21% 外，因進貨品項繁多，並無對其他供應商有進貨比重超過 10% 之情事。另因該公司採購之主要原物料多有兩家以上可供貨之來源，且與供應商均保持良好之合作關係，供貨來源尚屬穩定。綜上所述，該公司尚無進貨集中而導致供貨短缺或中斷之風險。

(4) 進貨政策

該公司進貨政策係依實際或預估之訂單狀況、考量庫存消耗量、生產排程及安全存量後，作為採購之計算標準，以維持適當之採購數量，同時定期每週召開產銷協調會議，使相關單位充分了解公司生產及去化狀況，作為採購部門及時調整之依據，避免因過度採購造成資金積壓或採購不足造成供應間斷之風險。在主要進貨項目上，該公司多能有至少二家以上之供應商，以滿足製程所需並減少進貨中斷或短缺之可能性，此外該公司亦經由定期評鑑供應商供貨品質及交期，以確保生產品質、效率及良率，並

且定期觀察市場原料價格之變動，適時與現有之供應商進行議價以降低進貨成本，確保公司採購價格之合理性。觀察該公司最近三年度，並未有供貨中斷或短缺之情事發生，經評估其進貨政策尚屬允當。

(二)最近期及最近二個會計年度發行人之財務報告及個體財務報告應收款項變動之合理性、母子公司備抵呆帳提列之適足性及收回可能性之評估，並與同業比較評估

1.合併財務報告

該公司最近兩年度及申請年度截至目前為止無須編製合併財務報告，故僅針對個體應收款項進行分析。

2.個體財務報告

(1)應收款項變動之合理性

單位：新台幣仟元

項目		102 年度	103 年度
營業收入淨額		4,256,761	4,934,078
應收款項總額	應收票據	-	-
	應收帳款-關係人	516,431	673,527
	應收帳款-非關係人	235,348	266,080
	合計(A)	751,779	939,607
備抵呆帳提列數(B)		-	522
備抵銷貨退回與折讓(C)		50,640(註)	60,155(註)
應收款項淨額(A)-(B)-(C)		701,139	878,930
備抵呆帳提列比率(B)/(A)%		-	0.06
應收款項週轉率(次)		7.28	5.84
應收款項收現日數(天)		50	63
授信條件		考量個別客戶營運規模、財務狀況、信用紀錄及過去往來交易情形，給予不同授信條件，一般收款條件在月結 30~60 天間。	

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告。

註：備抵銷貨退回及折讓於102年度起依國際財務報導準則規定重分類為負債準備(帳列流動負債項下)。該公司業務人員每月底依據歷史經驗及估計未來可能發生的金額訂定之，會計人員並據以調整入帳。

該公司 102 年底及 103 年底之應收款項總額分別為 751,779 仟元及 939,607 仟元，103 年底應收款項總額較 102 年底增加 187,828 仟元，增加幅度約為 24.98%，主係因受惠於全球半導體市場在智慧行動裝置的帶動下開始恢復成長態勢，且隨行動裝置產品影像品質需求殷切，以及對個人隱私的保護需求，該公司在持續開發其晶圓級尺寸封裝及晶圓級後護層封裝技術並成功量產下，營收呈成長趨勢，且因 103 年第四季營收較 102 年同期成長，致應收帳款部位亦增加，其變化應屬合理。

而在應收帳款週轉率變動方面，該公司 102 年度及 103 年之應收帳款週轉率分別為 7.28 次及 5.84 次，而週轉天數則分別為 50 天及 63 天。由於 103 年度營收與 102 年度相較成長幅度為 15.91%，而 103 年之平均應收款項淨額為 845,432 仟元 $((939,085+751,779)/2)$ ，與 102 年度之平均應收款

淨額 584,847 仟元 $((751,779+417,915)/2)$ 相較，平均應收款項之成長幅度高達 44.56%，在應收成長幅度高於營收成長幅度下，致該公司之週轉天數略為拉長，惟仍與該公司之授信政策月結 30~60 天約略相當，尚無重大異常。

綜上，該公司最近兩年度應收款項淨額及週轉率之變動，大致上隨營業收入之增減變化及銷貨淡、旺季影響而變動，應尚屬合理且無重大異常。

(2) 備抵呆帳提列之適足性

① 備抵呆帳提列政策

該公司考量過去應收票據的期後兌現情形良好，未有跳票情事發生，故原則上該公司並不針對應收票據提列備抵呆帳，惟若特殊情況逾期有無法收回之虞時，則個別認定予以提列備抵呆帳。

該公司就應收帳款於每一資產負債表日評估其減損跡象，當有客觀證據顯示應收帳款之估計未來現金流量受影響時，應認列減損損失；另就未發現個別減損之客觀證據，該公司先將銷售客戶進行信用評鑑，依銷售客戶組織狀況、財務狀況及營運狀況給予評分，依評分結果分為五級，A 為評等分數最高者，依序為 A~E，並綜合考量業務單位對銷售客戶各應收款項收回可能性之評估後，除逾期帳齡超過 90 天以上者提列 100% 之備抵呆帳外，逾期帳齡小於 90 天以下者，按其信用評等分別提列 0%~2.0% 不等之備抵呆帳，茲將其應收帳款備抵呆帳提列比率列示如下：

評等	逾期天數		
	0	1-90	>90
A	0.00%	0.05%	100%
B	0.05%	0.10%	100%
C	0.10%	0.50%	100%
D	0.20%	1.00%	100%
E	0.40%	2.00%	100%

資料來源：該公司提供。

該公司根據保守穩健原則，已依據該公司訂定之備抵呆帳提列政策，對國內外銷貨客戶之應收帳款進行備抵呆帳提列，經評估其備抵呆帳提列政策尚屬合理，應無重大異常。

② 備抵呆帳提列適足性

單位：新台幣仟元

項目	年度	102 年度	103 年
		金額	金額
期初備抵呆帳餘額		3,157	-
本期增加		-	522
本期減少		(3,157)	-
期末備抵呆帳餘額		-	522

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告。

該公司 102 年底及 103 年底之備抵呆帳金額分別為 0 仟元及 522 仟元，占各該年底應收款項總額之比率分別為 0.00%及 0.06%，該公司因逾期帳款比率低，致備抵呆帳應提列金額較低，加上該公司每月相關業務人員會針對逾期未收回款項進行瞭解與催收，並依據該公司「應收款項作業辦法」提列相關備抵呆帳，經評估尚無重大異常情形。

而在提列適足性方面而言，該公司自 102 年度起，迄今未有實際發生之壞帳費用，且因其主要銷貨客戶多為長期合作之關係人或國際大廠，應收帳款品質相對穩定，款項收回情形尚無重大疑慮，又因該公司已針對所有應收帳款依其帳齡提列備抵呆帳，並個別認定可能發生壞帳之風險，按月定期評估應收帳款收回情形，對已逾收款期限仍未收款之客戶，亦藉由業務人員密集接觸加強掌握，進行瞭解分析，故該公司備抵呆帳提列適足性應尚屬允當。

(3)應收款項收回可能性之評估

單位：新台幣仟元；%

項目	103 年 12 月 31 日	截至 104 年 1 月 31 日 止之收回情形		截至 104 年 1 月 31 日 止之未收回情形	
		金額	比率(%)	金額	比率(%)
應收票據	-	-	-	-	-
應收帳款	939,607	449,035	47.79	490,572	52.21
合計	939,607	449,035	47.79	490,572	52.21

資料來源：該公司提供。

該公司 103 年底之應收款項總額為 939,607 仟元，截至 104 年 1 月 31 日止已收回 449,035 仟元，收回比率達 47.79%，而未收回款項中，均為未逾期帳款，其應收款項收回情形良好。

(4)與同業比較

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 期間		102 年度	103 年度
營業收入淨額	精材	4,256,761	4,934,078
	日月光	219,862,446	註
	同欣	7,929,440	註
	菱生	6,047,661	註
應收款項總額	精材	751,779	939,607
	日月光	43,303,693	註
	同欣	1,036,177	註
	菱生	1,325,598	註
備抵呆帳	精材	-	522
	日月光	68,120	註
	同欣	23,382	註
	菱生	4,712	註

項目 \ 期間		102 年度	103 年度
應收款項淨額	精材	751,779	939,085
	日月光	43,235,573	註
	同欣	1,012,795	註
	菱生	1,320,886	註
備抵呆帳損失占應收款項總額比例(%)	精材	-	-
	日月光	0.16	註
	同欣	2.26	註
	菱生	0.36	註
應收款項週轉率(次)	精材	7.28	5.84
	日月光	5.45	
	同欣	7.49	註
	菱生	4.44	註
應收款項週轉天數(天)	精材	50	63
	日月光	67	註
	同欣	49	註
	菱生	82	註

資料來源：各公司經會計師查核簽證之財務報告。

註：截至評估報告出具日止，尚未公告 103 年度財務報告。

與採樣同業相較，該公司 102 年度之應收款項週轉率僅略遜於同欣，惟優於其他採樣同業，且因其最近二年度並無實際發生呆帳損失，加上應收款項期後收款情形良好，故應收款項品質相對穩定，備抵呆帳提列情形尚屬允當。

(三)最近期及最近二個會計年度發行人之財務報告及個體財務報告存貨淨額變動之合理性、母子公司備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列之適足性評估，並與同業比較評估

1.合併財務報告

該公司最近期及最近二個會計年度無須編製合併財務報告，故僅針對個體財務報告存貨進行說明。

2.個體財務報告

(1)申請公司最近期及最近二個會計年度財務報告存貨總額變化

單位：新台幣仟元

項目/年度	102 年度	103 年度
營業收入	4,256,761	4,934,078
營業成本	3,561,619	3,985,874
原物料	113,502	153,839
在製品	66,897	53,973
製成品	43,995	24,035
存貨總額	224,394	231,847

項目/年度	102 年度	103 年度
備抵存貨跌價及呆滯損失	(7,624)	(18,070)
期末存貨淨額	216,770	213,777
存貨週轉率(次)	19.45	18.52
存貨週轉天數(天)	19	20

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告；該公司提供。

該公司 102 年底及 103 年底之存貨總額分別為 224,394 仟元及 231,847 仟元，103 年底與 102 年底相較增加幅度為 3.32%，主係因該公司 103 年度延續 102 年下半年度新訂單之需求，出貨狀況穩定，該公司業已積極備料，使得原物料大幅增加 35.54%，然該公司積極去化製成品，以致 103 年底之存貨總額僅微幅增加。整體而言，並無重大不合理。

存貨週轉率方面，受惠於 102 年下半年新訂單需求延續之影響，103 年度營業收入較 102 年度成長 15.91%，營業成本增幅為 11.91%，然因 103 年底之存貨平均水位高於 102 年底，致存貨週轉率由 102 年度之 19.45 次下降至 103 年度之 18.52 次，週轉天數則由 19 天上升至 20 天，整體而言，並無重大不合理。

(2)申請公司截至最近期止存貨去化情形

單位：新台幣仟元

項 目	103 年 12 月底 存貨金額	截至 104 年 1 月 31 日存貨去化情形		104 年 1 月 31 日 未去化餘額
		金額	比率	
原 物 料	153,839	69,279	45.03%	84,560
在 製 品	53,973	51,996	96.34%	1,977
製 成 品	24,035	15,981	66.49%	8,054
合 計	231,847	137,256	59.20%	94,591

資料來源：該公司提供

該公司 103 年 12 月 31 日之存貨總額為 231,847 仟元，而截至 104 年 1 月底止該公司已去化之存貨金額為 137,256 仟元，占 103 年 12 月底存貨金額之比率為 59.20%，茲就該公司原物料、在製品、製成品之去化情形列示說明如下：

- ①原物料：該公司 103 年 12 月底之原物料存貨金額為 153,839 仟元，截至 104 年 1 月底止之去化金額為 69,279 仟元，去化比率為 45.03%，未去化之原物料中以非生產性原物料(含 Spare parts)比重較高，其非生產性原物料(含 Spare parts)主係供機器定期保養或偶發損壞修繕所儲備且具較不易損壞或生命週期較長之特性，其去化情形尚屬正常。
- ②在製品：該公司 103 年 12 月底之在製品存貨金額為 53,973 仟元，截至 104 年 1 月底止之去化金額為 51,996 仟元，去化比率為 96.34%，去化情形良好。
- ③製成品：該公司 103 年 12 月底之製成品存貨金額為 24,035 仟元，而截至 104 年 1 月底止該公司已去化之存貨金額為 15,981 仟元，占 103 年 12 月底存貨金額之比率則為 66.49%，其去化情形尚屬

正常。

(3)備抵存貨跌價損失與呆滯損失提列政策及其適足性

①備抵存貨跌價及呆滯損失提列政策合理性

該公司之存貨係採永續盤存制，以取得成本為入帳基礎，存貨成本之計算採加權平均法，存貨跌價損失依據國際會計準則公報第 2 號「存貨」規範，每季依成本與淨變現價值孰低法評估存貨價值，淨變現價值成本較低時，認列存貨跌價損失，另淨變現價值之決定以會計期間結束日為準，若結束日前物價波動巨大，得按當月平均數為準。其中，當原物料之價格下跌而製成品之成本超過淨變現價值時，該原物料宜沖減至淨變現價值。在此情況下，原物料之重置成本可能為其淨變現價值之最佳估計數，重置成本係指目前購入(製造)相同存貨所需之成本。存貨之成本與淨變現價值比較係採個別項目為比較基準。

存貨呆滯損失提列政策部分，該公司依存貨屬性提列不同的呆滯損失，原物料的留滯時間依料號逐項檢視，在製品依產品料號及製程站逐項檢視，而製成品則依產品料號逐項檢視。該公司將其原料細分為生產性、非生產性(不含 Spare Parts)及非生產性(含 Spare parts)係根據與生產是否具有直接性、使用頻率的高低而訂定，生產性原物料主要包括光學薄型玻璃、電解光阻劑等，其使用頻率高，故若未經購入或領用，則在 1 年以上即提列 100%呆滯損失，非生產性原物料(不含 Spare Parts)包含膠帶及切割刀等，因其非直接生產相關及較不易因存放較久而損壞，故 1 年以上提列 50%，而非生產性原物料(含 Spare Parts)係指小型彈簧、加熱帶及滾輪模組等，因其不常採購或領用，且不因存放較久而損壞，故超過 1 年以上始提列 10%，然為求更嚴謹且穩健之備抵存貨呆滯損失提列政策，自 103 年起，非生產性原物料(不含 Spare Parts)超過 2 年以上提列 100%，非生產性原物料(含 Spare Parts)超過 3 年以上提列 100%。

在製品係由其銷售客戶所自行提供之晶圓來進行封裝，大多數製程中還會切割為晶粒，少部分製程為提供封裝服務後即成為製成品，由於在製品通常須經 2~3 週生產始轉為製成品，並經相關檢驗且配合客戶出貨時程後即進行後續出貨作業。由於晶圓之所有者為銷售客戶，且該公司進行之加工封裝所投入之成本對整體晶圓價值比重尚非重大，除部分在製品可能因製程中發生良率未達客戶要求而未能完成生產，然發生情形尚非頻繁，可見存貨發生呆滯無法出貨可能性不高，故帳齡在 1 年以上僅提列 50%以上之呆滯損失，然為加強在製品及製成品之管理，該公司自 103 年起在製品及製成品超過半年以上提列 50%，超過一年以上提列 100%。

茲將新舊政策揭示如下：

A.103 年度以前之存貨呆滯損失提列政策：

存 貨	呆滯品備抵率
原物料	生產性原物料：存貨留滯時間超過 A. 半年~ 1 年提 50% B. 1 年以上提 100%
	非生產性原物料(不含 Spare Parts)：存貨留滯時間超過 A. 半年~ 1 年提 10% B. 1 年以上提 50%
	非生產性原物料(Spare Parts)：存貨留滯時間超過 1 年以上提 10%
在製品/製成品	存貨留滯時間超過 1 年以上提 50%

資料來源:該公司提供。

B.103 年度以後之存貨呆滯損失提列政策：

存 貨	呆滯品備抵率
原物料	生產性原物料：存貨留滯時間超過 A. 半年~ 1 年提 50% B. 1 年以上提 100%
	非生產性原物料(不含 Spare Parts)：存貨留滯時間超過 A. 半年~ 1 年提 10% B. 1 年~ 2 年提 50% C. 2 年以上提 100%
	非生產性原物料(Spare Parts)：存貨留滯時間超過 A. 1 年~ 2 年提 10% B. 2 年~ 3 年提 50% C. 3 年以上提 100%
在製品/製成品	存貨留滯時間超過 A. 半年~ 1 年提 50% B. 1 年以上提 100%

資料來源:該公司提供。

②存貨備抵跌價及呆滯損失提列之適足性

單位：新台幣仟元

項 目	102 年度	103 年度
備抵存貨跌價及呆滯損失(A)	7,624	18,070
存貨總額(B)	224,394	231,847
提列比率 (A)/(B)	3.40%	7.79%

資料來源：該公司提供

該公司 102 年底及 103 年底之備抵存貨跌價與呆滯損失，業已按該公司之提列政策予以提列，金額分別為 7,624 仟元及 18,070 仟元，占各該年度期末存貨總額之比率分別為 3.40%及 7.79%。103 年度提列比率增加 4.39%，主要係部分客戶因市場銷售表現不佳而放緩拉貨速度，使得製成品 183 天~365 天間之庫齡比重較高，且該公司制訂更為嚴謹之存貨跌價損失及備抵存貨呆滯損失提列政策，致備抵存貨跌價損失提列比率升至 7.79%，備抵存貨跌價損失金額亦較 102 年度增加 10,446 仟元，然該公司業依存貨管理政策提列備抵存貨跌價或呆滯損失，且因新政策較為嚴謹，較能有效評估精材應提列之備抵存貨跌價及呆滯損

失，經評估係屬合理。此外，該公司定期檢視是否有存貨損壞或無法使用而需報廢者，係依該公司之報廢作業程序處理，102 年度及 103 年度之原料報廢損失分別為 3,331 仟元及 290 仟元，另在製品因生產損壞而報廢，金額分別為 12,118 仟元及 13,688 仟元。綜上所述，該公司係根據過去之營運經驗，並參酌以往年度存貨的去化狀況，暨實際發生存貨呆滯及跌價損失之情形擬訂備抵提列政策，其 102 年底及 103 年度之存貨跌價及呆滯損失均依其政策提列，應足以涵蓋可能過時存貨之呆滯風險。

(4)與同業比較

單位：新台幣仟元

年度 項目		102 年度	103 年度
存貨週轉率(次)	精材	19.45	18.52
	日月光	11.26	(註 2)-
	同欣	6.94	(註 2)-
	菱生	13.59	(註 2)-
存貨週轉天數 (天)	精材	19	20
	日月光	32	(註 2)-
	同欣	53	(註 2)-
	菱生	27	(註 2)-
備抵存貨跌價 及呆滯損失(A)	精材	7,624	18,070
	日月光	(註 1)-	(註 2)-
	同欣	(註 1)-	(註 2)-
	菱生	(註 1)-	(註 2)-
存貨總額(B)	精材	224,394	231,847
	日月光	(註 1)-	(註 2)-
	同欣	(註 1)-	(註 2)-
	菱生	(註 1)-	(註 2)-
提列比率(A / (B)	精材	3.40%	7.79%
	日月光	(註 1)-	(註 2)-
	同欣	(註 1)-	(註 2)-
	菱生	(註 1)-	(註 2)-

資料來源：各公司經會計師查核簽證之財務報告。

註 1：因 102 年度起財務報表改採用 IFRS 編制，同業財務報告未揭露備抵存貨跌價及呆滯損失之金額，故未能予以計算其提列比率並與同業相互比較。

註 2：截至評估報告出具日止，尚未公告 103 年度財務報告。

該公司 102 年度及 103 年度之存貨週轉率則分別為 19.45 次及 18.52 次，存貨週轉天數則分別為 19 天及 20 天，經與採樣同業相較，其存貨週轉率及週轉天數均優於採樣同業，可見其存貨管理良好，尚無重大異常情事。

(四)發行人最近期及最近三個會計年度財務報告之業績概況

1.列表並說明最近期及最近三個會計年度財務報告之營業收入、營業毛利及營業利益與同業比較情形

單位：新台幣仟元

分析項目	年度	101 年度	102 年度		103 年度	
	公司名稱	金 額	金 額	成長率	金 額	成長率
營業收入	精材	3,139,385	4,256,761	35.59%	4,934,078	15.91%
	日月光	193,972,392	219,862,446	13.35%	註	註
	同欣	6,984,993	7,929,440	13.52%	註	註
	菱生	6,352,558	6,047,661	(4.80%)	註	註
營業毛利	精材	249,852	695,142	178.22%	948,204	36.40%
	日月光	36,619,812	42,813,744	16.91%	註	註
	同欣	2,154,222	2,477,098	14.99%	註	註
	菱生	915,642	897,033	(2.03%)	註	註
營業利益	精材	-96,240	380,636	(495.51%)	675,630	77.50%
	日月光	17,761,382	22,044,323	24.11%	註	註
	同欣	1,469,085	1,774,716	20.80%	註	註
	菱生	423,338	373,067	(11.87%)	註	註

資料來源：各公司經會計師查核簽證之財務報告。

註：截至評估報告出具日止，尚未公告 103 年度財務報告。

該公司為專業晶圓級 IC 封裝之領導廠商，主要服務包括晶圓級尺寸封裝服務與晶圓級後護層封裝服務，晶圓級尺寸封裝主要應用於影像感測器及環境感測器等光學感測元件，晶圓級後護層封裝服務主要應用於功率分離式元件、微機電系統感測器元件、指物辨識感測器元件和整合式被動元件等。綜觀目前國內上市櫃及興櫃公司，封裝技術及產品組合並無與該公司完全相同者，故以同為半導體封裝及測試產業及部分產品應用端相同作為取樣之依據：上市公司日月光主要係從事各型積體電路之製造、組合、加工、測試及外銷，亦有封裝影像感測器模組及生物辨識感測器模組與該公司產品應用端相同；上市公司同欣主要係從事高頻無線通訊模組、混合積體電路模組、陶瓷電路板及影像產品等電子產品生產及銷售，亦有影像感測器封裝與該公司產品應用端相同；上市公司菱生主要係從事各積體電路及各種半導體零組件之封裝加工、測試、製造及買賣，亦有用於手機或行動裝置之環境光學感測器模組封裝測試與該公司產品應用端相同。茲就該公司最近三年度之營業收入、營業毛利及營業利益與同業之比較分析如下：

(1)營業收入

該公司 101~103 年度之營業收入分別為 3,139,385 仟元、4,256,761 仟元及 4,934,078 仟元，營業收入呈逐年成長趨勢，主係因 102 年度全球經濟景氣逐漸復甦，受惠於智慧行動裝置需求增加，帶動整體半導體產業成長，該公司業績跟著上揚，且因應行動裝置對於個人隱私的保護需求，指

紋辨識感測器之市場需求大幅增加，該公司於 102 年下半年成功導入該項封裝產品並進入量產，致 102 年度及 103 年度之營收與獲利均有顯著之貢獻。與採樣同業相較，由於封裝產業為高度客製化之產業，又各採樣公司封裝服務內容及營運規模互異，故營收成長趨勢不盡相同。日月光及同欣受惠於市場對影像感測器之需求大幅增加，營收皆呈成長趨勢，而菱生因 MEMS 元件市場成長趨緩，以及面對第一季為傳統淡季之影響，其營收呈衰退趨勢，該公司則受惠於指紋辨識感測器封裝產品的挹注，其營收成長率均優於採樣同業，變化原因尚屬合理。

(2)營業毛利

該公司 101~103 年度之營業毛利分別為 249,852 仟元、695,142 仟元及 948,204 仟元；營業毛利率則分別為 7.96%、16.33%及 19.22%，由於封裝服務產業為資本密集之產業，其相關設備之折舊費用通常佔營業成本較高比重，而該公司 101 年度因銷量較少，導致產能利用率(即實際產量/建置之產能)偏低，以致毛利率較低；102 年度該公司因新訂單挹注，產能利用率增加，致整體毛利率大幅提升；103 年度延續訂單熱度，毛利率亦呈成長趨勢。與採樣同業相較，該公司雖 101 年度之毛利率遜於採樣同業，惟隨營收增加及新產品之挹注及產能利用率提升，毛利率逐年改善且介於或優於採樣同業，變化原因尚屬合理。

(3)營業利益

該公司 101~103 年度之營業利益(損失)分別為(96,240)仟元、380,636 仟元 675,630 仟元，營業利益(損失)率則分別為(3.07)%、8.94%及 13.69%。該公司營業利益及營業利益率大致隨營業收入及毛利之變化而同步增減，雖其 101 年度營業利益率遜於採樣同業，惟自 102 年起其營業利益率已獲改善，且介於或優於採樣同業，變化原因尚屬合理。

2.最近期及最近三個會計年度財務報告以「部門別」或「主要產品別」之營業收入、營業成本及營業毛利之變化情形是否合理

(1)最近三年度營業收入變動表

單位：新台幣仟元

產品別 \ 年度	101年度		102年度		103年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
晶圓級尺寸封裝	2,863,412	91.21	3,308,413	77.72	3,028,799	61.39
晶圓級後護層封裝	248,757	7.92	920,633	21.63	1,879,970	38.10
其他	27,216	0.87	27,715	0.65	25,309	0.51
合 計	3,139,385	100.00	4,256,761	100.00	4,934,078	100.00

資料來源：該公司提供

(2)最近三年度營業成本變動表

單位：新台幣仟元

產品別 \ 年度	101年度		102年度		103年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
晶圓級尺寸封裝	2,682,666	92.84	2,806,314	78.79	2,804,237	70.35
晶圓級後護層封裝	170,368	5.90	696,557	19.56	1,167,071	29.28
其他	36,499	1.26	58,748	1.65	14,566	0.37
合 計	2,889,533	100.00	3,561,619	100.00	3,985,874	100.00

資料來源：該公司提供

(3)最近三年度營業毛利變動表

單位：新台幣仟元

產品別 \ 年度	101年度		102年度		103年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
晶圓級尺寸封裝	180,746	72.34	502,099	72.23	224,562	23.68
晶圓級後護層封裝	78,389	31.37	224,076	32.23	712,899	75.19
其他	(9,283)	(3.71)	(31,033)	(4.46)	10,743	1.13
合 計	249,852	100.00	695,142	100.00	948,204	100.00

資料來源：該公司提供

(4)最近三年度主要產品別營業收入、營業成本及營業毛利變化情形說明

①晶圓級尺寸封裝

在營業收入方面，該公司最近三年度晶圓級尺寸封裝之營業收入分別為 2,863,412 仟元、3,308,413 仟元及 3,028,799 仟元，占各年度營業收入淨額之比例則分別為 91.21%、77.72%及 61.39%，為占該公司營業收入最大宗之品項，終端產品主要應用於智慧型行動裝置，如智慧型手機筆記型電腦、平板電腦等之影像感測器及環境感測器，該項產品銷售金額之增減主要視終端產品出貨情況而定。101 年受歐債及美國受財政赤字危機等影響，全球經濟景氣不若以往，使得消費者對智慧行動裝置等需求較保守，致全球半導體產業 101 年度呈現衰退趨勢，故在終端電子消費市場需求下降下，該公司晶圓級尺寸封裝之訂單量減少。102 年起全球景氣逐漸復甦，受惠於智慧行動裝置需求增加，以及主要客戶積極拓展中國市場而對該公司之需求大幅提升，導致 102 年度該公司晶圓級尺寸封裝營業收入較 101 年度大幅增加，成長幅度達 15.54%，然其占整體營業收入淨額之比重則因晶圓級後護層封裝業務成長而呈下降趨勢。103 年在晶圓級後護層封裝業務持續成長下，其占整體營業收入淨額之比重則下滑至 61.39%。整體而言，最近三年度晶圓級尺寸封裝服務之營業收入之變動，尚屬合理。

在營業成本方面，101~103 年度晶圓級尺寸封裝之營業成本分別為 2,682,666 仟元、2,806,314 仟元及 2,804,237 仟元；營業毛利及毛利率則分別為 180,746 仟元、502,099 仟元、224,562 仟元及 6.31%、15.18%、7.41%。101 年度隨客戶訂單量減少，該公司相關營業成本亦較低，且

因受產能利用率下降之影響，造成該公司 101 年度之毛利率較低；102 年度因該公司接單狀況良好，致營業成本微幅成長，然因產能利用率提升，致毛利率均大幅回升；103 年度受訂單量略為減少，致產能利用率下滑，又因新佈建 12 吋晶圓封裝生產線而認列相關建置成本，致毛利率下滑至 7.41%。整體而言，最近三年度晶圓級尺寸封裝服務之營業成本及毛利率之變動，尚屬合理。

②晶圓級後護層封裝

在營業收入方面，該公司最近三年度晶圓級後護層服務營收金額分別為 248,757 仟元、920,633 仟元及 1,879,970 仟元，占各年度銷貨收入淨額之比例則分別為 7.92%、21.63%及 38.10%，呈逐年大幅成長趨勢，主係因該公司 102 年接獲新產品指紋辨識器訂單大幅挹注營收，且 103 年市場需求持續暢旺所致。整體而言，最近三年度晶圓級後護層封裝之營業收入之變動，尚屬合理。

在營業成本方面，101~103 年度晶圓級後護層封裝服務之營業成本分別為 170,368 仟元、696,557 仟元及 1,167,071 仟元；營業毛利及毛利率則分別為 78,389 仟元、224,076 仟元、712,899 仟元及 31.51%、24.34%、37.92%，101 年度起因客戶需求及產品組合改變，致整體毛利率大幅提升；102 年則因新增之指紋辨識器製程較複雜，且量產初期試產及相關營業成本較高，其毛利率相對較低，致晶圓級後護層封裝服務之整體毛利率較 101 年微幅下滑；103 年因指紋辨識器製程逐漸成熟良率提升，且訂單暢旺，故毛利率大幅度提升。整體而言，最近三年度晶圓級後護層封裝之營業成本及毛利率之變動，尚屬合理。

③其他

該公司最近三年度其他類產品之營業收入分別為 27,216 仟元、27,715 仟元及 25,309 仟元，占各年度營業收入淨額之比例則分別為 0.87%、0.65%及 0.51%，主係設計收入及因應客戶或供應商研發需求，出售少量原物料之收入，然因佔營收比率均低，尚無發現重大異常情事。

在營業成本方面，101~103 年度其他類產品之營業成本分別為 36,499 仟元、58,748 仟元及 14,566 仟元；營業毛利(損)及毛利(損)率則分別為 (9,283) 仟元、(31,033) 仟元、10,743 仟元及 (34.11%)、(111.97%)、42.45%，101~102 年度營業毛損主係因屬其他項之營業成本中，除上述設計服務及出售原物料之成本外，該公司尚將新廠之廠務成本列入此項(103 年度因已開始佈建 12 吋晶圓級尺寸封裝生產線，故改列入晶圓級尺寸封裝項下)，故造成營業毛損，且因其他項收入金額較低，容易造成毛利(損)率計算出之數值變動劇烈。綜上所述，尚無重大異常之情事。

3.最近期及最近三個會計年度財務報告營業收入或毛利率變動達 20%以上者，應做價量分析變動之原因，並敘明是否合理

最近三年度營業收入及毛利率變動情形

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	101 年度	102 年度		103 年度	
	金額	金額	變動比率(%)	金額	變動比率(%)
營業收入淨額	3,139,385	4,256,761	35.59	4,934,078	15.91
毛利率(%)	7.96	16.33	105.15	19.22	17.70

資料來源：該公司各年度經會計師查核簽證之財務報告。

由上表得知，該公司僅101及102年度之毛利率變動均較前年度變動達 20%以上，茲將101及102年度之主要產品別之價量變動分析說明如下：

單位：新台幣仟元

主要產品	分析項目	101、102 年度
晶圓級尺寸封裝	(一) 營業收入差異分析：	
	$P(Q' - Q)$	837,738
	$Q(P' - P)$	(303,843)
	$(P' - P)(Q' - Q)$	(88,894)
	$P'Q' - PQ$	445,001
	(二) 營業成本差異分析：	
	$P(Q' - Q)$	784,858
	$Q(P' - P)$	(511,549)
	$(P' - P)(Q' - Q)$	(149,662)
	$P'Q' - PQ$	123,647
	(三) 毛利變動金額：	321,354
晶圓級後護層封裝	(一) 營業收入差異分析：	
	$P(Q' - Q)$	261,561
	$Q(P' - P)$	200,010
	$(P' - P)(Q' - Q)$	210,305
	$P'Q' - PQ$	671,876
	(二) 營業成本差異分析：	
	$P(Q' - Q)$	179,137
	$Q(P' - P)$	169,172
	$(P' - P)(Q' - Q)$	177,880
	$P'Q' - PQ$	526,189
	(三) 毛利變動金額：	145,687

資料來源：該公司提供。

註 1：P'及 Q'為最近年度單價及數量；P 及 Q 為上一年度單價及數量。

(1)101~102 年度主要產品價量分析

①晶圓級尺寸封裝

A.營業收入增加445,001仟元

(A)數量有利差異為837,738仟元，102年起受惠於全球智慧行動裝置需求增加，該公司業績跟著上揚，致產生數量有利差異。

(B)價格不利差異為303,843仟元，因影像感測器畫素提高需藉由感測器元件尺寸放大，致每片晶圓產生之晶粒減少(每晶粒的封裝成本增加)，該公司為維持此類服務之市場競爭力，故在晶圓級封裝之售價有所調降等因素，造成價格不利差異。

(C)組合不利差異為88,894仟元，主係102年度雖銷售數量增加，但因平均單位售價降低而產生組合不利差異。

B.營業成本增加123,647仟元

(A)數量不利差異為784,858仟元，主係102年度銷貨數量成長，致營業成本產生數量不利差異。

(B)價格有利差異為511,549仟元，主係因部份主要原物料價格下降，故平均成本較去年同期下滑，致產生價格有利差異。

(C)組合不利差異為149,662仟元，主係102年度銷售數量增加而平均單位成本降低所致。

綜上，該公司102年度晶圓級尺寸封裝之營業毛利較101年度增加321,354仟元。

②晶圓級後護層封裝

A.營業收入增加671,876仟元

(A)數量有利差異為261,561仟元，主係自102年下半年起新增指紋辨識器封裝服務訂單，致產生數量有利差異。

(B)價格有利差異為200,010仟元，主係因該公司新增之製程服務報價較高，致產生價格有利差異。

(C)組合有利差異為210,305仟元，由於銷售數量與銷售單價均增加，致產生組合有利差異。

B.營業成本增加526,189仟元

(A)數量不利差異為179,137仟元，主係102年度銷售數量上升，致銷貨成本增加產生數量不利差異。

(B)價格不利差異為169,172仟元，主係該公司為因應客戶訂單需求，而使用部份較高單價之原物料進貨量增加，故平均成本較去年同期為高，致產生價格不利差異。

(C)組合不利差異為177,880仟元，主係因銷售數量與平均銷貨成本均增加，致產生組合不利差異。

綜上，該公司102年度晶圓級後護層封裝之營業毛利因營收增幅大於成本增幅，而較101年度增加145,687仟元。

(五)最近三個會計年度及截至承銷商評估報告出具日止，發行人及其各子公司(包括母子公司間交易事項)與關係人交易之評估

- 1.與關係人間業務交易往來情形，以評估其有無涉及非常規交易情事，如屬銷貨予關係人者，則再評估授信政策、交易條件、款項收回、所售產品關係人後續投入生產或再銷售之情形及其合理性，如未符一般交易常規，其差異之原因及合理性。

該公司無任何轉投資公司，毋須編製合併財務報告，以下茲就其個體財報之關係人交易分析說明：

(1)關係人名稱及其關係

關係人名稱	與該公司之關係
采鈺科技股份有限公司（簡稱采鈺）	與該公司董事長同一人
OmniVision Technologies Inc. （簡稱 OVTI）	該公司法人董事之母公司
台灣積體電路製造股份有限公司 （簡稱台積電）	102 年 6 月該公司股東常會全面改選董事前係具有實質控制能力之母公司；102 年該公司股東常會全面改選董事後，因台積電占該公司董事席次未過半，故僅對該公司採權益法評價且為具重大影響力投資者
台積電（北美）公司 （簡稱台積(北美)）	台積電之子公司
台積電（中國）公司 （簡稱台積(中國)）	台積電之子公司
世界先進積體電路股份有限公司 （簡稱世界先進）	台積電採權益法評價之被投資公司，102 年 7 月該公司非台積電子公司後，世界先進已非為該公司之關係人

(2)發行人與關係人間業務交易往來情形之評估

①銷貨及應收帳款

銷貨

單位：新台幣仟元

名稱 \ 年度	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
OVTI 集團	1,261,163	40.17	1,580,579	37.13	1,425,860	28.90
台積電	185,554	5.91	862,202	20.25	1,732,290	35.11
世界先進	183	0.01	1,803	0.04	-	-
台積(中國)	-	-	81	0.01	-	-
合計	1,446,900	46.09	2,444,665	57.43	3,158,150	64.01

資料來源：該公司 101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

應收關係人款

單位：新台幣仟元

名稱 \ 年度	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
OVTI 集團	203,159	84.78	222,084	43.00	211,825	31.46
台積電	36,434	15.21	294,264	56.98	461,494	68.54
世界先進	28	0.01	-	-	-	-
台積(中國)	-	-	83	0.02	-	-
合計	239,621	100.00	516,431	100.00	673,319	100.00

資料來源：該公司 101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

A.OVTI 集團

OVTI 係該公司法人董事-台灣豪威投資控股(股)有限公司之最終母公司，亦為該公司之主要銷售客戶，其係於美國上市掛牌公司 (NASDAQ:OVTI)，為全球知名 CMOS 感測器大廠，其產品廣泛應用於消費性及商務商品上。該公司自 92 年即與其首次交易，主係提供影像感測器封裝業務。該公司最近三年度對 OVTI 集團之銷貨金額分別為 1,261,163 仟元、1,580,579 仟元及 1,425,860 仟元。其銷貨變化情形參閱本評估報告「參、發行人業務財務狀況、一、(一)」之說明。對 OVTI 集團之應收關係人款項淨額係因一般銷貨產生之款項，經抽核相關憑證及期後收款狀況，尚無發現重大異常之情事。

B.台積電

台積電係為專業積體電路技術及製造服務大廠，向來專注於先進晶圓代工服務，致力於晶圓先進製程之發展，以先進製程技術提供晶圓專業製造服務。該公司為專業封裝服務廠商，係以半導體製程在晶圓上進行相關封裝，歷年來對台積電主要多係提供晶圓級後護層封裝服務，其產品涵蓋指紋辨識、微機電及 MOSFET 功率元件等，為台積電下游供應鏈廠商之一。該公司最近三年度對台積電之銷貨金額分別為 185,554 仟元、862,202 仟元及 1,732,290 仟元，其銷貨變化情形參閱本評估報告「參、發行人業務財務狀況、一、營業概況 (一)」之說明。由於該公司先進封裝技術成熟獲終端特定客戶青睞，該終端特定客戶原係直接與該公司接洽開發合作新產品，然由於該終端特定客戶為確保新產品之良率、品質控管、交期及責任分工，並考量整體產品的產能供應鏈生產順暢，遂與台積電合作以 Turnkey 之商業模式合作，由該終端特定客戶將訂單交給其指定之晶圓代工廠-台積電負責統籌管理，台積電完成晶圓生產再垂直整合下游供應鏈製程，以有效管理並降低產品風險及縮短產品交期，然雖該公司係特定客戶指定之主要封裝廠商，為配合此交易(Turnkey)模式，終端特定客戶對該公司之訂單係透過台積電下單，致使該公司於 102 年度及 103 年度對台積電之銷貨金額大幅成長。對台積電之應收關係人款項淨額係因一般銷貨產生之款項，經抽核相關憑證及期後收款狀況，尚無發現重大異常之情事。

C. 世界先進

世界先進係台積電採權益法評價之轉投資公司，主係從事晶圓代工服務。該公司自 101 年度起方與其交易往來，101 年度由於該公司取得世界先進特定製程之晶圓封裝訂單，故 101 年度及 102 年度上半年度分別對世界先進銷貨 183 仟元及 1,803 仟元，102 下半年度起，由於世界先進業已非為該公司之關係人故未揭露銷貨情形。對世界先進之應收關係人款項淨額係因一般銷貨產生之款項，經抽核相關憑證及期後收款狀況，尚無發現重大異常之情事。

D. 台積(中國)

台積(中國)係台積電於大陸之轉投資事業，從事製造與銷售積體電路業務。該公司 102 年度起，提供台積(中國)少量晶圓封裝業務，103 年起則因未取得訂單，故未再有交易。對台積(中國)之應收關係人款項淨額係因一般銷貨產生之款項，經抽核相關憑證，業已收回款項。

綜上所述，該公司對關係人之授信政策均為月結 30 天，與對一般銷貨客戶之授信政策相當，未有重大差異。另，就交易條件觀之，由於該公司係屬客製化訂單生產，故考量產品差異化、生產成本及各訂單生產數量需求不同，以致產品價格略有差異，然該公司對關係人與一般銷貨客戶銷售之產品均依照該公司內部政策制定價格，故應屬合理。

② 進貨與應付帳款

進貨

單位：新台幣仟元

名稱 \ 年度	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
台積電	-	-	-	-	2,127	0.19
合計	-	-	-	-	2,127	0.19

資料來源：該公司 101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

應付關係人款

單位：新台幣仟元

名稱 \ 年度	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
台積電	-	-	-	-	517	100.00
合計	-	-	-	-	517	100.00

資料來源：該公司 101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

該公司 103 年度對台積電進貨 2,127 仟元，主係因生產製程所需向台積電購置光阻劑及膠帶所致。對台積電之應付關係人款項係因一般進貨產生之款項，尚無發現重大異常之情事。另該公司對關係人之付款政策為月結 30 天，與對一般進貨廠商之付款條件相當，未有重大差異。且該公司對關係人與一般進貨廠商之交易均依照該公司內部政策執行，故應屬合理。

③租金收入(帳列其他收益及費損)

單位：新台幣仟元

名稱 \ 年度	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
台積電	-	-	151,006	100.00	697,958	100.00
合計	-	-	151,006	100.00	697,958	100.00

資料來源：該公司 101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

由於指紋辨識感測器為特定客戶產品之創新應用，對其產品問市時程影響甚鉅，特定客戶原係直接與該公司接洽開發合作新產品，惟因考量整體產品的產能供應鏈生產順暢，最後採由台積電 turnkey 的方式為特定客戶提供服務，並透過台積電發包(One-stop Shopping Service)委由該公司進行封裝業務。然而，當時因該公司現有廠房空間有限，且該公司於短期間內無法覓得或立即建置適合之無塵室廠房放置所有符合產能需求之相關設備，故該公司與台積電協議將部分設備出租並放置於台積電。且係因放置於台積電廠房，基於員工管理、營運風險及業務機密等因素之考量，又該公司於園區並無分公司之設置，無法於台積電廠房負責管理營運相關設備，遂以租賃設備方式，由台積電自行負責部分封裝服務。經檢視雙方簽立之租賃契約暨其增補修訂協議，該公司自 102 年 7 月按月認列租金收入並逐季收款，而 103 年因合約條件略有調整，故金額高於 102 年。經抽核相關憑證及收款情形，尚無發現重大異常之情事。此外，經檢視該設備租賃交易產生之利潤並與市場從事設備租賃業務之公司相較，該公司設備租賃利潤尚落於設備租賃採樣公司毛利區間，故應尚屬合理。

④製造費用

單位：新台幣仟元

名稱 \ 年 度	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
采鈺	958	0.05	9,859	0.41	151	-
台積電	2,178	0.11	2,125	0.09	2,034	0.08
合 計	3,136	0.16	11,984	0.50	2,185	0.08

資料來源：該公司 101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

A. 采鈺

該公司最近三年度對采鈺產生之製造費用分別為 958 仟元、9,859 仟元及 151 仟元。101 年度對采鈺之製造費用主要為顧問費用等，該公司因計畫建置新廠(C 廠)，希望藉助采鈺專業之經驗，故聘請采鈺相關人員協助新廠規劃、設計及施工等相關事宜至 101 年 4 月止；102 年度因該公司訂單暢旺，既有產線作業人員不足且有經驗之人員又一時招募不及，而采鈺尚有產線人力得提供協助，故該公司與采鈺簽立合作意願書，由采鈺提供部分產線人員至該公司協助生產製造作業，故 102 年度該公司支付采鈺相關派遣人員費用，致使 102 年度對采鈺之製造費用增加。103 年度則因該公司已自行對外招募產

線人員以滿足產能需求，故終止與采鈺產線人員之合作意願書，並未再支付其派遣費用，僅有因製程單位為產品測試所需，委託采鈺協助前段彩色濾光片(RBG 陣列)之製程，故產生少額之製造費用。

經檢視雙方簽立之廠房租賃契約及人員支援意願書，並抽核相關憑證與付款情形，尚無發現重大異常情事。

B.台積電

該公司最近三年度對台積電產生之製造費用分別為 2,178 仟元、2,125 仟元及 2,034 仟元。該公司對台積電產生之製造費用主係因支付與廠務相關之顧問費等費用所致。由於該公司既有舊廠房年限已久，為提升舊廠房效能，該公司遂與台積電簽立合作意願書，由台積電派駐具備豐富廠務經驗之人員，提供 Line A 及 Line B 兩廠之廠務系統相關技術服務協助及水電氣化等相關廠務設備改善規劃與建議，該公司再依照協議內容支付台積電顧問費用。

經檢視雙方簽立之合作意願同意書及抽核相關憑證與付款情形，尚無發現重大異常情事。

⑤營業費用

單位：新台幣仟元

年 度 名 稱	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
采鈺	1,115	0.34	672	0.18	1,089	0.04
OVTI 集團	937	0.28	-	-	-	-
台積電	454	0.14	209	0.06	5,304	0.20
台積(北美)	174	0.05	-	-	-	-
合 計	2,680	0.81	881	0.24	6,393	0.24

資料來源：101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

A.采鈺

該公司最近三年度對采鈺產生之營業費用分別為 1,115 仟元、672 仟元及 1,089 仟元。該公司對采鈺產生之營業費用主係為研發用實驗品費用等。因該公司主要從事影像感測器封裝業務，相關產品製程技術之研發需搭配使用彩色濾光膜，故該公司若有研發所需，便向采鈺採購少量彩色濾光膜，致使該公司部分年度對采鈺之營業費用較為增加。

B.OVTI 集團及台積(北美)

該公司 101 年度對 OVTI 集團及台積(北美)產生之營業費用主要係因為產品研發所需，分別向 OVTI 集團及台積(北美)採購少量晶圓供研發使用所致。由於該公司係屬半導體產業下游封裝供應商，相關產品製程技術之研發需耗用部分少量晶圓產品，係以該公司針對不同技術研發所需向上述關係人採購，應屬合理。

C. 台積電

該公司最近三年度對台積電產生之營業費用分別為 454 仟元、209 仟元及 5,304 仟元。該公司對台積電產生之營業費用大多係因該公司向台積電採購線上課程(e-learning)供公司員工內部訓練使用，課程主要以廠務概念、半導體相關製程教學簡介為主；另為產品研發所需，向台積電採購少量晶圓供研發使用所致。

綜上，該公司最近三年度對上述關係人產生之營業費用主係因購置研發材料、購置線上課程(e-learning)等，經抽核相關交易憑證及付款情形，尚無發現重大異常之情事。

⑥購置固定資產及應付設備款

購置固定資產

單位：新台幣仟元

年 度 名 稱	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
台積電	-	-	84,921	1.41	23,447	0.36
台積(中國)	-	-	47,358	0.79	757	0.01
合 計	-	-	132,279	2.20	24,204	0.37

資料來源：101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

應付設備款

單位：新台幣仟元

年 度 名 稱	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
台積電	-	-	55,130	18.02	-	-
合 計	-	-	55,130	18.02	-	-

資料來源：101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

該公司每年均會評估次年度可能需汰換之相關機台設備並預估可能之資本支出，並依循取得或處份資產處理程序暨核決權限管理辦法，進行採購作業。由於晶圓封裝製程與上游晶圓製造商及其他下游製程供應商部分製程所使用之機器設備具共用性，故在評估設備採購交期是否能符合需求之前提下，再綜合考量設備之使用年限及狀況並依循內控制度辦理採購流程作業，再決議是否向該關係人採購。係以該公司分別於 102 年度及 103 年度向台積電及台積(中國)購置晶圓壓合機、自動傳送晶片檢測、金屬濺鍍機台及膜厚量測機等機器設備。

經抽核相關表單，該公司向關係人採購之機器設備業經董事會提案決議或報備通過，且遵循採購標準程序進行採購作業，故其交易價格及原由應屬合理。另該公司對台積電(中國)及台積之付款條件分別為月結 60 天及月結 30 天付款，該公司採購流程均找尋多家設備供應廠商進行詢比議價，再經考量各供應廠商之設備報價及交期等因素決議採購對象，係以該公司向關係人及非關係人之採購設備價格均遵循該公司內控流程執行，與該公司一般採購廠商(非關係人)之交易條件相當，另經抽

核該公司支付設備款項情形尚屬正常，並無發現重大異常之情事。

⑦其他預付費用及暫付款

單位：新台幣仟元

年 度 名 稱	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
OVTI 集團	771	1.08	463	0.66	655	0.90
台積電	293	0.41	215	0.30	137	0.19
合 計	1,064	1.49	678	0.96	792	1.09

資料來源：101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

A.OVTI 集團

該公司對 OVTI 集團之暫付款主要係因該公司代 OVTI 集團採購晶粒承載器具(Tray 盤)之款項所致。

B.台積電

該公司對台積電之預付費用主要係向台積電採購線上課程供公司員工內部訓練所致。參閱本評估報告「參、發行人業務財務狀況、(五)、1、(2)、⑤、C.」之說明。

⑧其他應收款

單位：新台幣仟元

年 度 名 稱	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
台積電	-	-	141,190	100.00	-	-
合 計	-	-	141,190	100.00	-	-

資料來源：101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

該公司 102 年度因配合特定客戶量產訂單及時程，進行相關設備採購及生產，然上項產品在銷售初期市場的接受度難以預估，為維護公司利益並保障已投入之成本未來得以回收，由台積電與特定客戶協議支付本公司投入設備之產能保證金約 1,016,977 仟元，後因特定客戶產品推出市場反應良好，故經協議該公司償還前述保證金款項(截至 102 年底尚餘 141,190 仟元之其他應收款)，該公司業於 103 年 6 月底前全數歸還。經檢視 102 年產能保證金協議備忘錄及抽核相關收款及還款情形，尚無發現重大異常情事。

⑨應付費用

單位：新台幣仟元

年 度 名 稱	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	%	金額	%	金額	%
采鈺	4	-	-	-	380	0.13
台積電	364	0.20	3,310	1.24	683	0.23
合 計	368	0.20	3,310	1.24	1,063	0.36

資料來源：101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告。

該公司對關係人之應付費用，主係支付關係人製造、營業費用及購置設備產生之稅款所致，然該公司對關係人及非關係人之費用類付款條

件均為月結 30 天，經抽核相關付款憑證尚無重大異常。

2.發行人與同屬關係企業公司之主要業務或產品(指最近二個會計年度均占各該年度總營業收入百分之三十以上者)，有無相互競爭之情形。

(1)該公司主要從事晶圓級尺寸封裝服務業務，經查核該公司之同屬關係企業計有 30 家，茲將各公司之主要營業項目列表如下：

①主要從事專業積體電路研發、製造及銷售服務，共計 11 間公司。

公司名稱	主要業務或產品
台灣積體電路製造(股)公司	積體電路及其他半導體裝置之銷售業務
TSMC North America	積體電路及其他半導體裝置之銷售業務
TSMC Europe B.V.	市場行銷業務及工程支援業務
TSMC Japan Limited	市場行銷業務
TSMC Korea Limited	客戶服務及技術支援業務
台積電（中國）有限公司	依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路
TSMC Technology, Inc.	工程支援業務
WaferTech, LLC	積體電路及其他半導體裝置之製造、銷售、測試與電腦輔助設計
TSMC Partners, Ltd.	半導體設計、製造等相關投資業務及一般投資業務
TSMC Design Technology Canada Inc.	工程支援業務
創意電子股份有限公司	積體電路之研發、生產、銷售相關諮詢服務

②主要從事投資業務之公司，共計 11 間公司。

公司名稱	主要業務或產品
InveStar Semiconductor Development Fund, Inc.	新創科技事業之投資
InveStar Semiconductor Development Fund, Inc. (II) LDC.	新創科技事業之投資
TSMC Development, Inc.	一般投資業務
TSMC Global Ltd.	一般投資業務
Emerging Alliance Fund, L.P.	新創科技事業之投資
VentureTech Alliance Fund II, L.P.	新創科技事業之投資
VentureTech Alliance Fund III, L.P.	新創科技事業之投資
Growth Fund Limited	新創科技事業之投資
VentureTech Alliance Holdings, LLC	新創科技事業之投資
台積光能投資有限公司	一般投資業務
英屬蓋曼群島商 VisEra Holding Company	半導體設計、製造及相關業務之投資

- ③主要從事太陽能產品之相關技術、研究開發、製造生產與銷售，共計 4 間公司。

公司名稱	主要業務或產品
台積太陽能股份有限公司	可再生能源及節能相關之技術與產品之研究、開發、設計、製造及銷售
TSMC Solar North America, Inc.	太陽能相關產品之銷售業務
TSMC Solar Europe B.V.	太陽能相關產品之銷售業務
TSMC Solar Europe GmbH	太陽能電池模組及相關產品之銷售及客戶服務

- ④主要從事固態照明產品之相關技術、研究開發、製造生產與銷售，共計 2 間公司。

公司名稱	主要業務或產品
台積固態照明股份有限公司 (註 1)	固態照明裝置及相關應用產品與系統之研究、開發、設計、製造及銷售
TSMC Lighting North America, Inc.(註 2)	固態照明相關產品之銷售業務

註 1：預計於 104 年 2 月底出售。

註 2：已於 103 年第 3 季清算結束。

- ⑤主要從事電子零組件製造、電子材料批發及零售與無線射頻辨識系統晶片(RFID)之研發及測試業務：相豐科技股份有限公司。

- ⑥主要從事彩色濾光膜製造及測試組裝業務：采鈺科技股份有限公司。

- (2)依據前項彙整，除從事投資為業務之公司外，該公司關係企業大致分為台積電及其子公司、采鈺科技股份有限公司及創意電子股份有限公司，以下茲就該公司主要業務或產品與關係企業競爭情形分析如下：

- ①台積電及其子公司

台積電成立於 76 年，並於 83 年於台灣證券交易所掛牌上市(股票代號：2330)，是目前全球最大之專業積體電路技術及製造服務業者，於全球晶圓代工市占率約莫五成，係為全球晶圓代工龍頭。台積電全球總部位於台灣新竹科學園區，負責研發、生產及銷售等業務，且服務據點(設置子公司)更遍及日本、韓國、大陸、及美洲與歐洲等地區，提供即時之晶圓代工技術服務及銷售業務，另外，亦設立美國及大陸子公司提供產能支援。近年，台積電除既有主營運項目晶圓代工業務外，亦投入太陽能產品研發及生產銷售業務，並成立轉投資公司致力前述產業發展。

就企業型態觀之，台積電係定位為半導體產業中上游之專業積體電路技術及製造服務者，向來專注於先進晶圓代工服務，致力於晶圓先進製程之發展。台積電為確保客戶交付之先進晶圓代工訂單，其後在封裝供應鏈上無斷鏈之虞(例如傳統封裝技術無法匹配其先進晶圓製程)，有提供客戶先進封裝解決方案之佈局，惟前述先進晶圓製程主要適用於高

端處理器、RF 射頻與記憶體相關產品之整合，其均屬高腳數及高性能之產品。該公司係定位為專業封裝服務廠商，主係從事晶圓級尺寸封裝及晶圓級後護層封裝服務，專注感測器(Sensor)產品應用及其他封裝需求(3D CSP；3DPPI，低腳數及節能等)，與前述台積電之封裝業務內容完全不同，又該公司之封裝業務均需在上游晶圓廠所提供之晶圓上進行封裝加工作業，係以該公司與台積電及其從事晶圓代工相關業務之子公司實為半導體供應鏈之上下游。綜前所述，可知該公司與台積電之企業型態、主要技術應用及產品(服務)定位並不相同。

就產品(服務)可替代性及對象客戶觀之，半導體產業分工細密，從 IC 研發設計、晶圓製造、晶圓封裝至晶圓測試等，彼此作業關係緊密且環環相扣。台積電與該公司於半導體產業扮演上下游之角色，分別為客戶提供晶圓製造與晶圓封裝之服務，所提供之技術服務不同，應尚無產品(服務)可替代之情形。

該公司近年度因先進封裝技術已趨成熟且受終端特定客戶青睞，為配合該特定客戶產品上市時程需求暨整體產品的產能供應鏈生產順暢，以致台積電除提供自有的晶圓代工服務外，並建立一條龍式的 turnkey service 確保供應鏈之順暢，以滿足該特定客戶之需求，故有台積電對該公司下單要求提供晶圓級後護層封裝服務，以及由該公司出租相關設備予台積電提供相同封裝服務之情事(相關說明參閱本評估報告「陸、關係人交易」之評估說明)，然前述之關係人交易均係配合該特定客戶之要求所衍生之交易模式。其中，台積電從事與該公司相同封裝服務部分，並非為台積電之主要營業項目，且以台積電最近兩年度之營收淨額新台幣 5,970 億及 7,628 億元視之，所佔比重應不具重大性。此外，該公司除持續精進 CIS(影像感測器)封裝技術外，亦跨足其他感測器之封裝服務，如指紋辨識感測器、微機電等產品，足見該公司具有自主研發能力，且擁有將近 200 項專利，並成功獲得終端客戶之認可，打入國際品牌市場，業已證明該公司亦具備獨立開發產品與客戶之實力。

綜上所述，由於該公司最近二個會計年度及申請年度之主要產品為晶圓級尺寸封裝服務，與台積電及其子公司專注於晶圓製造銷售等服務並不相同外，該公司與台積電無論企業型態、商品(服務)替代性等均尚無構成相互競爭之情形且具有獨立行銷之開發能力。另外，台積電從事太陽能及固態照明業務之子公司因與該公司主營業務及產品屬性完全不同，係以未有主要業務或商品相互競爭之疑慮。

② 采鈺科技股份有限公司

采鈺科技成立於 92 年，主係從事影像感測器之彩色濾光膜之製造。(彩色濾光膜係影像感測器之元件，透過彩色濾光膜用以提升影像色彩)。該公司主要從事影像感測器之封裝業務，係將完成之晶圓與彩色濾光膜之產品，進行晶圓級封裝，故該公司與采鈺係屬產業鏈上下游關係，雙方定位鮮明且產品核心技術應用迥異，產品(服務)亦無法取代，故應未有主要業務或產品(服務)相互競爭之疑慮。

③創意電子股份有限公司

創意電子係國內首家專業提供系統單晶片（SoC）設計代工服務，亦為國內第一大 IC 設計服務公司，同時提供客戶晶圓產品一元化(turnkey)服務，經由與世界級晶圓廠、封裝與測試業者以及其他支援供應商合作，提供客戶從設計到晶圓製造、系統封裝、測試的完整服務。創意電子係以 IC 設計為主要營運導向，並在為客戶縮短產品上市時間下，進行系統封裝業務作為提供終端客戶完整服務，故統籌中下游供應商以提供完成製程服務，而非以晶圓封裝業務為主要營運範疇；又該公司為晶圓級尺寸封裝與創意電子之系統封裝技術並不相同，故該公司與創意電子之主要營運產品定位鮮明且產品核心技術應用迥異。

另就產品可替代性及對象客戶觀之，創意電子主係從事 IC 設計與 ASIC(特殊用途之 IC)及晶圓產品一條龍式解決方案(Turnkey Service)，晶圓中下游製程係委託專業代工廠負責生產光罩、晶圓、切割與封裝等作業，而該公司為晶圓中下游之封裝廠商，故創意電子主要營業項目尚無法替代該公司之封裝業務。且創意電子主要客戶大多為終端品牌大廠，然該公司因係屬半導體產業下游供應商，主要客戶多為晶圓設計公司，故雙方應未有主要業務或商品相互競爭之疑慮。

綜上評估，就企業型態、商品可否替代及對象客戶等要素綜合評估，該公司與同屬關係企業公司之主要業務或產品(服務)尚無發生重大相互競爭情形。

二、財務狀況

(一)最近期及最近三個會計年度經會計師核閱或查核簽證財務報告之損益狀況及財務比率，並做變動分析與同業比較

1.最近三年度之損益狀況、變動分析及與同業之比較

單位：新台幣仟元

項目	年度 公司	101年度	102年度			103年度		
		金額	金額	增(減)金額	增(減)%	金額	增(減)金額	增(減)%
營業收入	精 材	3,139,385	4,256,761	1,117,376	35.59	4,934,078	677,317	15.91
	日月光	193,972,392	219,862,446	25,890,054	13.35	註	註	註
	同 欣	6,984,993	7,929,440	944,447	13.52	註	註	註
	菱 生	6,352,558	6,047,661	(304,897)	(4.80)	註	註	註
營業成本	精 材	2,889,533	3,561,619	672,086	23.26	3,985,874	424,255	11.91
	日月光	157,352,580	177,048,702	19,696,122	12.52	註	註	註
	同 欣	4,830,771	5,452,342	621,571	12.87	註	註	註
	菱 生	5,433,558	5,150,628	(282,930)	(5.21)	註	註	註
營業毛利	精 材	249,852	695,142	445,290	178.22	948,204	253,062	36.40
	日月光	36,619,812	42,813,744	6,193,932	16.91	註	註	註
	同 欣	2,154,222	2,477,098	322,876	14.99	註	註	註
	菱 生	919,000	897,033	(21,967)	(2.39)	註	註	註
營業費用	精 材	330,980	365,514	34,534	10.43	463,495	97,981	26.81
	日月光	18,932,727	20,769,421	1,836,694	9.70	註	註	註
	同 欣	685,137	702,382	17,245	2.52	註	註	註
	菱 生	495,662	523,966	28,304	5.71	註	註	註
營業（損） 益	精 材	(96,240)	380,636	476,876	(495.51)	675,630	294,994	77.50
	日月光	17,687,085	22,044,323	4,357,238	24.64	註	註	註
	同 欣	1,469,085	1,774,716	305,631	20.80	註	註	註
	菱 生	423,338	373,067	(50,271)	(11.87)	註	註	註
營業外收入及支出	精 材	(11,529)	(31,873)	(20,344)	176.46	(15,704)	16,169	(50.73)
	日月光	(1,102,770)	(2,687,631)	(1,584,861)	143.72	註	註	註
	同 欣	12,513	89,187	76,674	612.75	註	註	註
	菱 生	34,847	52,273	17,426	50.01	註	註	註
本期淨利 (損)	精 材	(90,205)	288,881	379,086	(420.25)	628,653	339,772	117.62
	日月光	13,523,583	16,155,040	2,631,457	19.46	註	註	註
	同 欣	1,312,938	1,583,473	270,535	20.61	註	註	註
	菱 生	383,720	351,315	(32,405)	(8.44)	註	註	註
本期其他 綜合損益	精 材	571	1,188	617	108.06	137	(1,051)	(88.47)
	日月光	(3,823,690)	3,238,026	7,061,716	(184.68)	註	註	註
	同 欣	(120,391)	18,049	138,440	(114.99)	註	註	註
	菱 生	30,626	56,213	25,587	83.55	註	註	註
本期綜合 損益總額	精 材	(89,634)	290,069	379,703	(423.61)	628,790	338,721	116.77
	日月光	9,699,893	19,393,066	9,693,173	99.93	註	註	註
	同 欣	1,192,547	1,601,522	408,975	34.29	註	註	註
	菱 生	414,346	407,528	(6,818)	(1.65)	註	註	註

資料來源：各公司經會計師查核簽證之財務報告。

註：截至評估報告日止，採樣同業尚未出具 103 年年報。

(1)營業收入、營業毛利及營業利益

請參閱本評估報告「參、一、業務狀況(四)、1」之說明。

(2)營業費用及其他收益及費損

營業費用

單位：新台幣仟元

年度 項目	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	占營收比率	金額	占營收比率	金額	占營收比率
推銷費用	34,305	1.09%	38,049	0.89%	39,809	0.81%
管理費用	90,558	2.88%	110,494	2.60%	147,006	2.98%
研究發展費用	206,117	6.57%	216,971	5.10%	276,680	5.61%
營業費用合計	330,980	10.54%	365,514	8.59%	463,495	9.39%
其他收益及費損淨額	(15,112)	(0.48 %)	51,008	1.20%	190,921	3.87%

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告。

該公司 101~103 年度之推銷費用變化不大；管理費用呈逐年成長趨勢，主係因伴隨業績成長，估列之年終獎金、績效獎金等費用亦增加，又因認列董事酬勞、員工分紅費用化以及員工認股權計畫所產生之酬勞成本等因素所致。研發費用則因 103 年度研發人力之擴編，人事相關作本(例如：加班費、相關年終獎金、績效獎金)等均增加，又因認列員工分紅費用之影響，該公司之研發費用亦呈成長趨勢。

其他收益及費損

單位：新台幣仟元

年度 項目	101 年度		102 年度		103 年度	
	金額	占營收比率	金額	占營收比率	金額	占營收比率
出租資產收益淨額	-	-	48,984	1.15%	285,914	5.79%
不動產、廠房及設備減損損失	(26,175)	(0.83%)	(3,804)	(0.09%)	(86,067)	(1.74%)
處分不動產、廠房及設備淨益	2,107	0.07%	2,670	0.06%	236	-
其他	8,956	0.29%	3,158	0.07%	(9,162)	(0.19%)
其他收益及費損淨額	(15,112)	(0.48) %	51,008	1.20%	190,921	3.38%

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告。

出租資產收益淨額：

出租資產收益淨額係出租設備予台積電所生之租金收入扣除相關出租資產折舊後之淨額，租金收入之相關說明請參閱本評估報告「參、發行人業務財務狀況、(五)、1、(2)、③」之說明。

不動產、廠房及設備減損損失：

不動產、廠房及設備減損損失部分，101 年度主係因一批待驗收之空氣污染防治設備等機台發生燒燬事件，雖未造成其他災害，然因該批設備已無法再行使用，故於 101 年認列減損損失；102 年度主要為晶圓級尺寸封裝製程改變，將不適用於新製程之機台認列

資產減損；103 年度則係為增進資產管理效率，將閒置資產提列政策從嚴認定而認列相關減損損失所致。

處分不動產、廠房及設備淨益：

該公司 101~103 年度之處分不動產、廠房及設備淨益分別為 2,107 仟元、2,670 仟元及 236 仟元。係因部分製程進行轉換後，若干設備已不再使用，經該公司評估而出售該等固定資產，進而產生淨處分固定資產利益。

其他收益及費損-其他：

101 年度主係因銷貨客戶所需製程特殊，該公司需購置專用機台供此客戶使用，雙方約定當其下單未達約定數量時，應補償該公司生產及營運上所產生之損失，而有相關補償款收入；102 年度主係因備抵呆帳損失迴轉轉列收入等因素所致；103 年度則係該公司委託一寶科技(股)公司(以下簡稱一寶)採購蝕刻機，然一寶未達符合要求，雙方經爭訟後，一寶因無法再上訴，且進行強制執执行程序，此案件原已支付價金扣除經該公司法務評估應可回收金額後，將差額認列為其他營業損失。

(3)營業外收支

單位：新台幣仟元

年度		101 年度	102 年度	103 年度
利息收入		4,194	4,575	6,114
其他利益及損失	透過損益按公允價值衡量之金融工具淨益(損)	19,339	(20,661)	(51,338)
	外幣兌換淨益(損)	(22,333)	12,117	49,819
	保險理賠收入	-	-	8,856
	其他	677	254	4,803
財務成本		13,406	28,158	33,958
合計		(11,529)	(31,873)	(15,704)

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告。

利息收入：

該公司 101~103 年度之利息收入分別為 4,194 仟元、4,575 仟元及 6,114 仟元，主係該公司銀行活存與定存產生之利息收入，103 年度因購買附買回條件公司債，使得利息收入較 102 年度增加，各期金額及變動尚非屬重大。

兌換損益：

該公司 101~103 年度之透過損益按公允價值衡量之金融工具淨益(損)分別為 19,339 仟元、(20,661)仟元及(51,338)仟元，外幣兌換淨益(損)為(22,333)仟元、12,117 仟元及 49,819 仟元，主係該公司之進、銷貨多以美元計價，為規避因外幣淨資產部位所產生之匯率風險，進而操作衍生性金融商品而產生之遠期外匯損益，大致隨美元兌台幣匯率變動增減。

保險理賠收入：

該公司 103 年度之保險理賠收入為 8,856 仟元，係該公司於 101 年因一批待驗收之空氣污染防治設備等機台發生燒燬事件，並於 103 年取得保險公司給付之理賠收入。

其他利益及損失-其他：

該公司 101~103 年度之其他收入分別為 677 仟元、254 仟元及 4,803 仟元，103 年度金額大幅增加主係因該出售整修 Line C 所拆除原遺留之廠務設施廢料予回收公司之款項、應付設備款掛帳多年轉列其他收入等因素。

財務成本：

該公司 101~103 年度之財務成本分別為 13,406 仟元、28,158 仟元及 33,958 仟元，係該公司向銀行借款產生之利息費用，其變動主係因近年來動支金額增加所致。

(4)淨(損)利及綜合(損)益

單位：新台幣仟元

年度	101 年度	102 年度	103 年度
本期淨(損)利	(90,205)	288,881	628,653
本期綜合(損)益	(89,634)	290,069	628,790
基本每股(虧損)盈餘	(0.38)	1.22	2.65

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告。

該公司 101~103 年度之淨(損)利分別為(90,205)仟元、288,881 仟元及 628,653 仟元，綜合(損)益分別為(89,634)仟元、290,069 仟元及 628,790 仟元，各期淨利及綜合損益呈成長趨勢，係因全球景氣復甦，受惠於市場對智慧型手機及平板電腦之需求增加，加以該公司 102 年下半年度起接獲較高毛利之指紋辨識感測器訂單大幅挹注營收，並帶動該公司之業績及營業利益成長。另因 102 年下半年度開始收取相關租金收入，亦有助於淨利及綜合損益之成長。

2.最近三年度之財務分析及與同業之比較

分析項目		年度	101 年度	102 年度	103 年度
		公司			
財務 結構	負債佔資產比率(%)	精 材	36.40	50.79	47.27
		日 月 光	55.21	55.66	註 4
		同 欣	15.89	19.89	註 4
		菱 生	24.14	24.88	註 4
		同 業	38.13	38.20-	註 1
	長期資金佔不動產、廠 房及設備比率(%)	精 材	117.30	100.45	107.21
		日 月 光	128.18	141.43	註 4
		同 欣	187.04	200.69	註 4
		菱 生	164.08	141.32	註 4
		同 業	201.61	168.92-	註 1

分析項目		年度 公司	101 年度	102 年度	103 年度
償債能力	流動比率(%)	精 材	175.00	95.78	115.61
		日 月 光	115.15	131.08	註 4
		同 欣	408.31	360.41	註 4
		菱 生	232.97	190.97	註 4
		同 業	118.30	174.80	註 1
	速動比率(%)	精 材	147.64	83.34	99.33
		日 月 光	73.86	93.47	註 4
		同 欣	353.23	314.91	註 4
		菱 生	197.97	154.79	註 4
		同 業	101.50	127.20	註 1
	利息保障倍數(倍)	精 材	(4.75)	13.39	20.43
		日 月 光	9.27	9.58	註 4
		同 欣	224.84	141.16	註 4
		菱 生	32.45	52.48	註 4
		同 業	2,452.80	489.30	註 1
經營能力	應收款項週轉率(次)	精 材	7.05	7.28	5.84
		日 月 光	5.70	5.45	註 4
		同 欣	7.53	7.49	註 4
		菱 生	4.72	4.44	註 4
		同 業	5.80	4.00	註 1
	存貨週轉率(次)	精 材	19.17	19.45	18.52
		日 月 光	10.82	11.26	註 4
		同 欣	7.29	6.94	註 4
		菱 生	13.08	13.59	註 4
		同 業	14.60	8.10	註 1
	不動產、廠房及設備週轉率(次)	精 材	0.67	0.81	0.78
		日 月 光	1.62	1.70	註 4
		同 欣	1.62	1.66	註 4
		菱 生	1.55	1.32	註 4
		同 業	1.30	1.90	註 1
	總資產週轉率(次)	精 材	0.50	0.59	0.57
		日 月 光	0.82	0.82	註 4
		同 欣	0.67	0.67	註 4
		菱 生	0.75	0.70	註 4
		同 業	0.50	0.80	註 1
獲利能力	權益報酬率(%)	精 材	(2.32)	7.27	14.34
		日 月 光	12.76	13.57	註 4
		同 欣	15.73	17.35	註 4
		菱 生	6.09	5.43	註 4
		同 業	10.20	(0.50)	註 1

分析項目		年度 公司	101 年度	102 年度	103 年度
	營業利益佔實收資本額比率(%)	精 材	(4.07)	16.10	28.37
		日 月 光	23.26	28.20	註 4
		同 欣	90.18	109.14	註 4
		菱 生	11.14	9.81	註 4
		同 業	註 2	註 2	註 1
	稅前純益佔實收資本額比率(%)	精 材	(4.56)	14.75	27.71
		日 月 光	21.81	24.76	註 4
		同 欣	90.95	114.42	註 4
		菱 生	12.05	11.19	註 4
		同 業	註 2	註 2	註 1
	純益率(%)	精 材	(2.87)	6.79	12.74
		日 月 光	6.97	7.35	註 4
		同 欣	18.80	19.97	註 4
		菱 生	6.04	5.81	註 4
		同 業	12.30	(0.30)	註 1
	每股稅後盈餘(元)	精 材	(0.38)	1.22	2.65
		日 月 光	1.75	2.09	註 4
		同 欣	8.09	9.72	註 4
		菱 生	1.01	0.97	註 4
		同 業	註 2	註 2	註 1
現金 流量	現金流量比率(%)	精 材	80.22	88.09	67.99
		日 月 光	39.02	40.95	註 4
		同 欣	140.42	150.94	註 4
		菱 生	78.43	95.05	註 4
		同 業	72.80	21.40	註 1
	現金流量允當比率(%)	精 材	96.53	85.96	79.63
		日 月 光	85.05	84.88	註 4
		同 欣	註 3	註 3	註 4
		菱 生	120.56	126.31	註 4
		同 業	註 2	註 2	註 1
	現金再投資比率(%)	精 材	6.65	18.09	8.05
		日 月 光	9.27	9.56	註 4
		同 欣	11.25	15.95	註 4
		菱 生	8.13	9.96	註 4
		同 業	15.60	10.40	註 1

資料來源：1.各公司經會計師查核簽證之合併財務報告。

2.同業之財務比率資料係取自「財團法人金融聯合徵信中心」出版之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」，行業類別為「半導體封裝及測試業」，統計數採綜合算術平均數。

註 1：截至評估報告日止，103 年度「中華民國台灣地區主要行業財務比率」尚未出版。

註 2：「中華民國台灣地區主要行業財務比率」未提供同業平均之營業利益佔實收資本額比率、稅前利益佔實收資本額比率、每股稅後盈餘及現金流量允當比率。

註3：同業年報未提供相關資訊，故不予以計算。

註4：截至評估報告日止，採樣同業尚未出具 103 年年報，故不予以計算。

財務分析計算公式：

1.財務結構

(1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率＝(股東權益＋非流動負債)／不動產、廠房及設備淨額

2.償債能力

(1)流動比率＝流動資產／流動負債

(2)速動比率＝(流動資產－存貨－預付費用)／流動負債

(3)利息保障倍數＝稅前息前純益／本期利息支出

3.經營能力

(1)應收款項(含應收票據)週轉率＝銷貨淨額／平均應收帳款(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)總額

(2)應收款項收現天數＝365／應收款項(含應收票據)週轉率

(3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨總額

(4)平均售貨天數＝365／存貨週轉率

(5)不動產、廠房及設備週轉率＝銷貨淨額／平均不動產、廠房及設備淨額

(6)總資產週轉率＝銷貨淨額／平均資產總額

4.獲利能力

(1)權益報酬率＝稅後損益／平均權益總額

(2)營業利益佔實收資本額比率＝營業利益／實收資本額

(3)稅前純益佔實收資本額比率＝稅前純益／實收資本額

(4)純益率＝稅後純益／營業收入淨額

(5)每股盈餘＝(歸屬於母公司業主之損益－特別股股利)／加權平均已發行股數

5.現金流量

(1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債

(2)淨現金流量允當比率＝最近5年度營業活動淨現金流量／最近5年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)

(3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(不動產、廠房及設備毛額＋長期投資＋其它非流動資產＋營運資金)

3.最近三年度財務比率與同業比較分析說明

(1)財務結構

①負債佔資產比率

該公司 101~103 年度負債占資產比率分別為 36.40%、50.79% 及 47.27%，102 年度為因應指紋辨識感測器封裝訂單之需求，增加長期借款以支應購置相關設備之資本支出，致應付設備款及長期借款大幅增加，另因收取終端客戶補償未來訂單風險之產能保證金(帳列存入保證金)，致 102 年底之負債較 101 年底之成長幅度高於資產成長幅度，造成負債比率由 101 年度之 36.40% 上升至 50.79%；103 年度雖該公司於 6 月底已返還全數產能保證金，惟因建置 12 吋影像感測器生產線，增加銀行借款以支應購置相關設備之資本支出，致負債比率僅較 102 年度微幅下降。與採樣公司及同業相較，該公司 101~102 年度之負債佔資產比率均介於採樣公司及同業之間，尚無重大異常之情事。

②長期資金佔不動產、廠房及設備比率

該公司 101~103 年度之長期資金佔不動產、廠房及設備比率分別為 117.30%、100.45%及 107.21%，102 年度為因應指紋辨識感測器封裝訂單而購置機器設備，致該公司之不動產、廠房及設備淨額較 101 年度增加，幅度高達 35.32%，以致長期資金佔不動產、廠房及設備比率下降至 100.45%；103 年度因營運所需增加銀行長期借款，使非流動負債較 102 年度增加 24.52%，致長期資金佔不動產、廠房及設備比率上升至 107.21%。與採樣公司及同業相較，該公司 101~102 年度之長期資金佔不動產、廠房及設備比率均低於採樣公司及同業，惟該公司最近三年度長期資金佔不動產、廠房及設備比率皆大於 100%，尚無以短期資金支應定不動產、廠房及設備支出之情事，顯示該公司整體財務結構尚屬健全。

(2)償債能力

①流動比率及速動比率

該公司 101~103 年度之流動比率分別為 175.00%、95.78%及 115.61%，速動比率分別為 147.64%、83.34%及 99.33%。102 年度因下半年度接獲指紋辨識感測器訂單及出租設備租金之挹注，又因收取終端客戶補償未來訂單風險之產能保證金(帳列存入保證金)，致現金部位、應收部位及存貨水位均較 101 年底成長，惟為因應指紋辨識感測器封裝訂單，而購置大批機器設備，並透過自有資金及長期借款等款項依設備付款進度支付，致流動資產及速動資產成長幅度，未若流動負債高，致流動比率及速動比率較 101 年度下降；103 年度指紋辨識感測器訂單出貨暢旺，雖持續挹注現金水位，惟因指紋辨識感測器市場接受度良好，經與終端客戶協議後已於 6 月返還產能保證金，又因建置 12 吋影像感測器生產線及購置相關設備，該公司增加長期借款，並透過自有資金及長期借款等款項依設備付款進度支付，在流動資產及速動資產變動幅度不大，惟流動負債較 102 年底低之情況下，致流動比率及速動比率較 102 年度上升。與採樣公司及同業相較，101 年度之流動比率及速動比率均介於採樣公司及同業之間；102 年度之流動比率及速動比率均低於採樣公司及同業。

②利息保障倍數

該公司 101~103 年度之利息保障倍數分別為 (4.75)倍、13.39 倍及 20.43 倍。102 年度及 103 年度因指紋辨識感測器封裝業務之挹注，帶動該公司之獲利，致利息保障倍數因而上升。與採樣公司及同業相較，雖 101 年遜於採樣公司及同業，惟 102 年度已介於採樣公司及同業之間

綜上分析，該公司之流動比率、速動比率及利息保障倍數均大致介於採樣公司及同業之間，故其償債能力尚屬合理。

(3)經營能力

①應收款項週轉率

該公司 101~103 年度應收款項週轉率分別為 7.05 次、7.28 次及 5.84 次，應收款項收現天數則分別為 52 天、50 天及 63 天。102 年度因指紋辨識感測器封裝業務之挹注使營收成長，而該公司收款政策一向良好，故應收款週轉率與 101 年度相較變化不大；103 年度因營收持續成長，使期末應收款項增加，應收款項週轉天數因而增加至 63 天，惟仍與該公司之授信政策月結 30~60 天相當，尚無重大異常。與採樣公司及同業相較，101~ 102 年度皆介於採樣公司及同業之間。

②存貨週轉率

該公司 101~103 年度之存貨週轉率分別為 19.17 次、19.45 次及 18.52 次，平均售貨天數則分別為 19 天、19 天及 20 天。102 年度指紋辨識感測器封裝業務之挹注，營收大幅成長，在市場反應良好且對未來出貨狀態保持樂觀下，該公司持續增加庫存水位，故存貨週轉率與 101 年度相較變化不大；103 年度因營收持續成長，該公司持續增加庫存水位，使期末存貨增加，存貨週轉率天數因而增加至 20 天。與採樣公司及同業相較，101~102 年度皆優於採樣公司及同業。

③不動產、廠房及設備週轉率

該公司 101~103 年度之不動產、廠房及設備週轉率分別為 0.67 次、0.81 次及 0.78 次，102 年度及 103 年度因影像感測器及指紋辨識感測器封裝需求增加，帶動營收成長動能，致固定資產週轉率呈成長趨勢。然近年該公司之資本支出持續增加，尤其新廠佈建中之 12 吋封裝生產線尚未產生營收，以及出租台積電之資產亦未能反映在營業收入上(認列於其他營業收益及費損項下)，致本項指標較遜於採樣公司及同業。若排除上述兩項資本支出的話，週轉率將成為 1.43 介於同業之間。

④總資產週轉率

該公司 101~103 年度之總資產週轉率分別為 0.50 次、0.59 次及 0.57 次，102 年度及 103 年度因影像感測器及指紋辨識感測器封裝需求增加，帶動營收成長動能，惟因仍持續增加資本支出，致整體總資產週轉率於 102 年度與 103 年度變化不大。與採樣公司及同業相較，該公司 101 年度之總資產週轉率均介於採樣公司及同業之間，102 年度低於採樣公司及同業。

綜上分析，該公司 101~103 年度經營能力各項指標之變化，尚無重大異常之情形。

(4)獲利能力

該公司 101~103 年度權益報酬率則分別為(2.32)%、7.27%及 14.34%，營業利益占實收資本額之比率分別為(4.07)%、16.10%及 28.37%，稅前利益占實收資本額之比率分別為(4.56)%、14.75%及 27.71%，純益率分別為(2.87)%、6.79%及 12.74%，每股盈餘則分別為(0.38)元、1.22 元及 2.65 元。101 年度因半導體市場需求趨緩，銷貨客戶對備貨態度相對謹慎，營收規模減少，致該公司轉為虧損，各項指標呈負值；102 年度因影像感測器及指紋辨識感測器封裝需求增加，帶動營收成長動能，致權益報酬率、營業利益占實收資本額之比率、稅前利益占實收資本額之比率、純益率及每股盈餘均較 101 年度上升；103 年度因訂單熱度不減，致前述各項指標與 102 年度相較呈大幅成長趨勢。與採樣同業相較，該公司 101 年度之權益報酬率、營業利益占實收資本額之比率、稅前利益占實收資本額之比率、純益率及每股盈餘遜於採樣同業，102 年度則係介於採樣同業之間。

綜上分析，該公司 101~103 年度獲利能力各項指標之變化，尚無重大異常之情形。

(5)現金流量

①現金流量比率

該公司 101~103 年度之營業活動之淨現金流入分別為 647,758 仟元、2,034,265 仟元及 1,196,897 仟元。101~103 年度之現金流量比率分別為 80.22%、88.09%及 67.99%。102 年度因影像感測器及指紋辨識感測器封裝需求增加，帶動營收成長動能，又因收取產能保證金，使營業活動之淨現金流入較 101 年度增加，致現金流量比率較 101 年度上升至 88.09%。103 年度因指紋辨識感測器市場接受度良好，經與終端客戶協議後已於 6 月返還產能保證金，使營業活動之淨現金流入較 102 年度減少，致現金流量比率較 102 年度下降至 67.99%。與採樣公司及同業相較，該公司 101~102 年度介於採樣公司及同業之間。

②現金流量允當比率

101~103 年度之現金流量允當比率分別為 96.53%、85.96%及 79.63%。102 年度為因應指紋辨識感測器封裝訂單而購置機器設備，使現金流量允當比率下降至 85.96%；103 年度因指紋辨識感測器市場接受度良好，經與終端客戶協議後已於 6 月返還產能保證金，使營業活動之淨現金流入數減少，致現金流量允當比率下降至 79.63%。與採樣公司及同業相較，該公司 101~102 年度均介於採樣公司及同業之間。

③現金再投資比率

公司 101~103 年度之現金再投資比率分別為 6.65%、18.09% 及 8.05%，102 年度因影像感測器及指紋辨識感測器封裝需求增加，帶動營收成長動能，及收取產能保證金，使營業活動之淨現金流入增加，致現金再投資比率上升至 18.09%；103 年度因指紋辨識感測器市場接受度良好，經與終端客戶協議後已於 6 月返還產能保證金，使營業活動之淨現金流入數減少，致現金再投資比率下降至 8.05%。與採樣公司及同業相較，該公司 101 年度低於採樣公司及同業，102 年度優於採樣公司及同業。

整體而言，該公司來自營運活動產生之資金尚稱充足，各項現金流量指標尚屬允當

經上述查核該公司最近三年度財務比率之分析，與同類別上櫃、上市公司及未上市櫃、未上市同業財務比率之比較分析，尚無重大異常情事。

(二)發行人及其各子公司(包括母子公司間交易事項)最近三個會計年度背書保證、重大承諾、資金貸與他人、衍生性金融商品交易之情形及重大資產交易之情形，並評估其對公司財務狀況之影響

1.背書保證

該公司業已訂定「背書保證作業程序」，並經董事會及股東會決議通過，以作為辦理背書保證之依據。經查閱該公司董事會、股東會議事錄、會計師查核簽證或核閱之財務報告及至公開資訊觀測站查詢申報內容，該公司最近三年度並無為他人背書保證之情事。

2.重大承諾事項

經參閱該公司最近三年度截至評估報告出具日止之董事會、股東會議記錄及經會計師查核簽證或核閱之財務報告，該公司重大承諾事項如下：

(1)營業租賃協議

該公司廠房及辦公室主係向經濟部工業局中壢工業區承租，租期將於 103 年 8 月至 109 年 10 月陸續到期，其中，經濟部工業局中壢工業區得依規定調整租金，所有租約到期時均可再續約。最近三年度及申請年度截至評估報告出具日止經會計師查核簽證之財務報告，該公司於 103 年 12 月 31 日止基於營運需求以簽訂租賃合約，不可取消之營業租賃所負擔之未來最低應付租賃給付如下：

單位：新台幣仟元

年度	不超過一年	超過一年 但不超過五年	超過五年	合計
應付租金	45,789	97,320	3,187	146,296

資料來源：該公司103年度經會計師查核簽證之財務報告。

上述租賃支出之承諾係該公司因營運所需，故對該公司財務狀況並無重大影響。

(2)或有負債及未認列之合約承諾

①該公司於 89 年 6 月與 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.(原名為以色列商 ShellCase Ltd.)簽訂之技術授權合約，該公司於合約有效期間內分期支付之技術授權費已於 90 年 6 月全數支付完畢，該技術授權費帳列無形資產之專門技術項下，且按耐用年限 20 年攤銷。另依該合約規定，自 92 年 4 月起，若使用該特定技術製造及銷售產品時，依合約規定應按其特定產品銷貨收入淨額之若干比率支付權利金，係因正常營運活動而產生，對該公司財務狀況尚無重大不利影響。

②該公司 101~103 年度承諾購置之固定資產合約總價如下表：

單位：新台幣仟元

項 目	101 年度	102 年度	103 年度
承諾購置之固定資產 合約總價	229,997	583,576	434,935

資料來源：該公司各年度經會計師查核簽證之財務報告。

上述項目主要係該公司因生產所需之設備，而與其他公司簽訂之承諾購置之固定資產合約，由於係正常營運活動而產生，且該公司尚有足夠自有資金及銀行額度得以支應，故對該公司財務狀況影響應屬有限。

③該公司 101~103 年度已開立未使用信用狀之餘額如下表：

單位：新台幣仟元

項 目	101 年度	102 年度	103 年度
已開立未使用信用狀餘額	12,557	-	4,243

資料來源：該公司各年度經會計師查核簽證之財務報告。

上述項目主要係該公司向供應商購買機器設備時，銀行所開立之信用狀未使用餘額，係因正常營運活動而產生，對該公司財務狀況並無重大不利影響。

3.資金貸與他人

該公司業已訂定「資金貸與他人作業程序」，並經董事會及股東會決議通過，以作為辦理資金貸與他人之依據。經查閱該公司董事會、股東會議事錄、會計師查核簽證或核閱之財務報告及至公開資訊觀測站查詢申報內容，該公司最近三年度並無資金貸與他人之情事。

4.衍生性商品交易情形

該公司業已訂定「取得或處分資產處理程序」，並經董事會及股東

會決議通過，作為從事衍生性商品交易之依據。該公司 101~103 年度從事之衍生性商品交易為買賣遠期外匯合約及利率交換合約，交易情形列示如下：

(1)買賣遠匯合約及評價(損)益

該公司之銷貨、進貨多以美元為計價單位，為有效規避匯率波動對淨外幣債權所造成之風險，故從事買賣遠期外匯之衍生性金融商品交易，截至 103 年度尚未到期之遠期外匯合約如下：

單位：新台幣仟元

金融商品	到期期間	合約金額
遠匯合約(賣出美元/買入台幣)	104 年 1 月~104 年 2 月	USD 26,000 / NTD 809,449

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告。

該公司於從事買賣遠期外匯交易係依相關規定辦理，且交易對象均為信用良好之金融機構，該公司 101~103 年度之淨兌換(損)益分別為占各年度營業收入淨額及營業淨利之比例分別為 (0.10)%、(0.20)%、(0.03)%及 3.11%、(2.24)%、(0.22)%，各年度因匯率變動產生之損益已大致與被避險項目之損益相抵銷，故對該公司財務狀況並無重大不利影響。

衍生性商品認列之金融工具損益

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	101 年度	102 年度	103 年度
透過損益按公允價值衡量之金融工具淨(損)益 (A)	19,339	(20,661)	(51,338)
外幣兌換(損)益 (B)	(22,333)	12,117	49,819
淨額 (C=A+B)	(2,994)	(8,544)	(1,519)
營業收入 (D)	3,139,385	4,256,761	4,934,078
營業淨利 (E)	(96,240)	380,636	675,630
C/D(%)	(0.10)%	(0.20)%	(0.03)%
C/E(%)	3.11%	(2.24)%	(0.22)%

資料來源：該公司經會計師查核簽證之財務報告。

(2)利率交換合約及評價(損)益

該公司目前所承擔之長期銀行借款係屬浮動利率之債務，因市場利率之變動極易造成未來現金流量之波動，故簽訂利率交換合約以規避利率變動之風險，截至 103 年 12 月底尚未到期之利率交換合約如下：

單位：新台幣仟元

合約金額	到期日	支付利率區間	收取利率區間
500,000	105 年 12 月 15 日	0.979%~1.108%	0.868%~0.885%

資料來源：該公司 103 年上半年度經會計師核簽證之財務報告

該公司於 101~103 年度從事利率交換合約交易，由權益轉列至當期損失(帳列財務成本項下)分別為 227 仟元、230 仟元及 500 仟元，占營業淨利分別為 0.24%、(0.06)%及(0.07)%，所佔比重甚微，對該公司財務狀況應無重大影響。

5.重大資產交易

該公司已訂定「取得或處分資產處理程序」，並業經董事會及股東會通過，以作為從事資產交易之依據。經查閱該公司董事會、股東會議事錄、會計師查核簽證或核閱之財務報告及至公開資訊觀測站查詢申報內容，100~103 年度並無重大資產達實收資本額百分之二十或金額達三億元以上之交易情形。

(三)發行人最近期及最近三個會計年度資金募集及每股盈餘變化情形

單位：除每股盈餘為新台幣元外，餘係新台幣仟元

項目 \ 年度	101 年度	102 年度	103 年度
普通股股本	2,362,079	2,364,018	2,381,207
營業收入	3,139,385	4,256,761	4,934,078
稅後(損)益	(90,205)	288,881	628,653
基本每股稅後(虧損)盈餘	(0.38)	1.22	2.65
稀釋每股稅後(虧損)盈餘	(0.38)	1.21	2.60

資料來源：該公司各年度經會計師查核簽證之財務報告。

註：每股盈餘係依據各該年流通在外加權平均股數計算。

該公司最近三個會計年度於 102 年度員工行使員工認股權 194 仟股，致使該公司之股本由 101 年度之 2,362,079 仟元增加至 102 年度之 2,364,018 仟元；於 103 年度員工行使員工認股權 1,719 仟股，致使該公司之股本由 102 年度之 2,364,018 仟元增加至 103 年度之 2,381,207 仟元。綜上所述，該公司員工行使員工認股權對每股盈餘稀釋效果尚屬有限。且因 101~103 年度該公司並無對外公開募集資金情事，故該公司最近三個會計年度資金募集及每股盈餘變化，尚無重大異常情事。

(四)本次募資計畫如用於償債或用於充實營運資金者，現金收支預測表中，未來如有重大資本支出及長期股權投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，其資金來源、用途及預計效益

該公司本次募資計畫係用於償還銀行借款，經檢視其現金收支預測表中，本年度及未來一年度重大資本支出達本次募資金額百分之六十以上，其資金來源、用途及預計效益請參閱本評估報告「陸、就本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論、三、(一)、6」之說明。

(五)前各次現金增資、併購或受讓其他公司股份發行新股或發行公司債計劃實際完成日距本次申報時尚未逾三年，且增資計畫係用於償債或用於充實營運資金者，前所提現金收支預測表中之重大資本支出及長期股權投資項目預計效益之達成情形

請參閱本評估報告「肆、發行人前各次募集與發行及私募有價證券計畫之執行情形」之說明。

(六)發行人其他特殊財務狀況

經查閱該公司 100~103 年度經會計師查核簽證之財務報告，該公司並無其他特殊財務狀況之情事。

肆、就發行人前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫之執行情形

本承銷商依「中華民國證券商業同業公會證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定查核，所獲致結論如下：

- 一、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫尚未完成者之執行狀況，如執行進度未達預計目標者，應再具體評估其落後原因之合理性、對股東權益之影響及是否有具體改進計畫

截至評估報告出具日止，該公司前各次資金募集計畫均已執行完畢，故不適用本項之評估。

- 二、前各次現金增資、併購或受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫如經重大變更且尚未完成者，應說明其變更計畫內容、資金之來源與運用、變更原因及變更前後效益

截至評估報告出具日止，該公司前各次資金募集計畫均已執行完畢，故不適用。

- 三、計畫實際完成日距申報時未逾三年之前各次現金增資、併購、受讓他公司股份發行新股或發行公司債及私募有價證券計畫已完成者之原預計效益是否顯現，如執行效益未達預計目標者，應具體評估其原因之合理性及對股東權益之影響

截至評估報告出具日止，該公司未曾辦理併購、受讓他公司股份發行新股或發行公司債之情事，且私募有價證券計畫及前各次現金增資發行新股之計畫實際完成日距本次籌資案申報時均已逾三年，故不適用本項評估。

- 四、曾發行公司債或舉借長期債務者，是否均如期還本付息，其契約對公司目前財務、業務或其他事項之重大限制條款，並說明最近期及最近三個會計年度有無財務週轉困難情事

經參閱該公司最近三個會計年度及申報年度經會計師查核簽證之財務報告、董事會及股東會議事錄，該公司未曾發行公司債；而因營運需求向金融機構舉借長期債務部分，經查閱該公司之借款合同，其借款合同對該公司之財務、業務或其他事項並無重大限制條款，且均能如期還本付息，並未有財務週轉困難之情事。

- 五、是否確實依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理資訊公開

該公司於95年10月17日經董事會決議辦理私募有價證券，並經該公司95年12月5日股東臨時會決議通過，該公司已依據公司法及證券交易法之相關規定，於價款或股款繳納完成日起十五日內向證券期貨局所指定之網站申報相關發行資料，該公司之私募有價證券已依相關規定辦理。

伍、本次募集與發行有價證券之適法性

一、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十三條第一項第二款所列之情事，如有，則應就其事項詳細評估對發行人財務狀況之影響及是否影響本次有價證券募集及發行

該公司本次係依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款之規定，辦理現金增資發行新股以供上櫃前公開承銷之用，非屬同準則第六條第二項第一款或第三款所列發行新股之情事，故不適用同準則第十三條第一項第二款所列情事之評估。

二、是否有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條及第八條所列之情事，並應詳細說明其評估依據

(一)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條所列情事之承銷商審查意見

審查情事	有無左列情事		評估依據
	有	無	
一、簽證會計師出具無法表示意見或否定意見之查核報告者。		✓	經參閱該公司 101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告，並無出具無法表示意見或否定意見之查核報告，故無左列之情事。
二、簽證會計師出具保留意見之查核報告，其保留意見影響財務報告之允當表達者。		✓	經參閱該公司 101~103 年度經會計師查核簽證之財務報告，並無出具保留意見之查核報告，故不適用左列之規定。
三、發行人填報、簽證會計師複核或主辦證券承銷商出具之案件檢查表，顯示有違反法令或公司章程，致影響有價證券之募集與發行者。		✓	該公司本次辦理現金增資發行新股係以供初次上櫃公開承銷之案件，依法無須檢附發行人填報、簽證會計師複核或主辦證券承銷商出具之案件檢查表，故不適用左列之評估。
四、律師出具之法律意見書，表示有違反法令，致影響有價證券之募集與發行者。		✓	經取具翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，該公司並無違反法令而致影響有價證券之募集與發行之情形。
五、證券承銷商出具之評估報告，未明確表示本次募集與發行有價證券計畫之可行性、必要性及合理性者。		✓	依本證券承銷商出具之評估報告總結意見中已表示該公司本次募集與發行新股計畫確具可行性、必要性及合理性，詳細說明請參閱本評估報告「陸、就本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論」之說明。
六、經金管會退回、撤銷、廢止或自行撤回其依「發行人募集與發行有價證券處理準則」申報（請）案件，		✓	經參閱該公司與金管會之往來文件、董事會及股東會議事錄暨證期局受理案件申請情形，該公司申報本次募資

審查情事	有無左列情事		評估依據
	有	無	
發行人自接獲金管會通知即日起三個月內辦理前條第二項規定之案件者。但本次辦理合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股者，不在此限。			計畫前三個月內，並無左列之經金管會退回、不予核准、撤銷、廢止或自行撤回申報(請)案件之情事。
七、申報現金增資或發行公司債案件，直接或間接赴大陸地區投資金額違反經濟部投資審議委員會規定者。但其資金用途係用於國內購置不動產、廠房及設備並承諾不再增加對大陸地區投資，不在此限。	✓		經檢視該公司關於本次資金運用計畫之董事會議事錄，該公司本次現金增資發行新股募集之資金係用於償還銀行借款，並無規劃直接或間接赴大陸地區投資，故無左列條款之情事。
八、上市、上櫃公司或興櫃股票公司未依證券交易法第十四條之六第一項規定設置薪資報酬委員會或未依相關法令規定辦理，情節重大者。	✓		經參閱該公司董事會議事錄與公開資訊觀測站相關資訊，該公司業已依法設立薪資報酬委員會，其成員分別為王文宇、徐中時及謝徽榮，並已訂定「薪資報酬委員會組織規程」，故無左列之情事。
九、未依公司法第一百七十七條之一第一項但書規定將電子方式列為表決權行使管道之一者。	✓		依金融監督管理委員會 102 年 11 月 8 日「金管證交字第 1020644212 號」函釋，公司法第一百七十七條之一第一項但書規定係規範實收資本額達新臺幣五十億元以上，且前次停止過戶日股東名簿記載股東人數達一萬人以上之上市(櫃)公司。該公司目前流通在外股份總額為 2,381,284 仟元，故該公司實收資本及股東人數尚未達適用標準。
十、違反或不履行申請股票上市或在證券商營業處所買賣時之承諾事項，情節重大者。	✓		經參閱該公司出具之承諾書，其截至評估報告出具日止，並無違反或不履行申請股票上櫃時之承諾事項，而有情節重大之情事。
十一、經金管會發現有違反法令，情節重大者。	✓		經參閱該公司與金管會之往來文件、董事會議事錄及該公司出具之聲明書等資料，該公司截至評估報告出具日止並無左列之情事。

綜上，該公司並無「發行人募集與發行有價證券處理準則」第七條所列之情事。

(二)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第八條所列情事之承銷商審查意見

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
一、申報年度及前二年度公司董事變動達二分之一，且其股東取得股份有違反證券交易法第四十三條之一規定。但於申報日前已完成補正者，不在此限。		✓		經核閱該公司最近二年度及104年截至評估報告出具日之變更登記事項表、董事會及股東會議事錄，該公司102年6月13日召開股東常會全面改選董事，席次由五席增加至七席，計有四席變動，變動比率4/7，達1/2標準。然並未發現該公司之股東有取得該公司股份有違反證券交易法第四十三條之一規定之情事。
二、上市或上櫃公司有證券交易法第一百五十六條各款情事之一者。但依證券交易法第一百三十九條第二項規定限制其上市買賣，不在此限。				經查閱該公司與證券主管機關之往來函文，該公司並無經證券主管機關依證券交易法第一百三十九條第二項規定限制上市買賣之情事。另該公司並無違反證券交易法第一百五十六條第一項各款之情事，評估依據說明如下：
(一)發行該有價證券之公司遇有訴訟事件或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計畫、財務狀況或停頓生產。		✓		經檢視該公司最近三年度及104年度截至評估報告出具日止之股東會及董事會議事錄、公開說明書、經會計師查核簽證之財務報告、相關細帳等、該公司之聲明書及律師出具之法律意見書等，該公司截至評估報告出具日止，未有訴訟事件或非訟事件，其結果足使公司解散或變動其組織、資本、業務計畫、財務狀況或停頓生產，而有影響市場秩序或損害公益之虞之情事。惟前述訴訟案件請參閱本評估報告「伍、本次募集與發行有價證券之適法性、四、(三)」之說明。
(二)發行該有價證券之公司，遇有重大災害，簽訂重要契約，發生特殊事故，改變業務計畫之重要內容或退票，其結果足使公司之財務狀況有顯著重大之變更。		✓		經參閱該公司最近三年度及104年截至評估報告出具日止之董事會及股東會議事錄、經會計師查核簽證之財務報告、與主管機關往來函文、現行有效之重要契約、相關明細分類帳及向台灣票據交換所取具該公司之無退票查詢紀錄、該公司出具之聲明書，並參閱律師出具之法律意見書，該公司於101年7月30日因一批待驗收之空氣污染防治設備等機台發生燒燬事件，雖未造成其他災害，然因該批設備已無法再行使用，故於

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
(三)發行該有價證券公司之行為，有虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格。	✓			101 年 12 月 31 日將已支付之設備款共計 22,181 仟元全數認列為減損損失，並於 103 年 6 月 23 日至 30 日取得保險公司給付之理賠收入共計 8,851 仟元(帳列保險理賠收入)。此事件產生結果並未對該公司之財務狀況產生重大之變更，而有影響市場秩序或損害公益之虞。 經參閱該公司最近三年度及 104 年截至評估報告出具日止之董事會、股東會議紀錄、與主管機關往來函文、取得公司聲明書並參閱律師出具之法律意見書，該公司截至目前為止並無虛偽不實或違法情事，足以影響其證券價格，而及於市場秩序或損害公益之虞者。
(四)該有價證券之市場價格，發生連續暴漲或暴跌情事，並使他種有價證券隨同為非正常之漲跌。		✓		該公司截至評估報告出具日止，僅登錄於興櫃市場，尚未於上市或上櫃市場掛牌交易，故不適用。
(五)其他重大情事。	✓			經參閱該公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報告、董事會與股東會議事錄及與主管機關往來函文，截至評估報告出具日止，尚無其他重大情事。
三、本次募集與發行有價證券計畫不具可行性、必要性及合理性者。	✓			該公司本次募集與發行有價證券計畫，經本承銷商審慎評估後，本次發行計畫應具可行性、必要性及合理性，詳細說明請參閱本評估報告「陸、就本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論」之說明。
四、前各次募集與發行及私募有價證券計畫之執行有下列情事之一，迄未改善：				
(一)無正當理由執行進度嚴重落後，且尚未完成。	✓			該公司最近一次增資計畫係於 95 年 1 月 9 日經證期局核准，業已依資金運用計畫執行完畢。另於 96 年辦理私募引進策略型股東，該次私募資金業於 96 年第三季執行完畢，故無左列情事。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
(二)無正當理由計畫經重大變更。但計畫實際完成日距申報時已逾三年，不在此限。	✓			該公司前各次募集與發行及私募有價證券計畫並無發生計畫變更之情事，且分別已於 95 年及 96 年執行完畢，故無左列情事。
(三)募集與發行有價證券計畫經重大變更，尚未提報股東會通過。	✓			該公司前各次募集與發行及私募有價證券計畫並無發生計畫變更之情事，且分別已於 95 年及 96 年執行完畢，故無左列情事。
(四)最近一年內未確實依第九條第一項第四款至第九款及發行人募集與發行海外有價證券處理準則第十一條規定辦理。	✓			該公司並未募集與發行海外有價證券，另參閱該公司與主管機關往來函文、查閱公開資訊觀測站相關公告資料，尚未發現該公司有違反第九條第一項第四款至第九款之情事。
(五)未確實依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項規定辦理，情節重大。	✓			該公司於 96 年辦理私募引進策略型股東，該次私募資金業於 96 年第三季執行完畢，故無左列情事。
(六)未能產生合理效益且無正當理由。但計畫實際完成日距申報時已逾三年，不在此限。	✓			該公司前次募集與發行及私募有價證券計畫分別於 95 年及 96 年執行完畢且產生合理效益，故無左列情事。
五、本次募集與發行有價證券計畫之重要內容（如發行辦法、資金來源、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益等）未經列成議案，依公司法及章程提董事會或股東會討論並決議通過者。	✓			該公司本次募集與發行有價證券計畫之重要內容，業於 103 年 3 月 6 日董事會、103 年 6 月 12 日股東常會及 104 年 2 月 4 日董事會列成議案並經討論決議通過，故無左列情事。
六、非因公司間或與行號間業務交易行為有融通資金之必要，將大量資金貸與他人，迄未改善，而辦理現金增資或發行公司債者。	✓			經參閱該公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報告、董事會議事錄及查詢公開資訊觀測站申報公告資訊，該公司並未有資金貸與他人之情事。
七、有重大非常規交易，迄未改善者。	✓			經參閱該公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報告、董事會及股東會之議事錄，並無發現該公司有重大非常規交易之情事。
八、持有具流動性質之金融資產投資、閒置性資產或投資性不動產而未有處分或積極開發計畫，達最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告歸屬於母公司業主之權益之百分之四十或本次申報現金增資或發行公司債募集總金額之百分之六十，而辦理現金增資或發行公司債者。但所		✓		該公司本次募資係依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款規定，辦理現金增資發行新股以供辦理初次上櫃前公開承銷使用，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第八條第四項規定，不適用左列條款之規定。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
募得資金用途係用於購買不動產、廠房及設備且有具體募資計畫佐證其募集資金之必要性，不在此限。				
九、本次現金增資或發行公司債計畫之用途為轉投資以買賣有價證券為主要業務之公司或籌設證券商或證券服務事業者。	✓			經參閱該公司本次現金增資計畫之董事會議事錄，其資金用途係為償還銀行借款，故無左列情事。
十、不依有關法令及一般公認會計原則編製財務報告，情節重大者。	✓			經參閱該公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報告，均依有關法令及一般公認會計原則編製，尚無所列之情事。
十一、違反第五條第二項規定情事者。	✓			該公司已出具承諾書，承諾不得於申報日至申報生效日間，除依法令發布之資訊外，不得對特定人或不特定人說明或發布財務業務之預測性資訊。
十二、內部控制制度之設計或執行有重大缺失者。	✓			經參閱該公司稽核報告、內控聲明書、會計師出具之內控建議書及內部控制制度審查報告，並未發現該公司內部控制制度之設計或執行有重大缺失之情事。
十三、申報日前一個月，其股價變化異常者。	✓			經查閱櫃買中心網站「興櫃公布注意股票資訊」，該公司並無左列情事。
十四、公司全體董事或監察人持股有下列情形之一者：				
(一)違反證券交易法第二十六條規定，經金管會通知補足持股尚未補足。	✓			經查閱該公司全體董事持股資料，截至 104 年 1 月 31 日止，全體董事持股總數為 104,759,216 股，占該公司目前流通在外股數之 43.99%；另該公司依證券交易法成立審計委員會，未有監察人之設置，故經計算該公司符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定。
(二)加計本次申報發行股份後，未符證券交易法第二十六條規定。但經全體董事或監察人承諾於募集完成時，補足持股，不在此限。	✓			該公司截至評估報告出具日止，已發行股數為 238,128,431 股，加計本次現金增資 30,000,000 股後，預計股數達 268,128,431 股，其董事持股成數將稀釋為 39.07%，仍符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之相關規定，故並無違反左列規定情事。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
(三)申報年度及前一年度公司全體董事或監察人未依承諾補足持股。			✓	經參閱該公司最近一年度及申報年度截至目前為止之全體董事持股資料，均符合規定，故不適用左列之評估。
十五、發行人或其現任董事長、總經理或實質負責人於最近三年內，因違反證券交易法、公司法、銀行法、金融控股公司法、商業會計法等工商管理法律，或因犯貪污、瀆職、詐欺、背信、侵占等違反誠信之罪，經法院判決有期徒刑以上之罪者。		✓		經核閱該公司股東會年報、最近三年度經會計師查核簽證之財務報告、取得該公司現任董事長暨總經理出具之聲明書及律師出具之法律意見書，該公司或其現任董事長暨總經理於最近三年內並無左列之情事。
十六、因違反證券交易法，經法院判決確定須負擔損害賠償義務，迄未依法履行者。		✓		經參閱該公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報告、董事會與股東會議事錄、律師出具之法律意見書並取具該公司聲明書，該公司並無因違反證交法，經法院判決確定須負擔損害賠償義務，而迄未依法履行之情事。
十七、為他人借款提供擔保，違反公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第五條規定，情節重大，迄未改善者。		✓		經參閱該公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報告、公開資訊觀測站、董事會與股東會議事錄，該公司並未有為他人借款提供擔保之情事，故無左列之情事。
十八、合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股者，而有下列情形之一： (一)違反金管會公開發行公司取得或處分資產處理準則第二章第五節規定，情節重大。 (二)受讓或併購之股份非為他公司新發行之股份、所持有非流動之股權投資或他公司股東持有之已發行股份。 (三)受讓之股份或收購之營業或財產有限制買賣等權利受損或受限制之情事。 (四)違反公司法第一百六十七條第三項及第四項之規定。			✓	該公司本次現金增資發行新股計畫並非合併發行新股、受讓他公司股份發行新股、依法律規定進行收購或分割發行新股，故不適用左列規定。

審查情事	有無左列情事			評估依據
	有	無	不適用	
(五)被合併公司最近一年度之財務報告非經會計師出具無保留意見之查核報告。但經出具保留意見之查核報告，其資產負債表經出具無保留意見，不在此限。				
十九、有「發行人募集與發行有價證券處理準則」第十三條第一項第二款第六目規定之情事，且有下列情形之一： (一)申報現金發行新股，公司董事、監察人及持有股份超過股份總額百分之十之股東未承諾將一定成數股份送交證券集中保管事業保管。 (二)申報發行轉換公司債或附認股權公司債。	✓			該公司本次係依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款之規定，辦理現金增資發行新股以供上櫃前公開承銷，非依同準則第六條第二項第一款或第三款募集與發行有價證券，故不適用同準則第十三條第一項第二款所列情事之評估。
二十、其他金管會為保護公益認為有必要者。	✓			經參閱該公司董事會議事錄及與主管機關往來函文，並無左列情事。

綜上，該公司並無「發行人募集與發行有價證券處理準則」第八條所列之情事。

三、是否符合「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定

自律規則		說明
第一條	為推動有價證券之發行，並保障投資，除其他法令另有規定外，本公會承銷商會員輔導發行公司或外國發行人辦理募集與發行有價證券事宜時應遵守本自律規則。	本承銷商辦理該公司本次募集與發行有價證券，謹遵守本自律規則。
第二條	承銷商輔導發行公司或外國發行人募集與發行有價證券時，主辦承銷商與發行公司或外國發行人間不得有下列情事： 一、任何一方與其母公司、母公司之全部子公司及其子公司管理之創業投資事業，合計持有對方股份總額百分之十以上者。 二、任何一方與其子公司派任於對方之董事，超過對方董事總席次半數者。 三、任何一方董事長或總經理與對方之董事長或總經理為同一人，或具有配偶、二親等以內親屬關係者。 四、任何一方股份總額百分之二十以上之股份為相同之股東持有者。 五、任何一方董事或監察人與對方之董事或監察人半數以上相同者。其計算方式係包括該等人員之配偶、子女及具二親等以內之親屬關係者在內。 六、任何一方與其關係人總計持有他方已發行股份總額百分之五十以上者。但證券承銷商為金融機構或金融控股公司之證券子公司時，如其母公司、母公司之全部子公司及其子公司管理之創業投資事業總計持有發行公司股份未逾發行公司已發行股份總額百分之十，且擔任發行公司董事或監察人席次分別未逾三分之一者，不在此限。 七、雙方依相關法令規定，應申請結合者或申報後未經公平交易委員會禁止結合者。 八、其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務、業務經營或雙方有重大業務往來關係，致有失其獨立性之情事者。 發行公司或外國發行人發行普通公司債，如銷售對象僅限於專業投資機構，其主辦承銷商得不受前項規定之限制，發行公司或外國發行人如具證券承銷商之資格者，亦得擔任主辦承銷商。 本條所稱母公司及子公司，應依證券商財務報告編製準則規定認定之。	經查本承銷商與該公司間並無左列各款之情事，故符合左列條文之規定。
第二條之一	承銷商輔導發行公司或外國發行人募集與發行有價證券應取得填報檢查表並出具法律意見書之律師，於最近一年內未受法務部律師懲戒委員會懲戒，且不得與發行公司或外國發行人、會計師及證券商具有下列關係之聲明書：	經取具翰辰法律事務所邱雅文律師所出具之聲明書，其業已聲明最近一年內未受法務部律師懲戒委員會

自律規則		說明
	一、財務會計準則公報第六號規定之關係人關係。 二、其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者。 依發行人募集與發行海外有價證券處理準則或外國發行人募集與發行有價證券處理準則規定出具海外存託憑證、海外股票或海外公司債發行辦法與行政院金融監督管理委員會同意生效內容無重大差異意見書中文本之律師，亦應符合前項之規定。	懲戒，且與該公司、會計師及本承銷商並無左列關係之情事，符合左列規定。
第三條	承銷商輔導發行公司或外國發行人募集與發行有價證券，應於向本公會申報承銷契約副本時，檢送有關承銷商與發行公司或外國發行人於向金管會申報案件至繳款截止日止，其相關宣傳或資訊揭露應以公開說明書所載內容為限之聲明書；承銷商並應複核發行公司或外國發行人有無違反前開規定。 前項聲明書之聲明事項，應增列有關不得對特定人或不特定人說明或發布除依金管會「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」辦理公告之財務預測資訊內容以外之其他財務業務預測性資訊。 經主管機關依證券交易法第二十二條第一項核定免向金管會申報生效者，第一項聲明書之聲明期間以向金管會申請案件至繳款截止日止。	本承銷商於向券商公會申報承銷契約副本時，將依左列規定辦理。
第四條	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券(員工認股權憑證除外)，加計其前各次(含其所私募者)上述有價證券流通在外餘額依各別轉換(認購)價格設算轉換(認購)後所增加之股數，不得逾已發行股數之百分之五十。 發行公司或外國發行人以已發行之股份做為轉換(認購)之用者，其做為轉換(認購)用之已發行股份不列入前項增加股數之計算。	該公司本次係辦理現金增資發行新股，非屬有普通股轉換(認購)權之各種有價證券，故不適用左列規定。
第四條之一	承銷商輔導發行公司申報發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券，以新發行之股份履行轉換義務或履約者，承銷商應加強輔導發行公司採取股票無實體發行之制度，惟自九十五年七月一日起，上市、上櫃及興櫃股票公司發行股票或公司債應採帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之。 承銷商輔導外國發行人募集與發行有價證券之交付，除外國發行人註冊地國另有規定外，應以帳簿劃撥方式為之。	該公司本次係辦理現金增資發行新股，非屬有普通股轉換(認購)權之各種有價證券，故不適用左列規定。
第四條之二	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換(認購)權之各種有價證券，應注意發行公司之發行與轉換(認購)辦法中應訂明「自發行公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，不得請求轉換(認購)」規定；另應注意已發行流	該公司本次係辦理現金增資發行新股，非屬有普通股轉換(認購)權之各種有價證券，故不適用左列規定。

自律規則		說明
	通在外之轉換公司債其轉換股份時先交付股票再辦理變更登記者，如遇普通股除息、除權或現金增資認股時，應符合證交所「營業細則」及櫃檯中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」第十條有關二階段公告規定。	
第四條之三	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換（認購、交換）權之各種有價證券，自發行日後屆滿一定期間起，除依法暫停過戶期間外，持有人得依發行人所定之發行及轉換（認股、交換）辦法請求轉換（認股、交換）；但發行公司或外國發行人為未上市（櫃）、未登錄興櫃之公開發行公司者，轉換（認股、交換）期間自發行日後屆滿一定期間至到期日前十日止為限。前項所稱一定期間不得少於一個月，並應由發行人或外國發行人於轉換（認購、交換）辦法中訂定之。	該公司本次係辦理現金增資發行新股，非屬有普通股轉換(認購、交換)權之各種有價證券，故不適用左列規定。
第四條之四	(刪除)	
第四條之五	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具股權轉換（交換、認購）性質之各種有價證券，應就發行年期、發行價格、贖回時點、轉換溢價率、收益率、賣回時點、擔保狀況、分券狀況等因素綜合評估其發行條件訂定之合理性。 對於發行條件顯不相當者，承銷商應輔導發行公司或外國發行人於重新合理訂定發行條件後，再行送件。	該公司本次係辦理現金增資發行新股，非屬具股權轉換(交換、認購)性質之各種有價證券，故不適用左列規定。
第四條之六	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行海外有價證券，其按發行價格計算之發行金額，應高於二千萬美元。但發行公司確有外幣需求或外國發行人確有特殊需求，且發行條件合理者，不受此限。	該公司本次非發行海外有價證券，故不適用左列規定。
第四條之七	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有普通股轉換（認購）權之各種有價證券，應注意發行公司或外國發行人之發行與轉換（認購）辦法中應訂明發行公司或外國發行人依發行與轉換（認購）辦法所定反稀釋調整公式計算其調整後轉換價格時，其公式中之已發行股數應加計已私募股數。 承銷商輔導發行公司或外國發行人申報（請）發行具有普通股轉換（認購）權之各種有價證券，應注意發行公司或外國發行人之發行與轉換（認購）辦法中應訂明發行公司或外國發行人發行具有普通股轉換（認購）權之各種有價證券後，除發行公司或外國發行人所私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份者外，發行公司或外國發行人遇有私募普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價之轉換或認股價格再私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時，發行公司或外國發行人應比照該發行與轉換（認購）辦法所定於遇有已發行普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價之轉換或認股價格再發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時之轉換價格調整公式，計算其調整後轉換價格（向下調整，向上則不予調整）並函請證交所或	該公司本次係辦理現金增資發行新股，非屬有普通股轉換(認購)權之各種有價證券，故不適用左列規定。

自律規則		說明
	櫃檯買賣中心公告，於私募有價證券交付日調整之。 依第二項計算調整後轉換價格時，如須訂定每股時價，應以私募有價證券交付日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。	
第四條之八	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具股權轉換（交換、認購）性質之各種有價證券，公開說明書中應充分揭露當次發行有價證券之發行條件及該發行條件對股權稀釋、股東權益之影響。	該公司本次係辦理現金增資發行新股，非屬具股權轉換（交換、認購）性質之各種有價證券，故不適用左列規定。
第四條之九	除上市（櫃）公司、興櫃公司辦理現金增資發行普通股採公開申購配售辦理案件外，發行公司或外國發行人得先行印製價格以區間方式揭露之公開說明書寄交投資人，並於該公開說明書封面顯著處註明提醒投資人上網查詢、參閱承銷商配售通知之實際承銷價格並依承銷商之通知繳交價款。 承銷商應注意交寄當日發行公司或外國發行人須將該公開說明書電子檔傳送至金管會指定之網站，另價格確定後二日內須將完整公開說電子檔傳送至金管會指定之網站。 第一項公開說明書上揭露之價格區間應與承銷商辦理詢價公告之預計承銷價格之可能範圍一致。	該公司本次辦理現金增資發行普通股申請初次上櫃案件，將採詢價圈購配售及公開申購配售方式辦理公開承銷，謹遵守本自律規則辦理。
第四條之十	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具有股權轉換（認購、交換）性質之各種有價證券，若發行條件中包含債券持有人之賣回權利，應注意發行公司或外國發行人之發行與轉換（認股、交換）辦法中應訂明債券持有人行使賣回權之款項支付日。	該公司本次係辦理現金增資發行新股，非屬具有股權轉換（認購、交換）性質之各種有價證券，故不適用左列規定。
第四條之十一	承銷商輔導發行公司或外國發行人申報發行具股權性質之各種公司債，應注意發行公司或外國發行人應依財務會計準則公報第 34 及 36 號規定設算應負擔年息總額是否符合公司法第 249 條第 2 款及第 250 條第 2 款之規定。	該公司本次係辦理現金增資發行新股，非屬具股權性質之各種公司債，故不適用左列規定。
第四條之十二	承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應輔導發行公司或外國發行人於申報案件時出具承諾書，承諾自申報日起至該有價證券掛牌後一個月內不得買回本公司股份。	該公司本次辦理現金增資發行新股已出具承諾書，承諾自申報日起至該有價證券掛牌後一個月內不得買回該公司股份。
第四條之十三	承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募集人民幣計價海外公司債時，應輔導發行公司或外國發行人於申報案件時出具承諾書及到期償債資金來源之計畫，承諾海外募得人民幣資金係供海外營運實體使用，不以任何方式匯回臺灣。	該公司本次係辦理現金增資發行新股，非屬人民幣計價海外公司債，故不適用左列規定。

自律規則		說明
第四條之十四	承銷商輔導發行公司或外國發行人辦理申報募資案件時，應輔導發行公司或外國發行人於公開說明書記載發行公司、發行公司之董事、監察人、總經理、財務長以及與發行公司辦理募資案件有關之經理人、受僱人，絕無要求或收取承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用予發行公司及上開所列人員或其關係人或其指定之人等之聲明書，並依「公司募集發行有價證券公開說明書應行記載事項準則」編製公開說明書及簡式公開說明書，且於申報募資案件及向本公會申報承銷契約前，檢核上傳之公開說明書電子檔已確實用印且內容具完整性。	經檢核該公司上傳之公開說明書電子檔，該公司已於公開說明書記載左列人員絕無要求或收取承銷商以任何方式或名目補償或退還承銷相關費用之聲明書且內容具完整性，而該等人員並已確實用印，本承銷商亦將於向券商公會申報承銷契約前，依左列規定辦理。
第四條之十五	承銷商輔導外國發行人辦理申報「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第一項第一款至第三款募資案件時，應於募集完成年度及其後二個會計年度，協助其遵循中華民國證券相關法令。	該公司非屬外國發行人辦理申報、故不適用。
第五條	承銷商輔導上市（櫃）公司辦理現金增資發行普通股，應於申報案件時出具發行公司或外國發行人之子公司不得參與新股認購之承諾書。	該公司非屬上市（櫃）公司，故不適用左列規定。
第五條之一	承銷商輔導上市（櫃）公司、興櫃公司辦理現金增資發行普通股，如申請延長募集期間且其財務預測無重大變動者，應檢送由發行公司或外國發行人出具經會計師複核之財務預測仍屬有效性聲明書。	截至評估報告日止，該公司並未公布財務預測，故不適用左列規定。
第五條之二	承銷商輔導發行公司或外國發行人以現金增資發行普通股申請初次上市（櫃）案件，向金管會或其委託之機構申報案件時應以合理之方式訂定暫定價格，如有興櫃交易者，暫定價格不得低於向金管會或其委託之機構申報案件前興櫃有成交之 10 個營業日其成交均價簡單算術平均數之七成；如經股東會決議原股東全數放棄優先認股者，得採股數區間方式辦理申報，並敘明實際發行價格或股數如有變動，導致募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。 承銷商應輔導發行公司或外國發行人於實際發行價格確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。 以現金增資發行新股辦理股票初次上市、上櫃前之承銷案件，主辦承銷商應與發行公司或外國發行人約定，由發行公司或外國發行人協調股東按該次現金增資對外公開發售之一定比例之已發行普通股股票，供主辦承銷商於承銷期間進行過額配售，並應依本公會「承銷商辦理初次上市（櫃）案件承銷作業應行注意事項要點」辦理。	該公司本次現金增資發行普通股，即係供申請初次上櫃公開承銷之用，該公司與本承銷商之間業已依合理之方式訂定暫定之承銷價格，且其價格未低於申報案件前興櫃有成交之 10 個營業日其成交均價簡單算術平均數之七成，亦於評估報告中敘明實際發行價格如有變動，導致募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，請參閱本評估報告「陸、就本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理

自律規則		說明
		性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論」之說明；待本案之實際發行價格確認後，本承銷商將遵循本自律規則之規定，輔導該公司於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。另本證券承銷商業已與該公司簽訂過額配售協議書並將依照「承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」辦理相關作業。
第六條	承銷商輔導上市（櫃）公司辦理現金增資發行普通股如採公開申購配售辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之七成。 承銷商輔導興櫃公司辦理現金增資發行普通股採公開申購配售辦理承銷，其發行價格除不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值外，應參考向本公會報備承銷契約前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之均價，並應提出合理說明。 承銷商輔導發行公司或外國發行人向金管會申報案件時，應載明暫定發行價格及因市場變動實際發行價格須依第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。 承銷商應輔導發行公司或外國發行人於實際發行價格確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。	該公司非屬上市(櫃)公司，且該公司本次辦理現金增資發行普通股係供申請初次上櫃公開承銷之用，故不適用左列規定。
第六條之一	承銷商輔導上市（櫃）公司辦理現金增資發行普通股，如發行公司依證券交易法第二十八條之一第三項規定，決議提撥發行新股總額超過百分之十對外採公開申購配售辦理承銷，其發行價格訂定方式應提報公司股東會。	該公司非屬上市(櫃)公司，故不適用左列規定。
第七條	承銷商輔導上市（櫃）公司辦理現金增資發行普通股經股東會決議原股東全數放棄優先認股者，如採詢價圈購方式辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案	該公司非屬上市(櫃)公司，故不適用左列規定。

	自律規則	說明
	件、向本公會申報詢價圈購約定書及向本公會申報承銷契約時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之九成；如採競價拍賣方式辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報辦理競價拍賣公告時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之九成。 承銷商輔導發行公司或外國發行人向金管會申報案件時，應載明暫定發行價格、股數區間及因市場變動實際發行價格須依第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。 承銷商應輔導發行公司或外國發行人於實際發行價格及股數確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。	
第七條之一	承銷商輔導上櫃（市）公司申請轉上市（櫃）為達股權分散標準辦理現金增資發行新股之承銷案件經股東會決議原股東全數放棄優先認股，採公開申購方式辦理承銷，其發行價格之訂定，於向金管會申報案件、向本公會申報辦理公開申購公告時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之九成。 承銷商輔導發行公司向金管會申報案件時，應載明暫定發行價格、股數區間及因市場變動實際發行價格須依第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，承銷商並應就其適法性及合理性評估。 承銷商應輔導發行公司於實際發行價格及股數確認後，於公開資訊觀測站中公告實際發行計畫，並更新公開說明書相關內容。	該公司非屬上市(櫃)公司，故不適用左列規定。
第八條	採詢價圈購配售辦理之承銷案件，於承銷契約報本公會前，如發行價格偏離市場價格過大者，應重新辦理詢價，並於詢價後，隨即進行承銷作業。 承銷商於向本公會申報承銷契約時，應一併檢送下列資料： 一、詢價圈購之相關資料（含詢價期間、詢價範圍、各圈購價格及其圈購股數、詢價公告暫訂發行價格占詢價公告日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之成數等資料）。 二、配售原則及預計配售予自然人、法人及本公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法第三十六條第	本承銷商本次輔導該公司以現金增發行新股辦理股票初次上櫃前之承銷案件，將謹遵守左列規定辦理。

自律規則		說明
	一項第一款至第七款有關董事、監察人、大股東、關係人等之股數及配售比率。 承銷商於向本公會申報承銷契約後，應隨即辦理承銷公告及相關承銷事宜。	
第九條	承銷商輔導上市（櫃）公司辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證，其發行價格之訂定方式及依公司法第二百六十七條第一項保留員、工承購股份於員、工未認購時之處理方式，均應列成議案經股東會討論並決議通過。 承銷商輔導上市（櫃）公司向金管會申報案件，暫訂發行價格不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之九成。 實際發行價格不得低於訂價日收盤價、訂價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之九成。	該公司非為上市(櫃)公司，且本次辦理現金增資發行新股並非參與發行海外存託憑證，故不適用。

綜上評估，該公司本次辦理辦理現金增資發行新股業已符合「中華民國證券商同業公會承銷會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之規定。

四、法令之遵循及對公司營運影響

(一)發行人是否符合公司法第一百三十條、第一百五十六條第七項、第一百六十七條第三項及第四項、第二百四十六條、第二百四十七條、第二百七十八條及證券交易法第二十八條之四規定，且無公司法第二百四十九條及第二百五十條、第二百六十九條及第二百七十條規定之情事

法律條文規定	說明
一、公司法第一百三十條 下列各款事項，非經載明於章程者，不生效力： (一)分公司之設立。 (二)分次發行股份者，定於公司設立時之發行數額。 (三)解散之事由。 (四)特別股之種類及其權利義務。 (五)發起人所得受之特別利益及受益者之姓名。 前項第五款發起人所得受之特別利益，股東會得修改或撤銷之。但不得侵及發起人既得之利益。	依該公司經股東會通過之公司章程第三條：「本公司設總公司於桃園縣，必要時得經過董事會之決議：一、於國內外設立分公司或工廠」，及第四條：「本公司資本總額定為新台幣肆拾億元整，分為肆億股，每股新台幣壹拾元，其中未發行之股份得授權董事會分次發行。前項資本額度內保留新台幣壹億貳仟萬元計壹仟貳佰萬股供發行員工認股權憑證，得依董事會決議分次發行」，故符合左列規定。
二、公司法第一百五十六條第七項 股東之出資除現金外，得以對公司所有	該公司本次係辦理現金增資發行新股，無左列各項事由，故不適用左列規定。

法律條文規定	說明
之貨幣債權，或公司所需之技術抵充之；其抵充之數額需經董事會通過，不受第二百七十二條之限制。	
三、公司法第一百六十七條第三項及第四項 被持有已發行有表決權之股份總數或資本總額超過半數之從屬公司，不得將控制公司之股份收買或收為質物。 前項控制公司及其從屬公司直接或間接持有他公司已發行有表決權之股份總數或資本總額合計超過半數者，他公司亦不得將控制公司及其從屬公司之股份收買或收為質物。	經參閱該公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報告，該公司並無從屬公司，故未有左列之情事。
四、公司法第二百四十六條 公司經董事會決議後，得募集公司債。但須將募集公司債之原因及有關事項報告股東會。 前項決議，應由三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之同意行之。	該公司本次係辦理現金增資發行新股，故不適用左列規定。
五、公司法第二百四十七條 公司債之總額，不得逾公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額。無擔保公司債之總額，不得逾前項餘額二分之一。	該公司本次係辦理現金增資發行新股，故不適用左列規定。
六、公司法第二百七十八條 公司非將已規定之股份總數，全數發行後，不得增加資本。 增加資本後之股份總數，得分次發行。	經查閱該公司章程及變更登記表，該公司額定資本為 400,000 仟股，截至目前為止該公司流通在外股數為 238,128 仟股，加計本次辦理現金增資發行普通股 30,000 仟股，估計發行後實收資本額增加至 268,128 仟股，尚未超過額定資本，故符合左列規定。
七、證券交易法第 28 條之四 已依本法發行股票之公司，募集與發行有擔保公司債、轉換公司債或附認股權公司債，其發行總額，除經主管機關徵詢目的事業中央主管機關同意者外，不得逾全部資產減去全部負債餘額之百分之二百，不受公司法第二百四十七條規定之限制。	該公司本次係辦理現金增資發行新股，故不適用左列規定。
八、公司法第二百四十九條 公司有下列情形之一者，不得發行無擔保公司債： (一)對於前已發行之公司債或其他債務有違約或遲延支付本息之事實，尚在繼續中者。 (二)最近三年或開業不及三年之開業年度課稅後之平均淨利，未達原定發行之公司債應負擔年息總額之百分之	該公司本次係辦理現金增資發行新股，故不適用左列規定。

法律條文規定	說明
一百者。但經銀行保證發行之公司債不受限制。	
九、公司法第二百五十條 公司有下列情形之一者，不得發行公司債： (一)對於前已發行之公司債或其他債務有違約或遲延支付本息之事實，尚在繼續中者。 (二)最近三年或開業不及三年之開業年度課稅後之平均淨利，未達原定發行之公司債應負擔年息總額之百分之一百者。但經銀行保證發行之公司債不受限制。	該公司本次係辦理現金增資發行新股，故不適用左列規定。
十、公司法第二百六十九條 公司有下列情形之一者，不得公開發行具有優先權利之特別股： (一)最近三年或開業不及三年之開業年度課稅後之平均淨利，不足支付已發行及擬發行之特別股股息者。 (二)對於已發行之特別股約定股息，未能按期支付者。	該公司本次係辦理現金增資發行新股，故不適用左列規定。
十一、公司法第二百七十條 公司有下列情形之一者，不得公開發行新股： (一)最近連續二年有虧損者。但依其事業性質，須有較長準備期間或具有健全之營業計畫，確能改善營利能力者，不在此限。 (二)資產不足抵償債務者。	經查閱該公司最近兩年度經會計師查核簽證之財務報告，其稅後純益分別為 288,881 仟元及 628,653 仟元，並無連續二年虧損之情事；另經查閱該公司 103 年度經會計師查核簽證之財務報告，合併資產總額為 8,827,269 仟元，合併負債總額為 4,173,026 仟元，故無資產不足抵償債務之情事。

(二)發行人是否有證券交易法第一百五十六條第一項各款情事

經參閱該公司最近三年度及申報年度與主管機關之往來函文、董事會及股東會議事錄、重大訊息、經會計師查核簽證之財務報告、重要契約以及向票據交換所查詢之無退票記錄，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書及取具該公司所出具之聲明書，尚未發現該公司有發生證券交易法第一百五十六條第一項各款之情事，而有影響市場秩序或損害公益之虞者。詳細內容請參閱本評估報告「伍、本次募集與發行有價證券之適法性、二、(二)」之說明。

(三)發行人及其現任董事、監察人、持股比例達百分之十以上之大股東、負責人、總經理或實質負責人與從屬公司最近三個會計年度至刊印日止繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件

經參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書、該公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報告，並取得該公司及其現任董事、持股比例達百分

之十以上之大股東、負責人、總經理或實質負責人出具之上述事項聲明書，該公司及其現任董事、持股比例達百分之十以上之大股東、負責人、總經理或實質負責人最近三年度至本評估報告出具日止，並無繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件。惟該公司及法人董事暨大股東台積電目前尚有繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件，茲將該等事件及對財務業務之影響說明如下：

1. 公司部分

(1) 確認僱傭關係民事訴訟案

該公司作業員湯君因足部病痛，經勞工保險局100年8月16日保給傷字第10010173570號函認定為職業傷病，湯君主張其於復健治療期遭調動工作多次，並於101年11月30日經該公司終止其勞動契約並資遣，雖分別在101年10月12日及101年11月19日向桃園縣人力資源管理協會及桃園縣政府勞資爭議調解委員會申請勞資調解，然未達成共識，故湯君於102年1月11日向台灣桃園地方法院提起確認僱傭關係存在之民事訴訟，103年6月20日業經台灣桃園地方法院判決，該公司一審敗訴在案，該公司另於103年7月19日再提起第二審上訴，然經評估業於103年7月25日與湯君達成庭外和解，約定由湯君撤回訴訟，並於103年8月13日向台灣桃園地方法院遞狀撤回本訴訟案。依據和解書之約定該公司應分三次給付湯君和解金(共計2,139仟元)，截至本評估報告出具日止，該公司業已支付1,426仟元，尚餘713仟元亦將依約定付款，對該公司之財務業務並無重大不利影響。

(2) 返還價金民事訴訟案

A 利昌案

該公司為進行機台設備升級，於99年12月30日與利昌機電企業社(以下簡稱利昌)簽訂機器開發契約，並依契約約定於100年8月30日以採購單號2000010755委由利昌進行一批機台設備之升級工程，總價為7,875仟元(含稅)，該公司並於100年11月18日支付工程款50%之訂金共3,938仟元(含稅)予利昌，然因設備逾期未能開發完成，故該公司於102年3月22日寄發存證信函通知利昌解除契約並要求返還已付價款3,938仟元與利息，並於102年5月14日向台灣桃園地方法院提起返還價金之民事訴訟，本案業於103年2月13日經台灣桃園地方法院民事判決確定，該公司獲得勝訴，判決應由利昌返還之3,938仟元款項及按月認列預付設備款返還應加記之利息收入計271仟元。該公司已依強制執行法第27條聲請核發債權憑證，並止付應付利昌之設備款631仟元。截至103年度，因利昌及其負責人無資產及所得可供執行且經多次約訪負責人未果，該公司評估無法收回之可能性極高，故於103年度認列損失計3,578仟元。此案件對該公司之財務業務並無產生重大影響。

B. 鋒華案

該公司向鋒華科技(股)公司(以下簡稱鋒華)購買晶圓Tray盤翻轉機一批，總價為3,150仟元(含稅)，該公司已依採購訂單先給付總價80%

即 2,520 仟元(含稅)予鋒華，然因鋒華所交付晶圓 Tray 盤翻轉機並未符合採購訂單所定規格，致無法完成驗收，該公司要求限期改正，然鋒華仍逾期未改正，故該公司於 102 年 12 月 31 日通知鋒華以書面解除此採購訂單，並於 103 年 1 月 10 日向台灣桃園地方法院提起返還價金之民事訴訟，要求鋒華返還其已付價款與利息。截至目前為止，本案件由台灣桃園地方法院民事庭審理中，尚不致對該公司之財務業務產生重大影響。

C.一寶案

該公司向一寶科技(股)公司(以下簡稱一寶)採購 Lam 蝕刻機台，原已支付價金 10,105 仟元(未稅)，然一寶未達該公司所要求之特定蝕刻程度，且不斷要求展期致無法完成驗收，該公司遂於 103 年 2 月 19 日寄發存證信函要求其限期改善，然一寶拒絕該公司之要求，故該公司於 103 年 3 月 10 日再度寄發存證信函通知一寶解除此採購訂單，並於 103 年 3 月 31 日向台灣桃園地方法院提起返還價金之民事訴訟，要求一寶返還其已付價款與利息。一寶已於 103 年 7 月 3 日經台灣桃園地方法院判決敗訴，其另於 7 月 28 日提起二審上訴，然因未繳納裁判費，於 103 年 9 月 9 日經法院裁定予以駁回，一寶逾上訴期間已無法再上訴，本案已取得法院判決確定證明書並依法進行強制執行程序。該公司經評估扣除尚可回收金額 2,503 仟元並加計原機台配管資本支出 1,560 仟元後，於 103 年度認列其他營業損失 9,162 仟元，然此案件對該公司之財務業務並無產生重大影響。

(3)妨害秘密之刑事告訴案

該公司主張員工呂君於在職時將該公司建置生產線及設備規格等資料以電子郵件寄發至競爭對手之供應商，楊君等四人則涉嫌協助呂君或將該公司機密檔案寄至私人信箱，且前述五人先後於98年~99年間自該公司離職，並先後至競爭對手宏寶科技(股)公司任職，該公司遂主張呂君等五人違反保密條款，並有利用電腦洩露秘密罪嫌、背信罪嫌及無故取得電磁紀錄罪嫌，而於99年6月7日向台灣新竹地方法院檢察署提起刑事訴訟。呂君等五人雖承認利用電子郵件寄發檔案，然並未為自己及第三人圖任何不法利益，該公司舉證不足無法證明呂君等五人上開行為造成之損害，業於101年1月9日分別與前述五人達成和解，並撤回告訴，呂君及楊君之和解書中除為前述行為道歉外，並承諾若有違反保證事項除負擔民、刑事責任外，尚須給付該公司200萬之懲罰性違約金，其餘三名離職員工亦為前述行為道歉，且承諾應盡永久保密義務。因本案件已達成和解，對該公司財務業務尚無產生重大影響。

(4)非訟案

強友企業股份有限公司(以下簡稱強友)所提供之晶圓框架規格與品質未符合該公司要求，雙方經由多次開會及103年2月20日經桃園縣中壢市調解委員會調解後，協議該公司退還該等框架予強友，該公司並需支付該筆

訂單之50%貨款共計1,772仟元（含稅）（帳列雜項購置）予強友，該公司已於103年3月3日付訖，對該公司之財務業務並無重大影響。

綜上所述，經評估對該公司尚無重大之影響。

2.董事及持股百分之十以上大股東

經取具該公司董事及持股百分之十以上大股東之聲明書，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，僅法人董事台積電有繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，茲列示如下：

訴訟/非訟/行政爭訟事件	訴訟相對人	訴訟原因及過程
專利權侵害訴訟	Keranos	Keranos 於 99 年 6 月，在美國東德州地方法院對台積電、TSMC North America 以及數十家居於領先地位的科技公司，提出對三篇已過期的美國專利之專利權侵害訴訟。 99 年 11 月，台積電、TSMC North America 以及德州訴訟案件中的數家共同被告在美國北加州地方法院提出訴訟，要求判決該等公司並未侵害 Keranos 公司的專利權以及判決訴訟標的專利權為無效。 此兩訟案已於美國東德州地方法院併成一案處理。103 年 2 月，法院宣布有利於台積公司之判決，駁回 Keranos 提出之所有請求。103 年 3 月，Keranos 於美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴。
專利權侵害訴訟	Ziptronix	Ziptronix 於 99 年 12 月，在美國北加州地方法院對台積電、TSMC North America 以及另一公司，提出對若干美國專利之專利權侵害訴訟。103 年 9 月，法院作成有利於台積公司及 TSMC North America 之判決(Summary Judgment)。Ziptronix 公司可對上述法院判決提出上訴。
專利權侵害訴訟	Zond	Zond 於 102 年 9 月，於美國麻州地方法院對台積電、部分台積電子公司以及其他公司，提出對若干美國專利權之專利權侵害訴訟。法官於 103 年 6 月裁定暫停該案之訴訟審理。其後，台積電及 Zond 公司於美國德拉瓦州地方法院及美國麻州地方法院對 Zond 公司的若干其他美國專利各自提出訴訟。
專利權侵害訴訟及不當使用營業秘密及違反合約訴訟	Tela Innovations（簡稱 Tela）	Tela 於 102 年 12 月，於美國德拉瓦州地方法院及美國國際貿易委員會對台積電及 TSMC North America 提出對一篇美國專利之專利權侵害訴訟。台積電於 103 年 1 月於美國北加州地方法院對 Tela 提起不當使用台積電之營業秘密及違反合約之訴訟。雙方已於 103 年 9 月撤回上述美國德拉瓦州地方法院、美國國際貿易委員會及美國北加州地方法院之案件。
專利權侵害訴訟	DSS Technology Management, Inc.(簡稱 DSS)	DSS 於 103 年 3 月，於美國東德州地方法院對台積電、TSMC North America 及 TSMC Development 及若干其他公司提出對一篇美國專利之專利權侵害訴訟。

經評估前述繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件均因該公司法人董事本身業務所致，目前尚無因違反誠信原則而遭判決有期徒刑，且同時該等事件與該公司並無實質上或法律上之牽連關係，其審理程序及判決結果均不致影響該董事執行該公司董事之職務，故對該公司之營運應無重大不利影響。

(四)發行人或其現任董事、監察人、負責人、總經理或實質負責人最近三個會計年度至刊印日止是否經法院判決有期徒刑以上之罪者

經參閱該公司最近三年度及截至評估報告出具日止與主管機關之往來函文、會計師查核簽證之財務報告、股東會年報、重大訊息、董事會及股東會議事錄等資料，暨取得該公司及其現任董事、負責人、總經理或實質負責人出具之上述事項聲明書及翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，並未發現該公司或其現任董事、負責人、總經理或實質負責人最近三年度及截至評估報告出具日止有經法院判決有期徒刑以上之罪者。

(五)發行人及其各子公司目前仍有效存續、最近一個會計年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約及其他足以影響投資人權益之重要契約

經取得翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書及核閱該公司目前仍有效存續、最近一個會計年度到期之重要契約，其所載之權利義務內容及限制條款尚屬合理，對投資人權益應無重大不利之影響。

(六)發行人及其各子公司是否有重大勞資糾紛或污染環境事件

經核閱該公司收發文紀錄及函詢環保局與勞保局等主管機關，並參酌翰辰法律事務所邱雅文律師出具之法律意見書，該公司並無重大勞資糾紛或污染環境情事。

(七)發行人之資金用途須經目的事業主管機關同意者，其核准之附帶事項是否有影響本次募集與發行有價證券之情事

該公司本次所募集資金預計用途為償還銀行借款，無須經目的事業主管機關同意，故本評估項目不適用。

四之一、發行人委請填報其案件檢查表並出具法律意見書之律師，未具有下列情事

(一)於最近一年內曾受法務部律師懲戒委員會懲戒

(二)與發行人、最近期財務報告簽證會計師及主辦證券承銷商間具有下列關係之一：

- 1.依主管機關訂頒之各業別財務報告編製準則所規範之關係人關係。
- 2.其他法令規定或事實證明任何一方直接或間接控制他方之人事、財務或業務經營者。

本承銷商已取具該公司委請填報本次申報案件檢查表並出具法律意見書之翰辰法律事務所邱雅文律師依前載規定內容所出具之聲明書，皆已符合上述規定。

陸、就本次募集與發行有價證券計畫是否具有可行性、必要性及合理性蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

經依「中華民國證券商業同業公會證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」定辦理查核完竣，所獲結論如下：

一、本次募集與發行有價證券資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益之合理性

(一)本次募集與發行有價證券計畫內容

1.本次計畫所需資金總額：新台幣 1,140,000 仟元。

2.資金來源：

現金增資發行新股30,000仟股，每股面額10元，每股發行價格暫定為新台幣38元整，預計募集資金總額為1,140,000仟元。

3.計畫項目、預定資金運用進度

單位：新台幣仟元

計畫項目	預定完成日期	所需資金總額	預定資金運用進度
			104 年第一季
償還銀行借款	104 年第一季	1,140,000	1,140,000

資料來源：該公司提供

4.預計可能產生之效益

該公司辦理本次現金增資所募集1,140,000仟元係用以償還銀行借款，減少利息支出，以降低利息費用對獲利之侵蝕程度，並強化公司財務結構，改善償債能力。

若以該公司擬償還之銀行借款(1.2380%~1.5063%)設算，其104年度可節省11,322仟元，未來可節省之利息支出每年約為15,095仟元，進而提升該公司之自有資本比率，對該公司整體營運有正面之助益，並可提升市場競爭力。

5.本次募集之資金如有不足，其籌措方法及來源

本次現金增資之實際發行價格將於案件申報生效後，視市場變動狀況而調整。若實際發行價格低於暫定發行價格致募集金額較預定不足時，將減少償還銀行借款金額或自有資金因應；若實際發行價格高於暫定發行價格致募集金額較預定增加時，增加之金額則作為充實營運資金。

(二)本次募集與發行有價證券之可行性

1.本次募集資金法定程序上之可行性

該公司本次辦理現金增資發行新股重要內容，業經該公司於104年2月4日董事會決議通過，本次現金增資計畫相關之發行價格、發行條件及其他相關事宜，待本次現金增資案呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股相關事宜。經評估該計畫內容及決議程序符合「公司法」、「證券交易法」、「發行人募集與發行有價證券處理準則」及「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」等

相關法令之規定；另依據翰辰法律事務所邱雅文律師對本次辦理現金增資發行新股計畫出具法律意見書，顯示本次計畫內容未有違法法令致影響有價證券募集與發行之情事，故該公司本次辦理現金增資發行新股計畫，於法定程序上係屬可行。

2. 本次資金募集完成之可行性

該公司本次辦理現金增資預計發行普通股30,000仟股，每股面額新台幣10元，並暫定以每股新台幣38元整，預計募集總金額為新台幣1,140,000仟元，其中依公司法第267條之規定，保留15%計4,500仟股由員工認購，其餘25,500仟股則依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」之規定，以現金增資發行新股方式委託證券承銷商辦理上櫃前公開銷售。而員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購，而對外公開承銷認購不足部分，則依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理，故該公司本次現金增資計畫之募集完成應具可行性。

3. 本次資金運用計畫之可行性

本次現金增資發行新股所募得資金擬用以償還銀行借款，依該公司所提供預計清償明細資料，其合約內容均無不得提前清償或其他特殊限制條款，因此，擬於104年3月下旬資金募資完成後，即可依資金運用計畫償還相關借款，故藉由本次上櫃前之現金增資用以償還銀行借款，可減輕利息費用侵蝕獲利，並可提升資金靈活調度之彈性，對企業之經營及改善財務結構具有正面之助益，故本次現金增資發行新股之資金運用計畫應屬合理可行。

綜上所述，該公司本次辦理現金增資發行新股，就其法定程序、募集完成及運用計畫等方面應屬可行。

(三) 本次募集與發行有價證券之必要性評估

該公司本次辦理現金增資發行新股係依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」及「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款之規定，以現金增資發行新股方式委託證券承銷商辦理上櫃前公開銷售，故本次增資計畫得不適用有關募集資金計畫必要性之規定。

(四) 本次資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益之合理性

1. 本次資金運用計畫及預定進度之合理性

該公司本次辦理現金增資發行新股於申報生效後將採公開申購及詢價圈購辦理，經考量本次向主管機關申報、審查時間、公開承銷期間及繳款作業等因素，預計於104年3月下旬資金募集完成。該公司本次募集資金計劃用於償還銀行借款，由於本次計畫償還銀行借款並無不得提前清償或其他特殊限制條款，俟104年3月募足款項後，旋即執行償還銀行借款作業，故本次資金運用計畫及預定進度應屬合理。

2. 預計可能產生效益之合理性

(1) 節省利息支出，減輕財務負擔

該公司本次募資計畫預計償還銀行借款之明細如下：

單位：新台幣仟元

貸款機構	利率% (註 1)	契約期間	貸款用途	原貸款金額	104 年第一季 擬償還金額	104 年度 節省利息	以後年度 節省利息
遠東銀行	1.2380	100/6/7~105/6/7	營運週轉金	500,000	500,000	4,643	6,190
遠東銀行	1.2380	100/6/7~105/6/7	營運週轉金	100,000	100,000	929	1,238
遠東銀行	1.2380	100/6/7~105/6/7	營運週轉金	100,000	100,000	929	1,238
台北富邦銀行	1.5011	100/02~106/05	營運週轉金	300,000	120,000	1,351	1,801
台北富邦銀行	1.5063	100/02~106/05	營運週轉金	300,000	120,000	1,356	1,808
台北富邦銀行	1.4186	103/07~106/05	營運週轉金	100,000	100,000	1,064	1,419
台北富邦銀行	1.4006	103/07~106/05	營運週轉金	100,000	100,000	1,050	1,401
合 計				1,500,000	1,140,000	11,322	15,095

資料來源：該公司提供

註1：因利率為每月/每季議價，故此為預估金額。

該公司本次現金增資發行普通股籌募資金，用以償還銀行借款 1,140,000 仟元，預計 104 年 3 月下旬資金募集完成後用於償還借款，若以該公司擬償還之銀行借款(1.2380%~1.5063%)設算，其 104 年度可節省利息支出約 11,322 仟元，未來每年預計可節省之利息支出約為 15,095 仟元，可減輕該公司之財務負擔，避免侵蝕該公司之獲利，其預計產生之效益應屬合理。

(2) 改善財務結構，提升償債能力

單位：%

項目	103 年底	104 年 3 月底募資前	104 年 3 月底(募資後)
負債比率(%)	47.27	46.34	33.73

資料來源：該公司提供

藉由本次籌資用以償還銀行借款 1,140,000 仟元，該公司預計之負債比率將由 103 年底 47.27%降至籌資後 33.73%，足見本次現金增資用以償還銀行借款，將可降低該公司之負債比率及維持償債能力，有助於降低其營運風險，對該公司整體營運發展有所裨益，其預計產生之效益應屬合理。

綜上所述，該公司本次辦理現金增資發行新股，其資金運用計畫、預計進度及預計可能產生效益應具合理性。

二、分析比較各種資金調度來源對發行人當年度每股盈餘稀釋、財務負擔、股權之可能稀釋情形及對現有股東權益之影響。發行人如辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款規定之案件，得僅就發行新股對當年度每股盈餘稀釋情形進行評估

該公司本次係屬辦理「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六條第二項第二款規定辦理現金增資發行新股，並委託證券承銷商辦理初次上櫃前之公開銷售案件，故僅就發行新股對當年度每股盈餘稀釋情形進行評估。

該公司本次辦理現金增資發行新股，預計於 104 年 3 月下旬募足股款完成，其目前流通在外股數為 238,128 仟股，而本次擬發行 30,000 仟股，合計 268,128 仟股，股本膨脹比率為 12.60%。該公司本次辦理現金增資以償還銀行借款，除可減少銀行借款利息費用外，同時可降低其營運風險，加上該公司近年來營收規模及獲利均呈成長之趨勢，故本次現金增資計畫尚不致因股本膨脹而對股東權益產生重大不利之影響。

三、本次募集與發行有價證券資金計畫如用於轉投資、償債、充實營運資金、購買營建用地、支付營建工程款、購買未完工程並承受賣方未履行契約者，其必要性及合理性

該公司本次辦理現金增資，係用於償還銀行借款，茲就下列事項加以評估：

(一)查閱發行人最近一年度財務報告暨申報年度及預計未來一年度各月份之現金收支預測表，以了解該公司之營業特性、應收帳款收款、應付帳款付款政策、資本支出計畫與前揭現金收支預測表編制基礎之合理性及與財務預測之關聯性，並分析本次增資計畫對發行人資金需求狀況，資金不足時點與原因相關影響之必較性及合理性

該公司申報年度(104 年)及預計未來一年度(105 年)各月份之現金收支預測表，請詳次頁。

申報年度(104 年)各月分之現金收支預測表

單位：新台幣仟元

項目/月份	1 月份	2 月份	3 月份	4 月份	5 月份	6 月份	7 月份	8 月份	9 月份	10 月份	11 月份	12 月份	合計
期初現金餘額 1	806,445	887,112	953,090	906,470	843,383	844,773	804,234	827,552	791,723	779,843	875,632	867,082	806,445
加：非融資性收入 2													
應收帳款收現	437,248	595,000	461,765	449,139	483,415	445,902	449,051	463,945	410,868	412,867	416,697	427,597	5,453,494
其他	125,079	523	517	130,162	438	457	130,139	435	446	130,190	467	449	519,302
合計(2)	562,327	595,523	462,282	579,301	483,853	446,359	579,190	464,380	411,314	543,057	417,164	428,046	5,972,796
減：非融資性支出 3													
應付帳款付現	232,665	311,850	244,971	217,026	236,878	245,246	265,978	274,170	225,977	207,077	210,183	235,178	2,907,199
薪資付現	211,514	83,000	83,000	124,500	83,000	83,000	124,500	83,000	83,000	124,500	83,000	83,000	1,249,014
利息支出	2,900	3,052	1,748	1,692	1,860	1,952	2,177	2,177	2,437	2,437	2,381	2,472	27,285
不動產、廠房及設備	85,362	131,493	160,283	249,020	227,575	237,800	73,632	140,712	342,880	113,104	80,000	274,129	2,115,990
董事報酬及酬勞	150	150	150	150	150	150	2,550	150	150	150	150	150	4,200
所得稅繳稅	0	0	0	0	83,000	0	0	0	0	0	0	0	83,000
合計(3)	532,591	529,545	490,152	592,388	632,463	568,148	468,837	500,209	654,444	447,268	375,714	594,929	6,386,688
要求最低現金餘額 4	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
所需資金總額 5=3+4	1,032,591	1,029,545	990,152	1,092,388	1,132,463	1,068,148	968,837	1,000,209	1,154,444	947,268	875,714	1,094,929	6,886,688
融資前可供支用現金餘額 6=1+2-5	336,181	453,090	425,220	393,383	194,773	222,984	414,587	291,723	48,593	375,632	417,082	200,199	(107,447)
融資淨額 7													
發行新股	0	0	1,140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,000
借款-中期借款	100,000	0	0	0	150,000	100,000	250,000	0	250,000	50,000	0	100,000	1,000,000
償債-中期借款	(50,000)	0	(1,158,750)	(50,000)	0	(18,750)	(50,000)	0	(18,750)	(50,000)	(50,000)	(18,750)	(1,465,000)
支付股利	0	0	0	0	0	0	(287,035)	0	0	0	0	0	(287,035)
其他	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931
合計(7)	50,931	0	(18,750)	(50,000)	150,000	81,250	(87,035)	0	231,250	0	(50,000)	81,250	388,896
期末現金餘額 8=1+2-3+7	887,112	953,090	906,470	843,383	844,773	804,234	827,552	791,723	779,843	875,632	867,082	781,449	781,449

資料來源：該公司提供

申報次一年度(105 年)各月份之現金收支預測表

單位：新台幣仟元

項目/月份	1 月份	2 月份	3 月份	4 月份	5 月份	6 月份	7 月份	8 月份	9 月份	10 月份	11 月份	12 月份	合計
期初現金餘額 1	781,449	756,433	823,456	791,958	805,324	820,501	831,395	854,603	890,472	819,035	850,713	874,116	781,449
加：非融資性收入 2													
應收帳款收現	417,414	453,151	405,583	391,469	427,068	485,107	488,378	504,847	489,722	492,798	496,776	433,096	5,485,409
其他	130,116	423	521	130,169	510	526	130,083	420	538	130,215	538	602	524,661
合計(2)	547,530	453,574	406,104	521,638	427,578	485,633	618,461	505,267	490,260	623,013	497,314	433,698	6,010,070
減：非融資性支出 3													
應付帳款付現	229,578	249,233	223,070	215,308	234,887	266,809	268,608	277,666	269,347	271,039	273,227	238,203	3,016,975
薪資付現	249,000	83,000	83,000	124,500	83,000	83,000	124,500	83,000	83,000	124,500	83,000	83,000	1,286,500
利息支出	2,416	2,416	2,282	2,114	2,114	1,980	1,945	1,832	1,600	1,396	1,284	1,052	22,431
不動產、廠房及設備	41,402	51,752	10,350	16,200	20,250	4,050	5,400	6,750	1,350	13,000	16,250	3,250	190,004
董事報酬及酬勞	150	150	150	150	150	150	2,550	150	150	150	150	150	4,200
所得稅繳稅	0	0	0	0	72,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000
合計(3)	522,546	386,551	318,852	358,272	412,401	355,989	403,003	369,398	355,447	410,085	373,911	325,655	4,592,110
要求最低現金餘額 4	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
所需資金總額 5=3+4	1,022,546	886,551	818,852	858,272	912,401	855,989	903,003	869,398	855,447	910,085	873,911	825,655	5,092,110
融資前可供支用現金餘額 6=1+2-5	306,433	323,456	410,708	455,324	320,501	450,145	546,853	490,472	525,285	531,963	474,116	482,159	1,699,409
融資淨額 7													
償債-中期借款	(50,000)	0	(118,750)	(150,000)	0	(118,750)	(31,250)	(100,000)	(206,250)	(181,250)	(100,000)	(206,250)	(1,262,500)
支付股利	0	0	0	0	0	0	(161,000)	0	0	0	0	0	(161,000)
合計(7)	(50,000)	0	(118,750)	(150,000)	0	(118,750)	(192,250)	(100,000)	(206,250)	(181,250)	(100,000)	(206,250)	(1,423,500)
期末現金餘額 8=1+2-3+7	756,433	823,456	791,958	805,324	820,501	831,395	854,603	890,472	819,035	850,713	874,116	775,909	775,909

資料來源：該公司提供

1.營業特性

該公司為專業3D晶圓級IC 封裝之領導者，主要從事光學感測元件之晶圓級封裝服務，以及應用於其他感測器及汽車電子相關之晶圓級後護層封裝服務。該公司主要現金收入係銷貨之應收帳款收現，主要現金支出則為購置機器設備之應付設備款付現與進貨之應付帳款付現。其所編製之104年度及105年度現金收支預測表，係以歷史經驗與該公司之營業特性、收款及付款情形、產業未來發展趨勢及市場淡旺季等推估，亦考量該公司對104年度營運成長之資金需求、資本支出及盈餘分派等情形編製而成，故其編製申報年度及預計未來一年度各月份之現金收支預測表之編製基礎尚屬合理。

2.應收帳款收款及應付帳款付款政策

應收帳款收款政策方面，該公司主要客戶為晶圓代工大廠、影像感測器IC設計大廠、環境感測器IC設計公司、電源管理元件IC設計大廠、印表機噴墨頭IC設計公司等，預計帳款逾期之風險較低，考量個別客戶營運規模、財務狀況、信用紀錄及過去往來交易情形，給予不同授信條件，一般收款條件在月結30~60天間。該公司101年度至103年度之應收款項收現天數介於50~63天，實際收款天數尚落於授信期間內；而該公司104年度及105年度編製之現金收支預測表預估應收款項收現天數即以過去實際營運情形，並考量未來不同客戶之收款條件及銷售產品組合變化因素為編製基礎，故104年度及105年度各月份現金收支應收款項收現之編製基礎尚屬合理。

該公司應付款項主要係封裝所需原物料所產生之貨款，對於進貨供應商之應付款項付款條件係依據供應商信用情形、公司資金調度狀況及參酌市場行情等因素進行調整，其付款條件大致為30天~60天，其與實際付款天數與付款條件相較並無明顯差異。該公司所編製104年度及105年度之現金收支預測表，尚落於該公司之付款條件30天~60天之區間內，故其編製基礎應尚具合理性。

3.資本支出計畫

104年2月~12月及105年度預計增加之資本支出為2,030,628仟元及190,004仟元，主要包括12吋晶圓級尺寸封裝生產線、8吋晶圓級尺寸封裝及後護層封裝生產線之製程改善、研究發展設備及自動化、提升良率或生產力之年度經常性資本支出，其編製之假設基礎應尚屬合理。

4.現金收支預測表編製基礎之合理性及與財務預測之關聯性

該公司104年度及105年度各月份現金收支預測表，104年1月份各項金額係以實際發生數額予以編製，104年2月~12月份及105年度則以可能之營運狀況作合理假設予以編製。另核閱該公司104年之期初現金餘額與103年底經會計師查核簽證之財務報告之現金餘額一致，整體而言，該公司申報年度及預計未來一年度各月份之現金收支預測表編製基礎尚屬合理。

另該公司並未對外公布財務預測，故不適用現金收支與財務預測關聯性之評估。

5.對發行人資金需求狀況、資金不足時點與原因相關影響之必要性與合理性

該公司104年1月底帳上自有資金為887,112仟元，與104年2月至3月之非融資性收入1,057,805仟元合計為1,944,917仟元，非融資性支出為1,019,697仟元，考量要求最低現金餘額500,000仟元及本次預計償還銀行借款1,158,750仟元，將出現資金缺口，可見該公司對銀行借款有一定依存度，且以該公司最近三年度之負債比率觀之，該公司之負債比率已由36.40%增加至47.27%，顯示該公司之財務風險逐年提升，為維持該公司之長期競爭力，故該公司本次透過辦理現金增資募集資金，並預計於104年3月下旬資金到位後，將募得之資金全數用以償還銀行借款，以因應營運成長之需及預留資金運用之彈性，應屬合理且必要。

6.未來重大資本支出及長期投資合計之金額達本次募資金額百分之六十者，其資金來源、用途及預計效益

就該公司編制之104及105年度現金收支預測表顯示，其固定資產於未來(104年2月~105年度)預計分別增加2,030,628仟元及190,004仟元，兩者合計為2,220,632仟元，達本次募資金額1,140,000仟元之194.79%。104年度資本支出包括12吋晶圓級尺寸封裝生產線，以及8吋晶圓級尺寸封裝與後護層封裝生產線之製程改善、研究發展設備及自動化、提升良率或生產力之年度經常性資本支出。該公司於3月底以現金增資款項11.4億元償還銀行借款後，4~12月尚有資本支出1,738,852仟元，將透過自有資金或銀行借款支應，其中，12吋晶圓尺寸封裝生產線之資本支出，因目前該公司已與亞洲及歐美等潛在影像感測器客戶進行12吋晶圓級尺寸封裝業務開發，預計建置此12吋晶圓級尺寸封裝生產線將可供應影像感測器客戶之封裝需求，且隨12吋晶圓級尺寸封裝生產線良率提升、經濟規模效益逐漸顯現後，12吋晶圓級尺寸封裝生產線將可望挹助該公司相當營收及獲利。105年資本支出預計為新台幣190,004仟元，主要係製程改善、提升良率或生產力之年度經常性資本支出，將透過自有資金或銀行借款支應，並無重大不合理。

(二)就發行人申報年度財務槓桿、負債比率(或自有資產與風險性資產比率)、營業收入、獲利能力及每股盈餘稀釋等相關影響，了解本次增資計畫之必要性及合理性

1.財務槓桿及負債比率單位：

單位：新台幣仟元；%

項目 \ 年度	101 年度	102 年度	103 年度
財務槓桿度(倍)	0.88	1.08	1.05
負債比率(%)	36.40	50.79	47.27

資料來源：該公司提供

財務槓桿度係衡量公司舉債經營之財務風險指標，評估利息費用變動對營業利益之影響程度，數值愈高，代表所承擔之風險愈大，該公司最近三年

度財務槓桿度分別為0.88倍、1.08倍及1.05倍，102年起已超過1倍，預計本次辦理現金增資用以償還銀行借款後，可節省利息支出，降低利息費用對獲利能力之侵蝕，財務槓桿度應會下降，同時負債比率亦將降低，減輕舉債經營帶來之財務風險，對該公司財務結構及償債能力具有正面之效益，故本次籌資計畫有其必要性及合理性。

2.營業收入及獲利能力

該公司本次募集資金償還銀行借款後，除可降低經營風險外，亦可提升資金調度能力，對該公司拓展營運規模所需之營運資金有極大助益，故該公司本次現金增資發行新股將有助於該公司未來年度營收成長，且本次募集資金償還銀行借款後，可降低銀行借款之利息支出對該公司獲利能力之侵蝕，故本次籌資計畫有其必要性及合理性。

3.每股盈餘稀釋

該公司本次擬發行 30,000仟股，股本稀釋比率為12.60%，考量該公司近年來營收規模及獲利均呈成長之趨勢，本次增資計畫對103年度每股盈餘稀釋之影響應屬有限。

綜上所述，該公司本次辦理現金增資募集資金計畫用以償還銀行借款，對整體營運發展、健全財務結構及強化償債能力均具正面助益，且對每股盈餘亦無重大稀釋之影響，顯見該公司本次計畫將所募集之資金用以償還銀行借款，應有其合理性。

(三)本次增資計畫如用於償債者，取得該公司償債之相關明細，以了解原借款用途之必要性、合理性及顯現之效益。

該公司本次籌資預計用於償還之銀行借款共計 1,140,000仟元，原借款用途主要為營運週轉之用，主係因最近三年度營運穩定成長，故用以支付貨款、營業費用等營運週轉需求支出。該公司受惠於智慧行動裝置需求增加，帶動整體半導體產業成長，其業績跟著上揚，除光學元件封裝服務訂單仍維持一定水準外，因應行動裝置對於個人隱私的保護需求，指紋辨識感測器之市場需求大幅增加，該公司於102年下半年成功導入該項封裝產品之驗證且進入量產，對於102年度及103年度之營收與獲利均有顯著之貢獻，可見該公司舉借之銀行營運週轉金確實替該公司帶來正面效益。

單位：新台幣仟元

年度 項目	101年度	102年度	103年度
營業收入淨額	3,139,385	4,256,761	4,934,078

資料來源：經會計師查核簽證之財務報告。

四、本次增資計畫如非以現金出資時，其出資金額之合理性及取得資產之必要性

該公司本次增資計畫係以現金增資發行新股，故不適用本項評估。

五、本次增資計畫如併同減資計畫辦理者，應就下列事項評估其可行性與合理性

該公司本次增資計畫未併同減資計畫辦理，故不適用本項評估。

六、以低於票面金額辦理現金發行新股者，應評估未採用其他籌資方式之原因及其合理性、發行價格訂定方式及對股東權益之影響

該公司本次辦理現金增資發行新股，並無以低於票面金額辦理發行，故不適用本項評估。

七、發行人向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報募集與發行有價證券，發行辦法依規定採彈性訂定方式之評估事項

(一)已上市(櫃)公司辦理現金增資發行普通股原股東未放棄優先認股，採公開申購配售方式辦理承銷者，應載明暫定發行價格及因市場變動實際發行價格須依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，及其適法性及合理性

該公司本次係辦理現金增資發行新股申請股票初次上櫃案件，故不適用本項評估。

(二)已上市(櫃)公司辦理現金增資，經股東會已決議原股東全數放棄優先認購，採全數詢價圈購或競價拍賣方式辦理承銷者，應載明暫定發行價格、股數區間及因市場變動實際發行須依「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第七條第一項規定調整，並敘明募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，及其適法性及合理性，及暫定發行股數區間是否符合公司法第二百七十八條規定之情事

該公司本次係辦理現金增資發行新股申請股票初次上櫃案件，故不適用本項評估。

(三)以現金增資發行普通股申請初次上市(櫃)案件向金管會申報(請)案件時應以合理之方式訂定暫定價格，並敘明實際發行價格如有變動，導致募集資金不足時之處理或募集資金增加時之資金用途及預計效益，其適法性及合理性

1.暫定價格之訂定

本推薦證券商採一般市場承銷價格訂定方式，參考市場基準法、成本法及收益基礎法等股價評價方法及該公司最近一個月之興櫃市場平均成交價，再參酌該公司所處產業、經營績效、競爭利基、發行市場環境及同業之市場狀況等因素，以推算其合理之承銷價格，再與該公司共同議定，暫定承銷價格為每股新台幣38元整。實際每股發行價格待主管機關核准後，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，參酌市場行情及該公司之整體營運及財務狀況，透過辦理詢價圈購之承銷作業後，由本推薦證券商與該公司共同議定最後實際發行價格。

2.募集資金不足時之處理

若該公司於本案件生效後，現金增資實際發行時如因詢價圈購結果之最後訂價變動，使得每股實際發行價格低於暫定承銷價格時，其資金募集不足部份，則該公司擬減少償還銀行借款或自有資金支應。

3.募集資金增加時之資金用途、預計效益，及其適法性與合理性

若本次現金增資實際發行時如因詢價圈購結果之最後訂價變動，使得每股實際發行價格高於暫定承銷價格時，該公司擬將高於原預定募集總金額之資金用於充實營運資金，將可保留資金之靈活運用。

(四)公司債未足額發行者，需就募集資金不足時之處理方式之合理性予以說明

該公司本次係辦理現金增資發行新股申請股票初次上櫃案件，故不適用本項評估。

八、就發行人申報發行人人民幣債券者，應審慎評估到期償債資金來源計畫之可行性、必要性及合理性(至少應包括到期還款之來源及如何取得人民幣資金等)

該公司本次係辦理現金增資發行新股，並非人民幣債券，故不適用本項評估。

柒、就本次附認股權特別股、分離型附認股權特別股分離後之特別股及認股權憑證發行及認股辦法之合理性及對原股東及附認股權特別股持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理現金增資發行新股，故不適用本項評估。

捌、就本次公司債發行（及轉換）辦法之下列各款之合理性及對原股東及轉換公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理現金增資發行新股，故不適用本項評估。

玖、就本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債分離後之公司債及認股權憑證發行及認股辦法之下列各款之合理性及對原股東及附認股權公司債持有者權益之影響蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理現金增資發行新股，故不適用本項評估。

拾、就本次發行公司債債權確保情形（列明有無擔保、擔保品種類與價值等）蒐集資料，說明其查核程序及其實際情形，如為經信用評等機構評等者，取得其相關項目及評等結果

該公司本次係辦理現金增資發行新股，故不適用本項評估。

拾壹、就本次轉換公司債設算理論價值之下列各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理現金增資發行新股，故不適用本項評估。

拾貳、就本次附認股權公司債、分離型附認股權公司債設算理論價值之下列各款因素蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

該公司本次係辦理現金增資發行新股，故不適用本項評估。

拾參、就發行人其他必要補充說明事項蒐集資料，說明其查核程序及所獲致結論

無。

推薦證券商：凱基證券股份有限公司



負責人簽章：許道義



(僅限於精材科技股份有限公司辦理104年度上櫃前現金增資發行新股承銷商評估報告用)

中 華 民 國 一 〇 四 年 二 月 六 日

精材科技股份有限公司

承銷價格計算書

一、承銷總股數說明

(一)承銷前後流通在外總股數

精材科技股份有限公司(以下簡稱「精材」或「該公司」)申請上櫃時之實收資本額為新台幣(以下同) 2,380,508 仟元，每股面額新台幣 10 元整，已發行股數為 238,051 仟股。另該公司於申請上櫃後至股票掛牌前，因已執行員工認股權憑證而新增之股數為 236 仟股，故預計該公司於辦理股票公開承銷前已發行股數為 238,287 仟股。該公司擬於股票初次申請上櫃經主管機關審查通過後，預計辦理現金增資發行新股 30,000 仟股作為股票公開承銷作業之用，預計股票上櫃掛牌時之實收資本額為 2,682,869 仟元，發行股數為 268,287 仟股。

(二)承銷股數來源

該公司本次申請股票上櫃，爰依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第四條之規定，採用現金增資發行新股辦理上櫃前公開承銷，另依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對公開發行公司申請股票櫃檯買賣應委託推薦證券商辦理承銷規定」第二條之規定，應至少提出擬上櫃股份總額 10% 委託推薦證券商辦理承銷，但依該比率計算之承銷股數如超過一千萬股以上者，以不低於一千萬股之股數辦理承銷。該公司依擬上櫃股份總額之 10% 計算應提出公開承銷股數已超過一千萬股，且將預計以現金增資發行新股 30,000 仟股，並依公司法第 267 條之規定，保留發行股份之 15%，計 4,500 仟股予員工認購外，其餘 25,500 仟股則依證券交易法第 28 條之規定排除公司法第 267 條第 3 項原股東優先認購之適用，全數辦理上櫃前公開承銷。

(三)過額配售

該公司爰依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則」第四條及「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」第二點之規定，經 103 年 8 月 7 日董事會通過授權董事長與推薦證券商簽訂「過額配售協議書」，協議提出委託推薦證券商辦理公開承銷股數之 15% 為上限，計不高於 3,825 仟股供主辦承銷商辦理過額配售之用，惟主辦承銷商得依市場需求決定過額配售數量。

(四)股權分散情形

該公司截至 103 年 9 月 30 日止，該公司內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東人數為 6,898 人，其所持有股份合計 95,650 仟股，占已發行總股數 238,051 仟股之 40.18%，業已符合股票上櫃之股權分散標準。

二、申請公司與推薦證券商共同訂定承銷價格之依據及方式

(一)承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式

股價評估之方法有很多種，各有其優劣，評估的結果亦有所差異，茲將目前市場上常用的股價評價方式分述如下：

1. 市場基礎法

市場基礎法主要係與上市、櫃公司中產業性質相近的同業，透過已公開資訊與被評價公司歷史軌跡比較，作為評價企業的價值。市場上運用市價計算股價之方法，主要為本益比法及股價淨值比法。本益比法及股價淨值比法係依據該公司之財務資料，計算每股盈餘及每股淨值，比較同業公司平均本益比及股價淨值比估算股價，再參考同業之市場價格及流動性、知名度、公司規模等等進行折溢價調整，因其乃以同業已公開之市場資訊作為基礎，客觀易懂又能貼近市場價值，是目前市場上最常用亦最為投資人接受之價格評定方式。

2. 成本法

成本法近似重置成本的理論，所謂重置成本法，本指企業如要重置或重購相似資產所需花費之數額。以重置成本來估計資產之價值，即是以企業重置或重購相同獲利能力之資產所需花費之成本數額來估計其價值，且必須有相似且合理之資產價格可供參考，另外使用成本法的限制有下列四種：

- (1)無法表達目前真正及外來的經濟貢獻值。
- (2)忽略了技術經濟壽年。
- (3)技術廢舊及變革對於其所造成的風險無法預測。
- (4)成本法中對於折舊項目及金額有量化的困難。

由於上述種種限制，故國際上採成本法評估企業價值者並不多見，因此本推薦證券商不擬採用此種方式作為承銷價格訂定之參考依據。

3. 收益基礎法

收益基礎法係根據該公司未來預估之獲利及現金流量，以涵蓋風險的折現率來折算現金流量，同時考慮實質現金及貨幣之時間價值。

茲就各種評價方法之優點、缺點及適用時機彙總說明如下：

項目	本益比法	股價淨值比法	成本法	收益基礎法
計算方式	依據公司之財務資料，計算每股帳面盈餘，並以上市櫃公司或產業性質相近的同業平均本益比估算股價，最後再調整溢價和折價以反應與類似公司不同之處。	依據公司之財務資料，計算每股帳面淨值，比較上市櫃公司或產業性質相近的同業平均股價淨值比估算股價，最後再調整溢價和折價以反應與類似公司不同之處。	以帳面之歷史成本資料為公司價值評定之基礎，即以資產負債表帳面資產總額減去帳面負債總額，並考量資產及負債之市場價格而進行帳面價值之調整。	根據公司預估之獲利及現金流量，以涵蓋風險的折現率來折算現金流量，同時考慮實質現金及貨幣之時間價值。
優點	1.具經濟效益與時效性，為一般投資人投資股票最常用之參考依據。 2.市場價格資料較易取得。	1.淨值係長期且穩定之指標，盈餘為負時之另一種評估選擇。 2.市場價格資料容易取得。	1.資料取得容易。 2.使用財務報表之資料，較客觀公正。	1.符合學理上對價值的推論，能依不同變數預期來評價公司。 2.較不受會計原則或會計政策不同影響，且可反應企業之永續經營價值。 3.考量企業之成長性及風險。
缺點	1.盈餘品質易受會計方法之選擇而受影響。 2.企業每股盈餘為負值或接近於零時不適用。 3.使用歷史性財務資訊，無法反應公司未來之績效。	1.帳面價值易受會計方法之選擇而受影響。 2.使用歷史性財務資訊，無法反應公司未來之績效。	1.資產帳面價值與市場價值差距甚大。 2.未考量公司經營成效之優劣。	1.程式繁瑣，需估計大量變數，花費成本大且不確定性高。 2.投資者不易瞭解現金流量觀念。
適用時機	評估風險水準、股利政策及成長率穩定的公司。	評估產業具有獲利波動幅度大之特性的公司。	評估如公營事業或傳統產業類股。	1.可取得公司詳細的現金流量與資金成本的預測資訊時。 2.企業經營穩定，無鉅額資本支出。

該公司為專業 3D 晶圓級 IC 封裝之領導者，主要業務為提供影像感測器、環境感測器等之晶圓級尺寸封裝，其指紋辨識感測器、微機電及電源控制元件之晶圓級後護層封裝服務技術已臻成熟，並深獲客戶肯定，故該公司近年來的營業收入呈現成長之勢，獲利表現亦屬良好，因此，在股價的評價上較不適用以評估資產投資金額較高的公司常用的股價淨值比法，或用於評估如傳統產業類股或公營事業之成本法；而收益基礎法對於公司未來數年的盈餘及現金流量均屬估算價格時必備之基礎，然因預測期間長，不僅困難度相對較高，且資料未必十分準確，較無法合理評估公司應有的價值；由於目前台灣市場上投資人對於獲利型、成長型或股利發放穩定的公司訂價多以每股盈餘為評價基礎，其最大優點在於簡單易懂，而且台灣市場

投資人的認同度較高，因而廣為獲利型、成長型或股利發放穩定之公司所採用，故擬採用市場基礎法作為承銷價格訂定所採用的方法應屬較佳之評價模式。

(二)承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式及與適用國際慣用之市價法、成本法及收益基礎法之比較。

股價評估之方法有很多種，各有其優劣，評估的結果亦有所差異，目前市場上常用的股價評價方式包括市價法之本益比法與股價淨值比法、成本法之帳面價值法及收益基礎法等。

1.市場基礎法

該公司為專業晶圓級IC封裝之領導廠商，主要服務包括晶圓級尺寸封裝服務與晶圓級後護層封裝服務，晶圓級尺寸封裝主要應用於影像感測器及環境感測器等光學感測元件，晶圓級後護層封裝服務主要應用於功率分離式元件、微機電系統感測器元件、指紋辨識感測器元件和整合式被動元件等。綜觀目前國內上市櫃及興櫃公司，封裝技術及產品組合並無與該公司完全相同者，故以同為半導體封裝及測試產業及部分產品應用端相同作為取樣之依據：上市公司日月光主要係從事各型積體電路之製造、組合、加工、測試及外銷，亦有封裝影像感測器模組及指紋辨識感測器模組與該公司產品應用端相同；上市公司同欣主要係從事高頻無線通訊模組、混合積體電路模組、陶瓷電路板及影像產品等電子產品生產及銷售，亦有影像感測器封裝與該公司產品應用端相同；上市公司菱生主要係從事各積體電路及各種半導體零組件之封裝加工、測試、製造及買賣，亦有用於手機或行動裝置之環境光學感測器模組封裝測試與該公司產品應用端相同。在綜合考量比較上述公司之產品營收比重、業務內容、實收資本額及資產規模等，選取日月光(2311)、同欣(6271)及菱生(2369)為採樣同業，茲彙整該公司採樣同業之本益比如下：

(1)本益比法

月份/公司	日月光	同欣	菱生	上市 半導體業	上櫃 半導體業
103年12月	14.01	11.19	21.47	15.18	23.23
104年01月	14.67	11.81	22.94	15.29	23.34
104年02月	15.55	12.42	22.21	14.45	23.60
平均本益比	14.74	11.81	22.21	14.97	23.39

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及臺灣證券交易所網站

由上表得知，該公司之採樣同業、上市櫃半導體業最近三個月之平均本益比在11.81倍～23.39倍之間，若以該公司103年度之每股盈餘2.65元為計算基礎，按上述平均本益比區間計算其參考價格，價格約在31.30元～61.98元之間。

(2)股價淨值比法

月份/公司	日月光	同欣	菱生	上市 半導體業	上櫃 半導體業
103 年 12 月	2.23	1.84	0.86	2.88	2.49
104 年 01 月	2.34	1.94	0.92	2.91	2.50
104 年 02 月	2.48	1.97	0.89	2.89	2.53
平均股價淨值比	2.35	1.92	0.89	2.89	2.51

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及臺灣證券交易所網站

由上表得知，該公司之採樣同業、上市櫃半導體業最近三個月之平均股價淨值比在 0.89 倍～2.89 倍之間，若依據該公司 103 年度經會計師查核簽證之每股淨值為 19.55 元，按上述平均股價淨值比區間計算其參考價格，價格約在 17.40 元～56.50 元之間。

2.成本法(帳面價值法)

成本法係為帳面價值法（Book Value Method），帳面價值乃是投資人對公司請求權價值之總和，包含債權人、普通股投資人及特別股投資人等，其中股票投資者對公司之請求權價值係公司資產總額扣除負債總額之淨資產價值。此種評價方式係以歷史成本為計算之依據，將忽略通貨膨脹因素且無法表達資產實際經濟價值，並深受財務報表採行之會計原則與方法影響，將可能低估成長型公司之企業價值，因此國際上以成本法評價初次上市（櫃）公司之企業價值者不多見。該公司 103 年度經會計師查核簽證之每股淨值約為 19.55 元，遠低於該公司 103 年 12 月～104 年 2 月興櫃市場各月平均價格 43.80 元～49.73 元，係因未能考量該公司實質企業價值，故本推薦證券商不擬採用此種評價方法。

3.收益基礎法

收益基礎法係根據公司預估之獲利及現金流量，以涵蓋風險的折現率來折算現金流量，同時考慮實質現金及貨幣之時間價值來進行估算，但考量現金流量折現法預測期間長，不僅困難度相對較高且資料未必十分準確，推薦證券商認為較不能合理評估公司應有之價值，又加以投資者不易瞭解現金流量觀念，故不擬採用本法為議定之承銷價格參考依據。

綜上所述，考量精材所處之產業應屬於營收獲利穩定之公司，並不適宜以成本法評價，而收益基礎法由於該方法需估計未來數年的營收獲利成長及現金流量、投資率等，估計參數不僅有其困難度，更難以佐證估計其正確性，以做合理之判斷。本推薦證券商能計算合理、客觀及具市場性之承銷價格，乃以市場基礎法中之本益比法作為精材上櫃申請之承銷價格計算依據。由於本益比法已考量該公司之獲利能力，暨市場對同業的認同度標準，應已具有市場性。

(三)申請公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形

1. 財務狀況

分析項目		年度	101 年度	102 年度	103 年度
		公司			
財務結構 (%)	負債佔資產比率	精 材	36.40	50.79	47.27
		日 月 光	55.21	55.66	52.56
		同 欣	15.89	19.89	35.69
		菱 生	24.14	24.88	註
	長期資金佔不動產、廠房及設備比率	精 材	117.30	100.45	107.21
		日 月 光	128.18	141.43	146.96
		同 欣	187.04	200.69	283.45
		菱 生	164.08	141.32	註

資料來源：各公司經會計師查核簽證之財務報告

註：尚未公告 103 年度財務報告。

該公司 101~103 年度負債占資產比率分別為 36.40%、50.79%及 47.27%，101 年度因銀行長期借款陸續償還及設備款陸續支付，使負債占資產比率較低；102 年度為因應指紋辨識感測器封裝訂單之需求，增加長期借款以支應購置相關設備之資本支出，致應付設備款及長期借款大幅增加，另因收取終端客戶補償未來訂單風險之產能保證金(帳列存入保證金)，致 102 年底之負債較 101 年底之成長幅度高於資產成長幅度，造成負債比率由 101 年度之 36.40%上升至 50.79%；103 年雖該公司於 6 月底已返還全數產能保證金，惟因建置 12 吋影像感測器生產線，增加銀行借款以支應購置相關設備之資本支出，致負債比率僅較 102 年度微幅下降。與採樣同業相較，該公司 101~103 年度之負債佔資產比率均介於採樣同業之間，尚無重大異常之情事。

該公司 101~103 年度之長期資金佔不動產、廠房及設備比率分別為 117.30%、100.45%及 107.21%，102 年度為因應指紋辨識感測器封裝訂單而購置機器設備，致該公司之固定資產淨額較 101 年度增加，幅度高達 35.32%，以致長期資金佔不動產、廠房及設備比率下降至 100.45%；103 年因營運所需增加銀行長期借款，使非流動負債較 102 年度增加 24.52%，致長期資金佔不動產、廠房及設備比率上升至 107.21%。與採樣同業相較，該公司 101~103 年度之長期資金占不動產、廠房及設備比率均低於採樣同業，惟該公司最近三年度長期資金占不動產、廠房及設備比率皆大於 100%，尚無以短期資金支應固定資產支出之情事，顯示該公司整體財務結構尚屬健全。

綜上所述，該公司最近三年度之財務狀況各項比率尚屬健全，且變動情形尚屬合理，與採樣同業相較亦無重大異常情事。

2. 獲利情形

分 析 項 目		年度	101 年度	102 年度	103 年度
		公司			
獲利能力(%)	權益報酬率	精 材	(2.32)	7.27	14.34
		日 月 光	12.76	13.57	16.96
		同 欣	15.73	17.35	15.46
		菱 生	6.09	5.43	註
	營業利益占實收資本額比率	精 材	(4.07)	16.10	28.37
		日 月 光	23.26	28.20	37.57
		同 欣	90.18	109.14	105.27
		菱 生	11.14	9.81	註
	稅前純益占實收資本額比率	精 材	(4.56)	14.75	27.71
		日 月 光	21.81	24.76	36.17
		同 欣	90.95	114.42	110.49
		菱 生	12.05	11.19	註
	純益率	精 材	(2.87)	6.79	12.74
		日 月 光	6.97	7.35	9.44
		同 欣	18.80	19.97	18.12
		菱 生	6.04	5.81	註
	每股稅後盈餘(元)	精 材	(0.38)	1.22	2.65
		日 月 光	1.75	2.09	3.07
		同 欣	8.09	9.72	9.27
		菱 生	1.01	0.97	註

資料來源：各公司經會計師查核簽證之財務報告

註：尚未公告 103 年度財務報告。

該公司 101~103 年度權益報酬率則分別為(2.32)%、7.27%及 14.34%，營業利益占實收資本額之比率分別為(4.07)%、16.10%及 28.37%，稅前利益占實收資本額之比率分別為(4.56)%、14.75%及 27.71%，純益率分別為(2.87)%、6.79%及 12.74%，每股盈餘則分別為(0.38)元、1.22 元及 2.65 元。101 年度因半導體市場需求趨緩，銷貨客戶對備貨態度相對謹慎，營收規模減少，致該公司轉為虧損，各項指標呈負值；102 年度因影像感測器及指紋辨識感測器封裝需求增加，帶動營收成長動能，致權益報酬率、營業利益占實收資本額之比率、稅前利益占實收資本額之比率、純益率及每股盈餘均較 101 年度上升；103 年度因訂單熱度不減，致前述各項指標與 102 年度相較呈大幅成長趨勢。與採樣同業相較，該公司 101 年度之權益報酬率、營業利益占實收資本額之比率、稅前利益占實收資本額之比率、純益率及每股盈餘遜於採樣同業，102 年度及 103 年度多已介於採樣同業之間。

綜上分析，該公司 101~103 年度獲利能力各項指標之變化，並無重大異常之情形。

3.本益比

依據上述市場基礎法中本益比法之評估說明，該公司之採樣同業、上市櫃半導體業最近三個月之平均本益比在 11.81 倍~23.39 倍之間，本推薦證券商與該公司此次議定承銷價格每股新台幣 42 元，若以該公司 103 年度每股盈餘 2.65 元為計算基礎，其本益比為 15.85 倍，落於採樣同業本益比之區間內，尚無重大異常之情事。

(四)所議定之承銷價若參考財務專家意見或鑑價機構之鑑價報告者，應說明該專家意見或鑑價報告內容及結論

本推薦證券商與該公司共同議定股票公開承銷價格並未委請財務專家出具意見或委託鑑定機構出具鑑價報告，故不適用。

(五)發行公司於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價及成交量資料

月份/項目	成交數量(股)	平均股價(元)
104 年 2 月 24 日~104 年 3 月 20 日	47,197,698	54.96

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心興櫃交易資訊

(六)推薦證券商就其與發行公司所共同議定承銷價格合理性之評估意見

本推薦證券商依一般市場承銷價格訂定方式，參考採樣同業之本益比區間，同時參考該公司最近一個月之興櫃市場平均成交價，作為該公司辦理股票承銷之參考價格訂定依據，基於流動性考量，並衡酌該公司之財務結構、公司規模、市場地位、經營績效、發行市場環境及該公司所處產業未來發展前景等因素，與該公司共同議定承銷價格為每股新台幣 42 元，另該價格並已符合不低於向券商公會報備詢圈約定書前興櫃有成交之 10 個營業日(104 年 2 月 26 日~104 年 3 月 12 日)成交均價簡單算術平均數 54.20 元之七成 37.94 元，故本次承銷價格之訂定應屬合理。

發行公司：精材科技股份有限公司



負 責 人：關 欣



(本用印僅限於精材科技股份有限公司股票初次上櫃承銷價格計算書使用)

中 華 民 國 一 ○ 四 年 三 月 二 十 三 日

證券承銷商： 凱基證券股份有限公司



負 責 人： 許 道 義



(本用印僅限於精材科技股份有限公司股票初次上櫃承銷價格計算書使用)

中 華 民 國 一 ○ 四 年 三 月 二 十 三 日

證券承銷商： 華南永昌綜合證券股份有限公司



負 責 人： 陳 錦 峰



(本用印僅限於精材科技股份有限公司股票初次上櫃承銷價格計算書使用)

中 華 民 國 一 ○ 四 年 三 月 二 十 三 日

證券承銷商： 元富證券股份有限公司



負 責 人： 陳 俊 宏



(本用印僅限於精材科技股份有限公司股票初次上櫃承銷價格計算書使用)

中 華 民 國 一 ○ 四 年 三 月 二 十 三 日

證券承銷商： 第一金證券股份有限公司



負 責 人： 林 漢 奇



(本用印僅限於精材科技股份有限公司股票初次上櫃承銷價格計算書使用)

中 華 民 國 一 ○ 四 年 三 月 二 十 三 日

證券承銷商：國泰綜合證券股份有限公司



負 責 人：莊順裕



(本用印僅限於精材科技股份有限公司股票初次上櫃承銷價格計算書使用)

中 華 民 國 一 ○ 四 年 三 月 二 十 三 日

精材科技股份有限公司



董事長暨總經理：關欣

